목 차

사 업 보 고 서 1
【 대표이사 등의 확인 】 2
I. 회사의 개요.....3
1. 회사의 개요.....3
2. 회사의 연혁.....10
3. 자본금 변동사항.....16
4. 주식의 총수 등.....17
5. 정관에 관한 사항.....22
II. 사업의 내용 23
1. 사업의 개요.....23
2. 주요 제품 및 서비스.....25
3. 원재료 및 생산설비 26
4. 매출 및 수주상황.....32
5. 위험관리 및 파생거래.....37
6. 주요계약 및 연구개발활동.....44
7. 기타 참고사항 50
III. 재무에 관한 사항 69
1. 요약재무정보 69
2. 연결재무제표 72
3. 연결재무제표 주석 79
4. 재무제표 195
5. 재무제표 주석 201
6. 배당에 관한 사항.....302
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항.....304
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 304
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 307
8. 기타 재무에 관한 사항.....308
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견.....331
V. 회계감사인의 감사의견 등 351
1. 외부감사에 관한 사항.....351
2. 내부통제에 관한 사항.....356
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 357
1. 이사회에 관한 사항 357
2. 감사제도에 관한 사항.....376
3. 주주총회 등에 관한 사항 383
VII. 주주에 관한 사항.....389
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항.....399
1. 임원 및 직원 등의 현황 399
2. 임원의 보수 등.....452
IX. 계열회사 등에 관한 사항.....470
X. 대주주 등과의 거래내용.....494
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 498
1. 공시내용 진행 및 변경사항.....498
2. 우발부채 등에 관한 사항 498
3. 제재 등과 관련된 사항.....501

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항.....513
XII. 상세표.....518
1. 연결대상 종속회사 현황(상세).....518
2. 계열회사 현황(상세).....530
3. 타법인출자 현황(상세).....547
4. 연구개발실적(상세).....551
【 전문가의 확인 】.....575
1. 전문가의 확인.....575
2. 전문가와의 이해관계.....575

사 업 보 고 서

(제 54 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중

2023년 3월 7일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼성전자주식회사
대 표 이 사 : 한 종 희
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)
(전 화) 031-200-1114
(홈페이지) https://www.samsung.com/sec
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경팀장 (성 명) 김 동 욱
(전 화) 031-277-7218

【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당임원으로서
2022년 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여
직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의
누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된
기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이
기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조의 규정에
따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2023. 3. 7

삼성전자 주식회사

대표이사: 한 종 희

신고업무 담당임원: 박 학 규

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적·상업적 명칭

당사의 명칭은 삼성전자주식회사이고 영문명은 Samsung Electronics Co., Ltd. 입니다.

나. 설립일자

당사는 1969년 1월 13일에 삼성전자공업주식회사로 설립되었으며,
1975년 6월 11일 기업공개를 실시하였습니다.
당사는 1984년 2월 28일 정기주주총회 결의에 의거하여 상호를
삼성전자공업주식회사에서 삼성전자주식회사로 변경하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)
전화번호: 031-200-1114
홈페이지: https://www.samsung.com/sec

라. 주요 사업의 내용

당사는 제품의 특성에 따라 DX(Device eXperience), DS(Device Solutions) 2개의 부문과 패널 사업을 영위하는 SDC(삼성디스플레이㈜ 및 그 종속기업), 전장부품사업 등을 영위하는 Harman(Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업)으로 나누어 경영을 하고 있습니다.

당사는 본사를 거점으로 한국과 DX 부문 산하 해외 9개 지역총괄, DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산・판매법인 및 SDC, Harman 산하 종속기업 등 232개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

각 부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

부문	주 요 제 품
DX 부문	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등
DS 부문	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등
SDC	스마트폰용 OLED 패널 등
Harman	디지털 콕핏(Digital Cockpit), 텔레매틱스(Telematics), 스피커 등

※ 당사는 2021년 12월 조직개편을 통해 CE 부문과 IM 부문을 DX 부문으로 통합하였으며, 내부 조직체계에 맞추어 SDC를 DS 부문과 별도로 구분하였습니다.

[DX 부문]

DX 부문은 TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 및 휴대폰, 태블릿, 웨어러블(Wearable) 제품 등을 생산・판매하는 사업을 영위하고 있습니다. Neo QLED TV 등 프리미엄 기술력을 바탕으로 한 프리미엄 TV, 경험을 중시하는 소비자들의 라이프스타일(Lifestyle)에 맞춰 출시한 Lifestyle TV, 그리고 소비자들의 다양한 Needs에 맞춘 비스포크(BESPOKE) 제품 등 차별화된 제품, 기술 및 디자인으로 글로벌 디지털 시장을 이끌고 있으며 특히 TV는 2022년까지 17년 연속으로 세계 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 또한 핵심제품인 스마트폰은 '갤럭시(GALAXY)' 브랜드를 통해 프리미엄부터 보급형까지 폭넓은 제품 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 당사는 앞으로도 프리미엄 TV와 Lifestyle TV 시장에서의 혁신 노력을 계속하고, 비스포크(BESPOKE) 제품의 글로벌 판매를 본격 강화하는 한편, Galaxy Ecosystem을 통해 고객들이 모바일 뿐 아니라 TV와 가전까지 편리하게 활용할 수 있는 최고의 Multi Device Experience를 제공해 나가겠습니다. 또한 소비자의 Needs와 Trend를 반영한 신제품을 지속적으로 출시하여 글로벌 브랜드로서의 위상 및 시장 지배력을 계속 강화해 나가고 단말, 칩셋으로 이어지는 End-to-End 솔루션과 5G 초기시장에서의 상용화 경험을 바탕으로 글로벌 5G 시장을 리드하겠습니다.

[DS 부문]

DS 부문은 DRAM, NAND Flash 등 제품을 생산・판매하는 메모리 반도체 사업과 모바일 AP, 카메라 센서칩 등을 설계・판매하는 System LSI 사업, 반도체 제조 위탁 생산을 하는 Foundry 사업 등으로 구성되어 있습니다.

메모리 반도체 사업은 DRAM, NAND Flash 제품 등에 선단 공정 기술을 적용하고, 고부가 솔루션 중심의 사업 포트폴리오 운영을 통해 제품을 차별화하고 원가 경쟁력을 제고하는 등 질적 성장에 주력하여 전 세계 메모리 시장에서 선두 자리를 지속적으로 유지하고 있습니다.

System LSI 사업은 모바일용 반도체 사업에서 차량용 반도체 사업으로 확장을 추진 중이며, 선행 공정 개발을 통한 AP, CIS 등 제품의 차별화 및 파운드리 공급처를 다변화하여 시장 수요에 대응하는 등 시장 지배력을 확대하고 있습니다.

Foundry 사업은 선단 공정에서 요소 기술과 신구조 도입을 통해 기술 경쟁력을 확보하고, 글로벌 반도체 공급 부족 상황에서도 안정적인 공급역량을 확보하는 한편, 레거시 공정에 대한 지속적인 수요 강세에도 적극적으로 대응하여 사업을 확장하고 있습니다.

[SDC]

SDC의 중소형 패널 사업은 차별화된 기술을 바탕으로 OLED 패널의 점유율을 확대하는 한편 폴더블・롤러블・전장 등 신규 응용처의 제품 출시를 통해 시장 영역을 넓혀 나가고 있습니다. 또한, 대형 패널 사업은 고화질, 초대형, 퀀텀닷(Quantum Dot) 등 프리미엄 제품 중심으로 사업을 특화하고, 기술 및 생산성 향상을 지속 추진하여 사업 경쟁력을 제고하고 있습니다.

[Harman]

Harman은 커넥티드카 제품 및 솔루션 등을 디자인하고 개발하는 전장부품 사업과 소비자 오디오 제품 및 프로페셔널 오디오 솔루션을 제공하는 라이프스타일 오디오 사업으로 구성되어 있습니다. Harman은 전장부품 시장의 선도업체로서 완성차 업체들에게 혁신 기술을 적용한 제품을 공급하는 한편, 오디오 시장에서도 기술혁신을 통해 일반 소비자들과 음악 애호가 사이에서 명성을 쌓아왔습니다. Harman은 시장 인지도가 높은 브랜드와 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 자체 개발 및 전략적 인수 등을 통해 각 사업 분야에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.

☞ 사업부문별 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

마. 연결대상 종속회사 현황(요약)

기업회계기준서(K-IFRS) 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사(최상위)인 당사의 연결대상 종속기업은 2022년말 현재 232개사입니다. 전년말 대비 8개 기업이 증가하고 4개 기업이 감소하였습니다.

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수				주요 종속회사수
	기초	증가	감소	기말	
상장	-	-	-	-	-
비상장	228	8	4	232	141
합계	228	8	4	232	141

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(당기 연결대상회사의 변동내용)

구 분	자회사	사 유
신규 연결	Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	설립
	Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	설립
	Apostera GmbH	지분취득
	Apostera UA, LLC	지분취득
	DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	설립
	Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	지분취득
	SVIC 57호 신기술투자조합	설립
	㈜희망별숲	설립
연결 제외	Dacor Canada Co.	청산
	AMX UK Limited	청산
	Harman International s.r.o	청산
	Apostera GmbH	합병

바. 중소기업 해당 여부

당사는「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

중소기업 해당 여부	미해당
벤처기업 해당 여부	미해당
중견기업 해당 여부	미해당

사. 신용평가에 관한 사항

당사는 Moody's(미국) 및 S&P(미국)로부터 신용등급 평가를 받고 있습니다.
2022년말 현재 Moody's의 당사 평가등급은 Aa2, 전망치는 안정적(Stable)이고, S&P의 당사 평가등급은 AA-, 전망치는 안정적(Stable)입니다.

평가대상 유가증권	평가일	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사	비고
회사채 US$ Bond ('97년 발행, '27년 만기)	2020.07	AA-	S&P	정기평가
	2020.09	Aa3	Moody's	정기평가
	2021.07	AA-	S&P	정기평가
	2021.08	Aa3	Moody's	정기평가
	2022.08	AA-	S&P	정기평가
	2022.09	Aa2	Moody's	정기평가

※ 신용평가등급 범위: Moody's (Aaa~C), S&P (AAA~D)

구 분	Moody's		S&P	
	등 급	정 의	등 급	정 의
투자적격 등급	Aaa	채무상환능력 최상, 신용위험 최소	AAA	채무상환능력이 극히 높음, 최고등급
	Aa1/Aa2/Aa3	채무상환능력 높음, 신용위험 매우 낮음	AA+/AA/AA-	채무상환능력이 매우 높음
	A1/A2/A3	채무상환능력 중상, 신용위험 낮음	A+/A/A-	채무상환능력은 충분하나 경제 상황 악화 및 변화에 다소 취약함
	Baa1/Baa2/ Baa3	채무상환능력 중간, 신용위험 크지 않으나 투기적 요소가 있음	BBB+/BBB/ BBB-	채무상환능력은 충분하나 상위 등급에 비해 경제 상황 악화에 좀 더 취약함
투기 등급	Ba1/Ba2/Ba3	투기적 성향, 신용위험 상당함	BB+/BB/BB-	가까운 장래에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 낮으나 경영, 재무, 경제 상황 악화에 대한 불확실성이 큼
	B1/B2/B3	투기적 성향, 신용위험 높음	B+/B/B-	경영, 재무, 경제 상황 악화에 좀 더 취약하나 현재로서는 채무상환능력이 있음
	Caa	투기적 성향 높음, 신용위험 매우 높음	CCC	현재 채무불이행 가능성이 있으며 채무상환은 경영, 재무, 경제 상황이 호의적일 경우에만 가능함
	Ca	투기적 성향 매우 높음, 가까운 시일 내 부도발생 가능, 원리금 상환가능성 존재	CC	채무불이행 가능성이 높음, 부도 상태는 아니지만 사실상 부도가 예상됨
	C	부도 상태, 원리금 상환가능성 낮음	C	현재 채무불이행 가능성이 매우 높으며 최종 회수율은 상위등급 채무보다 낮게 추정됨
			D	금융채무불이행 상태 혹은 묵시적 계약 (imputed promises) 파기, 또는 파산 신청 혹은 이와 유사한 상태

☞ 당사의 종속기업이 발행한 회사채 및 기업어음 등에 대한 신용등급 평가결과는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

아. 주권상장(또는 등록・지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

당사는 1975년 6월 11일 유가증권시장에 기업공개를 실시하였습니다.

주권상장 (또는 등록・지정)여부	주권상장 (또는 등록・지정)일자	특례상장 등 여부	특례상장 등 적용법규
유가증권시장	1975년 06월 11일	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

1969.01.13	삼성전자공업주식회사로 설립
1975.06.11	기업공개
1984.02.28	삼성전자주식회사로 상호 변경
1988.11.01	삼성반도체통신주식회사 흡수 합병
2012.04.01	LCD사업부 분사(삼성디스플레이㈜ 설립)
2017.03.05	'QLED TV' 진화된 퀀텀닷 기술 적용 TV 출시
2017.03.10	전장 기업 Harman International Industries, Inc. 지분(100%) 인수
2017.07.04	세계 최대 규모 평택 반도체 라인 가동
2017.11.01	프린팅솔루션 사업 매각
2018.08.30	'QLED 8K TV' 퀀텀닷 기술과 8K 해상도 적용 TV 출시
2019.04.03	'갤럭시 S10 5G' 5G 스마트폰 출시
2019.06.04	소비자 라이프스타일 맞춤형 냉장고 '비스포크(BESPOKE)' 출시
2019.09.04	'엑시노스 980' 5G 모바일 프로세서 공개
2019.09.06	'갤럭시 폴드' 새로운 폼팩터 폴더블폰 공개
2020.01.29	'그랑데 AI' 인공지능 기반 세탁기・건조기 출시
2020.02.04	AI・차세대 슈퍼컴퓨터용 초고속 DRAM 출시
2020.02.11	'갤럭시 Z 플립' 폴더블폰 공개
2020.08.30	세계 최대 규모 평택 반도체 2라인 가동
2021.01.07	'Neo QLED TV' 공개
2021.05.11	'비스포크 홈' 글로벌 시장 확대 선언
2021.06.03	전세계 반도체 업체 최초 전 사업장 '탄소/물/폐기물 저감' 인증
2021.08.11	'갤럭시 Z 폴드3', '갤럭시 Z 플립3' 공개
2021.10.12	업계 최선단 14나노 EUV DDR5 D램 양산
2021.11.09	업계 최초 LPDDR5X D램 개발
2021.11.24	미국 테일러市에 신규 파운드리 라인 투자 발표
2022.02.10	'갤럭시 S22' 시리즈 공개
2022.02.17	비스포크 인피니트 라인 공개
2022.06.30	세계 최초 3나노 GAA 파운드리 양산
2022.08.10	'갤럭시 Z 폴드4', '갤럭시 Z 플립4' 공개
2022.08.19	차세대 반도체 R&D단지 기공식
2022.09.15	'신환경경영전략' 선언
2022.11.07	1Tb 8세대 V낸드 양산
2022.12.21	업계 최선단 12나노급 16Gb DDR5 D램 개발

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본점소재지는 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)입니다.
최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경 사항은 없습니다.

다. 경영진의 중요한 변동

2022년말 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(한종희, 경계현, 노태문, 박학규,이정배)과 사외이사 6인(김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희) 등 총 11인의 이사로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임		임기만료 또는 해임
		신규	재선임	
2018.03.23	정기주총	사내이사 이상훈 사내이사 김기남 사내이사 김현석 사내이사 고동진 사외이사 김종훈 사외이사 김선욱 사외이사 박병국	-	사내이사 권오현 사내이사 윤부근(사임) 사내이사 신종균(사임) 사외이사 김한중 사외이사 이병기
2018.03.23	-	대표이사 김기남 대표이사 김현석 대표이사 고동진	-	-
2019.03.20	정기주총	사외이사 김한조 사외이사 안규리	사외이사 박재완	사외이사 이인호 사외이사 송광수
2019.10.26	-	-	-	사내이사 이재용
2020.02.14	-	-	-	사내이사 이상훈(사임)
2020.03.18	정기주총	사내이사 한종희 사내이사 최윤호	-	-
2021.03.17	정기주총	-	사내이사 김기남 사내이사 김현석 사내이사 고동진 사외이사 박병국 사외이사 김종훈 사외이사 김선욱	-
2021.03.17	-	-	대표이사 김기남 대표이사 김현석 대표이사 고동진	-
2021.12.31	-	-	-	사내이사 최윤호(사임)
2022.02.15	-	대표이사 한종희	-	대표이사 김기남(사임) 대표이사 김현석(사임) 대표이사 고동진(사임)

2022.03.16	정기주총	사내이사 경계현 사내이사 노태문 사내이사 박학규 사내이사 이정배 사외이사 한화진 사외이사 김준성	사외이사 김한조	-
2022.03.16	-	-	-	사내이사 김기남(사임) 사내이사 김현석(사임) 사내이사 고동진(사임)
2022.03.16	-	대표이사 경계현	-	-
2022.03.19	-	-	-	사외이사 박재완 사외이사 안규리
2022.04.20	-	-	-	사외이사 한화진(사임)
2022.05.17	-	-	-	사외이사 박병국(퇴임)
2022.11.03	임시주총	사외이사 허은녕 사외이사 유명희	-	-

※ 2018년 3월 23일 이사회에서 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다.

※ 2021년 3월 17일 이사회에서 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

※ 2021년 12월 31일 최윤호 사내이사가 사임하였습니다.

※ 2022년 2월 15일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 대표이사직에서 사임하였으며,
동일 개최한 이사회에서 한종희 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

※ 2022년 3월 16일 주주총회를 통해 경계현, 노태문, 박학규, 이정배 사내이사와
한화진, 김준성 사외이사가 신규 선임되었고, 김한조 사외이사가 재선임되었습니다.

※ 2022년 3월 16일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 사임하였습니다.

※ 2022년 3월 16일 이사회를 통해 경계현 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

※ 2022년 3월 19일 박재완, 안규리 사외이사의 임기가 만료되었습니다.

※ 2022년 4월 20일 한화진 사외이사가 사임하였습니다.

※ 2022년 5월 17일 박병국 사외이사가 퇴임하였습니다.

※ 2022년 11월 3일 주주총회를 통해 허은녕, 유명희 사외이사가 신규 선임되었습니다.

라. 최대주주의 변동

2021년 4월 29일에 기존 최대주주가 소유하던 당사 주식의 상속으로 인해 최대주주가 삼성생명보험㈜으로 변동되었습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고
2021.04.29	삼성생명보험㈜	1,263,050,053	21.16%	변동전 최대주주의 피상속	-

※ 소유주식수 및 지분율은 최대주주 및 그 특수관계인의 합산 내역이며,
의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다.

☞ 최대주주 관련 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

마. 상호의 변경

2018년 중에는 종속기업 Harman Connected Services Finland OY의 사명이 Harman Finland Oy로, Harman Professional Singapore Pte. Ltd의 사명이 Harman Singapore Pte. Ltd.로 변경되었습니다.

2019년 중에는 종속기업 Samsung Electronics Greece S.A. (SEGR) 사명이 Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)로 변경되었습니다.

2021년 중에는 종속기업 Samsung Electronics Portuguesa S.A. (SEP) 사명이 Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)로 변경되었습니다.

☞ 당사(지배기업) 및 주요 종속기업 기준으로 작성하였습니다.
주요 종속기업에 대한 사항은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참고하시기 바랍니다.

바. 합병 등에 관한 사항

2018년 중 종속기업 Samsung Pay, Inc.는 종속기업 Samsung Electronics America, Inc. (SEA)에 합병되었으며, 종속기업 Harman Connected Services Holding Corp.은 종속기업 Harman Connected Services, Inc.에 합병되었습니다. 또한 종속기업 Samsung Electronics America, Inc. (SEA)는 종속기업 NexusDX, Inc. 지분(100%)을 매각하였습니다.

2019년 중 종속기업 Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)은 Corephotonics Ltd. 지분을 인수하였으며, 당사는 관계기업인 삼성전기㈜의 PLP(Panel Level Package) 사업을 양수하였습니다. 또한, 종속기업 Duran Audio B.V.가 종속기업 HarmanBecker Automotive Systems Manufacturing Kft에 합병되었으며, 종속기업 Samsung Electronics (Beijing) Service Company Limited (SBSC)가 종속기업 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)에 합병되었습니다.

2021년 중 종속기업 Viv Labs, Inc.는 종속기업 Samsung Research America, Inc (SRA)에 합병되었습니다. 또한, 종속기업 Prismview, LLC는 종속기업 Samsung Electronics America, Inc. (SEA)에 합병되었습니다.

☞ 당사(지배기업) 및 주요 종속기업 기준으로 작성하였습니다.
주요 종속기업에 대한 사항은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참고하시기 바랍니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다.

아. 그 밖에 경영 활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

당사는 2021년 12월 중 기존의 CE 부문과 IM 부문을 DX 부문으로 통합하였으며, 무선사업부의 명칭을 MX(Mobile eXperience)사업부로 변경하였습니다. 또한 내부 조직체계에 맞추어 SDC를 DS 부문과 별도로 구분하였습니다.

[2021년 12월]

	변경전	변경후
사업 조직	CE 부문 (영상디스플레이, 생활가전, 의료기기)	DX 부문 (영상디스플레이, 생활가전, 의료기기, Mobile eXperience, 네트워크)
	IM 부문 (무선, 네트워크)	
	DS 부문 (메모리, System LSI, Foundry, DP)	DS 부문 (메모리, System LSI, Foundry)
		SDC (DP)
	Harman 부문	Harman
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)

3. 자본금 변동사항

당사는 최근 5사업연도 중 자본금 변동 사항은 없습니다.
한편, 발행주식의 액면총액은 679,267백만원(보통주 596,978백만원, 우선주 82,289백만원)으로, 납입자본금 897,514백만원과는 이익소각으로 인하여 상이합니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제54기말
보통주	발행주식총수	5,969,782,550
	액면금액	100
	자본금	596,978,255,000
우선주	발행주식총수	822,886,700
	액면금액	100
	자본금	82,288,670,000
합계	자본금	679,266,925,000

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

2022년말 현재 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하 "보통주") 및 무의결권 기명식 우선주식(이하 "우선주")의 수는 각각 7,780,466,850주와 1,194,671,350주입니다. 당사는 2022년말 현재까지 보통주 1,810,684,300주와 우선주 371,784,650주를 이사회 결의에 의거 이익으로 소각한 바 있습니다. 2022년말 현재 유통주식수는 보통주 5,969,782,550주, 우선주 822,886,700주입니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 주)

구 분		주식의 종류			비고
		보통주	우선주	합계	
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		20,000,000,000	5,000,000,000	25,000,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		7,780,466,850	1,194,671,350	8,975,138,200	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		1,810,684,300	371,784,650	2,182,468,950	-
	1. 감자	-	-	-	-
	2. 이익소각	1,810,684,300	371,784,650	2,182,468,950	자사주소각
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		5,969,782,550	822,886,700	6,792,669,250	-
Ⅴ. 자기주식수		-	-	-	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		5,969,782,550	822,886,700	6,792,669,250	-

※ 주식의 총수 현황은 주식분할로 인한 주식수의 변동을 반영한 수치입니다.
당사는 2018년 5월 3일을 효력 발생일로 하여 보통주 및 우선주(각 1주당 액면가 5,000원)를 각 50주(각 1주당 액면가 100원)로 분할하였습니다.

나. 자기주식

당사는 자기주식을 주주환원의 목적으로 2018년 중 모두 소각하였으며
공시 대상기간 중 자기주식의 취득 및 처분거래는 없습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
					취득(+)	처분(-)	소각(-)		
배당가능 이익 범위이내 취득	직접 취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		장외 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(A)	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
	신탁 계약에 의한 취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(B)	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
기타 취득(C)			보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
총 계(A+B+C)			보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식

당사는 보통주 외 비누적적 우선주가 있습니다. 이 우선주는 보통주의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%의 금전배당을 더 받을 수 있도록 하고 있습니다.
2022년말 현재 우선주의 발행주식수는 822,886,700주입니다.

[우선주 발행 현황]

구 분			내 용	
발행일자			1989년 08월 25일(최초 발행일)	
주당 액면가액			100원	
발행총액(액면가기준) / 현재까지 발행한 주식수			119,467백만원	1,194,671,350주
현재 잔액 / 현재 주식수			82,289백만원	822,886,700주
주식의 내용	이익배당에 관한 사항		액면금액 기준 보통주보다 1%의 금전배당을 추가로 받음	
	잔여재산분배에 관한 사항		-	
	상환에 관한 사항	상환조건	-	
		상환방법	-	
		상환기간	-	
		주당 상환가액	-	
		1년 이내 상환 예정인 경우	-	
	전환에 관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-	
		전환청구기간	-	
		전환으로 발행할 주식의 종류	-	
		전환으로 발행할 주식수	-	
	의결권에 관한 사항		의결권 없음	
기타 투자 판단에 참고할 사항 (주주간 약정 및 재무약정 사항 등)			-	

※ 이익소각으로 인해 발행주식의 액면 총액은 82,289백만원으로 납입자본금(119,467백만원)과 상이합니다.
상기 발행주식수, 현재주식수 등은 2018년 주식분할로 인한 주식수의 변동을 반영한 수치입니다.

[우선주 발행일자별 내역] (단위 : 주, 원)

일 자	변 동	증가(감소)한 주식의 내용					
		종류	수량(주)	주 당 액면가액	액면가액 합계	주 당 발행가액	발행가액 합계
1989.08.25	유상증자	우선주	3,400,000	5,000	17,000,000,000	28,800	97,920,000,000
1989.08.25	무상증자	우선주	340,000	5,000	1,700,000,000	5,000	1,700,000,000
1990.10.29	전환권 행사	우선주	371,620	5,000	1,858,100,000	29,600	10,999,952,000
1991.03.19	전환권 행사	우선주	40,898	5,000	204,490,000	29,341	1,199,988,218
1991.03.30	전환권 행사	우선주	5,112	5,000	25,560,000	29,341	149,991,192
1991.04.08	전환권 행사	우선주	1,704	5,000	8,520,000	29,341	49,997,064
1991.05.17	DR 발행	우선주	1,907,671	5,000	9,538,355,000	37,973	72,439,990,883
1991.07.24	전환권 행사	우선주	34,081	5,000	170,405,000	29,341	999,970,621
1991.07.30	전환권 행사	우선주	20,449	5,000	102,245,000	29,341	599,994,109
1991.07.31	전환권 행사	우선주	64,754	5,000	323,770,000	29,341	1,899,947,114
1991.08.30	전환권 행사	우선주	214,716	5,000	1,073,580,000	29,341	6,299,982,156
1991.09.30	전환권 행사	우선주	20,448	5,000	102,240,000	29,341	599,964,768
1993.06.17	DR 발행	우선주	2,542,372	5,000	12,711,860,000	47,312	120,284,704,064
1993.10.29	전환권 행사	우선주	105,999	5,000	529,995,000	28,302	2,999,983,698
1993.11.12	DR 발행	우선주	2,158,273	5,000	10,791,365,000	55,975	120,809,331,175
1993.11.29	전환권 행사	우선주	58,295	5,000	291,475,000	28,302	1,649,865,090
1993.11.30	전환권 행사	우선주	19,079	5,000	95,395,000	28,302	539,973,858
1994.04.06	DR 발행	우선주	1,086,956	5,000	5,434,780,000	74,502	80,980,395,912
1994.06.03	전환권 행사	우선주	16,027	5,000	80,135,000	25,809	413,640,843
1994.06.06	전환권 행사	우선주	9,072	5,000	45,360,000	25,809	234,139,248
1994.06.13	전환권 행사	우선주	17,236	5,000	86,180,000	25,809	444,843,924
1994.06.22	전환권 행사	우선주	1,209	5,000	6,045,000	25,809	31,203,081
1994.06.27	전환권 행사	우선주	16,632	5,000	83,160,000	25,809	429,255,288
1994.06.28	전환권 행사	우선주	54,131	5,000	270,655,000	25,809	1,397,066,979
1994.06.29	전환권 행사	우선주	292,127	5,000	1,460,635,000	25,809	7,539,505,743
1994.06.30	전환권 행사	우선주	52,922	5,000	264,610,000	25,809	1,365,863,898
1994.07.01	전환권 행사	우선주	232,854	5,000	1,164,270,000	25,809	6,009,728,886
1994.07.04	전환권 행사	우선주	116,426	5,000	582,130,000	25,809	3,004,838,634
1994.07.05	전환권 행사	우선주	188,401	5,000	942,005,000	25,809	4,862,441,409
1994.07.06	전환권 행사	우선주	686,164	5,000	3,430,820,000	25,809	17,709,206,676
1994.07.07	전환권 행사	우선주	270,349	5,000	1,351,745,000	25,809	6,977,437,341
1994.07.08	전환권 행사	우선주	977,068	5,000	4,885,340,000	25,809	25,217,148,012
1994.07.12	전환권 행사	우선주	6,048	5,000	30,240,000	25,809	156,092,832
1994.07.19	전환권 행사	우선주	68,040	5,000	340,200,000	25,809	1,756,044,360
1994.07.20	전환권 행사	우선주	4,232	5,000	21,160,000	25,809	109,223,688
1994.08.12	전환권 행사	우선주	944	5,000	4,720,000	25,502	24,073,888
1995.03.13	무상증자	우선주	3,028,525	5,000	15,142,625,000	5,000	15,142,625,000
1996.03.13	무상증자	우선주	5,462,593	5,000	27,312,965,000	5,000	27,312,965,000
2003.04.14	이익소각	우선주	△470,000	5,000	△2,350,000,000	-	-
2004.01.15	이익소각	우선주	△330,000	5,000	△1,650,000,000	-	-
2004.05.04	이익소각	우선주	△260,000	5,000	△1,300,000,000	-	-
2016.01.15	이익소각	우선주	△1,240,000	5,000	△6,200,000,000	-	-

2016.04.20	이익소각	우선주	△530,000	5,000	△2,650,000,000	-	-
2016.07.19	이익소각	우선주	△320,000	5,000	△1,600,000,000	-	-
2016.09.28	이익소각	우선주	△230,000	5,000	△1,150,000,000	-	-
2017.04.12	이익소각	우선주	△255,000	5,000	△1,275,000,000	-	-
2017.05.02	이익소각	우선주	△1,614,847	5,000	△8,074,235,000	-	-
2017.07.24	이익소각	우선주	△225,000	5,000	△1,125,000,000	-	-
2017.10.25	이익소각	우선주	△168,000	5,000	△840,000,000	-	-
2018.01.30	이익소각	우선주	△178,000	5,000	△890,000,000	-	-
2018.05.03	주식분할	우선주	885,556,420	100	-	-	-
2018.12.04	이익소각	우선주	△80,742,300	100	△8,074,230,000	-	-
우선주 계			822,886,700		82,288,670,000		642,261,376,652

[△는 부(-)의 값임]

5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2018년 3월 23일이며, 최근 3사업연도 및 작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변경된 정관 이력은 없습니다. 또한, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제54기 정기주주총회의 안건에는 정관 변경의 건이 포함되어 있지 않습니다.

☞ 제54기 정기주주총회 안건에 대한 사항은 당사가 2023년 2월 14일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시한 '주주총회소집공고' 등을 참고하시기 바랍니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 본사를 거점으로 한국과 DX 부문 산하 해외 9개 지역총괄 및 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산·판매법인, SDC 및 Harman 산하 종속기업 등 232개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

사업별로 보면, Set 사업은 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP(스마트폰 등), 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산·판매하는 DX(Device eXperience) 부문이 있으며, 부품 사업에는 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산·판매하고 있는 DS(Device Solutions) 부문과 중소형 OLED 등의 디스플레이 패널(DP)을 생산·판매하고 있는 SDC가 있습니다. 또한, 2017년에 인수한 Harman에서는 디지털 콕핏(Digital Cockpit), 텔레매틱스(Telematics), 스피커 등을 생산·판매하고 있습니다.

당사는 2021년 12월 조직개편을 통해 기존의 CE 부문과 IM 부문을 DX 부문으로 통합하였으며, 무선사업부의 명칭을 MX(Mobile eXperience)사업부로 변경하였습니다. 또한 내부 조직체계에 맞추어 SDC를 DS 부문과 별도로 구분하였습니다.

☞ 부문별 사업에 관한 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '다. 사업부문별 현황'과 '라. 사업부문별 요약 재무 현황' 항목을 참고하시기 바랍니다.

지역별로 보면, 국내에서는 DX 부문 및 DS 부문 등을 총괄하는 본사와 33개의 종속기업이 사업을 운영하고 있습니다. 본사는 수원, 구미, 광주, 기흥, 화성, 평택사업장 등으로 구성되어 있으며, 국내 종속기업은 디스플레이 패널을 생산하는 삼성디스플레이㈜와 국내 대리점 판매를 전담하는 삼성전자판매㈜, 제품 서비스를 담당하는 삼성전자서비스㈜, 제품 운송을 담당하는 삼성전자로지텍㈜ 등 비상장 종속기업들로 구성되어 있습니다.

해외(미주, 유럽・CIS, 중동・아프리카, 아시아 등지)에서는 생산, 판매, 연구활동 등을 담당하는 199개의 비상장 종속기업이 운영되고 있습니다.

미주에는 TV, HHP 등 Set 제품의 미국 판매를 담당하는 SEA(New Jersey, USA), TV 생산을 담당하는 SII(California, USA), 반도체・DP판매를 담당하는 SSI(California, USA), 반도체 생산을 담당하는 SAS(Texas, USA), Set 제품 복합 생산법인 SEDA(Brazil), 전장부품사업 등을 담당하는 Harman(Connecticut, USA) 등을 포함하여 총 45개의 판매・생산 등을 담당하는 법인이 있습니다.

유럽・CIS에는 SEUK(UK), SEG(Germany), SEF(France), SEI(Italy), SERC(Russia) 등 Set 제품 판매법인과 SEH(Hungary), SERK(Russia) 등 TV 생산법인, 가전제품 생산법인 SEPM(Poland) 등을 포함하여 총 72개의 법인이 운영되고 있습니다.

중동・아프리카에는 SGE(UAE), SSA(South Africa) 등 Set 제품 판매법인과 SEEG(Egypt), SSAP(South Africa) 등 TV 생산법인을 포함한 총 20개 법인이 운영되고 있습니다.

아시아(중국 제외)에는 SESP(Singapore), SEAU(Australia), SEPCO(Philippines), SME(Malaysia) 등 판매법인과, HHP 등 생산법인 SEV・SEVT(Vietnam), TV 등 생산법인 SEHC(Vietnam), DP 생산법인 SDV(Vietnam), 복합 생산법인 SIEL(India) 등을 포함한 총 32개의 법인이 운영되고 있습니다.

중국에는 SCIC(Beijing), SEHK(Hong Kong) 등 Set 제품 판매법인과 SSS(Shanghai), SSCX(Xian) 등 반도체・DP 판매법인, SSEC(Suzhou) 등 Set 제품 생산법인, SCS(Xian) 등 반도체 생산법인을 포함하여 총 30개의 법인이 운영되고 있습니다.

2022년 당사의 매출은 302조 2,314억원으로 전년 동기 대비 8.1% 증가하였으며, 주요 매출처로는 Apple, Best Buy, Deutsche Telekom, Qualcomm, Verizon 등(알파벳순)이 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 매출

당사는 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP 등 완제품과 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등 반도체 부품 및 디스플레이 패널 등을 생산・판매하고 있습니다. 아울러 Harman을 통해 디지털 콕핏, 텔레매틱스 등을 생산・판매하고 있습니다.

2022년(제54기) 매출은 DX 부문이 182조 4,897억원(60.4%), DS 부문이 98조 4,553억원(32.6%)이며, SDC가 34조 3,826억원(11.4%), Harman은 13조 2,137억원(4.4%)입니다.

(단위 : 억원, %)

부 문	주요 제품	매출액	비중
DX 부문	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등	1,824,897	60.4%
DS 부문	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	984,553	32.6%
SDC	스마트폰용 OLED패널 등	343,826	11.4%
Harman	디지털 콕핏, 텔레매틱스, 스피커 등	132,137	4.4%
기타	부문간 내부거래 제거 등	△263,099	△8.8%
총 계		3,022,314	100.0%

※ 각 부문별 매출액은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 세부 제품별 매출은 '4. 매출 및 수주상황' 항목을 참고하시기 바랍니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황

2022년 TV의 평균 판매가격은 전년 대비 약 7% 하락하였으며, HHP는 전년 대비 약 5% 상승하였습니다. 그리고 메모리 평균 판매가격은 전년 대비 약 17% 하락하였으며, 디스플레이 패널(스마트폰용 OLED 패널)은 약 20% 상승하였습니다. 또한 디지털 콕핏의 평균 판매가격은 전년 대비 약 0.5% 하락하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 현황

당사의 주요 원재료로 DX 부문은 모바일AP, Camera Module 등을 Qualcomm, 삼성전기㈜ 등에서 공급받고 있으며, TV・모니터용 디스플레이 패널 등을 CSOT 등으로부터 공급받고 있습니다. DS 부문은 Chemical, Wafer 등을 솔브레인㈜, SK실트론㈜ 등으로부터, SDC는 FPCA, Window 등을 ㈜비에이치, Apple 등으로부터 공급받고 있습니다. Harman은 SOC(System-On-Chip), 자동차용 메모리 등을 NVIDIA, Arrow 등에서 공급받고 있습니다.

(단위 : 억원, %)

부 문	매입유형	품 목	구체적 용도	매입액	비중	주요 매입처
DX 부문	원재료	모바일AP	CPU	93,138	12.8%	Qualcomm, MediaTek 등
	원재료	Camera Module	HHP 카메라	61,180	8.4%	삼성전기㈜. 캠시스 등
	원재료	디스플레이 패널	TV·모니터용 화상신호기	60,224	8.3%	CSOT, AUO, BOE 등
	원재료	기타	-	513,278	70.5%	
	소 계			727,820	100.0%	
DS 부문	원재료	Chemical	원판 가공	28,708	14.7%	솔브레인㈜, 동우화인켐㈜ 등
	원재료	Wafer	반도체 원판	28,157	14.4%	SK실트론㈜, SUMCO 등
	원재료	기타	-	138,263	70.9%	
	소 계			195,128	100.0%	
SDC	원재료	FPCA	구동회로	29,795	23.6%	㈜비에이치, 영풍전자 등
	원재료	Window	강화유리	19,367	15.3%	Apple, Biel 등
	원재료	기타	-	77,155	61.1%	
	소 계			126,317	100.0%	
Harman	원재료	SOC(System-On-Chip)	자동차용 제품	8,625	10.7%	NVIDIA, Intel 등
	원재료	기타	-	72,038	89.3%	
	소 계			80,663	100.0%	
기타	원재료	-	-	589	-	
총 계				1,130,517	-	

※ 매입액은 부문 등 간의 내부거래를 포함하고 있지 않습니다.

※ 비중은 각 부문의 원재료 총매입액 대비 각 품목의 매입액 비중입니다.

※ 주요 매입처 중 삼성전기㈜는 계열회사입니다.

나. 주요 원재료 가격 변동 추이

DX 부문의 주요 원재료인 모바일AP 가격은 전년 대비 약 77% 상승하였고, CameraModule 가격은 전년 대비 약 13% 상승하였으며, TV・모니터용 디스플레이 패널 가격은 약 51% 하락하였습니다. DS 부문의 주요 원재료 중 반도체 Wafer 가격은 전년도와 유사한 수준이었으며, SDC의 FPCA 가격은 약 37% 상승, 강화유리용 Window 가격은 약 10% 상승하였습니다. Harman의 원재료 중 SOC 가격은 전년 대비 약 3% 하락하였으며, 자동차용 메모리는 약 10% 상승하였습니다.

다. 생산능력, 생산실적, 가동률

(생산능력)

(단위 : 천대, 천개)

부 문	품 목	제54기	제53기	제52기
DX 부문	영상기기	55,747	54,235	51,538
	HHP	332,170	319,550	321,600
DS 부문	메모리	1,905,731,836	1,756,009,941	1,230,287,321
SDC	DP	2,700	3,604	7,274
Harman	디지털 콕핏	11,257	9,066	9,362

※ 생산능력은 주요 제품의 연결 기준입니다.

DX 부문의 주요 품목별 생산능력은 '평균 라인 수'×'시간당 평균 생산실적'×'일 평균 가동시간'×'표준 가동일수'로 산출하였으며, DS 부문의 메모리 생산능력은 1Gb환산 기준으로 환산 생산실적(패키지OUT 기준)을 가동률로 나눠서 생산능력을 산출하고 있습니다. SDC의 경우 라인별 생산 가능한 제품의 총 면적을 8세대 Glass
(2,200×2,500mm)로 환산하고 있으며, Harman의 디지털콕핏 생산능력은 '각 거래처・제품별 생산셀(조립, 테스트) 수'×'각 생산셀별 시간당 생산능력'×'1일 표준 생산시간'×'표준생산일수'로 산출하였습니다.

(생산실적)

2022년(제54기) DX 부문의 영상기기 생산실적은 41,802천대이며 멕시코, 베트남, 브라질, 헝가리 등 세계 각 지역에서 생산되고 있으며, HHP 생산실적은 229,180천대이며 한국(구미), 베트남, 인도, 브라질 등 지역에서 생산되고 있습니다. DS 부문의 메모리 생산실적은 1,905,732백만개(1Gb 환산 기준)이며 한국(화성, 평택 등), 중국에서 생산하고 있습니다. SDC의 DP 생산실적은 2,008천개이며 한국(천안, 아산) 등에서 생산 중입니다. Harman의 디지털 콕핏 생산실적은 8,334천개입니다.

(단위 : 천대, 천개)

부 문	품 목	제54기	제53기	제52기
DX 부문	영상기기	41,802	44,133	48,244
	HHP	229,180	260,501	249,218
DS 부문	메모리	1,905,731,836	1,756,009,941	1,230,287,321
SDC	DP	2,008	2,849	5,977
Harman	디지털 콕핏	8,334	6,928	6,116

※ 생산실적은 주요 제품의 연결 기준입니다.

(가동률)

당사 DX 부문의 2022년(제54기) 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, 영상기기 75.0%, HHP 69.0%입니다.

(단위 : 천대)

부 문	품 목	제54기		
		생산능력 대수	실제 생산 대수	가동률
DX 부문	영상기기	55,747	41,802	75.0%
	HHP	332,170	229,180	69.0%

DS 부문의 메모리 사업과 SDC의 DP 사업은 24시간 3교대 작업을 실시하고 있으며,2022년(제54기) 누적 가동일은 휴일을 포함하여 총 365일입니다. 가동률은 가동 가능시간 (가동일 ×생산라인 수 ×24시간) 대비 실제 가동 시간으로 산출하였습니다.

(단위 : 시간)

부 문	품 목	제54기		
		가동 가능 시간	실제 가동 시간	가동률
DS 부문	메모리	83,016	83,016	100%
SDC	DP	47,280	47,280	100%

Harman의 2022년 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며 74.0%입니다.

(단위 : 천개)

부문	품 목	제54기		
		생산능력 개수	실제 생산 개수	가동률
Harman	디지털 콕핏	11,257	8,334	74.0%

라. 생산설비 및 투자 현황 등

(생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등)

당사는 수원사업장을 비롯하여 구미, 광주, 화성, 평택, 아산 등 국내사업장 및 북미, 구주(유럽), 중국 등 해외 DX 부문 산하 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 5개 지역총괄,SDC 및 Harman 산하 종속기업 등에서 주요 제품의 생산, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업 활동을 수행하고 있습니다.

[주요 사업장 현황]

지역	사업장	소재지
국내 (DX 부문, DS 부문, SDC 산하 12개 사업장)	수원사업장	경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)
	서초사업장	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)
	우면사업장	서울특별시 서초구 성촌길 33(우면동)
	기흥사업장	경기도 용인시 기흥구 삼성로 1(농서동)
	화성사업장	경기도 화성시 삼성전자로 1(반월동)
	평택사업장	경기도 평택시 고덕면 삼성로 114
	천안사업장	충청남도 천안시 서북구 번영로 465 (성성동)
	온양사업장	충청남도 아산시 배방읍 배방로 158 (북수리)
	아산사업장	충청남도 아산시 탕정면 삼성로 181 (명암리)
	구미1사업장	경상북도 구미시 1공단로 244(공단동)
	구미2사업장	경상북도 구미시 3공단3로 302(임수동)
	광주사업장	광주광역시 광산구 하남산단6번로 107(오선동)
해외 (DX 부문 산하 9개 지역총괄)	북미 총괄	85 Challenger Rd., Ridgefield Park, New Jersey, USA
	구주 총괄	2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK
	중국 총괄	No.31, Jinghui Street, Chaoyang, Beijing, China
	동남아 총괄	30 Pasir Panjang Rd., Mapletree Business City, Singapore
	서남아 총괄	Two Horizon Centre, Golf Course RD, Gurgaon, Haryana, India
	CIS 총괄	31 Novinsky Boulevard, Moscow, Russia
	중동 총괄	Butterfly Building A, Dubai Media City, Dubai, UAE
	아프리카 총괄	2929 William Nicol Drive, Bryanston, Johannesburg, South Africa
	중남미 총괄	Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240 Diamond Tower, Sao Paulo, Brazil
해외 (DS 부문 산하 5개 지역총괄)	미주 총괄	3655 N. 1st St. San Jose, California, USA
	구주 총괄	Koelner Str. 12, Eschborn, Germany
	중국 총괄	3F, No.458, Fute North Rd., Shanghai, China
	동남아 총괄	3 Church Street, #26-01 Samsung Hub, Singapore
	일본 총괄	Shinagawa Grand Central Tower, Konan, Minato, Tokyo, Japan
Harman	미국 HQ	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA

※ Harman의 Automotive 사업은 미국(Novi), 독일(Garching) 등에서, Lifestyle 사업은 미국(Northridge) 등에서 영위하고 있습니다.

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2022년 말 현재 장부금액은 168조 454억원으로 전년말 대비 18조 1,169억원 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

구 분		토지	건물및구축물	기계장치	건설중인자산	기타유형자산	계
기초	기초장부금액	98,302	388,694	795,263	180,093	36,933	1,499,285
	- 취득원가	99,436	626,515	2,749,096	180,093	119,580	3,774,720
	- 감가상각누계액(손상 포함)	△1,134	△237,821	△1,953,833	-	△82,647	△2,275,435
증감	일반취득 및 자본적지출	1,389	53,021	310,101	166,757	21,002	552,270
	감가상각	△495	△35,339	△307,617	-	△16,070	△359,521
	처분・폐기・손상	△576	△1,302	△469	△2	△465	△2,814
	기타	302	1,995	△132	△10,772	△159	△8,766
기말	기말장부금액	98,922	407,069	797,146	336,076	41,241	1,680,454
	- 취득원가	100,246	677,138	3,030,006	336,076	132,485	4,275,951
	- 감가상각누계액(손상 포함)	△1,324	△270,069	△2,232,860	-	△91,244	△2,595,497

※ 토지의 감가상각은 기업회계기준서 제1116호 '리스'에 따른 사용권자산의 감가상각비입니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 기타는 환율변동에 의한 증감액 및 관련 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 시가 판단이 어려워 기재를 생략했습니다.

(시설투자 현황)

2022년 중 DS 부문 및 SDC 등의 첨단공정 증설・전환과 인프라 투자를 중심으로 53.1조원의 시설투자가 이루어졌습니다. 당사는 2023년 시장 불확실성 속에서도 차세대 기술 경쟁력 확보 및 미래 수요 대비를 위한 투자를 지속할 예정이며, 동시에 내실 있는 성장을 위한 투자 효율성 제고에도 집중할 계획입니다.

(단위 : 억원)

구 분	내 용	투자기간	대상자산	투자액
DS 부문	신・증설, 보완 등	2022.01~2022.12	건물・설비 등	478,717
SDC	신・증설, 보완 등	2022.01~2022.12	건물・설비 등	24,958
기 타	신・증설, 보완 등	2022.01~2022.12	건물・설비 등	27,478
합 계				531,153

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

2022년 매출은 302조 2,314억원으로 전년 대비 8.1% 증가하였습니다. 부문별로 보면 전년 대비 DX 부문이 9.8%, DS 부문이 3.2% 증가하였으며, SDC가 8.4%, Harman이 31.6% 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

부 문	매출유형	품 목	제54기	제53기	제52기
DX 부문	제・상품, 용역 및 기타매출	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등	1,824,897	1,662,594	1,489,135
DS 부문	제・상품, 용역 및 기타매출	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	984,553	953,872	740,540
SDC	제・상품, 용역 및 기타매출	스마트폰용 OLED 패널 등	343,826	317,125	305,857
Harman	제・상품, 용역 및 기타매출	디지털 콕핏, 텔레매틱스, 스피커 등	132,137	100,399	91,837
기 타	부문간 내부거래 제거 등		△263,099	△237,942	△259,299
합 계			3,022,314	2,796,048	2,368,070

※ 각 부문별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

※ 제53기, 제52기는 2021년 12월의 조직변경을 반영하여 제54기 기준으로 재작성하였습니다.

[△는 부(-)의 값임]

(1) 주요 제품별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제54기	제53기	제52기
영상기기	332,795	314,974	277,118
무선	1,154,254	1,046,806	960,217
메모리	685,349	726,022	555,442
DP	343,826	317,125	305,857

※ 각 제품별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

(2) 매출유형별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제54기	제53기	제52기
제・상품	2,903,461	2,658,785	2,235,963
용역 및 기타매출	118,853	137,263	132,107
계	3,022,314	2,796,048	2,368,070

※ 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다.

(3) 주요 지역별 매출 현황

(단위 : 억원)

구 분		제54기	제53기	제52기
내수	국내	221,799	221,497	198,331
수출	미주	659,617	583,805	476,768
	유럽	265,147	258,227	235,012
	아시아・아프리카	425,114	336,671	315,598
	중국	546,998	597,247	437,403
계		2,118,675	1,997,447	1,663,112

※ 별도 기준의 내수・수출 매출 현황입니다.

나. 판매경로 등

(1) 국내

판매자	판 매 경 로	소비자
생산 및 매입	전속 대리점	소비자
	유통업체(양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등)	
	통신사업자(SK텔레콤㈜, ㈜케이티, ㈜LG유플러스)	
	직접판매(B2B 및 온라인)	

(2) 해외

<table>
<tr><th>판매자</th><th colspan="4">판 매 경 로</th><th>소비자</th></tr>
<tr><td rowspan="6">생산법인</td><td rowspan="5">판매법인</td><td colspan="3">Retailer</td><td rowspan="10">소비자</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dealer</td><td>Retailer</td></tr>
<tr><td>Distributor</td><td>Dealer</td><td>Retailer</td></tr>
<tr><td colspan="3">통신사업자, Automotive OEM</td></tr>
<tr><td colspan="3">직접판매(B2B 및 온라인)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">물류법인</td><td rowspan="4">판매법인</td><td colspan="3">Retailer</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dealer</td><td>Retailer</td></tr>
<tr><td>Distributor</td><td>Dealer</td><td>Retailer</td></tr>
</table>

(3) 판매경로별 매출액 비중

경 로	도매	소매	특직판	기타
비 중	19%	27%	51%	3%

다. 판매방법 및 조건

(1) 국내

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
전속	대리점	약정여신조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
유통업체	양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
통신사업자	SK텔레콤㈜, ㈜케이티, ㈜LG유플러스	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담 (공동마케팅)
B2B 및 온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

(2) 해외

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
Retailer	소매점	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
Dealer	양판점, 할인점, 백화점	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
Distributor	현지 거래처 직판 영업	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
B2B 및 온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

라. 판매전략

- 프리미엄 제품을 중심으로 한 시장 우위 강화
- 브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공
- 고객 · 시장 중심의 수요 촉발 마케팅 강화

마. 주요 매출처

2022년 당사의 주요 매출처는 Apple, Best Buy, Deutsche Telekom, Qualcomm, Verizon 등(알파벳순)입니다. 당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 16% 수준입니다.

바. 수주상황

2022년말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리정책

당사의 재무위험관리는 영업 활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책과 프로그램을 운영하고 있습니다. 위험을 회피하기 위한 파생상품의 이용도 이 프로그램에 포함되어 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 글로벌 재무위험관리정책을 수립한 후 주기적으로 재무위험 측정, 헷지 및 평가 등을 실행하고 있습니다.

한편 해외 주요 권역별로 지역 금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역 내 자금을 통합운용하여 유동성위험을 관리하고 있습니다.

당사 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다
.

나. 주요 재무위험관리

(1) 시장위험

(환율변동위험)

당사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR, INR 등이 있습니다.

당사는 환율변동과는 무관하게 통화별 자산과 부채 규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융 거래 발생 시 현지 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다.

또한, 당사는 효과적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 기능통화와 다른 주요 외화로 표시된 금융자산 및 금융부채에 대하여 환율이 5% 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제54기말		제53기말	
	환율 상승시	환율 하락시	환율 상승시	환율 하락시
USD	258,655	△258,655	250,489	△250,489
EUR	92,546	△92,546	107,519	△107,519
INR	52,096	△52,096	24,216	△24,216

(이자율변동위험)

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무 활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 변동금리부 금융자산 및 금융부채에 대하여 이자율이 1%p 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제54기말		제53기말	
	이자율 상승시	이자율 하락시	이자율 상승시	이자율 하락시
금융자산	72,750	△72,750	71,131	△71,131
금융부채	△8,427	8,427	△18,779	18,779
순효과	64,323	△64,323	52,352	△52,352

(주가변동위험)

당사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

2022년말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 92,073백만원(전기: 116,087백만원)이며, 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 3,144백만원(전기: 4,784백만원)입니다.

(2) 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다
.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재경팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독하에 이루어지고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

(3) 유동성위험

대규모 투자가 많은 당사 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금 수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지・관리하고 있습니다.

당사는 주기적으로 미래 현금 흐름을 예측하여 유동성위험을 사전 관리하고 있습니다. 권역별로 Cash Pooling을 구축・활용하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 내부 자금을 활용하여 유동성위험을 효과적으로 관리하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사 간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성위험을 최소화하는 한편 자금운용부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 당사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

또한, 만약의 대규모 유동성 필요에 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있습니다.

금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따라 만기별로 구분된 유동성은 다음과 같습니다.

(1) 제54기말

(단위 : 백만원)

구 분	3개월 이내	~6개월	~1년	1~5년	5년 초과
금융부채	42,990,570	733,984	1,925,448	5,402,672	1,562,274

(2) 제53기말

(단위 : 백만원)

구 분	3개월 이내	~6개월	~1년	1~5년	5년 초과
금융부채	55,185,809	1,814,271	1,674,980	5,462,057	944,232

(4) 자본위험

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

2022년말 현재 당사는 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 Aa2 평가등급을 받고 있으며, 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	제54기말	제53기말
부 채	93,674,903	121,721,227
자 본	354,749,604	304,899,931
부채비율	26.4%	39.9%

다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 환율변동 위험관리 목적상 장부 통화가 아닌 외화 포지션에 대하여 통화선도(Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지하고 있습니다. 통화선도 상품은 매매목적 및 위험회피목적으로 은행을 통하여 매수 또는 매도하고 있습니다.

2022년말 현재 당사는 USD, EUR, JPY 등 총 35개 통화에 대하여 2,545건의 통화선도 거래를 체결하고 있으며, 관련 자산・부채 장부금액 및 평가손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	자산	부채	평가이익	평가손실
통화선도	166,087	158,686	1,351,390	1,450,638

그리고 종속회사인 삼성디스플레이㈜는 Corning Incorporated와 2021년 4월 8일 실행된 주식매매계약에 따라, 보유 중인 Corning 지분증권 일부를 Corning에게 매각할수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다.

또한, 삼성디스플레이㈜는 TCL Technology Group Corporation (TCL) 및 TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)와 2021년 4월 1일 실행된 주주간 계약에 따라 CSOT가 상장기한 내 비상장 시, 삼성디스플레이㈜가 보유 중인 CSOT 지분증권 전부 또는 일부를 TCL에게 매각할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다. 2022년말 현재 해당 풋옵션의 공정가치는 한영회계법인이 평가하였습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약 등

계약 상대방	항 목	내 용
Cisco	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2014.01.23
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
Google	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2014.01.25 (영구)
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
	기타 주요내용	영구 라이선스 계약 (향후 10년간 출원될 특허까지 포함)
GlobalFoundries	계약 유형	공정 기술 라이선스 계약
	체결시기	2014.02.28
	목적 및 내용	14nm 공정의 고객기반 확대
InterDigital	계약 유형	특허 사용 계약
	체결시기	2014.06.03
	목적 및 내용	특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
Qualcomm	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결기간	2018.01.01~2023.12.31
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스·부제소 계약 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
Apple	계약 유형	소취하 계약
	체결시기	2018.06.26
	목적 및 내용	양사 간 미국에서 진행 중인 모든 소송 취하
Nokia	계약 유형	특허 사용 계약
	체결시기	2018.10.19
	목적 및 내용	특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
Microsoft	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2019.02.11
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
Google	계약 유형	EMADA
	체결시기 및 기간	2019.02.27~2022.12.31(연장)
	목적 및 내용	유럽 31개국(EEA) 대상으로 Play Store, YouTube 등 구글 앱 사용에 대한 라이선스 계약
Huawei	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2019.02.28
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
AMD	계약 유형	기술 라이선스 계약
	체결시기	2019.05.30
	목적 및 내용	모바일 및 기타 응용 제품에 활용할 수 있는 그래픽 설계자산 확보

Sharp	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2019.07.30
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
Ericsson	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2021.05.07
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소

※ 계약 체결 금액 등 기타 분쟁에 참고가 될 사항은 기재하지 않았습니다.

나. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용

당사는 고객의 요구를 먼저 파악하고 발상의 전환을 통해 창조적이고 혁신적인 제품,미래를 선도하는 기술을 지속적으로 창출하여 세계 시장을 선도해 나가고 있습니다. 또한, 세계 IT업계에서의 위상을 더욱 굳건히 하기 위해 차세대 기술과 원천기술을 확보하여 세계 산업 기술을 이끄는 진정한 선도 기업(Leading Company)이 되도록 최선을 다하고 있습니다.

2022년(제54기) 당사의 연구개발비용은 24조 9,292억원이며, 이 중 정부보조금으로 차감되거나 자산화된 연구개발비를 제외하고 24조 9,192억원을 당기비용으로 회계처리하였습니다.

[연구개발비용] (단위 : 백만원, %)

과 목		제54기	제53기	제52기
연구개발비용 총계		24,929,171	22,596,487	21,229,200
(정부보조금)		△9,973	△1,053	△8,228
연구개발비용 계		24,919,198	22,595,434	21,220,972
회계처리	개발비 자산화(무형자산)	-	△193,708	△109,482
	연구개발비(비용)	24,919,198	22,401,726	21,111,490
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 총계÷당기매출액×100]		8.2%	8.1%	9.0%

※ 연결 누계기준입니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다.

다. 연구개발 조직 및 운영

(국내)

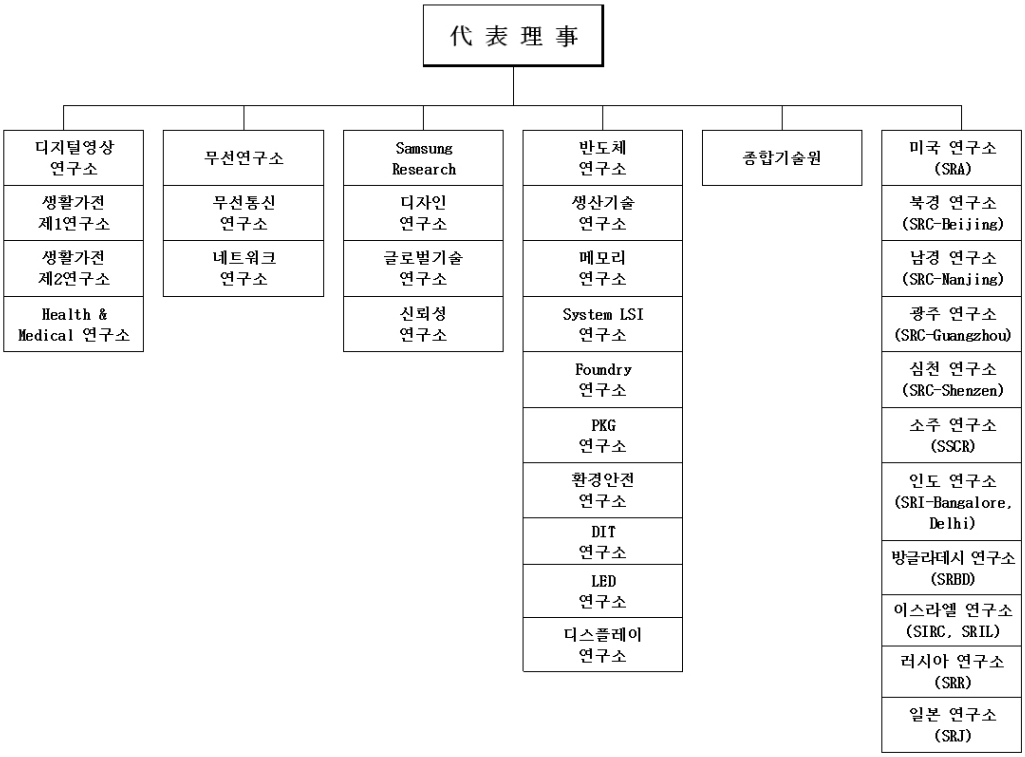
당사는 3계층의 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 1~2년 내에 시장에 선보일 상품화 기술을 개발하는 각 부문 산하 사업부 개발팀, 3~5년 후의 미래 유망 중장기 기술을 개발하는 각 부문 연구소, 그리고 미래 성장엔진에 필요한 핵심 요소 기술을 선행 개발하는 종합기술원 등으로 연구 개발 구조를 체계화하여 운영하고 있습니다.

종합기술원은 미래를 주도할 최첨단 기술의 산실로서 설립된 삼성전자의 중앙연구소로 미래 성장엔진 가시화와 주력사업의 기술 경쟁력 강화 등 전사 차원에서 유망 성장 분야에 대한 연구개발 방향 제시와 창의적 R&D 체제를 구축하고 있습니다.

(해외)

미국(SRA), 중국(SSCR, SRC-Beijing, SRC-Nanjing, SRC-Guangzhou, SRC-Shenzen), 인도(SRI-Bangalore, SRI-Delhi), 방글라데시(SRBD), 이스라엘(SRIL, SIRC), 러시아(SRR), 일본(SRJ) 등의 지역에 연구개발 조직을 운영하고 있으며 제품 개발 및기초 기술 연구 등의 연구 활동을 수행 중입니다.

또한, 영국 캠브리지, 러시아 모스크바, 캐나다 토론토・몬트리올, 미국 뉴욕에 AI센터를 설립하여 세계적인 전문가와 한국・미국 등의 AI 연구인력이 함께 AI 분야 기술력을 강화하고 있습니다.



※ 연구개발조직도는 2022년말 기준입니다.

☞ 상세한 해외 연구개발 조직(법인) 현황은 'XII. 상세표'의
'1. 연결대상 종속회사 현황(상세)'을 참고하시기 바랍니다.

라. 연구개발실적

2022년 중 당사의 각 부문별 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

부문	연구과제 등	연구결과 및 기대효과 등
DX 부문	Neo QLED 8K	· Mini LED 기반 초고화질 & 슬림 8K TV 출시
	Neo QLED 4K	· Mini LED 기반 3개 시리즈, 7개 사이즈 출시
	그랑데 AI 세탁기	· 펫케어 코스 적용된 그랑데 AI 24kg 세탁기 / 그랑데 AI 20kg 건조기 출시
	갤럭시 폴더블	· Galaxy Z Fold 4 출시 · Galaxy Z Flip 4 출시
	갤럭시 S22	· Galaxy S22 · S22+ · S22 Ultra 출시
	갤럭시 탭	· Galaxy Tab S8 · S8+ · S8 Ultra 출시
	갤럭시 A	· Galaxy A73 5G 출시 · Galaxy A53 5G 출시 · Galaxy A33 5G 출시 · Galaxy A23 LTE · 5G 출시 · Galaxy A13 LTE · 5G 출시
	갤럭시북	· Galaxy Book2 Pro 360 출시 · Galaxy Book2 Pro 출시 · Galaxy Book2 Go 5G 출시
	웨어러블	· Galaxy Watch 5 출시 · Galaxy Buds 2 Pro 출시
DS 부문	모바일 DRAM	· 업계 최초 LPDDR5X D램 개발
	엑시노스	· 프리미엄 모바일AP 엑시노스 2200 출시
	LSI	· 생체인증카드용 원칩 지문인증 IC(S3B512C) 출시
	Foundry	· 세계 최초 GAA 기술 적용 3나노 공정
SDC	QD-Display	· TV향 QD-Display (55" UHD, 65" UHD) · 모니터향 QD-Display (34" QHD)

※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(상세)' 참조

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 관련

당사는 R&D 활동의 지적재산화에도 집중하여 1984년 최초로 미국에 특허를 등록한이래 현재 세계적으로 총 225,910건의 특허를 보유하고 있으며, 특히 미국에서의 분쟁에 효과적으로 대응하고자 미국에서 가장 많은 특허를 보유하고 있습니다.

[국가별 등록 건수(2022년말 현재, 연결 기준)] (단위 : 건)

구분	한국	미국	유럽	중국	일본	기타국가	계
등록건수	52,044	88,024	41,915	20,762	8,901	14,264	225,910

2022년 중 총 24.9조원의 R&D투자를 통해 국내 특허 9,136건, 미국 특허 8,490건 등을 등록하였습니다.

[주요 국가 연도별 특허등록 건수] (단위 : 건)

구 분	2022년	2021년	2020년
한 국	9,136	8,437	6,648
미 국	8,490	8,565	8,520

이 지적재산권은 대부분 스마트폰, 스마트 TV, 메모리, System LSI 등에 관한 특허로써 당사 전략사업 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정이며, 사업 보호의 역할뿐만 아니라 유사 기술・특허가 난립하는 상황에서 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한, 미래 신기술 관련 선행 특허 확보를 통하여 향후 신규 사업 진출 시 사업 보호의 역할이 기대되고 있습니다. 당사는 Cisco(2014.01.체결), Google(2014.01.), Qualcomm(2018.01.), Nokia(2018.10.), Microsoft(2019.02.), Sharp(2019.07.), Ericsson(2021.05.) 등과의 특허 라이선스 체결을 통하여, 모바일, 반도체 등 당사 주력사업 및 신사업 분야에서 광범위한 특허 보호망을 확보하고 있습니다.

당사는 상기 특허뿐만 아니라 스마트폰, 스마트 TV 등에 적용된 당사 고유 디자인을보호하고자 디자인특허 확보도 강화하여, 2022년 중 미국에서 468건의 디자인특허(Design Patent)를 취득하였습니다.

나. 환경 관련 규제사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서요구하는 사업장에서 발생하는 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 신고하고지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다.

(제품 환경규제 준수)

전자제품은 일반적으로 소비자가 직접 휴대하거나, 가정에 설치하여 사용하고 있어 사용자 건강과 안전에 직・간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 관련 환경규제가 강화되고 있습니다. 이에 대해 당사는 부품 및 제품의 개발단계부터 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전 과정(Life Cycle)에 걸쳐 환경영향을 최소화하기 위한 활동을 하고있습니다. 유해물질을 제거한 부품 공급을 위해 협력회사 에코파트너 인증 제도를 운영하고 개발단계에서 제품의 친환경 요소(자원 사용 절감, 에너지 절약, 유해 물질 저감, 친환경소재 적용 등)를 제품에 반영하기 위해 에코디자인 평가 제도를 운영하며, 제품 사용 후 발생하는 폐전자제품을 회수하여 재활용하는 폐제품 회수・재활용시스템을 유럽, 북미, 한국, 인도 등 각국에서 운영하고 있습니다. 이러한 활동은 전기・전자 제품 관련 국내외 환경 법규를 준수할 뿐만 아니라 회사와 제품의 차별화 요소로 기여하고 있습니다.

각국 관련 법률은 다음과 같습니다.
1. 폐제품 회수・재활용법 (예: EU WEEE Directive)
2. 유해물질 사용 제한 (예: EU RoHS Directive, REACH Regulation)
3. 제품 에너지 소비효율 규정 (예: EU ErP Directive)

(사업장관리 환경규제 준수)

제품생산과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기 오염방지시설, 수질 오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지 시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 하고 있습니다.
이러한 사업장의 환경관리는 관련 부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며,
국내 및 글로벌 전 생산 사업장은 국제 환경안전보건경영시스템 인증 (ISO 14001, ISO 45001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

국내외 주요한 관련 법률은 다음과 같습니다.
1. 환경오염물질 배출 규제:「물환경보전법」「대기환경보전법」「폐기물관리법」
「소음・진동관리법」「환경영향평가법」등
2. 온실가스 배출 관리:「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」
「저탄소 녹색성장 기본법」등
3. 기타 사업장환경관리법:「화학물질관리법」
「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」
「악취방지법」「토양환경보전법」등

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조(기후변화대응 및 에너지의 목표관리) 제6항에 따른 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제44조(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 등의 보고)와 당국의 지침에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자에게 공개하고 있습니다.

정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

(단위 : tCO_2-eq, TJ)

구 분	2022년	2021년	2020년
온실가스(tCO_2-eq)	19,566,237	19,267,835	17,234,522
에너지(TJ)	277,270	274,298	255,990

※ 연결 기준입니다.

※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등입니다.

※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.

※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 2015년부터「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제8조(할당대상업체의 지정 및 지정취소)에 따라 온실가스 배출권 할당 대상업체에 해당합니다.

다. 사업부문별 현황

[DX 부문]

(산업의 특성 등)

DX 부문의 주요 제품인 TV 산업은 1926년 흑백 TV 개발, 1954년 RCA사가 Color TV(21") 양산・판매를 시작한 이래로 트리니트론 브라운관(1967년), 완전평면 브라운관(1996년) 개발 등 기술적인 발전을 거듭해 왔으나, 주요 국가 보급률이 90%를 넘어서면서 브라운관 TV 산업의 성장은 정체되었습니다. 그러나 Flat Panel TV(LCD, PDP) 출시, 디지털 방송의 확산 등을 통해 TV 시장은 성장 모멘텀을 되찾았으며, Flat Panel TV는 화질, 디자인 등 제품의 성능 향상과 가격 경쟁력 있는 제품 출시를 통해 성장을 지속하며 기존의 브라운관 TV 시장을 빠르게 대체하였습니다.

2010년에는 입체감을 느낄 수 있는 3D TV가 출시되었고, 2011년부터 2012년에 걸쳐 인터넷 동영상 서비스 업체의 부상과 스마트기기에 대한 사용자의 관심 확대로 스마트TV 시장이 태동하였습니다. 이후 2017년에 화질 및 해상도가 혁신적으로 높아진 퀀텀닷 소재를 사용한 QLED TV가 출시되고, 8K와 MICRO LED TV가 상용화되는 등 TV 시장은 끊임없이 진화하고 있습니다.

휴대폰 산업은 1980년대 초 음성통화만 가능했던 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 음성 및 문자 메시지 전송이 가능한 CDMA와 GSM의 2세대 디지털 방식을 거쳐, 음성 데이터뿐만 아니라, 사진, 동영상과 같은 멀티미디어 데이터까지 전송 가능한 WCDMA 등의 3세대 이동통신으로 발전하였습니다. 이후 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 전 세계로 확산되어 2021년에 판매된 휴대폰의 75%가 LTE를 지원하고 있습니다(출처: Strategy Analytics 2022.11).

또한, 2019년 초 4차 산업 혁명을 포함하여 미래 변화를 주도할 5세대 이동통신 5G 서비스는 한국과 미국을 시작으로 글로벌 상용화되었으며, 5G 스마트폰은 2020년 2.7억대에서 2021년 6.1억대로 판매가 확대되는 등, 융합 서비스 및 기반 산업의 생태계 조성을 가속화하고 있습니다(출처: Strategy Analytics 2022.11).

스마트폰 시장은 2007년 이후 큰 폭으로 성장하여 2021년 전체 휴대폰 판매량 중 스마트폰의 비중은 77% 수준, 피처폰의 비중은 일부 신흥 시장에서의 수요로 인해 23% 수준입니다(출처: Strategy Analytics 2022.12). 또한 스마트폰 보급률은 2021년 51%에서 2022년 52%로 소폭 증가한 것으로 예상됩니다(출처: Strategy Analytics 2022.12).

스마트폰 시장이 성숙함에 따라 고성능 AP, 대화면 AMOLED Display, 폴더블 폼팩터, 멀티 카메라, 센서, 방수・방진, 생체 인식 등과 같은 하드웨어뿐만 아니라 플랫폼 기반의 Application, UX, Game, Media, Advertisement, Digital Wallet, AI, 보안 등 소프트웨어 경쟁력의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

2021년에는 프리미엄 TV 시장 수요 창출을 위한 화질, 사운드, 폼팩터 혁신 노력이 지속되었지만, TV 전체 시장 수요는 글로벌 물류 대란 및 공급망 차질 영향 등으로 전년비 감소하여 약 2억 1,354만대 수준이었습니다. 2022년 또한 러시아-우크라이나 전쟁 및 원자재・에너지 공급 불안정, 글로벌 인플레이션 확대에 따른 가계 실질 소득 감소 영향 등으로 전년비 역성장하여 약 2억 326만대 수준이었습니다(출처: Omdia 2023.02).

< TV 시장점유율 추이 >

제 품	2022년	2021년	2020년
TV	29.7%	29.5%	31.9%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.

또한 스마트폰 시장도 지정학적 불안 지속, 인플레이션 등 불확실성으로 인해 2021년 13.6억대에서 2022년 12.2억대 수준으로 역성장한 것으로 예상됩니다(출처: Strategy Analytics 2022.12). 그동안 교체 수요의 감소 등으로 역성장을 지속했던 태블릿 시장은 코로나19(COVID-19)의 영향 등에 따른 비대면 수요 증가로 2021년 1.8억대로 성장한 후 2022년에는 1.6억대 수준으로 소폭 감소된 것으로 예상됩니다(출처: Strategy Analytics 2022.11).

< 스마트폰 시장점유율 추이 >

제 품	2022년	2021년	2020년
스마트폰	21.8%	20.0%	19.6%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Strategy Analytics의 세계시장점유율 자료(수량 기준)를 활용하였습니다.
(2022년 시장점유율은 외부조사기관의 예측치입니다.)

(영업의 개황 등)

당사는 2006년 이후 2022년까지 17년 연속으로 TV 판매 1위를 달성하였습니다.

2018년 당사는 세계 최초로 8K TV를 글로벌 시장에 공개하여 다시 한번 TV 산업의프리미엄 제품 리더십을 주도하였습니다. QLED 라인업은 중형에서 초대형까지 다양한 사이즈를 구비하여 소비자에게 폭넓은 선택을 할 수 있는 기회를 제공하였고, 화질도 한층 더 개선되었다는 전문가와 소비자의 평가를 받았습니다. 당사는 QLED뿐만 아니라 UHD 라인업에서도 초대형 사이즈를 구비해서 견조한 실적을 기록하였습니다.

2020년 당사는 코로나19(COVID-19)로 인한 전 세계 경제위기 상황에서도 QLED 4K・8K TV와 Lifestyle TV 신제품(The Terrace, The Premiere, The Sero 등)을 통해 시장 리더십과 지배력을 확대하였습니다.

2021년에는 명암비와 화질을 획기적으로 개선한 Neo QLED TV를 출시하여 프리미엄 제품군을 확대하였습니다. 또한 Lifestyle 제품과 Sound Bar 제품의 판매 비중도 상승하였으며, TV 플러스, 홈 트레이닝, 게임 등 다양한 스마트 생태계에 참여하는 업체들도 확대되었습니다. 특히, 당사는 2021년부터 제품 재질부터 패키징(Packaging)에 이르기까지 친환경 사업에 앞장서는 한편, 접근성을 발전시켜서 시각・청각 장애인도 불편없이 제품을 사용할 수 있도록 지원하고 있습니다.

2022년에는 Neo QLED 8K 혁신 기술들을 중심으로 75" 이상 초대형 프리미엄 시장 점유율을 확대해가는 한편, 더 프리스타일 제품을 도입하여 라이프스타일 라인업을
더욱 보강하였습니다.

2023년에는 당사의 주력 제품인 Neo QLED와 초대형 등 프리미엄 제품에 집중해 시장 점유율을 확대해 나가는 한편 라이프스타일 쪽에서도 라인업 확대와 제품 성능 개선 등을 통해 소비자 맞춤형 제품들을 지속적으로 제공할 것입니다. 또한, 전사 차원의 신환경경영전략에 맞춰 재생 플라스틱을 활용한 소재를 친환경 리모컨에 추가 확대 적용하고 초전력 기술을 적용한 TV 신제품들도 선보일 예정입니다.

또한 당사는 주력 사업인 휴대폰 시장에서 글로벌 1위의 위상을 유지하고 있으며, 특히 스마트폰은 2011년 이후 12년 연속 글로벌 1위의 입지를 확고히 하고 있습니다.

또한, 스마트폰 뿐만 아니라 전체 모바일 시장에서의 사업 위상을 강화하기 위해 태블릿과 웨어러블, 액세서리 등의 제품과 함께 Digital Health, Digital Wallet 등 미래 성장 동력이 될 수 있는 육성 사업을 적극적으로 확대해 나가고 있습니다.

당사는 프리미엄에서 보급형까지 다양하고 경쟁력 있는 스마트폰 라인업을 활용하여지역별 시장 상황과 경쟁 환경에 최적화된 제품 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 특히 프리미엄 스마트폰은 대화면 Infinity Display에 더해 Dynamic AMOLED 2X(120Hz) 지원, UWB(Ultra Wideband)를 활용한 디지털키 및 콘텐츠 공유, 방수・방진, 고속 유・무선 충전, 초음파 방식의 온스크린 지문 인식, AI 기술을 활용한 고화질 사진 및 고배율・야간 촬영, 8K 동영상 등고객의 Needs에 기반한 차별화된 기능을 지속해서 선보이고 있습니다.

2019년에는 세계 최초 5G 스마트폰 출시로 5G 시장 리더십을 선점하고 폴더블 디스플레이를 탑재한 '갤럭시 폴드'로 신규 시장을 개척한 데 이어, 2020년에는 상하로 접히는 '갤럭시 Z 플립'과 한층 더 진화된 '갤럭시 Z 폴드2'를, 2021년에는 독보적인 장인정신을 기반으로 내구성을 대폭 강화한 3세대 Z 시리즈를 출시하며 폴더블 시장을 리딩해 왔습니다.

2022년 출시한 '갤럭시 Z 폴드4'와 '갤럭시 Z 플립4'는 사용자 관점에서 각 제품의 핵심 경험인 멀티태스킹과 Flex Mode 경험의 완성도를 더욱 높여 시장의 호응을 얻고 있습니다. 당사는 새로운 폴더블 시리즈의 진정한 대중화로 기존 노트 시리즈 신제품 이상의 판매량을 달성할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다.

또한, 빠르게 변화하는 시장과 고객 Needs에 민첩하게 대응하기 위해 중저가 스마트폰에도 5G, 쿼드 카메라, 대화면 Infinity Display, 대용량 배터리 등을 적극적으로 채택하여 제품 경쟁력을 높이고 있습니다.

스마트폰 외에도 대화면 디스플레이와 S Pen으로 노트 필기와 영상회의, 멀티태스킹 등 생산적인 경험을 제공하는 태블릿, 혁신적인 생체 센서 기술을 적용하여 더욱 고도화된 피트니스 및 웰니스 기능을 제공하는 스마트 워치와 풍부하고 뛰어난 사운드 경험을 제공하는 무선 이어폰이 포함된 웨어러블 제품 등 다양한 Galaxy Eco 제품군을 통해 당사 스마트폰을 사용하는 고객에게 더욱 풍부한 모바일 경험을 제공하고 있습니다.

당사는 제품과 더불어 그동안 Samsung Pay, Samsung Health, SmartThings 등의 실용적이고 가치 있는 서비스를 제공해 왔으며, 스마트폰 외에도 TV, 냉장고, 에어컨 등 다양한 제품군에 Bixby를 적용하여 고객이 어느 기기를 사용하더라도 일관되고 끊김 없는 경험을 할 수 있는 Multi Device Experience를 제공하고 있습니다.

또한, Ecosystem 확장을 위한 전략적 파트너십도 강화하고 있으며, SmartThings, Bixby, Cloud를 활용하고 Service Biz를 강화하여 Digital Health, Digital Wallet 등 미래 성장에 대비한 투자를 지속하여 새롭고 혁신적인 기술을 확보하고 있습니다.

뿐만 아니라 제품에 재활용 소재 적용을 확대하는 등, 친환경 기술 혁신도 지속하고 있습니다. 대표적으로 플라스틱 폐기물 중 하나인 폐어망을 재활용해 만든 소재를 갤럭시 S22 및 S23 시리즈, 갤럭시 Z 폴드4 등 주요 제품에 적용하였습니다.

회사는 앞으로도 업계 최고 수준의 R&D 역량을 바탕으로 철저한 미래 준비를 통해 고객에게 새로운 가치를 끊임없이 제공하겠습니다.

[DS 부문]

(산업의 특성 등)

반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다.

메모리 반도체는 읽고(Read) 쓸 수(Write) 있는 램(RAM, Random Access Memory) 제품과 읽기만 할 수 있는 롬(ROM, Read Only Memory) 제품으로 구분됩니다. 램(RAM)은 전원이 꺼지면 기억된 내용은 지워져 휘발성 메모리(Volatile Memory)라고 하며, 컴퓨터의 주기억 장치, 응용프로그램의 일시적 로딩(Loading), 데이터의 일시적 저장 등에 사용됩니다. 롬(ROM)은 전원이 꺼져도 Data가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로, 대표적으로 입출력 시스템이나 IC카드 등에 사용됩니다.

System LSI 제품은 응용처에 따라 종류가 다양하며, 중앙처리 장치인 CPU(Central Processing Unit), 그래픽 처리 장치인 GPU(Graphics Processing Unit), ISP(Image Signal Processor), Modem(Modulator-Demodulator) 등을 내장한 모바일 기기용 SOC(System On Chip)가 가장 대표적인 제품입니다. 당사는 스마트폰, 태블릿 등 모바일용 SOC 제품과 이미지 센서, OLED용 DDI(Display Driver IC) 등을 공급하고 있습니다.

한편, 주문형 반도체(Foundry 서비스)는 다른 업체가 설계한 반도체를 위탁 생산해서 공급해 주는 사업으로, 일반 제조업의 OEM 공급과 비슷한 개념의 '수탁 반도체 제조 사업'입니다. 반도체 공정 기술의 고도화와 투자 부담의 증가로 생산 시설을 보유하지 않은 팹리스(Fabless) 업체가 증가하고 있으며, 이러한 팹리스 업체 제품의 위탁생산을 담당하고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

메모리 시장은 글로벌 경기 침체 가능성 등 대외환경 불확실성 지속에 따른 소비심리 위축 우려로 고객사들이 긴축 재정 기조를 강화하며, 전반적인 메모리 수요 약세가 지속되었습니다. PC・모바일 등 소비자향 제품의 수요 둔화가 심화되었으며, 서버 Set Build 지연 및 재고 축소 기조로 일부 수요 약세를 보였습니다. 매크로 경기 부진에 따른 메모리 수요 약세가 심화되는 모습을 보이고 있으나, 당사는 고부가가치・고용량 제품 판매를 통한 수익성 확보에 집중하고, 차세대・차별화된 솔루션 제품으로 메모리 시장을 지속 선도해 나가겠습니다.

파운드리 시장은 2022년초 팬데믹 완화와 위드 코로나 정책으로 완만한 회복을 기대했었으나, 러시아-우크라이나 전쟁, 중국의 대규모 봉쇄 시작 및 미국의 금리인상 가속화를 기점으로 하반기부터 기대보다는 느린 성장세가 이어지고 있습니다. 이에 2023년 1분기는 수요 약세를 반영하여 성장률 둔화가 전망됩니다만, 하반기부터는 주요국 긴축 완화 등 수요 진작과 공급망 정상화에 따른 점진적 시장 회복을 기대하고 있습니다. 중장기적으로는 모바일향 5G 보급 증가, 전장향 고성능 SOC 수요 증가, 고성능 컴퓨팅 수요 확대 등으로 성장세는 지속될 전망됩니다.

< DRAM 시장점유율 추이 >

제 품	2022년	2021년	2020년
DRAM	43.0%	43.0%	42.7%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 DRAMeXchange의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.

(2022년 시장점유율은 당사 추정치입니다.)

(영업의 개황 등)

2023년 1분기는 계절적 비수기 및 글로벌 매크로 불확실성 지속에 따른 고객사들의 재고 조정 기조가 유지될 가능성이 있습니다. 이에 당사는 신규 CPU 출시에 따른 서버・PC향 DDR5 수요 준비 본격화와 서버・모바일 응용의 고용량화 수요에 적극 대응하고 있으며, 수익성 중심의 고부가가치 제품 비중 확대를 통해 사업 경쟁력을 강화하고 있습니다.

또한, 세계 최초 Multi-step EUV가 적용된 DRAM 양산 체계를 선제적으로 갖추었고, 8세대 V-NAND 채용 SSD 등 선단 제품 라인업 확보로 원가 경쟁력을 강화함으로써, 차세대 성장 분야에서의 시장 리더십을 더욱 공고히 할 예정입니다.

System LSI는 글로벌 시장 둔화 상황을 고객과의 협력 강화를 통해 극복하고, 차세대 제품 선행 개발을 통하여 기술력 제고와 제품 경쟁력 향상에 박차를 가하고 있습니다. SOC는 당사의 AP 및 모뎀 기술력을 바탕으로 모바일 5G SOC와 선단공정 적용 제품의 개발을 강화하고 있으며, 모바일 Custom SOC 및 자동차향 SOC 등으로 제품 라인업을 확대하는 한편, 차세대 제품 개발 관련한 고객과의 협력도 강화하고 있습니다.

Foundry는 금번 다운턴 시기를 지속 성장 가능한 사업구조 강화 및 체질 전환의 기회로 활용하고 있습니다. Advanced 노드는 고객을 위한 개발 완성도 제고 및 기술 서비스 경쟁력 강화를 기조로 성공적인 3나노 2세대 제품 적기 개발을 위해 역량을 집중하고 있으며, 4나노 2・3세대의 안정적인 수율을 확보하여 2023년 상반기 양산을 준비 중 입니다. 더불어 평택・테일러 등 신규 FAB 구축을 기반으로 적기 Capa 확보 및 공급 능력 향상을 통해 고객 수요에 대응할 준비를 해 나가고 있습니다. Matured 노드는 기술 경쟁력 확보 및 장기 노드 활용을 위해 8나노・14나노의 성능, 파워, 면적, 원가 측면에서 개선 활동을 진행하고 있습니다. 또한, 고객 Needs에 맞는 스페셜티 공정을 개발함으로써, 기술경쟁력 제고와 더불어 고성능 컴퓨팅, 전장향 반도체, 5G, IoT 등 고성능 저전력 반도체 시장 진입을 확대하고 있습니다. 전체적인 사업구조 측면에서도 모바일 이외 제품의 기반 고객 다변화를 추진하여, 시황에 흔들리지 않고 성장할 수 있는 구조로 보강해 나가고 있습니다.

[SDC]

(산업의 특성 등)

디스플레이(Display)는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시 소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, OLED(Organic Light Emitting Diode)와 QD-OLED(Quantum Dot-Organic Light Emitting Diode), TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display) 등이 이에 해당합니다.

OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색 일치율이 높고 색 재현 범위가 넓으며 응답 속도가 빠르다는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 OLED 디스플레이는 멀티미디어 콘텐츠, 인터넷 사용 등 디스플레이의 성능이 중시되는 스마트폰 시장에서 채용이 빠르게 증가하고 있습니다. 과거에는 OLED로 고해상도의 장수명 패널을 구현하는 것에 대해 시장의 큰 우려가 있었으나, 당사는 기술적 한계를 극복하여 시장을 발전시켜 왔습니다. OLED는 LCD의 단점을 극복할 뿐만 아니라, 앞으로 폴더블, 롤러블, 전장 등 다른 응용처로 확대 적용이 가능하며 앞으로 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. QD-OLED는 수 나노 미터의 반도체 결정인 퀀텀닷(Quantum Dot)을 패널에 내재화해 색재현력과 시야각을 극대화한 자발광 디스플레이로, 향후 프리미엄급 TV 및 모니터 시장을 주도할 차세대 디스플레이로 주목받고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

스마트폰용 디스플레이 패널 시장은 인플레이션, 경기침체 우려 등에 따른 소비심리 위축으로 2021년 17.5억대에서 2022년 13.8억대로 감소된 것으로 예상됩니다. 스마트폰용 OLED 디스플레이 패널의 경우 2021년 6.2억대에서 2022년 5.7억대로 감소되었으나, 전체 스마트폰 디스플레이 패널에서 차지하는 비중은 2021년 35%에서 2022년 41%로 증가한 것으로 예상됩니다(출처: Omdia 2023.01).

대형 디스플레이 패널 시장 역시 시장 침체의 영향으로 2021년 9.8억대에서 2022년 8.8억대로 축소된 것으로 예상됩니다(출처: Omdia 2023.01).

< 스마트폰 패널 시장점유율 추이 >

제 품	2022년	2021년	2020년
스마트폰 패널	56.7%	51.4%	44.8%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.
(2022년 시장점유율은 외부조사기관의 예측치입니다.)

(영업의 개황 등)

당사는 2007년 세계 최초로 OLED 제품의 상용화에 성공한 이후 현재까지 중소형 OLED 시장에서 독보적인 점유율을 유지하고 있습니다. 또한 스마트폰 외에도 폴더블,태블릿, 워치, 노트북, 전장 등으로 제품군을 다각화하여 명실상부한 OLED 디스플레이의 선도 기업으로 자리매김하였습니다.

당사는 Flexible OLED와 Rigid OLED 패널을 통해 프리미엄부터 보급형 제품까지 최적의 제품 포트폴리오를 구축하여 소비자의 고도화되는 Needs에 적극 대응하고 있습니다. 또한 차별화된 기능과 디자인의 폴더블・OLED IT 제품을 지속적으로 출시하여 시장으로부터 업계 최고의 기술력을 인정받고 있습니다.

2022년은 거시 환경의 불확실성이 지속되며, 스마트폰 시장의 축소는 불가피하였습니다. 당사는 고객사 Needs에 발맞춰 저소비전력, 고속 구동, UPC(Under Panel Camera) 등 신기술 적용을 확대하는 한편, 원가 경쟁력을 강화하여 스마트폰 제품에서의 OLED 패널 채용률을 지속적으로 높여가기 위해 노력하였습니다.

또한 스마트폰에 편중된 중소형 패널 사업을 다각화하여, IT, Game, Auto 제품 등으로 제품 포트폴리오를 확대하고 사업 리더십을 더욱 견고히 하고 있습니다.

한편, 대형 디스플레이 사업은 QD-OLED 제품의 라인업 확대 및 판매처 다변화를 통해 프리미엄 시장에서의 점유율을 지속 높여가도록 할 계획입니다.

[Harman]

(산업의 특성 등)

Harman은 전장부품(Automotive)과 라이프스타일 오디오(Lifestyle Audio) 산업에서경쟁하고 있습니다.

전장부품(디지털 콕핏, 텔레매틱스, 카 오디오 등)의 소비자들이 지속해서 가장 최신 기술을 요구함에 따라, 자동차 제조사는 교통수단 공유, 자율주행 등의 분야에서 가장 앞선 기술을 요구하고 있습니다. 특히 전장산업의 커넥티비티(Connectivity) 및 엔터테인먼트 솔루션 시장에서 주요 업체(Alpine, Aptiv, Continental, Mitsubishi, Panasonic 등)간 경쟁이 매우 치열합니다. Harman은 카 오디오(Car Audio) 분야에서 시스템 솔루션뿐만 아니라 오디오 컴포넌트(스피커, 앰프 등)도 제공하고 있으며, 주요 업체(Bose, Pioneer, Panasonic) 간 경쟁이 매우 치열합니다. 이 분야는 지속적인 기술 발전이 예상되며, 여러 카 오디오 업체가 다양한 음향관리 솔루션 개발 등으로 차별화해 나갈 것으로 전망됩니다. 따라서 향후 지속해서 업체 간 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다.

라이프스타일 오디오 산업은 소비자 오디오와 프로페셔널(Professional) 오디오 솔루션으로 구분됩니다. 소비자 오디오(포터블 스피커, 헤드폰, 커넥티드 오디오 솔루션 등) 산업은 상대적으로 시장점유율 집중도가 낮으며 소수의 선도 업체(Amazon, Beats, Bose, Ultimate Ears 등)가 있습니다. 특히 커넥티드 홈(Connected Home)과 스마트 스피커 제품이 시장을 계속 포화 상태로 만들고 있기 때문에 다른 산업에서 진입하는 새로운 업체와 기존 업체 간 경쟁 상황이 지속될 것으로 전망됩니다. 특히 휴대폰 제조사가 절대적인 시장점유율을 차지하고 있는 True Wireless 헤드폰 분야는 폭발적인 성장이 예상됩니다.

프로페셔널 오디오 솔루션(상업용・대규모 공연장 등에서의 오디오, 특수조명, 영상컨트롤 솔루션 등) 산업은 제품 종류에 따라 세분화되어 있고 제품의 응용 방식에 따라 다양한 업체가 진출한 상태입니다. QSC와 Yamaha가 현재 산업 내에서 널리 알려진 선도 업체입니다.

(국내외 시장여건 등)

2022년말까지 점진적으로 완화될 것으로 예상됐던 코로나19(COVID-19) 팬데믹은 예상보다 완화의 속도가 느린 한편, 러시아-우크라이나 전쟁 영향 등으로 사업의 불확실성이 더욱 높아졌습니다. 이 가운데 중앙은행 긴축 정책에 따른 경제 리스크가 고조되는 등 2022년은 거시경제 환경의 불확실성이 매우 높았습니다.

이러한 요인들을 감안하였을때 2023년 전세계 자동차 생산은 2022년 대비 4% 수준 증가에 그칠 것으로 예상됩니다(출처: S&P Global Light Vehicle Production Forecast 2022.12).

< 디지털 콕핏 시장점유율 추이 >

제 품	2022년	2021년	2020년
디지털 콕핏	24.7%	25.3%	27.5%

※ 디지털 콕핏(Digital Cockpit)은 인포테인먼트 시스템 등을 통해 안전한 운전 환경을 제공하는 디지털 전장부품입니다.
※ 시장점유율은 외부조사기관인 I.H.S 와 LMC의 자료(수량 기준)를 활용한 당사 추정치 입니다.

(영업의 개황 등)

Harman은 전장부품 시장에서 선도 기업의 위상을 유지하고 있습니다. 대량 판매 시장에서부터 고급 특화 시장에 걸쳐 차량에 지속적으로 폭넓고 다양한 브랜드를 활용하는 한편, Harman 브랜드에 부합하는 품질 수준을 유지할 계획입니다. 더불어, 카 오디오와 커넥티비티(Connectivity) 분야에서 끊임없이 혁신에 집중하는 것은 자동차 제조사와의 공존을 견고히 하는데 도움이 될 것입니다.

자동차 시장에서의 여러 성공 요인은 소비자 오디오 및 프로페셔널 오디오 솔루션 시장에서도 유사하게 적용될 것입니다. 그래미상 3회, 아카데미상 2회 등을 수상한 바와 같이 여러 Harman 브랜드는 일상적인 소비자와 음악 애호가 사이에서 명성을 쌓아왔습니다. 무선 스마트 스피커와 같은 전도 유망한 분야에서 신제품을 제공하는 것은 신규 고객을 Harman으로 유인함과 동시에 브랜드 평판을 더욱 강화하는데 지속적으로 도움이 될 것입니다.

코로나19(COVID-19)의 세계적 유행은 자동차 생산의 중단, 소비・유동 인구의 감소, 소매점의 영업 중단 등 부정적인 영업 환경을 초래하였습니다. 특히, 프로페셔널 오디오 솔루션 사업은 대규모 모임 및 이벤트 축소 등으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. Harman은 코로나19(COVID-19)의 대유행이 시작되었을 때 다양한 비용 절감 방안을 도입하였으며, 비용을 절감한 분야에 대해서는 향후 재투자를 통해 효율적으로 시장에서 경쟁할 계획입니다.

라. 사업부문별 요약 재무 현황

2022년(제54기) 매출은 DX 부문이 182조 4,897억원(60.4%), DS 부문이 98조 4,553억원(32.6%)이며, SDC가 34조 3,826억원(11.4%), Harman은 13조 2,137억원(4.4%)입니다.

2022년(제54기) 영업이익은 DX 부문이 12조 7,461억원으로 전체이익의 29.4%, DS 부문이 23조 8,158억원으로 전체이익의 54.9%를 차지하며, SDC가 5조 9,530억원(13.7%), Harman은 8,805억원(2.0%)입니다.

(단위 : 억원, %)

부문	구 분	제54기		제53기		제52기	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중
DX 부문	매출액	1,824,897	60.4%	1,662,594	59.5%	1,489,135	62.9%
	영업이익	127,461	29.4%	173,866	33.7%	151,520	42.1%
	총자산	2,279,669	38.6%	2,479,832	42.0%	2,303,623	43.6%
DS 부문	매출액	984,553	32.6%	953,872	34.1%	740,540	31.3%
	영업이익	238,158	54.9%	291,920	56.5%	188,062	52.2%
	총자산	2,620,558	44.3%	2,258,223	38.3%	1,885,692	35.7%
SDC	매출액	343,826	11.4%	317,125	11.3%	305,857	12.9%
	영업이익	59,530	13.7%	44,574	8.6%	22,369	6.2%
	총자산	737,798	12.5%	668,836	11.3%	661,929	12.5%
Harman	매출액	132,137	4.4%	100,399	3.6%	91,837	3.9%
	영업이익	8,805	2.0%	5,991	1.2%	555	0.2%
	총자산	171,023	2.9%	158,874	2.7%	147,020	2.8%

※ 각 사업부문별 요약 재무 현황은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

※ 제53기, 제52기는 2021년 12월의 조직변경을 반영하여 제54기 기준으로 재작성하였습니다.

(공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부 기준 적용)

- 공통 판매비와 관리비의 경우 각 제품・모델별 귀속이 확실한 직접비용(위임성 경비)은 각 제품・모델부문에 직접 귀속시키고 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부 기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다.
- 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당 부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부 기준(매출액비, 세전이익비 등)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제54기	제53기	제52기
	2022년 12월말	2021년 12월말	2020년 12월말
[유동자산]	218,470,581	218,163,185	198,215,579
· 현금및현금성자산	49,680,710	39,031,415	29,382,578
· 단기금융상품	65,102,886	81,708,986	92,441,703
· 기타유동금융자산	443,690	3,409,791	2,828,562
· 매출채권	35,721,563	40,713,415	30,965,058
· 재고자산	52,187,866	41,384,404	32,043,145
· 기타	15,333,866	11,915,174	10,554,533
[비유동자산]	229,953,926	208,457,973	180,020,139
· 기타비유동금융자산	12,802,480	15,491,183	13,778,185
· 관계기업 및 공동기업 투자	10,893,869	8,932,251	8,076,779
· 유형자산	168,045,388	149,928,539	128,952,892
· 무형자산	20,217,754	20,236,244	18,468,502
· 기타	17,994,435	13,869,756	10,743,781
자산총계	448,424,507	426,621,158	378,235,718
[유동부채]	78,344,852	88,117,133	75,604,351
[비유동부채]	15,330,051	33,604,094	26,683,351
부채총계	93,674,903	121,721,227	102,287,702
[지배기업 소유주지분]	345,186,142	296,237,697	267,670,331
· 자본금	897,514	897,514	897,514
· 주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
· 이익잉여금	337,946,407	293,064,763	271,068,211
· 기타	1,938,328	△2,128,473	△8,699,287
[비지배지분]	9,563,462	8,662,234	8,277,685
자본총계	354,749,604	304,899,931	275,948,016
	2022년 1월~12월	2021년 1월~12월	2020년 1월~12월
매출액	302,231,360	279,604,799	236,806,988
영업이익	43,376,630	51,633,856	35,993,876
연결총당기순이익	55,654,077	39,907,450	26,407,832
· 지배기업 소유주지분	54,730,018	39,243,791	26,090,846
· 비지배지분	924,059	663,659	316,986
기본주당순이익(단위 : 원)	8,057	5,777	3,841
희석주당순이익(단위 : 원)	8,057	5,777	3,841
연결에 포함된 회사수	233개	229개	242개

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제52기~제54기 연결감사보고서 주석사항을 참고하시기 바랍니다.

나.요약별도재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제54기	제53기	제52기
	2022년 12월말	2021년 12월말	2020년 12월말
[유동자산]	59,062,658	73,553,416	73,798,549
· 현금및현금성자산	3,921,593	3,918,872	989,045
· 단기금융상품	137	15,000,576	29,101,284
· 매출채권	20,503,223	33,088,247	24,736,740
· 재고자산	27,990,007	15,973,053	13,831,372
· 기타	6,647,698	5,572,668	5,140,108
[비유동자산]	201,021,092	177,558,768	155,865,878
· 기타비유동금융자산	1,364,608	1,664,667	1,542,766
· 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	57,397,249	56,225,599	56,587,548
· 유형자산	123,266,986	103,667,025	86,166,924
· 무형자산	8,561,424	8,657,456	7,002,648
· 기타	10,430,825	7,344,021	4,565,992
자산총계	260,083,750	251,112,184	229,664,427
[유동부채]	46,086,047	53,067,303	44,412,904
[비유동부채]	4,581,512	4,851,149	1,934,799
부채총계	50,667,559	57,918,452	46,347,703
[자본금]	897,514	897,514	897,514
[주식발행초과금]	4,403,893	4,403,893	4,403,893
[이익잉여금]	204,388,016	188,774,335	178,284,102
[기타]	△273,232	△882,010	△268,785
자본총계	209,416,191	193,193,732	183,316,724
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
	2022년 1월~12월	2021년 1월~12월	2020년 1월~12월
매출액	211,867,483	199,744,705	166,311,191
영업이익	25,319,329	31,993,162	20,518,974
당기순이익	25,418,778	30,970,954	15,615,018
기본주당순이익(단위 : 원)	3,742	4,559	2,299
희석주당순이익(단위 : 원)	3,742	4,559	2,299

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제52기~제54기 감사보고서 주석사항을 참고하시기 바랍니다.

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 54 기 2022.12.31 현재

제 53 기 2021.12.31 현재

제 52 기 2020.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 54 기	제 53 기	제 52 기
자산			
유동자산	218,470,581	218,163,185	198,215,579
현금및현금성자산	49,680,710	39,031,415	29,382,578
단기금융상품	65,102,886	81,708,986	92,441,703
단기상각후원가금융자산	414,610	3,369,034	2,757,111
단기당기손익-공정가치금융자산	29,080	40,757	71,451
매출채권	35,721,563	40,713,415	30,965,058
미수금	6,149,209	4,497,257	3,604,539
선급비용	2,867,823	2,336,252	2,266,100
재고자산	52,187,866	41,384,404	32,043,145
기타유동자산	6,316,834	5,081,665	3,754,462
매각예정분류자산	0	0	929,432
비유동자산	229,953,926	208,457,973	180,020,139
기타포괄손익-공정가치금융자산	11,397,012	13,965,839	12,575,216
당기손익-공정가치금융자산	1,405,468	1,525,344	1,202,969
관계기업 및 공동기업 투자	10,893,869	8,932,251	8,076,779
유형자산	168,045,388	149,928,539	128,952,892
무형자산	20,217,754	20,236,244	18,468,502
순확정급여자산	5,851,972	2,809,590	1,355,502
이연법인세자산	5,101,318	4,261,214	4,275,000
기타비유동자산	7,041,145	6,798,952	5,113,279
자산총계	448,424,507	426,621,158	378,235,718
부채			
유동부채	78,344,852	88,117,133	75,604,351
매입채무	10,644,686	13,453,351	9,739,222
단기차입금	5,147,315	13,687,793	16,553,429
미지급금	17,592,366	15,584,866	11,899,022
선수금	1,314,934	1,224,812	1,145,423
예수금	1,298,244	1,294,052	974,521
미지급비용	29,211,487	27,928,031	24,330,339
당기법인세부채	4,250,397	6,749,149	4,430,272

유동성장기부채	1,089,162	1,329,968	716,099
충당부채	5,844,907	5,372,872	4,349,563
기타유동부채	1,951,354	1,492,239	1,127,719
매각예정분류부채	0	0	338,742
비유동부채	15,330,051	33,604,094	26,683,351
사채	536,093	508,232	948,137
장기차입금	3,560,672	2,866,156	1,999,716
장기미지급금	2,753,305	2,991,440	1,682,910
순확정급여부채	268,370	465,884	464,458
이연법인세부채	5,111,332	23,198,205	18,810,845
장기충당부채	1,928,518	2,306,994	1,051,428
기타비유동부채	1,171,761	1,267,183	1,725,857
부채총계	93,674,903	121,721,227	102,287,702
자본			
지배기업 소유주지분	345,186,142	296,237,697	267,670,331
자본금	897,514	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
이익잉여금(결손금)	337,946,407	293,064,763	271,068,211
기타자본항목	1,938,328	(2,128,473)	(8,687,155)
매각예정분류기타자본항목	0	0	(12,132)
비지배지분	9,563,462	8,662,234	8,277,685
자본총계	354,749,604	304,899,931	275,948,016
부채와자본총계	448,424,507	426,621,158	378,235,718

연결 손익계산서

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 53 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 52 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 54 기	제 53 기	제 52 기
수익(매출액)	302,231,360	279,604,799	236,806,988
매출원가	190,041,770	166,411,342	144,488,296
매출총이익	112,189,590	113,193,457	92,318,692
판매비와관리비	68,812,960	61,559,601	56,324,816
영업이익	43,376,630	51,633,856	35,993,876
기타수익	1,962,071	2,205,695	1,384,068
기타비용	1,790,176	2,055,971	2,488,902
지분법이익	1,090,643	729,614	506,530
금융수익	20,828,995	8,543,187	12,267,600
금융비용	19,027,689	7,704,554	11,318,055
법인세비용차감전순이익(손실)	46,440,474	53,351,827	36,345,117
법인세비용	(9,213,603)	13,444,377	9,937,285
계속영업이익(손실)	55,654,077	39,907,450	26,407,832
당기순이익(손실)	55,654,077	39,907,450	26,407,832
당기순이익(손실)의 귀속			
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	54,730,018	39,243,791	26,090,846
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	924,059	663,659	316,986
주당이익			
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8,057	5,777	3,841
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	8,057	5,777	3,841

연결 포괄손익계산서

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 53 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 52 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 54 기	제 53 기	제 52 기
당기순이익(손실)	55,654,077	39,907,450	26,407,832
기타포괄손익	4,005,664	10,002,299	(3,673,905)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(822,137)	2,508,106	1,788,764
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,969,498)	2,980,896	2,502,733
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(6,318)	51,816	5,591
순확정급여부채(자산) 재측정요소	1,153,679	(524,606)	(719,560)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	4,827,801	7,494,193	(5,462,669)
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(44,192)	160,163	(48,888)
해외사업장환산외환차이	4,884,886	7,283,620	(5,380,375)
현금흐름위험회피파생상품평가손익	(12,893)	50,410	(33,406)
총포괄손익	59,659,741	49,909,749	22,733,927
포괄손익의 귀속			
지배기업 소유주지분	58,745,107	49,037,912	22,374,398
비지배지분	914,634	871,837	359,529

연결 자본변동표

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 53 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 52 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	자본							
	지배기업 소유주지분						비지배지분	자본 합계
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	매각예정분류기타자본항목	지배기업 소유주지분 합계		
2020.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	254,582,894	(4,968,829)		254,915,472	7,964,949	262,880,421
당기순이익(손실)			26,090,846			26,090,846	316,986	26,407,832
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익			13,713	2,402,226		2,415,939	86,794	2,502,733
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분				(45,894)		(45,894)	2,597	(43,297)
해외사업장환산외환차이				(5,343,946)		(5,343,946)	(36,429)	(5,380,375)
순확정급여부채(자산) 재측정요소				(709,141)		(709,141)	(10,419)	(719,560)
현금흐름위험회피파생상품평가손익				(33,406)		(33,406)		(33,406)
매각예정분류				12,132	(12,132)	0		0
배당			(9,619,242)			(9,619,242)	(59,028)	(9,678,270)
연결실체내 자본거래 등				(830)		(830)	(701)	(1,531)
연결실체의 변동						0	17,838	17,838
기타				533		533	(4,902)	(4,369)
2020.12.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	271,068,211	(8,687,155)	(12,132)	267,670,331	8,277,685	275,948,016
2021.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	271,068,211	(8,687,155)	(12,132)	267,670,331	8,277,685	275,948,016
당기순이익(손실)			39,243,791			39,243,791	663,659	39,907,450
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익			3,232,934	(359,117)		2,873,817	107,079	2,980,896
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분				225,464		225,464	(13,485)	211,979
해외사업장환산외환차이				7,164,982		7,164,982	118,638	7,283,620
순확정급여부채(자산) 재측정요소				(520,552)		(520,552)	(4,054)	(524,606)
현금흐름위험회피파생상품평가손익				50,410		50,410		50,410
매각예정분류				(12,132)	12,132	0		0
배당			(20,480,721)			(20,480,721)	(32,005)	(20,512,726)
연결실체내 자본거래 등						0	12,553	12,553
연결실체의 변동						0	(477,617)	(477,617)
기타			548	9,627		10,175	9,781	19,956
2021.12.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	293,064,763	(2,128,473)	0	296,237,697	8,662,234	304,899,931
2022.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	293,064,763	(2,128,473)	0	296,237,697	8,662,234	304,899,931
당기순이익(손실)			54,730,018			54,730,018	924,059	55,654,077
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익			(38,937)	(1,867,530)		(1,906,467)	(63,031)	(1,969,498)
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분				(51,848)		(51,848)	1,338	(50,510)
해외사업장환산외환차이				4,863,930		4,863,930	20,956	4,884,886
순확정급여부채(자산) 재측정요소				1,122,367		1,122,367	31,312	1,153,679
현금흐름위험회피파생상품평가손익				(12,893)		(12,893)		(12,893)
매각예정분류						0		0
배당			(9,809,437)			(9,809,437)	(5,523)	(9,814,960)
연결실체내 자본거래 등						0	(176)	(176)
연결실체의 변동						0	124	124
기타				12,775		12,775	(7,831)	4,944
2022.12.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	337,946,407	1,938,328		345,186,142	9,563,462	354,749,604

연결 현금흐름표

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 53 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 52 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 54 기	제 53 기	제 52 기
영업활동 현금흐름	62,181,346	65,105,448	65,287,009
영업에서 창출된 현금흐름	71,728,568	72,676,199	68,148,810
당기순이익	55,654,077	39,907,450	26,407,832
조정	33,073,439	49,055,633	41,618,554
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(16,998,948)	(16,286,884)	122,424
이자의 수취	2,136,795	1,406,706	2,220,209
이자의 지급	(714,543)	(434,441)	(555,321)
배당금 수입	529,421	299,033	243,666
법인세 납부액	(11,498,895)	(8,842,049)	(4,770,355)
투자활동 현금흐름	(31,602,804)	(33,047,763)	(53,628,591)
단기금융상품의 순감소(증가)	15,214,321	10,917,128	(20,369,616)
단기상각후원가금융자산의 순감소(증가)	3,050,104	(336,959)	184,104
단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)	11,677	30,694	1,704,512
장기금융상품의 처분	8,272,909	10,216,082	12,184,301
장기금융상품의 취득	(4,393,754)	(6,981,810)	(8,019,263)
상각후원가금융자산의 처분	0	0	1,023,117
상각후원가금융자산의 취득	0	0	0
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	496,090	2,919,888	32,128
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(37,687)	(1,121,201)	(245,497)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	166,315	350,212	39,746
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(158,244)	(208,262)	(84,184)
관계기업 및 공동기업 투자의 처분	13,233	19,169	0
관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(907,958)	(47,090)	(83,280)
유형자산의 처분	217,878	358,284	376,744
유형자산의 취득	(49,430,428)	(47,122,106)	(37,592,034)
무형자산의 처분	23,462	1,752	7,027
무형자산의 취득	(3,696,304)	(2,706,915)	(2,679,779)
사업결합으로 인한 현금유출액	(31,383)	(5,926)	(49,420)
매각예정자산의 처분으로 인한 현금유입액	0	661,168	
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(413,035)	8,129	(57,197)
재무활동 현금흐름	(19,390,049)	(23,991,033)	(8,327,839)
단기차입금의 순증가(감소)	(8,339,149)	(2,616,943)	2,191,186

장기차입금의 차입	271,997	58,279	14,495
사채 및 장기차입금의 상환	(1,508,465)	(894,749)	(864,947)
배당금의 지급	(9,814,426)	(20,510,350)	(9,676,760)
비지배지분의 증감	(6)	(27,270)	8,187
매각예정분류	0	139	(139)
외화환산으로 인한 현금의 변동	(539,198)	1,582,046	(833,861)
현금및현금성자산의 순증감	10,649,295	9,648,837	2,496,579
기초의 현금및현금성자산	39,031,415	29,382,578	26,885,999
기말의 현금및현금성자산	49,680,710	39,031,415	29,382,578

3. 연결재무제표 주석

제 54 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 53 기 : 2021년 12월 31일 현재

삼성전자주식회사와 그 종속기업

1. 일반적 사항:

가. 연결회사의 개요

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사 및 종속기업(이하 삼성전자주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 사업은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman으로 구성되어 있습니다. DX(Device eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 휴대폰, 통신시스템 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry, System LSI 등으로 구성되어 있습니다. SDC는 디스플레이 패널 사업을 영위하며, Harman은 전장부품사업 등을 영위하고 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 회사는 삼성디스플레이㈜ 및 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 232개의 종속기업을 연결대상으로 하고, 삼성전기㈜ 등 37개 관계기업과 공동기업을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

나. 종속기업 현황

당기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung International, Inc. (SII)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Research America, Inc (SRA)	R&D	100.0
	SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	해외자회사 관리	100.0
	SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	NeuroLogica Corp.	의료기기 생산 및 판매	100.0
	Samsung HVAC America, LLC	에어컨공조 판매	100.0
	Joyent, Inc.	클라우드서비스	100.0
	Dacor Holdings, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	Dacor, Inc.	가전제품 생산 및 판매	100.0
	SmartThings, Inc.	스마트홈 플랫폼	100.0
	TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	네트워크장비 설치 및 최적화	100.0
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	반도체・DP 판매	100.0
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	해외자회사 관리	100.0
	SEMES America, Inc.	반도체 장비 서비스	100.0
	Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	전자제품 판매	100.0
	AdGear Technologies Inc.	디지털광고 플랫폼	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA)	컨설팅	100.0
	Harman International Industries, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Engineering Corp.	Connected Service Provider	100.0
	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Financial Group LLC	Management Company	100.0
	Harman International Industries Canada Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman KG Holding, LLC	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional, Inc.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	벤처기업 투자	61.4
	China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	벤처기업 투자	99.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽・CIS	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ltd. (SEL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	반도체・DP 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	반도체・DP 판매	100.0
	Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK)	TV・모니터 생산	100.0
	Samsung Display Slovakia, s.r.o. (SDSK)	DP 임가공	100.0
	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Baltics SIA (SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	R&D	100.0
	SAMSUNG Zhilabs, S.L.	네트워크Solution 개발, 판매	100.0
	FOODIENT LTD.	R&D	100.0
	Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	TV 생산	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	마케팅	100.0

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽・CIS	AKG Acoustics Gmbh	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Apostera UA, LLC	Connected Service Provider	100.0
	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive UK Limited	오디오제품 생산	100.0
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium SA	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Finland Oy	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services GmbH	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services UK Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Deutschland GmbH	오디오제품 판매	100.0
	Harman Finance International GP S.a.r.l	해외자회사 관리	100.0
	Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Holding Gmbh & Co. KG	Management Company	100.0
	Harman Hungary Financing Ltd.	Financing Company	100.0
	Harman Inc. & Co. KG	해외자회사 관리	100.0
	Harman International Estonia OU	R&D	100.0
	Harman International Industries Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Romania SRL	R&D	100.0
	Harman Finance International, SCA	Financing Company	100.0
	Harman Management Gmbh	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Red Bend Software Ltd.	소프트웨어 디자인	100.0
	Red Bend Software SAS	소프트웨어 디자인	100.0
	Studer Professional Audio GmbH	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services OOO	Connected Service Provider	100.0
	Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
중동・아프리카	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkiye (SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. (SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	R&D	100.0
	Corephotonics Ltd.	R&D	100.0
	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	TV・모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	마케팅	100.0
	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Red Bend Ltd.	오디오제품 생산	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
아시아 (중국 제외)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	DP 생산	100.0
	DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	DP 부품 생산	100.0
	PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	전자제품 판매 및 서비스	100.0
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	마케팅	100.0
	Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	DP 생산	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL)	서비스	100.0
	Samsung Japan Corporation (SJC)	반도체・DP 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman International (India) Private Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries PTY Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman International Japan Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Singapore Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
중국	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	전자제품 판매	100.0
	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. (TSEC)	TV・모니터 생산	91.2
	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	R&D	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	반도체・DP 판매	100.0
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	반도체 생산	100.0
	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	반도체・DP 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	반도체 임가공	100.0
	Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	LED 생산	100.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	DP 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	DP 생산	95.0
	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	반도체 장비 서비스	100.0
	Samsung Semiconductor Investment L.P. I	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	오디오제품 생산	100.0
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Holding Limited	오디오제품 판매	100.0
	Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
국내	삼성디스플레이㈜	DP 생산 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스㈜	DP 부품 생산	50.0
	스테코㈜	반도체 부품 생산	70.0
	세메스㈜	반도체・FPD 장비 생산, 판매	91.5
	삼성전자서비스㈜	전자제품 수리 서비스	99.3
	삼성전자서비스씨에스㈜	고객상담서비스	100.0
	삼성전자판매㈜	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍㈜	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨㈜	의료기기 생산 및 판매	68.5
	주식회사 희망별숲	식품 제조 가공	100.0
	㈜미래로시스템	반도체 소프트웨어 개발 및 공급	99.9
	㈜도우인시스	DP 부품 생산	69.0
	지에프㈜	DP 부품 생산	100.0
	㈜하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 29호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 37호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 40호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 42호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 43호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 45호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 48호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 52호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 55호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 56호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 57호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
	시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	62.5

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

다. 주요 연결대상 종속기업의 재무정보

당기 및 전기의 주요 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위 : 백만원)

기업명(*1)	자산	부채	매출액	당기순이익 (손실)
삼성디스플레이㈜	57,302,567	7,282,718	30,779,405	4,365,588
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	37,883,156	12,258,315	46,738,920	219,670
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	26,894,611	2,678,285	-	8,699,679
Harman과 그 종속기업(*2)	17,102,324	6,380,456	13,211,151	631,019
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	17,095,000	2,970,835	9,679,757	638,385
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	15,718,299	2,358,140	36,336,963	2,721,701
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	13,830,988	9,764,636	2,865,831	257,878
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	12,199,102	5,930,369	43,009,331	88,467
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	10,931,037	1,408,387	23,667,565	1,646,165
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	10,841,515	6,272,800	-	57,997
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	9,301,017	828,494	3,663,909	208,879
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	7,471,680	1,608,448	25,773,970	1,301,926
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	6,772,537	3,571,863	16,180,492	508,510
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	5,067,891	2,858,382	21,370,622	318,578
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	4,600,508	1,342,517	7,485,104	(38,490)
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	3,732,057	980,448	6,253,401	386,119
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	3,263,473	486,820	4,824,734	168,524
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	2,819,792	1,708,064	5,929,357	243,396
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	2,377,730	597,044	2,834,008	25,411
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	2,374,317	452,628	3,935,745	199,742
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	2,194,975	2,021,491	15,409,984	20,347
Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	2,135,132	265,835	2,556,608	111,643
세메스㈜	2,065,558	602,323	2,889,238	185,762
Samsung Electronics GmbH (SEG)	1,968,273	1,907,132	6,567,011	3,695
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	1,816,895	996,002	3,270,016	110,386

(*1) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

기업명(*1)	자산	부채	매출액	당기순이익 (손실)
삼성디스플레이㈜	54,967,156	9,081,737	28,755,975	2,770,060
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	42,982,054	19,246,751	42,325,524	823,914
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	19,049,536	5,168,738	7,341,018	1,708,832
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	17,521,446	3,425,127	32,184,024	2,298,273
Harman과 그 종속기업(*2)	15,887,380	6,104,012	10,015,092	357,612
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	14,683,789	58,381	-	4,668,478
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	14,651,496	8,998,502	-	24,527
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	13,744,799	7,955,060	33,895,805	74,531
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	13,599,093	9,685,278	2,615,685	451,062
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	13,023,272	2,085,411	21,583,038	1,455,704
Samsung Austin Semiconductor LLC (SAS)	8,705,085	958,537	3,703,472	759,206
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	7,765,126	5,799,690	31,326,186	325,397
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	7,765,019	3,236,745	12,222,643	522,672
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	6,821,066	2,486,703	21,722,446	981,311
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	4,589,505	1,671,097	6,020,523	490,202
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	3,129,104	919,721	6,551,242	472,666
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	3,018,358	474,223	4,443,031	142,191
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	2,925,062	1,992,367	5,621,922	241,403
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	2,612,357	766,034	2,569,603	284,816
Samsung Electronics Hungarian Private Co., Ltd. (SEH)	2,504,075	641,004	4,357,137	157,616
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	2,305,275	2,144,805	14,700,517	13,943
Samsung Electronics GmbH (SEG)	2,289,391	2,228,650	6,385,080	2,158
Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	2,149,277	339,425	3,987,674	163,637
Samsung International, Inc. (SII)	2,125,719	1,041,168	7,948,982	105,444
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	2,033,992	1,459,353	5,638,204	50,966

(*1) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

라. 연결대상범위의 변동

당기 중 연결재무제표 작성대상범위의 변동 내용은 다음과 같습니다.

구분	지역	기업명	사유
신규연결	유럽・CIS	Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	설립
		Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	설립
		Apostera GmbH	지분취득
		Apostera UA, LLC	지분취득
	아시아 (중국 제외)	DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	설립
		Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	지분취득
	국내	SVIC 57호 신기술투자조합	설립
		주식회사 희망별숲	설립
연결제외	미주	Dacor Canada Co.	청산
	유럽・CIS	AMX UK Limited	청산
		Harman International s.r.o	청산
		Apostera GmbH	합병

2. 중요한 회계처리방침:

다음은 연결재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성기준

연결회사의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 요구되는 부분이나 중요한 가정 및 추정이 요구되는 부분은 주석3에서 설명하고 있습니다.

2.2 회계정책과 공시의 변경

가. 연결회사가 채택한 제・개정 기준서

연결회사는 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제・개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정

사업결합 시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

나. 연결회사가 적용하지 않은 제・개정 기준서

제정 또는 공표됐으나 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지않았고, 연결회사가 조기 적용하지 않은 주요 제・개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

보고기간종료일 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다.
동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다.

- 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이허용됩니다.

- 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래당시 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.

2.3 연결

연결회사는 기준서 제1110호 '연결재무제표'에 따라 연결재무제표를 작성하고 있습니다.

가. 종속기업

종속기업은 연결회사가 지배하고 있는 모든 기업(특수목적기업 포함)입니다. 연결회사가 피투자자에 대한 관여로 변동이익에 노출되거나 변동이익에 대한 권리가 있고, 피투자자에 대하여 자신의 힘으로 그러한 이익에 영향을 미칠 능력이 있는 경우, 해당 피투자자를 지배합니다. 종속기업은 연결회사가 지배하게 되는 시점부터 연결에 포함되며, 지배력을 상실하는 시점부터 연결에서 제외됩니다.

연결회사의 사업결합은 취득법으로 회계처리 됩니다. 이전대가는 취득일의 공정가치로 측정하고, 사업결합으로 취득한 식별가능한 자산・부채 및 우발부채는 취득일의 공정가치로 최초 측정하고 있습니다. 연결회사는 청산 시 순자산의 비례적 몫을 제공하는 비지배지분을 사업결합 건별로 판단하여 피취득자의 순자산 중 비례적 지분으로 측정합니다. 취득 관련 원가는 발생 시 당기비용으로 인식됩니다.

이전대가, 피취득자에 대한 비지배지분의 금액과 취득자가 이전에 보유하고 있던 피취득자에 대한 지분의 취득일의 공정가치 합계액이 취득한 식별가능한 순자산을 초과하는 금액은 영업권으로 인식합니다. 또한, 이전대가 등이 취득한 종속기업 순자산의 공정가액보다 작다면, 그 차액은 당기이익으로 인식됩니다.

연결회사 내의 기업간에 발생하는 거래로 인한 채권, 채무의 잔액, 수익과 비용 및 미실현이익 등은 제거됩니다. 또한 종속기업의 회계정책은 연결회사에서 채택한 회계정책을 일관성있게 적용하기 위해 차이가 나는 경우 수정됩니다.

나. 지배력의 변동이 없는 종속기업에 대한 소유지분의 변동

지배력의 상실을 발생시키지 않는 비지배지분과의 거래는 자본거래, 즉 소유주로서의 자격을 행사하는 소유주와의 거래로 회계처리하고 있습니다. 지불한 대가의 공정가치와 종속기업의 순자산의 장부금액 중 취득한 지분 해당액과의 차이는 자본에 계상됩니다. 비지배지분의 처분에서 발생하는 손익 또한 자본에 반영됩니다.

다. 종속기업의 처분

연결회사가 지배력을 상실하는 경우 해당 기업에 대해 계속 보유하게 되는 지분은 동 시점에 공정가치로 재측정되며, 관련 차액은 당기손익으로 인식됩니다. 이러한 공정가치는 해당 지분이 후속적으로 관계기업, 공동지배기업 또는 금융자산으로 인식되는 경우의 최초 인식 시 장부가액이 됩니다. 또한, 해당 기업에 대하여 이전에 계상하고 있던 기타포괄손익의 금액은 연결회사가 관련 자산과 부채를 직접 처분하였을 경우와 동일하게 회계처리하고 있습니다. 따라서 과거에 인식되었던 기타포괄손익 항목은 손익 또는 자본으로 재분류됩니다.

라. 비지배지분

당기순손익과 기타포괄손익의 각 구성요소는 지배회사의 소유주와 비지배지분에 귀속되며, 비지배지분이 부(-)의 잔액이 되더라도 총포괄손익은 지배회사의 소유주와 비지배지분에 귀속시키고 있습니다.

마. 관계기업

관계기업은 연결회사가 유의적 영향력을 행사할 수는 있으나 지배력은 없는 모든 기업으로, 일반적으로 회사가 의결권 있는 주식의 20% 내지 50%를 소유하고 있는 피투자 기업입니다. 관계기업 투자지분은 최초에 취득원가로 인식하며 지분법을 적용하여 회계처리합니다. 연결회사와 관계기업 간의 거래에서 발생한 미실현이익은 연결회사의 관계기업에 대한 지분에 해당하는 부분만큼 제거됩니다. 관계기업의 손실 중 연결회사의 지분이 관계기업에 대한 투자지분(순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분 포함)과 같거나 초과하는 경우에는 지분법 적용을 중지합니다. 단, 연결회사의 지분이 영(0)으로 감소된 이후 추가 손실분에 대하여 연결회사에 법적・의제의무가 있거나 관계기업을 대신하여 지급하여야 하는 경우 그 금액까지만 손실과 부채로 인식합니다. 또한 관계기업 투자에 대한 객관적인 손상의 징후가 있는 경우 관계기업 투자의 회수가능액과 장부금액과의 차이는 손상차손으로 인식됩니다. 연결회사는 지분법을 적용하기 위하여 관계기업의 재무제표를 이용할 때, 유사한 상황에서 발생한 동일한 거래나 사건에 대하여 연결회사가 적용하는 회계정책과 동일한 회계정책이 적용되었는지 검토하여 필요한 경우 관계기업의 재무제표를 조정합니다.

바. 공동약정

둘 이상의 당사자들이 공동지배력을 보유하는 공동약정은 공동영업 또는 공동기업으로 분류됩니다. 공동영업자는 공동영업의 자산과 부채에 대한 권리와 의무를 보유하며, 공동영업의 자산과 부채, 수익과 비용 중 자신의 몫을 인식합니다. 공동기업참여자는 공동기업의 순자산에 대한 권리를 가지며, 지분법을 적용합니다.

2.4 외화환산

가. 기능통화와 표시통화

연결회사는 연결회사 내 개별기업의 재무제표에 포함되는 항목들을 각각의 영업활동이 이루어지는 주된 경제 환경에서의 통화("기능통화")를 적용하여 측정하고 있습니다. 지배회사의 기능통화는 대한민국 원화(KRW)이며 연결재무제표는 대한민국 원화(KRW)로 표시되어 있습니다.

나. 외화거래와 보고기간종료일의 외화환산

외화거래는 거래일의 환율 또는 재측정되는 항목인 경우 평가일의 환율을 적용한 기능통화로 인식되고, 외화거래의 결제나 화폐성 외화 자산·부채의 환산에서 발생하는 외환차이는 당기손익으로 인식됩니다. 비화폐성 금융자산·부채로부터 발생하는 외환차이는 공정가치 변동손익의 일부로 보아 당기손익-공정가치 측정 지분상품으로부터 발생하는 외환차이는 당기손익에, 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 외환차이는 기타포괄손익에 포함하여 인식됩니다.

다. 표시통화로의 환산

연결회사의 표시통화와 다른 기능통화를 가진 모든 연결회사 내 개별기업의 경영성과와 재무상태는 다음과 같은 방법으로 연결회사의 표시통화로 환산되고 있습니다.

(1) 자산과 부채는 보고기간종료일의 마감환율로 환산되고 있습니다.
(2) 손익계산서의 수익과 비용은 해당 기간의 평균환율로 환산되고 있습니다.
다만, 이러한 평균환율이 거래일의 전반적인 누적환율효과에 대한 합리적인 근사치가 아닐 경우에는 해당 거래일의 환율로 환산되고 있습니다.
(3) 위 (1), (2)의 환산에서 발생하는 외환차이는 기타포괄손익으로 인식됩니다.

2.5 현금및현금성자산

현금및현금성자산은 보유중인 현금, 요구불예금 및 취득일 현재 확정된 금액의 현금으로 전환이 용이하고, 가치변동의 위험이 경미한 매우 유동적인 단기 투자자산으로 구성되어 있습니다.

2.6 금융자산

가. 분류

연결회사는 기준서 제1109호 '금융상품'의 최초적용일 2018년 1월 1일부터 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다.
- 공정가치 측정 금융자산 (기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식)
- 상각후원가 측정 금융자산

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 분류합니다.

공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 연결회사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.

단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식 시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

나. 측정

연결회사는 최초 인식 시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.

내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

(1) 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 연결회사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.

① 상각후원가 측정 금융자산
계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.

② 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 모두를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 표시하고손상차손은 '기타비용'으로 표시합니다.

③ 당기손익-공정가치 측정 금융자산
상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

(2) 지분상품

연결회사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않고 제거되는 시점에 자본에 누적된 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익을 이익잉여금으로 대체합니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 연결회사가 배당을 받을 권리가 확정된 때에 손익계산서에 '기타수익'으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

다. 손상

연결회사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 연결회사는 채권의 최초 인식 시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

라. 인식과 제거

금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다. 연결회사가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행 시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 연결회사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다. 해당 금융부채는 재무상태표에 '차입금'으로 분류하고 있습니다.

마. 금융상품의 상계

금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다.

2.7 매출채권

매출채권은 정상적인 영업과정에서 판매된 재고자산 및 제공된 용역과 관련하여 고객으로부터 수취할 금액입니다. 매출채권의 회수가 1년 이내에 예상되는 경우 유동자산으로 분류하고, 그렇지 않은 경우 비유동자산으로 분류합니다. 매출채권은 유의적인 금융요소를 포함하지 않는 경우를 제외하고는 최초에 거래가격으로 인식하며, 유효이자율을 적용한 상각후원가에서 손실충당금을 차감하여 측정하고 있습니다.

2.8 재고자산

재고자산은 원가와 순실현가능가치 중 작은 금액으로 표시하고 있습니다. 원가는 미착품을 제외하고는 평균법에 따라 결정하고 있습니다. 제품과 재공품의 원가는 원재료비, 직접노무비 및 기타 직접원가와 정상조업도에 근거한 관련 제조간접비로 이루어지며, 유휴생산설비 원가나 폐기비용은 제외하고 있습니다. 순실현가능가치는 정상적인 영업과정에서의 추정 판매가격에서 적용 가능한 변동 판매비용을 차감한 금액입니다.

연결회사는 주기적으로 재고자산평가충당금의 중요한 변동을 발생시킬 가능성이 있는 미래의 제품 수요 등을 검토하여 과잉, 진부화 및 시장가치의 하락 등이 발생한 경우 재고자산평가충당금을 계상하고 있으며 재고자산평가손실을 '매출원가'로 처리하고 있습니다.

2.9 유형자산

유형자산은 역사적 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 역사적 원가는 자산의 취득에 직접적으로 관련된 지출을 포함합니다. 후속원가는 자산으로부터 발생하는 미래의 경제적 효익이 연결회사에 유입될 가능성이 높으며 그 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 한하여 자산의 장부금액에 포함하거나 별도의 자산으로 인식하고 있습니다. 대체된 부분의 장부금액은 제거하고 있으며 그 외의 모든 수선 및 유지비는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

연결회사의 유형자산은 취득원가에서 연결회사가 추정한 추정내용연수에 따라 정액법에 의하여 상각됩니다. 토지는 상각되지 않으며, 자본화차입금이자를 포함한 장기건설자산의 취득에 사용된 원가는 관련 자산의 추정내용연수 동안 상각됩니다.

자산별로 연결회사가 사용하고 있는 대표추정내용연수는 다음과 같습니다.

구 분	대표추정내용연수
건물 및 구축물	15, 30 년
기계장치	5 년
기타	5 년

연결회사는 매 회계연도 말에 유형자산의 감가상각방법, 잔존가치와 경제적 내용연수를 검토하고 필요한 경우 조정을 하고 있습니다. 자산의 장부금액이 추정 회수가능액을 초과하는 경우 자산의 장부금액을 회수가능액으로 즉시 감소시키고 있습니다. 자산의 처분손익은 처분대가와 자산의 장부금액의 차이로 결정되며, 손익계산서에
'기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시하고 있습니다.

2.10 차입원가

적격자산을 취득 또는 건설하는데 발생한 차입원가는 해당 자산을 의도된 용도로 사용할 수 있도록 준비하는 기간 동안 자본화되고, 적격자산을 취득하기 위한 특정목적
차입금의 일시적 운용에서 발생한 투자수익은 당 회계기간 동안 자본화 가능한 차입원가에서 차감됩니다. 기타 차입원가는 발생기간에 비용으로 인식됩니다.

2.11 무형자산

영업권은 취득 시점에 취득하는 종속기업, 관계기업 및 공동기업, 사업 등의 순식별가능자산에 대한 연결회사의 지분에 해당하는 공정가치를 초과하여 지급한 대가에 해당하며 종속기업의 사업취득과 관련된 건은 무형자산으로, 관계기업 및 공동기업의 지분 취득과 관련한 건은 관계기업 및 공동기업 투자에 포함하여 계상하고 있습니다.

영업권을 제외한 무형자산은 역사적 원가로 최초 인식되고, 원가에서 상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액으로 표시됩니다.

내부적으로 창출한 무형자산인 개발비는 기술적 실현가능성, 미래경제적효익 등을 포함한 자산 인식요건이 충족된 시점 이후에 발생한 지출금액의 합계입니다. 회원권 및 특정 상표권은 이용 가능 기간에 대하여 예측가능한 제한이 없으므로 내용연수가 한정되지 않아 상각되지 않습니다. 하지만 회원권의 시장가치 하락 등 손상 징후 발견 시 합리적으로 추정하여 손상을 반영합니다. 특허권, 상표권 및 기타무형자산 등 한정된 내용연수를 가지는 무형자산은 추정내용연수동안 정액법에 따라 상각하고 있습니다.

자산별 대표추정내용연수는 다음과 같습니다.

구 분	대표추정내용연수
개발비	2년
특허권, 상표권 및 기타무형자산	3년 ~ 25년

2.12 비금융자산의 손상

영업권이나 비한정내용연수를 가진 무형자산은 상각하지 않고 매년 손상검사를 실시하고 있습니다. 상각하는 자산의 경우 매 보고기간종료일에 장부금액이 회수가능하지 않을 수도 있음을 나타내는 환경의 변화나 사건이 있을 때마다 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상차손은 회수가능액을 초과하는 장부금액만큼 인식하고 있습니다. 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다. 손상을 측정하기 위한 목적으로 자산은 별도로 식별 가능한 현금흐름을 창출하는 가장 하위 수준의 집단(현금창출단위)으로 그룹화하고 있습니다. 손상차손을 인식한 경우, 영업권이외의 비금융자산은 매 보고기간종료일에 손상차손의 환입가능성을 검토하고 있습니다.

2.13 매각예정분류(처분자산집단)

비유동자산(또는 처분자산집단)은 장부금액이 매각거래를 통하여 주로 회수되고, 매각될 가능성이 매우 높은 경우에 매각예정으로 분류되며, 그러한 자산은 장부금액과 순공정가치 중 작은 금액으로 측정됩니다. 매각예정분류(처분자산집단) 처분손익은 처분대가와 자산의 장부금액의 차이로 결정되며, 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시하고 있습니다.

2.14 금융부채

가. 분류 및 측정

모든 금융부채는 다음을 제외하고는 후속적으로 상각후원가로 측정되도록 분류합니다.

(1) 당기손익-공정가치 측정 금융부채
파생상품부채를 포함한 이러한 부채는 후속적으로 공정가치로 측정합니다.
(2) 금융자산의 양도가 제거 조건을 충족하지 못하거나 지속적 관여 접근법이 적용되는 경우에 생기는 금융부채
이러한 금융부채는 주석 2.6 금융자산의 내용을 적용하여 측정합니다.
(3) 금융보증계약
최초 인식 시 공정가치로 측정되며, 이후에 이러한 계약의 발행자는 해당 계약을 후속적으로 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
- 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
- 최초 인식금액에서 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
(4) 시장이자율보다 낮은 이자율로 대출하기로 한 약정
최초 인식 후에 이러한 약정의 발행자는 후속적으로 해당 약정을 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
- 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
- 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
(5) 기준서 제1103호를 적용하는 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가
이러한 조건부 대가는 후속적으로 당기손익-공정가치로 측정합니다.

나. 제거

금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다. 소멸하거나 제3자에게 양도한 금융부채의 장부금액과 지급한 대가(양도한 비현금자산이나 부담한 부채를 포함)의 차액은 당기손익으로 인식합니다.

2.15 매입채무

매입채무는 정상적인 영업과정에서 공급자로부터 취득한 재고자산 및 제공받은 용역과 관련하여 지급할 의무가 있는 금액입니다. 매입채무의 지급이 12개월 이내에 예상되는 경우 유동부채로 분류하고, 그렇지 않은 경우 비유동부채로 분류합니다. 매입채무는 최초에 공정가치로 인식하며, 후속적으로 유효이자율법을 사용한 상각후원가로 측정하고 있습니다.

2.16 차입금

차입금은 최초에 공정가치에서 거래비용을 차감한 가액으로 인식하며, 후속적으로 상각후원가로 측정하고 있습니다. 거래비용 차감 후 수취한 금액과 상환금액의 차이는 유효이자율법으로 상각하여 차입기간 동안 손익계산서에 인식하고 있습니다. 또한, 보고기간종료일 이후 12개월 이상 결제를 이연할 수 있는 무조건적인 권리가 있는 경우 비유동부채로 분류하며, 그렇지 않은 경우 유동부채로 분류하고 있습니다.

2.17 충당부채 및 우발부채

과거사건의 결과로 현재의 법적의무나 의제의무가 존재하고, 그 의무를 이행하기 위한 자원의 유출가능성이 높으며, 당해 금액의 신뢰성 있는 추정이 가능한 경우 연결회사는 충당부채를 인식하고 있습니다. 미래영업손실에 대하여는 충당부채를 인식하지 않습니다.

충당부채는 의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재가치로 측정하며, 현재가치 평가에 사용하는 할인율은 그 부채의 고유한 위험과 화폐의 시간가치에 대한 현행 시장의 평가를 반영한 세전이자율입니다. 시간경과로 인한 충당부채의 증가는 이자비용으로 인식하고 있습니다.

또한, 과거사건은 발생하였으나 불확실한 미래사건의 발생 여부에 의해서 존재 여부가 확인되는 잠재적인 의무가 있는 경우 또는 과거사건이나 거래의 결과 현재 의무가 존재하나 자원이 유출될 가능성이 높지 않거나 당해 의무를 이행하여야 할 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우 우발부채로 주석에 기재하고 있습니다.

2.18 종업원급여

연결회사는 확정급여제도와 확정기여제도를 포함하는 다양한 형태의 퇴직연금제도를 운영하고 있습니다.

확정기여제도는 연결회사가 고정된 금액의 기여금을 별도 기금에 지급하는 퇴직연금제도입니다. 해당 기금이 현재나 과거 기간의 종업원 용역과 관련하여 지급하여야 할 급여 전액을 지급하기에 충분한 자산을 보유하지 못하는 경우에도 연결회사는 추가적인 기여금을 납부할 법적 의무나 의제의무를 부담하지 않습니다. 확정기여제도와 관련하여 연결회사는 상장되거나 비상장으로 관리되고 있는 연금보험제도에 의무적으로나 계약에 의해 또는 자발적으로 기여금을 지급하고 있습니다. 기여금이 지급된 이후에 연결회사는 더 이상의 미래 의무를 부담하지 않습니다. 기여금은 종업원이 근무 용역을 제공했을 때 비용으로 인식됩니다. 선급 기여금은 초과 기여금으로 인해 미래 지급액이 감소하거나 현금이 환급되는 만큼을 자산으로 인식하고 있습니다.

확정급여제도는 확정기여제도를 제외한 모든 퇴직연금제도입니다. 일반적으로 확정급여제도는 연령, 근속연수나 급여수준 등의 요소에 의해 종업원이 퇴직할 때 지급받을 퇴직연금급여의 금액을 확정하고 있습니다. 확정급여제도와 관련하여 재무상태표에 계상된 부채(자산)는 보고기간종료일 현재 확정급여채무의 현재가치에 사외적립자산의 공정가치를 차감한 과소적립액(자산인식상한을 한도로 하는 초과적립액)입니다. 확정급여채무는 매년 독립된 보험계리인에 의해 예측단위적립방식에 따라 산정됩니다. 확정급여채무의 현재가치는 급여가 지급될 통화로 표시되고 관련 확정급여채무의 지급 시점과 만기가 유사한 우량회사채의 이자율로 기대미래현금유출액을 할인하여 산정하고 있습니다.

보험수리적 가정의 변경 및 보험수리적 가정과 실제로 발생한 결과의 차이로 인해 발생하는 보험수리적손익은 발생한 기간의 기타포괄손익으로 인식하고 있으며, 제도개정, 축소 또는 정산이 발생하는 경우 과거근무원가 또는 정산으로 인한 손익은 발생 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다.

2.19 금융보증계약

금융보증계약은 채무상품의 최초 계약조건이나 변경된 계약조건에 따라 지급기일에 특정 채무자가 지급하지 못하여 보유자가 입은 손실을 보상하기 위하여 특정 금액을 지급하여야 하는 계약입니다.

연결회사가 제공한 금융보증계약은 최초 인식 시 공정가치로 측정되며, 후속적으로는 다음 중 큰 금액으로 측정하여 기타금융부채로 인식됩니다.
(1) 금융상품의 손상 규정에 따라 산정한 손실충당금
(2) 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액

2.20 당기법인세 및 이연법인세

연결회사의 법인세비용은 당기법인세와 이연법인세로 구성됩니다. 법인세는 기타포괄손익이나 자본에 직접 인식된 항목과 관련된 금액은 해당 항목에서 직접 인식하며, 이를 제외하고는 당기손익으로 인식됩니다. 법인세비용은 보고기간종료일 현재 제정되었거나 실질적으로 제정된 세법에 기초하여 측정됩니다.

이연법인세는 자산과 부채의 장부금액과 세무기준액의 차이로 정의되는 일시적차이에 대하여 장부금액을 회수하거나 결제할 때의 예상 법인세효과로 인식됩니다. 다만, 사업결합 이외의 거래에서 자산·부채를 최초로 인식할 때 발생하는 이연법인세자산과 부채는 그 거래가 회계이익이나 과세소득에 영향을 미치지 않는다면 인식되지 않습니다. 이연법인세자산은 차감할 일시적차이가 사용될 수 있는 미래 과세소득의 발생가능성이 높은 경우에 인식됩니다.

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자지분과 관련된 가산할 일시적차이에 대하여 소멸 시점을 통제할 수 있고 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸하지 않을 가능성이 높은 경우를 제외하고 이연법인세부채를 인식하고 있습니다. 또한 이러한 자산으로부터 발생하는 차감할 일시적차이에 대하여 일시적차이가 예측가능한 미래에 소멸할가능성이 높고 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득이 발생할 가능성이 높은 경우에만 이연법인세자산을 인식하고 있습니다.

이연법인세자산과 부채는 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한 권리를 연결회사가 보유하고, 이연법인세자산과 부채가 동일한 과세당국에 의해서 부과되는 법인세와 관련이 있으면서 순액으로 결제할 의도가 있는 경우에 상계됩니다.

2.21 파생상품

연결회사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피와 해외사업장에 대한 순투자에 대한 위험회피 금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

연결회사는 재고자산의 가격 변동 위험 등을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 현금흐름위험회피 대상으로 지정되어 적용요건을 충족하는 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 인식하고, 비효과적인 부분은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 인식하고 있습니다.

2.22 배당금

배당금은 연결회사의 주주에 의해 승인된 시점에 부채로 인식하고 있습니다.

2.23 자본금

보통주와 상환의무 없는 우선주는 모두 자본으로 분류하고 있습니다. 회사 또는 종속기업이 회사의 보통주를 취득하는 경우, 직접거래원가를 포함하는 지급 대가는 그 보통주가 소각되거나 재발행 될 때까지 연결회사의 자본에서 차감하여 표시하고 있습니다. 이러한 자기주식이 재발행되는 경우, 수취한 대가는 연결회사의 주주에게 귀속되는 자본에 포함하고 있습니다.

2.24 수익인식

수익은 주로 연결회사의 통상적인 활동에서 발생하는 재화의 판매에 대하여 받았거나 받을 대가의 공정가액으로 구성되어 있습니다. 수익은 부가가치세, 반품, 판매장려금 및 가격 할인액을 차감한 순액으로 표시하며, 내부거래를 제거한 후의 금액으로 표시하고 있습니다.

연결회사는 2018년 1월 1일부터 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 제1115호에 따르면 모든 유형의 계약에 5단계 수익인식모형(① 계약 식별 → ② 수행의무 식별 → ③ 거래가격 산정 → ④ 거래가격을 수행의무에 배분 → ⑤ 수행의무 이행 시 수익 인식)을 적용하여 수익을 인식합니다.

(1) 수행의무의 식별

연결회사는 Incoterms Group C 조건(무역조건 CIF 등)에 따라 다양한 제품 및 상품을 수출하고 있습니다. 고객에게 통제가 이전된 이후 매도인이 운송서비스를 제공하므로 해당 운송서비스(보험 포함)를 별도의 수행의무로 인식합니다.

(2) 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무

연결회사는 조달청을 통해 수주되는 시스템에어컨 도급공사계약에 따라 고객에게 제품을 납품하고 설치를 수행하고 있습니다. 기준서 제1115호에 따르면 기업이 수행하여 만들어지거나 가치가 높아지는 대로 고객이 통제하는 자산을 기업이 만들거나 그 자산가치를 높이는 경우 진행기준을 적용하여 수익을 인식하여야 합니다. 이에 따라 시스템에어컨 설치용역의 경우 용역 수행 경과에 따른 결과물을 고객이 직접 통제하기 때문에 진행기준을 적용하여 수익을 인식합니다.

(3) 변동대가

연결회사는 할인 등 고객과 약속한 대가에 변동가능성이 있는 경우, 고객으로부터 이미 받았거나 받을 대가 중 권리를 갖지 않을 것으로 예상하는 금액(변동대가)을 기대값 또는 가능성이 가장 높은 금액 중 보다 신뢰성 있는 방법으로 추정합니다. 이미 인식한 누적 수익금액 중 유의적인 부분을 되돌리지 않을 가능성이 매우 높은 금액까지만 거래가격에 포함하여 수익을 인식하며, 연결회사가 이미 받았거나 받을 대가 중에서 권리를 갖지 않는 것으로 예상하는 금액은 계약부채로 분류합니다.

연결회사는 고객에게 제품 판매 후 고객이 반품할 것으로 예상되는 제품에 대해 경험률에 기초한 기댓값 방법으로 반품율을 예측하여 계약부채(환불부채)를 인식하고 있습니다. 고객이 반품 권리를 행사할 때 고객으로부터 제품을 회수할 권리를 가지므로그 자산을 환불자산으로 인식하고 해당 금액만큼 매출원가를 조정합니다. 제품을 회수할 권리는 제품의 과거 장부금액에서 제품을 회수하는데 드는 원가를 차감하여 측정합니다.

(4) 거래가격의 배분

연결회사는 하나의 계약에서 식별된 여러 수행의무에 상대적 개별 판매가격을 기초로 거래가격을 배분합니다. 각 수행의무의 개별 판매가격을 추정하기 위하여 '시장평가 조정 접근법' 등을 사용합니다.

2.25 리스

리스는 리스제공자가 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정기간 리스이용자에게 이전하는 계약입니다.

연결회사는 계약의 약정 시점에, 계약 자체가 리스인지, 계약이 리스를 포함하는지를 판단합니다. 다만 연결회사는 기준서 제1116호 '리스' 최초적용일인 2019년 1월 1일 이전 계약에 대해서는 실무적 간편법을 적용하여 모든 계약에 대해 다시 판단하지 않았습니다.

리스이용자 및 리스제공자는 리스계약이나 리스를 포함하는 계약에서 계약의 각 리스요소를 리스가 아닌 요소(이하 "비리스요소")와 분리하여 리스로 회계처리합니다. 다만, 연결회사는 리스이용자로서의 회계처리에서 실무적 간편법을 적용하여 비리스요소를 리스요소와 분리하지 않고 각 리스요소와 관련 비리스요소를 하나의 리스요소로 회계처리합니다.

(1) 리스이용자

연결회사는 리스개시일에 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산(리스자산)과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다.

사용권자산은 최초 인식 시 원가로 측정하고, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하고, 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다. 또한 사용권자산은 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간
종료일 중 이른 날까지의 기간동안 감가상각합니다. 사용권자산은 재무상태표에 '유형자산'으로 분류합니다.

리스부채는 리스개시일에 그날 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정합니다. 현재가치 측정 시 리스의 내재이자율로 리스료를 할인하되, 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 회사의 증분차입이자율로 리스료를 할인하고 있습니다. 리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의 지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지나 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다. 리스부채는 재무상태표에 '유동성장기부채' 또는 '장기차입금'으로 분류합니다.

단기리스(리스개시일에 리스기간이 12개월 이하)와 소액자산 리스(기초자산 US$ 5,000 이하)의 경우 실무적 간편법을 적용하여 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 비용을 인식합니다.

(2) 리스제공자

리스제공자의 회계처리는 2019년 1월 1일 기준서 제1116호를 최초 적용하기 전의 회계정책과 유의적으로 변동되지 않았습니다.

연결회사는 리스약정일에 리스자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는 리스는 금융리스로 분류하고, 금융리스 이외의 모든 리스는 운용리스로 분류합니다. 운용리스로부터 발생하는 리스료 수익은 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 인식하고, 운용리스의 협상 및 계약 단계에서 발생한 리스개설 직접원가는 리스자산의 장부금액에 가산한 후 리스료 수익에 대응하여 리스기간 동안 비용으로 인식합니다.

2.26 정부보조금

정부보조금은 보조금의 수취와 정부보조금에 부가된 조건의 준수에 대한 합리적인 확신이 있을 때 공정가치로 인식됩니다. 수익과 관련된 정부보조금은 이연하여 정부보조금의 교부목적과 관련된 수익 또는 비용과 대응될 수 있는 기간에 손익계산서에 인식하고 있습니다. 한편, 특정 자산의 취득과 관련된 정부보조금은 이연수익으로 처리하고, 정부보조금 관련 이연수익은 관련 자산의 내용연수 동안 상각하여 손익으로 반영하고 있습니다.

2.27 주당이익

기본주당이익은 주주에게 귀속되는 손익계산서상 당기순이익을 보고기간 동안의 연결회사의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정한 것입니다.

희석주당이익은 주주에게 귀속되는 손익계산서상 당기순이익을 보고기간 동안의 연결회사의 가중평균 유통보통주식수와 가중평균 잠재적 희석증권주식수로 나누어 산정한 것입니다. 잠재적 희석증권은 희석효과가 발생하는 경우에만 희석주당이익의 계산에 반영됩니다.

2.28 보고부문

보고부문은 최고영업의사결정자에게 보고되는 부문별로 공시되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 부문에 배부될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하는데 책임이 있으며, 전략적 의사결정을 수행하는 경영위원회를 최고의사결정자로 보고 있습니다.

2.29 연결재무제표의 승인

연결회사의 연결재무제표는 2023년 1월 31일 이사회에서 승인되었으며, 향후 정기주주총회에서 수정 승인될 수 있습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정:

연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 특히 2020년부터 발생한 코로나19(COVID-19)의 확산으로 연결회사의 추정 및 가정에 영향이 발생할 수 있으나, 당기말 현재 그 영향을 합리적으로 추정할 수 없습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다.

가. 수익인식

연결회사는 고객에게 제품 판매 후 고객이 반품할 것으로 예상되는 제품에 대하여 환불부채와 회수할 재화에 대한 권리를 인식하고 있습니다. 판매 시점에 포트폴리오 수준에서 누적된 경험에 기초하여 기댓값 방법으로 반품률을 예측하고 있으며, 연결회사의 수익은 예측된 반품률의 변동에 영향을 받습니다.

연결회사는 재화의 판매로 인한 수익을 통제가 이전되는 시점에 계약에 따른 대가에서 특정 매출장려활동을 차감한 금액으로 인식하고 있습니다. 과거의 경험 및 계약에 기초하여 매출차감액을 합리적으로 추정하고 있으며, 연결회사의 수익은 추정된 매출차감에 영향을 받습니다.

나. 판매보증충당부채

연결회사는 판매한 제품에 대하여 품질에 대한 보증의무를 부담하고 있습니다. 연결회사는 매 보고기간종료일 미래와 현재의 보증의무를 제공하는데 필요하다고 판단되는 최선의 추정치를 기준으로 보증충당부채를 계상하고 있습니다. 이러한 최선의 추정치는 과거 경험에 기초하여 결정하고 있습니다.

다. 금융상품의 공정가치

연결회사는 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치에 대하여 보고기간종료일 현재 주요한 시장상황을 기초로 다양한 평가기법 및 가정을 사용하여 결정하고 있습니다.

라. 금융자산의 손상

연결회사는 금융자산의 손실충당금을 측정할 때에 채무불이행위험과 기대신용률에 대한 가정에 근거하였습니다. 연결회사는 이러한 가정을 세우고 손상 계산을 위한 투입요소를 선택할 때 보고기간종료일의 미래 전망에 대한 추정 및 과거 경험, 현재 시장 상황에 근거하여 판단합니다.

마. 리스

연결회사는 리스기간을 산정할 때에 연장선택권을 행사하거나 종료선택권을 행사하지 않을 경제적 유인이 생기게 하는 관련되는 사실 및 상황을 모두 고려합니다. 연장선택권의 대상 기간(또는 종료선택권의 대상 기간)은 리스이용자가 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한 경우에만 리스기간에 포함됩니다.

선택권이 실제로 행사되거나(행사되지 않거나) 연결회사가 선택권을 행사할(행사하지 않을) 의무를 부담하게 되는 경우에 리스기간을 다시 평가합니다. 리스이용자가 통제할 수 있는 범위에 있고 리스기간을 산정할 때에 영향을 미치는 유의적인 사건이 일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때에만 연결회사는 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한지의 판단을 변경합니다.

바. 순확정급여부채(자산)

순확정급여부채(자산)는 많은 가정을 사용하는 보험수리적 방식에 의해 결정되는 다양한 요소들에 따라 달라질 수 있습니다. 퇴직연금의 순원가(이익)를 결정하는 데 사용되는 가정은 할인율을 포함하고 있으며, 이러한 가정의 변동은 순확정급여부채(자산)의 장부금액에 영향을 줄 것입니다. 연결회사는 매년 말 우량회사채 이자율을 고려하여 적절한 할인율을 결정하고 있으며, 이러한 할인율은 순확정급여부채(자산)의 정산 시 발생할 것으로 예상되는 미래의 추정 현금 유출액의 현재가치를 결정할 때 사용되어야 하는 이자율을 나타냅니다. 순확정급여부채(자산)와 관련된 다른 주요한 가정들은 일부 현재의 시장 상황에 근거하고 있습니다.

사. 영업권 및 내용연수가 비한정인 무형자산의 손상

연결회사는 매년 영업권 및 내용연수가 비한정인 무형자산의 손상 여부를 검토하고 있습니다. 현금창출단위 또는 자산의 회수가능금액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정하고 있습니다. 이러한 계산은 추정에 근거하여 이루어집니다.

아. 법인세

연결회사의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. 연결회사는 보고기간종료일 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세효과를 최선의 추정과정을 거쳐 당기법인세 및 이연법인세로 인식하였습니다. 하지만 실제 미래 최종 법인세부담은 인식한 관련 자산·부채와 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 차이는 최종 세효과가 확정된 시점의 당기법인세 및 이연법인세 자산·부채에 영향을 줄 수 있습니다.

연결회사는 특정 기간 동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을 때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 연결회사가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다.

연결회사는 법인세 처리의 불확실성 여부를 검토하고 있으며, 과세당국이 불확실한 법인세 처리를 수용할 가능성이 높지 않다고 결론 내리는 경우에는 불확실한 법인세 처리 각각에 다음 방법 가운데 불확실성의 해소를 더 잘 예측할 것으로 예상하는 방법을 사용하여 불확실성의 영향을 연결재무제표에 반영하고 있습니다.

(1) 가능성이 가장 높은 금액: 가능한 결과치 범위에서 가능성이 가장 높은 단일금액
(2) 기댓값: 가능한 결과치의 범위에 있는 모든 금액에 각 확률을 곱한 금액의 합

4. 범주별 금융상품:

가. 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	49,680,710	-	-	-	49,680,710
단기금융상품	65,102,886	-	-	-	65,102,886
단기상각후원가금융자산	414,610	-	-	-	414,610
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	29,080	-	29,080
매출채권	35,721,563	-	-	-	35,721,563
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	11,397,012	-	-	11,397,012
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,405,468	-	1,405,468
기타	9,945,209	-	334,263	61,404	10,340,876
계	160,864,978	11,397,012	1,768,811	61,404	174,092,205

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	10,644,686	-	-	10,644,686
단기차입금	1,577,958	-	3,569,357	5,147,315
미지급금	16,328,237	-	-	16,328,237
유동성장기부채	215,143	-	874,019	1,089,162
사채	536,093	-	-	536,093
장기차입금	33,846	-	3,526,826	3,560,672
장기미지급금	2,289,236	-	-	2,289,236
기타	12,047,761	334,415	27,353	12,409,529
계	43,672,960	334,415	7,997,555	52,004,930

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	39,031,415	-	-	-	39,031,415
단기금융상품	81,708,986	-	-	-	81,708,986
단기상각후원가금융자산	3,369,034	-	-	-	3,369,034
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	40,757	-	40,757
매출채권	40,713,415	-	-	-	40,713,415
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	13,965,839	-	-	13,965,839
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,525,344	-	1,525,344
기타	8,711,973	-	279,127	49,089	9,040,189
계	173,534,823	13,965,839	1,845,228	49,089	189,394,979

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	13,453,351	-	-	13,453,351
단기차입금	2,131,692	-	11,556,101	13,687,793
미지급금	14,126,970	-	-	14,126,970
유동성장기부채	518,065	-	811,903	1,329,968
사채	508,232	-	-	508,232
장기차입금	1,500	-	2,864,656	2,866,156
장기미지급금	2,562,158	-	-	2,562,158
기타	10,444,290	323,526	13,868	10,781,684
계	43,746,258	323,526	15,246,528	59,316,312

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

나. 금융상품 범주별 순손익 구분

(1) 당기

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
평가손익(기타포괄손익)	-	(1,969,498)	-	53,180	(1,916,318)
평가 · 처분손익(당기손익)	(36,550)	-	83,332	474	47,256
평가손익(손익대체)	-	-	-	310	310
이자수익	2,720,213	-	266	-	2,720,479
외환차이(당기손익)	(822,011)		-	-	(822,011)
배당금수익	-	413,467	1,134	-	414,601
손상(환입)	(19,124)	-	-	-	(19,124)

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
평가손익(기타포괄손익)	-	-	(10,621)	(10,621)
평가 · 처분손익(당기손익)	-	(91,056)	(45)	(91,101)
평가손익(손익대체)	-	-	59	59
이자비용	(322,529)	-	(440,486)	(763,015)
외환차이(당기손익)	574,771	-	155,952	730,723

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
평가손익(기타포괄손익)	-	2,980,896	-	27,715	3,008,611
평가·처분손익(당기손익)	(1,969)	-	420,100	437	418,568
평가손익(손익대체)	-	-	-	(148)	(148)
이자수익	1,278,051	-	227	-	1,278,278
외환차이(당기손익)	29,834	-	-	-	29,834
배당금수익	-	133,532	2,308	-	135,840
손상(환입)	(27,194)	-	-	-	(27,194)

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
평가손익(기타포괄손익)	-	-	22,695	22,695
평가·처분손익(당기손익)	-	(65,368)	-	(65,368)
평가손익(손익대체)	-	-	(121)	(121)
이자비용	(213,477)	-	(218,063)	(431,540)
외환차이(당기손익)	362,820	-	3,447	366,267

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

5. 금융자산의 양도:

연결회사는 당기 및 전기 중 은행과의 매출채권 팩토링 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 연결회사가 매출채권 팩토링 거래에서 제공한 매출채권은 채무자의 채무불이행 시의 소구조건 등으로 대부분의 위험과 보상을 연결회사가 보유하므로 금융자산의 제거요건을 충족하지 않아 제거되지 않았습니다. 이러한 거래에서 인식한 금융부채는 재무상태표에 '단기차입금'으로 분류되어 있습니다(주석 12 참조).

보고기간종료일 현재 매출채권의 할인된 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말
할인된 매출채권의 장부금액(*)	3,569,357	11,556,101
관련 차입금의 장부금액	3,569,357	11,556,101

(*) 할인된 매출채권에는 연결회사 간의 매출채권이 포함되어 있습니다.

6. 공정가치금융자산:

가. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기타포괄손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말
비유동항목:		
지분상품	11,397,012	13,965,839

(2) 당기손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말
유동항목:		
채무상품	29,080	40,757
비유동항목:		
지분상품	773,063	905,094
채무상품	632,405	620,250
소 계	1,405,468	1,525,344
계	1,434,548	1,566,101

나. 당기 및 전기 중 비유동 공정가치금융자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기타포괄손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
기초	13,965,839	12,575,216
취득	35,013	1,146,868
처분	(20,913)	(3,551,604)
공정가치평가	(2,636,448)	3,653,253
기타	53,521	142,106
기말	11,397,012	13,965,839

(2) 당기손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
기초	1,525,344	1,202,969
취득	158,244	208,262
처분	(80,718)	(142,406)
공정가치평가	(198,594)	275,447
기타	1,192	(18,928)
기말	1,405,468	1,525,344

다. 당기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익의 변동 내역은 다음과같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
기초	6,222,980	7,071,415
공정가치평가	(2,636,448)	3,653,253
처분으로 인한 이익잉여금 대체	49,946	(4,501,688)
기말	3,636,478	6,222,980
차감: 자본에 가감되는 법인세효과 및 비지배지분	(887,369)	(1,606,341)
계	2,749,109	4,616,639

라. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

기 업 명	당기말				전기말
	보유주식수 (주)	지분율(%) (*)	취득원가	장부금액 (시장가치)	장부금액 (시장가치)
삼성중공업㈜	134,027,281	15.2	932,158	684,879	759,935
㈜호텔신라	2,004,717	5.1	13,957	166,592	156,368
㈜아이마켓코리아	647,320	1.9	324	6,538	6,926
㈜에스에프에이	3,644,000	10.2	38,262	132,642	131,366
㈜원익홀딩스	3,518,342	4.6	30,821	13,536	17,521
㈜원익아이피에스	3,701,872	7.5	32,428	91,621	156,589
ASML Holding N.V.	6,297,787	1.5	363,012	4,287,121	5,974,280
Wacom Co., Ltd.	8,398,400	5.1	62,013	46,750	79,256
BYD Company Limited	2,380,100	0.1	79,049	110,971	118,862
Corning Incorporated	80,000,000	9.5	3,980,636	3,238,205	3,530,893
기타			563,635	742,890	1,155,113
계			6,096,295	9,521,745	12,087,109

(*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

7. 매출채권 및 미수금:

가. 보고기간종료일 현재 매출채권 및 미수금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말		전기말	
	매출채권	미수금	매출채권	미수금
채권액	36,238,032	7,051,536	41,250,034	5,572,176
차감: 손실충당금	(312,221)	(78,101)	(310,880)	(72,805)
소 계	35,925,811	6,973,435	40,939,154	5,499,371
차감: 장기 채권	(204,248)	(824,226)	(225,739)	(1,002,114)
유동항목	35,721,563	6,149,209	40,713,415	4,497,257

나. 당기 및 전기 중 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기		전기	
	매출채권	미수금	매출채권	미수금
기초	310,880	72,805	318,731	59,487
대손상각(환입)	8,784	7,312	17,990	9,009
제각	(3,557)	(6,154)	(19,095)	(2,424)
기타	(3,886)	4,138	(6,746)	6,733
기말	312,221	78,101	310,880	72,805

다. 보고기간종료일 현재 기대신용손실을 측정하기 위해 연체일을 기준으로 구분한 매출채권 및 미수금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말		전기말	
	매출채권	미수금	매출채권	미수금
연체되지 않은 채권	33,177,298	5,890,018	39,677,264	5,125,414
연체된 채권(*):				
31일 이하	2,206,622	981,889	1,229,479	196,783
31일 초과 90일 이하	642,859	52,972	36,545	51,804
90일 초과	211,253	126,657	306,746	198,175
소 계	3,060,734	1,161,518	1,572,770	446,762
계	36,238,032	7,051,536	41,250,034	5,572,176

(*) 연결회사는 31일 이하 연체된 매출채권 및 미수금은 신용이 손상된 것으로 간주하지 않습니다.

라. 보고기간종료일 현재 신용위험의 최대 노출금액은 채권의 장부금액입니다. 연결회사의 주요 채권과 관련하여 보험사와 보험계약을 체결하고 있습니다.

8. 재고자산:

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말			전기말		
	평가전금액	평가충당금	장부금액	평가전금액	평가충당금	장부금액
제품 및 상품	17,526,178	(1,493,952)	16,032,226	13,000,200	(719,621)	12,280,579
반제품 및 재공품	21,612,965	(1,535,446)	20,077,519	13,967,331	(493,713)	13,473,618
원재료 및 저장품	16,268,974	(1,289,694)	14,979,280	14,864,486	(679,645)	14,184,841
미착품	1,098,841	-	1,098,841	1,445,366	-	1,445,366
계	56,506,958	(4,319,092)	52,187,866	43,277,383	(1,892,979)	41,384,404

당기 중 비용으로 인식한 재고자산의 금액은 186,396,549백만원(전기: 164,319,031백만원)입니다. 동 비용에는 재고자산평가손실 금액이 포함되어 있습니다.

9. 관계기업 및 공동기업 투자:

가. 당기 및 전기 중 관계기업 및 공동기업 투자의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
기초	8,932,251	8,076,779
취득	1,006,998	47,090
처분	(20,894)	(34,664)
이익 중 지분해당액	1,090,643	729,614
기타(*)	(115,129)	113,432
기말	10,893,869	8,932,251

(*) 기타는 배당, 손상, 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 및 공동기업 투자 현황은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월
삼성전기㈜	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국	12월
삼성에스디에스㈜	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합・관리 등 IT 서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국	12월
삼성바이오로직스㈜	신사업 투자	31.2	한국	12월
삼성SDI㈜(*2)	2차전지 등 전자부품의 생산 및 공급	19.6	한국	12월
㈜제일기획	광고 대행업	25.2	한국	12월

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.
(*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

(2) 공동기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*)	주사업장	결산월
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	기타 산업용 유리제품 생산 및 공급	50.0	한국	12월

(*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

다. 보고기간종료일 현재 관계기업 및 공동기업 투자 내역은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

(단위 : 백만원)

기 업 명	당기말			전기말		
	취득원가	순자산가액(*)	장부금액	취득원가	순자산가액(*)	장부금액
삼성전기㈜	359,237	1,765,507	1,764,249	359,237	1,573,570	1,556,386
삼성에스디에스㈜	147,963	1,857,481	1,870,338	147,963	1,632,847	1,652,155
삼성바이오로직스㈜	1,424,358	2,804,547	2,808,673	443,193	1,571,809	1,577,664
삼성SDI㈜	1,242,605	3,318,875	2,691,223	1,242,605	2,960,235	2,529,650
㈜제일기획	506,162	347,510	649,161	506,162	320,301	621,292
기타	645,255	718,801	907,333	644,903	578,547	793,748
계	4,325,580	10,812,721	10,690,977	3,344,063	8,637,309	8,730,895

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

(2) 공동기업 투자

(단위 : 백만원)

기 업 명	당기말			전기말		
	취득원가	순자산가액(*)	장부금액	취득원가	순자산가액(*)	장부금액
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	215,000	137,727	137,745	215,000	135,584	135,580
기타	259,994	67,632	65,147	259,994	67,517	65,776
계	474,994	205,359	202,892	474,994	203,101	201,356

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

라. 당기 및 전기 중 지분법평가 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위 : 백만원)

기 업 명	기초	지분법평가 내역			기말
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성전기㈜	1,556,386	242,139	2,880	(37,156)	1,764,249
삼성에스디에스㈜	1,652,155	241,962	18,154	(41,933)	1,870,338
삼성바이오로직스㈜	1,577,664	250,028	(183)	981,164	2,808,673
삼성SDI㈜	2,529,650	194,242	(19,207)	(13,462)	2,691,223
㈜제일기획	621,292	55,476	1,140	(28,747)	649,161
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	135,580	1,999	144	22	137,745
기타	859,524	104,797	(53,438)	61,597	972,480
계	8,932,251	1,090,643	(50,510)	921,485	10,893,869

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당, 손상 및 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

기 업 명	기초	지분법평가 내역			기말
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성전기㈜	1,333,819	207,949	51,702	(37,084)	1,556,386
삼성에스디에스㈜	1,525,857	137,926	30,305	(41,933)	1,652,155
삼성바이오로직스㈜	1,453,012	124,979	(327)	-	1,577,664
삼성SDI㈜	2,326,037	128,483	88,594	(13,464)	2,529,650
㈜제일기획	586,057	47,619	12,008	(24,392)	621,292
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	123,356	12,376	(129)	(23)	135,580
기타	728,641	70,282	29,826	30,775	859,524
계	8,076,779	729,614	211,979	(86,121)	8,932,251

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당, 손상 및 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

마. 주요 관계기업 및 공동기업 투자의 요약 재무정보 등은 다음과 같습니다.

(1) 주요 관계기업

(단위 : 백만원)

구 분	당기				
	삼성전기㈜	삼성에스디에스㈜	삼성바이오로직스㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획
Ⅰ. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)					
요약 재무상태표:					
유동자산	4,888,319	8,005,764	6,457,657	9,651,702	2,193,979
비유동자산	6,108,852	3,946,660	10,124,394	20,605,823	557,466
유동부채	2,525,123	2,493,323	4,181,542	8,006,939	1,335,643
비유동부채	778,563	992,132	3,416,034	5,033,084	194,373
비지배지분	154,991	243,777	-	731,779	9,388
요약 포괄손익계산서:					
매출	9,441,276	17,234,750	3,001,295	20,124,070	4,253,367
계속영업손익(*1)	993,519	1,099,745	798,056	1,952,149	193,732
세후중단영업손익(*1)	-	-	-	-	-
기타포괄손익(*1)	(9,601)	80,368	6,995	(139,877)	(1,122)
총포괄손익(*1)	983,918	1,180,113	805,051	1,812,272	192,610
Ⅱ. 관계기업 투자의 장부금액으로의 조정 내역					
순자산(a)	7,538,494	8,223,192	8,984,475	16,485,723	1,212,041
연결실체지분율(b)(*2)	23.4%	22.6%	31.2%	20.1%	28.7%
순자산지분금액(a×b)	1,765,507	1,857,481	2,804,547	3,318,875	347,510
영업권	7,081	26,801	3,645	-	298,779
내부거래 등(*3)	(8,339)	(13,944)	481	(627,652)	2,872
장부금액	1,764,249	1,870,338	2,808,673	2,691,223	649,161
Ⅲ. 배당					
배당	37,155	41,933	-	13,463	28,748

(*1) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(*2) 보통주와 우선주 포함 지분율입니다.

(*3) 미실현손익과 기타차이로 구성되어 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	전기				
	삼성전기㈜	삼성에스디에스㈜	삼성바이오로직스㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획
Ⅰ. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)					
요약 재무상태표:					
유동자산	4,598,269	7,575,968	2,823,175	7,444,907	2,018,598
비유동자산	5,343,105	2,941,464	5,146,835	18,388,286	523,513
유동부채	2,234,657	2,370,290	1,107,295	6,461,286	1,224,222
비유동부채	835,592	703,442	1,871,614	4,175,208	190,622
비지배지분	152,177	214,980	-	492,435	10,125
요약 포괄손익계산서:					
매출	9,675,036	13,630,002	1,568,007	13,553,220	3,325,712
계속영업손익(*1)	1,055,411	611,171	393,589	1,169,801	165,485
세후중단영업손익(*1)	(162,966)	-	-	-	-
기타포괄손익(*1)	151,809	134,163	(1,270)	623,792	32,535
총포괄손익(*1)	1,044,254	745,334	392,319	1,793,593	198,020
Ⅱ. 관계기업 투자의 장부금액으로의 조정 내역					
순자산(a)	6,718,948	7,228,720	4,991,101	14,704,264	1,117,142
연결실체지분율(b)(*2)	23.4%	22.6%	31.5%	20.1%	28.7%
순자산지분금액(a×b)	1,573,570	1,632,847	1,571,809	2,960,235	320,301
영업권	7,081	26,801	3,645	-	298,779
내부거래 등(*3)	(24,265)	(7,493)	2,210	(430,585)	2,212
장부금액	1,556,386	1,652,155	1,577,664	2,529,650	621,292
Ⅲ. 배당					
배당	24,770	41,933	-	13,463	24,392

(*1) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(*2) 보통주와 우선주 포함 지분율입니다.

(*3) 미실현손익과 기타차이로 구성되어 있습니다.

(2) 주요 공동기업

(단위 : 백만원)

구 분	삼성코닝어드밴스드글라스(유)	
	당기	전기
Ⅰ. 요약 재무정보		
요약 재무상태표:		
유동자산	170,103	163,083
비유동자산	125,507	141,411
유동부채	19,794	31,779
비유동부채	363	1,547
요약 포괄손익계산서:		
매출	133,634	204,130
계속영업손익(*1)	3,998	24,753
세후중단영업손익(*1)	-	-
기타포괄손익(*1)	288	(305)
총포괄손익(*1)	4,286	24,448
Ⅱ. 공동기업 투자의 장부금액으로의 조정 내역		
순자산(a)	275,453	271,168
연결실체지분율(b)	50.0%	50.0%
순자산지분금액(a×b)	137,727	135,584
내부거래 등(*2)	18	(4)
장부금액	137,745	135,580
Ⅲ. 배당		
배당	-	-

(*1) 공동기업별 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(*2) 미실현손익과 기타차이로 구성되어 있습니다.

(3) 개별적으로 중요하지 않은 관계기업과 공동기업의 손익 중 연결회사의 지분 해당액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기		전기	
	관계기업	공동기업	관계기업	공동기업
당기순손익	102,930	1,867	68,646	1,636
기타포괄손익	(50,761)	(2,677)	29,258	568
총포괄손익	52,169	(810)	97,904	2,204

바. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

구 분	당기말		전기말
	주식수(주)	시장가치	시장가치
삼성전기㈜	17,693,084	2,308,947	3,494,384
삼성에스디에스㈜	17,472,110	2,149,070	2,734,385
삼성바이오로직스㈜	22,217,309	18,240,411	18,815,659
삼성SDI㈜	13,462,673	7,956,440	8,818,051
㈜제일기획	29,038,075	669,328	663,520

사. 기타사항

증권선물위원회는 연결회사의 관계기업인 삼성바이오로직스㈜가 Biogen Therapeutics Inc.와 합작 투자한 삼성바이오에피스㈜ 지분에 대한 회계처리와 관련하여, 합작계약 약정사항의 재무제표 주석 미기재를 이유로 담당임원 해임권고, 검찰 고발, 감사인 지정 등의 조치(이하 "1차 처분")를 2018년 7월 12일에 의결하였으며, 연결대상 범위 회계처리 오류 등 회계기준 위반을 이유로 과징금 80억원 부과, 대표이사 해임권고, 재무제표 재작성, 검찰 고발 등의 조치(이하 "2차 처분")를 2018년 11월 14일에의결하였습니다.

이에 대하여 삼성바이오로직스㈜는 회계처리의 정당성을 입증하기 위하여 위 처분의 취소를 구하는 소송(이하 "본안 소송")을 서울행정법원에 제기하였고, 현재 소송을 진행 중입니다. 1차 처분의 취소를 구하는 소송과 관련하여, 서울행정법원은 2020년 9월 24일 증권선물위원회가 부과한 행정 처분을 취소한다고 판결하고, 항소심 판결 선고 시까지 위 처분의 효력을 정지하는 결정을 하였습니다. 이에 증권선물위원회는 2020년 10월 16일 항소하여 현재 서울고등법원에서 소송을 진행 중입니다. 또한, 삼성바이오로직스㈜는 위 처분에 대한 효력정지신청서를 서울행정법원에 제출하였으며, 법원은 2019년 1월 22일(2차 처분)과 2019년 2월 19일(1차 처분)에 본안 소송의 판결 시까지 처분의 효력을 정지하는 결정을 선고하였습니다. 이에 증권선물위원회는 위 집행정지 결정에 대하여 즉시항고하였으며, 서울고등법원은 2019년 5월 13일(2차 처분), 2019년 5월 24일(1차 처분) 항고를 기각하였습니다. 이에 증권선물위원회는 2019년 5월 23일(2차 처분), 2019년 6월 10일(1차 처분) 재항고하였으며, 대법원은 2019년 9월 6일(2차 처분), 2019년 10월 11일(1차 처분) 재항고를 기각하여 효력정지 결정이 확정되었습니다.

향후 행정소송의 결과를 예측하기 어려우나 소송 결과에 따라 삼성바이오로직스㈜가 삼성바이오에피스㈜ 지분에 관한 과거 회계처리를 수정하여 재무제표를 재작성하게 될 경우, 이로 인해 연결회사의 2015년과 그 이후 기간 지분법평가손익, 관계기업투자주식, 이익잉여금과 2016년 일부 지분 처분이익 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 현재로서는 삼성바이오로직스㈜와 증권선물위원회 간의 행정소송에 대한 종결 시기와 그 결과를 예측할 수 없으므로, 연결회사의 당기 재무제표에 이를 반영하기 어렵습니다.

10. 유형자산:

가. 당기 및 전기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위 : 백만원)

구 분	토지	건물및구축물	기계장치	건설중인자산	기타	계
기초장부금액	9,830,154	38,869,440	79,526,297	18,009,324	3,693,324	149,928,539
- 취득원가	9,943,570	62,651,459	274,909,571	18,009,324	11,958,070	377,471,994
- 감가상각누계액(손상 포함)	(113,416)	(23,782,019)	(195,383,274)	-	(8,264,746)	(227,543,455)
일반취득 및 자본적지출(*1)	138,925	5,302,095	31,010,080	16,675,741	2,100,119	55,226,960
감가상각	(49,516)	(3,533,917)	(30,761,685)	-	(1,606,980)	(35,952,098)
처분・폐기	(57,596)	(127,935)	(35,098)	(193)	(34,208)	(255,030)
손상(환입)	-	(2,255)	(11,815)	-	(12,323)	(26,393)
기타(*2)	30,200	199,490	(13,148)	(1,077,308)	(15,824)	(876,590)
기말장부금액	9,892,167	40,706,918	79,714,631	33,607,564	4,124,108	168,045,388
- 취득원가	10,024,569	67,713,808	303,000,627	33,607,564	13,248,490	427,595,058
- 감가상각누계액(손상 포함)	(132,402)	(27,006,890)	(223,285,996)	-	(9,124,382)	(259,549,670)

(*1) 자본화된 차입원가는 41,634백만원이며, 자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화 이자율은 2.1~4.1%입니다.

(*2) 기타는 환율변동에 의한 증감액 및 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

구 분	토지	건물및구축물	기계장치	건설중인자산	기타	계
기초장부금액	9,772,156	34,552,004	60,994,130	20,175,917	3,458,685	128,952,892
- 취득원가	9,850,942	55,026,369	233,056,501	20,175,917	10,496,584	328,606,313
- 감가상각누계액(손상 포함)	(78,786)	(20,474,365)	(172,062,371)	-	(7,037,899)	(199,653,421)
일반취득 및 자본적지출(*1)	117,933	6,608,620	43,862,769	(2,320,520)	1,696,362	49,965,164
감가상각	(47,517)	(3,174,672)	(26,552,958)	-	(1,510,062)	(31,285,209)
처분・폐기	(49,683)	(91,964)	(18,307)	(469)	(6,200)	(166,623)
손상(환입)	-	(12,135)	(131,985)	-	(7,082)	(151,202)
기타(*2)	37,265	987,587	1,372,648	154,396	61,621	2,613,517
기말장부금액	9,830,154	38,869,440	79,526,297	18,009,324	3,693,324	149,928,539
- 취득원가	9,943,570	62,651,459	274,909,571	18,009,324	11,958,070	377,471,994
- 감가상각누계액(손상 포함)	(113,416)	(23,782,019)	(195,383,274)	-	(8,264,746)	(227,543,455)

(*1) 자본화된 차입원가는 24,908백만원이며, 자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화 이자율은 0.3~1.1%입니다.

(*2) 기타는 환율변동에 의한 증감액 및 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

나. 당기 및 전기 중 유형자산에 포함된 사용권자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위 : 백만원)

구 분	토지	건물및구축물	기계장치	기타	계
기초장부금액	525,954	2,841,970	191,059	391,584	3,950,567
일반취득	32,632	1,542,889	29,098	507,041	2,111,660
감가상각	(49,516)	(823,543)	(58,000)	(116,287)	(1,047,346)
계약의 해지	(13,741)	(111,145)	(263)	(4,220)	(129,369)
기타(*)	7,874	1,425	13,257	9,541	32,097
기말장부금액	503,203	3,451,596	175,151	787,659	4,917,609

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

구 분	토지	건물및구축물	기계장치	기타	계
기초장부금액	441,603	2,105,360	109,372	313,538	2,969,873
일반취득	112,419	1,326,322	136,680	173,490	1,748,911
감가상각	(57,699)	(553,324)	(54,233)	(66,868)	(732,124)
계약의 해지	(398)	(60,742)	(1,265)	(4,790)	(67,195)
기타(*)	30,029	24,354	505	(23,786)	31,102
기말장부금액	525,954	2,841,970	191,059	391,584	3,950,567

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

다. 당기 및 전기 중 계정과목별 유형자산 상각 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
매출원가	32,285,800	27,868,090
판매비와관리비 등	3,666,298	3,417,119
계	35,952,098	31,285,209

11. 무형자산:

가. 당기 및 전기 중 무형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위 : 백만원)

구 분	산업재산권	개발비	회원권	영업권	기타	계
기초장부금액	4,153,236	236,910	241,219	5,844,259	9,760,620	20,236,244
개별 취득	299,484	-	8,905	-	2,375,986	2,684,375
내부개발에 의한 취득	-	-	-	-	-	-
상각	(268,070)	(151,892)	-	-	(2,735,599)	(3,155,561)
처분・폐기	(50,979)	-	(417)	-	(402)	(51,798)
손상(환입)	-	-	(509)	-	(5,753)	(6,262)
기타(*)	145,079	-	4,356	170,163	191,158	510,756
기말장부금액	4,278,750	85,018	253,554	6,014,422	9,586,010	20,217,754

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

구 분	산업재산권	개발비	회원권	영업권	기타	계
기초장부금액	4,033,904	371,391	229,987	5,673,642	8,159,578	18,468,502
개별 취득	333,073	-	8,757	-	3,648,484	3,990,314
내부개발에 의한 취득	-	193,708	-	-	-	193,708
상각	(278,288)	(321,608)	-	-	(2,362,256)	(2,962,152)
처분・폐기	(51,236)	-	(195)	-	(1,696)	(53,127)
손상(환입)	(52,101)	-	(1,586)	-	-	(53,687)
기타(*)	167,884	(6,581)	4,256	170,617	316,510	652,686
기말장부금액	4,153,236	236,910	241,219	5,844,259	9,760,620	20,236,244

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

나. 연결회사는 영업권을 식별된 현금창출단위에 배분하고 있으며, 보고기간종료일 현재 보고부문별 영업권 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말
DX 부문	1,249,290	1,214,730
DS 부문	159,359	160,026
SDC	138,754	138,061
Harman	4,466,339	4,330,139
기 타	680	1,303
계	6,014,422	5,844,259

연결회사는 매년 영업권의 손상 여부를 검토하고 있으며, 현금창출단위의 회수가능가액은 사용가치 계산 등에 근거하여 결정되었습니다. 사용가치의 계산은 경영진이 승인한 향후 5년간(단, 신기술 산업 등 중장기 계획이 합리적인 경우 5년 초과)의 재무예산에 근거한 세전현금흐름 추정치를 사용하였습니다. 동 기간을 초과하는 기간에 대한 영구 현금흐름의 산출은 일정 성장률의 가정(단, 산업평균 성장률을 초과하지 않음)이 사용되었습니다.

다. 당기 및 전기 중 계정과목별 무형자산 상각 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
매출원가	2,211,481	2,136,937
판매비와관리비 등	944,080	825,215
계	3,155,561	2,962,152

12. 차입금:

가. 보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	차입처	연이자율(%)	금 액	
		당기말	당기말	전기말
단기차입금:				
담보부차입금(*1)	우리은행 등	0.0~16.7	3,569,357	11,556,101
무담보차입금	씨티은행 등	0.1~38.5	1,577,958	2,131,692
계			5,147,315	13,687,793
유동성장기차입금:				
은행차입금	BNP 등	38.9~53.2	208,915	40,415
리스부채(*2)	CSSD 등	3.5	874,019	811,902
계			1,082,934	852,317
장기차입금:				
은행차입금	기업은행 등	1.6~5.9	33,846	1,500
리스부채(*2)	CSSD 등	3.5	3,526,826	2,864,656
계			3,560,672	2,866,156

(*1) 담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.

(*2) 리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며 당기 중 발생한 이자비용은 140,111백만원(전기: 106,877백만원)입니다. 또한, 채무불이행이 발생할 경우에 대비하여 리스제공자에게 사용권자산에 대한 권리를 담보로 제공하였습니다. 한편, 당기 중 리스부채 측정치에 포함되지 않은 단기리스료, 소액자산 리스료 등은 211,283백만원(전기: 129,686백만원)입니다.

나. 보고기간종료일 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

상환연도	금 액
2023년	208,915
2024년	1,000
2025년	31,346
2026년	-
2027년 이후	1,500
계	242,761

다. 보고기간종료일 현재 리스부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

상환연도	금 액
2023년	1,021,767
2024년	866,188
2025년	690,763
2026년	582,745
2027년 이후	1,905,034
계	5,066,497

13. 사채:

가. 보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	발행일	만기상환일	연이자율(%)	금 액	
			당기말	당기말	전기말
US$ denominated Straight Bonds(*1)	1997.10.02	2027.10.01	7.7	31,683 (US$ 25,000천)	35,565 (US$ 30,000천)
US$ denominated Debenture Bonds(*2)	2015.05.11	2025.05.15	4.2	506,920 (US$ 400,000천)	474,200 (US$ 400,000천)
EURO€ denominated Debenture Bonds(*3)	2015.05.27	2022.05.27	2.0	- -	469,819 (EUR€350,000천)
소 계				538,603	979,584
사채할인발행차금				(543)	(708)
사채할증발행차금				4,261	7,007
계				542,321	985,883
차감: 유동성사채				(6,228)	(477,651)
비유동성사채				536,093	508,232

(*1) 10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.
(*2) 종속기업 Harman International Industries, Inc.에서 발행하였고, 10년 만기 일시상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.
(*3) 종속기업 Harman Finance International, SCA에서 발행하였고, 7년 만기 일시상환되며 이자는 1년마다 후급됩니다. 한편 해당 사채는 2022년 3월 1일 전액 조기상환되었습니다.

나. 보고기간종료일 현재 사채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

상환연도	금 액
2023년	6,337
2024년	6,337
2025년	513,257
2026년	6,337
2027년 이후	6,335
계	538,603

14. 순확정급여부채(자산):

가. 보고기간종료일 현재 순확정급여부채(자산)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치	13,639,460	14,391,209
기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치	370,848	266,976
소 계	14,010,308	14,658,185
사외적립자산의 공정가치	(19,593,910)	(17,001,891)
순확정급여부채(자산) 계	(5,583,602)	(2,343,706)

나. 당기 및 전기 중 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
당기근무원가	1,365,600	1,247,857
순이자원가(수익)	(99,356)	(38,326)
과거근무원가	(253)	2,718
기타	28,713	3,847
계	1,294,704	1,216,096

한편, 당기 중 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 145,395백만원
(전기: 144,248백만원) 입니다.

다. 당기 및 전기 중 확정급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
매출원가	514,589	480,331
판매비와관리비 등	780,115	735,765
계	1,294,704	1,216,096

라. 당기 및 전기 중 확정급여채무의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
기초	14,658,185	12,948,999
당기근무원가	1,365,600	1,247,857
이자원가	528,884	396,730
과거근무원가	(253)	2,718
확정급여채무의 재측정요소:		
- 인구통계적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익	34,917	(34,014)
- 재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익	(2,496,879)	126,297
- 기타사항에 의한 효과	521,452	473,668
급여지급액	(630,019)	(519,043)
기타(*)	28,421	14,973
기말	14,010,308	14,658,185

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액과 사업결합으로 인한 증가액 등을 포함하고 있습니다.

마. 당기 및 전기 중 사외적립자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
기초	17,001,891	13,840,043
사외적립자산의 이자수익	628,240	435,056
사외적립자산의 재측정요소	(312,565)	(146,239)
사용자의 기여금	2,741,417	3,263,765
급여지급액	(498,246)	(397,678)
기타(*)	33,173	6,944
기말	19,593,910	17,001,891

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액과 사업결합으로 인한 증가액 등을 포함하고 있습니다.

한편, 확정급여제도와 관련하여 2023년도에 납입할 것으로 예상되는 사용자 기여금의 합리적인 추정치는 1,940,341백만원입니다.

바. 보고기간종료일 현재 사외적립자산 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말
원금보장형 고정수익 상품 등	18,766,006	16,935,143
기타	827,904	66,748
계	19,593,910	17,001,891

사외적립자산은 대부분 활성시장에서 공시되는 가격이 있는 자산에 투자되어 있습니다.

사. 보고기간종료일 현재 사용한 주요 보험수리적 가정은 다음과 같습니다.

(단위 : %)

구 분	당기말	전기말
할인율	4.3~6.4	0.2~7.2
미래임금상승률 (인플레이션 효과 포함)	2.0~6.4	1.5~10.0

아. 보고기간종료일 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 민감도 분석은 다음과 같습니다.

(단위 : %)

구 분	당기말	전기말
할인율:		
1%p 증가	92	91
1%p 감소	109	110
임금상승률:		
1%p 증가	109	110
1%p 감소	92	91

자. 보고기간종료일 현재 확정급여채무의 가중평균만기는 8.38년입니다.

15. 충당부채:

당기 중 충당부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	판매보증 (가)	기술사용료 (나)	장기성과급 (다)	기타 (라),(마)	계
기초	1,978,294	1,561,809	734,283	3,405,480	7,679,866
순전입(환입)	2,186,312	629,713	302,229	759,669	3,877,923
사용	(1,873,519)	(712,635)	(255,658)	(1,070,410)	(3,912,222)
기타(*)	18,639	67,719	2,409	39,091	127,858
기말	2,309,726	1,546,606	783,263	3,133,830	7,773,425

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

가. 연결회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다.

나. 연결회사는 협상 진행 중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 연결회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과 기간 해당분을 충당부채로 계상하고 있습니다.

라. 연결회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용 등을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

마. 연결회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

(1) 보고기간종료일 현재 당기 이행연도에 대한 무상할당 배출권과 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 만톤(tCO2-eq))

구 분	당기말
무상할당 배출권	1,754
배출량 추정치	1,957

(*) 보고기간종료일 현재 잔여 계획기간에 대해 무상할당 받은 배출권 수량은 4,905만톤(2023년 1,645만톤, 2024년 1,630만톤, 2025년 1,630만톤)입니다.

(2) 당기 및 전기 중 배출권 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
기초	46,073	44,865
증가	1,872	1,422
사용	(28,378)	(214)
기말	19,567	46,073

(*) 보고기간종료일 현재 보유중인 배출권 수량은 6,742만톤이며, 담보로 제공한 배출권은 없습니다.

(3) 당기 및 전기 중 배출부채 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
기초	45,049	31,876
순전입	16,167	13,374
사용	(28,378)	(201)
기말	32,838	45,049

16. 우발부채와 약정사항:

가. 소송 등

보고기간종료일 현재 연결회사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액및 시기는 불확실하며 연결회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

나. 기타 약정사항

(1) 보고기간종료일 현재 연결회사는 우리은행 등 26개 은행과 무역금융, 상업어음할인 및 외상매출채권담보대출 등의 약정을 맺고 있으며 동 약정에 대한 통합한도액은 21,609,679백만원입니다. 이외에도 연결회사는 신한은행 등 23개 은행과 한도액 16,020,930백만원의 무역금융 약정을 체결하고 있으며, 한도액 1,589,717백만원의 외상매출채권담보대출, 일반대출 등의 약정을 맺고 있습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 발생하지 않은 유・무형자산의 취득을 위한 약정액은 8,553,336백만원입니다.

17. 계약부채:

보고기간종료일 현재 계약부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말
계약부채(*)	13,255,682	13,235,108

(*) 계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

연결회사가 당기초 계약부채 잔액 중 당기에 수익으로 인식한 금액은 1,051,027백만원입니다.

18. 자본금:

보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250억주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사가 발행한 보통주 및 우선주의 수(소각 주식수 제외)는 각각 5,969,782,550주와 822,886,700주입니다. 보고기간종료일 현재 유통주식수는 상기 발행주식의 수와 동일하며, 당기 및 전기 중 변동사항은 없습니다. 한편, 발행주식의 액면총액은 679,267백만원(보통주 596,978백만원, 우선주 82,289백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다.

19. 연결이익잉여금:

가. 보고기간종료일 현재 연결이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말
임의적립금 등	192,294,496	170,814,107
연결미처분이익잉여금	145,651,911	122,250,656
계	337,946,407	293,064,763

나. 당기 및 전기 중 배당금 산정 내역은 다음과 같습니다.

(1) 분기배당 (배당기준일: 2022년과 2021년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일)

(단위 : 주, %, 백만원)

구 분			당기	전기
1분기	배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
		우선주	822,886,700주	822,886,700주
	배당률(액면가 기준)	보통주・우선주	361%	361%
	배당금액	보통주	2,155,092	2,155,092
		우선주	297,062	297,062
		계	2,452,154	2,452,154
2분기	배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
		우선주	822,886,700주	822,886,700주
	배당률(액면가 기준)	보통주・우선주	361%	361%
	배당금액	보통주	2,155,092	2,155,092
		우선주	297,062	297,062
		계	2,452,154	2,452,154
3분기	배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
		우선주	822,886,700주	822,886,700주
	배당률(액면가 기준)	보통주・우선주	361%	361%
	배당금액	보통주	2,155,092	2,155,092
		우선주	297,062	297,062
		계	2,452,154	2,452,154

(2) 기말배당 (배당기준일: 2022년과 2021년 12월 31일)

(단위 : 주, %, 백만원)

구 분		당기	전기
배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
	우선주	822,886,700주	822,886,700주
배당률(액면가 기준)	보통주	361%	361%
	우선주	362%	362%
배당금액	보통주	2,155,092	2,155,092
	우선주	297,884	297,884
	계	2,452,976	2,452,976

20. 기타자본항목:

보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	2,749,109	4,616,639
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익누계액에 대한 지분	114,987	166,835
해외사업장환산외환차이	1,039,197	(3,824,733)
순확정급여부채(자산) 재측정요소	(2,051,610)	(3,173,977)
기타	86,645	86,763
계	1,938,328	(2,128,473)

21. 비용의 성격별 분류:

당기 및 전기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
제품 및 재공품 등의 변동	(10,355,548)	(4,517,560)
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	112,591,917	95,625,437
급여	30,078,623	28,207,782
퇴직급여	1,440,099	1,360,344
감가상각비	35,952,098	31,285,209
무형자산상각비	3,155,561	2,962,152
복리후생비	6,091,626	5,073,002
유틸리티비	6,142,317	4,928,929
외주용역비	6,597,467	5,594,602
광고선전비	6,112,951	5,376,015
판매촉진비	7,110,649	6,286,159
기타비용	53,936,970	45,788,872
계(*)	258,854,730	227,970,943

(*) 연결손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

22. 판매비와관리비:

당기 및 전기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
(1) 판매비와관리비:		
급여	7,763,588	7,245,981
퇴직급여	330,115	310,823
지급수수료	7,457,896	6,192,568
감가상각비	1,574,757	1,529,507
무형자산상각비	664,346	543,544
광고선전비	6,112,951	5,376,015
판매촉진비	7,110,649	6,286,159
운반비	3,214,301	2,792,690
서비스비	3,671,913	4,039,642
기타판매비와관리비	5,993,246	4,840,946
소 계	43,893,762	39,157,875
(2) 경상연구개발비:		
연구개발 총지출액	24,919,198	22,595,434
개발비 자산화	-	(193,708)
소 계	24,919,198	22,401,726
계	68,812,960	61,559,601

23. 기타수익 및 기타비용:

당기 및 전기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
(1) 기타수익:		
배당금수익	414,601	135,840
임대료수익	140,908	132,801
유형자산처분이익	159,123	340,400
기타	1,247,439	1,596,654
계	1,962,071	2,205,695
(2) 기타비용:		
유형자산처분손실	61,256	75,586
기부금	305,941	270,927
기타	1,422,979	1,709,458
계	1,790,176	2,055,971

24. 금융수익 및 금융비용:

당기 및 전기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
(1) 금융수익:		
이자수익	2,720,479	1,278,278
- 상각후원가 측정 금융자산	2,720,213	1,278,051
- 당기손익-공정가치 측정 금융자산	266	227
외환차이	16,537,855	6,525,676
파생상품관련이익	1,570,661	739,233
계	20,828,995	8,543,187
(2) 금융비용:		
이자비용	763,015	431,540
- 상각후원가 측정 금융부채	322,529	213,477
- 기타금융부채	440,486	218,063
외환차이	16,809,703	6,486,093
파생상품관련손실	1,454,971	786,921
계	19,027,689	7,704,554

연결회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

25. 법인세비용:

가. 당기 및 전기 중 법인세비용의 주요 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
(1) 당기법인세:		
기간손익에 대한 당기법인세	7,391,099	11,135,521
당기에 인식한 조정사항	(501,683)	(195,237)
소 계	6,889,416	10,940,284
(2) 이연법인세:		
세액공제의 이월로 인한 이연법인세변동액	(1,080,068)	(332,975)
일시적차이로 인한 이연법인세변동액	(15,407,692)	2,172,312
이월결손금공제로 인한 이연법인세변동액	160,123	507,313
기타변동액	224,618	157,443
소 계	(16,103,019)	2,504,093
(3) 자본에 직접 부가되는 법인세부담액	-	-
법인세비용 계	(9,213,603)	13,444,377

나. 당기 및 전기 중 연결회사의 법인세비용차감전순이익에 대한 법인세비용과 연결회사 내 각 회사들의 이익에 대해 적용되는 가중평균세율을 사용하여 이론적으로 계산된 금액과의 차이는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
법인세비용차감전순이익	46,440,474	53,351,827
(1) 가중평균 적용세율(*)에 따른 법인세비용	13,652,900	15,760,775
(2) 조정사항:		
영구적차이	(2,090,031)	(464,839)
실현가능성이 없는 이연법인세 자산의 변동	769,211	(80,250)
세액공제 및 감면	(5,185,576)	(4,627,136)
종속기업 손익 등에 대한 법인세 효과	(16,186,745)	2,267,026
세율변동효과	(376)	8,691
기타	(172,986)	580,110
소 계	(22,866,503)	(2,316,398)
법인세비용 계	(9,213,603)	13,444,377

(*) 보고기간종료일 현재 연결회사의 이익에 대해서 과세관청별로 다르게 적용되는 법정세율을 가중평균하여 산정하였습니다.

다. 당기 및 전기 중 누적일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위 : 백만원)

계 정 과 목	누적일시적차이			이연법인세자산(부채)		
	기초잔액	증감액	기말잔액	기초 이연법인세 자산(부채)	증감액	기말 이연법인세 자산(부채)
1) 일시적차이로 인한 이연법인세:						
토지재평가	(3,406,625)	3,195	(3,403,430)	(936,822)	38,317	(898,505)
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자(*)	(126,816,779)	(18,391,837)	(145,208,616)	(20,614,554)	15,654,307	(4,960,247)
감가상각누계액 등	(3,814,598)	(3,782,747)	(7,597,345)	(1,771,793)	(794,742)	(2,566,535)
미수수익	(22,153)	108,861	86,708	6,853	32,827	39,680
충당부채 및 미지급비용 등	15,979,455	2,799,841	18,779,296	4,560,874	658,256	5,219,130
외화평가조정	62,615	670,489	733,104	12,076	173,824	185,900
자산손상	1,134,048	(69,523)	1,064,525	258,886	(24,152)	234,734
기타	(492,225)	(1,356,462)	(1,848,687)	(638,757)	(330,945)	(969,702)
소 계	(117,376,262)	(20,018,183)	(137,394,445)	(19,123,237)	15,407,692	(3,715,545)
2) 이월결손금공제로 인한 이연법인세:						
이월결손금이월액	2,015,448	(520,129)	1,495,319	436,481	(160,123)	276,358
3) 세액공제로 인한 이연법인세:						
세액공제이월액	1,687,065	1,243,873	2,930,938	1,666,362	1,080,068	2,746,430
4) 자본에 직접 가감하는 이연법인세:						
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 등	(3,575,094)	(61,384)	(3,636,478)	(3,155,310)	3,104,918	(50,392)
순확정급여부채(자산) 재측정요소	4,447,510	(1,627,945)	2,819,565	1,238,713	(505,578)	733,135
소 계	872,416	(1,689,329)	(816,913)	(1,916,597)	2,599,340	682,743
이연법인세자산(부채) 계				(18,936,991)	18,926,977	(10,014)
- 이 연 법 인 세 자 산				4,261,214	840,104	5,101,318
- 이 연 법 인 세 부 채				(23,198,205)	18,086,873	(5,111,332)

(*) 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자와 관련된 차감할 일시적차이 중 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높지 않을 경우 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

계 정 과 목	누적일시적차이			이연법인세자산(부채)		
	기초잔액	증감액	기말잔액	기초 이연법인세 자산(부채)	증감액	기말 이연법인세 자산(부채)
1) 일시적차이로 인한 이연법인세:						
토지재평가	(3,420,886)	14,261	(3,406,625)	(940,744)	3,922	(936,822)
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자(*)	(111,924,859)	(14,891,920)	(126,816,779)	(19,172,409)	(1,442,145)	(20,614,554)
감가상각누계액 등	(2,285,841)	(1,528,757)	(3,814,598)	(992,777)	(779,016)	(1,771,793)
미수수익	(139,406)	117,253	(22,153)	(31,486)	38,339	6,853
충당부채 및 미지급비용 등	13,121,416	2,858,039	15,979,455	3,764,808	796,066	4,560,874
외화평가조정	(24,683)	87,298	62,615	(10,077)	22,153	12,076
자산손상	1,855,765	(721,717)	1,134,048	453,486	(194,600)	258,886
기타	562,628	(1,054,853)	(492,225)	(21,726)	(617,031)	(638,757)
소 계	(102,255,866)	(15,120,396)	(117,376,262)	(16,950,925)	(2,172,312)	(19,123,237)
2) 이월결손금공제로 인한 이연법인세:						
이월결손금이월액	3,618,601	(1,603,153)	2,015,448	943,794	(507,313)	436,481
3) 세액공제로 인한 이연법인세:						
세액공제이월액	1,328,527	358,538	1,687,065	1,333,387	332,975	1,666,362
4) 자본에 직접 가감하는 이연법인세:						
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 등	(1,660,421)	(1,914,673)	(3,575,094)	(909,176)	(2,246,134)	(3,155,310)
순확정급여부채(자산) 재측정요소	3,735,320	712,190	4,447,510	1,047,075	191,638	1,238,713
소 계	2,074,899	(1,202,483)	872,416	137,899	(2,054,496)	(1,916,597)
이연법인세자산(부채) 계				(14,535,845)	(4,401,146)	(18,936,991)
- 이 연 법 인 세 자 산				4,275,000	(13,786)	4,261,214
- 이 연 법 인 세 부 채				(18,810,845)	(4,387,360)	(23,198,205)

(*) 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자와 관련된 차감할 일시적차이 중 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높지 않을 경우 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다.

연결회사는 차기 이후 예상연평균이익이 각 회계연도에 소멸되는 이월결손금 및 세액공제이월액을 초과하여 이연법인세자산의 실현가능성이 있는 것으로 판단하고 있습니다. 다만, 연결회사가 미래에 실현될 가능성이 희박하여 법인세효과를 인식하지 않은 일시적차이는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말
이월결손금이월액	594,798	706,512
세액공제이월액	46,550	47,929

보고기간종료일 현재 이연법인세자산으로 인식되지 않은 이월결손금 및 세액공제 이월액의 예상 소멸 시기는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과 3년 이내	3년 초과
이월결손금이월액	69,464	1,776	-	523,558
세액공제이월액	7,466	4,157	29,972	4,955

라. 보고기간종료일 현재 이연법인세자산(부채)의 회수(결제) 시기는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말
이연법인세자산:		
12개월 이내에 회수될 이연법인세자산	3,249,661	2,999,046
12개월 이후에 회수될 이연법인세자산	1,851,657	1,262,168
소 계	5,101,318	4,261,214
이연법인세부채:		
12개월 이후에 결제될 이연법인세부채	(5,111,332)	(23,198,205)
계	(10,014)	(18,936,991)

26. 주당이익:

가. 기본주당순이익

당기 및 전기 중 기본주당이익 산정 내역은 다음과 같습니다.

(1) 보통주

(단위 : 백만원, 천주, 원)

구 분	당기	전기
지배회사지분 당기순이익	54,730,018	39,243,791
당기순이익 중 보통주 해당분	48,099,117	34,488,944
÷ 가중평균유통보통주식수(천주)	5,969,783	5,969,783
기본 보통주 주당이익(원)	8,057	5,777

(2) 우선주

(단위 : 백만원, 천주, 원)

구 분	당기	전기
지배회사지분 당기순이익	54,730,018	39,243,791
당기순이익 중 우선주 해당분	6,630,901	4,754,847
÷ 가중평균유통우선주식수(천주)	822,887	822,887
기본 우선주 주당이익(원)	8,058	5,778

나. 희석주당순이익

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당기 및 전기의 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

27. 현금흐름표:

가. 연결회사는 영업활동 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다. 당기 및 전기 중 영업활동 현금흐름 관련 조정 내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

(1) 조정 내역

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
법인세비용	(9,213,603)	13,444,377
금융수익	(5,778,279)	(2,485,679)
금융비용	4,336,254	1,917,705
퇴직급여	1,440,099	1,360,344
감가상각비	35,952,098	31,285,209
무형자산상각비	3,155,561	2,962,152
대손상각비(환입)	8,784	17,990
배당금수익	(414,601)	(135,840)
지분법이익	(1,090,643)	(729,614)
유형자산처분이익	(159,123)	(340,400)
유형자산처분손실	61,256	75,586
재고자산평가손실(환입) 등	4,408,767	1,735,741
기타	366,869	(51,938)
계	33,073,439	49,055,633

(2) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
매출채권의 감소(증가)	7,856,258	(7,302,604)
미수금의 감소(증가)	(1,524,173)	(204,348)
장단기선급비용의 감소(증가)	3,506	(204,971)
재고자산의 감소(증가)	(13,311,072)	(9,712,379)
매입채무의 증가(감소)	(5,298,547)	1,027,017
장단기미지급금의 증가(감소)	(1,443,409)	1,516,076
선수금의 증가(감소)	106,977	(24,371)
예수금의 증가(감소)	25,392	275,998
미지급비용의 증가(감소)	919,271	3,340,697
장단기충당부채의 증가(감소)	(34,298)	1,862,320
퇴직금의 지급	(707,887)	(606,870)
사외적립자산의 감소(증가)	(2,243,171)	(2,866,087)
기타	(1,347,795)	(3,387,362)
계	(16,998,948)	(16,286,884)

나. 당기 및 전기 중 투자・재무활동 현금흐름 관련 주요 비현금거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가	(2,636,448)	3,653,253
관계기업 및 공동기업 투자의 평가	(50,510)	211,979
유형자산의 본계정 대체	36,047,916	50,451,574
사용권자산의 취득(리스부채의 신규계약)	2,111,660	1,748,911
사채의 유동성 대체	6,228	477,651
장기차입금의 유동성 대체	1,082,934	852,317

다. 당기 및 전기 중 재무활동 현금흐름에서 생기는 부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위 : 백만원)

구 분	기초	재무현금흐름	비현금흐름		기말
			리스신규계약	기타(*)	
단기차입금	13,687,793	(8,339,149)	-	(201,329)	5,147,315
사채 및 장기차입금	4,704,356	(1,236,468)	2,111,660	(393,621)	5,185,927
계	18,392,149	(9,575,617)	2,111,660	(594,950)	10,333,242

(*) 상각, 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

구 분	기초	재무현금흐름	비현금흐름		기말
			리스신규계약	기타(*)	
단기차입금	16,553,429	(2,616,943)	-	(248,693)	13,687,793
사채 및 장기차입금	3,663,952	(836,470)	1,748,912	127,962	4,704,356
계	20,217,381	(3,453,413)	1,748,912	(120,731)	18,392,149

(*) 상각, 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

한편, 당기 및 전기 중 리스부채와 관련하여 발생한 원금 상환에 따른 현금유출액(재무활동)은 998,531백만원 및 876,437백만원, 이자비용 현금유출액(영업활동)은 140,111백만원 및 106,877백만원입니다.

라. 연결회사는 거래가 빈번하며 총금액이 크고 단기간에 만기가 도래하는 단기금융상품, 단기차입금등으로 인한 현금의 유입과 유출항목을 순증감액으로 작성하였습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결회사의 현금및현금성자산은 대부분 예금 등으로 구성되어 있습니다.

28. 재무위험관리:

연결회사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책과 프로그램을 운영하고 있습니다. 위험을 회피하기 위한 파생상품의 이용도 이 프로그램에 포함되어 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 글로벌 재무위험 관리정책을 수립한 후 주기적으로 재무위험 측정, 헷지 및 평가 등을 실행하고 있습니다.

한편, 해외 주요 권역별로 지역 금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역 내 자금을 통합운용하여 유동성위험을 관리하고 있습니다.

재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

연결회사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따라 각 개별회사의 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, INR 등이 있습니다.

연결회사는 환율변동과는 무관하게 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융 거래 발생 시 현지 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 또한, 연결회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 기능통화와 다른 주요 외화로 표시된 금융자산 및 금융부채에 대하여 환율이 5% 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말		전기말	
	환율 상승시	환율 하락시	환율 상승시	환율 하락시
USD	258,655	(258,655)	250,489	(250,489)
EUR	92,546	(92,546)	107,519	(107,519)
INR	52,096	(52,096)	24,216	(24,216)

(2) 이자율변동위험

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 변동금리부 금융자산 및 금융부채에 대하여 이자율이 1%p 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말		전기말	
	이자율 상승시	이자율 하락시	이자율 상승시	이자율 하락시
금융자산	72,750	(72,750)	71,131	(71,131)
금융부채	(8,427)	8,427	(18,779)	18,779
순효과	64,323	(64,323)	52,352	(52,352)

(3) 주가변동위험

연결회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 92,073백만원(전기: 116,087백만원)이며, 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 3,144백만원(전기: 4,784백만원)입니다.

나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다
.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재경팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독하에 이루어지고 있습니다. 연결회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

보고기간종료일 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

다. 유동성위험

대규모 투자가 많은 연결회사 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 연결회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금 수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지・관리하고 있습니다.

연결회사는 주기적으로 미래 현금 흐름을 예측하여 유동성위험을 사전 관리하고 있습니다. 권역별로 Cash Pooling을 구축・활용하여 권역 내 자금 부족의 경우에도 내부 자금을 활용하여 유동성위험을 효율적으로 관리하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사 간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성위험을 최소화하는 한편 자금운용 부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 연결회사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

또한, 만약의 대규모 유동성 필요에 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따라 만기별로 구분된 유동성은 다음과 같습니다.

(1) 당기말

(단위 : 백만원)

구 분	3개월 이내	~6개월	~1년	1~5년	5년 초과
금융부채	42,990,570	733,984	1,925,448	5,402,672	1,562,274

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

구 분	3개월 이내	~6개월	~1년	1~5년	5년 초과
금융부채	55,185,809	1,814,271	1,674,980	5,462,057	944,232

위의 분석에 포함된 금융부채는 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다.

매매목적 파생상품 중 계약상 만기가 파생상품의 현금흐름의 시기를 이해하는 데 필수적이지 않은 순액 결제 요건의 파생금융부채 119,061백만원(전기말: 113,590백만원)은 3개월 이내 구간에 포함되어 있습니다. 이러한 파생상품 계약은 만기보다는 순공정가치 기준으로 관리됩니다. 순액으로 결제되는 파생상품은 연결회사의 환율변동을 관리할 목적으로 계약한 통화선도로 구성되어 있습니다.

위험회피목적 파생상품을 포함한 총액 결제 요건의 파생상품은 보고기간종료일로부터 최대 60개월 이내에 결제될 예정입니다. 이러한 파생상품은 위의 표에 포함되지 않았습니다.

보고기간종료일 현재 상기 금융부채 외 지급보증 및 이행보증 등으로 노출된 유동성위험은 없습니다.

라. 파생상품

연결회사는 재고자산의 가격 변동 위험 등을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 현금흐름 위험회피목적 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말		전기말	
	자산	부채	자산	부채
통화선도:				
유동항목	44,567	11,035	34,075	11,090
비유동항목	15,703	15,813	16,790	3,280
계	60,270	26,848	50,865	14,370

연결회사는 당기 중 현금흐름 위험회피목적 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분에 대한 세후 평가손실 12,893백만원(전기: 평가이익 50,410백만원)을 기타포괄손익으로 인식하였으며, 위험회피에 비효과적인 부분에 대한 세전 평가이익 611백만원(전기: 평가이익 451백만원)을 당기손익으로 인식하였습니다. 또한, 당기 중 기타포괄손익에서 당기손익으로 재분류한 세후 평가손실은 4,602백만원(전기: 평가이익 1,117백만원)이며, 기타포괄손익에서 재고자산으로 재분류한 세후 평가이익은 55,856백만원(전기: 평가이익 1,539백만원)입니다.

마. 자본위험관리

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

당기말 현재 연결회사는 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 Aa2 평가등급을 받고 있으며, 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말
부 채	93,674,903	121,721,227
자 본	354,749,604	304,899,931
부채비율	26.4%	39.9%

바. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산:				
현금및현금성자산	49,680,710	(*1)	39,031,415	(*1)
단기금융상품	65,102,886	(*1)	81,708,986	(*1)
단기상각후원가금융자산	414,610	(*1)	3,369,034	(*1)
단기당기손익-공정가치금융자산	29,080	29,080	40,757	40,757
매출채권	35,721,563	(*1)	40,713,415	(*1)
기타포괄손익-공정가치금융자산	11,397,012	11,397,012	13,965,839	13,965,839
당기손익-공정가치금융자산	1,405,468	1,405,468	1,525,344	1,525,344
기타(*2)	10,340,876	395,667	9,040,189	328,216
계	174,092,205		189,394,979	
금융부채:				
매입채무	10,644,686	(*1)	13,453,351	(*1)
단기차입금	5,147,315	(*1)	13,687,793	(*1)
미지급금	16,328,237	(*1)	14,126,970	(*1)
유동성장기부채	1,089,162	6,580	1,329,968	554,106
- 유동성장기차입금	1,082,934	(*1)(*3)	852,317	(*1)(*3)
- 유동성사채	6,228	6,580	477,651	554,106
사채	536,093	521,129	508,232	546,339
장기차입금	3,560,672	(*1)(*3)	2,866,156	(*1)(*3)
장기미지급금	2,289,236	(*1)	2,562,158	(*1)
기타(*2)	12,409,529	361,768	10,781,684	337,394
계	52,004,930		59,316,312	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융자산 9,945,209백만원(전기말: 8,711,973백만원)

및 금융부채 12,047,761백만원(전기말: 10,444,290백만원)은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*3) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	29,080	-	29,080
기타포괄손익-공정가치금융자산	9,207,295	-	2,189,717	11,397,012
당기손익-공정가치금융자산	314,449	-	1,091,019	1,405,468
기타	-	373,176	22,491	395,667
금융부채:				
유동성사채	-	6,580	-	6,580
사채	-	521,129	-	521,129
기타	-	354,364	7,404	361,768

(단위 : 백만원)

구 분	전기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	35,620	5,137	40,757
기타포괄손익-공정가치금융자산	11,608,708	-	2,357,131	13,965,839
당기손익-공정가치금융자산	478,401	-	1,046,943	1,525,344
기타	-	307,213	21,003	328,216
금융부채:				
유동성사채	-	554,106	-	554,106
사채	-	546,339	-	546,339
기타	-	331,956	5,438	337,394

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.
- '수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- '수준 2': 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
  (단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)
- '수준 3': 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

연결회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.
- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여
  해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(3) 가치평가기법 및 투입변수

연결회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

당기말 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	공정가치	가치평가기법	'수준 3' 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
기타포괄손익-공정가치금융자산:				
삼성벤처투자㈜	32,073	현금흐름할인법	영구성장률	-1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	15.8%~17.8%(16.8%)
㈜미코세라믹스	29,385	현금흐름할인법 등	영구성장률	0.0%~1.0%(0.5%)
			가중평균자본비용	13.1%~15.1%(14.1%)
TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)	1,244,889	현금흐름할인법	영구성장률	-1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	10.6%~12.6%(11.6%)
China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Ltd (CSOSDT)	230,263	현금흐름할인법	영구성장률	-1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	10.6%~12.6%(11.6%)
기타:				
지분 풋옵션	22,491	이항모형	무위험 이자율	4.0%~4.5%, 2.5%
			가격 변동성	22.3%~32.3%(27.3%) 25.3%~35.3%(30.3%)

(4) '수준 3'에 해당하는 금융상품의 변동 내역

(단위 : 백만원)

금융자산	당기	전기
기초	3,430,214	6,449,139
매입	207,730	1,075,389
매도	(207,252)	(402,782)
당기손익으로 인식된 손익	73,782	463,818
기타포괄손익으로 인식된 손익	(197,830)	1,543,511
기타	(3,417)	(5,698,861)
기말	3,303,227	3,430,214

(단위 : 백만원)

금융부채	당기	전기
기초	5,438	9,248
당기손익으로 인식된 손익	1,966	(784)
기타	-	(3,026)
기말	7,404	5,438

(5) '수준 3'으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

당기말 현재 '수준 3'으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(자본은 법인세효과 반영 전 효과)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동 효과		불리한 변동 효과	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산(*1)	-	112,515	-	(79,168)
기타(*2)	2,669	-	(3,750)	-

(*1) 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1.0%~1.0%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.
(*2) 주요 관측불가능한 투입변수인 가격 변동성을 5% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

29. 부문별 보고:

가. 부문별 정보

연결회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 연결회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman 등으로 구성되어 있습니다.

당기와 전기의 보고부문의 부문별 정보는 감가상각비, 무형자산상각비, 영업이익의 내부거래 조정이 배분된 후로 작성되었으며, 보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

(1) 당기

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	SDC	Harman	계(*)
매출액	182,489,720	98,455,270	34,382,619	13,213,694	302,231,360
감가상각비	2,520,708	28,196,959	4,768,498	331,342	35,952,098
무형자산상각비	1,678,572	809,270	237,182	211,549	3,155,561
영업이익	12,746,074	23,815,810	5,952,973	880,548	43,376,630

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

당기 주요 제품별 매출은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	영상기기	무선	메모리	DP	계(*)
매출액	33,279,488	115,425,375	68,534,930	34,382,619	302,231,360

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	SDC	Harman	계(*)
매출액	166,259,437	95,387,173	31,712,526	10,039,922	279,604,799
감가상각비	2,373,076	22,848,912	5,504,216	311,237	31,285,209
무형자산상각비	1,435,220	939,922	239,821	229,772	2,962,152

영업이익	17,386,554	29,192,021	4,457,365	599,097	51,633,856

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

전기 주요 제품별 매출은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	영상기기	무선	메모리	DP	계(*)
매출액	31,497,420	104,680,574	72,602,237	31,712,526	279,604,799

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

나. 지역별 정보

당기 및 전기 중 지역별 영업현황(소재지 기준)은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위 : 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체 내 내부거래조정	조정후금액
순매출액	48,654,656	118,974,561	50,283,975	48,692,399	35,625,769	-	302,231,360
비유동자산(*)	144,936,912	14,022,225	5,839,813	9,056,272	15,338,153	(930,233)	188,263,142

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체 내 내부거래조정	조정후금액
순매출액	43,971,631	97,903,868	50,323,287	41,834,609	45,571,404	-	279,604,799
비유동자산(*)	127,116,179	10,758,956	5,951,905	9,088,409	18,244,469	(995,135)	170,164,783

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

30. 특수관계자와의 거래:

가. 당기 및 전기 중 특수관계자와의 매출·매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위 : 백만원)

구 분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스㈜	214,105	-	1,865,588	378,770
	삼성전기㈜	62,274	767	1,401,483	120
	삼성SDI㈜	82,062	-	803,556	24,926
	㈜제일기획	31,782	-	964,096	361
	기타	1,353,769	-	15,158,969	125,053
	계	1,743,992	767	20,193,692	529,230
그 밖의 특수관계자	삼성물산㈜	51,447	-	433,100	7,423,404
	기타	345,901	188	1,595,487	1,910,813
	계	397,348	188	2,028,587	9,334,217
기타(*2)	삼성엔지니어링㈜	1,666	-	53,793	3,249,254
	㈜에스원	13,634	-	510,311	54,069
	기타	166,052	-	550,757	746,749
	계	181,352	-	1,114,861	4,050,072

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

구 분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스㈜	142,435	-	1,732,273	569,840
	삼성전기㈜	47,031	-	1,525,854	-
	삼성SDI㈜	76,160	269	671,169	36,180
	㈜제일기획	27,740	-	758,877	16
	기타	1,288,094	68	12,361,130	118,099
	계	1,581,460	337	17,049,303	724,135
그 밖의 특수관계자	삼성물산㈜	79,183	32,705	334,386	4,045,297
	기타	352,919	-	1,608,435	633,109
	계	432,102	32,705	1,942,821	4,678,406
기타(*2)	삼성엔지니어링㈜	787	-	48,284	2,404,314
	㈜에스원	13,819	-	469,979	35,762
	기타	129,439	2,371	496,451	261,614
	계	144,045	2,371	1,014,714	2,701,690

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

나. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권・채무 등 잔액은 다음과 같습니다.

(1) 당기말

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등(*2)
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스㈜	49,792	512,022
	삼성전기㈜	385	133,952
	삼성SDI㈜	121,605	92,452
	㈜제일기획	223	453,545
	기타	371,575	1,236,017
	계	543,580	2,427,987
그 밖의 특수관계자	삼성물산㈜	217,818	2,783,240
	기타	20,830	250,103
	계	238,648	3,033,343
기타(*3)	삼성엔지니어링㈜	331	1,251,039
	㈜에스원	3,839	73,102
	기타	15,647	545,684
	계	19,817	1,869,825

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다.
(*2) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.
(*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」
에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등(*2)
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스㈜	64,521	616,949
	삼성전기㈜	3,659	176,549
	삼성SDI㈜	130,638	100,835
	㈜제일기획	206	428,090
	기타	397,709	1,361,554
	계	596,733	2,683,977
그 밖의 특수관계자	삼성물산㈜	220,550	1,739,997
	기타	20,306	251,766
	계	240,856	1,991,763
기타(*3)	삼성엔지니어링㈜	338	1,151,536
	㈜에스원	2,423	40,558
	기타	48,703	185,256
	계	51,464	1,377,350

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다.

(*2) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」

에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

다. 연결회사는 당기 및 전기 중 관계기업 및 공동기업에 907,958백만원 및 47,090백만원을 출자하였습니다. 또한 당기 및 전기 중 관계기업 및 공동기업으로부터 13,087백만원 및 19,169백만원의 출자원금을 회수하였습니다.

라. 연결회사가 당기 및 전기 중 특수관계자에게 지급 결의한 배당금은 1,663,149백만원 및 3,527,449백만원입니다. 또한 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에게 당기 및 전기 중 지급 결의한 배당금은 128,232백만원 및 267,738백만원입니다. 당기말과 전기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 존재하지 않습니다.

마. 연결회사가 당기 및 전기 중 특수관계자와 체결한 리스 이용 계약은 25,243백만원 및 12,602백만원이며, 당기와 전기 중 특수관계자에게 지급한 리스료는 22,607백만원 및 31,893백만원입니다.

바. 연결회사가 당기 및 전기 중 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
단기급여	14,768	20,370
퇴직급여	612	886
기타 장기급여	5,434	8,092

31. 비지배지분:

보고기간종료일 현재 종속기업에 대한 비지배지분이 연결회사에게 중요한 종속기업의 정보는 다음과 같습니다.

가. 비지배지분이 보유한 소유지분율 및 누적 비지배지분의 변동

(단위 : %, 백만원)

구 분	삼성디스플레이㈜와 그 종속기업	
	당기	전기
비지배지분율	15.2%	15.2%
기초	8,028,555	7,723,784
당기순이익	853,290	580,164
배당금	(3,947)	(3,123)
기타	(24,186)	(272,270)
기말	8,853,712	8,028,555

나. 종속기업의 요약 재무정보(내부거래 제거 전)

(1) 요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원)

구 분	삼성디스플레이㈜와 그 종속기업	
	당기말	전기말
유동자산	42,082,412	35,220,985
비유동자산	23,070,658	24,773,119
유동부채	6,294,310	7,539,403
비유동부채	1,220,097	1,359,478
자본	57,638,663	51,095,223
- 지배기업 소유주지분	57,552,528	51,012,895
- 비지배지분	86,135	82,328

(2) 요약 연결포괄손익계산서

(단위 : 백만원)

구 분	삼성디스플레이㈜와 그 종속기업	
	당기	전기
매출	34,298,283	31,557,504
당기순이익	6,614,496	3,511,314
기타포괄손익	(67,942)	1,256,904
총포괄손익	6,546,554	4,768,218
- 지배기업 소유주지분	6,539,633	4,752,963
- 비지배지분	6,921	15,255

(3) 요약 연결현금흐름표

(단위 : 백만원)

구 분	삼성디스플레이㈜와 그 종속기업	
	당기	전기
영업활동 현금흐름	11,395,827	10,943,029
투자활동 현금흐름	(8,654,933)	(9,927,110)
재무활동 현금흐름	(1,146,117)	(1,284,749)
매각예정분류	-	-
외화환산으로 인한 현금의 변동	(44,426)	52,154
현금및현금성자산의 증가(감소)	1,550,351	(216,676)
기초의 현금및현금성자산	758,859	975,535
기말의 현금및현금성자산	2,309,210	758,859

4. 재무제표

재무상태표

제 54 기 2022.12.31 현재
제 53 기 2021.12.31 현재
제 52 기 2020.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 54 기	제 53 기	제 52 기
자산			
유동자산	59,062,658	73,553,416	73,798,549
현금및현금성자산	3,921,593	3,918,872	989,045
단기금융상품	137	15,000,576	29,101,284
매출채권	20,503,223	33,088,247	24,736,740
미수금	2,925,006	1,832,488	1,898,583
선급비용	1,047,900	817,689	890,680
재고자산	27,990,007	15,973,053	13,831,372
기타유동자산	2,674,792	2,922,491	2,350,845
비유동자산	201,021,092	177,558,768	155,865,878
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,364,325	1,662,532	1,539,659
당기손익-공정가치금융자산	283	2,135	3,107
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	57,397,249	56,225,599	56,587,548
유형자산	123,266,986	103,667,025	86,166,924
무형자산	8,561,424	8,657,456	7,002,648
순확정급여자산	4,410,223	2,324,291	1,162,456
이연법인세자산	2,142,512	1,211,100	992,385
기타비유동자산	3,878,090	3,808,630	2,411,151
자산총계	260,083,750	251,112,184	229,664,427
부채			
유동부채	46,086,047	53,067,303	44,412,904
매입채무	8,729,315	11,557,441	6,599,025
단기차입금	2,381,512	9,204,268	12,520,367
미지급금	18,554,543	13,206,753	9,829,541
선수금	320,689	474,731	424,368
예수금	523,354	624,585	432,714
미지급비용	8,359,296	8,275,410	7,927,017
당기법인세부채	2,533,481	5,599,896	3,556,146
유동성장기부채	135,753	139,328	87,571

충당부채	4,059,491	3,643,853	2,932,468
기타유동부채	488,613	341,038	103,687
비유동부채	4,581,512	4,851,149	1,934,799
사채	24,912	29,048	31,909
장기차입금	654,979	431,915	150,397
장기미지급금	2,439,232	2,653,715	1,247,752
장기충당부채	1,423,165	1,659,774	503,035
기타비유동부채	39,224	76,697	1,706
부채총계	50,667,559	57,918,452	46,347,703
자본			
자본금	897,514	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
이익잉여금(결손금)	204,388,016	188,774,335	178,284,102
기타자본항목	(273,232)	(882,010)	(268,785)
자본총계	209,416,191	193,193,732	183,316,724
부채와자본총계	260,083,750	251,112,184	229,664,427

손익계산서

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 53 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 52 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 54 기	제 53 기	제 52 기
수익(매출액)	211,867,483	199,744,705	166,311,191
매출원가	152,589,393	135,823,433	116,753,419
매출총이익	59,278,090	63,921,272	49,557,772
판매비와관리비	33,958,761	31,928,110	29,038,798
영업이익	25,319,329	31,993,162	20,518,974
기타수익	4,576,378	7,359,004	797,494
기타비용	296,344	745,978	857,242
금융수익	9,734,299	3,796,979	5,676,877
금융비용	9,641,742	3,698,675	5,684,180
법인세비용차감전순이익(손실)	29,691,920	38,704,492	20,451,923
법인세비용	4,273,142	7,733,538	4,836,905
계속영업이익(손실)	25,418,778	30,970,954	15,615,018
당기순이익(손실)	25,418,778	30,970,954	15,615,018
주당이익			
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,742	4,559	2,299
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3,742	4,559	2,299

포괄손익계산서

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 53 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 52 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 54 기	제 53 기	제 52 기
당기순이익(손실)	25,418,778	30,970,954	15,615,018
기타포괄손익	613,118	(613,225)	(549,299)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	613,118	(613,225)	(549,299)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(208,883)	(99,916)	93,251
순확정급여부채(자산) 재측정요소	822,001	(513,309)	(642,550)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	0	0	0
총포괄손익	26,031,896	30,357,729	15,065,719

자본변동표

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 53 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 52 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	자본				
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계
2020.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	172,288,326	280,514	177,870,247
당기순이익(손실)			15,615,018		15,615,018
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익				93,251	93,251
순확정급여부채(자산) 재측정요소				(642,550)	(642,550)
배당			(9,619,242)		(9,619,242)
2020.12.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	178,284,102	(268,785)	183,316,724
2021.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	178,284,102	(268,785)	183,316,724
당기순이익(손실)			30,970,954		30,970,954
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익				(99,916)	(99,916)
순확정급여부채(자산) 재측정요소				(513,309)	(513,309)
배당			(20,480,721)		(20,480,721)
2021.12.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	188,774,335	(882,010)	193,193,732
2022.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	188,774,335	(882,010)	193,193,732
당기순이익(손실)			25,418,778		25,418,778
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익			4,340	(213,223)	(208,883)
순확정급여부채(자산) 재측정요소				822,001	822,001
배당			(9,809,437)		(9,809,437)
2022.12.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	204,388,016	(273,232)	209,416,191

현금흐름표

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 53 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 52 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 54 기	제 53 기	제 52 기
영업활동 현금흐름	44,788,749	51,250,069	37,509,025
영업에서 창출된 현금흐름	49,589,897	50,357,361	39,541,654
당기순이익	25,418,778	30,970,954	15,615,018
조정	31,039,388	25,168,062	24,319,842
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(6,868,269)	(5,781,655)	(393,206)
이자의 수취	339,560	282,918	448,323
이자의 지급	(287,488)	(125,036)	(148,262)
배당금 수입	3,551,435	6,560,011	129,569
법인세 납부액	(8,404,655)	(5,825,185)	(2,462,259)
투자활동 현금흐름	(28,123,886)	(24,435,207)	(31,175,575)
단기금융상품의 순감소(증가)	15,000,439	13,600,708	(2,099,892)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	10,976	0	503
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(234,975)	(204,957)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,744	912	74
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분	165,089	605,607	22,057
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(1,001,723)	(138,858)	(163,456)
유형자산의 처분	288,684	408,560	431,142
유형자산의 취득	(39,160,176)	(36,021,504)	(26,962,042)
무형자산의 처분	6,242	5,809	1,082
무형자산의 취득	(3,298,378)	(2,459,929)	(2,239,834)
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(136,783)	(201,537)	39,748
재무활동 현금흐름	(16,665,064)	(23,885,054)	(7,426,376)
단기차입금의 순증가(감소)	(6,700,826)	(3,288,858)	2,326,350
사채 및 장기차입금의 상환	(155,264)	(117,963)	(134,443)
배당금의 지급	(9,808,974)	(20,478,233)	(9,618,283)
외화환산으로 인한 현금의 변동	2,922	19	54
현금및현금성자산의 순증감	2,721	2,929,827	(1,092,872)
기초의 현금및현금성자산	3,918,872	989,045	2,081,917
기말의 현금및현금성자산	3,921,593	3,918,872	989,045

5. 재무제표 주석

제 54 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 53 기 : 2021년 12월 31일 현재

삼성전자주식회사

1. 일반적 사항:

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사의 사업은 DX 부문, DS 부문으로 구성되어있습니다. DX(Device eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 휴대폰, 통신시스템 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry, System LSI 등으로 구성되어 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다.

2. 중요한 회계처리방침:

다음은 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성기준

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 요구되는 부분이나 중요한 가정 및 추정이 요구되는 부분은 주석3에서 설명하고 있습니다.

2.2 회계정책과 공시의 변경

가. 회사가 채택한 제・개정 기준서

회사는 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제・개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정

사업결합 시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

나. 회사가 적용하지 않은 제・개정 기준서

제정 또는 공표됐으나 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지않았고, 회사가 조기 적용하지 않은 주요 제・개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다.
동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다.

- 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이허용됩니다.

- 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래당시 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.

2.3 종속기업, 관계기업 및 공동기업

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 회사는 별도재무제표에서 종속기업, 관계기업 및 공동기업에 대한 투자를 기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따라 원가법으로 처리하고 있습니다. 또한 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자에 대한 객관적인 손상의 징후가 있는 경우 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 회수가능액과 장부금액과의 차이는 손상차손으로 인식됩니다.

2.4 외화환산

가. 기능통화와 표시통화

회사는 회사 내 개별기업의 재무제표에 포함되는 항목들을 각각의 영업활동이 이루어지는 주된 경제 환경에서의 통화("기능통화")를 적용하여 측정하고 있습니다. 회사의 기능통화는 대한민국 원화(KRW)이며 재무제표는 대한민국 원화(KRW)로 표시되어 있습니다.

나. 외화거래와 보고기간종료일의 외화환산

외화거래는 거래일의 환율 또는 재측정되는 항목인 경우 평가일의 환율을 적용한 기능통화로 인식되고, 외화거래의 결제나 화폐성 외화 자산・부채의 환산에서 발생하는 외환차이는 당기손익으로 인식됩니다. 비화폐성 금융자산・부채로부터 발생하는 외환차이는 공정가치 변동손익의 일부로 보아 당기손익-공정가치 측정 지분상품으로부터 발생하는 외환차이는 당기손익에, 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 외환차이는 기타포괄손익에 포함하여 인식됩니다.

2.5 현금및현금성자산

현금및현금성자산은 보유중인 현금, 요구불예금 및 취득일 현재 확정된 금액의 현금으로 전환이 용이하고, 가치변동의 위험이 경미한 매우 유동적인 단기 투자자산으로 구성되어 있습니다.

2.6 금융자산

가. 분류

회사는 기준서 제1109호 '금융상품'의 최초적용일인 2018년 1월 1일부터 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다.

- 공정가치 측정 금융자산 (기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식)
- 상각후원가 측정 금융자산

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다.

공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 회사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.

단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식 시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

나. 측정

회사는 최초 인식 시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.

내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

(1) 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 회사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.

① 상각후원가 측정 금융자산
계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.

② 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 모두를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 표시하고손상차손은 '기타비용' 으로 표시합니다.

③ 당기손익-공정가치 측정 금융자산
상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

(2) 지분상품

회사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않고 제거되는 시점에 자본에 누적된 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익을 이익잉여금으로 대체합니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 회사가 배당을 받을 권리가 확정된 때에 손익계산서에 '기타수익'으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

다. 손상

회사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 회사는 채권의 최초 인식 시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

라. 인식과 제거

금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다. 회사가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행 시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 회사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다. 해당 금융부채는 재무상태표에 '차입금'으로 분류하고 있습니다.

마. 금융상품의 상계

금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다.

2.7 매출채권

매출채권은 정상적인 영업과정에서 판매된 재고자산 및 제공된 용역과 관련하여 고객으로부터 수취할 금액입니다. 매출채권의 회수가 1년 이내에 예상되는 경우 유동자산으로 분류하고, 그렇지 않은 경우 비유동자산으로 분류합니다. 매출채권은 유의적인 금융요소를 포함하지 않는 경우를 제외하고는 최초에 거래가격으로 인식하며, 유효이자율을 적용한 상각후원가에서 손실충당금을 차감하여 측정하고 있습니다.

2.8 재고자산

재고자산은 원가와 순실현가능가치 중 작은 금액으로 표시하고 있습니다. 원가는 미착품을 제외하고는 평균법에 따라 결정하고 있습니다. 제품과 재공품의 원가는 원재료비, 직접노무비 및 기타 직접원가와 정상조업도에 근거한 관련 제조간접비로 이루어지며, 유휴생산설비 원가나 폐기비용은 제외하고 있습니다. 순실현가능가치는 정상적인 영업과정에서의 추정 판매가격에서 적용 가능한 변동 판매비용을 차감한 금액입니다.

회사는 주기적으로 재고자산평가충당금의 중요한 변동을 발생시킬 가능성이 있는 미래의 제품 수요 등을 검토하여 과잉, 진부화 및 시장가치의 하락 등이 발생한 경우 재고자산평가충당금을 계상하고 있으며 재고자산평가손실을 '매출원가'로 처리하고 있습니다.

2.9 유형자산

유형자산은 역사적 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 역사적 원가는 자산의 취득에 직접적으로 관련된 지출을 포함합니다. 후속원가는 자산으로부터 발생하는 미래의 경제적 효익이 회사에 유입될 가능성이 높으며 그 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 한하여 자산의 장부금액에 포함하거나 별도의 자산으로 인식하고 있습니다. 대체된 부분의 장부금액은 제거하고 있으며 그 외의 모든 수선 및 유지비는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

회사의 유형자산은 취득원가에서 회사가 추정한 추정내용연수에 따라 정액법에 의하여 상각됩니다. 토지는 상각되지 않으며, 자본화차입금이자를 포함한 장기건설자산의 취득에 사용된 원가는 관련 자산의 추정내용연수 동안 상각됩니다.

자산별로 회사가 사용하고 있는 대표추정내용연수는 다음과 같습니다.

구 분	대표추정내용연수
건물 및 구축물	15, 30 년
기계장치	5 년
기타	5 년

회사는 매 회계연도 말에 유형자산의 감가상각방법, 잔존가치와 경제적 내용연수를 검토하고 필요한 경우 조정을 하고 있습니다. 자산의 장부금액이 추정 회수가능액을 초과하는 경우 자산의 장부금액을 회수가능액으로 즉시 감소시키고 있습니다. 자산의 처분손익은 처분대가와 자산의 장부금액의 차이로 결정되며, 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시하고 있습니다.

2.10 차입원가

적격자산을 취득 또는 건설하는데 발생한 차입원가는 해당 자산을 의도된 용도로 사용할 수 있도록 준비하는 기간 동안 자본화되고, 적격자산을 취득하기 위한 특정목적차입금의 일시적 운용에서 발생한 투자수익은 당 회계기간 동안 자본화 가능한 차입원가에서 차감됩니다. 기타 차입원가는 발생기간에 비용으로 인식됩니다.

2.11 무형자산

영업권은 취득 시점에 취득하는 종속기업, 관계기업 및 공동기업, 사업 등의 순식별가능자산에 대한 회사의 지분에 해당하는 공정가치를 초과하여 지급한 대가에 해당하며 사업취득과 관련된 건은 무형자산으로, 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 지분취득과 관련한 건은 투자주식에 포함하여 계상하고 있습니다.

영업권을 제외한 무형자산은 역사적 원가로 최초 인식되고, 원가에서 상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액으로 표시됩니다.

내부적으로 창출한 무형자산인 개발비는 기술적 실현가능성, 미래경제적효익 등을 포함한 자산 인식요건이 충족된 시점 이후에 발생한 지출금액의 합계입니다. 회원권 및 특정 상표권은 이용 가능 기간에 대하여 예측가능한 제한이 없으므로 내용연수가 한정되지 않아 상각되지 않습니다. 하지만 회원권의 시장가치 하락 등 손상 징후 발견 시 합리적으로 추정하여 손상을 반영합니다. 특허권, 상표권 및 기타무형자산 등
한정된 내용연수를 가지는 무형자산은 추정내용연수동안 정액법에 따라 상각하고 있습니다.

자산별 대표추정내용연수는 다음과 같습니다.

구 분	대표추정내용연수
개발비	2년
특허권, 상표권 및 기타무형자산	5년 ~ 10년

2.12 비금융자산의 손상

영업권이나 비한정내용연수를 가진 무형자산은 상각하지 않고 매년 손상검사를 실시하고 있습니다. 상각하는 자산의 경우 매 보고기간종료일에 장부금액이 회수가능하지 않을 수도 있음을 나타내는 환경의 변화나 사건이 있을 때마다 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상차손은 회수가능액을 초과하는 장부금액만큼 인식하고 있습니다. 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다. 손상을 측정하기 위한 목적으로 자산은 별도로 식별 가능한 현금흐름을 창출하는 가장 하위 수준의 집단(현금창출단위)으로 그룹화하고 있습니다. 손상차손을 인식한 경우, 영업권이외의 비금융자산은 매 보고기간종료일에 손상차손의 환입가능성을 검토하고 있습니다.

2.13 매각예정분류(처분자산집단)

비유동자산(또는 처분자산집단)은 장부금액이 매각거래를 통하여 주로 회수되고, 매각될 가능성이 매우 높은 경우에 매각예정으로 분류되며, 그러한 자산은 장부금액과 순공정가치 중 작은 금액으로 측정됩니다. 매각예정분류(처분자산집단) 처분손익은 처분대가와 자산의 장부금액의 차이로 결정되며, 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시하고 있습니다.

2.14 금융부채

가. 분류 및 측정

모든 금융부채는 다음을 제외하고는 후속적으로 상각후원가로 측정되도록 분류합니다.

(1) 당기손익-공정가치 측정 금융부채
파생상품부채를 포함한 이러한 부채는 후속적으로 공정가치로 측정합니다.
(2) 금융자산의 양도가 제거 조건을 충족하지 못하거나 지속적 관여 접근법이 적용되는 경우에 생기는 금융부채
이러한 금융부채는 주석 2.6 금융자산의 내용을 적용하여 측정합니다.
(3) 금융보증계약
최초 인식 시 공정가치로 측정되며, 이후에 이러한 계약의 발행자는 해당 계약을 후속적으로 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
- 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
- 최초 인식금액에서 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
(4) 시장이자율보다 낮은 이자율로 대출하기로 한 약정
최초 인식 후에 이러한 약정의 발행자는 후속적으로 해당 약정을 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
- 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
- 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
(5) 기준서 제1103호를 적용하는 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가
이러한 조건부 대가는 후속적으로 당기손익-공정가치로 측정합니다.

나. 제거

금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다. 소멸하거나 제3자에게 양도한 금융부채의 장부금액과 지급한 대가(양도한 비현금자산이나 부담한 부채를 포함)의 차액은 당기손익으로 인식합니다.

2.15 매입채무

매입채무는 정상적인 영업과정에서 공급자로부터 취득한 재고자산 및 제공받은 용역과 관련하여 지급할 의무가 있는 금액입니다. 매입채무의 지급이 12개월 이내에 예상되는 경우 유동부채로 분류하고, 그렇지 않은 경우 비유동부채로 분류합니다. 매입채무는 최초에 공정가치로 인식하며, 후속적으로 유효이자율법을 사용한 상각후원가로 측정하고 있습니다.

2.16 차입금

차입금은 최초에 공정가치에서 거래비용을 차감한 가액으로 인식하며, 후속적으로 상각후원가로 측정하고 있습니다. 거래비용 차감 후 수취한 금액과 상환금액의 차이는 유효이자율법으로 상각하여 차입기간 동안 손익계산서에 인식하고 있습니다. 또한, 보고기간종료일 이후 12개월 이상 결제를 이연할 수 있는 무조건적인 권리가 있는 경우 비유동부채로 분류하며, 그렇지 않은 경우 유동부채로 분류하고 있습니다.

2.17 충당부채 및 우발부채

과거사건의 결과로 현재의 법적의무나 의제의무가 존재하고, 그 의무를 이행하기 위한 자원의 유출가능성이 높으며, 당해 금액의 신뢰성 있는 추정이 가능한 경우 회사는 충당부채를 인식하고 있습니다. 미래영업손실에 대하여는 충당부채를 인식하지 않습니다.

충당부채는 의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재가치로 측정하며, 현재가치 평가에 사용하는 할인율은 그 부채의 고유한 위험과 화폐의 시간가치에 대한 현행 시장의 평가를 반영한 세전이자율입니다. 시간경과로 인한 충당부채의 증가는 이자비용으로 인식하고 있습니다.

또한, 과거사건은 발생하였으나 불확실한 미래사건의 발생 여부에 의해서 존재 여부가 확인되는 잠재적인 의무가 있는 경우 또는 과거사건이나 거래의 결과 현재 의무가존재하나 자원이 유출될 가능성이 높지 않거나 당해 의무를 이행하여야 할 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우 우발부채로 주석기재하고 있습니다.

2.18 종업원급여

회사는 확정급여제도와 확정기여제도를 포함하는 다양한 형태의 퇴직연금제도를 운영하고 있습니다.

확정기여제도는 회사가 고정된 금액의 기여금을 별도 기금에 지급하는 퇴직연금제도입니다. 해당 기금이 현재나 과거 기간의 종업원 용역과 관련하여 지급하여야 할 급여 전액을 지급하기에 충분한 자산을 보유하지 못하는 경우에도 회사는 추가적인 기여금을 납부할 법적 의무나 의제의무를 부담하지 않습니다. 확정기여제도와 관련하여 회사는 상장되거나 비상장으로 관리되고 있는 연금보험제도에 의무적으로나 계약에 의해 또는 자발적으로 기여금을 지급하고 있습니다. 기여금이 지급된 이후에 회사는 더 이상의 미래 의무를 부담하지 않습니다. 기여금은 종업원이 근무 용역을 제공했을 때 비용으로 인식됩니다. 선급 기여금은 초과 기여금으로 인해 미래 지급액이 감소하거나 현금이 환급되는 만큼을 자산으로 인식하고 있습니다.

확정급여제도는 확정기여제도를 제외한 모든 퇴직연금제도입니다. 일반적으로 확정급여제도는 연령, 근속연수나 급여수준 등의 요소에 의해 종업원이 퇴직할 때 지급받을 퇴직연금급여의 금액을 확정하고 있습니다. 확정급여제도와 관련하여 재무상태표에 계상된 부채(자산)는 보고기간종료일 현재 확정급여채무의 현재가치에 사외적립자산의 공정가치를 차감한 과소적립액(자산인식상한을 한도로 하는 초과적립액)입니다. 확정급여채무는 매년 독립된 보험계리인에 의해 예측단위적립방식에 따라 산정됩니다. 확정급여채무의 현재가치는 급여가 지급될 통화로 표시되고 관련 확정급여채무의 지급 시점과 만기가 유사한 우량회사채의 이자율로 기대미래현금유출액을 할인하여 산정하고 있습니다.

보험수리적 가정의 변경 및 보험수리적 가정과 실제로 발생한 결과의 차이로 인해 발생하는 보험수리적손익은 발생한 기간의 기타포괄손익으로 인식하고 있으며, 제도개정, 축소 또는 정산이 발생하는 경우 과거근무원가 또는 정산으로 인한 손익은 발생 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다.

2.19 금융보증계약

금융보증계약은 채무상품의 최초 계약조건이나 변경된 계약조건에 따라 지급기일에 특정 채무자가 지급하지 못하여 보유자가 입은 손실을 보상하기 위하여 특정 금액을 지급하여야 하는 계약입니다.

회사가 제공한 금융보증계약은 최초 인식 시 공정가치로 측정되며, 후속적으로는 다음 중 큰 금액으로 측정하여 기타금융부채로 인식됩니다.
(1) 금융상품의 손상 규정에 따라 산정한 손실충당금
(2) 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액

2.20 당기법인세 및 이연법인세

회사의 법인세비용은 당기법인세와 이연법인세로 구성됩니다. 법인세는 기타포괄손익이나 자본에 직접 인식된 항목과 관련된 금액은 해당 항목에서 직접 인식하며, 이를 제외하고는 당기손익으로 인식됩니다. 법인세비용은 보고기간종료일 현재 제정되었거나 실질적으로 제정된 세법에 기초하여 측정됩니다.

이연법인세는 자산과 부채의 장부금액과 세무기준액의 차이로 정의되는 일시적차이에 대하여 장부금액을 회수하거나 결제할 때의 예상 법인세효과로 인식됩니다. 다만,사업결합 이외의 거래에서 자산·부채를 최초로 인식할 때 발생하는 이연법인세자산과 부채는 그 거래가 회계이익이나 과세소득에 영향을 미치지 않는다면 인식되지 않습니다. 이연법인세자산은 차감할 일시적차이가 사용될 수 있는 미래 과세소득의 발생가능성이 높은 경우에 인식됩니다.

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자지분과 관련된 가산할 일시적차이에 대하여 소멸 시점을 통제할 수 있고 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸하지 않을 가능성이 높은 경우를 제외하고 이연법인세부채를 인식하고 있습니다. 또한 이러한 자산으로부터 발생하는 차감할 일시적차이에 대하여 일시적차이가 예측가능한 미래에 소멸할가능성이 높고 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득이 발생할 가능성이 높은 경우에만 이연법인세자산을 인식하고 있습니다.

이연법인세자산과 부채는 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한 권리를 회사가 보유하고, 이연법인세자산과 부채가 동일한 과세당국에 의해서 부과되는 법인세와 관련이 있으면서 순액으로 결제할 의도가 있는 경우에 상계됩니다.

2.21 파생상품

회사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피와 해외사업장에 대한 순투자에 대한 위험회피금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

회사는 재고자산의 가격 변동 위험 등을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 현금흐름위험회피 대상으로 지정되어 적용요건을 충족하는 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 인식하고, 비효과적인 부분은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 인식하고 있습니다.

2.22 배당금

배당금은 회사의 주주에 의해 승인된 시점에 부채로 인식하고 있습니다.

2.23 자본금

보통주와 상환의무 없는 우선주는 모두 자본으로 분류하고 있습니다. 회사 또는 종속기업이 회사의 보통주를 취득하는 경우, 직접거래원가를 포함하는 지급 대가는 그 보통주가 소각되거나 재발행 될 때까지 회사의 자본에서 차감하여 표시하고 있습니다. 이러한 자기주식이 재발행되는 경우, 수취한 대가는 회사의 주주에게 귀속되는 자본에 포함하고 있습니다.

2.24 수익인식

수익은 주로 회사의 통상적인 활동에서 발생하는 재화의 판매에 대하여 받았거나 받을 대가의 공정가액으로 구성되어 있습니다. 수익은 부가가치세, 반품, 판매장려금 및 가격 할인액을 차감한 순액으로 표시하며, 내부거래를 제거한 후의 금액으로 표시하고 있습니다.

회사는 2018년 1월 1일부터 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 제1115호에 따르면 모든 유형의 계약에 5단계 수익인식모형(① 계약 식별 → ② 수행의무 식별 → ③ 거래가격 산정 → ④ 거래가격을 수행의무에 배분 →⑤ 수행의무 이행 시 수익 인식)을 적용하여 수익을 인식합니다.

(1) 수행의무의 식별

회사는 Incoterms Group C 조건(무역조건 CIF 등)에 따라 다양한 제품 및 상품을 수출하고 있습니다. 고객에게 통제가 이전된 이후 매도인이 운송서비스를 제공하므로 해당 운송서비스(보험 포함)를 별도의 수행의무로 인식합니다.

(2) 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무

회사는 조달청을 통해 수주되는 시스템에어컨 도급공사계약에 따라 고객에게 제품을납품하고 설치를 수행하고 있습니다. 기준서 제1115호에 따르면 기업이 수행하여 만들어지거나 가치가 높아지는 대로 고객이 통제하는 자산을 기업이 만들거나 그 자산가치를 높이는 경우 진행기준을 적용하여 수익을 인식하여야 합니다. 이에 따라 시스템에어컨 설치용역의 경우 용역 수행 경과에 따른 결과물을 고객이 직접 통제하기 때문에 진행기준을 적용하여 수익을 인식합니다.

(3) 변동대가

회사는 할인 등 고객과 약속한 대가에 변동가능성이 있는 경우, 고객으로부터 이미 받았거나 받을 대가 중 권리를 갖지 않을 것으로 예상하는 금액(변동대가)을 기대값 또는 가능성이 가장 높은 금액 중 보다 신뢰성있는 방법으로 추정합니다. 이미 인식한 누적 수익금액 중 유의적인 부분을 되돌리지 않을 가능성이 매우 높은 금액까지만거래가격에 포함하여 수익을 인식하며, 회사가 이미 받았거나 받을 대가 중에서 권리를 갖지 않는 것으로 예상하는 금액은 계약부채로 분류합니다.

회사는 고객에게 제품 판매 후 고객이 반품할 것으로 예상되는 제품에 대해 경험률에기초한 기댓값 방법으로 반품율을 예측하여 계약부채(환불부채)를 인식하고 있습니다. 고객이 반품권리를 행사할 때 고객으로부터 제품을 회수할 권리를 가지므로그 자산을 환불자산으로 인식하고 해당 금액만큼 매출원가를 조정합니다. 제품을 회수할 권리는 제품의 과거 장부금액에서 제품을 회수하는데 드는 원가를 차감하여 측정합니다.

(4) 거래가격의 배분

회사는 하나의 계약에서 식별된 여러 수행의무에 상대적 개별 판매가격을 기초로 거래가격을 배분합니다. 각 수행의무의 개별 판매가격을 추정하기 위하여 '시장평가 조정 접근법' 등을 사용합니다.

2.25 리스

리스는 리스제공자가 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정기간 리스이용자에게 이전하는 계약입니다.

회사는 계약의 약정 시점에, 계약 자체가 리스인지, 계약이 리스를 포함하는지를 판단합니다. 다만, 회사는 기준서 제1116호 '리스' 최초적용일인 2019년 1월 1일 이전 계약에 대해서는 실무적 간편법을 적용하여 모든 계약에 대해 다시 판단하지 않았습니다.

리스이용자 및 리스제공자는 리스계약이나 리스를 포함하는 계약에서 계약의 각 리스요소를 리스가 아닌 요소(이하 "비리스요소")와 분리하여 리스로 회계처리합니다. 다만, 회사는 리스이용자로서의 회계처리에서 실무적 간편법을 적용하여 비리스요소를 리스요소와 분리하지 않고 각 리스요소와 관련 비리스요소를 하나의 리스요소로 회계처리합니다.

(1) 리스이용자

회사는 리스개시일에 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산(리스자산)과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다.

사용권자산은 최초 인식 시 원가로 측정하고, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하고, 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다. 또한 사용권자산은 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간
종료일 중 이른 날까지의 기간동안 감가상각합니다. 사용권자산은 재무상태표에 '유형자산'으로 분류합니다.

리스부채는 리스개시일에 그날 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정합니다. 현재가치 측정 시 리스의 내재이자율로 리스료를 할인하되, 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 회사의 증분차입이자율로 리스료를 할인하고 있습니다. 리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의 지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지나 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다. 리스부채는 재무상태표에 '유동성장기부채' 또는 '장기차입금'으로 분류합니다.

단기리스(리스개시일에 리스기간이 12개월 이하)와 소액자산 리스(기초자산 US$ 5,000 이하)의 경우 실무적 간편법을 적용하여 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 비용을 인식합니다.

(2) 리스제공자

리스제공자의 회계처리는 2019년 1월 1일 기준서 제1116호를 최초 적용하기 전의 회계정책과 유의적으로 변동되지 않았습니다.

회사는 리스약정일에 리스자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는 리스는 금융리스로 분류하고, 금융리스 이외의 모든 리스는 운용리스로 분류합니다. 운용리스로부터 발생하는 리스료 수익은 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 인식하고, 운용리스의 협상 및 계약단계에서 발생한 리스개설 직접원가는 리스자산의 장부금액에 가산한 후 리스료 수익에 대응하여 리스기간 동안 비용으로 인식합니다.

2.26 정부보조금

정부보조금은 보조금의 수취와 정부보조금에 부가된 조건의 준수에 대한 합리적인 확신이 있을 때 공정가치로 인식됩니다. 수익과 관련된 정부보조금은 이연하여 정부보조금의 교부목적과 관련된 수익 또는 비용과 대응될 수 있는 기간에 손익계산서에인식하고 있습니다. 한편, 특정 자산의 취득과 관련된 정부보조금은 이연수익으로 처리하고, 정부보조금 관련 이연수익은 관련 자산의 내용연수 동안 상각하여 손익으로 반영하고 있습니다.

2.27 주당이익

기본주당이익은 주주에게 귀속되는 손익계산서상 당기순이익을 보고기간 동안의 회사의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정한 것입니다.

희석주당이익은 주주에게 귀속되는 손익계산서상 당기순이익을 보고기간 동안의 회사의 가중평균 유통보통주식수와 가중평균 잠재적 희석증권주식수로 나누어 산정한 것입니다. 잠재적 희석증권은 희석효과가 발생하는 경우에만 희석주당이익의 계산에반영됩니다.

2.28 보고부문

보고부문은 최고영업의사결정자에게 보고되는 부문별로 공시되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 부문에 배부될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하는데 책임이 있으며, 전략적 의사결정을 수행하는 경영위원회를 최고의사결정자로 보고 있습니다.

2.29 재무제표의 승인

회사의 재무제표는 2023년 1월 31일 이사회에서 승인되었으며, 향후 정기주주총회에서 수정 승인될 수 있습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정:

회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 특히 2020년 부터 발생한 코로나19(COVID-19)의 확산으로 회사의 추정 및 가정에 영향이 발생할 수 있으나, 당기말 현재 그 영향을 합리적으로 추정할 수 없습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 유의적 위험에 대한 추정 및가정은 다음과 같습니다.

가. 수익인식

회사는 고객에게 제품 판매 후 고객이 반품할 것으로 예상되는 제품에 대하여 환불부채와 회수할 재화에 대한 권리를 인식하고 있습니다. 판매 시점에 포트폴리오 수준에서 누적된 경험에 기초하여 기댓값 방법으로 반품률을 예측하고 있으며, 회사의 수익은 예측된 반품률의 변동에 영향을 받습니다.

회사는 재화의 판매로 인한 수익을 통제가 이전되는 시점에 계약에 따른 대가에서 특정 매출장려활동을 차감한 금액으로 인식하고 있습니다. 과거의 경험 및 계약에 기초하여 매출차감액을 합리적으로 추정하고 있으며, 회사의 수익은 추정된 매출차감에 영향을 받습니다.

나. 판매보증충당부채

회사는 판매한 제품에 대하여 품질에 대한 보증의무를 부담하고 있습니다. 회사는 매 보고기간종료일 미래와 현재의 보증의무를 제공하는데 필요하다고 판단되는 최선의 추정치를 기준으로 보증충당부채를 계상하고 있습니다. 이러한 최선의 추정치는 과거 경험에 기초하여 결정하고 있습니다.

다. 금융상품의 공정가치

회사는 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치에 대하여 보고기간종료일 현재 주요한 시장상황을 기초로 다양한 평가기법 및 가정을 사용하여 결정하고 있습니다.

라. 금융자산의 손상

회사는 금융자산의 손실충당금을 측정할 때에 채무불이행위험과기대신용률에대한 가정에 근거하였습니다. 회사는 이러한 가정을 세우고 손상 계산을 위한 투입요소를 선택할 때 보고기간종료일의 미래 전망에 대한 추정 및 과거 경험, 현재 시장 상황에 근거하여 판단합니다.

마. 리스

회사는 리스기간을 산정할 때에 연장선택권을 행사하거나 종료선택권을 행사하지 않을 경제적 유인이 생기게 하는 관련되는 사실 및 상황을 모두 고려합니다. 연장선택권의 대상 기간(또는 종료선택권의 대상 기간)은 리스이용자가 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한 경우에만 리스기간에 포함됩니다.

선택권이 실제로 행사되거나(행사되지 않거나) 회사가 선택권을 행사할(행사하지 않을) 의무를 부담하게 되는 경우에 리스기간을 다시 평가합니다. 리스이용자가 통제할수 있는 범위에 있고 리스기간을 산정할 때에 영향을 미치는 유의적인 사건이 일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때에만 회사는 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한지의 판단을 변경합니다.

바. 순확정급여부채(자산)

순확정급여부채(자산)는 많은 가정을 사용하는 보험수리적 방식에 의해 결정되는 다양한 요소들에 따라 달라질 수 있습니다. 퇴직연금의 순원가(이익)를 결정하는 데 사용되는 가정은 할인율을 포함하고 있으며, 이러한 가정의 변동은 순확정급여부채(자산)의 장부금액에 영향을 줄 것입니다. 회사는 매년 말 우량회사채 이자율을 고려하여 적절한 할인율을 결정하고 있으며 이러한 할인율은 순확정급여부채(자산)의 정산 시 발생할 것으로 예상되는 미래의 추정 현금 유출액의 현재가치를 결정할 때 사용되어야 하는 이자율을 나타냅니다. 순확정급여부채(자산)와 관련된 다른 주요한 가정들은 일부 현재의 시장 상황에 근거하고 있습니다.

사. 영업권 및 내용연수가 비한정인 무형자산의 손상

회사는 매년 영업권 및 내용연수가 비한정인 무형자산의 손상 여부를 검토하고 있습니다. 현금창출단위 또는 자산의 회수가능금액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정하고 있습니다. 이러한 계산은 추정에 근거하여 이루어집니다.

아. 법인세

회사의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. 회사는 보고기간종료일 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세효과를 최선의 추정과정을 거쳐 당기법인세 및 이연법인세로 인식하였습니다. 하지만 실제 미래 최종 법인세부담은 인식한 관련 자산·부채와 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 차이는 최종 세효과가 확정된 시점의 당기법인세 및 이연법인세 자산·부채에 영향을 줄 수 있습니다.

회사는 특정 기간 동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을 때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 회사가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다.

회사는 법인세 처리의 불확실성 여부를 검토하고 있으며, 과세당국이 불확실한 법인세 처리를 수용할 가능성이 높지 않다고 결론 내리는 경우에는 불확실한 법인세 처리각각에 다음 방법 가운데 불확실성의 해소를 더 잘 예측할 것으로 예상하는 방법을 사용하여 불확실성의 영향을 재무제표에 반영하고 있습니다.

(1) 가능성이 가장 높은 금액: 가능한 결과치 범위에서 가능성이 가장 높은 단일금액
(2) 기댓값: 가능한 결과치의 범위에 있는 모든 금액에 각 확률을 곱한 금액의 합

4. 범주별 금융상품:

가. 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	계
현금및현금성자산	3,921,593	-	-	3,921,593
단기금융상품	137	-	-	137
매출채권	20,503,223	-	-	20,503,223
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	1,364,325	-	1,364,325
당기손익-공정가치금융자산	-	-	283	283
기타	5,470,355	-	-	5,470,355
계	29,895,308	1,364,325	283	31,259,916

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	8,729,315	-	8,729,315
단기차입금	-	2,381,512	2,381,512
미지급금	18,324,604	-	18,324,604
유동성장기부채	6,228	129,525	135,753
사채	24,912	-	24,912
장기차입금	-	654,979	654,979
장기미지급금	2,083,790	-	2,083,790
기타	3,145,473	-	3,145,473
계	32,314,322	3,166,016	35,480,338

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	계
현금및현금성자산	3,918,872	-	-	3,918,872
단기금융상품	15,000,576	-	-	15,000,576
매출채권	33,088,247	-	-	33,088,247
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	1,662,532	-	1,662,532
당기손익-공정가치금융자산	-	-	2,135	2,135
기타	5,076,418	-	-	5,076,418
계	57,084,113	1,662,532	2,135	58,748,780

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	11,557,441	-	11,557,441
단기차입금	-	9,204,268	9,204,268
미지급금	12,948,960	-	12,948,960
유동성장기부채	5,810	133,518	139,328
사채	29,048	-	29,048
장기차입금	-	431,915	431,915
장기미지급금	2,335,218	-	2,335,218
기타	3,056,156	-	3,056,156
계	29,932,633	9,769,701	39,702,334

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

나. 금융상품 범주별 순손익 구분

(1) 당기

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	계
평가손익(기타포괄손익)	-	(208,883)	-	(208,883)
평가・처분손익(당기손익)	-	-	271,057	271,057
이자수익	339,242	-	-	339,242
외환차이(당기손익)	(668,955)		-	(668,955)
배당금수익	-	3,594	-	3,594
손상(환입)	(2,130)	-	-	(2,130)

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
이자비용	(45,883)	(244,200)	(290,083)
외환차이(당기손익)	477,397	132,902	610,299

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	계
평가손익(기타포괄손익)	-	(99,916)	-	(99,916)
평가・처분손익(당기손익)	-	-	14,003	14,003
이자수익	260,396	-	-	260,396
외환차이(당기손익)	69,874	-	-	69,874
배당금수익	-	3,118	593	3,711
손상(환입)	(17,144)	-	-	(17,144)

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
이자비용	(49,982)	(100,002)	(149,984)
외환차이(당기손익)	317,176	(21,167)	296,009

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

5. 금융자산의 양도:

회사는 당기 및 전기 중 은행과의 매출채권 팩토링 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 회사가 매출채권 팩토링 거래에서 제공한 매출채권은 채무자의 채무불이행 시의 소구조건 등으로 대부분의 위험과 보상을 회사가 보유하므로 금융자산의 제거요건을 충족하지 않아 제거되지 않았습니다. 이러한 거래에서 인식한 금융부채는 재무상태표에 '단기차입금'으로 분류되어 있습니다(주석 12 참조).

보고기간종료일 현재 매출채권의 할인된 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말
할인된 매출채권의 장부금액	2,381,512	9,204,268
관련 차입금의 장부금액	2,381,512	9,204,268

6. 공정가치금융자산:

가. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기타포괄손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말
지분상품	1,364,325	1,662,532

(2) 당기손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말
채무상품	283	2,135

나. 당기 및 전기 중 공정가치금융자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기타포괄손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
기초	1,662,532	1,539,659
취득	-	260,642
처분	(10,976)	-
공정가치평가	(285,585)	(137,815)
기타	(1,646)	46
기말	1,364,325	1,662,532

(2) 당기손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
기초	2,135	3,107
처분	(1,744)	(912)
기타	(108)	(60)
기말	283	2,135

다. 당기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
기초	124,937	262,752
공정가치평가	(285,585)	(137,815)
처분으로 인한 이익잉여금 대체	(5,987)	-
기말	(166,635)	124,937
차감: 자본에 가감되는 법인세효과	43,991	(34,358)
계	(122,644)	90,579

라. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

기 업 명	당기말				전기말
	보유주식수 (주)	지분율 (%)(*)	취득원가	장부금액 (시장가치)	장부금액 (시장가치)
삼성중공업㈜	134,027,281	15.2	932,158	684,879	759,935
㈜호텔신라	2,004,717	5.1	13,957	166,592	156,368
㈜아이마켓코리아	647,320	1.9	324	6,538	6,926
㈜케이티스카이라이프	240,000	0.5	3,344	1,954	2,194
㈜용평리조트	400,000	0.8	1,869	1,412	1,958
㈜에이테크솔루션	1,592,000	15.9	26,348	12,879	26,188
㈜원익홀딩스	1,759,171	2.3	15,410	5,972	8,761
㈜원익아이피에스	1,850,936	3.8	16,214	45,811	78,295
㈜동진쎄미켐	2,467,894	4.8	48,277	73,913	125,863
솔브레인홀딩스㈜	461,741	2.2	30,752	10,989	15,976
솔브레인㈜	373,368	4.8	24,866	81,357	103,983
㈜에스앤에스텍	1,716,116	8.0	65,933	45,220	63,153
와이아이케이㈜	9,601,617	11.7	47,336	26,933	59,530
㈜케이씨텍	1,022,216	4.9	20,720	15,129	24,584
㈜엘오티베큠	1,267,668	7.1	18,990	14,326	21,805
㈜뉴파워프라즈마	2,140,939	4.9	12,739	7,579	13,723
㈜에프에스티	1,522,975	7.0	43,009	23,758	38,607
㈜디엔에프	810,030	7.0	20,964	10,692	18,509
Marvell	173,187	0.0	11,705	8,129	17,962
SoundHound AI, Inc.	1,702,957	0.9	13,719	3,820	-
계			1,368,634	1,247,882	1,544,320

(*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

7. 매출채권 및 미수금:

가. 보고기간종료일 현재 매출채권 및 미수금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말		전기말	
	매출채권	미수금	매출채권	미수금
채권액	20,720,707	2,945,898	33,353,467	1,855,136
차감: 손실충당금	(56,432)	(6,387)	(56,610)	(4,397)
소 계	20,664,275	2,939,511	33,296,857	1,850,739
차감: 장기 채권	(161,052)	(14,505)	(208,610)	(18,251)
유동항목	20,503,223	2,925,006	33,088,247	1,832,488

보고기간종료일 현재 회사가 은행에 양도한 매출채권은 담보부 차입금으로 회계처리되었으며, 보고기간종료일 현재 2,381,512백만원(전기: 9,204,268백만원)입니다
(주석 12 참조).

나. 당기 및 전기 중 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기		전기	
	매출채권	미수금	매출채권	미수금
기초	56,610	4,397	37,469	7,014
대손상각(환입)	(178)	1,994	19,235	(1,998)
제각	-	(4)	(94)	(619)
기말	56,432	6,387	56,610	4,397

다. 보고기간종료일 현재 기대신용손실을 측정하기 위해 연체일을 기준으로 구분한 매출채권 및 미수금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말		전기말	
	매출채권	미수금	매출채권	미수금
연체되지 않은 채권	19,948,076	2,237,287	32,986,766	1,640,450
연체된 채권(*):				
31일 이하	581,231	651,489	181,986	31,420
31일 초과 90일 이하	89,722	30,611	26,727	17,586
90일 초과	101,678	26,511	157,988	165,680
소 계	772,631	708,611	366,701	214,686
계	20,720,707	2,945,898	33,353,467	1,855,136

(*) 회사는 31일 이하 연체된 매출채권 및 미수금은 신용이 손상된 것으로 간주하지 않습니다.

라. 보고기간종료일 현재 신용위험의 최대 노출금액은 채권의 장부금액입니다. 회사의 주요 채권과 관련하여 보험사와 보험계약을 체결하고 있습니다.

8. 재고자산:

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말			전기말		
	평가전금액	평가충당금	장부금액	평가전금액	평가충당금	장부금액
제품 및 상품	8,589,879	(956,427)	7,633,452	3,884,713	(366,987)	3,517,726
반제품 및 재공품	16,738,121	(1,216,059)	15,522,062	9,384,285	(222,291)	9,161,994
원재료 및 저장품	4,891,951	(492,006)	4,399,945	3,211,380	(258,464)	2,952,916
미착품	434,548	-	434,548	340,417	-	340,417
계	30,654,499	(2,664,492)	27,990,007	16,820,795	(847,742)	15,973,053

당기 중 비용으로 인식한 재고자산의 금액은 151,436,315백만원(전기: 135,609,737백만원)입니다. 동 비용에는 재고자산평가손실(환입) 금액이 포함되어 있습니다.

9. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자:

가. 당기 및 전기 중 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
기초	56,225,599	56,587,548
취득	1,272,296	138,858
처분	(164,503)	(567,693)
손상(환입)	63,857	66,886
기말	57,397,249	56,225,599

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 투자 현황은 다음과 같습니다.
(종속기업 현황은 주석 30 참조)

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월
삼성전기㈜	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국	12월
삼성에스디에스㈜	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합・관리 등 IT 서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국	12월
삼성바이오로직스㈜	신사업 투자	31.2	한국	12월
삼성SDI㈜(*2)	2차전지 등 전자부품의 생산 및 공급	19.6	한국	12월
㈜제일기획	광고 대행업	25.2	한국	12월

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.
(*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

다. 보고기간종료일 현재 주요 종속기업 및 관계기업 투자의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(1) 주요 종속기업

(단위 : 백만원)

기업명(*)	당기			
	자산	부채	매출액	당기순이익
삼성디스플레이㈜	57,302,567	7,282,718	30,779,405	4,365,588
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	37,883,156	12,258,315	46,738,920	219,670
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	26,894,611	2,678,285	-	8,699,679
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	17,095,000	2,970,835	9,679,757	638,385
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	13,830,988	9,764,636	2,865,831	257,878
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	10,841,515	6,272,800	-	57,997
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	6,772,537	3,571,863	16,180,492	508,510
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	5,067,891	2,858,382	21,370,622	318,578
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	4,600,508	1,342,517	7,485,104	(38,490)
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	3,263,473	486,820	4,824,734	168,524
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	2,819,792	1,708,064	5,929,357	243,396
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	2,377,730	597,044	2,834,008	25,411
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	2,374,317	452,628	3,935,745	199,742
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	2,194,975	2,021,491	15,409,984	20,347
세메스㈜	2,065,558	602,323	2,889,238	185,762

(*) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(단위 : 백만원)

기업명(*)	전기			
	자산	부채	매출액	당기순이익
삼성디스플레이㈜	54,967,156	9,081,737	28,755,975	2,770,060
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	42,982,054	19,246,751	42,325,524	823,914
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	13,599,093	9,685,278	2,615,685	451,062
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	19,049,536	5,168,738	7,341,018	1,708,832
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	14,651,496	8,998,502	-	24,527
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	14,683,789	58,381	-	4,668,478
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	7,765,126	5,799,690	31,326,186	325,397
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	4,589,505	1,671,097	6,020,523	490,202
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	7,765,019	3,236,745	12,222,643	522,672
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	3,018,358	474,223	4,443,031	142,191
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	2,925,062	1,992,367	5,621,922	241,403
Samsung Electronics GmbH (SEG)	2,289,391	2,228,650	6,385,080	2,158
Samsung Electronics Hungarian Private Co., Ltd. (SEH)	2,504,075	641,004	4,357,137	157,616
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	2,612,357	766,034	2,569,603	284,816
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	2,305,275	2,144,805	14,700,517	13,943

(*) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(2) 주요 관계기업

(단위 : 백만원)

구 분	당기				
	삼성전기㈜	삼성에스디에스㈜	삼성바이오로직스㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획
요약 재무상태표:					
유동자산	4,888,319	8,005,764	6,457,657	9,651,702	2,193,979
비유동자산	6,108,852	3,946,660	10,124,394	20,605,823	557,466
유동부채	2,525,123	2,493,323	4,181,542	8,006,939	1,335,643
비유동부채	778,563	992,132	3,416,034	5,033,084	194,373
요약 포괄손익계산서:					
매출	9,441,276	17,234,750	3,001,295	20,124,070	4,253,367
계속영업손익(*)	993,519	1,099,745	798,056	1,952,149	193,732
세후중단영업손익(*)	-	-	-	-	-
기타포괄손익(*)	(9,601)	80,368	6,995	(139,877)	(1,122)
총포괄손익(*)	983,918	1,180,113	805,051	1,812,272	192,610

(*) 관계기업별 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	전기				
	삼성전기㈜	삼성에스디에스㈜	삼성바이오로직스㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획
요약 재무상태표:					
유동자산	4,598,269	7,575,968	2,823,175	7,444,907	2,018,598
비유동자산	5,343,105	2,941,464	5,146,835	18,388,286	523,513
유동부채	2,234,657	2,370,290	1,107,295	6,461,286	1,224,222
비유동부채	835,592	703,442	1,871,614	4,175,208	190,622
요약 포괄손익계산서:					
매출	9,675,036	13,630,002	1,568,007	13,553,220	3,325,712
계속영업손익(*)	1,055,411	611,171	393,589	1,169,801	165,485
세후중단영업손익(*)	(162,966)	-	-	-	-
기타포괄손익(*)	151,809	134,163	(1,270)	623,792	32,535
총포괄손익(*)	1,044,254	745,334	392,319	1,793,593	198,020

(*) 관계기업별 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

라. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

구 분	당기말			전기말	
	주식수(주)	시장가치	장부금액	시장가치	장부금액
삼성전기㈜	17,693,084	2,308,947	445,244	3,494,384	445,244
삼성에스디에스㈜	17,472,110	2,149,070	560,827	2,734,385	560,827
삼성바이오로직스㈜	22,217,309	18,240,411	1,595,892	18,815,659	443,193
삼성SDI㈜	13,462,673	7,956,440	1,242,605	8,818,051	1,242,605
㈜제일기획	29,038,075	669,328	491,599	663,520	491,599

10. 유형자산:

가. 당기 및 전기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위 : 백만원)

구 분	토지	건물및구축물	기계장치	건설중인자산	기타	계
기초장부금액	7,780,994	21,841,816	57,135,313	15,307,502	1,601,400	103,667,025
- 취득원가	7,782,125	33,244,532	175,487,461	15,307,502	4,022,759	235,844,379
- 감가상각누계액(손상 포함)	(1,131)	(11,402,716)	(118,352,148)	-	(2,421,359)	(132,177,354)
일반취득 및 자본적지출(*)	154	3,246,081	26,182,600	13,481,591	1,085,750	43,996,176
감가상각	(439)	(1,827,588)	(21,889,623)	-	(594,290)	(24,311,940)
처분・폐기	(27,720)	(20,264)	(137,496)	-	(8,247)	(193,727)
기타	-	6,577	135,746	(20,729)	(12,142)	109,452
기말장부금액	7,752,989	23,246,622	61,426,540	28,768,364	2,072,471	123,266,986
- 취득원가	7,754,559	36,449,026	199,823,339	28,768,364	4,886,059	277,681,347
- 감가상각누계액(손상 포함)	(1,570)	(13,202,404)	(138,396,799)	-	(2,813,588)	(154,414,361)

(*) 자본화된 차입원가는 40,577백만원이며, 자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화 이자율은 4.1%입니다
.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

구 분	토지	건물및구축물	기계장치	건설중인자산	기타	계
기초장부금액	7,800,435	19,087,134	43,749,609	13,994,259	1,535,487	86,166,924
- 취득원가	7,801,259	28,992,675	146,778,918	13,994,259	3,535,985	201,103,096
- 감가상각누계액(손상 포함)	(824)	(9,905,541)	(103,029,309)	-	(2,000,498)	(114,936,172)
일반취득 및 자본적지출(*)	5,295	4,385,819	31,501,402	1,339,173	607,076	37,838,765
감가상각	(406)	(1,614,006)	(18,016,803)	-	(532,894)	(20,164,109)
처분・폐기	(24,319)	(5,104)	(108,737)	-	(5,402)	(143,562)
기타	(11)	(12,027)	9,842	(25,930)	(2,867)	(30,993)
기말장부금액	7,780,994	21,841,816	57,135,313	15,307,502	1,601,400	103,667,025
- 취득원가	7,782,125	33,244,532	175,487,461	15,307,502	4,022,759	235,844,379
- 감가상각누계액(손상 포함)	(1,131)	(11,402,716)	(118,352,148)	-	(2,421,359)	(132,177,354)

(*) 자본화된 차입원가는 21,911백만원이며, 자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화 이자율은 1.1%입니다
.

나. 당기 및 전기 중 유형자산에 포함된 사용권자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위 : 백만원)

구 분	토지	건물및구축물	기계장치	기타	계
기초장부금액	2,279	510,528	39,038	178,480	730,325
일반취득	26	261,999	1,380	410,088	673,493
감가상각	(439)	(128,754)	(23,276)	(19,120)	(171,589)
계약의 해지	-	(1,070)	-	(737)	(1,807)
기타	-	(3)	4,993	601	5,591
기말장부금액	1,866	642,700	22,135	569,312	1,236,013

(2) 전기

(단위 : 백만원)

구 분	토지	건물및구축물	기계장치	기타	계
기초장부금액	2,593	144,615	70,429	188,236	405,873
일반취득	91	446,071	4,674	992	451,828
감가상각	(405)	(80,085)	(36,065)	(9,617)	(126,172)
계약의 해지	-	(28)	-	(1,131)	(1,159)
기타	-	(45)	-	-	(45)
기말장부금액	2,279	510,528	39,038	178,480	730,325

다. 당기 및 전기 중 계정과목별 유형자산 상각 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
매출원가	22,486,452	18,479,655
판매비와관리비 등	1,825,488	1,684,454
계	24,311,940	20,164,109

11. 무형자산:

가. 당기 및 전기 중 무형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위 : 백만원)

구 분	산업재산권	개발비	회원권	기타	계
기초장부금액	1,226,241	236,910	195,135	6,999,170	8,657,456
개별 취득	232,768	-	5,795	2,315,598	2,554,161
내부개발에 의한 취득	-	-	-	-	-
상각	(217,808)	(151,892)	-	(2,235,367)	(2,605,067)
처분・폐기	(47,915)	-	(197)	-	(48,112)
손상(환입)	-	-	(863)	-	(863)
기타	-	-	-	3,849	3,849
기말장부금액	1,193,286	85,018	199,870	7,083,250	8,561,424

(2) 전기

(단위 : 백만원)

구 분	산업재산권	개발비	회원권	기타	계
기초장부금액	1,195,319	371,392	194,277	5,241,660	7,002,648
개별 취득	286,963	-	4,329	3,610,518	3,901,810
내부개발에 의한 취득	-	193,708	-	-	193,708
상각	(218,754)	(321,608)	-	(1,851,408)	(2,391,770)
처분・폐기	(42,031)	-	-	(557)	(42,588)
손상(환입)	-	-	(3,471)	-	(3,471)
기타	4,744	(6,582)	-	(1,043)	(2,881)
기말장부금액	1,226,241	236,910	195,135	6,999,170	8,657,456

나. 당기 및 전기 중 계정과목별 무형자산 상각 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
매출원가	2,006,928	1,931,598
판매비와관리비 등	598,139	460,172
계	2,605,067	2,391,770

12. 차입금:

가. 보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	차입처	연이자율(%)	금 액	
		당기말	당기말	전기말
단기차입금:				
담보부차입금(*1)	우리은행 등	0.0 ~ 16.7	2,381,512	9,204,268
유동성장기차입금:				
리스부채(*2)	-	1.6	129,525	133,518
장기차입금:				
리스부채(*2)	-	1.6	654,979	431,915

(*1) 담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.

(*2) 리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며, 당기 중 발생한 이자비용은 10,876백만원(전기: 4,939백만원)입니다. 또한, 채무불이행이 발생할 경우에 대비하여 리스제공자에게 사용권자산에 대한 권리를 담보로 제공하였습니다. 한편, 당기 중 리스부채 측정치에 포함되지 않은 단기리스료, 소액자산 리스료 등은 63,103백만원(전기: 56,750백만원)입니다.

나. 보고기간종료일 현재 리스부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

상환연도	금 액
2023년	149,150
2024년	151,838
2025년	146,916
2026년	131,801
2027년 이후	303,645
계	883,350

13. 사채:

가. 보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : %, 백만원)

구 분	발행일	만기상환일	연이자율(%)	금 액	
			당기말	당기말	전기말
US$ denominated Straight Bonds(*)	1997.10.02	2027.10.01	7.7	31,683 (US$ 25,000천)	35,565 (US$ 30,000천)
사채할인발행차금				(543)	(707)
계				31,140	34,858
차감: 유동성사채				(6,228)	(5,810)
비유동성사채				24,912	29,048

(*) 10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

나. 보고기간종료일 현재 사채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

상환연도	금 액
2023년	6,337
2024년	6,337
2025년	6,337
2026년	6,337
2027년 이후	6,335
계	31,683

14. 순확정급여부채(자산):

가. 보고기간종료일 현재 순확정급여부채(자산)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치	10,729,126	11,155,187
기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치	29,546	18,449
소 계	10,758,672	11,173,636
사외적립자산의 공정가치	(15,168,895)	(13,497,927)
순확정급여부채(자산) 계	(4,410,223)	(2,324,291)

나. 당기 및 전기 중 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
당기근무원가	1,030,033	907,450
순이자원가(수익)	(91,902)	(40,104)
계	938,131	867,346

다. 당기 및 전기 중 확정급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
매출원가	373,835	341,934
판매비와관리비 등	564,296	525,412
계	938,131	867,346

라. 당기 및 전기 중 확정급여채무의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
기초	11,173,636	9,754,082
당기근무원가	1,030,033	907,450
이자원가	401,973	296,029
확정급여채무의 재측정요소:		
- 인구통계적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익	-	-
- 재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익	(1,779,803)	150,624
- 기타사항에 의한 효과	356,672	429,051
급여지급액	(455,787)	(374,416)
기타	31,948	10,816
기말	10,758,672	11,173,636

마. 당기 및 전기 중 사외적립자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
기초	13,497,927	10,916,538
사외적립자산의 이자수익	493,875	336,133
사외적립자산의 재측정요소	(249,943)	(128,336)
사용자의 기여금	1,757,800	2,640,100
급여지급액	(355,311)	(276,733)
기타	24,547	10,225
기말	15,168,895	13,497,927

한편, 확정급여제도와 관련하여 2023년도에 납입할 것으로 예상되는 사용자 기여금의 합리적인 추정치는 1,451,728백만원입니다.

바. 보고기간종료일 현재 사외적립자산은 원금보장형 고정수익 상품 등에 투자되어 있습니다.

사. 보고기간종료일 현재 사용한 주요 보험수리적 가정은 다음과 같습니다.

(단위 : %)

구 분	당기말	전기말
할인율	6.1	3.8
미래임금상승률 (인플레이션 효과 포함)	5.8	5.3

아. 보고기간종료일 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 민감도 분석은 다음과 같습니다.

(단위 : %)

구 분	당기말	전기말
할인율:		
1%p 증가	92	91
1%p 감소	109	110
임금상승률:		
1%p 증가	109	110
1%p 감소	92	91

자. 보고기간종료일 현재 확정급여채무의 가중평균만기는 8.1년입니다.

15. 충당부채:

당기 중 충당부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	판매보증 (가)	기술사용료 (나)	장기성과급 (다)	기타 (라),(마)	계
기초	386,713	1,496,525	558,982	2,861,407	5,303,627
순전입(환입)	764,209	590,483	184,480	865,232	2,404,404
사용	(563,257)	(608,120)	(194,281)	(964,082)	(2,329,740)
기타	-	67,718	-	36,647	104,365
기말	587,665	1,546,606	549,181	2,799,204	5,482,656

가. 회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다.

나. 회사는 협상 진행 중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과 기간 해당분을 충당부채로 계상하고 있습니다.

라. 회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용 등을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

마. 회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

(1) 보고기간종료일 현재 당기 이행연도에 대한 무상할당 배출권과 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 만톤(tCO2-eq))

구 분	당기말
무상할당 배출권	1,147
배출량 추정치	1,521

(*) 보고기간종료일 현재 잔여 계획기간에 대해 무상할당 받은 배출권 수량은 3,361만톤(2023년 1,127만톤, 2024년 1,117만톤, 2025년 1,117만톤)입니다.

(2) 당기 및 전기 중 배출권 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
기초	46,073	44,865
증가	1,872	1,312
사용	(28,378)	(104)
기말	19,567	46,073

(*) 보고기간종료일 현재 보유중인 배출권 수량은 4,589만톤이며, 담보로 제공한 배출권은 없습니다.

(3) 당기 및 전기 중 배출부채 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
기초	45,049	31,777
순전입	16,154	13,376
사용	(28,378)	(104)
기말	32,825	45,049

16. 우발부채와 약정사항:

가. 지급보증한 내역

(1) 보고기간종료일 현재 회사가 해외종속기업의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 채무보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

해외종속기업	보증처	보증종료일	당기말	
			관련 차입금	채무보증한도
SETK	BNP 외	2023-12-16	303,386	984,692
SEDAM	Citibank 외	2023-12-16	197,405	680,540
SETK-P	BNP 외	2023-12-16	32,506	164,749
SEIL	Citibank	2023-12-16	12,248	19,770
기타	기타	-	-	8,474,399
계			545,545 (US$ 430,476천)	10,324,150 (US$ 8,146,572천)

(2) 보고기간종료일 현재 회사가 해외종속기업의 계약이행을 위하여 제공하고 있는 지급보증 한도액은 469,262백만원입니다.

(3) 보고기간종료일 현재 회사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.

나. 소송 등

보고기간종료일 현재 회사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

다. 분할과 관련된 연대채무

회사와 삼성디스플레이㈜ 등은 분할된 삼성디스플레이㈜ 등의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

라. 기타 약정사항

(1) 보고기간종료일 현재 회사는 우리은행 외 4개 은행과 무역금융, 상업어음할인 및 외상매출채권담보대출 등의 약정을 맺고 있으며 동 약정에 대한 통합한도액은 10,411,963백만원입니다. 이외에도 회사는 신한은행 외 18개 은행과 한도액 US$ 8,950백만의 무역금융 약정을 체결하고 있으며, 구매대금의 지급과 관련하여 기업은행 외
3개 은행과 한도액 415,048백만원의 외상매출채권담보대출 약정 등을 맺고 있습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 발생하지 않은 유・무형자산의 취득을 위한 약정액은 7,191,569백만원입니다.

17. 계약부채:

보고기간종료일 현재 계약부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말
계약부채(*)	1,133,426	1,104,756

(*) 계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

회사가 당기초 계약부채 잔액 중 당기에 수익으로 인식한 금액은 361,591백만원입니다.

18. 자본금:

보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250억주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사가 발행한 보통주 및 우선주의 수(소각 주식수 제외)는 각각 5,969,782,550주와 822,886,700주입니다. 보고기간종료일 현재 유통주식수는 상기 발행주식의 수와 동일하며, 당기 및 전기 중 변동사항은 없습니다. 한편, 발행주식의 액면총액은 679,267백만원(보통주 596,978백만원, 우선주 82,289백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다.

19. 이익잉여금:

가. 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말
(1) 법정적립금:		
이익준비금(*1)	450,789	450,789
(2) 임의적립금	185,870,540	164,709,023
(3) 미처분이익잉여금	18,066,687	23,614,523
계	204,388,016	188,774,335

(*1) 회사는 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으나, 보고기간종료일 현재 회사의 이익준비금이 납입자본의 50%에 달하였으므로 추가 적립할 의무는 없습니다.

나. 당기 및 전기의 회사의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다(전기 처분확정일: 2022년 3월 16일).

(단위 : 백만원)

과 목	제 54 (당) 기		제 53 (전) 기	
Ⅰ. 미처분이익잉여금		18,066,687		23,614,523
1. 전기이월이익잉여금	30		30	
2. 분기배당 주당배당금(률) 제54기 - 1,083원(1083%) 제53기 - 1,083원(1083%)	(7,356,461)		(7,356,461)	
3. 당기순이익	25,418,778		30,970,954	
4. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분	4,340		-	
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액		-		-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		18,066,657		23,614,493
1. 배당금 주당배당금(률) 제54기 - 보통주: 361원(361%) 우선주: 362원(362%) 제53기 - 보통주: 361원(361%) 우선주: 362원(362%)	2,452,976		2,452,976	
2. 연구및인력개발준비금	15,613,681		21,161,517	
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		30		30

다. 당기 및 전기 중 배당금 산정 내역은 다음과 같습니다.

(1) 분기배당(배당기준일: 2022년과 2021년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일)

(단위 : 주, %, 백만원)

구 분			당기	전기
1분기	배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
		우선주	822,886,700주	822,886,700주
	배당률(액면가 기준)	보통주・우선주	361%	361%
	배당금액	보통주	2,155,092	2,155,092
		우선주	297,062	297,062
		계	2,452,154	2,452,154
2분기	배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
		우선주	822,886,700주	822,886,700주
	배당률(액면가 기준)	보통주・우선주	361%	361%
	배당금액	보통주	2,155,092	2,155,092
		우선주	297,062	297,062
		계	2,452,154	2,452,154
3분기	배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
		우선주	822,886,700주	822,886,700주
	배당률(액면가 기준)	보통주・우선주	361%	361%
	배당금액	보통주	2,155,092	2,155,092
		우선주	297,062	297,062
		계	2,452,154	2,452,154

(2) 기말배당 (배당기준일: 2022년과 2021년 12월 31일)

(단위 : 주, %, 백만원)

구 분		당기	전기
배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
	우선주	822,886,700주	822,886,700주
배당률(액면가 기준)	보통주	361%	361%
	우선주	362%	362%
배당금액	보통주	2,155,092	2,155,092
	우선주	297,884	297,884
	계	2,452,976	2,452,976

20. 기타자본항목:

보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(122,644)	90,579
순확정급여부채(자산) 재측정요소	(1,910,996)	(2,732,997)
기타	1,760,408	1,760,408
계	(273,232)	(882,010)

21. 비용의 성격별 분류:

당기 및 전기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
제품 및 재공품 등의 변동	(10,475,794)	(1,423,122)
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	107,383,581	90,519,249
급여	14,861,811	14,870,760
퇴직급여	974,711	898,132
감가상각비	24,311,940	20,164,109
무형자산상각비	2,605,067	2,391,770
복리후생비	3,220,421	2,630,171
유틸리티비	3,779,467	2,903,838
외주용역비	3,623,225	3,106,610
광고선전비	1,662,135	1,945,358
판매촉진비	1,385,835	1,066,434
기타비용	33,215,755	28,678,234
계(*)	186,548,154	167,751,543

(*) 손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

22. 판매비와관리비:

당기 및 전기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
(1) 판매비와관리비:		
급여	2,308,767	2,396,978
퇴직급여	171,358	163,395
지급수수료	2,652,491	2,397,640
감가상각비	412,787	396,881
무형자산상각비	361,653	220,616
광고선전비	1,662,135	1,945,358
판매촉진비	1,385,835	1,066,434
운반비	790,774	907,948
서비스비	935,838	1,675,628
기타판매비와관리비	2,333,072	1,911,866
소 계	13,014,710	13,082,744
(2) 경상연구개발비:		
연구개발 총지출액	20,944,051	19,039,074
개발비 자산화	-	(193,708)
소 계	20,944,051	18,845,366
계	33,958,761	31,928,110

23. 기타수익 및 기타비용:

당기 및 전기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
(1) 기타수익:		
배당금수익	3,952,338	6,560,011
임대료수익	173,719	164,197
유형자산처분이익	115,861	278,849
기타	334,460	355,947
계	4,576,378	7,359,004
(2) 기타비용:		
유형자산처분손실	18,842	13,366
기부금	220,309	195,457
기타	57,193	537,155
계	296,344	745,978

24. 금융수익 및 금융비용:

당기 및 전기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
(1) 금융수익:		
이자수익	339,242	260,396
- 상각후원가 측정 금융자산	339,242	260,396
외환차이	9,124,484	3,497,401
파생상품관련이익	270,573	39,182
계	9,734,299	3,796,979
(2) 금융비용:		
이자비용	290,083	149,984
- 상각후원가 측정 금융부채	45,883	49,982
- 기타금융부채	244,200	100,002
외환차이	9,351,659	3,485,602
파생상품관련손실	-	63,089
계	9,641,742	3,698,675

회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

25. 법인세비용:

가. 당기 및 전기 중 법인세비용의 주요 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
(1) 당기법인세:		
기간손익에 대한 당기법인세	5,926,928	8,041,604
당기에 인식한 조정사항	(449,536)	(321,952)
소 계	5,477,392	7,719,652
(2) 이연법인세:		
세액공제의 이월로 인한 이연법인세변동액	(1,010,632)	(332,351)
일시적차이로 인한 이연법인세변동액	(193,618)	346,237
소 계	(1,204,250)	13,886
(3) 자본에 직접 부가되는 법인세부담액	-	-
법인세비용 계	4,273,142	7,733,538

나. 당기 및 전기 중 회사의 법인세비용차감전순이익에 대한 법인세비용과 적용세율을 사용하여 이론적으로 계산된 금액과의 차이는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
법인세비용차감전순이익	29,691,920	38,704,492
(1) 적용세율에 따른 법인세비용(*)	8,165,278	10,643,735
(2) 조정사항:		
세무상 과세되지 않는 수익	(47,446)	(34,706)
세무상 차감되지 않는 비용	507,992	651,517
세액공제	(4,133,747)	(3,420,702)
기타	(218,935)	(106,306)
소 계	(3,892,136)	(2,910,197)
법인세비용 계	4,273,142	7,733,538

(*) 보고기간종료일 현재 제정된 세법에서 규정한 법정세율을 적용하여 산정하였습니다.

다. 당기 및 전기 중 누적일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위 : 백만원)

계 정 과 목	누적일시적차이			이연법인세자산(부채)		
	기초잔액	증감액	기말잔액	기초 이연법인세 자산(부채)	증감액	기말 이연법인세 자산(부채)
1) 일시적차이로 인한 이연법인세:						
토지재평가	(3,406,625)	3,195	(3,403,430)	(936,822)	38,317	(898,505)
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자(*1)	(3,837,368)	-	(3,837,368)	(853,165)	34,127	(819,038)
감가상각누계액 등	(2,456,302)	(3,733,239)	(6,189,541)	(675,483)	(958,555)	(1,634,038)
미수수익	(54,107)	44,687	(9,420)	(14,879)	12,392	(2,487)
충당부채 및 미지급비용 등	11,098,305	2,589,469	13,687,774	3,052,034	561,538	3,613,572
외화평가조정	(5,313)	562,866	557,553	(1,461)	148,655	147,194
자산손상	1,096,297	(105,290)	991,007	220,916	(36,634)	184,282
퇴직급여	(6,093,355)	685,667	(5,407,688)	(1,675,673)	248,043	(1,427,630)
분할 시 투자주식 평가증(*2)	10,586,822	-	10,586,822	-	-	-
기타	3,897,591	624,521	4,522,112	478,445	145,735	624,180
소 계	10,825,945	671,876	11,497,821	(406,088)	193,618	(212,470)
2) 세액공제로 인한 이연법인세:						
세액공제이월액	672,053	1,153,334	1,825,387	614,893	1,010,632	1,625,525
3) 자본에 직접 가감하는 이연법인세:						
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 등	(124,938)	291,573	166,635	(34,358)	78,349	43,991
순확정급여부채(자산) 재측정요소	3,769,652	(1,173,189)	2,596,463	1,036,653	(351,187)	685,466
소 계	3,644,714	(881,616)	2,763,098	1,002,295	(272,838)	729,457
이연법인세자산(부채) 계				1,211,100	931,412	2,142,512

(*1) 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자와 관련된 차감할 일시적차이 중 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높지 않을 경우 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다.

(*2) 과거 LCD 사업부문 분할로 인하여 교부 받은 삼성디스플레이㈜ 투자주식에 대한 세무상 장부금액과 회계상 장부금액의 차이입니다. 보고기간종료일 현재 회사는 향후 삼성디스플레이㈜ 주식을 처분하지 않을 예정이므로, 동 투자주식의 차감할 일시적차이가 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높지 않을 것으로 보아 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

계 정 과 목	누적일시적차이			이연법인세자산(부채)		
	기초잔액	증감액	기말잔액	기초 이연법인세 자산(부채)	증감액	기말 이연법인세 자산(부채)
1) 일시적차이로 인한 이연법인세:						
토지재평가	(3,420,886)	14,261	(3,406,625)	(940,744)	3,922	(936,822)
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자(*1)	(3,994,444)	157,076	(3,837,368)	(909,018)	55,853	(853,165)
감가상각누계액 등	(514,103)	(1,942,199)	(2,456,302)	(141,379)	(534,104)	(675,483)
미수수익	(112,810)	58,703	(54,107)	(31,023)	16,144	(14,879)
충당부채 및 미지급비용 등	9,540,744	1,557,561	11,098,305	2,623,704	428,330	3,052,034
외화평가조정	(51,955)	46,642	(5,313)	(14,288)	12,827	(1,461)
자산손상	1,744,851	(648,554)	1,096,297	399,268	(178,352)	220,916
퇴직급여	(4,223,358)	(1,869,997)	(6,093,355)	(1,161,424)	(514,249)	(1,675,673)
분할 시 투자주식 평가증(*2)	10,586,822	-	10,586,822	-	-	-
기타	1,038,962	2,858,629	3,897,591	115,053	363,392	478,445
소 계	10,593,823	232,122	10,825,945	(59,851)	(346,237)	(406,088)
2) 세액공제로 인한 이연법인세:						
세액공제이월액	282,542	389,511	672,053	282,542	332,351	614,893
3) 자본에 직접 가감하는 이연법인세:						
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 등	(262,753)	137,815	(124,938)	(72,257)	37,899	(34,358)
순확정급여부채(자산) 재측정요소	3,061,640	708,012	3,769,652	841,951	194,702	1,036,653
소 계	2,798,887	845,827	3,644,714	769,694	232,601	1,002,295
이연법인세자산(부채) 계				992,385	218,715	1,211,100

(*1) 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자와 관련된 차감할 일시적차이 중 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높지 않을 경우 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다.

(*2) 과거 LCD 사업부문 분할로 인하여 교부 받은 삼성디스플레이㈜ 투자주식에 대한 세무상 장부금액과 회계상 장부금액의 차이입니다. 보고기간종료일 현재 회사는 향후 삼성디스플레이㈜ 주식을 처분하지 않을 예정이므로, 동 투자주식의 차감할 일시적차이가 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높지 않을 것으로 보아 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다.

라. 보고기간종료일 현재 이연법인세자산(부채)의 회수(결제) 시기는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말
12개월 이내에 회수(결제)될 이연법인세자산(부채)	2,267,807	2,837,162
12개월 이후에 회수(결제)될 이연법인세자산(부채)	(125,295)	(1,626,062)
계	2,142,512	1,211,100

26. 주당이익:

가. 기본주당순이익

당기 및 전기 중 기본주당이익 산정 내역은 다음과 같습니다.

(1) 보통주

(단위 : 백만원, 천주, 원)

구 분	당기	전기
당기순이익	25,418,778	30,970,954
당기순이익 중 보통주 해당분	22,338,739	27,218,306
÷ 가중평균유통보통주식수(천주)	5,969,783	5,969,783
기본 보통주 주당이익(원)	3,742	4,559

(2) 우선주

(단위 : 백만원, 천주, 원)

구 분	당기	전기
당기순이익	25,418,778	30,970,954
당기순이익 중 우선주 해당분	3,080,039	3,752,648
÷ 가중평균유통우선주식수(천주)	822,887	822,887
기본 우선주 주당이익(원)	3,743	4,560

나. 희석주당순이익

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당기 및 전기의 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

27. 현금흐름표:

가. 회사는 영업활동 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다. 당기 및 전기 중 영업활동 현금흐름 관련 조정 내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

(1) 조정 내역

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
법인세비용	4,273,142	7,733,538
금융수익	(1,224,148)	(514,303)
금융비용	1,565,955	636,934
퇴직급여	974,711	898,132
감가상각비	24,311,940	20,164,109
무형자산상각비	2,605,067	2,391,770
대손상각비(환입)	(178)	19,235
배당금수익	(3,952,338)	(6,560,011)
유형자산처분이익	(115,861)	(278,849)
유형자산처분손실	18,842	13,366
재고자산평가손실(환입) 등	2,529,351	696,536
기타	52,905	(32,395)
계	31,039,388	25,168,062

(2) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
매출채권의 감소(증가)	12,354,628	(8,102,318)
미수금의 감소(증가)	(711,933)	54,306
장단기선급비용의 감소(증가)	11,033	(198,371)
재고자산의 감소(증가)	(14,337,291)	(2,732,143)
매입채무의 증가(감소)	(2,494,560)	4,935,529
장단기미지급금의 증가(감소)	1,522,457	1,004,128
선수금의 증가(감소)	(154,042)	50,363
예수금의 증가(감소)	(101,231)	191,872
미지급비용의 증가(감소)	88,828	920,919
장단기충당부채의 증가(감소)	74,664	1,570,118
퇴직금의 지급	(492,366)	(405,203)
사외적립자산의 감소(증가)	(1,402,489)	(2,363,367)
기타	(1,225,967)	(707,488)
계	(6,868,269)	(5,781,655)

나. 당기 및 전기 중 투자・재무활동 현금흐름 관련 주요 비현금거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가	(285,585)	(137,815)
유형자산의 본계정 대체	30,539,179	36,663,946
사용권자산의 취득(리스부채의 신규계약)	673,493	451,828
사채의 유동성 대체	6,228	5,810
장기차입금의 유동성 대체	129,525	133,518

다. 당기 및 전기 중 재무활동 현금흐름에서 생기는 부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위 : 백만원)

구 분	기초	재무현금흐름	비현금흐름		기말
			리스신규계약	기타(*)	
단기차입금	9,204,268	(6,700,826)	-	(121,930)	2,381,512
사채 및 장기차입금	600,291	(155,264)	673,493	(302,876)	815,644
계	9,804,559	(6,856,090)	673,493	(424,806)	3,197,156

(*) 상각, 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

구 분	기초	재무현금흐름	비현금흐름		기말
			리스신규계약	기타(*)	
단기차입금	12,520,367	(3,288,858)	-	(27,241)	9,204,268
사채 및 장기차입금	269,877	(117,963)	451,828	(3,451)	600,291
계	12,790,244	(3,406,821)	451,828	(30,692)	9,804,559

(*) 상각, 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

한편, 당기 및 전기 중 리스부채와 관련하여 발생한 원금 상환에 따른 현금유출액(재무활동)은 149,337백만원 및 112,523백만원, 이자비용 현금유출액(영업활동)은 10,876백만원 및 4,939백만원입니다.

라. 회사는 거래가 빈번하며 총금액이 크고 단기간에 만기가 도래하는 단기금융상품,단기차입금 등으로 인한 현금의 유입과 유출항목을 순증감액으로 작성하였습니다. 한편, 보고기간 종료일 현재 회사의 현금및현금성자산은 대부분 예금 등으로 구성되어 있습니다.

28. 재무위험관리:

회사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책과 프로그램을 운영하고 있습니다. 위험을 회피하기 위한 파생상품의 이용도 이 프로그램에 포함되어 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 글로벌 재무위험 관리정책을 수립한 후 주기적으로 재무위험 측정, 헷지 및 평가 등을 실행하고 있습니다.

한편, 해외 주요 권역별로 지역 금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역 내 자금을 통합운용하여 유동성위험을 관리하고 있습니다.

재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

회사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, INR 등이 있습니다.

회사는 환율변동과는 무관하게 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융 거래 발생 시 현지 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 또한, 회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 기능통화와 다른 주요 외화로 표시된 금융자산 및 금융부채에 대하여 환율이 5% 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말		전기말	
	환율 상승시	환율 하락시	환율 상승시	환율 하락시
USD	77,795	(77,795)	119,312	(119,312)
EUR	(53,114)	53,114	(33,776)	33,776
INR	52,012	(52,012)	25,057	(25,057)

(2) 이자율변동위험

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 회사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.

(3) 주가변동위험

회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 12,479백만원(전기: 15,443백만원)입니다.

나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재경팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독하에 이루어지고 있습니다. 회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

보고기간종료일 현재 회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

다. 유동성위험

대규모 투자가 많은 회사 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금 수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지・관리하고 있습니다.

회사는 주기적으로 미래 현금 흐름을 예측하여 유동성위험을 사전 관리하고 있습니다. 권역별로 Cash Pooling을 구축・활용하여 권역 내 자금 부족의 경우에도 내부 자금을 활용하여 유동성위험을 효율적으로 관리하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사 간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성위험을 최소화하는 한편 자금운용부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 회사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

또한, 만약의 대규모 유동성 필요에 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따라 만기별로 구분된 유동성은 다음과 같습니다.

(1) 당기말

(단위 : 백만원)

구 분	3개월 이내	~6개월	~1년	1~5년	5년 초과
금융부채	31,354,944	316,725	1,096,183	2,431,415	472,135

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

구 분	3개월 이내	~6개월	~1년	1~5년	5년 초과
금융부채	35,764,225	435,581	728,627	2,798,560	87,798

위의 분석에 포함된 금융부채는 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다.

당기말 현재 상기 금융부채 외 종속기업 지급보증 및 이행보증 등으로 노출된 유동성위험의 최대금액은 10,793,412백만원(전기말: 10,211,619백만원)입니다.

라. 자본위험

회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 회사는 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 Aa2 평가등급을 받고 있으며, 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말
부 채	50,667,559	57,918,452
자 본	209,416,191	193,193,732
부채비율	24.2%	30.0%

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산:				
현금및현금성자산	3,921,593	(*1)	3,918,872	(*1)
단기금융상품	137	(*1)	15,000,576	(*1)
매출채권	20,503,223	(*1)	33,088,247	(*1)
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,364,325	1,364,325	1,662,532	1,662,532
당기손익-공정가치금융자산	283	283	2,135	2,135
기타	5,470,355	(*1)	5,076,418	(*1)
계	31,259,916		58,748,780	
금융부채:				
매입채무	8,729,315	(*1)	11,557,441	(*1)
단기차입금	2,381,512	(*1)	9,204,268	(*1)
미지급금	18,324,604	(*1)	12,948,960	(*1)
유동성장기부채	135,753	6,580	139,328	6,276
- 유동성장기차입금	129,525	(*2)	133,518	(*2)
- 유동성사채	6,228	6,580	5,810	6,276
사채	24,912	27,845	29,048	35,863
장기차입금	654,979	(*2)	431,915	(*2)
장기미지급금	2,083,790	(*1)	2,335,218	(*1)
기타	3,145,473	(*1)	3,056,156	(*1)
계	35,480,338		39,702,334	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*2) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,247,882	-	116,443	1,364,325
당기손익-공정가치금융자산	-	-	283	283
금융부채:				
유동성사채	-	6,580	-	6,580
사채	-	27,845	-	27,845

(단위 : 백만원)

구 분	전기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,544,320	-	118,212	1,662,532
당기손익-공정가치금융자산	-	-	2,135	2,135
금융부채:				
유동성사채	-	6,276	-	6,276
사채	-	35,863	-	35,863

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.
- '수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- '수준 2': 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
  (단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)
- '수준 3': 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.
- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여
  해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(3) 가치평가기법 및 투입변수

회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	공정가치	가치평가기법	'수준 3' 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
기타포괄손익-공정가치금융자산:				
삼성벤처투자㈜	32,073	현금흐름할인법	영구성장률	-1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	15.8%~17.8%(16.8%)
㈜미코세라믹스	29,385	현금흐름할인법 등	영구성장률	0.0%~1.0%(0.5%)
			가중평균자본비용	13.1%~15.1%(14.1%)

(4) '수준 3'에 해당하는 금융상품의 변동 내역

(단위 : 백만원)

금융자산	당기	전기
기초	120,347	130,242
매도	(12,720)	(912)
당기손익으로 인식된 손익	(108)	-
기타포괄손익으로 인식된 손익	22,926	2,736
기타	(13,719)	(11,719)
기말	116,726	120,347

(5) '수준 3'으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

당기말 현재 '수준 3'으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(자본은 법인세효과 반영 전 효과)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동 효과		불리한 변동 효과	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산(*)	-	2,970	-	(2,374)

(*) 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1.0%~1.0%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

29. 부문별 보고:

회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 회사의 보고부문은 조직 및 수익을창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문 등으로 구성되어 있습니다.

보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

(1) 당기

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	계(*)
매출액	117,257,647	97,102,386	211,867,483
감가상각비	542,437	23,589,388	24,311,940
무형자산상각비	1,631,289	754,791	2,605,067
영업이익	3,083,254	22,232,180	25,319,329

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	계(*)
매출액	107,675,342	94,373,136	199,744,705
감가상각비	537,479	19,457,650	20,164,109
무형자산상각비	1,382,922	891,431	2,391,770
영업이익	6,389,720	25,592,201	31,993,162

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

30. 특수관계자와의 거래:

가. 보고기간종료일 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung International, Inc. (SII)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Research America, Inc (SRA)	R&D	100.0
	SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	해외자회사 관리	100.0
	SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	NeuroLogica Corp.	의료기기 생산 및 판매	100.0
	Samsung HVAC America, LLC	에어컨공조 판매	100.0
	Joyent, Inc.	클라우드서비스	100.0
	Dacor Holdings, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	Dacor, Inc.	가전제품 생산 및 판매	100.0
	SmartThings, Inc.	스마트홈 플랫폼	100.0
	TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	네트워크장비 설치 및 최적화	100.0
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	반도체・DP 판매	100.0
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	해외자회사 관리	100.0
	SEMES America, Inc.	반도체 장비 서비스	100.0
	Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	전자제품 판매	100.0
	AdGear Technologies Inc.	디지털광고 플랫폼	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA)	컨설팅	100.0
	Harman International Industries, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Engineering Corp.	Connected Service Provider	100.0
	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Financial Group LLC	Management Company	100.0
	Harman International Industries Canada Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman KG Holding, LLC	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional, Inc.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	벤처기업 투자	61.4
	China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	벤처기업 투자	99.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽・CIS	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ltd. (SEL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	반도체・DP 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	반도체・DP 판매	100.0
	Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK)	TV・모니터 생산	100.0
	Samsung Display Slovakia, s.r.o. (SDSK)	DP 임가공	100.0
	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	전자제품 판매	100.0
	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	R&D	100.0
	SAMSUNG Zhilabs, S.L.	네트워크Solution 개발, 판매	100.0
	FOODIENT LTD.	R&D	100.0
	Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	TV 생산	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	마케팅	100.0

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽・CIS	AKG Acoustics Gmbh	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Apostera UA, LLC	Connected Service Provider	100.0
	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive UK Limited	오디오제품 생산	100.0
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium SA	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Finland Oy	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services GmbH	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services UK Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Deutschland GmbH	오디오제품 판매	100.0
	Harman Finance International GP S.a.r.l	해외자회사 관리	100.0
	Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Holding Gmbh & Co. KG	Management Company	100.0
	Harman Hungary Financing Ltd.	Financing Company	100.0
	Harman Inc. & Co. KG	해외자회사 관리	100.0
	Harman International Estonia OU	R&D	100.0
	Harman International Industries Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Romania SRL	R&D	100.0
	Harman Finance International, SCA	Financing Company	100.0
	Harman Management Gmbh	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Red Bend Software Ltd.	소프트웨어 디자인	100.0
	Red Bend Software SAS	소프트웨어 디자인	100.0
	Studer Professional Audio GmbH	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services OOO	Connected Service Provider	100.0
	Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
중동・아프리카	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkiye (SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. (SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	R&D	100.0
	Corephotonics Ltd.	R&D	100.0
	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	TV・모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	마케팅	100.0
	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Red Bend Ltd.	오디오제품 생산	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
아시아 (중국 제외)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	DP 생산	100.0
	DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	DP 부품 생산	100.0
	PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	전자제품 판매 및 서비스	100.0
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	마케팅	100.0
	Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	DP 생산	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL)	서비스	100.0
	Samsung Japan Corporation (SJC)	반도체・DP 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman International (India) Private Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries PTY Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman International Japan Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Singapore Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
중국	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	전자제품 판매	100.0
	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. (TSEC)	TV・모니터 생산	91.2
	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	R&D	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	반도체・DP 판매	100.0
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	반도체 생산	100.0
	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	반도체・DP 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	반도체 임가공	100.0
	Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	LED 생산	100.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	DP 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	DP 생산	95.0
	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	반도체・FPD 장비 서비스	100.0
	Samsung Semiconductor Investment L.P. I	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	오디오제품 생산	100.0
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Holding Limited	오디오제품 판매	100.0
	Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
국내	삼성디스플레이㈜	DP 생산 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스㈜	DP 부품 생산	50.0
	스테코㈜	반도체 부품 생산	70.0
	세메스㈜	반도체・FPD 장비 생산, 판매	91.5
	삼성전자서비스㈜	전자제품 수리 서비스	99.3
	삼성전자서비스씨에스㈜	고객상담서비스	100.0
	삼성전자판매㈜	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍㈜	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨㈜	의료기기 생산 및 판매	68.5
	주식회사 희망별숲	식품 제조 가공	100.0
	㈜미래로시스템	반도체 소프트웨어 개발 및 공급	99.9
	㈜도우인시스	DP 부품 생산	69.0
	지에프㈜	DP 부품 생산	100.0
	㈜하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 29호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 37호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 40호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 42호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 43호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 45호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 48호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 52호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 55호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 56호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 57호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
	시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	62.5

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

나. 당기 및 전기 중 특수관계자와의 매출·매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
종속기업	삼성디스플레이㈜	283,011	-	981,927	-
	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	35,303,291	632	209,912	-
	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	42	-	30,982	-
	Harman과 그 종속기업(*2)	-	-	76,891	-
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	184,796	10,644	9,679,473	5,534
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	8,668,668	-	25,941,259	831
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	1,588,710	-	9,035	-
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	40,907,261	-	532,962	-
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	5,804,935	256	16,441,332	50
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	-	-	-	-
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	1,053	-	3,663,909	2,457
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	2,073,972	-	-	-
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	7,439,341	112	5,798,974	-
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	16,490,821	-	47	-
	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	1,262,369	-	2,174	-
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	628,854	2,791	4,830,861	1,680
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	1,578,349	-	2,615,512	-
	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	1,529,791	-	98,891	-
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	788,385	-	2,333	-
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	408,409	141	2,191	-
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	4,772,554	-	5,104	-
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	249,142	-	-	-
	세메스㈜	8,224	-	2,283,556	-
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	3,865,859	-	6,948	-
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	2,442,869	-	6,950	-
	기타	58,705,560	4,198	23,123,295	2,213
	계	194,986,266	18,774	96,344,518	12,765

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스㈜	212,376	-	1,672,853	348,752
	삼성전기㈜	60,343	767	919,709	120
	삼성SDI㈜	60,325	-	422,836	24,874
	㈜제일기획	31,194	-	931,489	361
	기타	617,779	-	881,585	10,224
	계	982,017	767	4,828,472	384,331
그 밖의 특수관계자	삼성물산㈜	44,359	-	84,635	7,018,252
	기타	283,122	188	602,014	132,512
	계	327,481	188	686,649	7,150,764
기타(*2)	삼성엔지니어링㈜	1,490	-	32,677	3,106,154
	㈜에스원	7,530	-	428,907	45,864
	기타	136,969	-	251,907	540,591
	계	145,989	-	713,491	3,692,609

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
종속기업	삼성디스플레이㈜	234,883	2,475	916,709	-
	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	32,860,328	-	165,629	-
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	167,937	190,056	7,340,085	9,857
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	9,380,604	686	21,146,962	1,111
	Harman과 그 종속기업(*2)	65	-	48,387	-
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	6,652,988	1,716	15,387,219	317
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	1,525,639	-	9,019	-
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	31,894,007	-	409,852	-
	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	18	-	22,855	-
	Samsung Austin Semiconductor LLC (SAS)	598	1,183	3,703,472	7,511
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	4,327,075	2,609	3,373,962	-
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	25,683,936	-	3,885	-
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	1,314,121	-	-	-
	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	3,151,503	403	8,600	-
	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	1,535,053	-	91,821	1
	Samsung International, Inc. (SII)	417,680	-	7,721,915	-
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	1,459,938	-	2,489,534	-
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	652,277	3,222	5,183,912	900
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	4,853,191	-	674	-
	Samsung Electronics Hungarian Private Co., Ltd. (SEH)	547,190	-	547	-
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	4,294,662	-	11,007	-
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	365,818	-	2,695	-
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	3,332,793	-	7,646	-
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	288,980	-	-	-
	기타	53,602,392	10,982	15,648,603	3,784
	계	188,543,676	213,332	83,694,990	23,481

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스㈜	141,014	-	1,542,039	530,412
	삼성전기㈜	45,303	-	975,086	-
	삼성SDI㈜	49,995	269	360,350	30,627
	㈜제일기획	26,794	-	720,533	16
	기타	595,551	68	773,381	8,011
	계	858,657	337	4,371,389	569,066
그 밖의 특수관계자	삼성물산㈜	66,745	-	78,054	3,902,417
	기타	303,093	-	564,706	92,577
	계	369,838	-	642,760	3,994,994
기타(*2)	삼성엔지니어링㈜	598	-	38,556	2,106,166
	㈜에스원	7,132	-	401,224	27,744
	기타	106,714	2,371	200,387	38,531
	계	114,444	2,371	640,167	2,172,441

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

다. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권・채무 등 잔액은 다음과 같습니다.

(1) 당기말

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등(*2)	채무 등(*3)
종속기업	삼성디스플레이㈜	32,521	108,011
	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	868,937	983,709
	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	1,604	1,812
	Harman과 그 종속기업(*4)	-	6,537
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	57,423	751,693
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	606,030	2,396,411
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	131,285	283,459
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	4,700,427	263,757
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	369,380	1,748,670
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	693	-
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	21,309	386,640
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	196,643	7
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	1,219,298	312,243
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	1,623,968	77
	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	227,180	3,037
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	234,870	358,082
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	115,103	379,098
	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	76,264	-
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	18,403	-
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	11,449	-
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	273,816	506,872
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	20,177	11
	세메스㈜	54,327	561,368
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	10,607	-
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	230,508	1,093
	기타	6,565,258	2,226,116
	계	17,667,480	11,278,703

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다.

(*2) 종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다.

(*3) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(*4) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등(*2)
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스㈜	49,439	468,830
	삼성전기㈜	385	101,960
	삼성SDI㈜	114,618	51,199
	㈜제일기획	43	444,017
	기타	203,575	159,668
	계	368,060	1,225,674
그 밖의 특수관계자	삼성물산㈜	194,539	2,718,294
	기타	14,679	160,305
	계	209,218	2,878,599
기타(*3)	삼성엔지니어링㈜	286	1,181,947
	㈜에스원	3,085	59,352
	기타	4,113	478,136
	계	7,484	1,719,435

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등(*2)	채무 등(*3)
종속기업	삼성디스플레이㈜	23,791	119,401
	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	4,708,011	143,310
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	59,110	726,945
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	734,283	4,049,400
	Harman과 그 종속기업(*4)	-	7,541
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	414,781	2,301,949
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	138,307	77,540
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	316	-
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	7,320,890	123,555
	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	1,736	2,164
	Samsung Austin Semiconductor LLC (SAS)	4,645	277,682
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	1,099,927	463,652
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	4,337,520	217
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	161,441	-
	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	258,490	1,040
	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	201,717	19,595
	Samsung International, Inc. (SII)	32,564	259,847
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	132,508	334,943
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	167,225	430,960
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	372,716	32,145
	Samsung Electronics Hungarian Private Co., Ltd. (SEH)	58,694	99
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	629,882	1,715
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	45,171	3,351
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	223,603	2,272
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	18,025	-
	기타	9,220,424	2,284,643
	계	30,365,777	11,663,966

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다.

(*2) 종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다.

(*3) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(*4) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	기업명(*1)	채권 등	채무 등(*2)
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스㈜	64,364	574,443
	삼성전기㈜	2,415	108,103
	삼성SDI㈜	113,845	54,076
	㈜제일기획	59	421,901
	기타	192,550	166,311
	계	373,233	1,324,834
그 밖의 특수관계자	삼성물산㈜	195,355	1,640,615
	기타	15,839	125,470
	계	211,194	1,766,085
기타(*3)	삼성엔지니어링㈜	289	1,099,881
	㈜에스원	2,058	29,620
	기타	4,286	56,476
	계	6,633	1,185,977

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

라. 회사는 당기 및 전기 중 종속기업에 119,598백만원 및 138,858백만원을 출자하였으며, 종속기업으로부터 출자원금 164,503백만원 및 592,520백만원을 회수하였습니다. 또한, 당기 중 관계기업 및 공동기업에 882,125백만원을 출자하였으며(전기:추가 출자 내역 없음), 당기 및 전기 중 회수한 출자원금 내역은 없습니다.

마. 회사가 당기 및 전기 중 특수관계자에게 지급 결의한 배당금은 1,663,149백만원 및 3,527,449백만원입니다. 또한 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에게 당기 및 전기 중 지급 결의한 배당금은 128,232백만원 및 267,738백만원입니다. 당기말과 전기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 존재하지 않습니다.

바. 회사가 당기 및 전기 중 특수관계자와 체결한 리스 이용 계약은 20백만원 및 63,887백만원이며, 특수관계자에게 지급한 리스료는 46,819백만원 및 51,703백만원입니다.

사. 회사는 보고기간종료일 현재 특수관계자의 채무에 대하여 채무보증을 제공하고 있습니다(주석 16 참조).

아. 회사가 당기 및 전기 중 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
단기급여	14,768	20,370
퇴직급여	612	886
기타 장기급여	5,434	8,092

31. 보고기간 후 사건

회사는 보고기간종료일 이후 2023년 2월 14일자 이사회 결의에 의거 2023년 2월 16일자로 종속기업인 삼성디스플레이㈜와 총 20조원 규모의 차입계약을 체결하기로 결정하였습니다.

6. 배당에 관한 사항

당사는 제품 및 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 2018~2020년의 주주환원 정책에 따라 3년간 잉여현금흐름(Free Cash Flow)의 50%를 주주환원 재원으로 활용하여, 매년 연간 총 9.6조원 수준의 정규 배당을 실시하고 잔여 재원 10.7조원을 특별 배당금 성격으로 2020년 기말 정규 배당에 더해 지급하였습니다. 또한, 당사는 2021~2023년의 주주환원 정책을 2021년 1월에 발표하였습니다. 이에 따라 향후 3년의 사업연도에도 잉여현금흐름의 50%를 재원으로 활용하되 정규 배당을 연간 총 9.8조원 수준으로 확대하고 잔여 재원이 발생하는 경우에는 추가로 환원할 계획입니다.

[주요 배당지표] (단위 : 원, 백만원, %, 주)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제54기	제53기	제52기
주당액면가액(원)		100	100	100
(연결)당기순이익(백만원)		54,730,018	39,243,791	26,090,846
(별도)당기순이익(백만원)		25,418,778	30,970,954	15,615,018
(연결)주당순이익(원)		8,057	5,777	3,841
현금배당금총액(백만원)		9,809,438	9,809,438	20,338,075
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		17.9	25.0	78.0
현금배당수익률(%)	보통주	2.5	1.8	4.0
	우선주	2.7	2.0	4.2
주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	1,444	1,444	2,994
	우선주	1,445	1,445	2,995
주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

※ 상기 표의 당기(제54기) 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

※ (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.

※ (연결)주당순이익은 보통주 기본주당이익입니다. 기본주당이익 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당이익' 항목을 참고하시기 바랍니다.

※ 현금배당금총액의 자세한 내용은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '연결이익잉여금' 항목을 참고하시기 바랍니다. 분기 배당금은

제54기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원), 3분기 2,452,154백만원(주당 361원)이며,

제53기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원), 3분기 2,452,154백만원(주당 361원)이고,

제52기 1분기 2,404,605백만원(주당 354원), 2분기 2,404,605백만원(주당 354원), 3분기 2,404,605백만원(주당 354원)입니다.

[배당 이력]

(단위: 회, %)

연속 배당횟수		평균 배당수익률	
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
36	42	2.7	2.9

※ 연속 배당횟수는 당기 분기배당 및 최근사업연도 결산배당을 포함하고 있습니다.

※ 중간배당은 1999년(제31기)부터 연속 배당 시작하였고, 분기배당은 2017년(제49기)부터 연속 배당중이며, 결산배당은 1981년(제13기)부터 연속 배당 중입니다.

※ 평균 배당수익률은 보통주 배당수익률입니다. 우선주에 대한 최근 3년간 평균 배당수익률은 3.0%, 최근 5년간 평균 배당수익률은 3.3%입니다.

※ 최근 3년간은 2020년(제52기)부터 2022년(제54기)까지 기간이며, 최근 5년간은 2018년(제50기)부터 2022년(제54기)까지 기간입니다. 2022년(제54기) 배당수익률은 상기 '주요 배당지표'를 참고하시기 바랍니다(보통주 2.5%, 우선주 2.7%).

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 공시대상기간 중 지분증권의 발행 실적이 없습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
삼성전자㈜	회사채	공모	1997.10.02	126,730	7.7%	Aa2 (Moody's), AA- (S&P)	2027.10.01	일부상환	Goldman Sachs 등
Harman International Industries, Inc	회사채	공모	2015.05.11	506,920	4.2%	Baa1 (Moody's), A- (S&P)	2025.05.15	미상환	J.P. Morgan 등
Harman Finance International, SCA (*1)	회사채	공모	2015.05.27	469,819	2.0%	Baa1 (Moody's), A- (S&P)	2022.05.27	상환	HSBC 등
㈜도우인시스	회사채	사모	2020.02.28	23,000	0.5%	-	2025.02.28	미상환	-
㈜도우인시스	회사채	사모	2022.12.08	42,000	0.5%	-	2027.12.08	미상환	-
세메스㈜	기업어음증권	사모	2022.07.28	80,000	3.0%	A1	2022.08.26	상환	-
세메스㈜	기업어음증권	사모	2022.08.30	30,000	3.3%	A1	2022.09.29	상환	-
합 계	-	-	-	1,278,469	-	-	-	-	-

※ 기업어음증권의 평가기관은 나이스신용평가㈜, 한국기업평가㈜입니다.
(*1) 해당 사채는 2022년 3월 1일 전액 조기상환되었습니다.

나. 기업어음증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 전자단기사채 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	6,337	6,337	513,257	6,337	6,335	-	-	538,603
	사모	-	-	23,000	-	42,000	-	-	65,000
	합계	6,337	6,337	536,257	6,337	6,335	-	-	603,603

- 삼성전자㈜

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	6,337	6,337	6,337	6,337	6,335	-	-	31,683
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	6,337	6,337	6,337	6,337	6,335	-	-	31,683

- Harman International Industries, Inc.와 그 종속기업

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	506,920	-	-	-	-	506,920
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	506,920	-	-	-	-	506,920

※ 미상환잔액은 기준일 환율을 적용하였습니다.

- ㈜도우인시스

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	23,000	-	42,000	-	-	65,000
	합계	-	-	23,000	-	42,000	-	-	65,000

※ ㈜도우인시스의 회사채는 연결 내 내부거래 상계대상입니다.

마. 신종자본증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(삼성전자)

(작성기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
US$ 100,000,000 7.7% Debenture	1997.10.02	2027.10.01	126,730	1997.10.02	The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	해당사항 없음
	이행현황	해당사항 없음
담보권설정 제한현황	계약내용	순유형자산의 10% 미만
	이행현황	계약내용 이행 중 (해당 자산에 대해 담보권 설정 없음)
자산처분 제한현황	계약내용	(보증인이) 자산의 전부 또는 대부분을 처분하려면 본채권에 대한 의무사항 승계 등 조건을 충족시켜야 함
	이행현황	계약내용 이행 중 (2022년 중 처분 자산은 전체의 0.2%)
지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음
	이행현황	해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당사항 없음

※ 발행액은 기준일 환율을 적용하였습니다.
※ 사채관리계약 체결일은 Fiscal Agency Agreement 체결일로서, The Bank of New York Mellon Trust Company,
N.A.는 Fiscal Agent의 지위에 있습니다.
※ 담보권설정 제한자산인 순유형자산은 생산설비 및 본사 보유주식입니다.
※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근 재무제표의 작성기준일입니다.
※ 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일입니다.

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공시대상기간 중 공시대상인 자금조달 실적이 없습니다.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 재무제표 재작성

해당사항 없습니다.

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

(SSL, SSM 법인 매각)

종속기업 삼성디스플레이㈜는 2020년 8월 28일자 이사회 결의에 의거 2021년 4월 1일자로 수익성 악화에 따른 LCD 사업 축소를 위하여 Samsung Suzhou Module Co.,Ltd. (SSM) 지분 100%와 Samsung Suzhou LCD Co., Ltd. (SSL) 지분 60%를 TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)에게 매각하였습니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

(자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리)

해당사항 없습니다.

(중요한 소송사건)

당사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(채무보증 내역)

1) 국내채무보증

해당사항 없습니다.

2) 해외채무보증

(단위 : 천US$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2022.04.16	2023.12.16	1,328,000	1,278,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2022.03.28	2023.11.08	906,000	715,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	310,000	210,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2022.10.01	2023.12.16	409,000	409,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	62,000	62,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2022.06.01	2023.12.16	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	318,000	318,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.12.16	110,000	110,000	-	-	-	
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	807,000	777,000	102,275	137,120	239,395	37.6%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.12.16	130,000	130,000	33,334	△7,685	25,649	34.4%
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	73,722	60,000	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2022.04.28	2023.12.16	877,579	832,572	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	150,000	150,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	141,000	537,000	-	155,768	155,768	11.6%
SECA	계열회사	BoA	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	120,000	60,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	712,400	888,400	-	-	-	
SERK	계열회사	SMBC 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.12.16	290,000	45,000	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	15,600	15,600	10,947	△1,283	9,664	1.3%
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	345,000	404,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	300,000	300,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	110,000	110,000	-	-	-	
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	50,000	20,000	-	-	-	

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	100,000	100,000	-	-	-	
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	25,000	25,000	-	-	-	
Harman RUS CIS LLC	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.05.31	15,000	-	-	-	-	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	-	30,000	-	-	-	
Harman Finance International, SCA	계열회사	JP Morgan 등	지급보증	운영자금	2015.05.27	2022.03.01	396,304	-	396,304	△396,304	-	
SDN	계열회사	SIEL	지급보증	운영자금 등	2020.01.03	2024.11.22	671,908	603,960	571,121	△57,755	513,366	5.8%
SAS	계열회사	Epcor	지급보증	운영자금 등	2022.04.26	채무 소멸시	-	340,000	-	-	-	
DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	계열회사	ANZ	지급보증	시설자금	2022.11.10	2025.11.09	-	20,000	-	20,000	20,000	5.9%
합 계							9,333,513	9,110,532	1,113,981	△150,139	963,842	

※ 연결 기준입니다. Harman Finance International, SCA 건은 Harman International Industries, Inc., SDN 건은 삼성디스플레이㈜, SAS 건은 SEA, DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED 건은 ㈜도우인시스가 각각 채무보증인입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 법인명은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참고하시기 바랍니다.

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.
또한 종속기업인 삼성디스플레이㈜의 경우 건별 채무보증금액이 100억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 상기 채무보증에 대하여 당사가 보증하는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 수수료를 수취하고 있습니다. 당사는 2022년 중 US$547천의 수수료를 청구하였으며, 2022년말 현재 미수취하였습니다.

한편, 삼성디스플레이㈜는 SDN에게 2022년 중 US$3,080천 수수료를 청구하였으며, 2022년말 현재 미수취하였습니다.

☞ 우발채무 등에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

(감사보고서상 강조사항과 핵심감사사항)

구 분	강조사항 등	핵심감사사항
제54기	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감
제53기	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감
제52기	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 2. 영업권 및 내용연수가 비한정인 무형자산 손상 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감

나. 대손충당금(손실충당금) 설정 현황

(1) 계정과목별 대손충당금(손실충당금) 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 금액	대손충당금 (손실충당금)	대손충당 설정률
제54기말	매출채권	36,033,784	312,221	0.9%
	단기대여금	22,403	215	1.0%
	미수금	6,227,068	77,859	1.3%
	선급금	1,741,031	3,965	0.2%
	장기매출채권	204,248	-	0.0%
	장기미수금	824,468	242	0.0%
	장기선급금	2,382,711	10,969	0.5%
	장기대여금	225,983	1,206	0.5%
	합 계	47,661,696	406,677	0.9%
제53기말	매출채권	41,024,295	310,880	0.8%
	단기대여금	17,895	73	0.4%
	미수금	4,569,772	72,515	1.6%
	선급금	1,122,660	3,847	0.3%
	장기매출채권	225,739	-	0.0%
	장기미수금	1,002,404	290	0.0%
	장기선급금	1,770,999	9,003	0.5%
	장기대여금	199,577	917	0.5%
	합 계	49,933,341	397,525	0.8%
제52기말	매출채권	31,283,789	318,731	1.0%
	단기대여금	7,813	73	0.9%
	미수금	3,663,822	59,283	1.6%
	선급금	890,413	3,371	0.4%
	장기매출채권	85,575	-	0.0%
	장기미수금	401,582	204	0.1%
	장기선급금	1,397,698	5,972	0.4%
	장기대여금	113,944	1,309	1.1%
	합 계	37,844,636	388,943	1.0%

※ 연결 기준입니다.

※ 채권 금액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.

(2) 대손충당금(손실충당금) 변동 현황

(단위 : 백만원)

구 분	제54기	제53기	제52기
기초 대손충당금(손실충당금)	397,525	388,943	411,310
순대손처리액(①－②＋③)	16,658	25,926	65,575
① 대손처리액(상각채권액) 등	9,711	22,400	40,487
② 상각채권회수액	-	-	745
③ 기타증감액	6,947	3,526	25,833
대손상각비 계상(환입)액	25,810	34,508	43,208
기말 대손충당금(손실충당금)	406,677	397,525	388,943

※ 연결 기준입니다. [△는 부(-)의 값임]

(3) 매출채권 관련 대손충당금(손실충당금) 설정 방침

(설정방침)

- 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 고려하는 기대신용손실모형을 적용하여 대손충당금(손실충당금) 설정

(대손경험률 및 대손예상액 산정근거)

- 대손경험률: 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 신용손실 경험 등을 근거로 연령별 대손경험률을 산정하여 설정
- 대손예상액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등과 채무자의 신용정보 및 미래 전망을 고려하여 합리적인 대손예상액 설정

[대손 설정 기준]

상 황	설정률
분 쟁	25 %
수금의뢰	50 %
소 송	75 %
부 도	100 %

(대손 처리 기준)

매출채권 등에 대해 다음과 같은 사유 발생 시 실대손처리
- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수 불능이 객관적으로 입증된 경우
- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우
- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우
- 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우
- 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우

(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원, %)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	36,067,812	4,549	68,147	97,524	36,238,032
구성비율	99.5%	0.0%	0.2%	0.3%	100.0%

※ 연결 기준입니다.
※ 매출채권 잔액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.

다. 재고자산 현황

(1) 사업부문별 재고자산의 보유 현황

(단위 : 백만원, %, 회)

부문	계정과목	제54기말	제53기말	제52기말
DX 부문	제품 및 상품	7,712,885	8,894,766	7,088,063
	반제품 및 재공품	1,013,606	799,218	592,903
	원재료 및 저장품	10,520,293	11,384,887	7,862,310
	미착품	943,322	1,299,624	876,270
	소 계	20,190,106	22,378,495	16,419,546
DS 부문	제품 및 상품	6,601,087	2,490,097	1,719,095
	반제품 및 재공품	18,756,104	11,809,911	10,639,866
	원재료 및 저장품	3,639,061	2,118,424	1,674,081
	미착품	61,352	36,685	46,587
	소 계	29,057,604	16,455,117	14,079,629
SDC	제품 및 상품	811,518	294,777	134,963
	반제품 및 재공품	542,473	874,229	650,762
	원재료 및 저장품	788,521	810,325	603,779
	미착품	23,626	48,253	33,271
	소 계	2,166,138	2,027,584	1,422,775
Harman	제품 및 상품	799,919	533,008	502,117
	반제품 및 재공품	119,890	105,271	80,237
	원재료 및 저장품	913,085	736,109	337,386
	미착품	269,715	321,128	224,961
	소 계	2,102,609	1,695,516	1,144,701
총 계	제품 및 상품	16,032,226	12,280,579	9,387,886
	반제품 및 재공품	20,077,519	13,473,618	11,818,090
	원재료 및 저장품	14,979,280	14,184,841	9,790,766
	미착품	1,098,841	1,445,366	1,046,403
	소 계	52,187,866	41,384,404	32,043,145
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]		11.6%	9.7%	8.5%
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]		4.1회	4.5회	4.9회

※ 당사 연결 기준입니다.

※ 제53기, 제52기는 2021년 12월의 조직변경을 반영하여 제54기 기준으로 재작성하였습니다.

(2) 재고자산의 실사내역 등

(실사내역)

・5월말 및 11월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시
・재고조사 시점과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당 기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인

(실사방법)

・사내보관재고: 폐창식 전수조사 실시
※ 반도체 및 DP 라인 재고 및 자동화창고보관 SVC자재는 표본조사
・사외보관재고: 제3자 보관재고, 운송 중인 재고에 대해선 전수로 물품보유확인서 또는 장치보관확인서 징구 및 표본조사 병행
・외부감사인은 당사의 기말 재고실사에 입회・확인하고 일부 항목에 대해 표본 추출하여 그 실재성 및 완전성 확인

※ 당사는 2022년 11월 26일부터 12월 5일까지 하반기 재고실사를 실시하였으며, 종속기업들도 동일 기준(11월말)으로 하반기 재고실사를 진행하였습니다.

(장기체화재고 등 내역)

재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우 저가법 등을 사용하여 재고자산의 재무상태표 가액을 결정하고 있으며, 2022년말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가충당금	기말잔액
제품 및 상품	17,526,178	17,526,178	△1,493,952	16,032,226
반제품 및 재공품	21,612,965	21,612,965	△1,535,446	20,077,519
원재료 및 저장품	16,268,974	16,268,974	△1,289,694	14,979,280
미착품	1,098,841	1,098,841	-	1,098,841
합 계	56,506,958	56,506,958	△4,319,092	52,187,866

※ 연결 기준입니다. [△는 부(-)의 값임]

라. 수주계약 현황

2022년말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

마. 공정가치평가 내역

(1) 금융상품의 공정가치평가 방법

[금융자산]

(분류)

2018년 1월 1일부터 당사는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다.
・공정가치 측정 금융자산 (기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식)
・상각후원가 측정 금융자산

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 분류합니다.

공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 당사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.

단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

(측정)

당사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.

내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

1) 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 당사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.

① 상각후원가 측정 금융자산
계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.

② 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 모두를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 표시하고손상차손은 '기타비용'으로 표시합니다.

③ 당기손익-공정가치 측정 금융자산
상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

2) 지분상품

당사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않고 제거되는 시점에 자본에 누적된 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익을 이익잉여금으로 대체합니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 당사가 배당을 받을 권리가 확정된 때에 손익계산서에 '기타수익'으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

(손상)

당사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 당사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

(인식과 제거)

금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다. 당사가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행 시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 당사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다. 해당 금융부채는 재무상태표에 '차입금'으로 분류하고 있습니다.

(금융상품의 상계)

금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다.

[금융부채]

(분류 및 측정)

모든 금융부채는 다음을 제외하고는 후속적으로 상각후원가로 측정되도록 분류합니다.

1) 당기손익-공정가치 측정 금융부채
   파생상품부채를 포함한 이러한 부채는 후속적으로 공정가치로 측정합니다.
2) 금융자산의 양도가 제거 조건을 충족하지 못하거나 지속적 관여 접근법이 적용되는 경우에 생기는 금융부채
   이러한 금융부채는 상기 금융자산의 내용을 적용하여 측정합니다.
3) 금융보증계약
   최초 인식 시 공정가치로 측정되며, 이후에 이러한 계약의 발행자는 해당 계약을 후속적으로 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
   - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
   - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
4) 시장이자율보다 낮은 이자율로 대출하기로 한 약정
   최초 인식 후에 이러한 약정의 발행자는 후속적으로 해당 약정을 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
   - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
   - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
5) 기준서 제1103호를 적용하는 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가
   이러한 조건부 대가는 후속적으로 당기손익-공정가치로 측정합니다.

(제거)

금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다. 소멸하거나 제3자에게 양도한 금융부채의 장부금액과 지급한 대가(양도한 비현금자산이나 부담한 부채를 포함)의 차액은 당기손익으로 인식합니다.

[파생상품]

당사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피와 해외사업장에 대한 순투자에 대한 위험회피금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

당사는 재고자산의 가격 변동 위험 등을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 현금흐름위험회피 대상으로 지정되어 적용요건을 충족하는 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 인식하고, 비효과적인 부분은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 인식하고 있습니다.

(2) 범주별 금융상품 내역

1) 제54기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	49,680,710	-	-	-	49,680,710
단기금융상품	65,102,886	-	-	-	65,102,886
단기상각후원가금융자산	414,610	-	-	-	414,610
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	29,080	-	29,080
매출채권	35,721,563	-	-	-	35,721,563
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	11,397,012	-	-	11,397,012
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,405,468	-	1,405,468
기타	9,945,209	-	334,263	61,404	10,340,876
계	160,864,978	11,397,012	1,768,811	61,404	174,092,205

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	10,644,686	-	-	10,644,686
단기차입금	1,577,958	-	3,569,357	5,147,315
미지급금	16,328,237	-	-	16,328,237
유동성장기부채	215,143	-	874,019	1,089,162
사채	536,093	-	-	536,093
장기차입금	33,846	-	3,526,826	3,560,672
장기미지급금	2,289,236	-	-	2,289,236
기타	12,047,761	334,415	27,353	12,409,529
계	43,672,960	334,415	7,997,555	52,004,930

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

2) 제53기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	39,031,415	-	-	-	39,031,415
단기금융상품	81,708,986	-	-	-	81,708,986
단기상각후원가금융자산	3,369,034	-	-	-	3,369,034
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	40,757	-	40,757
매출채권	40,713,415	-	-	-	40,713,415
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	13,965,839	-	-	13,965,839
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,525,344	-	1,525,344
기타	8,711,973	-	279,127	49,089	9,040,189
계	173,534,823	13,965,839	1,845,228	49,089	189,394,979

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	13,453,351	-	-	13,453,351
단기차입금	2,131,692	-	11,556,101	13,687,793
미지급금	14,126,970	-	-	14,126,970
유동성장기부채	518,065	-	811,903	1,329,968
사채	508,232	-	-	508,232
장기차입금	1,500	-	2,864,656	2,866,156
장기미지급금	2,562,158	-	-	2,562,158
기타	10,444,290	323,526	13,868	10,781,684
계	43,746,258	323,526	15,246,528	59,316,312

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(3) 금융상품의 공정가치 측정내역

(금융상품의 장부금액과 공정가치)

(단위 : 백만원)

구 분	제54기말		제53기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산:				
현금및현금성자산	49,680,710	(*1)	39,031,415	(*1)
단기금융상품	65,102,886	(*1)	81,708,986	(*1)
단기상각후원가금융자산	414,610	(*1)	3,369,034	(*1)
단기당기손익-공정가치금융자산	29,080	29,080	40,757	40,757
매출채권	35,721,563	(*1)	40,713,415	(*1)
기타포괄손익-공정가치금융자산	11,397,012	11,397,012	13,965,839	13,965,839
당기손익-공정가치금융자산	1,405,468	1,405,468	1,525,344	1,525,344
기타(*2)	10,340,876	395,667	9,040,189	328,216
계	174,092,205		189,394,979	
금융부채:				
매입채무	10,644,686	(*1)	13,453,351	(*1)
단기차입금	5,147,315	(*1)	13,687,793	(*1)
미지급금	16,328,237	(*1)	14,126,970	(*1)
유동성장기부채	1,089,162	6,580	1,329,968	554,106
- 유동성장기차입금	1,082,934	(*1)(*3)	852,317	(*1)(*3)
- 유동성사채	6,228	6,580	477,651	554,106
사채	536,093	521,129	508,232	546,339
장기차입금	3,560,672	(*1)(*3)	2,866,156	(*1)(*3)
장기미지급금	2,289,236	(*1)	2,562,158	(*1)
기타(*2)	12,409,529	361,768	10,781,684	337,394
계	52,004,930		59,316,312	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융자산 9,945,209백만원(전기말: 8,711,973백만원) 및

금융부채 12,047,761백만원(전기말: 10,444,290백만원)은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*3) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계)

(단위 : 백만원)

구 분	제54기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	29,080	-	29,080
기타포괄손익-공정가치금융자산	9,207,295	-	2,189,717	11,397,012
당기손익-공정가치금융자산	314,449	-	1,091,019	1,405,468
기타	-	373,176	22,491	395,667
금융부채:				
유동성사채	-	6,580	-	6,580
사채	-	521,129	-	521,129
기타	-	354,364	7,404	361,768

(단위 : 백만원)

구 분	제53기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	35,620	5,137	40,757
기타포괄손익-공정가치금융자산	11,608,708	-	2,357,131	13,965,839
당기손익-공정가치금융자산	478,401	-	1,046,943	1,525,344
기타	-	307,213	21,003	328,216
금융부채:				
유동성사채	-	554,106	-	554,106
사채	-	546,339	-	546,339
기타	-	331,956	5,438	337,394

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- '수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- '수준 2': 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
  (단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)
- '수준 3': 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

당사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.
・유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
・파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여
  해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(가치평가기법 및 투입변수)

당사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

2022년말 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	공정가치	가치평가기법	'수준 3' 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
기타포괄손익-공정가치금융자산:				
삼성벤처투자㈜	32,073	현금흐름할인법	영구성장률	△1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	15.8%~17.8%(16.8%)
㈜미코세라믹스	29,385	현금흐름할인법 등	영구성장률	0.0%~1.0%(0.5%)
			가중평균자본비용	13.1%~15.1%(14.1%)
TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)	1,244,889	현금흐름할인법	영구성장률	△1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	10.6%~12.6%(11.6%)
China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Ltd (CSOSDT)	230,263	현금흐름할인법	영구성장률	△1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	10.6%~12.6%(11.6%)
기타:				
지분 풋옵션	22,491	이항모형	무위험 이자율	4.0%~4.5%, 2.5%
			가격 변동성	22.3%~32.3%(27.3%) 25.3%~35.3%(30.3%)

[△는 부(-)의 값임]

('수준 3'에 해당하는 금융상품의 변동내역)

(단위 : 백만원)

금융자산	제54기	제53기
기초	3,430,214	6,449,139
매입	207,730	1,075,389
매도	△207,252	△402,782
당기손익으로 인식된 손익	73,782	463,818
기타포괄손익으로 인식된 손익	△197,830	1,543,511
기타	△3,417	△5,698,861
기말	3,303,227	3,430,214

[△는 부(-)의 값임]

(단위 : 백만원)

금융부채	제54기	제53기
기초	5,438	9,248
당기손익으로 인식된 손익	1,966	△784
기타	-	△3,026
기말	7,404	5,438

[△는 부(-)의 값임]

('수준 3'으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석)

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

2022년말 현재 '수준 3'으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(자본은 법인세효과 반영 전 효과)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동 효과		불리한 변동 효과	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	112,515	-	△79,168
기타	2,669	-	△3,750	-

※ 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(△1.0%~1.0%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 기타는 주요 관측불가능한 투입변수인 가격 변동성을 5% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

(4) 유형자산 재평가내역

당사는 공시대상기간 중 유형자산 재평가내역이 없습니다.

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.
이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.

'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.

- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내·외 금융 시장의 동향
- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정
- DX부문, DS부문, SDC, Harman 등 회사가 영위하는 주요 사업의 예상치 못한 급격한 여건변화
- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내·외적 변화

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

2. 개요

2022년 세계 경제는 글로벌 통화긴축 강화, 러시아-우크라이나 전쟁 및 원자재・에너지 공급 불안정 등으로 불확실성이 확대되며 어려운 경영 여건이 지속되었습니다. 당사는 이러한 경제여건 속에서도 2022년 연결기준 매출 302조원, 영업이익 43조원, 별도기준 매출 212조원, 영업이익 25조원을 기록하였습니다.

재무적인 측면에서는 연결기준 부채비율 26.4%, 자기자본비율 79.1%, ROE 16.9%, 별도기준 부채비율 24.2%, 자기자본비율 80.5%, ROE 12.6% 등 견실한 재무구조를 지속하였으며, 2022년 브랜드 가치는 전년대비 17% 증가한 877억달러로 사상 최대를 기록하며 세계 전체 기업 중 5위(2022년 11월 인터브랜드 발표 기준)를 차지하였습니다.

사업 측면에서는 갤럭시 Z 폴드4와 Z 플립4 출시 및 Neo QLED TV, BESPOKE 라인업 강화로 시장지배력 및 업계리더십을 더욱 공고히 하였으며, 세계 최초 Multi-step EUV 기술 적용 등 핵심기술 역량을 바탕으로 부품 사업의 수익성 및 원가 경쟁력을 더욱 강화하였습니다.

2023년에도 글로벌 통화긴축 지속, 원자재・에너지 수급 차질의 장기화 등 세계 경제의 불확실성은 여전히 클 것으로 전망되는 가운데, 당사 주력제품의 경쟁 심화 및 급변하는 IT산업의 패러다임은 당사에 위협이 될 것으로 보입니다. 하지만 당사는 이를 기회로 삼아, 끊임없는 혁신과 철저한 준비를 통하여 실적 개선과 미래기회 선점에 총력을 기울이겠습니다.

3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준)

가. 재무상태

(단위 : 백만원)

구 분	제54기	제53기	증 감	증감률
[유동자산]	218,470,581	218,163,185	307,396	0.1%
· 현금및현금성자산	49,680,710	39,031,415	10,649,295	27.3%
· 단기금융상품	65,102,886	81,708,986	△16,606,100	△20.3%
· 기타유동금융자산	443,690	3,409,791	△2,966,101	△87.0%
· 매출채권	35,721,563	40,713,415	△4,991,852	△12.3%
· 재고자산	52,187,866	41,384,404	10,803,462	26.1%
· 기타	15,333,866	11,915,174	3,418,692	28.7%
[비유동자산]	229,953,926	208,457,973	21,495,953	10.3%
· 기타비유동금융자산	12,802,480	15,491,183	△2,688,703	△17.4%
· 관계기업 및 공동기업 투자	10,893,869	8,932,251	1,961,618	22.0%
· 유형자산	168,045,388	149,928,539	18,116,849	12.1%
· 무형자산	20,217,754	20,236,244	△18,490	△0.1%
· 기타	17,994,435	13,869,756	4,124,679	29.7%
자산총계	448,424,507	426,621,158	21,803,349	5.1%
[유동부채]	78,344,852	88,117,133	△9,772,281	△11.1%
[비유동부채]	15,330,051	33,604,094	△18,274,043	△54.4%
부채총계	93,674,903	121,721,227	△28,046,324	△23.0%
[지배기업 소유주지분]	345,186,142	296,237,697	48,948,445	16.5%
[비지배지분]	9,563,462	8,662,234	901,228	10.4%
자본총계	354,749,604	304,899,931	49,849,673	16.3%
부채와 자본총계	448,424,507	426,621,158	21,803,349	5.1%
자기자본비율	79.1%	71.5%	7.6%p	
부채비율	26.4%	39.9%	△13.5%p	
재고자산회전율	4.1회	4.5회	△0.4회	

※ 제54기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. [△는 부(-)의 값임]

향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

제54기 당사 자산은 전년 대비 21조 8,033억원(5.1%) 증가한 448조 4,245억원입니다. 자산의 주요 증가 원인은 재고자산의 증가 10조 8,035억원 및 반도체・DP 사업의 대규모 시설투자에 따른 유형자산의 증가 18조 1,168억원 등입니다.

부채는 전년 대비 28조 463억원(23.0%) 감소한 93조 6,749억원으로, 유동부채가 9조 7,723억원(11.1%) 감소하였고 비유동부채가 18조 2,740억원(54.4%) 감소하였습니다. 부채의 주요 변동 원인으로는 단기차입금이 8조 5,405억원 감소하였으며, 이연법인세부채가 18조 869억원 감소하였습니다.

자본은 전년 대비 49조 8,497억원(16.3%) 증가한 354조 7,496억원으로, 2022년 당기순이익(지배지분) 54조 7,300억원 및 배당금의 지급 9조 8,094억원 등으로 이익잉여금이 44조 8,816억원 증가하였으며, 해외사업환산차이 등으로 인해 기타자본항목이 4조 668억원 증가하였습니다.

재무비율 측면에서는 자기자본비율이 전년 대비 7.6%p 증가한 79.1%, 부채비율이 전년 대비 13.5%p 감소한 26.4%로 견실한 재무구조를 지속적으로 유지하였습니다.

나. 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분	제54기	제53기	증 감	증감률
매출액	302,231,360	279,604,799	22,626,561	8.1%
매출원가	190,041,770	166,411,342	23,630,428	14.2%
매출총이익	112,189,590	113,193,457	△1,003,867	△0.9%
판매비와관리비	68,812,960	61,559,601	7,253,359	11.8%
영업이익	43,376,630	51,633,856	△8,257,226	△16.0%
기타수익	1,962,071	2,205,695	△243,624	△11.0%
기타비용	1,790,176	2,055,971	△265,795	△12.9%
지분법이익	1,090,643	729,614	361,029	49.5%
금융수익	20,828,995	8,543,187	12,285,808	143.8%
금융비용	19,027,689	7,704,554	11,323,135	147.0%
법인세비용차감전순이익	46,440,474	53,351,827	△6,911,353	△13.0%
법인세비용	△9,213,603	13,444,377	△22,657,980	△168.5%
당기순이익	55,654,077	39,907,450	15,746,627	39.5%
・지배기업 소유주지분	54,730,018	39,243,791	15,486,227	39.5%
・비지배지분	924,059	663,659	260,400	39.2%

※ 제54기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. [△는 부(-)의 값임]

향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

제54기 당사 매출액은 Neo QLED TV, 비스포크(BESPOKE), 플래그십 스마트폰 등 프리미엄 제품 판매 확대 및 DS 부문 환율 상승 영향 등으로 전년 대비 22조 6,266억원(8.1%) 증가하여 연간 최대 매출인 302조 2,314억원을 기록하였으나, 영업이익은 반도체 판가 하락 및 Set 사업 물류비 증가 영향 등으로 전년 대비 8조 2,572억원(16.0%) 감소하여 43조 3,766억원을 기록하였습니다. 법인세비용차감전순이익은 전년 대비 6조 9,114억원(13.0%) 감소한 46조 4,405억원, 당기순이익은 전년 대비 15조 7,466억원(39.5%) 증가한 55조 6,541억원을 기록하였습니다.

수익성 지표 측면에서는 ROE가 전년 대비 3.2%p 증가한 16.9%, 매출액순이익률이 전년 대비 4.1%p 증가한 18.4%로, 견실한 재무구조를 지속적으로 유지하였습니다.

[부문별 영업실적 분석]

[단위 : 백만원]

구분	부문	제54기		제53기		증감(률)	
		금액	비중	금액	비중	금액	(%)
매출	DX 부문	182,489,720	60.4%	166,259,437	59.5%	16,230,283	9.8%
	DS 부문	98,455,270	32.6%	95,387,173	34.1%	3,068,097	3.2%
	SDC	34,382,619	11.4%	31,712,526	11.3%	2,670,093	8.4%
	Harman	13,213,694	4.4%	10,039,922	3.6%	3,173,772	31.6%
	전사 매출	302,231,360	100.0%	279,604,799	100.0%	22,626,561	8.1%
영업이익	DX 부문	12,746,074	29.4%	17,386,554	33.7%	△4,640,480	△26.7%
	DS 부문	23,815,810	54.9%	29,192,021	56.5%	△5,376,211	△18.4%
	SDC	5,952,973	13.7%	4,457,365	8.6%	1,495,608	33.6%
	Harman	880,548	2.0%	599,097	1.2%	281,451	47.0%
	전사 영업이익	43,376,630	100.0%	51,633,856	100.0%	△8,257,226	△16.0%

※ 각 부문별 매출 및 영업이익은 부문간 내부거래 등을 포함하고 있습니다. [△는 부(-)의 값임]

(DX 부문)

DX 부문의 제54기 매출은 182조 4,897억원으로 전년 대비 16조 2,303억원(9.8%) 증가하였으나, 영업이익은 12조 7,461억원으로 전년 대비 4조 6,405억원(26.7%) 감소하였습니다. Neo QLED TV, 비스포크(BESPOKE), 플래그십 스마트폰 등 프리미엄 제품 중심으로 매출은 증가하였으나, 물류비 증가 영향 등으로 영업이익은 감소하였습니다.

DX 부문의 영상디스플레이/생활가전 사업은 프리미엄 기술력을 바탕으로 한 Neo QLED TV 등 프리미엄 제품, 소비자의 경험을 중시하는 라이프스타일(Lifestyle)에 맞춰 출시한 Lifestyle TV와 BESPOKE 제품 그리고 신가전 제품 판매 중심으로 성장을 지속하고 있습니다.

영상디스플레이 사업은 퀀텀닷 기반의 QLED TV를 통해 75인치 이상 초대형 시장에서 프리미엄 리더십을 확대하고 있으며, 지속적인 Lifestyle TV 신제품(The Terrace, The Premiere 등) 출시로 시장 지배력을 키워나가고 있습니다. 이와 함께 마이크로 LED The Wall과 사운드바, LED 사이니지 등 다양한 신제품을 출시함으로써 시장을 확대해 나가고 있습니다.

이러한 신제품에 대한 긍정적인 반응을 기반으로 글로벌 TV 시장에서는 2006년부터 2022년까지 17년 연속 세계 1위를 유지하며, 업계 리더로서의 위상을 지키고 있습니다.

2023년에도 프리미엄 TV 수요와 Lifestyle 제품 판매를 위한 혁신 노력은 계속될 것입니다. 마이크로 LED 기술을 활용하여 폼팩터 사업을 주도하고, 모바일 기기와의 콘텐츠 연동, 홈 트레이닝/게임 등 다양하게 변화하는 소비자들의 스크린 사용 방식을 반영한 Lifestyle 제품 확대 등 디자인 차별화를 공고히 하여 새로운 Lifestyle을 제시해 나가겠습니다. 또한, 전사 차원 신환경경영전략의 일환으로 재생 플라스틱을 활용한 소재를 친환경 리모컨에 추가 확대 적용하고 초전력 기술을 적용한 TV 신제품들을 출시하여 지속가능한 성장을 위해 노력하겠습니다.

생활가전 사업은 친환경・고효율 기술을 통해 제품의 기본 성능 우위는 물론이고, 변화하는 Lifestyle에 대한 깊은 이해를 바탕으로 소비자의 삶을 편리하게 하는 제품과 서비스를 지속 출시하고 있습니다. 또한 Bixby와 SmartThings를 중심으로 다양한 제품 및 서비스와 연동하는 스마트 가전을 통해 고객에게 새로운 가치를 제공하고 있습니다.

2023년에도 차별화된 BESPOKE 제품 라인업으로 글로벌 판매를 확대하여 소비자 경험 혁신을 지속할 예정입니다. 시스템에어컨, 빌트인 등 고수익 B2B 사업은 친환경 기능 차별화, 고객 맞춤형 제품 도입 등을 통해 수주 경쟁력을 강화하여 성장세를 이어 나가겠습니다. 또한 제품간 연결을 통한 개인별 맞춤 서비스 제공으로 소비자 경험을 더욱 차별화하고 에너지 절감, 친환경 소재 도입 확대 등 ESG 활동을 강화하여 글로벌 가전 브랜드로서 위상을 공고히 하겠습니다.

DX 부문의 MX(Mobile eXperience) 사업은 지정학적 이슈의 장기화, 인플레이션 및 경기 침체의 영향 등 어려운 시장 상황에서도 제품 경쟁력 강화를 통해 플래그십 스마트폰 시장점유율 확대되는 등 소기의 성과를 달성했습니다.

2020년 갤럭시 Z 플립과 갤럭시 Z 폴드2 출시에 이어 2021년에는 S시리즈를 통해 Lifestyle에 맞춘 사용자 경험을 제공함으로써 프리미엄 고객의 저변을 더욱 확대하였습니다. 폴더블은 당사만의 차별화된 사용자 경험을 제공하며 S시리즈와 함께 플래그십의 성장을 주도하고 있습니다. 또한 Galaxy Ecosystem은 다양한 제품과 서비스의 연결, 개방형 파트너십의 활용을 경험할 수 있도록 함으로써 2021년 태블릿과 PC, 웨어러블 사업이 시장 성장을 초과하는 성장세를 보여주는데 큰 역할을 담당하였습니다. 2022년에는 지정학적 이슈 등 시장 불확실성 고조 및 수요 정체에 직면하였으나 플래그십 제품군에 역량을 집중하여 S 시리즈의 최상위 모델인 Ultra의 비중 확대와 원활한 공급을 통해 플래그십 시장 내 입지를 공고히 하였습니다.

2023년에도 역성장이 전망되는 시장 상황을 극복하기 위한 전략을 강하게 추진할 것입니다. 플래그십 시장 리더십의 강화를 위해 S23과 Ultra를 활용한 프리미엄 고객의 저변 확대를 추진할 계획이며, 폴더블은 기술뿐 아니라 파트너사들과의 광범위한 협력을 통해 시장 리더십을 더욱 공고히 하여 글로벌 시장을 지속 선도하겠습니다. 또한 동남아, 중남미 등 성장 시장에서 Mass 제품을 통해 5G 전환 수요에 적극 대응하여 전체 스마트폰 성장을 추진하겠습니다. 나아가 고객들이 Galaxy Ecosystem을 통해 최고의 경험을 누릴 수 있도록, DX 부문의 긴밀한 협업을 통해 모바일 뿐 아니라 TV와 가전까지 편리하게 활용할 수 있는 Multi Device 경험을 확대해 나가겠습니다.

앞으로도 미래지향 가치와 고객 경험을 최우선으로 삼겠다는 경영철학 아래, 변화하는 시장 환경과 다각화된 고객 니즈에 선제적으로 대응해 나가겠습니다. 당사는 개방형 협력을 기반으로 XR(eXtended Reality), Chipset, Digital Health/Wallet 등 미래 신성장 기반의 핵심 기술과 플랫폼을 선제적으로 확보하기 위해 노력하고 있으며, 향후에도 견조한 실적을 달성하고 모바일 시장을 선도해 나가겠습니다.

(DS 부문)

DS 부문의 제54기 매출은 전년 대비 3조 681억원(3.2%) 증가한 98조 4,553억원이었으나, 영업이익은 하반기 반도체 판가 하락 영향 등으로 전년 대비 5조 3,762억원(18.4%) 감소한 23조 8,158억원입니다.

메모리 사업은 글로벌 경기 둔화와 수요 부진 등 어려운 경영여건 속에서도 기술리더십을 통해 원가경쟁력 우위를 유지하고, 시장 수요에 적기 대응하며 사업 경쟁력 강화에 집중하고 있습니다. 2023년은 고객사의 재고 조정 기조, 매크로 이슈에 따른 소비심리 위축이 단기적으로 지속될 것으로 보이나, 하반기 수요 회복 가능성 등을 고려한 다양한 시나리오를 두고 시장 상황을 지속 관찰하며 변화에 선제적으로 대응하도록 하겠습니다.

DRAM은 세계 최초 Multi-step EUV(극자외선) 기술이 적용된 DRAM 양산 체계를 선제적으로 갖추어 기술경쟁력을 한층 강화하고, 고부가가치・고용량 제품 중심의 사업 포트폴리오 운영을 통한 질적 성장에 주력하고 있습니다. 또한, 당사는 신규 CPU 채용 본격 확대에 따른 서버・PC향 DDR5 수요에 적극 대응하는 가운데, 제품 믹스 최적화를 통해 서버・모바일 고용량 제품 중심으로 수요 성장세에 적기 대응할 계획입니다.

NAND는 앞선 기술력의 7세대 V-NAND 제품으로의 전환과 더불어 2023년 본격적으로 8세대 V-NAND 제품 채용을 추진함으로써, 선단 제품 라인업 확보를 통해 원가경쟁력을 강화하고, 시장리더십을 공고히 할 예정입니다.

System LSI는 다양한 응용제품을 통한 시너지 극대화로 플랫폼 공급자로의 변화를 꾀하며 매출 극대화를 통한 성장 기조를 유지하고 있습니다. 또한, 제품 경쟁력을 기반으로 고객 확대를 지속하면서 적극적인 신기술 확보를 통해 미래 시장 변화에 대비하도록 하겠습니다. SOC는 5G 기술을 활용한 제품 라인업 보강을 하면서 모바일 및 자동차향 SOC 등 고객 추가 확보를 진행하고 있으며, 차세대 IP 기술 개발을 통한 미래 준비를 지속하고 있습니다. 이미지센서 제품의 경우 ISOCELL 미세픽셀 기술력을 바탕으로 모바일향 2억화소 센서를 세계 최초로 출시하였으며, 자동차향 이미지 센서는 수주 확대를 지속하고 있습니다.

파운드리는 2022년 하반기부터 이어지고 있는 시장 침체에 따른 수요 약화 및 고객사 재고 조정 영향으로 2023년 성장률 둔화가 전망되고 있는 가운데, 당사는 다운턴 극복 활동과 병행하여 올해를 체질 전환의 기회로 활용, 경쟁력 강화를 꾀하고자 합니다. Advanced 노드는 3나노 GAA(Gate All Around) 2세대 공정의 조기 Ramp-up 및 차세대 2나노 개발에 집중하고 있으며, Matured 노드는 고객 니즈에 맞는 스페셜티 공정을 개발하고, 더불어 고성능 컴퓨팅, 전장, IoT 등 응용처 다변화를 통해 다양한 고객군으로 확대코자 합니다. 또한, 고객 VoC 개선 및 고객 중심의 디자인 플랫폼을 제공하여, 고객 동반 성장 서비스 강화를 추진하겠습니다.

(SDC)

SDC의 제54기 매출은 34조 3,826억원으로 전년 대비 2조 6,701억원(8.4%) 증가하였으며, 영업이익도 전년 대비 1조 4,956억원(33.6%) 증가한 5조 9,530억원입니다. 고부가 OLED 패널 제품의 판매 확대 및 환율상승 영향 등으로 매출 및 영업이익이 증가하였습니다.

중소형 패널 사업은 인플레이션, 금리상승, 경기침체 우려 등에 따른 소비심리 위축으로 스마트폰 수요 감소에도 불구, High-end 제품 중심의 운영으로 견조한 실적을 달성하였습니다. Flexible OLED와 Rigid OLED 패널을 통해 프리미엄부터 보급형 제품까지 최적의 제품 포트폴리오를 구축하여 고도화되는 소비자의 니즈에 적극 대응하였으며, 차별화된 기술과 성능으로 시장으로부터 업계 최고의 기술력을 인정받고 있습니다.

대형 패널 사업은 QD-OLED 전환과 같은 선제적인 사업구조 개편으로 가시적인 성과를 거두었습니다. QD-OLED 사업을 본격 시작하여 조기 수율 확보를 통한 양산 안정화 및 프리미엄 시장 내 성공적인 진입 등 차질 없이 사업을 진행하고 있습니다.

2023년은 인플레이션 및 긴축적 통화정책 기조 영향으로 불안정한 시장 상황과 본격적인 경쟁사 진입으로 어려운 사업 환경이 예상됩니다. 중소형 패널 사업은 상대적으로 견조한 High-end 스마트폰 시장에서 기술 성능 격차 우위를 활용하고, 원가 경쟁력 우위를 통한 시장 지배력을 강화하겠습니다. 또한 IT, Gaming, Automotive 등으로 제품 포트폴리오를 다각화하여 사업 리더십을 더욱 견고히 하겠습니다.

대형 패널 사업은 지속된 경기 불확실성으로 패널 수요는 부진할 것으로 전망됩니다만, 당사는 안정화된 수율을 바탕으로 프리미엄 시장에서 판매 기반을 강화하여 수익성을 지속 개선하도록 하겠습니다.

(Harman)

Harman 부문의 제54기 매출은 13조 2,137억원으로 전년 대비 3조 1,738억원(31.6%) 증가하였으며, 영업이익은 8,805억원으로 전년 대비 2,815억원(47.0%) 증가하였습니다. 반도체 공급 이슈 완화 등으로 전장 부문의 실적이 개선되었고, 소비자 오디오 판매도 호조를 이어가며 매출 및 영업이익이 증가하였습니다.

글로벌 물류 대란 등 어려운 경영환경 속에서도 전장부품 및 소비자오디오, 프로페셔널 솔루션 시장에서 인수 이후 최고의 성과를 달성했습니다. Harman은 자체적인 혁신과 당사 다른 부문의 모바일・IT・디스플레이・반도체 기술과의 융합을 통해 사업역량을 확대할 수 있었습니다.

당사는 전장부품 시장의 선도업체로서 완성차 업체들에게 혁신 기술을 적용한 제품을 공급하는 한편, 프리미엄 브랜드에 부합하는 품질수준을 유지하고 있습니다. 인포테인먼트 분야에서는 디지털콕핏으로의 전환에 선행 대응함으로써 시장을 선점하였으며, 차별화된 기술개발을 통해 5G TCU(Telematics Control Unit)를 업계 최초로 수주하는 등 성과를 달성했습니다. 이러한 기술혁신을 바탕으로 향후 자율주행차 시대에 대비하여 더 편리하고 즐겁고 안전한 차량내 사용자경험(In-Cabin Experience)을 제공하는데 사업 역량을 집중할 것입니다.

당사의 소비자오디오 브랜드는 오디오 시장에서 기술혁신을 통해 일반 소비자들과 음악 애호가 사이에서 명성을 쌓아왔습니다. 특히, JBL 브랜드는 2015년부터 글로벌 블루투스 스피커에서 판매량 기준 7년 연속 시장 1위를 차지했으며, 무선 이어폰 시장에서도 괄목할만한 성장세를 이어가고 있습니다.

2023년은 Global GDP 성장률이 작년대비 크게 감소하고, 자동차 및 오디오 시장 성장 정체 등 경영 환경이 더욱 악화될 것으로 예상됩니다. 그러나 당사는 철저한 준비와 기술혁신을 통해 제품 및 원가경쟁력을 확보하는 한편, 견실한 경영실적 달성을 통하여 주주가치 제고에 이바지 할 수 있도록 노력하겠습니다.

다. 신규 사업 및 중단 사업

해당사항 없습니다.

라. 조직개편

당사는 2021년 12월 중 기존의 CE부문과 IM부문을 DX부문으로 통합하였으며, 무선사업부의 명칭을 MX(Mobile eXperience)사업부로 변경하였습니다. 또한 내부 조직체계에 맞추어 SDC를 DS부문과 별도로 구분하였습니다.

[2021년 12월]

<table>
<tr><th></th><th>변경전</th><th>변경후</th></tr>
<tr><td rowspan="4">사업
조직</td><td>CE 부문
(영상디스플레이,
생활가전, 의료기기)</td><td rowspan="2">DX 부문
(영상디스플레이,
생활가전, 의료기기,
Mobile eXperience, 네트워크)</td></tr>
<tr><td>IM 부문
(무선, 네트워크)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">DS 부문
(메모리, System LSI, Foundry, DP)</td><td>DS 부문
(메모리, System LSI, Foundry)</td></tr>
<tr><td>SDC
(DP)</td></tr>
<tr><td>Harman 부문</td><td>Harman</td></tr>
<tr><td rowspan="2">지역
총괄</td><td>한국, 북미, 중남미, 구주,
CIS, 서남아, 동남아, 중국,
중동, 아프리카</td><td>한국, 북미, 중남미, 구주,
CIS, 서남아, 동남아, 중국,
중동, 아프리카</td></tr>
<tr><td>미주(DS), 구주(DS),
중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)</td><td>미주(DS), 구주(DS),
중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)</td></tr>
</table>

마. 환율변동 영향

당사는 글로벌 영업활동으로 인하여 기능통화와는 다른 통화로 표시된 거래를 하고 있어 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 환율변동위험에 노출되어 있는 주요 통화는 USD, EUR, INR 등이 있습니다.

[각 통화별 기말환율] (단위 : 원)

구 분	제54기	제53기	변동	변동률
USD	1,267.30	1,185.50	81.80	6.9%
EUR	1,351.20	1,342.34	8.86	0.7%
INR	15.31	15.93	△0.62	△3.9%

[△는 부(-)의 값임]

기능통화와 다른 주요 외화로 표시된 금융자산 및 금융부채에 대하여 환율이 5% 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제54기		제53기	
	환율 상승시	환율 하락시	환율 상승시	환율 하락시
USD	258,655	△258,655	250,489	△250,489
EUR	92,546	△92,546	107,519	△107,519
INR	52,096	△52,096	24,216	△24,216

[△는 부(-)의 값임]

당사는 환율변동과는 무관하게 통화별 자산과 부채 규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상
거래 및 예금, 차입 등의 자금 거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환율변동위험 발생을 최대한 억제하고 있습니다.

당사는 효율적인 환율변동위험관리를 위해 당사의 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며, 헷지목적 외의 외환거래는 금지하고 있습니다.

바. 자산 손상 인식

당사는 매년 개별자산(영업권 포함)이나 현금창출단위에 대해 손상 여부를 검토하고 있습니다.

현금창출단위의 회수가능가액은 사용가치 계산 등에 근거하여 결정되었습니다. 사용가치의 계산은 경영진이 승인한 향후 5년간(단, 신기술 산업 등 중장기 계획이 합리적인 경우 5년 초과)의 재무예산에 근거하여 세전현금흐름추정치를 사용하였습니다. 동 기간을 초과하는 기간에 대한 영구 현금흐름의 산출은 일정성장률의 가정(단, 산업평균성장률을 초과하지 않음)이 사용되었습니다.

개별자산에 대한 손상차손은 회수가능가액을 초과하는 장부금액만큼 인식하며,
회수가능가액은 처분부대원가를 차감한 공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다.

당기의 계정과목별 손상차손(환입) 인식액은 유형자산 264억원, 무형자산 63억원 등입니다.

☞ 자산 손상의 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'과
'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'의 '2. 타법인출자 현황'(별도 기준)을
참고하시기 바랍니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출

당사는 대규모 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금 수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지・관리하고 있습니다.

당사는 주기적으로 미래 현금 흐름을 예측하여 유동성위험을 사전 관리하고 있습니다. 권역별로 Cash Pooling을 구축・활용하여 권역 내 자금 부족의 경우에도 내부 자금을 활용하여 유동성위험을 효율적으로 관리하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사 간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성위험을 최소화하는 한편 자금운용부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 당사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

또한, 만약의 대규모 유동성 필요에 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있습니다.

가. 유동성 현황

당기말 현재 당사의 유동성은 상당히 양호하며, Cash Coverage(유동자금÷차입금)는 1,115%입니다.

구 분	제54기	제53기
Cash Coverage(유동자금÷차입금)	1,115%	675%

(단위 : 백만원)

구 분	제54기	제53기	증감
유동자금:			
현금및현금성자산	49,680,710	39,031,415	10,649,295
단기금융상품	65,102,886	81,708,986	△16,606,100
단기상각후원가금융자산	414,610	3,369,034	△2,954,424
단기당기손익-공정가치금융자산	29,080	40,757	△11,677
소 계	115,227,286	124,150,192	△8,922,906
차입금:			
단기차입금	5,147,315	13,687,793	△8,540,478
유동성장기부채	1,089,162	1,329,968	△240,806
사채	536,093	508,232	27,861
장기차입금	3,560,672	2,866,156	694,516
소 계	10,333,242	18,392,149	△8,058,907
Net Cash(유동자금-차입금)	104,894,044	105,758,043	△863,999

※ 유동성장기부채는 유동성장기차입금과 유동성사채입니다. [△는 부(-)의 값임]

당사는 당기말 현재 115조 2,273억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 ① 현금및현금성자산, ② 단기금융상품, ③ 단기상각후원가금융자산, ④ 단기당기손익-공정가치금융자산을 모두 포함한 금액이며, 전기말 유동자금 124조 1,502억원 대비 8조 9,229억원 감소하였습니다.

당기말 현재 당사 차입금(사채 포함)은 10조 3,332억원으로 전기말 18조 3,921억원 대비 8조 589억원 감소하였습니다.

당사의 유동성은 당기 영업활동 현금흐름으로 62조 1,813억원이 유입되었고, 유·무형자산의 취득 53조 1,267억원, 배당금 지급 9조 8,144억원 등이 유출되었으며,
Net Cash(유동자금-차입금)는 104조 8,940억원으로 전기말 105조 7,580억원 대비 8,640억원 감소하였습니다.

나. 자금 조달과 지출

(차입금 내역)

(단위 : 백만원)

구 분	차입처	연이자율(%)	제54기	제53기
단기차입금:				
담보부차입금	우리은행 등	0.0~16.7	3,569,357	11,556,101
무담보차입금	씨티은행 등	0.1~38.5	1,577,958	2,131,692
계			5,147,315	13,687,793
유동성장기차입금:				
은행차입금	BNP 등	38.9~53.2	208,915	40,415
리스부채	CSSD 등	3.5	874,019	811,902
계			1,082,934	852,317
장기차입금:				
은행차입금	기업은행 등	1.6~5.9	33,846	1,500
리스부채	CSSD 등	3.5	3,526,826	2,864,656
계			3,560,672	2,866,156

(단위 : 백만원)

구 분	발행일	만기상환일	연이자율(%)	제54기	제53기
US$ denominated Straight Bonds	1997.10.02	2027.10.01	7.7	31,683 (US$ 25,000천)	35,565 (US$ 30,000천)
US$ denominated Debenture Bonds	2015.05.11	2025.05.15	4.2	506,920 (US$ 400,000천)	474,200 (US$ 400,000천)
EURO€ denominated Debenture Bonds	2015.05.27	2022.05.27	2.0	- -	469,819 (EUR€350,000천)
소 계				538,603	979,584
사채할증발행차금(사채할인발행차금)				3,718	6,299
계				542,321	985,883
차감: 유동성사채				(6,228)	(477,651)
비유동사채				536,093	508,232

(차입금의 차입 및 상환)

당사의 단기차입금은 주로 매출채권할인 규모에 따라 증가 또는 감소하고 있습니다.
당사는 당기 중 단기차입금은 8조 5,405억원이 감소하였으며, 사채 및 장기차입금은 리스부채 증가 등으로 4,816억원 증가하였습니다.

(차입금의 상환계획)

(단위 : 백만원)

상환연도	금액
2023년	6,384,334
2024년	873,525
2025년	1,235,366
2026년	589,082
2027년 이후	1,912,869
계	10,995,176

※ 상환계획 금액은 사채의 할증발행차금과 할인발행차금, 리스부채의 현재가치 할인차금을 고려하기 전 금액입니다.

(사채관리계약 이행현황)

당사가 발행한 공모사채는 투자자 보호를 위하여 담보권설정 제한, 자산처분 제한 등의 이행조건이 부과되어 있으며, 당사는 이행조건을 준수하고 있습니다.

5. 부외거래

당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '우발부채와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항

당사는 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제・개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정

사업결합 시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항

환경 관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다.

당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.

다. 법규상의 규제에 관한 사항

당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다.

라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항

환율 변동 리스크 관리를 위하여 해외법인은 기능통화가 아닌 외화 포지션에
대하여 통화선도(Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지하고 있습니다.

당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래'와 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 감사의견 등

안진회계법인은 당사의 제52기, 제53기 및 제54기 재무제표에 대한 감사를 수행하였으며, 감사결과 감사의견은 적정입니다.

한편, 당사의 감사 대상 종속기업은 공시대상기간 중 모두 적정의견을 받았습니다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항
제54기 (당기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감
제53기 (전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감
제52기 (전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 2. 영업권 및 내용연수가 비한정인 무형자산 손상 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감

※ 감사의견은 별도・연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

[감사용역 체결 현황]

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역	
			보수	시간	보수	시간
제54기 (당기)	안진회계법인	분・반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 감사	8,424	78,000	8,424	78,146
제53기 (전기)	안진회계법인	분・반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 감사	7,900	76,741	7,900	76,999
제52기 (전전기)	안진회계법인	분・반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 감사	8,400	85,721	8,400	86,128

(제54기 일정)

구 분		일 정
제54기 1분기	사전검토	2022.03.07 ~ 2022.03.25
	본검토	2022.04.05 ~ 2022.05.13
제54기 2분기	사전검토	2022.06.06 ~ 2022.06.24
	본검토	2022.07.06 ~ 2022.08.12
제54기 3분기	사전검토	2022.09.07 ~ 2022.09.23
	본검토	2022.10.07 ~ 2022.11.11
시스템 및 자동 내부통제 감사		2022.03.16 ~ 2023.01.13
조기입증감사(연중감사)		2022.03.07 ~ 2022.12.31
내부회계관리제도 감사		2022.04.05 ~ 2023.01.20
조기입증감사 절차 업데이트 및 재무제표 감사		2023.01.09 ~ 2023.02.15

※ 별도・연결 재무제표 검토 및 감사와 내부회계관리제도 감사에 대한 일정입니다.

[비감사용역 체결 현황] (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제54기 (당기)	-	-	-	-	-
제53기 (전기)	2017.06	E-Discovery 자문업무	2021.01~2021.12	394	안진회계법인
제52기 (전전기)	2017.06	E-Discovery 자문업무	2020.01~2020.12	59	안진회계법인

[내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과]

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
1	2022.01.25	· 감사위원회: 위원 3명 · 회사: 감사팀장 · 감사인: 업무수행이사 외 1명	대면회의	· 핵심감사사항 등 중점 감사사항 · 내부회계관리제도 감사 진행 상황 · 기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항
2	2022.04.26	· 감사위원회: 위원 3명 · 회사: 감사팀장 · 감사인: 업무수행이사 외 4명	대면회의	· 연간 지배기구와의 커뮤니케이션 계획 · 연간 회계감사 일정 계획 · 분기 검토 경과보고
3	2022.07.26	· 감사위원회: 위원 3명 · 회사: 감사팀장 · 감사인: 업무수행이사 외 4명	대면회의	· 연간 감사계획 및 진행 상황 · 핵심감사사항 선정계획 · 내부회계관리제도 감사 진행 상황 · 분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항
4	2022.10.25	· 감사위원회: 위원 3명 · 회사: 감사팀장 · 감사인: 업무수행이사 외 4명	대면회의	· 연간 감사계획 및 진행 상황 · 핵심감사사항 선정계획 · 내부회계관리제도 감사 진행 상황 · 분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항
5	2023.01.27	· 감사위원회: 위원 3명 · 회사: 감사팀장 · 감사인: 업무수행이사 외 4명	대면회의	· 핵심감사사항 등 중점 감사사항 · 내부회계관리제도 감사 진행 상황 · 기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항

[조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보]

해당사항 없습니다.

나. 회계감사인의 변경

제54기말(당기) 현재 당사의 종속기업은 232개이며, 당기 중 종속기업 Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)이 PwC를, SVIC 52호 신기술투자조합과 SVIC 55호 신기술투자조합, SVIC 56호 신기술투자조합, SVIC 57호 신기술투자조합은 삼정회계법인(KPMG)을 회계감사인으로 신규 선임하였습니다.

제53기말(전기) 현재 당사의 종속기업은 228개이며, 종속기업 Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)와 Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd.(SETK-P)가 Deloitte를, 지에프㈜가 안진회계법인(Deloitte)을 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 또한 종속기업 Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)이 Deloitte에서 E&Y로 감사인을 변경하였으며, 도우인시스㈜가 삼덕회계법인에서 안진회계법인(Deloitte)으로 변경하였습니다. 종속기업의 회계감사인 신규 선임 및 변경은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

또한, 당사는 제52기(전전기) 회계감사인을 삼일회계법인(PwC)에서 안진회계법인(Deloitte)으로 변경하였습니다. 이는 기존 감사인과 계약 기간 만료 후,「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조,「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 따른 감사인 주기적 지정에 의한 것입니다. 당사의 종속기업은 제52기말(전전기말, 2020년말) 현재 241개이며, 2020년 중 삼성디스플레이㈜ 등 6개 국내종속기업은 삼일회계법인(PwC)에서 안진회계법인(Deloitte)으로 회계감사인을 변경하였으며, Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 24개 해외종속기업은 PwC에서 Deloitte로, Samsung Eletronica da AmazoniaLtda. (SEDA) 등 2개 해외종속기업은 KPMG에서 Deloitte로 회계감사인을 변경하였습니다. 해당 종속기업들은 당사(지배회사)의 회계감사인 변경에 따라 연결감사 업무 효율화를 위해 회계감사인을 변경하였습니다.

[제52기 종속기업의 회계감사인 변경 현황]

종속법인명	변경전 회계감사인	변경후 회계감사인
삼성디스플레이㈜	삼일회계법인(PwC)	안진회계법인(Deloitte)
삼성전자서비스㈜	삼일회계법인(PwC)	안진회계법인(Deloitte)
삼성전자서비스씨에스㈜	삼일회계법인(PwC)	안진회계법인(Deloitte)
삼성전자판매㈜	삼일회계법인(PwC)	안진회계법인(Deloitte)
삼성전자로지텍㈜	삼일회계법인(PwC)	안진회계법인(Deloitte)
㈜미래로시스템	삼일회계법인(PwC)	안진회계법인(Deloitte)
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	PwC	Deloitte
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	PwC	Deloitte
Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	PwC	Deloitte
Samsung International, Inc. (SII)	PwC	Deloitte
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	PwC	Deloitte
Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics GmbH (SEG)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	PwC	Deloitte
Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	PwC	Deloitte
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	PwC	Deloitte
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	PwC	Deloitte
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	PwC	Deloitte
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	PwC	Deloitte
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Turkey (SETK)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	PwC	Deloitte
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	KPMG	Deloitte
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	KPMG	Deloitte

또한, 제52기(전전기) 중 신규 인수한 종속기업 TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)는 PwC를 회계감사인으로 선임하였습니다. 회계감사인 신규 선임은 회사의 결정에 의한 것입니다.

2. 내부통제에 관한 사항

[회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견]

사업연도	감사인	감사의견	지적사항
제54기 (당기)	안진회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음
제53기 (전기)	안진회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음
제52기 (전전기)	안진회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 사내이사 5인(한종희, 경계현, 노태문, 박학규, 이정배)과 사외이사 6인(김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희), 총 11인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 김한조 사외이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사 후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 지속가능경영위원회 등 6개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일)

구 분	구 성	소속 이사명	의장·위원장	주요 역할
이사회	사내이사 5명, 사외이사 6명	한종희, 경계현, 노태문, 박학규, 이정배 김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희	김한조 (사외이사)	· 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 · 경영진의 업무집행 감독
경영위원회	사내이사 5명	한종희, 경계현, 노태문, 박학규, 이정배	한종희 (사내이사)	· 경영 일반, 재무 관련 사항 및 이사회가 위임한 사안을 심의·결의
감사위원회	사외이사 3명	김한조, 김선욱, 김종훈	김한조 (사외이사)	· 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사
사외이사 후보추천위원회	사외이사 2명	김종훈, 김선욱	김종훈 (사외이사)	· 사외이사 후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천
내부거래위원회	사외이사 3명	김선욱, 김한조, 김종훈	김선욱 (사외이사)	· 자율적인 공정거래 준수를 통해 회사 경영의 투명성을 제고
보상위원회	사외이사 3명	김종훈, 김한조, 김준성	-	· 이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보
지속가능경영위원회	사외이사 6명	김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희	김한조 (사외이사)	· 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 영역에서 지속가능경영을 추진하고 주주가치를 제고

※ 2022년 1월 27일 김종훈 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2022년 3월 16일 주주총회를 통해 경계현, 노태문, 박학규, 이정배 사내이사와
한화진, 김준성 사외이사가 신규 선임되었고, 김한조 사외이사가 재선임되었습니다.

※ 2022년 3월 16일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 사임하였습니다.

※ 2022년 3월 19일 박재완, 안규리 사외이사의 임기가 만료되었습니다.

※ 2022년 4월 1일 한종희 사내이사가 경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2022년 4월 20일 한화진 사외이사가 사임하였습니다.

※ 2022년 4월 26일 김한조 사외이사가 감사위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2022년 4월 28일 김한조 사외이사가 지속가능경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2022년 5월 17일 박병국 사외이사가 퇴임하였습니다.

※ 2022년 7월 28일 이사회를 통해 김선욱 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.

※ 2022년 7월 28일 이사회를 통해 김종훈 사외이사가 보상위원회 위원으로 선임되었습니다.

※ 2022년 11월 3일 주주총회를 통해 허은녕, 유명희 사외이사가 신규 선임되었습니다.

※ 2022년 11월 3일 이사회를 통해 허은녕, 유명희 사외이사가 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었습니다.

※ 2023년 1월 27일 김종훈 사외이사가 보상위원회 위원장으로 선임되었습니다.

(사외이사 및 그 변동 현황)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황		
		선임	해임	중도퇴임
11	6	5	-	2

※ 2022년 3월 16일 주주총회에서 한화진, 김준성 사외이사가 신규 선임되었고, 김한조 사외이사가 재선임되었습니다.

※ 2022년 3월 19일 박재완, 안규리 사외이사의 임기가 만료되었습니다.

※ 2022년 4월 20일 한화진 사외이사가 사임하였습니다.

※ 2022년 5월 17일 박병국 사외이사가 퇴임하였습니다.

※ 2022년 11월 3일 주주총회에서 허은녕, 유명희 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명							
			사내이사							
			김기남 (출석률 :100%)	김현석 (출석률 :100%)	고동진 (출석률 :100%)	한종희 (출석률 :90%)	경계현 (출석률 :100%)	노태문 (출석률 :88%)	박학규 (출석률 :100%)	이정배 (출석률 :100%)
			찬 반 여 부							
'22.01.27 (1차)	1. 2021년(제53기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성				
	2. 삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성				
	※ 보고사항									
	① 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건									
	② 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건									
'22.02.15 (2차)	1. 대표이사 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성				
	2. 제53기 정기주주총회 소집결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성				
	3. 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성				
	□ 보고 사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고									
	□ 제1호: 제53기(2021.1.1~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건									
	□ 제2호: 이사 선임의 건						해당 사항 없음 (신규 선임)	해당 사항 없음 (신규 선임)	해당 사항 없음 (신규 선임)	해당 사항 없음 (신규 선임)
	- 제2-1호 사외이사 선임의 건									
	・제2-1-1호 사외이사 김한조 선임의 건									
	・제2-1-2호 사외이사 한화진 선임의 건									
	・제2-1-3호 사외이사 김준성 선임의 건									
	- 제2-2호 사내이사 선임의 건									
	・제2-2-1호 사내이사 경계현 선임의 건									
	・제2-2-2호 사내이사 노태문 선임의 건									
	・제2-2-3호 사내이사 박학규 선임의 건									
	・제2-2-4호 사내이사 이정배 선임의 건									
	- 제2-3호 감사위원회 위원 선임의 건									
	・제2-3-1호: 감사위원회 위원 김한조 선임의 건									
	・제2-3-2호: 감사위원회 위원 김종훈 선임의 건									
	□ 제3호: 이사 보수한도 승인의 건									
	4. 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성				
	5. 2022년 사회공헌 매칭기금 운영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성				
	6. 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성				
	7. 생산물 배상책임보험 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성				
'22.03.16 (3차)	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	해당 사항 없음 (사임)	해당 사항 없음 (사임)	해당 사항 없음 (사임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	2. 대표이사 선정의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	3. 이사회내 위원회 위원 선임의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	4. 이사 보수 책정의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	5. 삼성바이오로직스 유상증자 참여의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
'22.04.28 (4차)	1. 2022년 1분기 보고서 및 분기배당 승인의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	2. 서초 전자사옥 부동산 임대차계약 체결의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

	3. 사원 단체보험 가입의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	4. 사회공헌 기부금 출연의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	5. 삼성SDI와의 임대차계약 체결의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	6. DS부문 우수협력사 인센티브 기금 출연의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	7. 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	1. 2022년 반기보고서 및 2분기 배당 승인의 건	가결				찬성	찬성	불참	-	찬성
	2. 이사회내 위원회 위원 선임의 건	가결				찬성	찬성	불참	-	찬성
	3. 신기술사업투자조합 가입의 건	가결				찬성	찬성	불참	-	찬성
'22.07.28	4. 삼성 준법감시위원회 설치 및 운영에 관한 규정 개정의 건	가결				찬성	찬성	불참	-	찬성
(5차)	5. 국내 사업장 패키지보험 가입의 건	가결				찬성	찬성	불참	-	찬성
	6. 모바일 기기보험 가입의 건	가결				찬성	찬성	불참	-	찬성
	7. 삼성디스플레이㈜와 부동산 임대계약 체결의 건	가결				찬성	찬성	불참	-	찬성
	8. 서울대 반도체공동연구소 운영비 기부의 건	가결				찬성	찬성	불참	-	찬성
	1. 임시주주총회 소집결정의 건	가결				불참	찬성	찬성	찬성	-
	2. 임시주주총회 회의 목적사항 결정의 건	가결				불참	찬성	찬성	찬성	-
'22.09.01	□ 보고 사항: 감사보고									
(6차)	□ 제1호: 사외이사 선임의 건									
	- 제1-1호 사외이사 허은녕 선임의 건									
	- 제1-2호 사외이사 유명희 선임의 건									
	3. 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일 설정의 건	가결				불참	찬성	찬성	찬성	-
	1. 이재용 부회장, 회장 승진의 건	가결				찬성	찬성	찬성	-	-
'22.10.27	2. 2022년 3분기 보고서 및 분기배당 승인의 건	가결				찬성	찬성	찬성	-	-
(7차)	3. 서울상공회의소 특별회비 납부의 건	가결				찬성	찬성	찬성	-	-
	※ 보고사항									
	① 최고경영자 승계 후보군 보고의 건									
'22.11.03	1. 이사회내 위원회 위원 선임의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
(8차)	2. 이태원 사고 관련 지원 및 사회안전시스템 구축 성금의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	1. 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	2. 퇴직연금 불입의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	3. 2023년 경영계획 승인의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	4. 희망2023 나눔 캠페인 기부금 출연의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
'22.11.30	5. Samsung Global Goals 기부금 출연의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
(9차)	6. 국제기능올림픽 후원의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	※ 보고사항									
	① 준법통제체제 유효성 평가 결과 보고의 건									
	② 준법점검 결과 보고의 건									
	③ 준법문화 구축방안 보고의 건									
'22.12.20	1. 준법지원인 선임의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
(10차)										

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명									
			사외이사									
			박재완 (출석률 :67%)	김선욱 (출석률 :90%)	박병국 (출석률 :100%)	김종훈 (출석률 :100%)	안규리 (출석률 :67%)	김한조 (출석률 :100%)	한화진 (출석률 :100%)	김준성 (출석률 :100%)	허은녕 (출석률 :100%)	유명희 (출석률 :100%)
			찬 반 여 부									
'22.01.27 (1차)	1. 2021년(제53기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건 ※ 보고사항 ① 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 ② 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성				
'22.02.15 (2차)	1. 대표이사 선정의 건 2. 제53기 정기주주총회 소집결정의 건 3. 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 □ 보고 사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 제1호: 제53기(2021.1.1~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 □ 제2호: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사외이사 선임의 건 ・제2-1-1호 사외이사 김한조 선임의 건 ・제2-1-2호 사외이사 한화진 선임의 건 ・제2-1-3호 사외이사 김준성 선임의 건 - 제2-2호 사내이사 선임의 건 ・제2-2-1호 사내이사 경계현 선임의 건 ・제2-2-2호 사내이사 노태문 선임의 건 ・제2-2-3호 사내이사 박학규 선임의 건 ・제2-2-4호 사내이사 이정배 선임의 건 - 제2-3호 감사위원회 위원 선임의 건 ・제2-3-1호: 감사위원회 위원 김한조 선임의 건 ・제2-3-2호: 감사위원회 위원 김종훈 선임의 건 □ 제3호: 이사 보수한도 승인의 건 4. 내부회계관리규정 개정의 건 5. 2022년 사회공헌 매칭기금 운영계획 승인의 건 6. 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건 7. 생산물 배상책임보험 가입의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	해당 사항 없음 (신규 선임)	해당 사항 없음 (신규 선임)	해당 사항 없음 (신규 선임)	해당 사항 없음 (신규 선임)
'22.03.16 (3차)	1. 이사회 의장 선임의 건 2. 대표이사 선정의 건 3. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 4. 이사 보수 책정의 건 5. 삼성바이오로직스 유상증자 참여의 건	가결 가결 가결 가결 가결	불참 불참 불참 불참 불참	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	불참 불참 불참 불참 불참	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성		
'22.04.28 (4차)	1. 2022년 1분기 보고서 및 분기배당 승인의 건 2. 서초 전자사옥 부동산 임대차계약 체결의 건 3. 사원 단체보험 가입의 건 4. 사회공헌 기부금 출연의 건 5. 삼성SDI와의 임대차계약 체결의 건 6. DS부문 우수협력사 인센티브 기금 출연의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결	해당 사항 없음 (임기 만료)	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	해당 사항 없음 (임기 만료)	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	해당 사항 없음 (사임)	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성		

	7. 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건	가결		찬성	찬성	찬성		찬성		찬성		
'22.07.28 (5차)	1. 2022년 반기보고서 및 2분기 배당 승인의 건 2. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 3. 신기술사업투자조합 가입의 건 4. 삼성 준법감시위원회 설치 및 운영에 관한 규정 개정의 건 5. 국내 사업장 패키지보험 가입의 건 6. 모바일 기기보험 가입의 건 7. 삼성디스플레이㈜와 부동산 임대계약 체결의 건 8. 서울대 반도체공동연구소 운영비 기부의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결		찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성		
'22.09.01 (6차)	1. 임시주주총회 소집결정의 건 2. 임시주주총회 회의 목적사항 결정의 건 □ 보고 사항: 감사보고 □ 제1호: 사외이사 선임의 건 - 제1-1호 사외이사 허은녕 선임의 건 - 제1-2호 사외이사 유명희 선임의 건 3. 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일 설정의 건	가결 가결 가결		찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성		
'22.10.27 (7차)	1. 이재용 부회장, 회장 승진의 건 2. 2022년 3분기 보고서 및 분기배당 승인의 건 3. 서울상공회의소 특별회비 납부의 건 ※ 보고사항 ① 최고경영자 승계 후보군 보고의 건	가결 가결 가결		찬성 찬성 찬성	해당 사항 없음 (퇴임)	찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성		
'22.11.03 (8차)	1. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 2. 이태원 사고 관련 지원 및 사회안전시스템 구축 성금의 건	가결 가결		불참 불참		찬성 찬성		찬성 찬성		찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
'22.11.30 (9차)	1. 특수관계인과의 거래 승인의 건 2. 퇴직연금 불입의 건 3. 2023년 경영계획 승인의 건 4. 희망2023 나눔 캠페인 기부금 출연의 건 5. Samsung Global Goals 기부금 출연의 건 6. 국제기능올림픽 후원의 건 ※ 보고사항 ① 준법통제체제 유효성 평가 결과 보고의 건 ② 준법점검 결과 보고의 건 ③ 준법문화 구축방안 보고의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결		찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
'22.12.20 (10차)	1. 준법지원인 선임의 건	가결		찬성		찬성		찬성		찬성	찬성	찬성

※ 2022년 2차 이사회 안건 중 '⑥ 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건'은 상법상 이사와 회사간의 거래에 해당되므로, 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사인 김기남 사내이사는 해당 안건에 대해 의결권을 행사하지 않았습니다.

※ 2022년 3월 16일 주주총회를 통해 경계현, 노태문, 박학규, 이정배 사내이사와 한화진, 김준성 사외이사가 신규 선임되었고, 김한조 사외이사가 재선임되었습니다.

※ 2022년 3월 16일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 사임하였습니다.

※ 2022년 3월 19일 박재완, 안규리 사외이사의 임기가 만료되었습니다.

※ 2022년 4월 20일 한화진 사외이사가 사임하였습니다.

※ 2022년 5월 17일 박병국 사외이사가 퇴임하였습니다.

※ 2022년 11월 3일 주주총회를 통해 허은녕, 유명희 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 이사회내의 위원회

(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고
경영위원회	사내이사 5명	한종희(위원장), 경계현, 노태문, 박학규, 이정배	하단 기재내용 참고	· 한종희 사내이사 위원장 선임('22.04.01)
내부거래위원회	사외이사 3명	김선욱(위원장), 김한조, 김종훈	하단 기재내용 참고	· 김선욱 사외이사 위원장 선임('21.04.27)
보상위원회	사외이사 3명	김종훈, 김한조, 김준성	하단 기재내용 참고	-
지속가능경영위원회	사외이사 6명	김한조(위원장), 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희	하단 기재내용 참고	· 김한조 사외이사 위원장 선임('22.04.28)

※ 감사위원회와 사외이사 후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

※ 2022년 3월 16일 주주총회를 통해 경계현, 노태문, 박학규, 이정배 사내이사와 한화진, 김준성 사외이사가 신규 선임되었고, 김한조 사외이사가 재선임되었습니다.

※ 2022년 3월 16일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 사임하였습니다.

※ 2022년 3월 19일 박재완, 안규리 사외이사의 임기가 만료되었습니다.

※ 2022년 4월 1일 한종희 사내이사가 경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2022년 4월 20일 한화진 사외이사가 사임하였습니다.

※ 2022년 4월 28일 김한조 사외이사가 지속가능경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2022년 5월 17일 박병국 사외이사가 퇴임하였습니다.

※ 2022년 7월 28일 이사회를 통해 김종훈 사외이사가 보상위원회 위원으로 선임되었습니다.

※ 2022년 11월 3일 주주총회를 통해 허은녕, 유명희 사외이사가 신규 선임되었습니다.

※ 2022년 11월 3일 이사회를 통해 허은녕, 유명희 사외이사가 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었습니다.

※ 2023년 1월 27일 김종훈 사외이사가 보상위원회 위원장으로 선임되었습니다.

(경영위원회)

- 설치목적: 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행해야 하며,
그 외 수시로 이사회가 위임한 사항에 관하여 심의하고 결의한다.
경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

- 권한사항: 경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함

1. 경영일반에 관한 사항
1) 회사의 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략
2) 주요 경영전략
3) 사업계획·사업구조 조정 추진
4) 해외 지점·법인의 설치, 이전 및 철수
5) 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진
6) 국내외 주요 자회사 매입 또는 매각(자기자본 0.1% 이상인 경우에 한함)
7) 기타 주요 경영현안
8) 지점, 사업장의 설치 및 이전, 폐지
9) 지배인의 선임 또는 해임
10) 최근사업연도 생산액의 5%이상 생산중단, 폐업
11) 자기자본 0.5%이상 기술도입계약 체결 및 기술이전, 제휴
12) 자기자본 0.5%이상 신물질, 신기술 관련 특허권 취득, 양수, 양도계약
13) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 제품수거, 파기
14) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일계약 체결
15) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일판매 대행 또는
공급계약 체결 또는 해지
16) 조직의 운영에 관한 기본원칙
17) 급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙의 결정 및 변경
18) 명의개서 대리인의 선임, 해임 및 변경
19) 주주명부폐쇄 및 기준일 설정에 관한 사항
20) 업무추진 및 경영상 필요한 세칙의 제정

2. 재무 등에 관한 사항
1) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 타법인 출자, 처분
2) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 해외 직접투자
3) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 신규 담보제공 또는
신규 채무보증(기간 연장은 제외함)
- 담보: 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함
- 채무보증: 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외
4) 자기자본 0.1%이상 5%미만 상당 신규 차입계약 체결 (기간 연장은 제외함)
5) 내부거래의 승인
내부거래라 함은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 30억원 이상 50억원 미만 상당의 자금(가지급금, 대여금 등), 유가증권(주식, 회사채 등) 또는 자산(부동산, 무체재산권 등)을 제공하거나 거래하는 행위(기존 계약을 중대한 변경 없이 갱신하는 경우는 제외함)
6) 사채발행
7) 자기자본 0.1% 이상의 부동산 취득 및 처분. 단, 제3자와의 거래로 인한 경우에 한함
8) 주요 시설투자 등 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

3. 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회의 권한에 속하는 사항 중 이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과 다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항

(내부거래위원회)

- 설치목적: 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함

- 권한사항
  · 내부거래 보고 청취권: 계열사와의 내부거래 현황에 대해 보고받을 수 있음
    ※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 50억원 이상 대규모 내부거래는 사전 심의하고 그 이외의 거래에 있어서도 중요한 거래라고 판단하는 거래는 심의 및 의결할 수 있음
  · 내부거래 직권조사 명령권
  · 내부거래 시정조치 건의권

(보상위원회)

- 설치목적: 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함

- 권한사항
  · 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도
  · 등기이사에 대한 보상체계
  · 기타 이사회에서 위임한 사항

(지속가능경영위원회)

- 설치목적: 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 영역에서 지속가능경영을 추진하고 주주가치를 제고하기 위함

- 권한사항
  · 회사의 지속가능경영과 관련된 사항
    1) 주요 지속가능경영 전략 및 정책
    2) 환경, 사회, 지배구조 등 지속가능경영 관련 주요 활동 보고
    3) 지속가능경영보고서 발간 계획
  · 주주가치 제고와 관련된 사항
    1) 주주환원 정책 사전 심의
    2) 주주권익 관련 주요 사안 보고
  · 기타 지속가능경영 및 주주가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항으로 위원회가 부의가 필요하다고 판단한 사항
  · 위원회 산하 연구회, 협의회 등 조직의 설치, 구성, 운영과 관련된 사항
  · 기타 이사회에서 위임한 사항

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

(경영위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명							
				김기남 (출석률: 100%)	김현석 (출석률: 100%)	고동진 (출석률 :100%)	한종희 (출석률: 100%)	경계현 (출석률 :100%)	노태문 (출석률 :89%)	박학규 (출석률 :89%)	이정배 (출석률 :100%)
				찬 반 여 부							
경영위원회	'22.01.27	1. 메모리 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 사항 없음 (신규 선임)	해당 사항 없음 (신규 선임)	해당 사항 없음 (신규 선임)	해당 사항 없음 (신규 선임)
		2. 메모리(평택) 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성				
		3. 해외법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성				
		4. 임대차 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성				
	'22.02.25	1. 메모리(평택 3라인) 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성				
		2. 메모리(평택 4라인) 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성				
		3. 메모리 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성				
		4. DS 부문 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성				
		5. 해외법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성				
	'22.04.01	1. 경영위원회 위원장 선임의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 메모리('23년) 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 메모리('25년) 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		4. 메모리 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		5. Foundry(평택) 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		6. Foundry 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		7. TSP 총괄(천안) 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		8. TSP 총괄 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		9. 임대차 계약 체결의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		10. 반도체연구소(기흥) 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		11. 반도체연구소 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	'22.04.05	1. 메모리 투자의 건	가결	해당 사항 없음 (사임)	해당 사항 없음 (사임)	해당 사항 없음 (사임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	'22.04.28	1. 반도체연구소 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 메모리 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 책임보험 가입의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	'22.05.27	1. Foundry(평택) 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. Foundry(평택) 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	'22.06.30	1. 메모리 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 천안단지 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 협력 계약 체결의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	'22.07.13	1. 라이선스 계약 체결의 건	가결				찬성	찬성	찬성	불참	찬성
	'22.07.28	1. 메모리 투자의 건	가결				찬성	찬성	불참	찬성	찬성
	'22.11.17	1. 메모리(평택 3라인) 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 메모리(평택 4라인) 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 메모리 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		4. 해외현지법인 증자의 건	부결				반대	반대	반대	반대	반대
	'22.12.14	1. 라이선스 계약 체결의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2022년 11월 17일 개최된 경영위원회 안건 중 '4. 해외현지법인 증자의 건'의 부결사유

: 해외손회사의 투자재원 확보와 관련, 본사가 증자에 참여하지 않더라도 해외자회사의 유보자금으로 증자를 진행할 수 있다고 판단

(내부거래위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명			
				김선욱 (출석률: 100%)	박재완 (출석률: 100%)	김한조 (출석률: 100%)	김종훈 (출석률: 100%)
				찬 반 여 부			
내부거래 위원회	'22.01.25	1. 2021년 4분기 내부거래 현황 보고	-	-	-	-	해당 사항 없음 (신규 선임)
	'22.02.11	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 ① 생산물 배상책임보험 가입의 건	-	-	-	-	
	'22.03.11	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 ① 삼성바이오로직스㈜ 유상증자 참여의 건	-	-	-	-	
	'22.04.26	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 ① 서초 전자사옥 부동산 임대차계약 체결의 건 ② 사원단체보험 가입의 건 ③ 사회공헌 기부금 출연의 건 ④ 삼성SDI와의 임대차 계약 체결의 건 2. 2022년 1분기 내부거래 현황 보고	- -	- -	해당 사항 없음 (임기 만료)	- -	- -
	'22.07.26	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 ① 신기술사업투자조합 가입의 건 ② 국내 사업장 패키지보험 가입의 건 ③ 모바일 기기보험 가입의 건 ④ 삼성디스플레이㈜와 임대계약 체결의 건 2. 2022년 2분기 내부거래 현황 보고	- -	- -		- -	- -
	'22.10.25	1. 2022년 3분기 내부거래 현황 보고	-	-		-	-
	'22.11.28	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 ① 퇴직연금 불입의 건 ② 2023년도 대규모 상품·용역거래 승인의 건	-	-		-	-

(보상위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명				
				박병국 (출석률: 100%)	박재완 (출석률: 100%)	김종훈 (출석률: 100%)	김한조 (출석률: -)	김준성 (출석률: -)
				찬 반 여 부				
보상 위원회	'22.02.11	1. 2022년 사내이사 개별 고정연봉 심의의 건 2. 2022년 이사보수 한도 심의의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	해당 사항 없음 (신규 선임)	해당 사항 없음 (신규 선임)

(지속가능경영위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명									
				박재완 (출석률 :100%)	김선욱 (출석률 :100%)	박병국 (출석률 :100%)	김종훈 (출석률 :100%)	안규리 (출석률 :100%)	김한조 (출석률 :100%)	한화진 (출석률 :-)	김준성 (출석률 :100%)	허은녕 (출석률 :-	유명희 (출석률 :-)
				찬 반 여 부									
지속가능 경영위원회	'22.02.11	1. 사회공헌활동(CSR) 2.0 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	해당 사항 없음 (신규 선임)	해당 사항 없음 (신규 선임)	해당 사항 없음 (신규 선임)	해당 사항 없음 (신규 선임)
		2. UN Global Compact 가입 진행 현황 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-				
		3. IR 동향 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-				
	'22.04.28	1. 지속가능경영위원회 위원장 선임의 건	가결	해당 사항 없음 (임기 만료)	찬성	찬성	찬성	해당 사항 없음 (임기 만료)	찬성	해당 사항 없음 (사임)	찬성		
		2. IR 동향 보고의 건	-		-	-	-		-		-		
		3. 투자자 ESG 미팅 결과 보고의 건	-		-	-	-		-		-		
		4. 지속가능경영보고서 발간 계획 보고의 건	-		-	-	-		-		-		
		5. 전자 지속가능경영 추진 과제 보고의 건	-		-	-	-		-		-		
		6. 기업평판 조사 결과 보고의 건	-		-	-	-		-		-		
	'22.07.28	1. IR 동향 보고의 건	-		-	해당 사항 없음 (퇴임)	-		-		-		
		2. 전자 다양성 및 포용 추진 경과 보고의 건	-		-		-		-		-		
	'22.09.01	1. 전자 환경전략 추진(안) 심의의 건	가결		찬성		찬성		찬성		찬성		
	'22.10.27	1. IR동향 보고의 건											
		2. 대내외 지속가능경영 동향 보고의 건	-		-		-		-		-		
		3. Semiconductor Climate Consortium 가입 보고의 건	-		-		-		-		-		
		4. 자회사형 장애인표준사업장 설립 추진 현황 보고의 건	-		-		-		-		-		

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사 후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 전자 산업에 대한 이해와 IT, 회계, 재무, 법무, 경제, 금융, EHS 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령・정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.

각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일)

직명	성 명	임기 (연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계
사내이사 (대표이사)	한종희	'20.03~'23.03 (해당사항 없음)	디스플레이 제품 분야의 최고 개발 전문가로서 당사가 글로벌 TV 1위를 지속 달성하는데 주도적인 역할을 하였으며, 탁월한 경영역량을 발휘하여 경쟁이 심화되고 있는 TV 시장을 주도하여 리더십을 더욱 공고히 하는데 기여할 것으로 판단	이사회	DX부문 경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인
사내이사 (대표이사)	경계현	'22.03~'25.03 (해당사항 없음)	DS부문장으로서, DRAM, Flash, Solution 메모리 3대 제품을 모두 섭렵한 기술력을 보유하고 있으며, 소통과 공감을 통해 조직의 근본적인 체질을 개선하고 세계 반도체시장 1위 지위를 굳건히 강화 하는데 가장 적임자로 판단	이사회	DS부문 경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인
사내이사	노태문	'22.03~'25.03 (해당사항 없음)	MX사업부의 주요 핵심보직을 두루 경험하였고, '21년에는 갤럭시 S21, 폴더블 등을 통해 매출 104조원을 달성하여 '14년 이후 최고 실적을 창출하였음. 또한, 사업운영 개선을 통해 수익성을 강화하고 사업체질을 공고화하는 등 기업체질 변화에 크게 기여할 것으로 판단	이사회	MX사업부 경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인
사내이사	박학규	'22.03~'25.03 (해당사항 없음)	주요 사업부들의 경영관리 보직들을 거치며 경영 리스크 관리역량을 입증하였고, 폭넓은 안목으로 사업 혁신을 성공적으로 이끌었음. 현재는 DX부문 경영지원실장으로서, 사업 성과창출을 위해 핵심 스탭 기능과 진단 및 감사역할까지 담당하고 있으며 전사 경영 이슈를 조율하는데 크게 기여	이사회	전사 경영전반 에 대한 업무	해당사항 없음	특수관계인
사내이사	이정배	'22.03~'25.03 (해당사항 없음)	메모리사업부의 개발, 품질, 전략 등 주요 보직들을 두루 경험한 전문가로 제품 경쟁력 확보를 통해 DRAM 30년 연속 매출 1위를 달성하였고, '21년에는 세계 반도체 매출 1위를 재탈환하는 등 DS부문 사업에 대한 풍부한 경험과 뛰어난 역량을 보유한 것으로 판단	이사회	메모리사업부 경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인
사외이사	김한조	'19.03~'25.03 (1회)	은행장을 역임한 재무전문가이자 전문 경영인이며 현재 사회공헌 재단을 맡고 있어 경영 전반에 대한 조언 외에 재무 전문성 및 상생·나눔경영 역량을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반 에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음
사외이사	김선욱	'18.03~'24.03 (1회)	법학전문대학원 교수와 법제처장을 역임한 법률전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반 에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음
사외이사	김종훈	'18.03~'24.03 (1회)	IT 분야의 통신 전문가이자 경영인으로서 다양한 경험을 바탕으로 경영을 감독할 수 있는 역량과 함께 IT산업에 대한 통찰력과 광범위한 네트워크를 통한 글로벌 경영 감각으로 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반 에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김준성	'22.03~'25.03 (해당사항 없음)	글로벌 선진 금융시장에서 주식시장 분석과 투자 경험을 쌓은 국제경제 및 투자 전문가로서, 해외시장과 외국 투자자들의 입장을 잘 대변하고, 글로벌 네크워킹을 활용하여 트렌디한 투자 전략 수립에 큰 기여를 할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음
사외이사	허은녕	'22.11~'25.11 (해당사항 없음)	에너지・자원・환경 관련 경제 및 정책 분야 전문가이자 세계적으로도 손꼽히는 석학으로 당사 해당 분야의 경영 강화에 기여하는 한편, 이사회에 실질적인 조언을 해줄 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음
사외이사	유명희	'22.11~'25.11 (해당사항 없음)	통상교섭본부장을 역임한 국제 통상전문가로 외교적 소통 노하우, 글로벌 인적 네트워크를 바탕으로 회사의 주요 투자자 및 이해 관계자들과 긴밀히 소통할 수 있을 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

※ 2022년 2월 15일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 대표이사직에서 사임하였으며, 동일 개최한 이사회에서 한종희 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

※ 2022년 3월 16일 주주총회를 통해 경계현, 노태문, 박학규, 이정배 사내이사와 한화진, 김준성 사외이사가 신규 선임되었고, 김한조 사외이사가 재선임되었습니다.

※ 2022년 3월 16일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 사임하였습니다.

※ 2022년 3월 16일 이사회를 통해 경계현 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

※ 2022년 3월 19일 박재완, 안규리 사외이사의 임기가 만료되었습니다.

※ 2022년 4월 20일 한화진 사외이사가 사임하였습니다.

※ 2022년 5월 17일 박병국 사외이사가 퇴임하였습니다.

※ 2022년 11월 3일 주주총회를 통해 허은녕, 유명희 사외이사가 신규 선임되었습니다.

(2) 사외이사 후보추천위원회

주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사 후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 작성기준일(2022년 12월 31일) 현재 위원회는 사외이사 2인(김종훈, 김선욱)으로 구성되어 있습니다.

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명				
				김종훈 (출석률:100%)	박병국 (출석률:100%)	안규리 (출석률:100%)	한화진 (출석률:-)	김선욱 (출석률:100%)
				찬 반 여 부				
사외이사 후보추천위원회	'22.01.27	1. 위원장 선임의 건 2. 사외이사 후보추천일 결정의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	해당 사항 없음 (신규 선임)	해당 사항 없음 (신규 선임)
	'22.02.11	1. 사외이사 후보추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성		
	'22.08.30	1. 사외이사 후보추천의 건	가결	찬성	해당 사항 없음 (퇴임)	해당 사항 없음 (임기 만료)	해당 사항 없음 (사임)	찬성

※ 2022년 1월 27일 김종훈 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2022년 3월 16일 이사회를 통해 한화진 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.

※ 2022년 3월 19일 안규리 사외이사의 임기가 만료되었습니다.

※ 2022년 4월 20일 한화진 사외이사가 사임하였습니다.

※ 2022년 5월 17일 박병국 사외이사가 퇴임하였습니다.

※ 2022년 7월 28일 이사회를 통해 김선욱 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.

(3) 사외이사의 전문성

1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수 / 지원업무 담당기간)	주요 활동내역
이사회 사무국	3	・상무 1명(17년 11개월 / 1개월), ・직원(Principal Professional) 1명 (19년 11개월 / 3년 5개월), ・직원(Senior Professional) 1명 (15년 11개월 / 5년 11개월)	・주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원 ・사외이사 교육 및 직무수행 지원 ・이사 후보에 대한 데이터베이스 구축 ・각 이사에게 의결을 위한 정보 제공 ・회의 진행을 위한 실무 지원 ・이사회 및 위원회의 회의내용 기록

2) 경영이해도 제고를 위한 사외이사 내부교육 실시 현황

① 국내외 경영현장 점검

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2022.04.28	MX사업부	김한조, 김선욱, 박병국, 김종훈, 김준성	해당사항 없음	· 사업부 경영현황 파악 및 현장 답사
2022.07.28	Memory 사업부	김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성	해당사항 없음	· 사업부 경영현황 파악 및 현장 답사
2022.11.30	Foundry 사업부	김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희	해당사항 없음	· 사업부 경영현황 파악 및 현장 답사

② 신임 사외이사 오리엔테이션

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2022.04.27	경영지원실	김준성	해당사항 없음	· 이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항
2022.11.28	경영지원실	허은녕, 유명희	해당사항 없음	· 이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항

※ 교육 참석 대상은 신임 사외이사입니다.

③ 사외이사 공통 교육

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2020.11.27	기획팀	박재완, 김선욱, 박병국, 김종훈, 안규리, 김한조	해당사항 없음	· 포스트 코로나 시대 환경변화와 중장기 전략

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 2022년말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 동 위원회 위원 중 재무전문가는 김한조 위원이며, 관련 법령의 경력 요건을 충족하고 있습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일)

성명	사외이사 여부	경력	회계・재무전문가 관련		
			해당 여부	전문가 유형	관련 경력
김한조	예	・하나금융나눔재단 이사장('22~현재) ・하나금융공익재단 이사장('19~'21) ・하나금융나눔재단 이사장('15~'19) ・㈜하나금융지주 부회장('15~'16) ・㈜한국외환은행 은행장('14~'15) ・외환캐피탈㈜ 사장('13~'14)	예	4호 유형 (금융기관・정부・ 증권유관기관 등 경력자)	・㈜하나금융지주 부회장('15~'16) ・㈜한국외환은행 은행장('14~'15) ・외환캐피탈㈜ 사장('13~'14) ・㈜한국외환은행 - 기업사업그룹장('12~'13) - 지점장('99~'02, '04~'05)
김선욱	예	・이화여대 법학전문대학원 명예교수('18~현재) ・이화여대 법학과(법학전문대학원) 교수('95~'18) ・이화여대 총장('10~'14) ・법제처 처장('05~'07)	-	-	-
김종훈	예	・Kiswe Mobile 공동 창업자 및 회장('13~현재) ・Alcatel-Lucent 최고전략책임자(CSO)('11~'13) ・Alcatel-Lucent Bell 연구소 사장('05~'13) ・University of Maryland 전기 및 컴퓨터공학과 교수 겸 기계공학과 교수('02~'13) ・Lucent Technologies 사장('98~'01) ・Yurie Systems 창업자, 회장 및 CEO('92~'98)	-	-	-

※ 전문가 유형은 기업공시서식 작성기준 및「상법 시행령」제37조 제2항에 따른 회계・재무전문가 유형입니다.

・4호 유형: 금융기관・정부・증권유관기관 등에서 회계・재무 관련 업무 또는 이에 대한 감독업무를 수행한 경력이 모두 5년 이상인지 여부

※ 공시대상 기간 중 박재완 사외이사가 퇴임하고 2022년 3월 16일 김종훈 사외이사가 위원으로 선임되었습니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한・책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회 위원 전원은 이사회의 추천을 받아 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성되어 있으며, 재무전문가(김한조 위원)와 법률전문가(김선욱 위원)를 선임하고 있습니다. 동 위원회 위원은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요 주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한, 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련 법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관련 법령 등
3명의 이사로 구성	충족(3명)	「상법」 제415조의2 제2항, 당사 감사위원회 규정 제2조
사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)	
위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김한조 위원)	「상법」 제542조의11 제2항, 당사 감사위원회 규정 제3조
감사위원회의 대표는 사외이사	충족(김한조 위원)	
그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	「상법」 제542조의11 제3항

(기준일 : 2022년 12월 31일)

성 명	임기 (연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	회사와의 관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계	타회사 겸직 현황
김한조 (위원장)	'19.03~'25.03 (1회)	재무전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	-
김선욱	'18.03~'24.03 (1회)	법률전문가로서 전문성과 행정, 재무, 대외협력 등 조직 운영에 대한 경험을 바탕으로 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	-
김종훈	'18.03~'24.03 (1회)	글로벌 경영인으로서 여러 기업을 투명하고 공정하게 운영한 경험을 바탕으로 독립적이고 객관적인 시각에서 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	Kiswe Mobile 회장 ('13년~현재)

※ 회사와의 관계, 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

감사위원회는 회계감사를 위해서 재무제표 등 회계 관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한, 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용합니다.

다. 감사위원회 주요 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명			
				박재완 (출석률: 100%)	김선욱 (출석률: 100%)	김한조 (출석률: 100%)	김종훈 (출석률: 100%)
				찬 반 여 부			
감사 위원회	'22.01.25	1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	해당 사항 없음 (신규 선임)
		2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	
		3. 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	-	-	-	-	
		4. 2021년(제53기) 재무제표 및 영업보고서 보고	-	-	-	-	
		5. 2021년 4분기 비감사업무 수행 검토 보고	-	-	-	-	
		6. 2021년 4분기 대외후원금 현황 보고	-	-	-	-	
		7. 2021년 감사실적 보고	-	-	-	-	
	'22.02.11	1. 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 심의	-	-	-	-	
		2. 내부회계관리규정 개정	가결	찬성	찬성	찬성	
		3. 2021년 내부감시장치 가동현황 보고	-	-	-	-	
	'22.04.26	1. 감사위원회 위원장 선임	가결	해당 사항 없음 (임기 만료)	찬성	찬성	찬성
		2. 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	-		-	-	-
		3. 2021년 외부감사 이행 평가 보고	-		-	-	-
		4. 지정 외부감사인과의 감사계약조건 결정	가결		찬성	찬성	찬성
		5. 2022년 1분기 보고서 보고	-		-	-	-
		6. 2022년 1분기 비감사업무 수행 검토 보고	-		-	-	-
		7. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고	-		-	-	-
		8. 2022년 1분기 대외후원금 현황 보고	-		-	-	-
		9. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가계획 보고	-		-	-	-
	'22.07.26	1. 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	-		-	-	-
		2. 2022년 반기 보고서 보고	-		-	-	-
		3. 2022년 2분기 비감사업무 수행 검토 보고	-		-	-	-
		4. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 중간보고	-		-	-	-
		5. 2022년 2분기 대외 후원금 현황 보고	-		-	-	-
		6. 2022년 상반기 감사실적 보고	-		-	-	-
		7. 외부감사인 선임규정 개정	가결		찬성	찬성	찬성
		8. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 중간보고	-		-	-	-
	'22.08.30	1. 임시주주총회 회의 목적사항 심의	-		-	-	-
	'22.10.25	1. 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	-		-	-	-
		2. 2022년 3분기 보고서 보고	-		-	-	-
		3. 2022년 3분기 비감사업무 수행 검토 보고	-		-	-	-

		4. 2022년 3분기 대외 후원금 현황 보고	-		-	-	-
	'22.10.27	1. 외부감사인 선임 준수사항 결정의 건	가결		찬성	찬성	찬성
		2. 외부감사인 선정 등 결정의 건	가결		찬성	찬성	찬성
		3. 2022년 퇴직연금 운용위원회 설치의 건	-		-	-	-

라. 감사위원회 교육 실시 계획

당사는 내부회계관리제도 업무지침에 따라 연 1회 이상 감사위원의 전문성 확보 등을 위해 외부전문가, 재경팀 및 감사팀이 주체가 되어 내부통제 변화사항, 내부회계관리제도 등에 대하여 별도의 교육을 실시하고 있습니다.

마. 감사위원회 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용
2020.07.28	외부전문가	박재완 김선욱 김한조	해당사항 없음	· 내부회계관리제도
2021.07.27	외부전문가	박재완 김선욱 김한조	해당사항 없음	· 내부회계관리제도
2022.05.25	재경팀, 외부전문가	김종훈	해당사항 없음	· 입문교육

바. 감사위원회 지원조직 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
감사팀	4	부사장 1명(3년), 직원(Principal Professional) 1명(5년), 직원(Senior Professional) 2명(평균 2년 5개월)	· 감사위원회 지원
내부회계 평가지원그룹	3	상무 1명(4년), 변호사 1명(1년 9개월) 직원(Senior Professional) 1명(1년 11개월)	· 내부회계관리제도 운영실태 평가 지원

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.

사. 준법지원인에 관한 사항

(기준일 : 2022년 12월 31일)

구 분		내 용
1. 인적사항 및 주요경력	성명	박정호
	출생연월	1971.09
	성별	남
	담당업무	삼성전자㈜ Compliance팀장('22.12~현재)
	주요경력	'04.05. : 삼성전자㈜ 경영지원실 인사팀 변호사 '14.12. : 삼성전자㈜ 법무실 법무팀 상무대우 '18.03. : 삼성전자㈜ DS부문 법무지원팀 상무대우 '20.01. : 삼성전자㈜ Compliance팀 상무대우 '22.12. : 삼성전자㈜ Compliance팀장 부사장대우
	학력	서울대 법학(학사) 미시간주립대 대학원 노사관계학(석사)
2. 이사회 결의일		2022.12.20
3. 결격요건		해당사항 없음
4. 기타		해당사항 없음

※ 준법지원인은 관련 법령「상법」제542조의13 제5항의 요건(변호사 자격)을 충족하고 있습니다.
※ 2022년 12월 20일 이사회 결의에 따라 박정호 Compliance팀장이 준법지원인으로 신규 선임되었습니다.

아. 준법지원인 등의 주요 활동 내역 및 그 처리 결과

당사는 국내외 사업장에서 정기・비정기적으로 준법 점검 활동을 수행하고 있으며, 점검 결과를 바탕으로 개선이 필요한 사안은 경영 활동에 반영하여 회사 및 임직원이제반 법규를 준수할 수 있도록 효과적인 준법 지원 활동을 하고 있습니다.

점검일시		점 검 내 용	점 검 분 야	점검 및 처리 결과
'22.1분기	'22.01.	비밀정보 관리현황 점검	영업비밀	・전반적으로 양호하며, 일부 개선 필요사항은 사내 정책 등에 따라 보완함
	'22.03.	국내외 제3자 생산 거래선 준법 점검	기술유출, 제조물책임 등	
'22.2분기	'22.04.	국내 개발조직 준법 점검	영업비밀, 기술유용 등	
	'22.06.	해외법인 자율 준법 점검	컴플라이언스 프로그램 운영 현황	
		해외 생산법인 준법 점검	기술유용, 반부패 등	
		해외 판매법인 준법 점검	공정거래, 영업비밀 등	
		국내외 제3자 생산 거래선 준법 점검	기술유출, 제조물책임 등	
'22.3분기	'22.07.	해외 판매법인 준법 점검	공정거래, 영업비밀 등	
		국내 영업조직 준법 점검	공정거래, 영업비밀 등	
	'22.08.	대외후원금 및 내부거래 리스크 점검	반부패, 공정거래	
	'22.09.	해외 생산법인 준법 점검	기술유용, 반부패 등	
		국내 개발조직 준법 점검	영업비밀	
		자회사 준법 점검	영업비밀, 개인정보 등	
		국내외 제3자 생산 거래선 준법 점검	기술유출, 제조물책임 등	
'22.4분기	'22.10.	대외후원금 및 내부거래 리스크 점검	반부패, 공정거래 등	
	'22.11.	특허출원 프로세스 정기점검	기술유용, 영업비밀 등	
		설비사 영업비밀 침해 리스크 점검	영업비밀	
	'22.12.	국내 개발조직 준법 점검	영업비밀	
		해외 생산법인 준법 점검	기술유용, 반부패 등	
		국내외 제3자 생산 거래선 준법 점검	기술유출, 제조물책임 등	

※ 점검시기는 각 분기별 종료월 기준입니다.

※ 각 점검은 일부 점검대상 조직을 선정하여 실시하였습니다.

자. 준법지원인 지원 조직 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
Compliance팀 등	69	상무 2명 (평균 7년 1개월) 직원(Principal Professional/Engineer) 15명(평균 8년 3개월), 변호사 11명(평균 4년 9개월), 직원(Senior Professional) 36명(평균 5년 2개월), 직원(Professional) 5명(평균 1년 10개월)	・준법지원인 주요 활동 지원

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 2022년말 현재 집중투표제와 서면투표제를 도입하지 않았으며,
2022년 3월 16일 제53기 정기주주총회 및 2022년 11월 3일 제54기 임시주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다. 당사 이사회는 2020년 1월 30일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 「상법」 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 당사는 2020년 3월 18일에 개최한 제51기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다. 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일)

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부	배제	미도입	도입
실시여부	-	-	제53기('21년도) 정기주주총회 제54기('22년도) 임시주주총회

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권

당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

2022년말 현재 당사의 발행주식총수는 보통주 5,969,782,550주, 우선주 822,886,700주입니다. 이 중 우선주는 의결권이 없으며, 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식(597,466,009주)을 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 5,372,316,541주입니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	5,969,782,550	-
	우선주	822,886,700	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-
	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	822,886,700	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	596,959,200	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 제한 (삼성생명보험㈜ 508,157,148주, 삼성화재해상보험㈜ 88,802,052주)
	보통주	506,809	「보험업법」에 의한 제한 (삼성생명보험㈜ 특별계정 일부)
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	5,372,316,541	-
	우선주	-	-

※ 단, '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에서,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의해 제한된 주식(596,959,200주) 중 일부는 임원의 선임 또는 해임 및 정관변경 등과 관련하여 의결권 행사가 가능합니다.

마. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의 내용	1. 이 회사가 발행할 신주의 주주인수에 관하여는 제8조 6항에서 정하는 바에 따라 그 소유주식수에 비례하여 신주를 배정하며, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정시 단수주가 발생 하였을 경우에는 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 이를 처리한다. 2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 ③ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ④ 제11조의 3에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ⑤ 제11조의 4에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ⑥ 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기술도입 등을 필요로 그 제휴회사에게 이사회 결의로 회사의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다. ☞ (주) 제8조 6항 이 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을, 우선주식에 대하여는 동일한 조건의 우선주식을 각 그 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 회사는 필요에 따라서 유상증자나 주식배당시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수도 있으며 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다. ☞ (주) 제11조의 3 (일반공모증자) 1. 이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제1항 제3호의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의하여 신주를 발행할 수 있다. 2. 일반공모증자방식에 의하여 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다. ☞ (주) 제11조의 4 (주식매수선택권) 1. 이 회사는 임・직원(「상법」 제542조의3 제1항에서 규정하는 관계회사의 임・직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 「상법」이 허용하는 한도내에서

	「상법」 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의로 부여할 수 있다. 다만, 관련 법령이 정하는 한도까지 임・직원(이 회사의 이사를 제외한다)에게 이사회 결의로써 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립・경영・해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임・직원으로 하되 관련 법령에서 주식매수선택권을 부여받을 수 없는 자로 규정한 임・직원은 제외한다. 3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식 또는 기명식 우선주식으로 한다. 4. 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총수는 관련 법령에서 허용하는 한도까지로 한다. 5. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 또는 이사회의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 8년이내에서 각 해당 주주총회 또는 해당 이사회의 결의로 정하는 행사만료일까지 행사할 수 있다. 단, 이 경우 주식매수선택권을 부여받은 자는 관련 법령이 정하는 경우를 제외하고는 본문의 규정에 의한 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 이를 행사할 수 있다. 6. 주식매수선택권의 내용, 행사가격 등 주식매수선택권의 조건은 관련 법령 및 정관이 정하는 바에 따라 주주총회의 특별결의 또는 이사회 결의로 정하되, 관련 법령 및 정관에서 주주총회 또는 이사회의 결의사항으로 규정하지 않은 사항은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회에서 결정할 수 있다. 7. 다음 각호에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. ① 임・직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우 ② 임・직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우 ③ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우
결 산 일	12월 31일
정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내
명의개서대리인	한국예탁결제원(051-519-1500): 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동)
주주의 특전	없음
공고 방법	중앙일보

※ 2019년 9월 16일「주식・사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법")시행으로,주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.

※ 당사는 정관에 의거 중앙일보에 공고하고 있으며, 당사 홈페이지(https://www.samsung.com/sec/ir)에도 게재하고 있습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2022년 12월 31일)

주총일자	안 건	결의내용
제54기 임시주주총회 (2022.11.03)	1. 사외이사 선임의 건 1-1호: 사외이사 허은녕 선임의 건 1-2호: 사외이사 유명희 선임의 건	 가결 가결
제53기 정기주주총회 (2022.03.16)	1. 제53기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 2-1호: 사외이사 선임의 건 2-1-1호: 사외이사 김한조 선임의 건 2-1-2호: 사외이사 한화진 선임의 건 2-1-3호: 사외이사 김준성 선임의 건 2-2호: 사내이사 선임의 건 2-2-1호: 사내이사 경계현 선임의 건 2-2-2호: 사내이사 노태문 선임의 건 2-2-3호: 사내이사 박학규 선임의 건 2-2-4호: 사내이사 이정배 선임의 건 2-3호: 감사위원회 위원 선임의 건 2-3-1호: 감사위원회 위원 김한조 선임의 건 2-3-2호: 감사위원회 위원 김종훈 선임의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결
제52기 정기주주총회 (2021.03.17)	1. 제52기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 2-1호: 사외이사 선임의 건 2-1-1호: 사외이사 박병국 선임의 건 2-1-2호: 사외이사 김종훈 선임의 건 2-2호: 사내이사 선임의 건 2-2-1호: 사내이사 김기남 선임의 건 2-2-2호: 사내이사 김현석 선임의 건 2-2-3호: 사내이사 고동진 선임의 건 3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김선욱 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결
제51기 정기주주총회 (2020.03.18)	1. 제51기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 2. 사내이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 한종희 선임의 건 2-2호: 사내이사 최윤호 선임의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건	가결 가결 가결 가결

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
삼성생명보험㈜	최대주주 본인	보통주	508,157,148	8.51	508,157,148	8.51	-
삼성생명보험㈜	최대주주 본인	우선주	43,950	0.01	43,950	0.01	-
삼성생명보험㈜(특별계정)	최대주주 본인	보통주	13,860,804	0.23	10,246,942	0.17	장내매매
삼성생명보험㈜(특별계정)	최대주주 본인	우선주	548,463	0.07	403,278	0.05	장내매매
삼성물산㈜	계열회사	보통주	298,818,100	5.01	298,818,100	5.01	-
삼성화재해상보험㈜	계열회사	보통주	88,802,052	1.49	88,802,052	1.49	-
삼성복지재단	출연 재단	보통주	4,484,150	0.08	4,484,150	0.08	-
삼성문화재단	출연 재단	보통주	1,880,750	0.03	1,880,750	0.03	-
홍라희	최대주주의 특수관계인	보통주	137,244,666	2.30	117,302,806	1.96	시간외매매
홍라희	최대주주의 특수관계인	우선주	206,633	0.03	206,633	0.03	-
이재용	최대주주의 특수관계인	보통주	97,414,196	1.63	97,414,196	1.63	-
이재용	최대주주의 특수관계인	우선주	137,757	0.02	137,757	0.02	-
이부진	계열회사 임원	보통주	55,394,044	0.93	55,394,044	0.93	-
이부진	계열회사 임원	우선주	137,755	0.02	137,755	0.02	-
이서현	최대주주의 특수관계인	보통주	55,394,044	0.93	55,394,044	0.93	-
이서현	최대주주의 특수관계인	우선주	137,755	0.02	137,755	0.02	-
한종희	계열회사 임원	보통주	5,000	0.00	15,000	0.00	장내매매
경계현	계열회사 임원	보통주	0	0.00	18,050	0.00	신규 선임
노태문	계열회사 임원	보통주	0	0.00	13,000	0.00	신규 선임
박학규	계열회사 임원	보통주	0	0.00	22,500	0.00	신규 선임
이정배	계열회사 임원	보통주	0	0.00	15,000	0.00	신규 선임
김한조	계열회사 임원	보통주	2,175	0.00	3,655	0.00	장내매매
김기남	계열회사 임원	보통주	210,000	0.00	0	0.00	이사 사임
김현석	계열회사 임원	보통주	99,750	0.00	0	0.00	이사 사임
고동진	계열회사 임원	보통주	75,000	0.00	0	0.00	이사 사임
안규리	계열회사 임원	보통주	3,800	0.00	0	0.00	이사 임기만료
박병국	계열회사 임원	보통주	1,000	0.00	0	0.00	이사 퇴임
계		보통주	1,261,846,679	21.14	1,237,981,437	20.74	-
		우선주	1,212,313	0.15	1,067,128	0.13	-

※ 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다. (단, 보통주 일부는 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한되어 있습니다.
자세한 현황은 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항' 중 '3. 주주총회 등에 관한 사항'의 '라. 의결권 현황'을 참고하시기 바랍니다.)

※ 2022년 12월 31일 기준입니다. 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)의 '임원・주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참고하십시오.

2. 최대주주 관련 사항

가. 최대주주의 개요

(1) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 기본정보

1) 법적・상업적 명칭: 삼성생명보험㈜ (Samsung Life Insurance Co., Ltd.)

2) 설립일자: 1957년 4월 24일

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지
주소: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)
전화번호: 1588-3114
홈페이지: www.samsunglife.com

4) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 대표이사・업무집행자・최대주주

(단위 : 명, %)

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
삼성생명보험㈜	100,800	전영묵	0.00	-	-	삼성물산㈜	19.34
		-	-	-	-	-	-

※ 2022년 12월 31일 보통주 기준입니다.

5) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 대표이사・업무집행자・최대주주의 변동내역

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2020.03.19	현성철	0.00	-	-	-	-
2020.03.19	전영묵	-	-	-	-	-
2020.03.23	전영묵	0.00	-	-	-	-
2020.03.24	전영묵	0.00	-	-	-	-
2021.03.16	전영묵	0.00	-	-	-	-
2021.04.29	-	-	-	-	이건희	-
2021.04.29	-	-	-	-	삼성물산㈜	19.34

※ 2020년 3월 19일 현성철 대표이사가 사임하고, 전영묵 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.
※ 2021년 4월 29일 최대주주(2020년 10월 25일 별세)가 소유하던 주식에 대한 상속으로 인하여 최대주주가 삼성물산㈜으로 변경되었습니다.

(2) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	삼성생명보험㈜
자산총계	316,165,903
부채총계	291,997,434
자본총계	24,168,469
매출액	40,330,993
영업이익	1,386,595
당기순이익	1,720,794

※ 재무현황은 2022년 12월 31일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

(3) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 사업현황 등

삼성생명보험㈜은 인보험 및 그와 관련된 재보험계약 등을 주요 영업목적으로 하는 생명보험회사로, 보험업법 및 기타 법령 등에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.
또한, 주요 종속기업인 삼성카드㈜는 여신전문금융업(신용카드업・시설대여업・할부금융업 등)을 영위하는 여신전문금융회사로, 여신전문금융업법 및 기타 관계법령에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

☞ 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시된 삼성생명보험㈜의 사업(분・반기)보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래

해당사항 없습니다.

다. 최대주주의 최대주주의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 기본정보

1) 법적・상업적 명칭: 삼성물산㈜ (Samsung C&T Corporation)

2) 설립일자 및 존속기간
1963년 12월 23일에 동화부동산주식회사로 시작하여, 2014년 7월 제일모직 주식회사로 사명을 변경하였습니다. 또한 1938년 3월 1일 설립된 삼성상회를 모태로 1951년 1월에 설립된 삼성물산주식회사와의 합병을 통하여 2015년 9월 2일(합병등기일) 삼성물산주식회사로 사명을 변경하였습니다.

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지
주소: 서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)
전화번호: 02-2145-5114
홈페이지: www.samsungcnt.com

4) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 대표이사・업무집행자・최대주주

(단위 : 명, %)

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
삼성물산㈜	174,953	고정석	0.00	-	-	이재용	18.13
		오세철	0.00	-	-	-	-
		한승환	0.00	-	-	-	-

※ 2022년 12월 31일, 보통주 기준입니다.

5) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 대표이사・업무집행자・최대주주의 변동내역

(단위 : %)

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2021.03.19	이영호	-	-	-	-	-
2021.03.19	정금용	-	-	-	-	-
2021.03.19	오세철	0.00	-	-	-	-
2021.03.19	한승환	0.00	-	-	-	-
2021.03.19	고정석	0.00	-	-	-	-
2021.04.29	-	-	-	-	이재용	18.13

※ 2021년 3월 19일 이영호, 정금용 대표이사가 사임하고, 오세철, 한승환 사내이사가 대표이사로 선임되었으며, 고정석 대표이사가 재선임되었습니다.

※ 2021년 4월 29일 상속(상속인: 이재용 외 3명)으로 인하여 최대주주의 지분율(보통주)이 변동(17.48%→18.13%)되었습니다.

(2) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	삼성물산㈜
자산총계	58,981,492
부채총계	27,017,371
자본총계	31,964,121
매출액	43,161,653
영업이익	2,528,524
당기순이익	2,544,957

※ 재무현황은 2022년 12월 31일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

(3) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 사업현황 등

삼성물산㈜은 국내외의 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하고 있는 건설부문과 자원개발, 철강, 화학, 산업소재, 섬유 등 다양한 방면에서 국제무역을 하고 있는 상사부문, 의류제품 제조, 판매사업과 모제품(직물)가공, 판매사업을 하는 패션부문, 조경사업과 에버랜드(드라이파크), 캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식, 식자재유통사업(삼성웰스토리)을 영위 운영하는 리조트부문, 바이오의약품 위탁생산사업 및 바이오시밀러 사업으로 구성되어 있습니다.

☞ 최대주주의 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시된 삼성물산㈜의 사업(분・반기)보고서를 참고하시기 바랍니다.

3. 최대주주 변동현황

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고
2021.04.29	삼성생명보험㈜	1,263,050,053	21.16	변동전 최대주주의 피상속	-

※ 소유주식수 및 지분율은 최대주주 및 그 특수관계인의 합산 내역이며,
의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다.

4. 주식의 분포 현황

가. 주식 소유 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	삼성생명보험㈜	518,404,090	8.68	특별계정 포함
	국민연금공단	449,387,577	7.53	-
	BlackRock Fund Advisors	300,391,061	5.03	2019년 1월 28일 기준
	삼성물산㈜	298,818,100	5.01	-
우리사주조합		-	-	-

※ 5% 이상 주주는 의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다.
자세한 현황은 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항' 중 '3. 주주총회 등에 관한 사항'의 '라. 의결권 현황 '을
참고하시기 바랍니다.
※ BlackRock Fund Advisors의 소유주식수 및 지분율은 2019년 2월 7일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에
공시된 '주식등의 대량보유상황보고서' 기준입니다.

나. 소액주주 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 주)

구 분	주주			소유주식			비 고
	소액 주주수	전체 주주수	비율 (%)	소액 주식수	총발행 주식수	비율 (%)	
소액주주	5,813,977	5,814,080	99.99	3,992,080,268	5,969,782,550	66.87	-

※ 소유주식은 의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다.
※ 소액주주는 총발행주식수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주 기준입니다.

5. 주가 및 주식거래실적

가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류			'22.07월	'22.08월	'22.09월	'22.10월	'22.11월	'22.12월
보통주	주가	최 고	61,900	61,700	58,400	59,500	62,900	62,600
		최 저	56,200	58,600	52,600	55,200	59,200	55,300
		평 균	59,548	60,273	55,595	56,711	61,091	59,081
	거래량	최고(일)	24,982,097	18,251,170	22,503,249	22,458,970	21,087,633	16,631,445
		최저(일)	6,597,211	5,767,902	7,503,086	11,456,060	6,677,933	6,756,411
		월 간	301,826,933	251,681,339	288,615,372	326,537,635	290,682,036	234,543,029
우선주	주가	최 고	57,000	56,500	53,700	53,600	58,000	56,200
		최 저	51,500	54,200	46,900	49,300	53,000	50,500
		평 균	54,614	55,364	50,788	51,642	55,677	53,600
	거래량	최고(일)	1,186,949	1,461,200	1,933,302	2,294,508	1,735,156	1,050,714
		최저(일)	403,293	400,765	457,773	673,346	414,256	371,155
		월 간	17,923,841	16,784,714	22,399,891	24,238,262	19,724,856	13,711,304

※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.

나. 해외증권시장

[증권거래소명 : 런던 증권거래소(보통주)] (단위 : US$, 원, DR)

종 류				'22.07월	'22.08월	'22.09월	'22.10월	'22.11월	'22.12월
보통주	주가	최고	US$	1,193.00	1,176.50	1,066.00	1,044.00	1,193.00	1,188.50
			₩환산	1,566,170	1,527,803	1,433,877	1,499,706	1,575,118	1,568,939
		최저	US$	1,067.50	1,075.00	907.00	930.20	1,033.00	1,101.50
			₩환산	1,385,508	1,448,778	1,302,906	1,334,651	1,464,794	1,397,143
		평균	US$	1,134.48	1,137.86	992.71	983.74	1,123.45	1,133.38
			₩환산	1,482,596	1,499,080	1,379,218	1,401,900	1,533,059	1,469,026
	거래량	최고(일)		22,992	23,926	18,880	40,134	28,096	19,921
		최저(일)		6,503	4,184	5,145	8,647	4,992	2,281
		월 간		253,038	241,613	251,472	434,156	278,312	238,590

※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.

※ 최고·최저 주가의 원화 환산은 해당 일자의 종가 원/달러 환율 기준이며, 평균 주가의 원화 환산은 월평균 원/달러 환율 기준입니다.

※ DR 1주당 원주 25주입니다.

[증권거래소명 : 룩셈부르크 증권거래소(우선주)] (단위 : US$, 원, DR)

종 류				'22.07월	'22.08월	'22.09월	'22.10월	'22.11월	'22.12월
우선주	주가	최고	US$	1,092.00	1,082.00	986.00	955.00	1,090.00	1,068.00
			₩환산	1,433,578	1,405,085	1,326,269	1,371,858	1,439,127	1,409,867
		최저	US$	979.00	992.00	821.00	824.00	928.00	998.00
			₩환산	1,270,644	1,336,918	1,177,971	1,182,275	1,315,904	1,265,863
		평균	US$	1,041.19	1,048.18	910.38	895.90	1,024.18	1,026.80
			₩환산	1,360,685	1,380,929	1,264,829	1,276,725	1,397,592	1,330,888
	거래량	최고(일)		3,429	12,020	4,845	4,688	4,141	4,125
		최저(일)		328	345	502	270	164	192
		월 간		19,559	31,347	39,750	24,646	26,804	26,944

※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.

※ 최고·최저 주가의 원화 환산은 해당 일자의 종가 원/달러 환율 기준이며, 평균 주가의 원화 환산은 월평균 원/달러 환율 기준입니다.

※ DR 1주당 원주 25주입니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 등기임원

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의관계	재직기간	임기만료일
								의결권있는 주식	의결권없는 주식			
한종희	남	1962.03	부회장	사내이사	상근	· 대표이사 (DX 부문 경영전반 총괄)	· 인하대 전자공학 학사 · 삼성전자 DX부문장	15,000	-	계열회사 임원	34개월	2023.03.17
경계현	남	1963.03	사장	사내이사	상근	· 대표이사 (DS 부문 경영전반 총괄)	· 서울대 제어계측공학 박사 · 삼성전자 DS부문장	18,050	-	계열회사 임원	10개월	2025.03.15
노태문	남	1968.09	사장	사내이사	상근	· MX사업부장	· 포항공대 전자전기공학 박사 · 삼성전자 MX사업부장	13,000	-	계열회사 임원	10개월	2025.03.15
박학규	남	1964.11	사장	사내이사	상근	· CFO	· KAIST 경영학 석사 · 삼성전자 경영지원실장	22,500	-	계열회사 임원	10개월	2025.03.15
이정배	남	1967.02	사장	사내이사	상근	· 메모리사업부장	· 서울대 전자공학 박사 · 삼성전자 메모리사업부장	15,000	-	계열회사 임원	10개월	2025.03.15
김한조	남	1956.07	이사	사외이사	비상근	· 이사회 의장 · 감사위원회 위원장 · 내부거래위원회 위원 · 보상위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원장	· 연세대 불어불문학 학사 · 하나금융나눔재단 이사장	3,655	-	계열회사 임원	46개월	2025.03.19
김선욱	여	1952.12	이사	사외이사	비상근	· 감사위원회 위원 · 내부거래위원회 위원장 · 사외이사후보추천위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원	· Konstanz대 법학 박사 · 이화여대 명예교수	-	-	계열회사 임원	58개월	2024.03.22
김종훈	남	1960.08	이사	사외이사	비상근	· 감사위원회 위원 · 내부거래위원회 위원 · 보상위원회 위원 · 사외이사후보추천위원회 위원장 · 지속가능경영위원회 위원	· Maryland대 신뢰성공학 박사 · Kiswe Mobile 회장	-	-	계열회사 임원	58개월	2024.03.22
김준성	남	1967.10	이사	사외이사	비상근	· 보상위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원	· Carnegie Mellon대 경제학/산업공학 학사 · 싱가포르투자청 토탈리턴그룹 이사	-	-	계열회사 임원	10개월	2025.03.15
허은녕	남	1964.08	이사	사외이사	비상근	· 지속가능경영위원회 위원	· Pennsylvania State대 자원경제학 박사 · 서울대 공과대학 교수	-	-	계열회사 임원	2개월	2025.11.02
유명희	여	1967.06	이사	사외이사	비상근	· 지속가능경영위원회 위원	· Vanderbilt대 법학 박사 · 서울대 국제대학원 객원교수	-	-	계열회사 임원	2개월	2025.11.02

※ 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 등기임원 소유주식수는 작성기준일 현재 기준이며, 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)의 '임원・주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참고하십시오.

※ 2022년 2월 15일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 대표이사직에서 사임하였으며, 동일 개최한 이사회에서 한종희 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

※ 2022년 3월 16일 주주총회를 통해 경계현, 노태문, 박학규, 이정배 사내이사와 한화진, 김준성 사외이사가 신규 선임되었고, 김한조 사외이사가 재선임되었습니다.

※ 2022년 3월 16일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 사임하였습니다.

※ 2022년 3월 16일 이사회를 통해 경계현 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

※ 2022년 3월 19일 박재완, 안규리 사외이사의 임기가 만료되었습니다.

※ 2022년 4월 20일 한화진 사외이사가 사임하였습니다.

※ 2022년 5월 17일 박병국 사외이사가 퇴임하였습니다.

※ 2022년 11월 3일 주주총회를 통해 허은녕, 유명희 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일)

구분	성명	성별	출생년월	사외이사 후보자 해당여부	주요경력	선・해임 예정일	최대주주와의 관계
선임	한종희	남	1962.03	사내이사	・인하대 전자공학 학사 ・삼성전자 영상디스플레이사업부 상품개발팀장 ・삼성전자 영상디스플레이사업부 개발실장 ・삼성전자 영상디스플레이사업부 개발팀장 ・삼성전자 영상디스플레이사업부장 ・삼성전자 DX부문장 ・삼성전자 대표이사 사장 ・삼성전자 대표이사 부회장 ・삼성전자 생활가전사업부장	2023.03.15	계열회사 임원

※ 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제54기 정기주주총회의 안건으로,
향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

※ 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

다. 등기임원의 타회사 임원겸직 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일)

겸 직 자		겸 직 회 사		
성 명	직 위	기업명	직 위	재임 기간
김종훈	사외이사	Kiswe Mobile	회장	2013년~현재
유명희	사외이사	현대건설기계	사외이사	2022년~현재

라. 미등기임원 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 개월)

성명	성별	출생 연월	직위	상근 여부	담당업무	주요경력	학력	최대주주와의 관계	재직 기간
김기남	남	1958.04	회장	상근	SAIT 회장	DS부문장	Univ. of California, LA(박사)	계열회사 임원	
이재용	남	1968.06	회장	상근	회장	COO	Harvard Univ.(박사수료)	최대주주의 특수관계인	
정현호	남	1960.03	부회장	상근	사업지원T/F장	디지털이미징사업부장	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
강인엽	남	1963.07	사장	상근	미주담당 사장	System LSI사업부장	Univ. of California, LA(박사)	계열회사 임원	
김수목	남	1964.05	사장	상근	법무실장	법무실 송무팀장	서울대(학사)	계열회사 임원	28
김우준	남	1968.05	사장	상근	네트워크사업부장	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
남석우	남	1966.03	사장	상근	제조담당	글로벌인프라총괄	연세대(박사)	계열회사 임원	
박승희	남	1964.08	사장	상근	Corporate Relations담당	삼성물산 건설부문 커뮤니케이션팀장	건국대(석사)	계열회사 임원	1
박용인	남	1964.04	사장	상근	System LSI사업부장	System LSI 전략마케팅실장	연세대(석사)	계열회사 임원	
백수현	남	1963.01	사장	상근	커뮤니케이션팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
송재혁	남	1967.08	사장	상근	DS부문 CTO, 반도체연구소장	메모리 Flash개발실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
승현준	남	1966.06	사장	상근	Samsung Research 글로벌 R&D협력담당	Samsung Research 담당임원	Harvard Univ.(박사)	계열회사 임원	55
양걸	남	1962.10	사장	상근	중국전략협력실장	DS부문 중국총괄	서강대(석사)	계열회사 임원	
이영희	여	1964.11	사장	상근	글로벌마케팅실장	무선 마케팅팀장	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
이원진	남	1967.08	사장	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀장	영상디스플레이 Service Business팀장	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
전경훈	남	1962.12	사장	상근	DX부문 CTO	네트워크사업부장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	
진교영	남	1962.08	사장	상근	SAIT 원장	메모리사업부장	서울대(박사)	계열회사 임원	
최경식	남	1962.03	사장	상근	북미총괄	무선 전략마케팅실장	한양대(석사)	계열회사 임원	
최시영	남	1964.01	사장	상근	Foundry사업부장	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터장	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	
한승환	남	1964.07	사장	상근	의료사업일류화추진단장	삼성물산 리조트부문 대표이사	서울대(학사)	계열회사 임원	1
강문수	남	1969.08	부사장	상근	AVP사업팀장	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	42

강봉구	남	1962.02	부사장	상근	한국총괄	생활가전 전략마케팅팀장	홍익대(학사)	계열회사 임원	
강성철	남	1967.08	부사장	상근	Samsung Research Robot센터장	무선 개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	45
계종욱	남	1966.10	부사장	상근	Foundry Design Platform개발실장	Foundry Design Platform개발실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
고대곤	남	1965.03	부사장	상근	SEPM법인장	SIEL-P(C)법인장	아주대(학사)	계열회사 임원	
고봉준	남	1972.01	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	Stanford Univ., Research Fellow	Columbia Univ.(박사)	계열회사 임원	34
고승환	남	1962.09	부사장	상근	영상디스플레이 구매팀장	생활가전 구매팀장	인하대(학사)	계열회사 임원	
고재윤	남	1973.01	부사장	상근	지원팀 담당임원	경영혁신팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
고재필	남	1970.03	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	메모리 인사팀장	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
고형종	남	1970.11	부사장	상근	메모리 Design Platform개발실장	메모리 Design Platform개발실 담당임원	Univ. of Florida(박사)	계열회사 임원	
곽성웅	남	1965.05	부사장	상근	System LSI Design Platform개발팀장	System LSI Security&Power제품개발팀장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	49
곽연봉	남	1967.03	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
구본영	남	1967.05	부사장	상근	SAS법인장	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
구자흠	남	1968.01	부사장	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	North Carolina State Univ.(박사)	계열회사 임원	
권상덕	남	1967.03	부사장	상근	반도체연구소 Logic TD실장	반도체연구소 Logic TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
권오상	남	1967.04	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
권태훈	남	1968.02	부사장	상근	재경팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당임원	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	
권환준	남	1971.09	부사장	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	Qualcomm, Sr. Director	Univ. of California, San Diego(박사)	계열회사 임원	10
김강태	남	1972.10	부사장	상근	Samsung Research 기술전략팀장	Samsung Research SE팀장	중앙대(박사)	계열회사 임원	
김경진	남	1963.11	부사장	상근	DX부문 CSO, Global EHS센터장	영상디스플레이 Global제조팀장	숭실대(학사)	계열회사 임원	
김경환	남	1970.06	부사장	상근	법무실 법무팀장	법무실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	38
김경희	여	1969.07	부사장	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Moda Operandi, CMO	Yale Univ.(석사)	계열회사 임원	52
김기훈	남	1968.05	부사장	상근	지원팀 담당임원	구주총괄 지원팀장	Univ. of Baltimore(석사)	계열회사 임원	
김대주	남	1969.10	부사장	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	서남아총괄 지원팀장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
김대현	남	1974.06	부사장	상근	Samsung Research NPU Lab장	Samsung Research Platform팀 담당임원	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	

김도현	남	1975.03	부사장	상근	DS부문 법무지원팀장	DS부문 법무지원팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
김도형	남	1964.10	부사장	상근	구주총괄 대외협력팀장	삼성물산 법무팀장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	36
김동관	남	1969.10	부사장	상근	DS부문 정보보호센터장	삼성SDS 정보보호센터장	한양대(학사)	계열회사 임원	13
김동욱	남	1968.10	부사장	상근	재경팀장	재경팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
김두일	남	1971.07	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Samsung Research Platform팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	
김만영	남	1969.07	부사장	상근	SEG법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	Boston Univ.(학사)	계열회사 임원	
김명철	남	1968.09	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	반도체연구소 공정개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김민구	남	1964.08	부사장	상근	System LSI CP개발실장	System LSI SOC개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김병도	남	1967.03	부사장	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	글로벌마케팅센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
김보현	남	1973.02	부사장	상근	메모리 People팀장	Samsung Research 인사팀장	서강대(석사)	계열회사 임원	
김사필	남	1965.04	부사장	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당임원	경찰대(학사)	계열회사 임원	
김선식	남	1964.06	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	메모리 인사팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	
김성욱	남	1968.06	부사장	상근	한국총괄 e-Commerce팀장	인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김성윤	남	1966.10	부사장	상근	법무실 IP센터 담당임원	IP센터 책임변호사	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
김세윤	남	1973.06	부사장	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	감사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김세호	남	1967.10	부사장	상근	SEI법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	동국대(학사)	계열회사 임원	
김수진	여	1969.08	부사장	상근	지속가능경영추진센터장	Global Public Affairs팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(박사)	계열회사 임원	
김연성	남	1966.05	부사장	상근	생활가전 지원팀 담당임원	한국총괄 지원팀장	MIT(석사)	계열회사 임원	
김영집	남	1971.03	부사장	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김영호	남	1964.12	부사장	상근	수원지원센터장	생활가전 지원팀 담당임원	Tulane Univ.(석사)	계열회사 임원	
김용관	남	1963.12	부사장	상근	의료기기사업부장	의료기기 전략지원담당	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	
김용국	남	1968.01	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성바이오에피스 생산본부 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	18
김용재	남	1972.03	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀 副팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
김용주	남	1970.08	부사장	상근	Foundry 지원팀장	삼성SDI 중대형사업부 지원팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	13

김우평	남	1970.05	부사장	상근	DSRA-AVP 연구소장	TSP총괄 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	6
김원경	남	1967.08	부사장	상근	Global Public Affairs팀장	북미총괄 대외협력팀장	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	
김유석	남	1965.04	부사장	상근	법무실 IP센터장	법무실 IP센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김은중	남	1965.06	부사장	상근	AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원	TSP총괄 GPO팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
김이수	남	1973.03	부사장	상근	SIEL-P(N)공장장	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	아주대(학사)	계열회사 임원	
김이태	남	1966.02	부사장	상근	상생협력센터 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	Univ. of Missouri, Columbia(박사)	계열회사 임원	
김인식	남	1967.09	부사장	상근	재경팀 담당임원	삼성SDS 전략기획담당 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	55
김장경	남	1973.05	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	
김재묵	남	1965.05	부사장	상근	생활가전 구매팀 담당임원	상생협력센터 상생협력팀장	국민대(학사)	계열회사 임원	
김재열	남	1965.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
김재윤	남	1963.03	부사장	상근	기획팀장	삼성경제연구소 산업전략1실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
김재준	남	1968.01	부사장	상근	메모리 전략마케팅실장	DS부문 미주총괄 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
김재훈	남	1967.01	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SELA법인장	서울대(석사)	계열회사 임원	
김정식	남	1970.08	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	
김정현	남	1975.06	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 기획팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
김종헌	남	1966.08	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 People팀장	Foundry 인사팀장	육사(학사)	계열회사 임원	
김주년	남	1969.12	부사장	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터장	Mobile eXperience 개발실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	
김준	남	1964.02	부사장	상근	SAIT Air Science Research Center 담당임원	종합기술원 미세먼지연구소장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	24
김준석	남	1969.04	부사장	상근	System LSI CP개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
김진수	남	1971.10	부사장	상근	디자인경영센터 副센터장	무선 디자인팀 담당임원	국민대(학사)	계열회사 임원	
김찬우	남	1976.04	부사장	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Samsung Research AI센터 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	59
김창업	남	1969.08	부사장	상근	SEDA-S판매부문장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
김철기	남	1968.03	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
김태훈	남	1969.04	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	

김학상	남	1966.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Univ. of Massachusetts, Lowell(박사)	계열회사 임원	
김한석	남	1968.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
김현도	남	1966.04	부사장	상근	Mobile eXperience 구미지원센터장	생활가전 광주지원센터장	연세대(석사)	계열회사 임원	
김현우	남	1970.02	부사장	상근	반도체연구소 기술기획팀장	반도체연구소 공정개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김형섭	남	1966.01	부사장	상근	DS부문 CTO 담당임원	반도체연구소장	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
김홍경	남	1965.11	부사장	상근	DS부문 경영지원실장	DS부문 경영지원실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김홍식	남	1969.09	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
나기홍	남	1966.03	부사장	상근	People팀장	인사팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
노원일	남	1967.08	부사장	상근	SRA연구소장	네트워크 상품전략팀장	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
다니엘리	남	1969.12	부사장	상근	Samsung Research Global AI센터장	SRA 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	55
다니엘오	남	1974.03	부사장	상근	IR팀 副팀장	Morrow Sodali, Managing Director	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	11
더못라이언	남	1962.09	부사장	상근	DS부문 DSE총괄	DS부문 구주총괄 담당임원	Limerick Regional Technical Coll.(학사)	계열회사 임원	
데이브다스	남	1975.06	부사장	상근	SEIB법인장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
데이빗리	남	1969.07	부사장	상근	Samsung NEXT장	Refactor Capital, Co-founder	New York Univ.(석사)	계열회사 임원	23
도현호	남	1967.10	부사장	상근	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	Applied Materials, Managing Director	서울대(박사)	계열회사 임원	10
디페쉬	남	1969.06	부사장	상근	SRI-Bangalore연구소장	SRI-Bangalore 副연구소장	Indian Inst. of Management, Bangalore(석사)	계열회사 임원	
마크리퍼트	남	1973.02	부사장	상근	북미총괄 대외협력팀장	YouTube, APAC 대외협력총괄	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	10
메노	남	1968.06	부사장	상근	SEF법인장	SEBN법인장	Haarlem Business School(학사)	계열회사 임원	
명호석	남	1967.04	부사장	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	SEA 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
문성우	남	1971.12	부사장	상근	경영혁신센터장	경영혁신센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
문성훈	남	1974.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당부장	경북대(박사)	계열회사 임원	49
문승도	남	1968.10	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	
문종승	남	1971.08	부사장	상근	생산기술연구소장	SEDA-P(M) 공장장	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	

문준	남	1974.06	부사장	상근	네트워크 개발팀장	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
문창록	남	1971.01	부사장	상근	반도체연구소 CIS TD팀장	System LSI Sensor사업팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
문희동	남	1971.07	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	종합기술원 인사팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	
민종술	남	1968.03	부사장	상근	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
바우만	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEUK법인장	Univ. of Bath(석사)	계열회사 임원	
박건태	남	1969.09	부사장	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	감사팀 담당부장	Univ. of Colorado, Boulder(석사)	계열회사 임원	
박길재	남	1966.04	부사장	상근	Global CS센터장	Mobile eXperience 품질혁신센터장	연세대(석사)	계열회사 임원	
박문호	남	1965.01	부사장	상근	People팀 담당임원	경영진단팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
박성선	남	1965.08	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	충남대(학사)	계열회사 임원	
박성욱	남	1972.04	부사장	상근	SCS법인장	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	49
박성준	남	1971.01	부사장	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	종합기술원 Material연구센터 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
박성호	남	1968.09	부사장	상근	SEVT법인장	SIEL-P(N)공장장	경북대(석사)	계열회사 임원	
박수남	남	1970.10	부사장	상근	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	생산기술연구소 설비개발실 담당임원	Univ. of Minnesota, Minneapolis(박사)	계열회사 임원	48
박순철	남	1966.07	부사장	상근	Mobile eXperience 지원팀장	사업지원T/F 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	
박정민	남	1972.03	부사장	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 副팀장	Virginia Tech, 교수	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	24
박정호	남	1971.09	부사장	상근	Compliance팀장	Compliance팀 담당임원	Michigan State Univ.(석사)	계열회사 임원	
박정훈	남	1969.10	부사장	상근	Samsung Research Visual Technology팀장	Samsung Research Media Research팀장	한양대(석사)	계열회사 임원	
박제민	남	1971.12	부사장	상근	반도체연구소 DRAM TD실장	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	49
박종범	남	1969.02	부사장	상근	서남아총괄	SIEL-S 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
박지선	남	1974.09	부사장	상근	SRA 담당임원	무선 개발실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	49
박진영	여	1971.11	부사장	상근	DS부문 구매팀장	DS부문 구매팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
박찬우	남	1973.05	부사장	상근	생활가전 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
박찬익	남	1972.04	부사장	상근	DS부문 DSA 담당임원	메모리 기획팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
박찬훈	남	1962.04	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 담당임원	電氣通信大學(박사)	계열회사 임원	

박철우	남	1971.10	부사장	상근	영상디스플레이 Customer Marketing팀장	Mattel, SVP	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	41
박현정	남	1969.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
박형원	남	1966.09	부사장	상근	System LSI Global Operation실장	System LSI 품질팀장	한양대(석사)	계열회사 임원	
박훈종	남	1967.08	부사장	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	한국총괄 모바일영업팀 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
반효동	남	1967.06	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
배광진	남	1968.02	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	금오공대(학사)	계열회사 임원	
배상우	남	1970.10	부사장	상근	메모리 품질실장	메모리 품질보증실 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
배용철	남	1970.05	부사장	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	Harvard Univ.(박사수료)	계열회사 임원	
서병훈	남	1963.07	부사장	상근	IR팀장	IR팀 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	49
서한석	남	1968.02	부사장	상근	SEA 담당임원	SEDA-S판매부문장	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
서행룡	남	1967.09	부사장	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	
서형석	남	1968.02	부사장	상근	DS부문 DSC총괄	메모리 전략마케팅실 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
성일경	남	1964.01	부사장	상근	구주총괄	영상디스플레이 영상전략마케팅팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	
손성원	남	1969.02	부사장	상근	북미총괄 지원팀장	무선 지원팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
손영수	남	1974.02	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
송기환	남	1970.07	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	
송두근	남	1968.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터장	글로벌 제조&인프라총괄 글로벌환경안전/인프라센터장	아주대(박사수료)	계열회사 임원	
송명주	여	1970.02	부사장	상근	TSE-S법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
송병무	남	1973.08	부사장	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Intel, Yield Group Manager	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	
송승엽	남	1968.08	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터장	TSP총괄 TP센터 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
송용호	남	1967.04	부사장	상근	메모리 Solution개발실장	메모리 Solution개발실 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	45
송원득	남	1964.01	부사장	상근	DS부문 IP팀장	법무실 IP센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
송철섭	남	1967.12	부사장	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
송호건	남	1966.01	부사장	상근	TSP총괄 Package개발실장	TSP총괄 TP센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	

신경섭	남	1968.09	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	반도체연구소 공정개발실 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	
신명훈	남	1965.01	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
신승원	남	1974.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	KAIST, 교수	Texas A&M Univ.(박사)	계열회사 임원	24
신승철	남	1973.04	부사장	상근	DS부문 DSSEA총괄	Foundry Corporate Planning실 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	
신승혁	남	1968.01	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Samsung Research IP출원팀장	Polytechnic Univ. of NY(박사)	계열회사 임원	
신영주	남	1969.09	부사장	상근	DS부문 구매팀 담당임원	메모리제조기술센터 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
신유균	남	1965.02	부사장	상근	반도체연구소 차세대연구실장	반도체연구소 공정개발실장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
신종신	남	1973.12	부사장	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
심상필	남	1965.05	부사장	상근	Foundry Corporate Planning실장	Foundry 전략마케팅실장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
심은수	남	1966.10	부사장	상근	SAIT System Research Center장	DIT센터장	Columbia Univ.(박사)	계열회사 임원	
안길준	남	1969.01	부사장	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터장	무선 개발실 담당임원	George Mason Univ.(박사)	계열회사 임원	
안상호	남	1965.03	부사장	상근	SESS법인장	TSP총괄 TP센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
안수진	여	1969.12	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
안용일	남	1971.02	부사장	상근	CX·MDE센터 담당임원	디자인경영센터 담당임원	서강대(박사)	계열회사 임원	
안장혁	남	1967.12	부사장	상근	네트워크 지원팀장	SEVT 담당임원	육사(학사)	계열회사 임원	
안재용	남	1968.08	부사장	상근	DS부문 감사팀 담당임원	DS부문 상생협력센터 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
안정착	남	1970.12	부사장	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	반도체연구소 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
양세영	남	1975.08	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Apple, Engineering Manager	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
양장규	남	1963.09	부사장	상근	설비기술연구소장	생산기술연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
양준호	남	1971.02	부사장	상근	생활가전 디자인팀장	Mobile eXperience CX실 담당임원	세종대(학사)	계열회사 임원	
양태종	남	1970.11	부사장	상근	Mobile eXperience Digital Health팀 담당임원	United Health Group, SVP	Arizona State Univ.(석사)	계열회사 임원	34
양혜순	여	1968.02	부사장	상근	생활가전 Global CS팀장	생활가전 상품전략팀장	Michigan State Univ.(박사)	계열회사 임원	
엄대현	남	1966.03	부사장	상근	법무실 송무팀장	법무실 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	49
엄재훈	남	1966.06	부사장	상근	DS부문 DS대외협력팀장	DS부문 상생협력센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	

여명구	남	1970.10	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	조직문화개선T/F 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
여형민	남	1971.06	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성SDS 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	49
오문욱	남	1974.02	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	
오정석	남	1970.03	부사장	상근	TSP총괄 지원팀장	System LSI 지원팀장	淸華大(석사)	계열회사 임원	
오종훈	남	1969.10	부사장	상근	메모리 지원팀장	DS부문 미주총괄 담당임원	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
오치오	남	1967.01	부사장	상근	한국총괄 B2B팀장	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	건국대(석사)	계열회사 임원	
오태영	남	1974.10	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
오화석	남	1972.02	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
왕통	남	1962.06	부사장	상근	중국전략협력실 담당임원	SCIC 담당임원	北京郵電大(학사)	계열회사 임원	
용석우	남	1970.09	부사장	상근	영상디스플레이 副사업부장	영상디스플레이 개발팀장	Polytechnic Univ. of NY(석사)	계열회사 임원	
우영돈	남	1974.01	부사장	상근	법무실 담당임원	무선 지원팀 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
원성근	남	1968.05	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
원순재	남	1972.01	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	
원종현	남	1967.05	부사장	상근	영상디스플레이 지원팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
위훈	남	1970.04	부사장	상근	생활가전 선행개발팀장	생활가전 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
유규태	남	1975.02	부사장	상근	의료기기 전략마케팅팀장	삼성메디슨 전략마케팅팀장	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	1
유미영	여	1968.07	부사장	상근	생활가전 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	포항공대(석사)	계열회사 임원	
유병길	남	1970.09	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Mobile eXperience 전략기획팀장	Univ. of Virginia(석사)	계열회사 임원	
유승호	남	1968.06	부사장	상근	지원팀 담당임원	생활가전 지원팀 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	
유창식	남	1969.12	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	한양대, 교수	서울대(박사)	계열회사 임원	26
윤석민	남	1971.02	부사장	상근	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	LAM Research, Sr.Director	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	9
윤세승	남	1965.12	부사장	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Qulcomm, Senior Director	연세대(학사)	계열회사 임원	8
윤인수	남	1974.11	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
윤장현	남	1968.12	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	

윤종덕	남	1969.04	부사장	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	
윤종식	남	1961.09	부사장	상근	Foundry CTO	Foundry 기술개발실장	Univ. of California, LA(박사)	계열회사 임원	
윤준오	남	1967.06	부사장	상근	기획팀 담당임원	네트워크 기획팀장	건국대(학사)	계열회사 임원	
윤철운	남	1962.11	부사장	상근	SEHC법인장	영상디스플레이 Global운영팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
윤태양	남	1968.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터장	고려대(석사)	계열회사 임원	
이경우	남	1969.04	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 수석	한양대(박사)	계열회사 임원	
이계성	남	1967.11	부사장	상근	법무실 해외법무팀장	구주총괄 대외협력팀장	St. Louis Univ.(석사)	계열회사 임원	
이광렬	남	1969.02	부사장	상근	영상디스플레이 Global CS팀장	Global CS센터 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
이광헌	남	1971.06	부사장	상근	Mobile eXperience People팀장	인사팀 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	
이규열	남	1966.05	부사장	상근	TSP총괄	TSP총괄 TP센터장	항공대(학사)	계열회사 임원	
이규필	남	1961.05	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	반도체연구소 메모리TD실장	Univ. of Florida(박사)	계열회사 임원	
이규호	남	1969.06	부사장	상근	People팀 담당임원	영상디스플레이 인사팀장	서강대(학사)	계열회사 임원	
이근호	남	1970.02	부사장	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이금주	여	1971.09	부사장	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	중앙대(석사)	계열회사 임원	
이동근	남	1971.08	부사장	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	한양대(박사)	계열회사 임원	49
이동기	남	1969.05	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	Univ. of California, San Diego(박사)	계열회사 임원	
이동우	남	1967.06	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	메모리 지원팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	
이무형	남	1970.02	부사장	상근	생활가전 개발팀장	생활가전 개발팀 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
이병국	남	1965.11	부사장	상근	Mobile eXperience Global제조센터장	SEVT법인장	부산대(학사)	계열회사 임원	
이상도	남	1969.03	부사장	상근	SEA 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	City Univ. of New York(석사)	계열회사 임원	
이상우	남	1972.11	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	
이상원	남	1971.07	부사장	상근	서남아총괄 지원팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
이상재	남	1965.12	부사장	상근	TSP총괄 품질팀장	TSP총괄 TP센터 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	
이상주	남	1970.09	부사장	상근	구주총괄 대외협력팀장	법무실 담당임원	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	

이상현	남	1966.05	부사장	상근	Foundry사업부 담당임원	Foundry Design Platform개발실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
이상훈	남	1973.04	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	Intel, Sr. Principal Engineer	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	5
이석원	남	1970.07	부사장	상근	설비기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이석준	남	1965.07	부사장	상근	System LSI AP개발실장	System LSI SOC개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이성수	남	1964.11	부사장	상근	DS부문 감사팀장	메모리 품질보증실 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
이성현	남	1966.07	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SGE법인장	홍익대(학사)	계열회사 임원	
이승구	남	1969.08	부사장	상근	People팀 담당임원	SEG 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
이승욱	남	1967.02	부사장	상근	전장사업팀장	사업지원T/F 담당임원	Univ. of Akron(박사)	계열회사 임원	
이시영	남	1972.04	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Univ. of Sussex(석사)	계열회사 임원	
이양우	남	1972.02	부사장	상근	영상디스플레이 담당임원	KNOWCK, 공동대표	Univ. of Colorado(석사)	계열회사 임원	22
이영수	남	1972.01	부사장	상근	SEVT 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이영호	남	1967.07	부사장	상근	중국사업혁신팀장	무선 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Maryland, College Park(석사)	계열회사 임원	
이왕익	남	1963.07	부사장	상근	재경팀 담당임원	삼성생명 지원팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
이우섭	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience 구매팀장	무선 구매팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
이원준	남	1970.02	부사장	상근	재경팀 담당임원	중동총괄 지원팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	
이일환	남	1973.09	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Mercedez-Benz, CDO of China	Art Center College Of Design(학사)	계열회사 임원	1
이재범	남	1970.10	부사장	상근	영상디스플레이 기획팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	
이재열	남	1970.01	부사장	상근	System LSI LSI개발실장	System LSI LSI개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	49
이정원	남	1977.04	부사장	상근	System LSI CP개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	24
이제현	남	1970.04	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성디스플레이 경영지원실 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
이종명	남	1970.03	부사장	상근	반도체연구소 공정개발실장	반도체연구소 공정개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이종민	남	1971.09	부사장	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	무선 기획팀 담당임원	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	
이종열	남	1970.02	부사장	상근	혁신센터장	메모리 Solution개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이종철	남	1968.01	부사장	상근	법무실 담당임원	Compliance팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	

이주영	남	1966.07	부사장	상근	메모리 DRAM개발실장	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	Univ. of California, LA(박사)	계열회사 임원	
이준현	남	1965.05	부사장	상근	Samsung Research 차세대가전연구팀장	생활가전 선행개발팀장	Univ. of Cincinnati(박사)	계열회사 임원	
이준화	남	1972.03	부사장	상근	생활가전 CX팀장	생활가전 개발팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
이준희	남	1969.03	부사장	상근	네트워크 전략마케팅팀장	네트워크 개발팀장	MIT(박사)	계열회사 임원	
이지별	남	1971.03	부사장	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	Meta, Creative Director	Parsons School of Design(학사)	계열회사 임원	5
이진엽	남	1970.02	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서강대(석사)	계열회사 임원	
이창수	남	1971.07	부사장	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
이청용	남	1968.12	부사장	상근	SAVINA-S법인장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	
이충순	남	1967.09	부사장	상근	CIS총괄	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
이태관	남	1971.12	부사장	상근	법무실 담당임원	삼성물산 법무팀 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
이학민	남	1972.04	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	네트워크 지원팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	
이해창	남	1975.10	부사장	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	Google, Sensor Team Lead	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	27
이헌	남	1969.02	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	TSE-S법인장	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	
이헌	남	1971.01	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEF 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
이흥모	남	1962.10	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Samsung Research IP출원팀장	Franklin Pierce Law Center(석사)	계열회사 임원	
임건	남	1970.03	부사장	상근	반도체연구소 Logic TD실 담당임원	Qualcomm, Sr. Director Engineer	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	34
임근휘	남	1973.05	부사장	상근	Big Data센터 담당임원	Samsung Research AI센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	55
임병일	남	1970.01	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성증권 기업금융1본부장	Univ. of Chicago(석사)	계열회사 임원	13
임석환	남	1974.11	부사장	상근	DSRA-S.LSI 연구소장	System LSI 기반설계실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	48
임성택	남	1966.06	부사장	상근	중동총괄	SEI법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	
임용식	남	1971.01	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
임준서	남	1968.08	부사장	상근	System LSI Sensor사업팀장	System LSI Sensor사업팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
장상익	남	1968.07	부사장	상근	영상디스플레이 구매팀 副팀장	영상디스플레이 구매팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
장성대	남	1964.08	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터장	글로벌 제조&인프라총괄 환경안전센터장	동국대(학사)	계열회사 임원	

장성재	남	1965.06	부사장	상근	생활가전 지원팀장	사업지원T/F 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	
장성진	남	1965.07	부사장	상근	TSP총괄 담당임원	TSP총괄	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
장세명	남	1968.01	부사장	상근	기획팀 副팀장	삼성글로벌리서치 Tech&Future본부장	Case Western Reserve Univ.(박사)	계열회사 임원	1
장세연	남	1967.01	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
장우승	남	1970.02	부사장	상근	Big Data센터장	무선 차세대플랫폼센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	45
장재훈	남	1969.07	부사장	상근	반도체연구소 Flash TD실장	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
장종산	남	1964.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS연구소장	글로벌인프라총괄 환경안전연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	33
장호영	남	1968.01	부사장	상근	네트워크 구매팀장	네트워크 Global운영팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
장호진	남	1970.09	부사장	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
전경빈	남	1966.12	부사장	상근	로봇사업팀장	로봇사업화T/F장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
전상욱	남	1971.01	부사장	상근	Mobile eXperience 전략기획팀장	삼성글로벌리서치 글로벌전략실 담당임원	Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	1
정기봉	남	1970.01	부사장	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	DS부문 IP팀 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	25
정기태	남	1965.09	부사장	상근	Foundry 기술개발실장	Foundry 기술개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
정상섭	남	1966.11	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터장	SAS법인장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
정상태	남	1972.01	부사장	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEA 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
정서형	남	1967.05	부사장	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발2팀 담당임원	Univ. of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	
정성택	남	1976.09	부사장	상근	신사업T/F장	Goldman Sachs, SVP	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	5
정완영	남	1965.05	부사장	상근	DS부문 상생협력센터장	DS부문 중국총괄 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
정용준	남	1969.10	부사장	상근	Foundry 품질팀장	Foundry Corporate Planning실 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
정윤	남	1967.05	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실장	SEA 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
정재연	여	1974.09	부사장	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
정재욱	남	1976.07	부사장	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Apple, Sr. Engineering Mgr	Univ. of Waterloo(박사)	계열회사 임원	2
정재헌	남	1962.09	부사장	상근	DS부문 DSA 담당임원	DS부문 미주총괄	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	
정진민	남	1972.12	부사장	상근	Samsung Research S/W혁신센터장	Samsung Research Platform팀장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	

정혁준	남	1972.05	부사장	상근	System LSI AP개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	25
정현준	남	1964.06	부사장	상근	영상디스플레이 Global제조팀장	영상디스플레이 Micro LED팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	
정호진	남	1971.05	부사장	상근	한국총괄 MX팀장	한국총괄 CE영업팀장	Rutgers Univ.(석사)	계열회사 임원	
정훈	남	1969.01	부사장	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀장	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	
조기재	남	1967.01	부사장	상근	DS부문 지원팀장	사업지원T/F 담당임원	Babson College(석사)	계열회사 임원	
조명호	남	1969.05	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	감사팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
조상연	남	1971.12	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	System LSI A-Project팀장	Univ. of Minnesota, Twin Cities(박사)	계열회사 임원	
조상호	남	1965.02	부사장	상근	동남아총괄	구주총괄	경희대(학사)	계열회사 임원	
조성대	남	1969.06	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	RPI(박사)	계열회사 임원	
조성혁	남	1970.05	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
조시정	남	1969.11	부사장	상근	People팀 담당임원	Mobile eXperience 인사팀장	경희대(학사)	계열회사 임원	
조영준	남	1971.05	부사장	상근	북미총괄 People팀장	네트워크 인사팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
조웅	남	1972.08	부사장	상근	법무실 담당임원	SDI 법무팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	9
조인하	여	1974.02	부사장	상근	SEUK법인장	SENA법인장	서강대(석사)	계열회사 임원	
조필주	남	1971.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 지원팀장	종합기술원 기획지원팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
조홍상	남	1966.06	부사장	상근	중남미총괄	SEF법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	
주드버클리	남	1970.05	부사장	상근	SEA 담당임원	SEA EVP	Queensland Univ.(석사)	계열회사 임원	13
주영수	남	1965.08	부사장	상근	성균관대(파견)	삼성생명서비스 고객지원실 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	36
주은기	남	1962.01	부사장	상근	상생협력센터장	상생협력센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
주창훈	남	1970.10	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	인사팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
주혁	남	1971.10	부사장	상근	S.LSI 전략마케팅실 담당임원	종합기술원 Device연구센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	55
지현기	남	1968.01	부사장	상근	메모리 기획팀장	SCS 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
짐엘리엇	남	1970.11	부사장	상근	DS부문 DSA 담당임원	미주총괄 VP	California Polytechnic State Univ.(학사)	계열회사 임원	

차병석	남	1968.11	부사장	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	삼성경제연구소 연구조정실 담당임원	Helsinki Sch. Of Economics & Business Administration(석사)	계열회사 임원	16
채원철	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 副실장	무선 상품전략팀장	광운대(학사)	계열회사 임원	
최강석	남	1965.12	부사장	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀장	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	Univ of California, Irvine(학사)	계열회사 임원	38
최경세	남	1969.04	부사장	상근	AVP사업팀 AVP개발실장	TSP총괄 Package개발실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
최광보	남	1971.03	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	북미총괄 지원팀장	부산대(학사)	계열회사 임원	
최성현	남	1970.05	부사장	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터장	서울대, 교수	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	40
최승걸	남	1968.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 글로벌EHS/인프라센터장	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터장	서울시립대(학사)	계열회사 임원	
최승범	남	1964.12	부사장	상근	디바이스플랫폼센터장	Samsung Research 기술전략팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
최승식	남	1966.01	부사장	상근	중국총괄	무선 전략마케팅실 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
최승은	여	1969.07	부사장	상근	Mobile eXperience 마케팅팀장	무선 GDC센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
최승훈	남	1970.10	부사장	상근	상생협력센터 담당임원	생명 기획팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	1
최완우	남	1965.02	부사장	상근	DS부문 People팀장	메모리 인사팀장	서강대(학사)	계열회사 임원	
최용원	남	1968.05	부사장	상근	설비기술연구소 설비개발실장	생산기술연구소 설비개발실장	고려대(석사)	계열회사 임원	
최용훈	남	1969.07	부사장	상근	영상디스플레이 담당임원	영상디스플레이 Global운영팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	
최원준	남	1970.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실장	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
최윤준	남	1967.09	부사장	상근	LED사업팀장	LED사업팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
최익수	남	1967.05	부사장	상근	생활가전 전략마케팅팀장	SESA법인장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
최정준	남	1965.08	부사장	상근	지원팀장	지원팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
최주호	남	1963.03	부사장	상근	베트남복합단지장	무선 인사팀장	아주대(석사)	계열회사 임원	
최진원	남	1966.09	부사장	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	
최진한	남	1973.05	부사장	상근	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	AMAT, Managing Director	Univ. Of Arizona(박사수료)	계열회사 임원	2
최진혁	남	1967.02	부사장	상근	DSRA-Memory 연구소장	메모리 Solution개발실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
최창규	남	1970.03	부사장	상근	SAIT AI Research Center장	종합기술원 AI&SW연구센터장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	

추종석	남	1962.09	부사장	상근	상생협력센터 담당임원	구주총괄	Univ. of Missouri, Columbia(석사)	계열회사 임원	
패트릭쇼메	남	1964.05	부사장	상근	Mobile eXperience CX실장	무선 서비스사업실 담당임원	Institut d administration des entreprises(석사)	계열회사 임원	
피재걸	남	1964.04	부사장	상근	System LSI 전략마케팅실장	System LSI 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
한상숙	여	1966.07	부사장	상근	영상디스플레이 Service Business팀 副팀장	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
한인택	남	1966.10	부사장	상근	SAIT Material Research Center장	종합기술원 Material연구센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
한지니	여	1969.04	부사장	상근	Mobile eXperience Digital Wallet팀장	Mobile eXperience Digital Life팀장	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	28
한진만	남	1966.10	부사장	상근	DS부문 DSA총괄	메모리 전략마케팅실장	서울대(학사)	계열회사 임원	
허길영	남	1965.08	부사장	상근	DS부문 재경팀장	DS부문 재경팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
허석	남	1973.10	부사장	상근	DS부문 기획팀장	DS부문 기획팀 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
허성회	남	1969.01	부사장	상근	메모리 Flash개발실장	메모리 Flash개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
홍기채	남	1969.06	부사장	상근	법무실 담당임원	법무법인 다전, 변호사	한양대(학사)	계열회사 임원	18
홍두희	남	1964.02	부사장	상근	감사팀장	무선 지원팀장	Wake Forest Univ.(석사)	계열회사 임원	
홍범석	남	1968.06	부사장	상근	아프리카총괄	Iran지점장	중앙대(학사)	계열회사 임원	
홍성민	남	1969.06	부사장	상근	Foundry People팀장	글로벌인프라총괄 인사팀장	Univ. of Texas, Austin(석사)	계열회사 임원	
홍성희	남	1966.02	부사장	상근	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	
홍승완	남	1971.06	부사장	상근	반도체연구소 Flash TD실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
홍영기	남	1970.03	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	Imperial College(박사)	계열회사 임원	
홍유진	여	1972.05	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 Mobile UX센터 담당임원	Univ. of California, LA(석사)	계열회사 임원	
홍형선	남	1963.08	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실장	인하대(석사)	계열회사 임원	
황기현	남	1967.06	부사장	상근	제조담당 제조시너지팀장	반도체연구소 공정개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
황상준	남	1972.01	부사장	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	
황태환	남	1968.04	부사장	상근	한국총괄 CE팀장	한국총괄 CE영업팀장	경희대(학사)	계열회사 임원	
황하섭	남	1964.03	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터장	SCS법인장	인하대(학사)	계열회사 임원	
강건혁	남	1978.11	상무	상근	System LSI Design Platform개발팀 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	16

강도희	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 품질혁신센터 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	49
강동구	남	1976.12	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	49
강동우	남	1971.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 AVP제조기술센터장	TSP총괄 Package개발실 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	36
강동훈	남	1970.12	상무	상근	DS부문 법무지원팀 담당임원	법무실 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
강명진	남	1977.02	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	1
강민석	남	1976.10	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 CX실 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	13
강병욱	남	1967.02	상무	상근	한국총괄 CE팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	36
강보경	여	1976.12	상무	상근	System LSI Design Platform개발팀 담당임원	System LSI Design Platform개발팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	1
강상용	남	1972.09	상무	상근	전장사업팀 담당임원	SEG 담당임원	Univ. of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	49
강석채	남	1971.06	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
강성욱	남	1971.05	상무	상근	지원팀 담당임원	SEUK 담당부장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	36
강신광	남	1968.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	21
강윤경	여	1968.12	상무	상근	People팀 담당임원	Samsung Research 창의개발센터 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	
강은경	여	1972.08	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	13
강정대	남	1970.09	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	한국방송통신대(학사)	계열회사 임원	
강진선	남	1975.09	상무	상근	한국총괄 CE팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	13
강태규	남	1972.01	상무	상근	IR팀 담당임원	IR그룹 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	
강태우	남	1973.10	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	49
강혁	남	1984.10	상무	상근	로봇사업팀 담당임원	생산기술연구소 스마트팩토리팀 담당부장	서울대(박사)	계열회사 임원	1
강희성	남	1970.08	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
고경민	남	1975.03	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
고광현	남	1968.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Intel, Senior Technical Staff	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	54
고상원	남	1979.11	상무	상근	영상디스플레이 구매팀 담당임원	Flex, Sr. Director	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	1
고승범	남	1971.07	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	메모리 Design Platform개발실 담당임원	아주대(학사)	계열회사 임원	49

고얄시드	남	1977.12	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Accenture, Mng. Director	Univ. of Sydney(석사)	계열회사 임원	29
고영관	남	1972.06	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	삼성전기 중앙연구소 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	43
고의중	남	1972.02	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	서울대(학사)	계열회사 임원	13
고정욱	남	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	36
고주현	남	1974.08	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	25
고택균	남	1971.05	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 중국총괄 담당부장	서강대(학사)	계열회사 임원	25
고형석	남	1972.09	상무	상근	SEA 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Case Western Reserve Univ.(석사)	계열회사 임원	49
공병진	남	1971.09	상무	상근	SIEL-P(C)공장장	생활가전 Global운영팀 담당부장	항공대(학사)	계열회사 임원	25
곽진환	남	1968.01	상무	상근	SAIT 미래기술육성센터장	SRIL연구소장	Santa Clara Univ.(석사)	계열회사 임원	
구관본	남	1975.01	상무	상근	System LSI LSI개발실 담당임원	On Semiconductor, Director	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	18
구봉진	여	1971.05	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	25
구윤본	남	1970.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	49
구자천	남	1981.04	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	System LSI 기획팀장	Northwestern Univ.(박사)	계열회사 임원	39
권기덕	여	1974.10	상무	상근	기획팀 담당임원	기획팀 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	25
권기덕	남	1977.10	상무	상근	법무실 담당임원	DS부문 법무지원팀 수석변호사	서울대(학사)	계열회사 임원	25
권기덕	남	1972.07	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	SCS 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	49
권상욱	남	1968.08	상무	상근	Samsung Research Smart Device팀 담당임원	SRUK연구소장	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	
권순범	남	1976.09	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	연세대(석사)	계열회사 임원	36
권영재	남	1972.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	25
권영훈	남	1972.02	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	NXP, Technical Director	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	18
권오경	남	1977.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	25
권욱	남	1978.07	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Lazada, CMO	서울대(석사)	계열회사 임원	7
권진현	남	1968.07	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 담당부장	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	49
권춘기	남	1969.04	상무	상근	생활가전 Global제조팀 담당임원	SEEG-P법인장	포항공대(학사)	계열회사 임원	25

권태훈	남	1971.02	상무	상근	SEA 담당임원	경영혁신센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	25
권혁만	남	1973.06	상무	상근	System LSI 전략마케팅실 담당임원	System LSI 상품기획팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	36
권혁우	남	1973.07	상무	상근	Global Public Affairs팀 담당임원	산업통상자원부 과장	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	6
권형석	남	1973.02	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 동남아총괄 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
권호범	남	1975.12	상무	상근	Samsung Research Platform팀장	Samsung Research Platform팀 담당임원	New York Univ., Tandon School of Engineering(석사)	계열회사 임원	25
길태호	남	1977.11	상무	상근	Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원	Samsung Research Security팀 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	48
김강수	남	1966.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라QA팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
김건우	남	1976.01	상무	상근	SEH-P 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당부장	MIT(석사)	계열회사 임원	13
김경륜	남	1983.02	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	13
김경준	남	1969.01	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 미주총괄 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	49
김경태	남	1973.07	상무	상근	한국총괄 마케팅팀 담당임원	한국총괄 IMC팀 담당부장	성균관대(학사)	계열회사 임원	1
김경태	남	1973.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	25
김광연	남	1965.07	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
김광익	남	1974.09	상무	상근	DS부문 지원팀 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 담당부장	한양대(학사)	계열회사 임원	13
김광훈	남	1975.02	상무	상근	SEDA-P(C)공장장	Mobile eXperience Global제조센터 담당부장	인하대(학사)	계열회사 임원	1
김구영	남	1975.03	상무	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임원	TSP총괄 Package개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	13
김규태	남	1970.12	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 Global운영팀 담당임원	RPI(석사)	계열회사 임원	51
김기남	남	1964.08	상무	상근	SAIT Material Research Center 담당임원	DMC연구소 ECO Solution팀 담당임원	Stevens Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
김기수	남	1970.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
김기수	남	1976.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	1
김기언	남	1972.06	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	DS부문 DSC 수석	한양대(학사)	계열회사 임원	1
김기호	남	1966.03	상무	상근	SRA 담당임원	SRI-Delhi연구소장	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
김기환	남	1975.03	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	NVIDIA, Principal Research Scientist	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	33

김대신	남	1970.03	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	49
김대우	남	1970.03	상무	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임원	반도체연구소 Package개발팀 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
김대현	남	1974.08	상무	상근	SME법인장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당부장	경북대(학사)	계열회사 임원	1
김덕헌	남	1975.06	상무	상근	상생협력센터 담당임원	메타볼라이트, Co-Founder	고려대(학사)	계열회사 임원	35
김덕호	남	1970.11	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	SRI-Delhi연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	36
김도기	남	1975.05	상무	상근	반도체연구소 People팀장	인사팀 담당부장	숭실대(학사)	계열회사 임원	1
김동근	남	1976.07	상무	상근	System LSI AP개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	13
김동수	남	1975.10	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	DS부문 인사팀 담당부장	Univ. of Maryland, College Park(석사)	계열회사 임원	13
김동욱	남	1969.06	상무	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임원	Test&Package센터 담당임원	Univ. of California, Irvine(박사)	계열회사 임원	57
김동준	남	1973.05	상무	상근	TSLED법인장	글로벌인프라총괄 LED기술센터 담당임원	광주과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김래훈	남	1975.07	상무	상근	System LSI AP개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	21
김륭	남	1971.12	상무	상근	People팀 담당임원	무선 인사팀 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	25
김명오	남	1972.09	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	25
김무성	남	1975.12	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	포항공대(석사)	계열회사 임원	13
김문수	남	1977.12	상무	상근	SRI-Delhi연구소장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	25
김민우	남	1978.06	상무	상근	TSE-S 담당임원	SESP법인장	한양대(학사)	계열회사 임원	25
김범진	남	1975.02	상무	상근	SEAU 담당임원	SERC 담당임원	Southern Illinois Univ.(석사)	계열회사 임원	49
김보성	남	1974.04	상무	상근	Samsung Research 담당임원	Awair, CDO	Royal Collge of Art(석사)	계열회사 임원	10
김보창	남	1977.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	1
김봉수	남	1971.06	상무	상근	반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	25
김상윤	남	1972.01	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SECE법인장	인하대(학사)	계열회사 임원	25
김상윤	남	1969.10	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Synopsys, Technical Member	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	35
김상효	남	1967.10	상무	상근	SRA 담당임원	네트워크 지원팀 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
김상훈	남	1968.02	상무	상근	SEI 담당임원	SENA 담당임원	건국대(학사)	계열회사 임원	

김석희	남	1971.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	부산대(석사)	계열회사 임원	25
김선길	남	1974.11	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임원	생활가전 Global CS팀 담당부장	전남대(학사)	계열회사 임원	1
김선정	남	1973.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 수석	National Univ. of Singapore(박사)	계열회사 임원	13
김성권	남	1971.02	상무	상근	디자인경영센터 담당임원	디자인경영센터 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	49
김성기	남	1968.11	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	북미총괄 CS팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
김성민	남	1976.03	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	SEA 담당부장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	13
김성은	남	1968.11	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	무선 기술전략팀 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	
김성은	남	1970.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	경북대(학사)	계열회사 임원	36
김성한	남	1970.05	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
김세진	여	1973.07	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당부장	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	1
김세훈	남	1975.01	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	중앙대(학사)	계열회사 임원	1
김수련	여	1967.04	상무	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임원	메모리제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김수형	남	1972.08	상무	상근	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	49
김수홍	남	1972.11	상무	상근	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	생산기술연구소 설비개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
김승연	여	1975.04	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	36
김승일	남	1970.07	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당부장	단국대(학사)	계열회사 임원	
김시우	남	1972.10	상무	상근	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI LSI개발실 수석	단국대(석사)	계열회사 임원	25
김신	남	1971.12	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	13
김연정	남	1975.12	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	무선 상품전략팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
김영대	남	1968.10	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 제품기술팀장	동국대(석사)	계열회사 임원	
김영무	남	1976.09	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당부장	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	13
김영일	남	1974.12	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	DS부문 미주총괄 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	1
김영정	남	1972.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	13
김영주	남	1973.07	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	13

김영집	남	1979.05	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	1
김용관	남	1976.04	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	Apple, Manager	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	35
김용상	남	1972.08	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	25
김용성	남	1973.09	상무	상근	SAIT Device Research Center장	종합기술원 Material연구센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	36
김용완	남	1970.04	상무	상근	메모리 Global운영팀장	메모리 Global운영팀 담당부장	연세대(학사)	계열회사 임원	36
김용찬	남	1969.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	49
김용한	남	1976.02	상무	상근	생활가전 선행개발팀 담당임원	생활가전 선행개발팀 수석	고려대(박사)	계열회사 임원	13
김용훈	남	1972.11	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	한양대(학사)	계열회사 임원	25
김우년	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Qualcomm, Principal Engineer	포항공대(박사)	계열회사 임원	48
김원국	남	1975.11	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	경북대(석사)	계열회사 임원	13
김원우	남	1970.03	상무	상근	SEDA-S 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	36
김원희	남	1971.04	상무	상근	SEAU법인장	SEAU 담당임원	Mcgill Univ.(석사)	계열회사 임원	49
김유나	여	1979.01	상무	상근	SRPOL연구소장	Samsung Research Platform팀 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	13
김윤재	남	1973.02	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	25
김은경	여	1974.04	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	단국대(학사)	계열회사 임원	49
김은용	남	1979.02	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	1
김은하	여	1971.05	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 수석	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	25
김이태	남	1971.01	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 수석	포항공대(석사)	계열회사 임원	49
김인범	남	1973.05	상무	상근	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	1
김인형	남	1973.12	상무	상근	System LSI CP개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	49
김일룡	남	1974.02	상무	상근	System LSI Global Operation실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	49
김장환	남	1975.08	상무	상근	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	생산기술연구소 설비개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	36
김재성	남	1972.04	상무	상근	SEA 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	36
김재영	남	1971.11	상무	상근	SECA 담당임원	SIEL-S 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	

김재윤	남	1970.07	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	전장사업팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	49
김재진	남	1969.11	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	25
김재홍	남	1973.03	상무	상근	지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	25
김재환	남	1969.07	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 수석변호사	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	1
김재훈	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Facebook, S/W Engineer	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	15
김정봉	남	1965.07	상무	상근	육상연맹(파견)	SSC 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	
김정헌	남	1972.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	DL E&C, 전무	경희대(석사)	계열회사 임원	2
김정호	남	1972.01	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	기획팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	49
김종균	남	1966.08	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	정보전략팀 담당부장	경상대(학사)	계열회사 임원	
김종근	남	1967.06	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	
김종민	남	1968.03	상무	상근	SSC 담당임원	전장사업팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	
김종훈	남	1969.12	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
김주연	남	1974.12	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	한양대(박사)	계열회사 임원	1
김준석	남	1972.10	상무	상근	System LSI 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
김준성	남	1975.08	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	1
김준엽	남	1969.10	상무	상근	SEHC 담당임원	SESK 담당임원	경기대(학사)	계열회사 임원	
김중정	남	1973.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	東北大(박사)	계열회사 임원	
김지영	남	1970.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	Univ. of California, LA(박사)	계열회사 임원	
김지용	남	1975.06	상무	상근	SEA 담당임원	SEA 담당부장	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	1
김지윤	여	1975.02	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	49
김지훈	남	1971.08	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	서강대(박사)	계열회사 임원	13
김진교	남	1973.05	상무	상근	상생협력센터 담당임원	베트남복합단지 담당부장	경찰대(학사)	계열회사 임원	13
김진기	남	1972.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	인하대(학사)	계열회사 임원	13
김진성	남	1971.02	상무	상근	SEVT 담당임원	지원팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	36

김진주	남	1969.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김진호	남	1977.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	1
김찬호	남	1975.06	상무	상근	SESA 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	25
김창용	남	1973.04	상무	상근	SAIT People팀장	종합기술원 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	13
김창태	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	금오공대(학사)	계열회사 임원	
김철주	남	1976.07	상무	상근	SRR연구소장	SRR 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	1
김태균	남	1969.01	상무	상근	AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원	DS부문 지원팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
김태균	남	1976.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 수석	RPI(박사)	계열회사 임원	13
김태수	남	1971.11	상무	상근	한국총괄 CE팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	36
김태수	남	1985.03	상무	상근	Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원	Samsung Research Security팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	20
김태영	남	1968.04	상무	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	LBS(석사)	계열회사 임원	35
김태우	남	1971.05	상무	상근	메모리 기획팀 담당임원	DS부문 기획팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	49
김태정	남	1972.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	충북대(학사)	계열회사 임원	25
김태중	남	1971.05	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 디자인팀 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
김태진	남	1969.01	상무	상근	재경팀 담당임원	삼성경제연구소 사회인프라개발실 담당부장	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
김태훈	남	1973.01	상무	상근	상생협력센터 담당임원	감사팀 담당임원	단국대(학사)	계열회사 임원	25
김태훈	남	1970.10	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	49
김평진	남	1973.12	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	연세대(학사)	계열회사 임원	
김향희	여	1972.07	상무	상근	SEROM법인장	SEH-S법인장	고려대(학사)	계열회사 임원	13
김현	남	1968.07	상무	상근	서남아총괄 대외협력팀장	SEVT 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
김현근	남	1973.07	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당부장	경희대(학사)	계열회사 임원	13
김현기	남	1973.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 수석	광운대(학사)	계열회사 임원	1
김현석	남	1976.10	상무	상근	반도체연구소 Flash TD실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	13
김현수	남	1970.09	상무	상근	Samsung Research 기술전략팀 담당임원	DMC연구소 기술전략팀 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	

김현조	남	1970.05	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	반도체연구소 Logic TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	36
김현종	남	1977.11	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	25
김현중	남	1969.05	상무	상근	한국총괄 마케팅팀장	한국총괄 CE영업팀 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	49
김현철	남	1969.05	상무	상근	반도체연구소 CIS TD팀 담당임원	반도체연구소 CIS TD팀 수석	Texas A&M Univ.(박사)	계열회사 임원	36
김형로	남	1973.01	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	13
김형섭	남	1970.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	중앙대(학사)	계열회사 임원	36
김형재	남	1970.12	상무	상근	SEM-S법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김형준	남	1972.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	숭실대(석사)	계열회사 임원	13
김호균	남	1968.12	상무	상근	중남미총괄 대외협력팀장	Samsung Research 인사팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
김홍민	남	1971.10	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 디자인팀 담당임원	SAIC(석사)	계열회사 임원	40
김후성	남	1972.01	상무	상근	System LSI Global Operation실 담당임원	메모리 품질보증실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김희승	남	1970.09	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	SCS 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	36
나현수	남	1971.06	상무	상근	중국총괄 지원팀장	한국총괄 지원팀 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	36
남경인	남	1973.03	상무	상근	SELS법인장	경영혁신센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	49
남기돈	남	1972.09	상무	상근	재경팀 담당임원	CIS총괄 지원팀장	중앙대(학사)	계열회사 임원	36
남정만	남	1967.06	상무	상근	생활가전 Global제조팀 담당임원	생활가전 구매팀 담당임원	전남기계공고(고교)	계열회사 임원	
노강호	남	1978.05	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	25
노경래	남	1976.12	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SEM-S 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	49
노경윤	남	1972.09	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	Intel, Director	MIT(박사)	계열회사 임원	16
노미정	여	1971.04	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	36
노수혁	남	1970.04	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	25
노승남	남	1973.04	상무	상근	메모리 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	25
노승환	남	1974.08	상무	상근	SEM-P 담당임원	생활가전 지원팀 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	13
노태현	남	1969.09	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	

다니엘아라우조	남	1981.08	상무	상근	Mobile eXperience 전략기획팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	Univ. Of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	1
도성대	남	1966.12	상무	상근	서남아총괄 담당임원	CS환경센터 담당부장	부산대(학사)	계열회사 임원	
드미트리	남	1972.07	상무	상근	SERC 담당임원	SERC VP	Moscow Institute of Physics and Technology(석사)	계열회사 임원	25
라병주	남	1972.05	상무	상근	전장사업팀 담당임원	전장사업팀 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	25
류일곤	남	1968.07	상무	상근	SEVT 담당임원	인사팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
류효겸	남	1980.10	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Broadcom, Principal Engineer	Univ. of Michigan(박사)	계열회사 임원	26
마띠유	남	1981.10	상무	상근	기획팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	MIT(석사)	계열회사 임원	36
명관주	남	1972.10	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	36
모한	남	1973.07	상무	상근	SRI-Bangalore 담당임원	SRI-Bangalore VP	Acharya Nagarjuna Univ.(학사)	계열회사 임원	36
목진호	남	1968.09	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
문국열	남	1969.01	상무	상근	SEVT 담당임원	SVCC 담당임원	구미1대(전문대)	계열회사 임원	
문진옥	남	1971.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	한양대(박사)	계열회사 임원	36
문형준	남	1968.07	상무	상근	반도체연구소 기술기획팀 담당임원	System LSI 기획팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
민병기	남	1963.02	상무	상근	상생협력센터 담당임원	에스원 커뮤니케이션팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	13
민재호	남	1976.09	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	13
민현진	남	1974.06	상무	상근	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	설비기술연구소 설비개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	1
박동욱	남	1974.01	상무	상근	System LSI 기획팀장	DS부문 기획팀 담당부장	한양대(석사)	계열회사 임원	25
박두건	남	1981.01	상무	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	Amazon, Applied Science Mgr	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	2
박래순	남	1969.05	상무	상근	중국전략협력실 담당임원	삼성전기 인사지원그룹장	Peking Univ.(석사)	계열회사 임원	5
박민규	남	1976.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	25
박민철	남	1972.09	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	49
박범주	남	1966.04	상무	상근	인재개발원 담당임원	Samsung Research S/W혁신센터 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	
박병률	남	1968.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	43

박병수	남	1972.12	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B팀 담당부장	한양대(학사)	계열회사 임원	1
박봉일	남	1972.02	상무	상근	System LSI AP개발실 담당임원	System LSI Custom SOC사업팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	25
박봉태	남	1974.10	상무	상근	SCS 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	36
박상교	남	1972.03	상무	상근	중국전략협력실 담당임원	중국본사 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
박상권	남	1971.07	상무	상근	DS부문 커뮤니케이션팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	22
박상도	남	1973.12	상무	상근	북미총괄 담당임원	북미총괄 담당부장	성균관대(학사)	계열회사 임원	36
박상훈	남	1969.09	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	법무실 담당임원	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	
박상훈	남	1978.02	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	13
박석민	남	1970.12	상무	상근	생활가전 Global운영팀 副팀장	생활가전 Global운영팀 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
박성범	남	1984.10	상무	상근	System LSI AP개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	13
박성제	남	1971.05	상무	상근	영상디스플레이 Global CS팀 담당임원	영상디스플레이 담당임원	국민대(석사)	계열회사 임원	25
박성철	남	1972.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	1
박세근	남	1974.01	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	성균관대(박사)	계열회사 임원	36
박장묵	남	1967.02	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	계명대(학사)	계열회사 임원	
박장용	남	1979.01	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	서울대(학사)	계열회사 임원	25
박재범	남	1977.08	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	DS부문 인사팀 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	13
박재성	남	1971.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	49
박재식	남	1976.08	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 구매팀 담당부장	경희대(학사)	계열회사 임원	1
박재현	남	1970.07	상무	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	글로벌마케팅센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	25
박정대	남	1976.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 분석기술팀장	포항공대(박사)	계열회사 임원	49
박정미	여	1968.07	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
박정재	남	1974.01	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당부장	Univ. of Texas, Austin(석사)	계열회사 임원	36
박정호	남	1974.11	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	36
박제영	남	1969.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	

박제임스	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 담당부장	California Polytechnic State Univ.(학사)	계열회사 임원	
박종규	남	1969.07	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	경북대(학사)	계열회사 임원	
박종만	남	1971.11	상무	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	13
박종우	남	1972.02	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	서울시립대(학사)	계열회사 임원	13
박종욱	남	1968.11	상무	상근	Global CS센터 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
박종진	남	1970.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	생활가전 구매팀 담당임원	Univ. Of Michigan, Ann Arbor(학사)	계열회사 임원	34
박준수	남	1967.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	4
박준영	남	1974.10	상무	상근	SEBN법인장	SEA 담당임원	Univ. of Paris 11(석사)	계열회사 임원	25
박준호	남	1972.05	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
박진수	남	1969.07	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	49
박진표	남	1972.11	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	System LSI AP개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	49
박찬형	남	1973.06	상무	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당부장	City Univ. of New York(CUNY)(석사)	계열회사 임원	1
박창서	남	1980.06	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	22
박창진	남	1967.01	상무	상근	네트워크 Global CS팀장	네트워크 개발팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
박철민	남	1971.01	상무	상근	AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	35
박철범	남	1966.03	상무	상근	상생협력센터 구매전략팀장	상생협력센터 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
박철웅	남	1973.01	상무	상근	Mobile eXperience 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	13
박충신	남	1973.09	상무	상근	의료기기 People팀장	의료기기 인사팀장	경북대(석사)	계열회사 임원	25
박태상	남	1975.01	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	49
박태호	남	1969.03	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	SEAG법인장	Univ. of Pittsburgh(석사)	계열회사 임원	
박태훈	남	1974.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	13
박행철	남	1970.01	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	부산대(학사)	계열회사 임원	25
박현근	남	1973.01	상무	상근	Foundry 기획팀장	DS부문 기획팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	36
박현준	남	1978.01	상무	상근	구주총괄 People팀장	사업지원T/F 담당부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	1

박형민	남	1977.03	상무	상근	SEA 담당임원	SEAD법인장	서울대(학사)	계열회사 임원	25
박호우	남	1971.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	13
박훈혈	남	1974.05	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	지원팀 담당부장	광운대(학사)	계열회사 임원	13
박희걸	남	1972.08	상무	상근	네트워크 시스템솔루션팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	23
반수형	남	1972.06	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	아주대(학사)	계열회사 임원	1
반일승	남	1974.11	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	SEJ 담당부장	경희대(학사)	계열회사 임원	36
발라지	남	1969.09	상무	상근	SSIR연구소장	SSIR VP	Birla Institute of Technology and Science, Pilani(석사)	계열회사 임원	49
방지훈	남	1973.11	상무	상근	System LSI AP개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(석사)	계열회사 임원	59
배범희	남	1985.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	생산기술연구소 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	1
배상기	남	1974.04	상무	상근	메모리 지원팀 담당임원	SAS 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	36
배승준	남	1976.03	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	49
배일환	남	1970.07	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
배학범	남	1963.08	상무	상근	SESK법인장	SEHC 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
배희선	여	1974.02	상무	상근	SCIC 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	25
백기열	남	1967.07	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	삼성SDS 품질팀장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	1
백아론	남	1979.10	상무	상근	Samsung Research Robot센터 담당임원	Samsung Research Robot센터 수석	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	13
백일섭	남	1968.08	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
백종수	남	1971.01	상무	상근	지원팀 담당임원	전장사업팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
백피터	남	1971.06	상무	상근	DS부문 IP팀 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Univ. of Minnesota, Minneapolis(석사)	계열회사 임원	36
변준호	남	1972.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Southern Illinois Univ.(박사)	계열회사 임원	
부민혁	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience사업부 CX실 담당임원	생활가전 디자인팀장	제주대(학사)	계열회사 임원	
부장원	남	1973.06	상무	상근	Big Data센터 담당임원	글로벌마케팅센터 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	36
서경헌	남	1970.05	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	13

서보철	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience Global운영팀장	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	동국대(학사)	계열회사 임원	
서상원	남	1979.06	상무	상근	System LSI CP개발실 담당임원	Apple, Engineer/Manager	Michigan Univ.(박사)	계열회사 임원	2
서성기	남	1972.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	건국대(학사)	계열회사 임원	36
서영진	남	1969.05	상무	상근	Global CS센터 담당임원	CS환경센터 담당부장	Insa De Lyon(박사)	계열회사 임원	
서원주	남	1976.07	상무	상근	DS부문 IP팀 담당임원	DS부문 미주총괄 VP	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	25
서정아	여	1971.05	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
서정혁	남	1972.07	상무	상근	Samsung Research People팀장	네트워크 인사팀장	건국대(학사)	계열회사 임원	13
서정현	남	1974.04	상무	상근	SCS 담당임원	DS부문 지원팀 담당임원	Univ. of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	36
서창우	남	1974.06	상무	상근	SEF 담당임원	SEBN 담당부장	Manchester(석사)	계열회사 임원	1
서치영	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	Airbnb, Director	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	10
서현정	여	1978.02	상무	상근	DS부문 경영지원실 담당임원	ERM 코리아, 대표	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	14
석종욱	남	1969.06	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 LED제조기술팀장	글로벌인프라총괄 LED제조기술팀장	광운대(학사)	계열회사 임원	
선동석	남	1974.04	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	25
설지윤	남	1974.12	상무	상근	네트워크 상품전략팀장	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	36
설훈	남	1970.03	상무	상근	SEG 담당임원	SEROM법인장	고려대(학사)	계열회사 임원	
성낙희	남	1973.03	상무	상근	System LSI AP개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
성덕용	남	1973.09	상무	상근	설비기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	
성백민	남	1971.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 수석	한양공고(고교)	계열회사 임원	13
성한준	남	1971.02	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	성균관대(학사)	계열회사 임원	36
소재민	남	1983.04	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	13
손석준	남	1974.07	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	전남대(석사)	계열회사 임원	25
손성민	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	SEV 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	13
손영아	여	1973.05	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SELA 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	1
손영웅	남	1970.10	상무	상근	반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	36

손용우	남	1968.09	상무	상근	감사팀 담당임원	SEDA-P(M) 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
손용훈	남	1973.03	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	13
손준호	남	1976.08	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담당부장	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	1
손중곤	남	1970.09	상무	상근	LED사업팀 담당임원	LED사업팀 수석	State Univ. of New York, Stony Brook(박사)	계열회사 임원	
손태용	남	1972.08	상무	상근	영상디스플레이 Micro LED팀장	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
손한구	남	1969.06	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	49
손현석	남	1976.03	상무	상근	SEH-P법인장	SEH-P 담당부장	홍익대(학사)	계열회사 임원	1
손호민	남	1969.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	36
손호성	남	1968.04	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 구매팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
송기재	남	1970.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	광운대(박사)	계열회사 임원	25
송명숙	여	1972.11	상무	상근	영상디스플레이 Customer Marketing팀 담당임원	글로벌마케팅센터 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	49
송방영	남	1974.10	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	지원팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	49
송보영	여	1976.10	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	포항공대(석사)	계열회사 임원	1
송상철	남	1973.09	상무	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	Verizon Media, Chief Architect	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	22
송우창	남	1968.01	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
송원준	남	1969.04	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
송원철	남	1976.01	상무	상근	SAMEX 담당임원	지원팀 담당부장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	1
송윤종	남	1971.10	상무	상근	반도체연구소 차세대연구실 담당임원	반도체연구소 차세대TD팀장	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	49
송인강	남	1971.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 기술전략팀 담당부장	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	49
송정우	남	1977.12	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	State Univ. Of New York, Buffalo(박사)	계열회사 임원	1
송태중	남	1971.04	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
송호영	남	1972.12	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	36
쉐인힉비	남	1972.05	상무	상근	SEA 담당임원	SEA VP	Fairleigh Dickinson Univ.(석사)	계열회사 임원	
신규범	남	1972.06	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 Global CS팀 담당부장	부산대(학사)	계열회사 임원	25

신대중	남	1971.11	상무	상근	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	SEDA-P(C)공장장	경북대(학사)	계열회사 임원	36
신문선	남	1975.04	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	한국해양대(학사)	계열회사 임원	1
신민호	남	1970.03	상무	상근	System LSI CP개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	25
신상용	남	1973.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	1
신승주	남	1972.04	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SESA 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	36
신용우	남	1974.12	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	DS부문 기획팀 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	13
신원화	남	1976.11	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	성균관대(박사)	계열회사 임원	1
신인철	남	1974.06	상무	상근	TSP총괄 People팀장	DS부문 인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	25
신현	남	1972.12	상무	상근	한국총괄 e-Commerce팀 담당임원	한국총괄 온라인영업팀 담당부장	경기대(학사)	계열회사 임원	1
신현석	남	1969.05	상무	상근	Samsung Research Smart Device팀장	Samsung Research Intelligent Machine센터장	서강대(석사)	계열회사 임원	
신현진	남	1971.01	상무	상근	영상디스플레이 People팀장	영상디스플레이 인사팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	
심우철	남	1982.06	상무	상근	Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원	Samsung Research Security팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	13
심재혁	남	1978.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	Dupont Korea, 상무	서강대(학사)	계열회사 임원	3
심재현	남	1972.01	상무	상근	지원팀 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
심호준	남	1977.12	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	36
심황윤	남	1971.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	13
아라이	남	1968.08	상무	상근	DS부문 DSJ총괄	DS부문 일본총괄 VP	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	25
안대현	남	1972.02	상무	상근	한국총괄 CE팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	25
안성준	남	1975.01	상무	상근	System LSI S/W Engineering팀장	System LSI S/W Architecture팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	49
안승환	남	1970.10	상무	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	SEA 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	49
안신헌	남	1972.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 수석	한양대(학사)	계열회사 임원	13
안용석	남	1974.11	상무	상근	반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	반도체연구소 DRAM TD실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	1
안재용	남	1977.02	상무	상근	감사팀 담당임원	감사팀 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	1
안정희	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEMAG법인장	경북대(석사)	계열회사 임원	

안주원	여	1977.03	상무	상근	생활가전 기획팀 담당임원	기획팀 담당부장	서강대(학사)	계열회사 임원	1
안준	남	1978.02	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	AWS, S/W Engineer	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	15
안진우	남	1969.11	상무	상근	Compliance팀 담당임원	법무실 담당임원	동아대(학사)	계열회사 임원	
안치용	남	1975.12	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질실 수석	성균관대(학사)	계열회사 임원	1
안희영	여	1976.12	상무	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	1
양병덕	남	1971.03	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Apple, Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	
양시준	남	1974.01	상무	상근	네트워크 지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당부장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	25
양익준	남	1969.11	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	아프리카총괄 지원팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
양종훈	남	1974.05	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 구매팀 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	1
양준철	남	1972.06	상무	상근	영상디스플레이 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	36
양진기	남	1971.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	49
양택진	남	1971.08	상무	상근	Samsung Research 기술전략팀 담당임원	Samsung Research 기술전략팀 담당부장	연세대(학사)	계열회사 임원	49
양희철	남	1975.07	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 UX혁신팀 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	36
여태정	남	1970.06	상무	상근	전장사업팀 담당임원	전장사업팀 담당부장	서울대(박사)	계열회사 임원	
연지현	여	1974.10	상무	상근	System LSI 전략마케팅실 담당임원	System LSI 전략마케팅실 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	13
염강수	남	1972.08	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	25
염부호	남	1972.04	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	13
염종범	남	1977.06	상무	상근	Mobile eXperience People팀 담당임원	DS부문 중국총괄 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	1
오름	여	1977.02	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	고려대(박사)	계열회사 임원	13
오상진	남	1977.11	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	Foundry 지원팀 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	13
오석민	여	1974.07	상무	상근	디자인경영센터 담당임원	디자인경영센터 수석	New York Univ.(석사)	계열회사 임원	36
오승훈	남	1968.03	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	SRI-Noida연구소장	Aachen Univ. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
오영기	남	1973.01	상무	상근	인재개발원 담당임원	인재개발원 담당부장	충남대(학사)	계열회사 임원	1
오용찬	남	1972.10	상무	상근	SIEL-S 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	홍익대(학사)	계열회사 임원	1

오재균	남	1972.02	상무	상근	System LSI 지원팀장	TSP총괄 지원팀장	Univ. of Iowa(석사)	계열회사 임원	
오정환	남	1973.12	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당 임원	반도체연구소 공정개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	1
오준영	남	1969.02	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당 임원	메모리 Solution개발실 수석	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	49
오창민	남	1965.02	상무	상근	SEJ법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
오창호	남	1971.03	상무	상근	SEV 담당임원	무선 구매팀 담당임원	동아대(학사)	계열회사 임원	25
오창환	남	1969.01	상무	상근	DS부문 창의혁신센터장	DS부문 경영지원실 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
오혁상	남	1969.06	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	부산대(석사)	계열회사 임원	36
오형석	남	1970.09	상무	상근	TSP총괄 구매팀장	TSP총괄 구매팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	
올라프	남	1971.01	상무	상근	SEG 담당임원	SEG VP	Johannes Gutenberg Univ.(석사)	계열회사 임원	13
왕지연	여	1977.09	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	Mobile eXperience CX실 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	1
우형동	남	1970.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	49
원석준	남	1970.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	36
원찬식	남	1975.12	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 수석	서강대(박사)	계열회사 임원	13
유미경	여	1974.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	16
유상민	남	1973.09	상무	상근	System LSI CP개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Univ. of Washington(박사)	계열회사 임원	25
유성종	남	1976.03	상무	상근	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI LSI개발실 수석	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	1
유성호	남	1973.02	상무	상근	System LSI 지원팀 담당임원	System LSI 지원팀 담당부장	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	13
유송	남	1975.05	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEA 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	13
유종민	남	1974.04	상무	상근	People팀 담당임원	SSC 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	36
유한종	남	1973.10	상무	상근	SEF 담당임원	재경팀 담당임원	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	25
유화열	남	1971.11	상무	상근	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI LSI개발실 수석	인하대(석사)	계열회사 임원	36
육근성	남	1968.08	상무	상근	한국총괄 지원팀장	한국총괄 지원팀 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	49
윤가람	여	1983.08	상무	상근	Samsung Research Smart Device팀 담당임원	Meta, Manager	Univ. of Arizona(박사)	계열회사 임원	7
윤남호	남	1968.12	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	49

윤보영	여	1977.08	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	이화여대(석사)	계열회사 임원	13
윤석진	남	1968.11	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	23
윤석호	남	1972.07	상무	상근	LED사업팀 담당임원	글로벌인프라총괄 LED기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
윤성욱	남	1974.06	상무	상근	구주총괄 담당임원	인사팀 담당부장	연세대(학사)	계열회사 임원	13
윤성환	남	1972.04	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 수석	State Univ. of New York, Buffalo(석사)	계열회사 임원	1
윤송호	남	1974.10	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	광운대(학사)	계열회사 임원	13
윤승욱	남	1970.01	상무	상근	AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원	TSP총괄 Package개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	39
윤여완	남	1972.02	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 책임변호사	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	25
윤영조	남	1975.02	상무	상근	Global Public Affairs팀 담당임원	IR팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	33
윤우근	남	1972.01	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	東北大(박사)	계열회사 임원	23
윤인철	남	1971.03	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 선행개발팀 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	49
윤주한	남	1970.05	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
윤찬현	남	1971.10	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	무선 구매팀 담당부장	영남대(학사)	계열회사 임원	49
윤철웅	남	1970.07	상무	상근	SERC 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	49
윤하룡	남	1971.12	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
윤호용	남	1969.12	상무	상근	SEM-S 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Drexel Univ.(석사)	계열회사 임원	36
은성민	남	1977.01	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	사업지원T/F 담당부장	Wake Forest Univ.(석사)	계열회사 임원	1
이강규	남	1972.09	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	DS부문 미주총괄 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	25
이강승	남	1977.07	상무	상근	System LSI Global Operation실 담당임원	System LSI Global운영팀장	포항공대(박사)	계열회사 임원	36
이경준	남	1976.06	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	25
이경호	남	1975.10	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	13
이계복	남	1969.06	상무	상근	SEM-P법인장	SEHA법인장	홍익대(학사)	계열회사 임원	36
이계원	남	1968.05	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이계훈	남	1980.02	상무	상근	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	13

이관수	남	1969.11	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	SAMEX 담당임원	영남대(학사)	계열회사 임원	
이광열	남	1974.11	상무	상근	아프리카총괄 지원팀장	사업지원T/F 담당부장	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	13
이귀호	여	1975.05	상무	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 담당부장	이화여대(학사)	계열회사 임원	36
이규영	남	1968.10	상무	상근	LED사업팀 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
이규원	남	1974.03	상무	상근	DS부문 DSJ 담당임원	DS부문 일본총괄 담당부장	Waseda Univ.(석사)	계열회사 임원	36
이근수	남	1970.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	세종대(학사)	계열회사 임원	49
이기욱	남	1970.08	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 개발2실 수석	동아대(학사)	계열회사 임원	
이기철	남	1972.11	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 Global Technology Service팀 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	36
이남호	남	1972.02	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	두산, 부문장	성균관대(박사)	계열회사 임원	24
이대성	남	1970.09	상무	상근	SCIC 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	25
이동진	남	1971.01	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	성균관대(학사)	계열회사 임원	25
이동하	남	1968.07	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	37
이동헌	남	1972.09	상무	상근	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원실 수석변호사	고려대(학사)	계열회사 임원	
이두희	남	1973.11	상무	상근	SGE법인장	SEMAG법인장	단국대(석사)	계열회사 임원	1
이민철	남	1970.04	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	무선 PC사업팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
이범섭	남	1972.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	인하대(학사)	계열회사 임원	13
이병일	남	1983.07	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	1
이병진	남	1970.09	상무	상근	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 담당부장	Univ. Of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	25
이병철	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience People팀 담당임원	Mobile eXperience 인사팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	13
이병한	남	1974.05	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	Univ. Of Wisconsin, Madison(학사)	계열회사 임원	1
이병헌	남	1974.11	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	Manchester Business Sch.(석사)	계열회사 임원	13
이보나	여	1973.02	상무	상근	생활가전 담당임원	생활가전 CX팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	13
이상수	남	1975.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	무선 개발실 수석	아주대(석사)	계열회사 임원	25
이상엽	남	1967.11	상무	상근	상생협력센터 담당임원	삼성물산 상생협력팀 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	1

이상용	남	1970.02	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	GCT Semiconductor, Senior Director	서울대(박사)	계열회사 임원	42
이상욱	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 품질혁신센터 담당임원	금오공대(학사)	계열회사 임원	
이상육	남	1971.01	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
이상직	남	1970.06	상무	상근	SELA법인장	SEM-S법인장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	
이상현	남	1970.09	상무	상근	SRJ 담당임원	SCS 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
이상호	남	1973.01	상무	상근	SAMCOL법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	1
이상희	남	1974.09	상무	상근	반도체연구소 Mask개발팀장	반도체연구소 Mask개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	13
이석림	남	1974.03	상무	상근	SEAS법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	13
이선화	여	1975.08	상무	상근	글로벌마케팅실 CX·MDE센터 담당임원	CX·MDE센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	13
이성원	남	1976.03	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	25
이성원	남	1978.10	상무	상근	System LSI AP개발실 담당임원	Qualcomm, Sr. Staff Engineer	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	4
이성재	남	1974.12	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	IBM, Principal Manager	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	15
이성훈	남	1975.11	상무	상근	반도체연구소 Flash TD실 담당임원	반도체연구소 Flash TD실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	1
이수용	남	1968.03	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	반도체연구소 공정개발실 담당 Master	한양대(석사)	계열회사 임원	5
이승관	남	1973.10	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	연합뉴스, 기자	고려대(학사)	계열회사 임원	35
이승목	남	1973.09	상무	상근	System LSI People팀장	동남아총괄 인사팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	49
이승엽	남	1968.08	상무	상근	SEIN-S법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
이승재	남	1974.08	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이승준	남	1974.04	상무	상근	반도체연구소 Flash TD실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	1
이승철	남	1975.12	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	생활가전 지원팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	25
이승호	남	1973.11	상무	상근	SEVT 담당임원	SEIN-P법인장	서울사이버대(학사)	계열회사 임원	25
이승환	남	1971.05	상무	상근	LED사업팀 담당임원	LED사업팀 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	13
이승훈	남	1976.03	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	1
이신재	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당부장	인하대(학사)	계열회사 임원	49

이애영	여	1968.12	상무	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	무선 차세대플랫폼센터 담당임원	포항공대(석사)	계열회사 임원	
이영민	남	1964.03	상무	상근	Samsung Research 기술전략팀 담당임원	SRPOL연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이영직	남	1967.08	상무	상근	SEHA법인장	SEH-P법인장	아주대(학사)	계열회사 임원	
이영춘	남	1967.10	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	56
이영학	남	1974.09	상무	상근	혁신센터 담당임원	혁신센터 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	1
이우용	남	1975.10	상무	상근	SEDA-P(M) 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담당부장	성균관대(학사)	계열회사 임원	1
이원용	남	1978.11	상무	상근	SAIT 기획지원팀장	SAIT 기획지원팀 수석	Massachusetts Inst. Of Tech.(박사)	계열회사 임원	1
이윤경	여	1979.09	상무	상근	Big Data센터 담당임원	Samsung Research AI센터 수석	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	25
이윤성	남	1971.09	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	25
이윤수	남	1975.11	상무	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Samsung Research AI센터 수석	Univ. of Maryland(박사)	계열회사 임원	25
이의형	남	1975.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당부장	서울대(박사)	계열회사 임원	1
이재영	남	1974.11	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	구주총괄 인사팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	36
이재환	남	1970.09	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEEG-S법인장	중앙대(석사)	계열회사 임원	
이재훈	남	1974.01	상무	상근	SERC 담당임원	SEUC법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	13
이정노	남	1971.02	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	49
이정삼	남	1967.06	상무	상근	TSP총괄 Global운영팀장	TSP총괄 기획팀장	인하대(학사)	계열회사 임원	
이정숙	여	1972.12	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 Mobile UX센터 담당임원	Berlin Art Univ.(석사)	계열회사 임원	40
이정원	남	1971.07	상무	상근	네트워크 Global운영팀장	네트워크 Global운영팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	25
이정자	여	1969.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
이정호	남	1974.11	상무	상근	한국총괄 People팀장	한국총괄 인사팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	13
이종규	남	1970.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	
이종민	남	1973.06	상무	상근	DS부문 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당임원	Univ. of Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	36
이종석	남	1973.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Apple, CPU Micro Architect	서강대(석사)	계열회사 임원	2
이종우	남	1978.04	상무	상근	System LSI 담당임원	System LSI 기반설계실 수석	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	49

이종포	남	1974.10	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	36
이종필	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	경북대(석사)	계열회사 임원	36
이종필	남	1973.11	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	충남대(석사)	계열회사 임원	36
이종호	남	1968.01	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
이종호	남	1976.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	TSP총괄 Package개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	36
이주형	남	1972.08	상무	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Samsung Research AI센터 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	40
이준	남	1972.04	상무	상근	중동총괄 지원팀장	SEF 담당임원	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	25
이준표	남	1971.06	상무	상근	생활가전 C&M사업팀장	생활가전 C&M사업팀 담당임원	Univ. of Maryland(박사)	계열회사 임원	14
이중원	남	1975.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	13
이지수	남	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
이지영	여	1976.08	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 CX실 수석	제주대(학사)	계열회사 임원	13
이지훈	남	1970.11	상무	상근	SECA법인장	SEA 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	36
이지훈	남	1976.02	상무	상근	구주총괄 지원팀장	SEG 담당임원	Northwestern Univ., Evanston(석사)	계열회사 임원	25
이진구	남	1973.02	상무	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	
이진석	남	1971.09	상무	상근	SIEL-S 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	Imperial College(박사)	계열회사 임원	52
이진우	남	1979.01	상무	상근	네트워크 시스템솔루션팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	13
이진욱	남	1972.01	상무	상근	DS부문 DS대외협력팀 담당임원	DS부문 상생협력센터 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	13
이진원	남	1973.03	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임원	생활가전 Global CS팀 담당부장	서울대(박사)	계열회사 임원	36
이창엽	남	1970.04	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	DS부문 중국총괄 담당부장	영남대(학사)	계열회사 임원	49
이창원	남	1972.03	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당임원	Pennsylvania State Univ.(석사)	계열회사 임원	13
이치훈	남	1969.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이한관	남	1971.09	상무	상근	SRA 담당임원	DS부문 인사팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	
이한용	남	1976.05	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	김앤장, Sr.Foreign Attorney	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	10
이한형	남	1968.09	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	

이현동	남	1972.02	상무	상근	SELV법인장	Lebanon지점장	영남대(학사)	계열회사 임원	13
이현우	남	1974.10	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	25
이현정	여	1971.11	상무	상근	한국총괄 마케팅팀 담당임원	한국총괄 Retail마케팅팀장	고려대(박사)	계열회사 임원	13
이현정	여	1977.12	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	1
이형우	남	1970.03	상무	상근	북미총괄 담당임원	Global Public Affairs팀 담당임원	Univ. of Texas, Austin(석사)	계열회사 임원	57
이호	남	1972.07	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	25
이호신	남	1970.12	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	49
이홍빈	남	1964.04	상무	상근	SSEC법인장	생활가전 Global제조팀 담당임원	명지대(학사)	계열회사 임원	
이화성	남	1970.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	49
이훈신	남	1974.09	상무	상근	Global EHS센터 담당임원	Dupont, APAC EHS Head	성균관대(석사)	계열회사 임원	12
이희수	여	1978.03	상무	상근	영상디스플레이 Customer Marketing팀 담당임원	Estee Lauder, Executive Director	Cornell Univ.(학사)	계열회사 임원	1
이희윤	남	1968.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	부산수산대(학사)	계열회사 임원	
임백준	남	1968.07	상무	상근	SRUK연구소장	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	
임산	남	1973.03	상무	상근	메모리 기획팀 담당임원	DS부문 감사팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	13
임성수	남	1978.11	상무	상근	반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	36
임성택	남	1970.10	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 C&M사업팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	49
임순규	남	1979.07	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성디스플레이 대형 지원팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	1
임아영	여	1974.09	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당부장	City Univ. of New York(석사)	계열회사 임원	25
임영수	남	1969.06	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	영남대(학사)	계열회사 임원	
임재우	남	1973.04	상무	상근	메모리 Design Platform개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	25
임전식	남	1969.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	전북대(학사)	계열회사 임원	49
임지훈	남	1972.12	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	30
임휘용	남	1965.02	상무	상근	인재개발원 담당임원	네트워크 인사팀장	서강대(학사)	계열회사 임원	
장경훈	남	1970.02	상무	상근	로봇사업팀 담당임원	Samsung Research Robot센터 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	

장세정	남	1974.04	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(학사)	계열회사 임원	36
장소연	여	1971.06	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	이화여대(학사)	계열회사 임원	49
장순복	여	1977.04	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	부산대(학사)	계열회사 임원	25
장실완	남	1973.02	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(학사)	계열회사 임원	49
장용	남	1970.03	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	49
장우영	남	1973.02	상무	상근	의료기기 DR사업팀장	의료기기 Global CS팀장	서울대(박사수료)	계열회사 임원	25
장욱	남	1973.11	상무	상근	SEJ 副법인장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	1
장윤희	남	1974.09	상무	상근	SIEL-P(N) 담당임원	Mobile eXperience Global제조센터 담당부장	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	1
장인갑	남	1975.06	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	13
장정렬	남	1977.01	상무	상근	SIEL-S 담당임원	네트워크 개발팀 수석	중앙대(석사)	계열회사 임원	1
장준희	남	1974.01	상무	상근	SEASA법인장	무선 전략마케팅실 담당부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	25
장지호	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	GCT, VP	서울대(박사)	계열회사 임원	29
장흥민	남	1972.06	상무	상근	동남아총괄 CS팀장	Global CS센터 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	1
저메인클라우제	남	1982.08	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당부장	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	1
전대호	남	1971.01	상무	상근	제조담당 People팀장	반도체연구소 인사팀장	아주대(석사)	계열회사 임원	25
전범준	남	1976.07	상무	상근	Foundry 지원팀 담당임원	Foundry 지원팀 담당부장	Southern Methodist Univ.(석사)	계열회사 임원	1
전병권	남	1967.02	상무	상근	SAMEX법인장	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	전북대(학사)	계열회사 임원	49
전상욱	남	1980.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	1
전성훈	남	1977.01	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	13
전소영	여	1974.05	상무	상근	SEA 담당임원	무선 지원팀 담당부장	Univ. of Texas, Dallas(석사)	계열회사 임원	25
전승수	남	1976.07	상무	상근	생활가전 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	25
전승훈	남	1971.08	상무	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	무선 차세대플랫폼센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	49
전지환	남	1977.10	상무	상근	System LSI 전략마케팅실 담당임원	System LSI 전략마케팅실 수석	Univ. Of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	1
전진규	남	1974.05	상무	상근	SENA 담당임원	SEAG 담당부장	한양대(학사)	계열회사 임원	25

전진완	남	1974.03	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	25
전형준	남	1972.10	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	4
정강일	남	1974.10	상무	상근	영상디스플레이 CX팀 담당임원	영상디스플레이 CX팀 담당부장	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	13
정광민	남	1971.07	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEPR법인장	부산대(학사)	계열회사 임원	13
정광섭	남	1970.04	상무	상근	재경팀 담당임원	삼성물산 경영정보팀 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	13
정광희	남	1971.08	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	Tsinghua Univ.(석사)	계열회사 임원	49
정기호	남	1973.08	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 CX팀 담당임원	한국해양대(학사)	계열회사 임원	13
정다운	남	1980.09	상무	상근	혁신센터 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	36
정무경	남	1971.05	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	36
정문일	남	1971.01	상무	상근	상생협력센터 담당임원	법무법인 지평, 전문위원	숭실대(학사)	계열회사 임원	15
정상인	남	1969.06	상무	상근	법무실 담당임원	DS부문 법무지원팀 담당임원	Case Western Reserve Univ.(석사)	계열회사 임원	
정상일	남	1967.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
정성원	남	1971.12	상무	상근	SCA법인장	Senegal지점장	고려대(학사)	계열회사 임원	13
정성원	남	1974.07	상무	상근	메모리 Global운영팀 담당임원	메모리 Global운영팀 담당부장	서울대(박사)	계열회사 임원	13
정승목	남	1969.05	상무	상근	중국전략협력실 담당임원	중국전략협력실 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	49
정승일	남	1973.08	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	경영혁신센터 담당부장	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	1
정승진	남	1972.11	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	25
정신영	여	1973.03	상무	상근	Foundry 품질팀 담당임원	Foundry 제품기술팀 수석	Univ. of Florida(석사)	계열회사 임원	13
정연일	남	1975.06	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	DS부문 기획팀 담당부장	인하대(학사)	계열회사 임원	1
정영환	남	1971.08	상무	상근	SCIC 담당임원	SET법인장	복단대(석사)	계열회사 임원	1
정용덕	남	1976.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	25
정원석	남	1971.07	상무	상근	상생협력센터 담당임원	감사팀 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	36
정원철	남	1973.12	상무	상근	반도체연구소 Logic TD실 담당임원	반도체연구소 Logic TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	36
정유진	여	1970.06	상무	상근	SENA법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	49

정윤찬	남	1968.09	상무	상근	베트남복합단지 담당임원	감사팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
정의옥	남	1968.07	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry Global운영팀장	인하대(학사)	계열회사 임원	
정의철	남	1969.12	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	Seattle Pacific Univ.(학사)	계열회사 임원	36
정인호	남	1975.02	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	DS부문 지원팀 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	36
정인호	남	1970.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	36
정인희	여	1974.09	상무	상근	지속가능경영추진센터 담당임원	LG화학, Expert Advisor	Imperial College(석사)	계열회사 임원	13
정일규	남	1968.05	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	49
정일룡	남	1970.10	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	DS부문 재경팀 담당부장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	13
정재용	남	1973.09	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	25
정준수	남	1970.09	상무	상근	SEEG-P법인장	SERK법인장	영남대(학사)	계열회사 임원	13
정지은	여	1974.05	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
정진국	남	1975.10	상무	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	서강대(박사)	계열회사 임원	49
정한기	남	1976.05	상무	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임원	TSP총괄 Package개발실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	1
정혁준	남	1974.09	상무	상근	생활가전 광주지원센터장	생활가전 광주지원센터 담당부장	전남대(학사)	계열회사 임원	13
정혜순	여	1975.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 수석	부산대(학사)	계열회사 임원	
정희재	남	1971.04	상무	상근	생활가전 디자인팀 담당임원	생활가전 디자인팀 수석	서울시립대(학사)	계열회사 임원	25
제이콥	남	1978.11	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	DS부문 중국총괄 VP	中國科學技術大學(석사)	계열회사 임원	36
제임스휘슬러	남	1972.10	상무	상근	SEA 담당임원	SEA SVP	Ward Melivle High School(고교)	계열회사 임원	13
제희원	남	1978.09	상무	상근	System LSI CP개발실 담당임원	System LSI CP개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	1
조강욱	남	1977.08	상무	상근	동남아총괄 지원팀장	사업지원T/F 담당부장	성균관대(학사)	계열회사 임원	1
조민정	여	1974.07	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	49
조성일	남	1973.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	49
조성제	남	1977.04	상무	상근	People팀 담당임원	People팀 담당부장	Michigan State Univ.(석사)	계열회사 임원	1
조성훈	남	1970.11	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	SELS법인장	건국대(박사)	계열회사 임원	

조성훈	남	1976.01	상무	상근	생활가전 People팀장	생활가전 인사팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	36
조성희	남	1974.08	상무	상근	영상디스플레이 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	서강대(석사)	계열회사 임원	1
조신형	남	1972.10	상무	상근	DS부문 커뮤니케이션팀 담당임원	DS부문 커뮤니케이션팀 담당부장	서강대(학사)	계열회사 임원	36
조영석	남	1976.11	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	1
조영진	남	1979.06	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	1
조용호	남	1970.03	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 미주총괄 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
조욱래	남	1972.03	상무	상근	제조담당 지원팀장	DS부문 재경팀 담당임원	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	25
조유미	여	1971.09	상무	상근	DS부문 글로벌마컴팀장	메모리 전략마케팅실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	25
조유성	남	1971.06	상무	상근	Global EHS센터 담당임원	Global EHS센터 담당부장	서울과학기술대(석사)	계열회사 임원	25
조익현	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	25
조종욱	남	1969.08	상무	상근	상생협력센터 담당임원	삼성바이오에피스 인사팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	13
조지호	남	1972.04	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	부산대(학사)	계열회사 임원	13
조철민	남	1971.03	상무	상근	System LSI AP개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	36
조철용	남	1975.08	상무	상근	영상디스플레이 디자인팀장	영상디스플레이 디자인팀 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	1
조철형	남	1971.03	상무	상근	SEDA-P(M)공장장	글로벌기술센터 담당임원	충북대(학사)	계열회사 임원	25
조철호	남	1971.07	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	
조학주	남	1969.03	상무	상근	반도체연구소 Logic TD실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
조현덕	남	1974.05	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당부장	경북대(석사)	계열회사 임원	1
조호근	남	1977.11	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	Univ. Of California, LA(석사)	계열회사 임원	1
조훈영	남	1973.08	상무	상근	Samsing Research Global AI센터 담당임원	NC Soft, Lab장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	11
조희권	남	1976.06	상무	상근	SEA 담당임원	SEA 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	25
존테일러	남	1968.04	상무	상근	SAS 담당임원	SAS VP	Univ. of New Hampshire(학사)	계열회사 임원	49
주명휘	남	1963.08	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	DS부문 중국총괄 VP	上海大(석사)	계열회사 임원	
주재완	남	1968.02	상무	상근	Global CS센터 담당임원	중국총괄 CS팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	

주현태	남	1972.12	상무	상근	생활가전 Global제조팀 담당임원	생활가전 Global운영팀 담당임원	울산대(학사)	계열회사 임원	13
주형빈	남	1973.06	상무	상근	SESAR법인장	SEIL법인장	경희대(학사)	계열회사 임원	25
지송하	여	1973.01	상무	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	이화여대(학사)	계열회사 임원	
지우정	남	1967.11	상무	상근	SEEG-S법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
지혜령	여	1972.04	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	
진영두	남	1972.06	상무	상근	Mobile eXperience사업부 개발실 담당임원	Mobile eXperience사업부 개발실 수석	동아대(학사)	계열회사 임원	1
진인식	남	1971.03	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	서강대(박사)	계열회사 임원	25
차경환	남	1972.04	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SEAU법인장	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
차도헌	남	1973.04	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	36
차이위엔천	남	1968.01	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	TEXAS INSTRUMENTS, Selection Manager	국립대만대(석사)	계열회사 임원	3
천기철	남	1970.09	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	메모리 품질보증실 담당임원	Univ. Of Minnesota, Twin Cities(박사)	계열회사 임원	25
천상필	남	1969.05	상무	상근	Global Public Affairs팀 담당임원	구주총괄 대외협력팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	36
최경수	남	1971.12	상무	상근	감사팀 담당임원	상생협력센터 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	25
최기화	남	1969.03	상무	상근	네트워크 시스템솔루션팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	
최동준	남	1972.05	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	글로벌마케팅센터 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	
최병철	남	1971.06	상무	상근	영상디스플레이 Global운영팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	25
최병희	남	1970.05	상무	상근	SETK법인장	SEB법인장	경북대(학사)	계열회사 임원	25
최삼종	남	1973.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	한양대(박사)	계열회사 임원	25
최서림	남	1972.02	상무	상근	DS부문 감사팀 담당임원	설비기술연구소 기획지원팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	13
최선일	남	1971.11	상무	상근	System LSI AP개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 Master	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	13
최성욱	남	1969.02	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	삼성전자공과대학(전문대)	계열회사 임원	
최순	남	1970.10	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEA 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
최승림	남	1972.02	상무	상근	CIS총괄 지원팀장	재경팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	13
최영	남	1969.07	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	49

최영돈	남	1972.12	상무	상근	메모리 Design Platform개발실 담당임원	메모리 Design Platform개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	13
최영일	남	1973.08	상무	상근	SAS 담당임원	Foundry 지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	25
최영준	남	1967.09	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	LG전자, 자문역	Univ. of Minnesota, Twin Cities(석사)	계열회사 임원	29
최원경	여	1973.08	상무	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임원	TSP총괄 Package개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	36
최유중	남	1971.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	인사팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
최유진	여	1979.06	상무	상근	영상디스플레이 UX팀장	영상디스플레이 UX팀 수석	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	13
최윤석	남	1974.09	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	TSP총괄 Package개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	25
최인수	남	1973.02	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	1
최일환	남	1972.11	상무	상근	Big Data센터 담당임원	Big Data센터 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	13
최장석	남	1973.06	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 수석	충남대(학사)	계열회사 임원	1
최재혁	남	1974.06	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	생활가전 지원팀 담당부장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	25
최정연	남	1974.11	상무	상근	메모리 Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	49
최정화	남	1973.01	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	1
최종무	남	1975.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	아주대(석사)	계열회사 임원	25
최진필	남	1973.04	상무	상근	SCS 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	36
최창훈	남	1973.08	상무	상근	SIEL-S 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당부장	인하대(학사)	계열회사 임원	13
최창훈	남	1972.02	상무	상근	제조담당 담당임원	생산기술연구소 설비개발실 담당임원	서울시립대(박사)	계열회사 임원	49
최철민	남	1973.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
최철환	남	1974.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	1
최혁승	남	1976.04	상무	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 수석	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	1
최현호	남	1979.06	상무	상근	SAIT Material Research Center 담당임원	종합기술원 Material연구센터 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	25
최호규	남	1968.12	상무	상근	글로벌마케팅실 CX·MDE센터 담당임원	CX·MDE센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	25
추민기	남	1975.10	상무	상근	SECE법인장	SEUZ법인장	서강대(학사)	계열회사 임원	1
추민수	남	1973.10	상무	상근	SEPCO법인장	SENZ법인장	Univ. of California, LA(석사)	계열회사 임원	13

카리야타 카시	남	1969.02	상무	상근	DS부문 DSRJ 담당임원	TDK, 총괄부장	Tohoku Univ.(박사)	계열회사 임원	2
코너피어스	남	1970.04	상무	상근	SEPOL법인장	SEUK 담당임원	Univ. of Dublin(석사)	계열회사 임원	49
편정우	남	1970.10	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
하경수	남	1979.04	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	13
하헌재	남	1970.08	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	DS부문 People팀 담당부장	광운대(학사)	계열회사 임원	1
한규희	남	1974.01	상무	상근	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	생산기술연구소 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	13
한글라라	여	1976.02	상무	상근	영상디스플레이 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 담당부장	경희대(학사)	계열회사 임원	1
한상섭	남	1972.04	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Global CS센터 담당부장	광운대(석사)	계열회사 임원	13
한상연	남	1969.01	상무	상근	반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
한상욱	남	1974.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 수석	Univ. of Texas at Austin(박사)	계열회사 임원	1
한우섭	남	1967.01	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
한의택	남	1974.02	상무	상근	SIEL-S 담당임원	SME법인장	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	36
한인국	남	1964.11	상무	상근	창의개발센터 담당임원	Samsung Research 창의개발센터장	한양대(학사)	계열회사 임원	
한장수	남	1970.02	상무	상근	북미총괄 법무지원팀장	무선 지원팀 담당임원	State Univ. of New York, Buffalo(박사)	계열회사 임원	
한정남	남	1973.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	49
한종호	남	1976.01	상무	상근	SEG 담당임원	SEI 담당임원	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	25
한진규	남	1973.12	상무	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	Samsung Research 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	36
한진우	남	1980.07	상무	상근	반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	NASA, Senior Scientist	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	8
함선규	남	1970.01	상무	상근	중남미총괄 지원팀장	SRA 담당임원	Washington Univ. in St. Louis(석사)	계열회사 임원	49
허욱	남	1972.05	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당부장	Waseda Univ.(학사)	계열회사 임원	1
허일정	남	1978.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS연구소 담당임원	한국화학연구원 환경자원연구센터장	포항공대(박사)	계열회사 임원	2
허준	남	1972.08	상무	상근	SEA 담당임원	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당부장	한양대(석사)	계열회사 임원	1
허준영	남	1977.02	상무	상근	네트워크 People팀장	구주총괄 인사팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	13
허준회	남	1979.03	상무	상근	System LSI CP개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	18

허지영	남	1970.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	
허진욱	남	1971.09	상무	상근	북미총괄 CS팀장	ECSO장	한양대(박사)	계열회사 임원	25
허태영	남	1970.11	상무	상근	글로벌마케팅실 CX·MDE센터 담당임원	영상디스플레이 CX팀장	Univ. of California, LA(학사)	계열회사 임원	
허훈	남	1974.08	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	25
현대은	남	1975.10	상무	상근	영상디스플레이 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	25
현상진	남	1972.02	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	49
현정혁	남	1977.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	성균관대(학사)	계열회사 임원	1
홍경선	남	1970.08	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	49
홍기준	남	1971.05	상무	상근	System LSI AP설계실 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
홍순상	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	무선 서비스Biz팀 담당부장	연세대(학사)	계열회사 임원	13
홍연석	남	1972.01	상무	상근	SEIN-P법인장	무선 Global제조센터 담당부장	경북대(석사)	계열회사 임원	13
홍영주	남	1977.08	상무	상근	네트워크 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	13
홍유석	남	1972.12	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 책임변호사	Univ. of Notre Dame(석사)	계열회사 임원	49
홍정호	남	1969.02	상무	상근	의료기기 지원팀장	전장사업팀 담당임원	Univ. of Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	
홍주선	남	1971.10	상무	상근	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	경희대(석사)	계열회사 임원	49
홍준식	남	1971.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	전북대(석사)	계열회사 임원	25
홍희일	남	1970.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	36
황근철	남	1973.03	상무	상근	네트워크 시스템솔루션팀장	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	36
황근하	남	1970.05	상무	상근	영상디스플레이 Global운영팀 副팀장	영상디스플레이 Global제조팀 담당임원	아주대(학사)	계열회사 임원	
황보용	남	1970.10	상무	상근	창의개발센터장	신사업T/F 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
황성훈	남	1969.07	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Global CS센터 담당부장	한양대(석사)	계열회사 임원	49
황영삼	남	1977.10	상무	상근	동남아총괄 People팀장	People팀 담당부장	한양대(학사)	계열회사 임원	1
황완구	남	1972.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	삼성바이오로직스 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	13
황용호	남	1975.10	상무	상근	Samsung Research Security & Privacy팀장	Samsung Research Security팀 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	36

황인철	남	1977.11	상무	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	Samsung Research Global AI센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	49
황일권	남	1973.12	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	1
황찬수	남	1975.07	상무	상근	네트워크 시스템솔루션팀 담당임원	Tinoq, Co-Founder	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	29
황호송	남	1967.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원	Imperial College(박사)	계열회사 임원	25
황희돈	남	1974.01	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	36

※ 미등기임원 소유주식수는 작성기준일 현재 보통주(의결권 있는 주식) 98,147,153주(이재용 회장 97,414,196주 등),
우선주(의결권 없는 주식) 182,722주(이재용 회장 137,757주 등)이며, 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)의 '임원・주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참고하시기 바랍니다.

※ 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 재직기간은 기업공시서식 작성기준에 따라 미등기임원으로서 5년 이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 기재를 생략하였습니다.

※ 미등기임원의 타회사 겸직 현황은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'의 '4. 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황'을 참고하기 바랍니다.

※ 공시대상 기간 중 인사팀의 명칭이 People팀으로 변경되었습니다.

마. 미등기임원의 변동

작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변동된 미등기임원은 다음과 같습니다.

구분 (사유)	성명	성별	출생연월	직위	담당업무	최대주주와의 관계
임원선임	강신봉	남	1970.01	부사장	글로벌마케팅실 D2C센터장	계열회사 임원
	린준청	남	1970.07	부사장	AVP사업팀 AVP개발실 담당임원	계열회사 임원
	이정환	남	1971.05	부사장	DS부문 법무지원팀장	계열회사 임원
	권정현	남	1980.03	상무	Samsung Research Robot센터 담당임원	계열회사 임원
	김현덕	남	1981.06	상무	혁신센터 담당임원	계열회사 임원
	송영근	남	1970.01	상무	글로벌 제조&인프라총괄 AVP제조기술센터 담당임원	계열회사 임원
	윤석호	남	1973.04	상무	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	계열회사 임원
	윤성호	남	1974.01	상무	생활가전 선행개발팀 담당임원	계열회사 임원
	조미선	남	1980.04	상무	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	계열회사 임원
	최청호	남	1976.11	상무	법무실 담당임원	계열회사 임원
	헨릭얀손	남	1975.03	상무	네트워크 신사업전략T/F장	계열회사 임원
임원사임	김도형	남	1964.10	부사장	구주총괄 대외협력팀장	계열회사 임원
	김준	남	1964.02	부사장	SAIT Air Science Research Center 담당임원	계열회사 임원
	양태종	남	1970.11	부사장	Mobile eXperience Digital Health팀 담당임원	계열회사 임원
	이흥모	남	1962.10	부사장	Mobile eXperience 개발실 담당임원	계열회사 임원
	길태호	남	1977.11	상무	Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원	계열회사 임원
	김태영	남	1968.04	상무	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	계열회사 임원
	도성대	남	1966.12	상무	서남아총괄 담당임원	계열회사 임원
	박종진	남	1970.12	상무	상생협력센터 담당임원	계열회사 임원
	이영민	남	1964.03	상무	Samsung Research 기술전략팀 담당임원	계열회사 임원
	이영춘	남	1967.10	상무	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	계열회사 임원
	이진석	남	1971.09	상무	SIEL-S 담당임원	계열회사 임원
	정상인	남	1969.06	상무	법무실 담당임원	계열회사 임원
	한인국	남	1964.11	상무	창의개발센터 담당임원	계열회사 임원
	황찬수	남	1975.07	상무	네트워크 시스템솔루션팀 담당임원	계열회사 임원

※ 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

바. 직원 등의 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원)

직원										소속 외 근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균 근속연수	연간급여 총 액	1인평균 급여액	남	여	계	
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자		합 계							
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)								
DX	남	38,023	-	333	-	38,356	16.0	-	-				-
DX	여	11,948	223	94	-	12,042	12.8	-	-				-
DS	남	51,079	-	126	-	51,205	10.5	-	-				-
DS	여	19,777	181	24	-	19,801	10.7	-	-	26,721	11,771	38,492	-
성별합계	남	89,102	-	459	-	89,561	12.9	12,408,336	143				-
성별합계	여	31,725	404	118	-	31,843	11.5	3,189,421	110				-
합 계		120,827	404	577	-	121,404	12.5	15,597,757	135				-

※ 본사 기준이며, 휴직자는 포함하고 등기임원 11명(사내이사 5명, 사외이사 6명)은 제외한 기준입니다.

※ 연간급여 총액 및 1인평균 급여액은「소득세법」제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준(근로소득공제 반영전)입니다.

※ 1인 평균급여액은 평균 재직자 115,231명(남 86,373명, 여 28,858명) 기준으로 산출하였습니다.

사. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원	918	646,246	703	-

※ 인원수는 작성기준일 현재 재임 중인 임원을 기준으로 하였으며, '미등기임원 현황'의 임원 중 국내에서 근로소득이 발생하지 않은 인원은 제외하였습니다.

※ 연간급여 총액과 1인평균 급여액은「소득세법」제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.

※ 연간급여 총액은 성과급 지급 실적을 포함하고 있으며, 성과급 지급 시점은 매년 상이합니다.

※ 1인 평균급여액은 평균 재직자 919명을 기준으로 산출하였습니다.

2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수

<이사・감사 전체의 보수현황>

(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고
등기이사	5	-	-
사외이사	3	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-
계	11	41,000	-

※ 인원수는 주주총회 승인일 기준입니다.
※ 주주총회 승인금액은「상법」제388조와 당사 정관에 따라 2021년 3월 17일 주주총회 결의를 통해 승인받은
이사(퇴임이사 포함)의 보수 한도입니다.

(2) 보수지급금액

(2-1) 이사・감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
11	30,024	2,729	-

※「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한
등기이사・사외이사・감사위원회 위원에게 지급된 금액 기준입니다.
※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.
※ 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사의 미등기임원 재임 시 보수 금액을 포함하여 산정하였으며,
「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.
※ 주식매수선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

(2-2) 유형별

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	28,930	5,786	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	3	449	150	-
감사위원회 위원	3	644	215	-
감사	-	-	-	-

※「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한
등기이사・사외이사・감사위원회 위원에게 지급된 금액 기준입니다.
※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.
※ 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사의 미등기임원 재임 시 보수 금액을 포함하여 산정하였으며,
「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.
※ 2022년 3월 16일 주주총회를 통해 감사위원회 위원으로 선임된 김종훈 사외이사의 보수는
감사위원회 위원 보수총액에 포함하여 기재하였습니다.
※ 주식매수선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

(3) 보수지급기준

당사는 주주총회의 승인을 받은 이사보수 한도 금액 내에서 당사 임원처우규정 및 사외이사 처우규정에 따라 이사의 보수를 지급하고 있습니다.

구 분	보수지급기준
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	・급여: 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무 수행 결과 등을 고려하여 보수를 결정 ・설・추석상여: 각 월급여 100% 지급 ・목표인센티브: 부서별 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 월급여의 0~200% 내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ・성과인센티브: 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ・장기성과인센티브: ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급 ・복리후생: 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원・건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	・급여: 사외이사 처우규정에 따라 위임업무의 성격 등을 고려하여 보수를 결정 ・복리후생: 사외이사 처우규정에 따라 의료지원・건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
감사위원회 위원	・급여: 사외이사 처우규정에 따라 위임업무의 성격 등을 고려하여 보수를 결정 ・복리후생: 사외이사 처우규정에 따라 의료지원・건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공

<보수지급금액 5억원 이상인 이사・감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
한종희	대표이사	4,635	-
경계현	대표이사	2,953	-
노태문	이사	4,100	-
박학규	이사	1,946	-
이정배	이사	2,802	-
김기남	회장(前대표이사)	5,672	-
김현석	고문(前대표이사)	3,133	-
고동진	고문(前대표이사)	3,689	-

※「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임
또는 퇴임한 등기이사・사외이사・감사위원회 위원 기준입니다.
※ 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사의 미등기임원 재임 시 보수 금액을 포함하여
산정하였으며,「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
대표이사 한종희	근로소득	급 여	1,229	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(부회장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 77백만원, 3월 170백만원, 4월부터 12월까지 매월 101백만원을 지급
		상 여	3,228	・설/추석상여 : 각 월급여 100% 지급 ・목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ・성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ・장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급

				※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 주가상승률 54.8%를 달성하였고, 2022년 DX 부문 매출액 182.5조원, 영업이익 12.7조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 전사 공통 플랫폼 고도화를 통한 DX 부문 제품 경쟁력 제고를 이끌었고, B2B 및 서비스 사업 강화로 미래경쟁력 제고에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	179	・복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원・건강검진, 차량지원, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
대표이사 경계현	근로 소득	급 여	1,019	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 53백만원, 3월 170백만원, 4월부터 12월까지 매월 83백만원을 지급
		상 여	1,795	・설/추석상여 : 각 월급여 100% 지급 ・목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ・성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ・장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 주가상승률 54.8%를 달성하였고, 2022년 DS 부문 매출액 98.5조원, 영업이익 23.8조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 최선단 12나노급 DRAM 개발, 세계 최초 3나노 파운드리 양산, 업계 최초 2억화소 이미지센서 개발 등을 통해 반도체 사업 미래 경쟁력 제고에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	139	・복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원・건강검진, 차량지원, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
이 사 노태문	근로 소득	급 여	1,144	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 82백만원, 3월 131백만원, 4월부터 12월까지 매월 94백만원을 지급
		상 여	2,822	・설/추석상여 : 각 월급여 100% 지급 ・목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ・성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ・장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급

				※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 주가상승률 54.8%를 달성하였고, 2022년 MX사업 매출액 115.4조원, 영업이익 10.5조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 모바일 분야 기술 혁신과 지역별 판매전략 강화를 통해 리더십 수성을 이끌었고, Risk 관리를 통한 브랜드 이미지 개선에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	135	・복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원・건강검진, 차량지원, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
이 사 박학규	근로 소득	급 여	889	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 67백만원, 3월 94백만원, 4월부터 12월까지 매월 74백만원을 지급
		상 여	881	・설/추석상여 : 각 월급여 100% 지급 ・목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ・성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ・장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 주가상승률 54.8%를 달성하였고, 2022년 DX 부문 매출액 182.5조원, 영업이익 12.7조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 글로벌 경제 위기 상황에서도 사업리스크 선제적 관리, 자원 운영 고도화로 견실한 실적을 이끌었고, 중장기 투자 자원을 효과적으로 배분하여 미래 성장 동력 확보에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	177	・복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원・건강검진, 차량지원, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
이 사 이정배	근로 소득	급 여	841	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 55백만원, 3월 110백만원, 4월부터 12월까지 매월 69백만원을 지급
		상 여	1,770	・설/추석상여 : 각 월급여 100% 지급 ・목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ・성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ・장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로

				주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 주가상승률 54.8%를 달성하였고, 2022년 메모리 사업 매출액 68.5조원, 영업이익 20.8조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 DRAM/Flash 시장 리더십 수성과 최선단 12나노급 DRAM, 8세대 V-NAND 개발 등 메모리 제품 미래 경쟁력 제고에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	191	・복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원・건강검진, 차량지원, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
김기남	근로소득	급 여	1,723	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(회장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 144백만원을 지급
		상 여	3,735	・설/추석상여 : 각 월급여 100% 지급 ・목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ・성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ・장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 주가상승률 54.8%를 달성하였고, 2022년 DS 부문 매출액 98.5조원, 영업이익 23.8조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 신기술 확보, 중장기 R&D 전략 제시 등을 통해 경영에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	214	・복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원・건강검진, 차량지원, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
김현석	근로소득	급 여	878	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장급), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 73백만원을 지급
		상 여	2,122	・설/추석상여 : 각 월급여 100% 지급 ・목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ・성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ・장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 주가상승률 54.8%를 달성하였고, 2022년 DX 부문 매출액 182.5조원, 영업이익 12.7조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 미래기술 담당으로서 신사업분야 발굴, 미래 변화에 대한

				인사이트 제공 등을 통해 경영에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	132	・복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원・건강검진, 차량지원, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
고동진	근로소득	급 여	936	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장급), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 78백만원을 지급
		상 여	2,659	・설/추석상여 : 각 월급여 100% 지급 ・목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ・성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ・장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 주가상승률 54.8%를 달성하였고, 2022년 DX 부문 매출액 182.5조원, 영업이익 12.7조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 인재혁신 담당으로서 차세대 경영진 발굴, 회사의 인적자원 역량 제고 등을 통해 경영에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	94	・복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원・건강검진, 차량지원, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
정은승	고문	8,073	-
김기남	회장	5,672	-
승현준	사장	5,580	-
이원진	사장	5,453	-
전준영	고문	5,251	-

※ 보수총액은「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
정은승	근로소득	급 여	942	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장급), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 79백만원을 지급
		상 여	1,954	・설/추석상여 : 각 월급여 100% 지급 ・목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ・성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ・장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 주가상승률 54.8%를 달성하였고, 2022년 DS 부문 매출액 98.5조원, 영업이익 23.8조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 DS 부문 기술 개발 전략 수립, 차세대 연구 강화 등 반도체 미래 경쟁력 제고에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	192	・복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원・건강검진, 차량지원, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		4,985	・임원퇴직금지급규정(이사회 결의)에 의거 퇴직기준급여 79백만원, 임원 근무기간 19년

			에 지급배수(1~3.5)를 곱하여 산출
	기타소득	-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
김기남	근로소득	급 여	1,723	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(회장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 144백만원을 지급
		상 여	3,735	・설/추석상여 : 각 월급여 100% 지급 ・목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ・성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ・장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 주가상승률 54.8%를 달성하였고, 2022년 DS 부문 매출액 98.5조원, 영업이익 23.8조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 신기술 확보, 중장기 R&D 전략 제시 등을 통해 경영에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	214	・복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원・건강검진, 차량지원, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
승현준	근로소득	급 여	2,116	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 평균 176백만원을 지급
		상 여	3,351	・설/추석상여 : 평균 91백만원을 지급 ・목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정한 지급률과 개별 기준금액에 따라 산정한 인센티브를 연 2회 분할지급 ・성과인센티브 : 개인의 연간 업무목표(AI/Security/IoT 등 핵심 기술 및 선행 IP확보, S/W경쟁력 강화 등) 달성도에 근거하여 대표이사가 결정한 지급률과 개별 기준금액에 따라 산정한 인센티브를 연 2회 지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2022년 DX 부문 매출액 182.5조원, 영업이익 12.7조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 신기술 확보, 대외 위상 강화 등을 통해 경영에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	112	・복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원・건강검진, 차량지원,

				단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
이원진	근로소득	급 여	1,999	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 평균 167백만원을 지급
		상 여	3,357	・설/추석상여 : 평균 153백만원을 지급 ・목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정한 지급률과 개별 기준금액에 따라 산정한 인센티브를 연 2회 분할지급 ・성과인센티브 : 개인의 연간 업무목표(게임/미디어/광고 서비스 강화, 서비스 파트너십 강화 등) 달성도에 근거하여 대표이사가 결정한 지급률과 개별 기준금액에 따라 산정한 인센티브를 연 1회 지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2022년 VD사업 매출액 33.3조원, 영업이익 1.7조원을 달성한 점과 MX사업의 관련 업무 매출액, 담당 서비스사업 성장률을 고려하였고, 비계량 지표 관련하여 기존의 제품 중심의 사업 구조에서 벗어나 서비스 기반의 신성장 동력을 확보하여 경영에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	97	・복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원・건강검진, 차량지원, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
전준영	근로소득	급 여	643	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(부사장급), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 54백만원을 지급
		상 여	1,173	・설/추석상여 : 각 월급여 100% 지급 ・목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ・성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ・장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 주가상승률 54.8%를 달성하였고, 2022년 DS 부문 매출액 98.5조원, 영업이익 23.8조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 DS 부문 설비 및 원자재의 안정적 공급망 구축, FAB설비 이원화 비중 확대에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권	-	-

		행사이익		
		기타 근로소득	83	・복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원・건강검진, 차량지원, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		3,352	・임원퇴직금지급규정(이사회 결의)에 의거 퇴직기준급여 54백만원, 임원 근무기간 19년에 지급배수(1~3.5)를 곱하여 산출
	기타소득		-	-

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황

(1) 이사・감사에게 부여한 주식매수선택권

2022년말 현재 이사・감사・업무집행지시자 등에게 부여한 미행사 주식매수선택권(누적기준)은 없습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사	5	-	-
사외이사	3	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-
업무집행지시자	1,148	-	-
계	1,159	-	-

※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단에 소속된 회사(요약)

당사는「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 삼성그룹에 속한 계열회사로서, 2022년말 현재 삼성그룹에는 전년말 대비 4개 회사(㈜에스에이치피코퍼레이션, 성균관대학교기술지주㈜, 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜, ㈜희망별숲)가 증가하여 63개의 국내 계열회사가 있습니다. 이중 상장사는 당사를 포함하여 총 16개사이며 비상장사는 47개사입니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수		
	상장	비상장	계
삼성	16	47	63

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

※ 2022년중 계열회사에 추가된 4개 회사 중 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜와 ㈜희망별숲은 2023년 1월에 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 상호출자제한기업집단으로 편입되었습니다.

나. 계열회사간 출자현황

[국내]

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : %)

피출자회사 \ 출자회사	삼성물산㈜	삼성바이오로직스㈜	삼성생명보험㈜	삼성에스디아이㈜	삼성에스디에스㈜	삼성엔지니어링㈜	삼성전기㈜	삼성전자㈜	삼성중공업㈜	삼성증권㈜	삼성카드㈜	삼성화재해상보험㈜	㈜멀티캠퍼스
삼성물산㈜		43.1	19.3		17.1	7.0		5.0	0.1				
삼성바이오로직스㈜													
삼성생명보험㈜	0.1	0.1		0.1	0.0	0.1	0.2	8.7	2.9	29.4	71.9	15.0	0.0
삼성에스디아이㈜						11.7			0.4				
삼성에스디에스㈜													47.2
삼성전기㈜									2.1				
삼성전자㈜		31.2		19.6	22.6		23.7		15.2				
삼성중공업㈜													
삼성증권㈜													
삼성카드㈜													
삼성화재해상보험㈜						0.2		1.5					
㈜에스원													
㈜제일기획									0.1				
㈜호텔신라													
삼성디스플레이㈜													
삼성자산운용㈜													
삼성전자서비스㈜													
㈜미라콤아이앤씨													
㈜삼성글로벌리서치													15.2
Harman International Industries, Inc.													
계	0.1	74.3	19.3	19.7	39.7	19.0	23.8	15.2	20.8	29.4	71.9	15.0	62.4

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : %)

피출자회사 \ 출자회사	㈜에스원	㈜제일기획	㈜호텔신라	삼성디스플레이㈜	삼성메디슨㈜	삼성바이오에피스㈜	삼성벤처투자㈜	삼성생명서비스손해사정㈜	삼성선물㈜	삼성액티브자산운용㈜	삼성에스알에이자산운용㈜	삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜	삼성웰스토리㈜
삼성물산㈜							16.7						100.0
삼성바이오로직스㈜						100.0							
삼성생명보험㈜	5.4	0.4	7.5					99.8			100.0	19.7	
삼성에스디아이㈜	11.0		0.1	15.2			16.3						
삼성에스디에스㈜													
삼성전기㈜							17.0						
삼성전자㈜		25.2	5.1	84.8	68.5		16.3						
삼성중공업㈜							17.0						
삼성증권㈜	1.3		3.1				16.7		100.0			3.6	
삼성카드㈜	1.9	3.0	1.3										
삼성화재해상보험㈜	1.0											18.9	
㈜에스원													
㈜제일기획													
㈜호텔신라													
삼성디스플레이㈜													
삼성자산운용㈜										100.0			
삼성전자서비스㈜													
㈜미라콤아이앤씨													
㈜삼성글로벌리서치													
Harman International Industries, Inc.													
계	20.7	28.6	17.1	100.0	68.5	100.0	100.0	99.8	100.0	100.0	100.0	42.1	100.0

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : %)

피출자회사 \ 출자회사	삼성자산운용㈜	삼성전자로지텍㈜	삼성전자서비스㈜	삼성전자서비스씨에스㈜	삼성전자판매㈜	삼성카드고객서비스㈜	삼성코닝어드밴스드글라스(유)	삼성헤지자산운용㈜	삼성화재서비스손해사정㈜	삼성화재애니카손해사정㈜	세메스㈜	수원삼성축구단㈜
삼성물산㈜												
삼성바이오로직스㈜												
삼성생명보험㈜	100.0											
삼성에스디아이㈜												
삼성에스디에스㈜												
삼성전기㈜												
삼성전자㈜		100.0	99.3		100.0						91.5	
삼성중공업㈜												
삼성증권㈜												
삼성카드㈜						100.0						
삼성화재해상보험㈜									100.0	100.0		
㈜에스원												
㈜제일기획												100.0
㈜호텔신라												
삼성디스플레이㈜							50.0					
삼성자산운용㈜								100.0				
삼성전자서비스㈜				100.0								
㈜미라콤아이앤씨												
㈜삼성글로벌리서치												
Harman International Industries, Inc.												
계	100.0	100.0	99.3	100.0	100.0	100.0	50.0	100.0	100.0	100.0	91.5	100.0

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : %)

피출자회사 \ 출자회사	스테코㈜	신라에이치엠㈜	에스디플렉스㈜	에스비티엠㈜	에스원씨알엠㈜	에스유머티리얼스㈜	에스코어㈜	에스티엠㈜	에이치디씨신라면세점㈜	오픈핸즈㈜	제일패션리테일㈜	㈜미라콤아이앤씨
삼성물산㈜											100.0	
삼성바이오로직스㈜												
삼성생명보험㈜												
삼성에스디아이㈜			50.0					100.0				
삼성에스디에스㈜							81.8			100.0		83.6
삼성전기㈜												
삼성전자㈜	70.0											
삼성중공업㈜												
삼성증권㈜												
삼성카드㈜												
삼성화재해상보험㈜												
㈜에스원					100.0		0.6					0.6
㈜제일기획							5.2					5.4
㈜호텔신라		100.0		100.0					50.0			
삼성디스플레이㈜						50.0						
삼성자산운용㈜												
삼성전자서비스㈜												
㈜미라콤아이앤씨							0.5					
㈜삼성글로벌리서치												
Harman International Industries, Inc.												
계	70.0	100.0	50.0	100.0	100.0	50.0	88.1	100.0	50.0	100.0	100.0	89.6

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : %)

피출자회사 \ 출자회사	㈜삼성글로벌리서치	㈜삼성라이온즈	㈜삼성생명금융서비스보험대리점	㈜삼성화재금융서비스보험대리점	㈜삼우종합건축사사무소	㈜서울레이크사이드	㈜시큐아이	㈜씨브이네트	㈜에스에이치피코퍼레이션	㈜하만인터내셔널코리아	㈜휴먼티에스에스	㈜희망별숲
삼성물산㈜	1.0				100.0	100.0	8.7	40.1				
삼성바이오로직스㈜												
삼성생명보험㈜	14.8		100.0									
삼성에스디아이㈜	29.6											
삼성에스디에스㈜							56.5	9.4				
삼성전기㈜	23.8											
삼성전자㈜	29.8											100.0
삼성중공업㈜	1.0											
삼성증권㈜												
삼성카드㈜												
삼성화재해상보험㈜				100.0								
㈜에스원											100.0	
㈜제일기획		67.5										
㈜호텔신라									100.0			
삼성디스플레이㈜												
삼성자산운용㈜												
삼성전자서비스㈜												
㈜미라콤아이앤씨												
㈜삼성글로벌리서치												
Harman International Industries, Inc.										100.0		
계	100.0	67.5	100.0	100.0	100.0	100.0	65.2	49.5	100.0	100.0	100.0	100.0

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

[해외]

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : %)

출자회사	피출자회사	지분율(%)
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO AUSTIN INC	100.0
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO HU Designer and Engineering Services Limited	100.0
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO DESIGNERS & ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED	100.0
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO (KL) SDN. BHD.	100.0
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO Design Consulting Co.,Ltd	100.0
Samsung C&T America Inc.	Meadowland Distribution	100.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Green repower, LLC	100.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Solar Construction Inc.	100.0
Samsung C&T America Inc.	QSSC, S.A. de C.V.	20.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Solar Energy LLC	100.0
Samsung C&T America Inc.	Equipment Trading Solutions Group, LLC	70.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SP Armow Wind Ontario LP	50.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE WIND PA GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE WIND PA LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRS Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRS Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE K2 EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE K2 EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE KS HOLDINGS GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE KS HOLDINGS LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SP Belle River Wind LP	42.5
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Armow EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Armow EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	North Kent Wind 1 LP	35.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Wind GP Holding Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	South Kent Wind LP Inc.	50.0
Samsung Renewable Energy Inc.	Grand Renewable Wind LP Inc.	45.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 2 LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Development GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Development LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Windsor Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Southgate Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Construction Management GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Construction Management LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE BRW EPC GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE BRW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 2 GP Holdings Inc	100.0

Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Belle River GP Holdings Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE NK1 EPC GP Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE NK1 EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Summerside Construction GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Summerside Construction LP	100.0
Samsung Green repower, LLC	Monument Power, LLC	100.0
SP Armow Wind Ontario GP Inc	SP Armow Wind Ontario LP	0.0
Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	PLL Holdings LLC	83.6
Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	PLL E&P LLC	90.0
SRE GRW EPC GP Inc.	SRE GRW EPC LP	0.0
SRE SKW EPC GP Inc.	SRE SKW EPC LP	0.0
PLL Holdings LLC	Parallel Petroleum LLC	61.0
SRE WIND PA GP INC.	SRE WIND PA LP	0.0
SRE GRS Holdings GP Inc.	Grand Renewable Solar GP Inc.	50.0
SRE GRS Holdings GP Inc.	SRE GRS Holdings LP	0.0
SRE K2 EPC GP Inc.	SRE K2 EPC LP	0.0
SRE KS HOLDINGS GP INC.	KINGSTON SOLAR GP INC.	50.0
SRE KS HOLDINGS GP INC.	SRE KS HOLDINGS LP	0.0
SP Belle River Wind GP Inc	SP Belle River Wind LP	0.0
SRE Armow EPC GP Inc.	SRE Armow EPC LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SP Armow Wind Ontario GP Inc	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	South Kent Wind GP Inc.	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	Grand Renewable Wind GP Inc.	50.0
South Kent Wind GP Inc.	South Kent Wind LP Inc.	0.0
Grand Renewable Wind GP Inc.	Grand Renewable Wind LP Inc.	0.0
North Kent Wind 1 GP Inc	North Kent Wind 1 LP	0.0
SRE Solar Development GP Inc.	SRE Solar Development LP	0.0
SRE Solar Construction Management GP Inc.	SRE Solar Construction Management LP	0.0
SRE BRW EPC GP INC.	SRE BRW EPC LP	0.0
SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	North Kent Wind 1 GP Inc	50.0
SRE North Kent 2 GP Holdings Inc	SRE North Kent 2 LP Holdings LP	0.0
SRE Belle River GP Holdings Inc	SP Belle River Wind GP Inc	50.0
SRE NK1 EPC GP Inc	SRE NK1 EPC LP	0.0
SRE Summerside Construction GP Inc.	SRE Summerside Construction LP	0.0
Samsung Solar Energy LLC	Samsung Solar Energy 1 LLC	100.0
Samsung Solar Energy LLC	Samsung Solar Energy 2 LLC	100.0
Samsung Solar Energy LLC	Samsung Solar Energy 3, LLC	100.0
Samsung Solar Energy 1 LLC	CS SOLAR LLC	50.0
Samsung Solar Energy 2 LLC	5S ENERGY HOLDINGS, LLC	50.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	SungEel Recycling Park Thuringen GmbH	100.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	POSS-SLPC, S.R.O	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	Solluce Romania 1 B.V.	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	S.C. Otelinox S.A	99.9
Samsung C&T Malaysia SDN. BHD	WARIS GIGIH ENGINEERING AND TECHNOLOGY SDN. BHD.	70.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Samsung Chemtech Vina LLC	48.3
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	0.2

Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	PT. INSAM BATUBARA ENERGY	65.2
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	30.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	S&G Biofuel PTE.LTD	12.6
S&G Biofuel PTE.LTD	PT. Gandaerah Hendana	95.0
S&G Biofuel PTE.LTD	PT. Inecda	95.0
Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd.	VISTA CONTRACTING AND DEVELOPMENT BANGLADESH LTD.	100.0
CHEIL HOLDING INC.	SAMSUNG CONST. CO. PHILS.	75.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	6.8
Samsung C&T Hongkong Ltd.	SAMSUNG TRADING (SHANGHAI) CO., LTD	100.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	45.0
삼성전자(주)	Samsung Japan Corporation	100.0
삼성전자(주)	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics America, Inc.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Canada, Inc.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	63.6
삼성전자(주)	Samsung Electronics Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics (UK) Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Holding GmbH	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Iberia, S.A.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics France S.A.S	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Italia S.P.A.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Europe Logistics B.V.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Benelux B.V.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Overseas B.V.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Austria GmbH	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Slovakia s.r.o	55.7
삼성전자(주)	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	75.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Vina Electronics Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Asia Pte. Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung India Electronics Private Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.	100.0
삼성전자(주)	PT Samsung Electronics Indonesia	100.0
삼성전자(주)	Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	91.8
삼성전자(주)	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	69.1
삼성전자(주)	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	48.2

삼성전자(주)	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.	90.0
삼성전자(주)	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	73.7
삼성전자(주)	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Egypt S.A.E	0.1
삼성전자(주)	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.	87.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Argentina S.A.	98.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Chile Limitada	4.1
삼성전자(주)	Samsung Electronics Rus Company LLC	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC	100.0
삼성전자(주)	Tianjin Samsung LED Co., Ltd.	100.0
삼성바이오로직스(주)	Samsung Biologics America, Inc.	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis United States Inc.	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis NL B.V.	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis CH GmbH	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis PL Sp z o.o.	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS AU PTY LTD	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS NZ LIMITED	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Biopeis TW Limited	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis HK Limited	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS IL LTD	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS BR PHARMACEUTICAL LTDA	100.0
삼성디스플레이(주)	Intellectual Keystone Technology LLC	41.9
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Slovakia, s.r.o.	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Noida Private Limited	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Dongguan Co., Ltd.	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Tianjin Co., Ltd.	95.0
삼성디스플레이(주)	Novaled GmbH	9.9
세메스(주)	SEMES America, Inc.	100.0
세메스(주)	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	NeuroLogica Corp.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Dacor Holdings, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung HVAC America, LLC	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	SmartThings, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Oak Holdings, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Joyent, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	TeleWorld Solutions, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Semiconductor, Inc.	100.0

Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Research America, Inc	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung International, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Harman International Industries, Inc.	100.0
Dacor Holdings, Inc.	Dacor, Inc.	100.0
Samsung Semiconductor, Inc.	Samsung Austin Semiconductor LLC.	100.0
Samsung Electronics Canada, Inc.	AdGear Technologies Inc.	100.0
Samsung Research America, Inc	SAMSUNG NEXT LLC	100.0
SAMSUNG NEXT LLC	SAMSUNG NEXT FUND LLC	100.0
Samsung International, Inc.	Samsung Mexicana S.A. de C.V	100.0
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman International Japan Co., Ltd.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman International Industries Canada Ltd.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Professional, Inc.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Connected Services, Inc.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Financial Group LLC	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Belgium SA	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman France SNC	100.0
Harman International Industries, Inc.	Red Bend Software SAS	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Inc. & Co. KG	66.0
Harman International Industries, Inc.	Harman KG Holding, LLC	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Finance International, SCA	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Finance International GP S.a.r.l	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	99.9
Harman Becker Automotive Systems, Inc.	Harman International Estonia OU	100.0
Harman Professional, Inc.	Harman Singapore Pte. Ltd.	100.0
Harman Professional, Inc.	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	0.0
Harman Professional, Inc.	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	0.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services Engineering Corp.	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services AB.	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services UK Ltd.	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	1.6
Harman Connected Services, Inc.	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	100.0
Harman Financial Group LLC	Harman International (India) Private Limited	0.0
Harman Financial Group LLC	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	0.1
Harman Financial Group LLC	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	0.0
Samsung Electronics (UK) Ltd.	Samsung Semiconductor Europe Limited	100.0
Samsung Electronics Holding GmbH	Samsung Semiconductor Europe GmbH	100.0
Samsung Electronics Holding GmbH	Samsung Electronics GmbH	100.0
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	31.4
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	Samsung Electronics Slovakia s.r.o	44.3
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	36.4
Samsung Electronics Benelux B.V.	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA	100.0

Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics West Africa Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics East Africa Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Egypt S.A.E	99.9
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Israel Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	99.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Turkiye	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Levant Co.,Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Maghreb Arab	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Venezuela, C.A.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.	13.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Chile Limitada	95.9
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Peru S.A.C.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Ukraine Company LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung R&D Institute Ukraine	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung R&D Institute Rus LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Central Eurasia LLP	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Uzbekistan Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Corephotonics Ltd.	100.0
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	Samsung Nanoradio Design Center	100.0
AKG Acoustics Gmbh	Harman Professional Denmark ApS	100.0
AKG Acoustics Gmbh	Studer Professional Audio GmbH	100.0
Harman Professional Denmark ApS	Martin Professional Japan Ltd.	40.0
Harman Becker Automotive Systems GmbH	Harman International Romania SRL	0.0
Harman Becker Automotive Systems GmbH	Apostera UA, LLC	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman Becker Automotive Systems GmbH	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman Deutschland GmbH	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman RUS CIS LLC	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Holding Gmbh & Co. KG	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Management Gmbh	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Hungary Financing Ltd.	100.0
Harman Connected Services GmbH	Harman Connected Services OOO	100.0
Harman KG Holding, LLC	Harman Inc. & Co. KG	34.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman Professional Kft	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman Consumer Nederland B.V.	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman International Romania SRL	100.0

Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Red Bend Ltd.	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	100.0
Harman Hungary Financing Ltd.	Harman International Industries Limited	100.0
Harman Finance International GP S.a.r.l	Harman Finance International, SCA	0.0
Harman Consumer Nederland B.V.	AKG Acoustics Gmbh	100.0
Harman Consumer Nederland B.V.	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	100.0
Harman Consumer Nederland B.V.	Harman Holding Limited	100.0
Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	Harman France SNC	0.0
Harman Connected Services AB.	Harman Finland Oy	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services GmbH	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	100.0
Harman International Industries Limited	Harman Automotive UK Limited	100.0
Harman International Industries Limited	Harman International Industries PTY Ltd.	100.0
Harman International Industries Limited	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	100.0
Harman Connected Services UK Ltd.	Harman Connected Services Morocco	100.0
Samsung Electronics Austria GmbH	Samsung Electronics Switzerland GmbH	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	68.6
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Romania LLC	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	SAMSUNG Zhilabs, S.L.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.	49.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Greece S.M.S.A	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	FOODIENT LTD.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Denmark Research Center ApS	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Cambridge Solution Centre Limited	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Novaled GmbH	40.0
Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd.	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	25.0
Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd.	iMarket Asia Co., Ltd.	11.4
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Japan Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd.	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics New Zealand Limited	100.0

Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Philippines Corporation	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd.	100.0
Samsung India Electronics Private Ltd.	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd	100.0
Samsung India Electronics Private Ltd.	Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	100.0
PT Samsung Electronics Indonesia	PT Samsung Telecommunications Indonesia	100.0
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd	100.0
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	iMarket Asia Co., Ltd.	11.3
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd.	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	19.2
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung R&D Institute China-Shenzhen	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	43.1
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Beijing Samsung Telecom R&D Center	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	26.3
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics China R&D Center	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	100.0
Harman Holding Limited	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	100.0
Harman Holding Limited	Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	100.0
Harman Holding Limited	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	100.0
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Egypt S.A.E	0.1
Samsung Electronics Maghreb Arab	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	1.0
Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	Harman International (India) Private Limited	100.0
Global Symphony Technology Group Private Ltd.	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	98.4
Red Bend Ltd.	Red Bend Software Ltd.	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A.	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc.	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A.	Samsung Electronica Colombia S.A.	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A.	Samsung Electronics Panama. S.A.	100.0
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.	Samsung Electronics Argentina S.A.	2.0
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	100.0
Samsung Electronics Central Eurasia LLP	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd	0.0
삼성에스디아이(주)	Intellectual Keystone Technology LLC	41.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Japan Co., Ltd.	89.2
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI America, Inc.	91.7
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Hungary., Zrt.	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Europe GmbH	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Battery Systems GmbH	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Vietnam Co., Ltd.	100.0

삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd.	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI India Private Limited	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	97.6
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI China Co., Ltd.	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI-ARN (Xi'An) Power Battery Co., Ltd.	65.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd.	80.0
삼성에스디아이(주)	STARPLUS ENERGY LLC.	51.0
삼성에스디아이(주)	Novaled GmbH	50.1
삼성에스디아이(주)	SAMSUNG SDI WUXI CO.,LTD.	100.0
삼성에스디아이(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	8.7
Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Samsung SDI India Private Limited	0.0
Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Tianjin Samsung SDI Co., Ltd.	80.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Machanics Japan Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics America, Inc.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics GmbH	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Philippines, Corp.	100.0
삼성전기(주)	Calamba Premier Realty Corporation	39.8
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited	99.9
삼성전기(주)	Dongguan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Tianjin Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	81.8
삼성전기(주)	Samsung High-Tech Electro-Mechanics(Tianjin) Co., Ltd.	95.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics (Shenzhen) Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Kunshan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	8.7
Calamba Premier Realty Corporation	Batino Realty Corporation	100.0
Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd.	Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited	0.1
삼성화재해상보험(주)	Samsung Fire & Marine Management Corporation	100.0
삼성화재해상보험(주)	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD.	100.0
삼성화재해상보험(주)	PT. Asuransi Samsung Tugu	70.0
삼성화재해상보험(주)	SAMSUNG VINA INSURANCE COMPANY LIMITED	75.0
삼성화재해상보험(주)	Samsung Reinsurance Pte. Ltd.	100.0
삼성화재해상보험(주)	삼성재산보험 (중국) 유한공사	37.0
삼성화재해상보험(주)	Samsung Fire & Marine Insurance Management Middle East Limited	100.0
삼성중공업(주)	Camellia Consulting Corporation	100.0
삼성중공업(주)	Samsung Heavy Industries India Pvt.Ltd.	100.0
삼성중공업(주)	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (M) SDN.BHD	100.0
삼성중공업(주)	삼성중공업(영파)유한공사	100.0
삼성중공업(주)	삼성중공업(영성)유한공사	100.0
삼성중공업(주)	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED	100.0
삼성중공업(주)	Samsung Heavy Industries Mozambique LDA	100.0

삼성중공업(주)	Samsung Heavy Industries Rus LLC	100.0
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED	SHI - MCI FZE	70.0
삼성생명보험(주)	Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.	51.0
삼성생명보험(주)	Samsung Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd	48.9
삼성생명보험(주)	Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd	90.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management (New York), Inc.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Global SME Private Equity Manager Fund Co., Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management U.S. Holdings, Inc.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Private Equity Fund 2022 GP, Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Co-Investment 2021 GP, Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management(London) Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Private Equity Manager I Co., Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.	100.0
Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.	Samsung Asset Management (Beijing) Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Japan Corporation	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T America Inc.	100.0
삼성물산(주)	Samsung E&C America, INC.	100.0
삼성물산(주)	Samsung Renewable Energy Inc.	100.0
삼성물산(주)	QSSC, S.A. de C.V.	80.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Lima S.A.C.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Deutschland GmbH	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T U.K. Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T ECUK Limited	100.0
삼성물산(주)	Whessoe engineering Limited	100.0
삼성물산(주)	POSS-SLPC, S.R.O	50.0
삼성물산(주)	Solluce Romania 1 B.V.	80.0
삼성물산(주)	SAM investment Manzanilo.B.V	53.3
삼성물산(주)	Samsung C&T (KL) Sdn.,Bhd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Malaysia SDN. BHD	100.0
삼성물산(주)	Erdsam Co., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung Chemtech Vina LLC	51.7
삼성물산(주)	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	93.0
삼성물산(주)	PT. INSAM BATUBARA ENERGY	34.8
삼성물산(주)	Samsung C&T India Private Limited	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Corporation India Private Limited	100.0
삼성물산(주)	Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	70.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	S&G Biofuel PTE.LTD	50.5
삼성물산(주)	SAMSUNG C&T Mongolia LLC.	70.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Eng.&Const. Mongolia LLC.	100.0
삼성물산(주)	S&WOO CONSTRUCTION PHILIPPINES,INC.	100.0
삼성물산(주)	VSSC STEEL CENTER LIMITED LIABILITY COMPANY	70.0
삼성물산(주)	Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd.	100.0
삼성물산(주)	SAMSUNG CONST. CO. PHILS.	25.0
삼성물산(주)	CHEIL HOLDING INC.	40.0

삼성물산(주)	Samsung C&T Renewable Energy Australia Pty Ltd	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Hongkong Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Taiwan Co., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	55.0
삼성물산(주)	SAMSUNG C&T (SHANGHAI) CO., LTD.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T (Xi'an) Co., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	WARIS GIGIH ENGINEERING AND TECHNOLOGY SDN. BHD.	30.0
삼성물산(주)	SAMSUNG C&T CORPORATION SAUDI ARABIA	100.0
삼성물산(주)	SAM Gulf Investment Limited	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Chile Copper SpA	100.0
삼성물산(주)	SCNT Power Kelar Inversiones Limitada	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Corporation Rus LLC	100.0
삼성물산(주)	Samsung SDI America, Inc.	8.3
삼성물산(주)	Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	2.4
삼성물산(주)	Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd	10.0
삼성물산(주)	CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL	100.0
삼성물산(주)	Samsung Fashion Trading Co. ,Ltd	100.0
삼성물산(주)	SAMSUNG C&T CORPORATION VIETNAM CO., LTD	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Corporation UEM Construction JV Sdn Bhd	60.0
삼성물산(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	19.3
삼성웰스토리(주)	WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED	100.0
삼성웰스토리(주)	Shanghai Ever-Hongjun Business Mgt Service Co.,LTD	85.0
삼성웰스토리(주)	Shanghai Welstory Food Company Limited	81.6
(주)멀티캠퍼스	LANGUAGE TESTING INTERNATIONAL, INC.	82.4
Pengtai Greater China Company Limited	PENGTAI CHINA CO.,LTD.	100.0
Pengtai Greater China Company Limited	PengTai Taiwan Co., Ltd.	100.0
PENGTAI CHINA CO.,LTD.	PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD	100.0
PENGTAI CHINA CO.,LTD.	PENGTAI MARKETING SERVICE CO.,LTD.	100.0
PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD	Medialytics Inc.	100.0
PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD	Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd.	51.0
iMarket Asia Co., Ltd.	iMarket China Co., Ltd.	80.0
삼성증권(주)	Samsung Securities (America), Inc.	100.0
삼성증권(주)	Samsung Securities (Europe) Limited.	100.0
삼성증권(주)	Samsung Securities (Asia) Limited.	100.0
삼성에스디에스(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	40.6
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS America, Inc.	100.0
삼성에스디에스(주)	SAMSUNG SDS GSCL Canada., Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Neo EXpress Transportation (NEXT) Inc.	51.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Europe, Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Hungary, Kft.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Slovakia, S.R.O.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung GSCL Sweden AB	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL France SAS	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Italy S.R.L. A Socio Unico	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Spain S.L.U	100.0

삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Germany GmbH	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Romania S.R.L	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Asia Pacific Pte, Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung Data Systems India Private Limited	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd.Inc.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Thailand Co.,Ltd	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Malaysia SDN.BHD.	100.0
삼성에스디에스(주)	SAMSUNG SDS Global SCL Austraila Pty.,Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	SDS-ACUTECH CO., Ltd.	50.0
삼성에스디에스(주)	ALS SDS Joint Stock Company	51.0
삼성에스디에스(주)	SDS-MP Logistics Joint Stock Company	51.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS China Co., Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Hong Kong Co., Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	SAMSUNG SDS Global SCL Egypt	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL South Africa (PTY) Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Nakliyat ve Lojistik Anonim Sirketi	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Middle East DWC-LLC	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Latin America Solucoes Em Tecnologia Ltda.	99.7
삼성에스디에스(주)	INTE-SDS Logistics S.A. de C.V.	51.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Rus Limited Liability Company	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Mexico, S.A. DE C.V.	99.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Panama S.A.	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Chile Limitada	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Peru S.A.C	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Colombia S.A.S	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Latin America Solucoes Em Tecnologia Ltda.	0.3
Samsung SDS Europe, Ltd.	Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o.	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	Samsung SDS Global SCL Romania S.R.L	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	Samsung SDS Rus Limited Liability Company	0.0
Samsung SDS China Co., Ltd.	Samsung SDS Global Development Center Xi'an	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering America Inc.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Project Management Inc.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Hungary Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Italy S.R.L.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD.	100.0
삼성엔지니어링(주)	PT Samsung Engineering Indonesia Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.	81.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering India Private Limited	100.0

삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Global Private Limited	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Construction(Shanghai) Co., Ltd	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Construction Xi' an Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Muharraq Wastewater Services Company W.L.L.	99.8
삼성엔지니어링(주)	Muharraq STP Company B.S.C.	6.6
삼성엔지니어링(주)	Muharraq Holding Company 1 Ltd.	65.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria Mexico Construccion Y Operacion S.A. De C.V.	99.9
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Trinidad Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria Manzanillo, S.A. De C.V.	99.9
삼성엔지니어링(주)	Grupo Samsung Ingenieria Mexico, S.A. De C.V.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria Energia S.A. De C.V.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Bolivia S.A	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria DUBA S.A. de C.V.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Kazakhstan L.L.P.	100.0
Samsung Engineering America Inc.	SEA Construction, LLC	100.0
Samsung Engineering America Inc.	SEA Louisiana Construction, L.L.C.	100.0
Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD.	Muharraq Wastewater Services Company W.L.L.	0.3
Samsung Engineering India Private Limited	Samsung Engineering Global Private Limited	0.0
Samsung Engineering India Private Limited	Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.	0.0
Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.	Samsung EPC Company Ltd.	75.0
Muharraq Holding Company 1 Ltd.	Muharraq Holding Company 2 Ltd.	100.0
Muharraq Holding Company 2 Ltd.	Muharraq STP Company B.S.C.	89.9
Samsung Ingenieria DUBA S.A. de C.V.	Asociados Constructores DBNR, S.A. de C.V.	49.0
(주)에스원	S-1 CORPORATION HUNGARY LLC	100.0
(주)에스원	S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD	100.0
(주)에스원	Samsung Beijing Security Systems	100.0
(주)제일기획	PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD	100.0
(주)제일기획	Cheil USA Inc.	100.0
(주)제일기획	Cheil Central America Inc.	100.0
(주)제일기획	Iris Worldwide Holdings Limited	100.0
(주)제일기획	CHEIL EUROPE LIMITED	100.0
(주)제일기획	Cheil Germany GmbH	100.0
(주)제일기획	Cheil France SAS	100.0
(주)제일기획	CHEIL SPAIN S.L	100.0
(주)제일기획	Cheil Benelux B.V.	100.0
(주)제일기획	Cheil Nordic AB	100.0
(주)제일기획	Cheil India Private Limited	100.0
(주)제일기획	Cheil (Thailand) Ltd.	100.0
(주)제일기획	Cheil Singapore Pte. Ltd.	100.0
(주)제일기획	CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED	99.0
(주)제일기획	Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.	100.0
(주)제일기획	CHEIL MALAYSIA SDN. BHD.	100.0
(주)제일기획	Cheil New Zealand Limited	100.0

(주)제일기획	Pengtai Greater China Company Limited	3.1
(주)제일기획	CHEIL CHINA	100.0
(주)제일기획	Cheil Hong Kong Ltd.	100.0
(주)제일기획	Caishu (Shanghai) Business Consulting Co., Ltd	100.0
(주)제일기획	Cheil MEA FZ-LLC	100.0
(주)제일기획	Cheil South Africa (Pty) Ltd	100.0
(주)제일기획	CHEIL KENYA LIMITED	99.0
(주)제일기획	Cheil Communications Nigeria Ltd.	99.0
(주)제일기획	Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC.	100.0
(주)제일기획	Cheil Ghana Limited	100.0
(주)제일기획	Cheil Egypt LLC	99.9
(주)제일기획	Cheil Brasil Comunicacoes Ltda.	100.0
(주)제일기획	Cheil Mexico, S.A. de C.V.	98.0
(주)제일기획	Cheil Chile SpA.	100.0
(주)제일기획	Cheil Peru S.A.C.	100.0
(주)제일기획	CHEIL ARGENTINA S.A.	98.0
(주)제일기획	Cheil Rus LLC	100.0
(주)제일기획	Cheil Ukraine LLC	100.0
(주)제일기획	Cheil Kazakhstan LLC	100.0
(주)호텔신라	Samsung Hospitality America Inc.	100.0
(주)호텔신라	Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	100.0
(주)호텔신라	Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.	100.0
(주)호텔신라	Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	100.0
에이치디씨신라면세점(주)	HDC SHILLA (SHANGHAI) CO., LTD	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality U.K. Ltd.	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality Europe GmbH	100.0
에스비티엠(주)	SAMSUNG HOSPITALITY ROMANIA SRL	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.	99.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality Philippines Inc.	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality India Private Limited	100.0
삼성벤처투자(주)	Samsung Venture Investment (Shanghai) Co., Ltd.	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris (USA) Inc.	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris Atlanta, Inc.	100.0
Iris Americas, Inc.	89 Degrees, Inc.	100.0
Cheil USA Inc.	The Barbarian Group LLC	100.0
Cheil USA Inc.	McKinney Ventures LLC	100.0
Cheil USA Inc.	Cheil India Private Limited	0.0
Cheil USA Inc.	Cheil Mexico, S.A. de C.V.	2.0
Iris Worldwide Holdings Limited	Iris Nation Worldwide Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Americas, Inc.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Pricing Solutions Ltd	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris London Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Promotional Marketing Ltd	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Ventures 1 Limited	100.0

Iris Nation Worldwide Limited	Founded Partners Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Korea Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Digital Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Amsterdam B.V.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Ventures (Worldwide) Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Culture Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Concise Consultants Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Atom42 Ltd	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	WDMP Limited	49.0
Iris Nation Worldwide Limited	Pricing Solutions (UK) Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Services Limited Dooel Skopje	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Singapore Pte. ltd.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Worldwide Integrated Marketing Private Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Sydney PTY Ltd	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Worldwide (Thailand) Limited	100.0
Iris London Limited	Iris Partners LLP	100.0
Iris Promotional Marketing Ltd	Holdings BR185 Limited	100.0
Iris Ventures 1 Limited	Iris Germany GmbH	100.0
Founded Partners Limited	Founded, Inc.	100.0
Iris Germany GmbH	Pepper NA, Inc.	100.0
Iris Germany GmbH	Pepper Technologies Pte. Ltd.	100.0
CHEIL EUROPE LIMITED	Beattie McGuinness Bungay Limited	100.0
CHEIL EUROPE LIMITED	Cheil Italia S.r.l	100.0
Cheil Germany GmbH	Cheil Austria GmbH	100.0
Cheil Germany GmbH	Centrade Integrated SRL	100.0
Centrade Integrated SRL	Centrade Cheil HU Kft.	100.0
Centrade Integrated SRL	Centrade Cheil Adriatic D.O.O.	100.0
Cheil India Private Limited	Experience Commerce Software Private Limited	100.0
Cheil Singapore Pte. Ltd.	Pengtai Greater China Company Limited	95.7
Cheil Singapore Pte. Ltd.	PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA	100.0
Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.	Cheil Philippines Inc.	30.0
Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	Shilla Retail Plus Pte. Ltd.	100.0
Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.	Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd	100.0
Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	Shilla Retail Limited	100.0
Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited	100.0
Cheil MEA FZ-LLC	One Agency FZ-LLC	100.0
Cheil MEA FZ-LLC	One RX Project Management Design and Production Limited Company	0.0
Cheil MEA FZ-LLC	Cheil Egypt LLC	0.1
Cheil South Africa (Pty) Ltd	CHEIL KENYA LIMITED	1.0
Cheil South Africa (Pty) Ltd	Cheil Communications Nigeria Ltd.	1.0
One Agency FZ-LLC	One RX India Private Limited	100.0
One Agency FZ-LLC	One RX Project Management Design and Production Limited Company	100.0
One Agency FZ-LLC	ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C	100.0
One Agency FZ-LLC	ONE AGENCY PRINTING L.L.C	100.0

One Agency FZ-LLC	One Agency South Africa (Pty) Ltd	100.0
ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C	One RX India Private Limited	0.0
Holdings BR185 Limited	Brazil 185 Participacoes Ltda	100.0
Brazil 185 Participacoes Ltda	Iris Router Marketing Ltda	100.0
Cheil Brasil Comunicacoes Ltda.	CHEIL ARGENTINA S.A.	2.0

다. 관련법령상의 규제내용 등

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 상호출자제한기업집단 등
① 지정시기: 2022년 5월 1일
② 규제내용 요약
・상호출자의 금지
・계열사 채무보증 금지
・금융・보험사의 계열사 의결권 제한
・대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시
・비상장사 중요사항 공시
・기업집단 현황 등에 관한 공시

라.회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일)

겸직자		계열회사 겸직현황		
성명	직위	기업명	직위	상근 여부
김용관	부사장	삼성메디슨㈜	대표이사	상근
김연성	부사장	삼성전자판매㈜	감사	비상근
		삼성전자로지텍㈜	감사	비상근
		삼성전자서비스㈜	감사	비상근
유승호	부사장	삼성메디슨㈜	감사	비상근
최정준	부사장	삼성벤처투자㈜	감사	비상근
유한종	상무	㈜삼성글로벌리서치	감사	비상근
조기재	부사장	삼성디스플레이㈜	감사	비상근
김현우	부사장	세메스㈜	감사	비상근
김명철	부사장	세메스㈜	기타비상무이사	비상근
성덕용	상무	세메스㈜	기타비상무이사	비상근
오재균	상무	스테코㈜	감사	비상근
박동욱	상무	스테코㈜	기타비상무이사	비상근
한승환	사장	삼성물산㈜	대표이사	상근
		삼성웰스토리㈜		
유규태	부사장	삼성메디슨㈜	사내이사	상근

2. 타법인 출자 현황(요약)

2022년말 현재 당사 타법인 출자 금액은 장부금액 기준 58조 7,619억원이며, 경영참여 등 목적으로 출자하였습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원)

출자 목적	출자회사수			총 출자금액			
	상장	비상장	계	기초 장부 가액	증가(감소)		기말 장부 가액
					취득 (처분)	평가 손익	
경영참여	20	80	100	57,768,459	1,107,793	-197,848	58,678,404
일반투자	0	0	0	0	0	0	0
단순투자	5	35	40	121,807	-14,928	-23,426	83,453
계	25	115	140	57,890,266	1,092,865	-221,274	58,761,857

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

※ 별도재무제표 기준입니다.

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

당사는 2022년말 현재 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 계열회사의 자금조달 등을 위하여 채무보증을 제공하고 있습니다.

(단위 : 천US$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2022.04.16	2023.12.16	1,328,000	1,278,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2022.03.28	2023.11.08	906,000	715,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	310,000	210,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2022.10.01	2023.12.16	409,000	409,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	62,000	62,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2022.06.01	2023.12.16	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	318,000	318,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.12.16	110,000	110,000	-	-	-	
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	807,000	777,000	102,275	137,120	239,395	37.6%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.12.16	130,000	130,000	33,334	△7,685	25,649	34.4%
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	73,722	60,000	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2022.04.28	2023.12.16	877,579	832,572	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	150,000	150,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	141,000	537,000	-	155,768	155,768	11.6%
SECA	계열회사	BoA	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	120,000	60,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	712,400	888,400	-	-	-	
SERK	계열회사	SMBC 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.12.16	290,000	45,000	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	15,600	15,600	10,947	△1,283	9,664	1.3%
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	345,000	404,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	300,000	300,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	110,000	110,000	-	-	-	
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	50,000	20,000	-	-	-	

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	100,000	100,000	-	-	-	
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	25,000	25,000	-	-	-	
Harman RUS CIS LLC	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.05.31	15,000	-	-	-	-	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	-	30,000	-	-	-	
합 계							8,265,301	8,146,572	146,556	283,920	430,476	

※ 별도 기준입니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 법인명은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참고하시기 바랍니다.

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 상기 채무보증에 대하여 당사가 보증하는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 수수료를 수취하고 있습니다. 당사는 2022년 중 US$547천의 수수료를 청구하였으며, 2022년말 현재 미수취하였습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 2022년 중 법인의 생산설비 증설 등 목적으로 자산을 Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS) 등의 계열회사에 매각하였으며, 국내 생산 효율화 등을 위해 자산을 계열회사로부터 매입하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	처분손익
SCS	계열회사	자산매각・매입	2022.12.26	기계장치 등	생산설비 증설・생산효율화 등	16,177	4,072
SESS	계열회사	자산매각・매입	2022.07.12	기계장치 등	생산설비 증설・생산효율화 등	5,346	639
SEHC	계열회사	자산매각・매입	2022.12.14	기계장치 등	생산설비 증설・생산효율화 등	4,471	259
SAS	계열회사	자산매입	2022.11.21	기계장치 등	생산설비 증설・생산효율화 등	2,457	-
SEVT	계열회사	자산매입	2022.11.29	기계장치 등	생산설비 증설・생산효율화 등	831	-
SEA	계열회사	자산매각	2022.08.09	기계장치 등	생산설비 증설・생산효율화 등	632	37
TSLED	계열회사	자산매각	2022.12.21	기계장치 등	생산설비 증설・생산효율화 등	338	73
SEV	계열회사	자산매각・매입	2022.12.21	기계장치 등	생산설비 증설・생산효율화 등	306	42
SERK	계열회사	자산매각	2022.05.19	기계장치 등	생산설비 증설・생산효율화 등	282	18
SEUZ	계열회사	자산매각	2022.06.22	기계장치 등	생산설비 증설・생산효율화 등	224	6
SII	계열회사	자산매각	2022.05.09	기계장치 등	생산설비 증설・생산효율화 등	216	△10
삼성생명보험㈜	계열회사	자산매각	2022.12.27	기계장치 등	생산설비 증설・생산효율화 등	188	△74
SEH	계열회사	자산매각	2022.04.13	기계장치 등	생산설비 증설・생산효율화 등	142	14
SIEL	계열회사	자산매각	2022.10.12	기계장치 등	생산설비 증설・생산효율화 등	112	26
삼성메디슨㈜	계열회사	자산매각	2022.03.17	기계장치 등	생산설비 증설・생산효율화 등	5	5

※ 별도 기준입니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 법인명은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참고하시기 바랍니다.

※ 거래일자는 최근 거래일자 기준입니다.

※ 거래금액은 시장 및 가치평가 등을 거쳐 적절히 산정되었으며, 거래 다음달 15일・30일 이내 현금 지급조건 등 통상적인 조건으로 거래되었습니다.

※ 상기 자산양수도 거래는 이사회 결의 대상이 아닙니다.

3. 대주주와의 영업거래

당사는 2022년 중 계열회사인 Samsung Semiconductor, Inc. (SSI) 등과 매출, 매입 등의 영업거래를 하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
SSI	계열회사	매출・입 등	2022.01~2022.12	반도체 매출 등	41,440,223
SEA	계열회사	매출・입 등	2022.01~2022.12	HHP 및 가전제품 매출・입 등	35,513,203
SEVT	계열회사	매출・입 등	2022.01~2022.12	HHP 매출・입 등	34,609,927
SEV	계열회사	매출・입 등	2022.01~2022.12	HHP 매출・입 등	22,246,267
SSS	계열회사	매출・입 등	2022.01~2022.12	반도체 매출 등	16,490,868
SIEL	계열회사	매출・입 등	2022.01~2022.12	HHP 및 가전제품 매출・입 등	13,238,315

※ 별도 기준입니다.

※ 법인명은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참고하시기 바랍니다.

※ 공시대상은 최근사업연도 매출액의 5% 이상 기준입니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 2022년말 현재 제품경쟁력 제고, 상생경영을 위한 협력사 지원 및 종업원 복리후생 목적의 주택대부, 학자금 등으로 1,401억원의 대여금이 있습니다.

(단위 : 백만원)

성 명 (법인명)	관 계	계정과목	대여금 변동 내역		
			기초	증감	기말
㈜이랜텍 등	협력업체 및 종업원	단기대여금	42,999	4,162	47,161
범진아이엔디㈜ 등	협력업체 및 종업원	장기대여금	71,604	21,294	92,898
합 계			114,603	25,456	140,059

※ 별도 기준입니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 대여금은 현재가치할인차금 차감후, 대손충당금(손실충당금) 차감전 기준입니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건등

당사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등을 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

당사(삼성전자㈜, 삼성디스플레이㈜)는 삼성디스플레이㈜의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

그 밖의 우발부채 및 약정사항에 대해서는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.

나. 채무보증내역

(단위 : 천US$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2022.04.16	2023.12.16	1,328,000	1,278,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2022.03.28	2023.11.08	906,000	715,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	310,000	210,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2022.10.01	2023.12.16	409,000	409,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	62,000	62,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2022.06.01	2023.12.16	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	318,000	318,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.12.16	110,000	110,000	-	-	-	
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	807,000	777,000	102,275	137,120	239,395	37.6%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.12.16	130,000	130,000	33,334	△7,685	25,649	34.4%
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	73,722	60,000	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2022.04.28	2023.12.16	877,579	832,572	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	150,000	150,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	141,000	537,000	-	155,768	155,768	11.6%
SECA	계열회사	BoA	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	120,000	60,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	712,400	888,400	-	-	-	
SERK	계열회사	SMBC 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.12.16	290,000	45,000	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	15,600	15,600	10,947	△1,283	9,664	1.3%
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	345,000	404,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.12.16	300,000	300,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	110,000	110,000	-	-	-	
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	50,000	20,000	-	-	-	

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	100,000	100,000	-	-	-	
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	25,000	25,000	-	-	-	
Harman RUS CIS LLC	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.05.31	15,000	-	-	-	-	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	-	30,000	-	-	-	
Harman Finance International, SCA	계열회사	JP Morgan 등	지급보증	운영자금	2015.05.27	2022.03.01	396,304	-	396,304	△396,304	-	
SDN	계열회사	SIEL	지급보증	운영자금 등	2020.01.03	2024.11.22	671,908	603,960	571,121	△57,755	513,366	5.8%
SAS	계열회사	Epcor	지급보증	운영자금 등	2022.04.26	채무 소멸시	-	340,000	-	-	-	
DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	계열회사	ANZ	지급보증	시설자금	2022.11.10	2025.11.09	-	20,000	-	20,000	20,000	5.9%
합 계							9,333,513	9,110,532	1,113,981	△150,139	963,842	

※ 연결 기준입니다. Harman Finance International, SCA 건은 Harman International Industries, Inc., SDN 건은 삼성디스플레이㈜, SAS 건은 SEA, DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED 건은 ㈜도우인시스가 각각 채무보증인입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 법인명은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참고하시기 바랍니다.

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.
또한 종속기업인 삼성디스플레이㈜의 경우 건별 채무보증금액이 100억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 상기 채무보증에 대하여 당사가 보증하는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 수수료를 수취하고 있습니다. 당사는 2022년 중 US$547천의 수수료를 청구하였으며, 2022년말 현재 미수취하였습니다.

한편, 삼성디스플레이㈜는 SDN에게 2022년 중 US$3,080천 수수료를 청구하였으며, 2022년말 현재 미수취하였습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 수사·사법기관의 제재현황

[요약] (단위 : 백만원)

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적 제재금액	횡령·배임등 금액	근거 법령
2019.04.18	서울중앙지방법원	당사 임직원	벌금	100	-	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조 제4항, 제68조 제4호
2019.12.09	서울중앙지방법원 (항소심 진행 중)	당사 임직원	징역	-	-	「형법」 제155조 제1항, 제31조 제1항, 제30조
2020.02.14	수원지방법원	당사 및 당사 임직원	벌금	12	-	「구.산업안전보건법」 제23조, 제24조, 제29조, 제67조, 제68조, 제70조, 제71조 등
2021.01.25	서울고등법원 (파기환송심)	당사 임직원	징역	-	약 8,681	「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」
2021.02.04	대법원	당사 임직원	징역	-	-	「노동조합 및 노동관계조정법」 제90조, 제81조 등
		자회사 및 임직원 (삼성전자서비스㈜)	벌금, 징역	50	-	「노동조합 및 노동관계조정법」 제90조, 제81조 등, 「조세범처벌법」 제10조
2022.07.07	광주지방법원	당사 임직원	벌금	6	-	「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제33조 7호, 제34조, 제18조 1항 등

공정거래위원회는「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제14조 제4항에 따른 2014년도 기업집단 지정자료 제출 시 ㈜삼우종합건축사사무소 및 ㈜서영엔지니어링을 기업집단「삼성」소속회사에서 누락한 허위의 자료를 제출했다는 이유로, 2018년 11월 21일 당사 임원 이건희 회장을 고발 조치하였으며, 이에 따라 검찰은 이건희 회장을 약식기소하였습니다.

서울중앙지방법원은 위 혐의를 인정하여 이건희 회장에게 2019년 4월 18일 일억원의 벌금 납입을 명령하였으며, 이건희 회장은 위 벌금을 납입하였습니다.

서울중앙지방법원은 2019년 12월 9일 당사 임원이 삼성바이오로직스㈜ 회계부정 의혹 사건에 관한 증거를 인멸·은닉하도록 삼성바이오로직스㈜와 삼성바이오에피스㈜ 임직원을 교사했다는 혐의 일부를 인정하여「형법」제155조 제1항, 제31조 제1항, 제30조 위반으로 K부사장(근속연수 27년) 징역 1년 6개월, L부사장(근속연수 31년) 징역 1년 6개월, M부사장(근속연수 9년) 징역 2년, N상무(근속연수 16년) 징역 1년 6개월(3년간 집행유예), O상무(근속연수 10년) 징역 1년 6개월(3년간 집행유예)을 각 선고하였습니다. 이 사건은 현재 항소심 재판이 진행 중으로, 당사는 향후 진행 상황을 확인할 예정입니다.

수원지방법원은 2018년 9월 4일 발생한 기흥사업장의 이산화탄소 누출사고와 관련하여, 2020년 2월 14일「구.산업안전보건법」제23조(안전조치), 제24조(보건조치), 제29조(도급사업 시의 안전・보건조치) 등 위반으로 당사에 벌금(7백만원)과 당사 임원 1명(안전보건총괄책임자 P부사장, 근속연수 27년)에게 벌금(5백만원)을 선고하였으며, 당사 및 당사 임원은 위 벌금을 납입하였습니다. 당사는 재발 방지를 위하여 임직원 및 협력사의 안전보건 역량 강화 등 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

대법원은 '박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건'에서 당사 임원 5명(이재용 부회장, 최지성 前부회장, 장충기 前사장, 박상진 前사장, 황성수 前전무)의「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」위반(횡령) 등의 혐의와 관련하여, 2019년 8월 29일 고등법원의 원심판결 중 일부를 파기하고 서울고등법원에 환송하였습니다. 서울고등법원은 2021년 1월 18일 파기 환송심에서 이재용 부회장, 최지성 前부회장, 장충기 前사장에 대해 징역 2년 6개월, 박상진 前사장, 황성수 前전무에 대해 징역 2년 6개월(집행유예 4년)을 선고하였으며, 위 판결은 2021년 1월 25일 확정되었습니다. 당사는 재발 방지를 위하여 대외후원금 집행 관련 프로세스를 강화하고 외부 독립 조직인 삼성 준법감시위원회를 신설하였습니다.

대법원이 2021년 2월 4일 당사 및 당사 임직원의「노동조합 및 노동관계조정법」제90조, 제81조 등 위반 혐의에 관해 상고기각 판결을 내림에 따라 서울고등법원이 2020년 8월 10일 선고한 당사 A부사장(근속연수 29년) 징역 1년 4개월, B前부사장 징역 1년 2개월(2년간 집행유예), C부사장(근속연수 34년) 징역 10개월(2년간 집행유예), D前부사장 징역 1년(2년간 집행유예), E전무(근속연수 32년) 징역 1년, F전무(근속연수 24년) 징역 1년 2개월(2년간 집행유예), G상무(근속연수 27년) 징역 10개월(2년간 집행유예), H상무(근속연수 18년) 징역 10개월(2년 집행유예)형이 확정되었고, 당사 및 당사의 前이사회 의장(근속연수 39년) 등은 무죄로 확정되었습니다. 또한 위 사건에서 자회사 삼성전자서비스㈜ 및 임직원의「노동조합 및 노동관계조정법」제90조, 제81조 등 위반과 허위 세금 계산서 수수에 대한「조세범처벌법」제10조 위반(위반금액 약 1,678백만원) 혐의에 대해 삼성전자서비스㈜ 벌금 50백만원(추징세액 약 97백만원), 삼성전자서비스㈜ 前대표이사(근속연수 4년) 징역 1년 4개월, I전무(근속연수 11년) 징역 1년, J상무(근속연수 21년) 징역 10개월(2년간 집행유예)의 형이 확정되었습니다. 당사는 행동규범 등에 노동3권 보장을 명시하고 부당노동행위 예방 관련 전 임직원 교육을 실시하는 등 재발 방지를 위하여 노력하고 있습니다.

광주지방법원 순천지원은 2021년 1월 20일 「환경분야 시험・검사 등에 관한 법률」 제 18조 등 위반으로 당사 직원 A프로(근속연수 11년), B프로(근속연수 8년)에게 각 벌금(3백만원)을 선고하였고, 광주지방법원은 2022년 7월 7일 이 사건 항소심에서 항소 기각 판결을 선고하였으며, 당사 직원은 위 벌금을 납입하였습니다. 당사는 재발 방지를 위하여 주기적인 교차 측정 등을 실시하고 있습니다.

나. 행정기관의 제재현황

(1) 공정거래위원회의 제재현황

[요약] (단위 : 백만원)

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적 제재금액	사유 및 근거 법령
2018.10.04	공정거래위원회	당사	시정명령, 과징금	488	「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 제3조(부당한 표시·광고 행위의 금지) 제1항 제2호 및 동법 시행령 제3조 제2항
2018.11.21	공정거래위원회	당사 임직원	검찰고발	-	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조(상호출자제한기업집단 등의 지정 등) 제4항
2019.08.23	공정거래위원회	당사	시정조치, 과태료	0.5	「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제5조 제4항(온라인 완결서비스 제공의무), 제10조 제1항(사이버몰 운영자의 표시의무)
2021.06.22	공정거래위원회	당사 및 당사 임직원	검찰고발	-	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제7호
2021.08.27.	공정거래위원회	당사	시정조치 과징금	101,217	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제7호
		자회사 (삼성디스플레이㈜)	시정조치 과징금	22,857	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제7호
2021.11.17	공정거래위원회	자회사 (삼성전자서비스 씨에스㈜)	과태료	2.4	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제11조의4(기업집단현황 등에 관한 공시)
2022.03.17	공정거래위원회	당사 임직원	경고	-	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조(상호출자제한기업집단 등의 지정 등) 제4항
2022.06.27	공정거래위원회	당사	과태료	10	「대리점거래의 공정화에 관한 법률」 제5조(대리점거래 계약서의 작성의무) 제1항

공정거래위원회는 당사의 공기청정기 등 공기청정 제품에 대한 광고와 관련하여, 2018년 10월 4일 당사에 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 제3조(부당한 표시·광고 행위의 금지) 제1항 제2호 및 동법 시행령 제3조 제2항 위반으로 시정명령 및 과징금(488백만원)을 부과 처분하였으며, 당사는 이를 납부하였습니다. 위 부과 처분의취소를 구하는 소송에서 대법원은 2021년 3월 11일 당사 일부 승소 판결을 선고하였습니다.

공정거래위원회는 2018년 11월 21일 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조(상호출자제한기업집단 등의 지정 등) 제4항에 따른 2014년도 기업집단 지정자료 제출 시 ㈜삼우종합건축사사무소 및 ㈜서영엔지니어링을 기업집단 「삼성」 소속회사에서 누락한 허위의 자료를 제출했다는 이유로 당사 임원 이건희 회장을 고발 조치하였습니다.

※ 처벌 내용 등 자세한 사항은 '가. 수사·사법기관의 제재현황'을 참고하시기 바랍니다.

공정거래위원회는 밀크 음원서비스와 관련하여, 2019년 8월 23일 당사에「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」제5조 제4항(온라인 완결서비스 제공의무) 및 제10조 제1항(사이버몰 운영자의 표시의무) 위반으로 시정조치 및 과태료(50만원)을 부과 처분하였으며, 당사는 이를 납부하였습니다.

공정거래위원회는 2021년 6월 22일 삼성웰스토리㈜와의 단체급식 거래와 관련하여 검찰에 당사 및 퇴직 임원인 최지성 전 미래전략실장을「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제7호 위반 혐의로 고발하였습니다.

또한 당사와 삼성디스플레이㈜는 삼성웰스토리㈜와의 단체급식 거래와 관련하여「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제23조 제1항 제7호 위반 혐의로 공정거래위원회로부터 2021년 8월 27일 시정조치 및 과징금(당사: 1,012억 17백만원, 삼성디스플레이㈜: 228억 5천 7백만원) 처분을 받았습니다. 동 처분에 대해 현재 행정소송이 진행 중이며, 시정조치에 대해 2022년 1월 27일 집행정지 결정이 확정되었습니다.

공정거래위원회는 2021년 11월 5일 당사의 자회사인 삼성전자서비스씨에스㈜의 대규모 기업집단 현황 공시 자진 정정공시(이사회 구성원 누락) 관련하여「독점규제및 공정거래에 관한 법률」제11조의4(기업집단현황 등에 관한 공시) 위반으로 과태료(2.4백만원)를 부과하였으며, 삼성전자서비스씨에스㈜는 2021년 11월 17일 이를 납부하였습니다. 삼성전자서비스씨에스㈜는 재발 방지를 위하여 담당자 추가 배치 등 내부관리 기준을 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

공정거래위원회는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제31조 제4항에 따른 2018년과 2019년 지정자료 제출시 삼성카드㈜의 사외이사가 지배하는 회사인 발벡케이피엘코리아㈜, 발벡케이피엘파트너스㈜, 발벡케이피엘자산운용㈜ 3개사를 상호출자제한기업집단「삼성」의 소속회사에서 누락했다는 이유로 2022년 3월 17일 당사의 이재용 부회장에 대해「경고」처분 하였습니다.

당사는 2022년 6월 27일 공정거래위원회로부터 '대리점거래의 공정화에 관한 법률' 제5조(대리점거래 계약서의 작성의무) 제1항 위반 혐의로 과태료 1천만원을 부과 받았으며, 이에 대하여 현재 이의신청 절차가 진행 중입니다.

당사는 공정거래법, 표시광고법, 대리점법 등 법률 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에 대해 관련 예방교육을 시행하고 있습니다.

(2) 기타 행정・공공기관(금융감독・과세 당국 등 포함)의 제재현황

[요약] (단위 : 백만원)

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적 제재금액	사유 및 근거 법령
2019.01.18	용인소방서	당사 (기흥사업장)	과태료	0.5	「화재예방, 소방시설 설치・유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조 (특정소방대상물의 소방안전관리) 제6항
2019.01.03 ~2022.02.23	고용노동부	당사 (평택, 온양, 천안, 기흥・화성사업장)	과태료	14.7	「구.산업안전보건법」제48조(유해・위험 방지 계획서의 제출 등) 제1항, 「산업안전보건법」제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등

2019.12.02 ~2020.12.28	고용노동부	당사 (광주사업장)	과태료	386.3	「구.산업안전보건법」 제41조(물질안전보건자료의 작성・비치 등) 제3항, 제10조(산업재해 발생 기록 및 보고 등) 제2항 등, 「산업안전보건법」 제57조(산업재해 발생 은폐 금지 및 보고 등) 제3항, 제164조(서류의 보존) 제1항 등
2021.03.02	환경부	당사 (광주사업장)	녹색기업 지정취소	-	「환경기술 및 환경산업 지원법」 제16조의3(녹색기업의 지정취소) 제1항 제1호
2021.08.10	법무부	당사	과태료	0.1	「출입국관리법」 제19조(외국인을 고용한 자 등의 신고의무)
2020.07.08	방송통신위원회	자회사 (삼성전자판매㈜)	시정명령, 과태료	36	「이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률」 제3조(지원금의 차별 지급 금지) 제1항, 제4조(지원금의 과다 지급 제한 및 공시) 제5항
2020.09.18	고용노동부	자회사 (삼성전자판매㈜)	공사중지명령, 과태료	5	「산업안전보건법」 제55조(중대재해 발생 시 고용노동부장관의 작업중지 조치), 제68조(안전보건조정자) 제1항
2021.04.01	고용노동부	자회사 (삼성전자서비스 씨에스㈜)	과태료	1	「고용보험법」 제15조(피보험자격에 관한 신고 등)
2021.09.29	고용노동부	자회사 (삼성전자서비스㈜)	부분작업중지 명령 과태료	14	「산업안전보건법」 제16조(관리감독자) 제1항, 제41조(고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방조치 등) 제7항, 제53조(고용노동부장관의 시정조치 등) 제3항, 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육) 제3항
2021.11.23	고용노동부	자회사 (삼성디스플레이㈜)	과태료	0.2	「산업안전보건법」 제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항
2022.10.13	광주시청	당사 (광주사업장)	과태료	3.2	「대기환경보전법」 제39조 제1항
2022.12.14	환경부	당사 (한국총괄)	과태료	2.0	「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제 17조 제2항
2022.12.22	환경부	당사 (광주사업장)	과태료	1.6	「대기환경보전법」 제31조 1항의 4
2022.12.23	고용노동부	당사 (광주사업장)	과태료	0.08	「산업안전보건법」 제37조 1항

당사는 2018년 9월 4일 발생한 기흥사업장의 이산화탄소 누출사고와 관련하여, 2018년 11월 27일부터 12월 6일까지 진행된 용인소방서의 소방특별조사에 따라 2019년 1월 18일「화재예방, 소방시설 설치・유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조(특정소방대상물의 소방안전관리) 제6항 위반으로 과태료(50만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 재발 방지를 위하여 법적 안전검사 관리시스템을 구축하고 검사 주기를 강화하는 등 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 2018년 9월 10일부터 9월 13일까지 진행된 평택사업장(P1-2)에 대한 고용노동부의 PSM 심사(2차)와 관련하여, 2019년 1월 3일「구.산업안전보건법」제48조(유해・위험 방지계획서의 제출 등) 제1항 위반으로 과태료(10백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다.

2020년 2월 19일 온양사업장에 대한 고용노동부의 PSM 이행상태점검과 관련하여, 2020년 2월 25일「산업안전보건법」제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등 위반으로 과태료(20만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다.

2020년 5월 26일부터 5월 28일까지 진행된 천안사업장에 대한 고용노동부의 PSM 이행상태점검과 관련하여, 2020년 6월 29일「산업안전보건법」제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등 위반으로 과태료(90만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다.

2020년 11월 16일부터 11월 18일까지 진행된 평택사업장에 대한 고용노동부의 PSM 이행상태점검과 관련하여, 2020년 11월 26일「산업안전보건법」제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등 위반으로 과태료(2.1백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다.

2020년 12월 7일부터 12월 11일까지 진행된 기흥・화성사업장에 대한 고용노동부의 PSM 이행상태점검과 관련하여, 2020년 12월 14일「산업안전보건법」제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등 위반으로 과태료(90만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다.

2022년 2월 21일부터 2월 23일까지 진행된 온양사업장에 대한 고용노동부의 PSM 이행상태 정기평가와 관련하여 PSM 평가 등급은 한 단계 향상되었으나, 4월 21일「산업안전보건법」제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등 위반으로 과태료(60만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다.

당사는 위반사항에 대해서 조치 후 고용노동부에 개선 결과를 제출하였으며, PSM 혁신조직을 신설하여 인허가, 설계 반영, 12대 실천과제, 전문성 향상 활동을 통해 PSM 상시 운영체계를 구축하여 운영 중에 있으며, 현장 공정안전 전문가를 육성하고 공정안전 자체평가를 실시하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 2019년 11월 28일 광주사업장에 대한 고용노동부의 MSDS 경고표시 이행실태 감독과 관련하여, 2019년 12월 2일「구.산업안전보건법」제41조(물질안전보건자료의 작성・비치 등) 제3항 등 위반으로 과태료(1.4백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 화학물질 취급 장소에 대하여 전수조사 및 개선 조치하였으며, G-EHS 신규 화학물질의 사전평가 Process를 개선하고 화학 물질 사용부서 관리감독자를 교육하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 2020년 5월 19일 광주사업장에서 발생한 산업재해와 관련하여, 고용노동부 광주지방고용노동청에 산업재해조사표를 지연 보고하여 2020년 6월 26일「산업안전보건법」제57조(산업재해 발생 은폐 금지 및 보고 등) 제3항 위반으로 과태료(7백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 재발 방지를 위하여 현장 환경안전담당자 및 관리감독자 대상으로 특별 교육을 실시하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 2020년 8월 18일부터 2021년 1월 18일까지 진행된 광주사업장에 대한 고용노동부 광주지방고용노동청의 현장조사 중 2015년부터 광주사업장에서 발생한 산업재해와 관련하여, 2020년 9월 1일「구.산업안전보건법」제10조(산업재해 발생 기록 및 보고 등) 제2항 위반으로 과태료(6백만원)가 발생하였고, 2020년 9월 10일과 9월 23일「산업안전보건법」제57조(산업재해 발생 은폐 금지 및 보고 등) 제3항 및 제164조(서류의 보존) 제1항 위반으로 과태료(60.4백만원과 11.5백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 또한 2020년 10월 19일「산업안전보건법」제57조(산업재해 발생 은폐 금지 및 보고 등) 제3항 위반으로 과태료(20백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였으며, 2020년 12월 28일「구.산업안전보건법」제10조(산업재해 발생 은폐 금지 및 보고 등) 제2항 위반으로 과태료(280백만원)가 발생하여 납부 완료하였습니다. 당사는 재발 방지를 위하여 현장 환경안전담당자 및 관리감독자 대상으로 특별교육을 실시하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 2018년 녹색기업으로 지정된 광주사업장에 대해 2021년 3월 2일 환경부 영산강유역환경청으로부터 대기오염물질 측정값과 관련하여「환경기술 및 환경산업 지원법」제16조의3(녹색기업의 지정취소) 제1항 제1호를 이유로 녹색기업 지정취소를 통보받았습니다. 당사는 측정값에 대한 신뢰도를 높이기 위하여 주기적인 교차 측정 등을 실시하고 있습니다.

당사는 2021년 8월 10일 「출입국관리법」 제19조 1항 (외국인을 고용한 자 등의 신고의무)에 따른 외국인 고용 변동사실 신고의무를 위반하여 수원출입국・외국인청으로부터 과태료(10만원)가 발생하였으며, 자진납부 완료하였습니다. 당사는 퇴직프로세스 개선을 통해 외국인 퇴직자의 고용변동 신고기한을 엄수하기 위해 노력하고 있습니다.

2022년 7월 7일 광주지방법원에서 당사 임직원 2명에게 「환경분야 시험・검사 등에 관한 법률」 제18조 등 위반에 대한 선고가 완료 됨에 따라 2022년 10월 13일 광주시청으로부터 대기오염물질 자가측정결과 기록과 관련하여「대기환경보전법」제39조 (자가측정) 제1항 위반으로 과태료(3.2백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 측정값에 대한 신뢰도를 높이기 위하여 주기적인 교차 측정 등을 실시하고 있습니다.

당사는 2022년 11월 28일부터 29일까지 광주사업장에 대한 환경부의 대기방지시설 감독과 관련하여, 2022년 12월 22일「대기환경보전법」제31조 (배출시설과 방지시설의 운영) 제1항 위반으로 과태료(1.6백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 대기방지시설 점검을 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 환경부로부터 2022년 12월 14일「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제17조 (배출권 할당의 취소) 제2항 위반으로 과태료(2백만원)를 부과 받았으며, 이에 대하여 현재 이의신청 절차가 진행 중입니다.

당사는 2022년 12월 19일부터 21일까지 광주사업장에 대한 고용노동부의 산업안전보건관리 감독과 관련하여, 2022년 12월 23일「산업안전보건법」제37조 (안전보건표지의 설치·부착) 제1항 위반으로 과태료(8만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 안전표지판 설치 및 부착 점검을 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

삼성전자판매㈜는 2020년 7월 8일 방송통신위원회로부터「이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률」제3조(지원금의 차별 지급 금지) 제1항, 제4조(지원금의 과다 지급 제한 및 공시) 제5항 위반으로 시정명령 및 과태료(36백만원) 부과 처분을 받아 납부하였습니다. 삼성전자판매㈜는 관련 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에 대해 예방교육 등을 시행하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

삼성전자판매㈜는 2020년 9월 16일 삼성디지털프라자 홍대점 신설 공사 현장에서 엘리베이터 벽체 공사 중 작업자가 사망한 사고와 관련하여, 2020년 9월 17일 현장 조사 후 고용노동부 서울지방고용노동청 서울서부지청으로부터 9월 18일「산업안전보건법」제55조(중대재해 발생 시 고용노동부장관의 작업중지 조치)에 따라 공사중지 명령을 받았고「산업안전보건법」제68조(안전보건조정자) 제1항 위반으로 과태료(5백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였으며, 이후 안전보건 조정자를 선임하였습니다. 삼성전자판매㈜는 재발 방지를 위하여 현장 안전담당자 및 관리감독자 대상으로 특별 교육을 실시하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

삼성전자서비스씨에스㈜는 고용보험 취득신고를 지연 신고하여 고용노동부 중부지방고용노동청으로부터 2021년 4월 1일「고용보험법」제15조(피보험자격에 관한 신고 등) 위반으로 과태료(1백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 삼성전자서비스씨에스㈜는 재발 방지를 위하여 고용보험법 개정사항에 대해 주기적으로 검토하고 담당자 실무 교육을 실시하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

삼성전자서비스㈜는 2021년 9월 28일 세탁기 수리 중 발생한 작업자의 감전사와 관련하여, 2021년 9월 29일 고용노동부 서울지방고용노동청 서울남부지청으로부터 「산업안전보건법」 제53조(고용노동부장관의 시정조치 등)에 따른 부분작업중지 명령을 받았습니다. 이에 삼성전자서비스㈜는 전국 사업장에 대한 안전보건조치 개선 대책(안)을 제출하여 2021년 11월 10일부로 부분작업중지명령이 해제되었습니다. 또한 2021년 11월 15일 「산업안전보건법」 제16조(관리감독자) 제1항, 제41조(고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방조치 등) 제7항, 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육) 제3항 등 위반으로 과태료 14백만원이 발생하였으며, 2021년 12월 28일 과태료를 자진납부 완료하였습니다.

삼성디스플레이㈜는 2021년 11월 15일부터 11월 16일까지 진행된 기흥사업장에 대한 고용노동부의 PSM 이행상태점검과 관련하여 2021년 11월 23일 「산업안전보건법」 제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등 위반으로 과태료 16만원이 발생하였으며, 자진 납부 완료하였습니다.

다. 한국거래소 등으로부터 받은 제재현황

해당사항 없습니다.

라. 단기매매차익 발생 및 반환에 관한 사항

해당사항 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

해당사항 없습니다.

나. 대외후원 현황

현 황	금 액	내 용	비 고
삼성꿈장학재단 기부금 출연	11.2억원	· 저소득층 고등학생 학습지원	2020.01.30 이사회 결의
2020년 사회공헌 매칭기금 운영계획	118.9억원	· 당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금으로 구성되며, 2020년 회사매칭기금으로 118.9억원 운영 · 청소년 교육 관련 사회공헌 활동에 사용	2020.02.21 이사회 결의
학교법인 충남삼성학원 기부금 출연	25.76억원	· 지역 교육 환경 개선 도모	
코로나19 관련 긴급 구호지원	230억원	· 코로나19 관련 피해자 및 지역사회 긴급 구호지원	2020.02.26 이사회 결의
삼성복지재단 등 기부금 출연	518억원	· 저소득층 중학생 학습지원 프로그램인 드림클래스 운영 (삼성복지재단, 106억원) · 삼성서울병원 시설 및 연구 인프라 지원, 메르스 백신개발 연구 지원 (삼성생명공익재단, 265억원) · 교직원 법정부담금 지원 및 삼성장학금 운영 등(성균관대학, 147억원)	2020.04.29 이사회 결의
DS 부문 우수협력사 인센티브	약 620억원	· 사업장내 안전사고 예방, 생산성 향상 및 협력사와의 동반성장 확산 · 대상: DS 부문 상주 1, 2차 협력회사 중 중소기업	
호암재단 기부금 출연	41억원	· 학술, 예술 및 인류 복지 증진에 크게 공헌한 인물 시상	2020.05.27 이사회 결의
희망2021나눔캠페인 기부금 출연	338억원	· 연말 이웃사랑 성금 보금 참여로 소외계층을 돕고 기업의 사회적 책임을 다하고자 사회복지공동모금회에 출연	2020.11.30 이사회 결의
Samsung Global Goals 기부금 출연	$1,421,154 (약 15.7억원)	· UNDP(United Nations Development Programme)에 전달하여 각 국의 구호 활동 등에 활용	
2021년 사회공헌 매칭기금 운영계획	116.1억원	· 당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금으로 구성되며, 2021년 회사매칭기금으로 116.1억원 운영 · 청소년 교육 관련 및 취약계층 관련 사회공헌 사업에 활용	2021.02.16 이사회 결의
학교법인 충남삼성학원 기부금 출연	24.46억원	· 지역 교육 환경 개선 도모	
삼성복지재단 등 기부금 출연	601억원	· 저소득층 중학생 학습지원 프로그램인 드림클래스 운영 (삼성복지재단, 115억원) · 삼성서울병원 시설 및 연구 인프라 지원, 응급헬기 운영 지원 (삼성생명공익재단, 299억원) · 교직원 법정부담금 지원 및 삼성장학금 운영 등(성균관대학, 150억원) · 학술, 예술 및 인류 복지 증진에 크게 공헌한 인물 시상(호암재단, 37억원)	2021.04.29 이사회 결의
DS 부문 우수협력사 인센티브	약 632억원	· 사업장내 안전사고 예방, 생산성 향상 및 협력사와의 동반성장 확산 · 대상: DS부문 상주 1,2차 협력회사 중 중소기업	
국제기능올림픽	150만 유로	· 제46회 중국 상하이 국제기능올림픽대회 및	2021.10.28

후원	(약 20.9억원)	국제기능올림픽위원회(WorldSkills International) 후원	이사회 결의
공동투자형 기술개발 협약기금 출연	150억원	・중소벤처기업부 주관 공동투자형 기술개발사업 참여 ・중소벤처기업부와 협약기금을 조성, 협약기금은 중소기업이 제안한 로봇·AI / 바이오헬스 / 시스템 반도체, 소재부품장비 국산화 관련 과제 평가 후 최종 선정된 중소기업에 지급	2021.10.28 이사회 결의
희망2022 나눔캠페인 기부금 출연	256억원	・연말 이웃사랑 성금 보금 참여로 소외계층을 돕고 기업의 사회적 책임을 다하고자 사회 복지공동모금회에 출연	2021.11.30 이사회 결의
Samsung Global Goals 기부금 출연	$2,689,094 (약 32.0억원)	・United Nations Development Programme(UNDP)에 전달하여, 각 국의 구호활동 등에 활용	2021.11.30 이사회 결의
2022년 사회공헌 매칭기금 운영계획	117.5억원	・당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금으로 구성되며, 2022년 회사매칭기금으로 117.5억원 운영 ・청소년 교육 관련 및 취약계층 관련 사회공헌 사업에 활용	2022.02.15 이사회 결의
학교법인 충남삼성학원 기부금 출연	23.24억원	・지역 교육 환경 개선 도모	
삼성복지재단 등 기부금 출연	468억원	・저소득층 중학생 학습지원 프로그램인 드림클래스 운영 (삼성복지재단, 44억원) ・삼성서울병원 리모델링 공사비 지원(삼성생명공익재단, 232억원) ・교직원 법정부담금 지원 및 삼성장학금 운영 등(성균관대학, 150억원) ・학술, 예술 및 인류 복지 증진에 크게 공헌한 인물 시상(호암재단, 42억원)	2022.04.28 이사회 결의
DS부문 우수협력사 인센티브	약 740억원	・사업장내 안전사고 예방, 생산성 향상 및 협력사와의 동반성장 확산 ・대상: DS부문 상주 1,2차 협력회사 중 중소기업	
서울대 반도체공동연구소 운영비 기부금 출연	50억원	・서울대학교 반도체공동연구소의 교육 장비 인프라 및 연구 인력 채용을 위한 운영비 지원	2022.07.28 이사회 결의

※ 대외후원 현황 및 금액은 이사회 결의 기준으로 기재하였습니다.

다. 녹색경영

당사는 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 '녹색기업 지정' 및 '녹색기술 인증'을 확대하고 있습니다. 특히 관련 법규에서 요구하는 사업장에서 발생하는 '온실가스배출량'과 '에너지 사용량'을 정부에 신고하고 지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다.

(녹색기업 지정)

당사는 오염물질 감소, 자원과 에너지의 절감, 제품의 환경성 개선, 녹색경영체제의 구축 등 친환경기업으로서의 책임을 다하고 있으며,「환경기술 및 환경산업 지원법」제16조의2(녹색기업의 지정 등)에 따라 2022년말 현재(별도 기준) 수원사업장, 구미사업장, 기흥・화성사업장, 평택사업장, 온양사업장이 녹색기업으로 지정되어 있습니다. 한편, 2021년 3월 광주사업장은「환경기술 및 환경산업 지원법」제16조의3(녹색기업의 지정취소) 제1항 제1호에 따라 녹색기업 지정이 취소되었습니다.

(녹색기술 인증)

당사는「저탄소 녹색성장 기본법」제32조(녹색기술・녹색산업의 표준화 및 인증 등) 2항에 따라 '녹색기술 인증'을 취득하고 있습니다. 당사의 녹색기술 개발은 사람과 자연을 존중하는 기업 활동을 목표로 하는 플래닛퍼스트(Planet First) 전략으로 친환경 제품 개발과 보급 확대에 주력한 결과, 인증 제도가 시작된 2010년 이래 2022년말 현재 총 11건의 유효 녹색기술 인증을 확보하고 있습니다. 또한 당사는 인증 받은 녹색기술이 적용된 상용화 제품에 대해 부여하는 '녹색기술제품 확인' 인증을 총 183개 모델에 대해서 보유 중입니다.

2022년말 현재 녹색기술 인증 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건)

부문	녹색기술인증	건수
DX 부문	고효율 전력 변환 기술을 활용한 노트북 대기전력 저감기술, 고효율 히트펌프와 열교환기를 적용한 의류건조기 에너지 효율 향상 기술, 모니터 대기전력 저감 기술 등	11

※ 별도 기준입니다.

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조(기후변화대응 및 에너지의 목표관리) 제6항에 따라 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제44조(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 등의 보고)와 당국의 지침에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자에게 공개하고 있습니다.

정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

(단위 : tCO_2-eq, TJ)

구 분	2022년	2021년	2020년
온실가스(tCO_2-eq)	15,208,803	14,515,620	12,534,930
에너지(TJ)	210,382	200,942	177,156

※ 별도 기준입니다.

※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등입니다.

※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.

※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 2015년부터「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제8조(할당대상업체의 지정 및 지정취소)에 따라 온실가스 배출권 할당대상업체에 해당합니다.

라. 건강친화기업 인증

당사는 임직원 건강증진을 위해 사내부속의원, 물리치료실, 근골격계예방센터, 마음건강클리닉 등 다양한 의료시설을 운영하고 있고, 건강증진 프로그램을 통해 직원 스스로가 건강관리를 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이를 인정받아 DS 부문은 「국민건강증진법」 제6조의2 제1항에 따라 2022년 12월 7일 보건복지부 장관으로부터 건강친화기업 인증을 취득하였습니다 (유효기간 : 2022년 12월 7일 ~ 2025년 12월 6일).

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

당사의 연결대상 종속기업은 2022년말 현재 232개사입니다. 전년말 대비 8개 기업이 증가하고 4개 기업이 감소하였습니다.

☞ 본문 위치로 이동

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도 말 자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	1978. 07	85 Challenger Rd., Ridgefield Park, New Jersey, USA	전자제품 판매	37,883,156	의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 1110호)	O
Samsung International, Inc. (SII)	1983. 10	9335 Airway Rd. #105, San Diego, California, USA	전자제품 생산	1,595,348	상동	O
Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	1988. 03	Parque Ind., El Florido 1ra y 2da Secc, Tijuana, B.C., Mexico	전자제품 생산	114,887	상동	O
Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	2017. 08	284 Mawsons Way, Newberry, South Carolina, USA	가전제품 생산	1,004,065	상동	O
Samsung Research America, Inc (SRA)	1988. 10	665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA	R&D	824,812	상동	O
SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	2016. 08	665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA	해외자회사 관리	190,103	상동	O
SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	2016. 08	665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA	신기술사업자, 벤처기업 투자	305,097	상동	O
NeuroLogica Corp.	2004. 02	14 Electronics Ave., Danvers, Massachusetts, USA	의료기기 생산 및 판매	236,677	상동	O
Samsung HVAC America, LLC	2001. 07	3001 Northern Cross Blvd. #361, Fort Worth, Texas, USA	에어컨공조 판매	62,570	상동	X
Joyent, Inc.	2005. 03	655 Montgomery St. #1600, San Francisco, California, USA	클라우드서비스	190,791	상동	O
Dacor Holdings, Inc.	1998. 12	14425 Clark Ave., City of Industry, California, USA	해외자회사 관리	8,533	상동	X
Dacor, Inc.	1965. 03	14425 Clark Ave., City of Industry, California, USA	가전제품 생산 및 판매	8,457	상동	X
SmartThings, Inc.	2012. 04	665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA	스마트홈 플랫폼	205,450	상동	O
TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	2002. 05	43130 Amberwood Plaza #210, Chantilly, Virginia, USA	네트워크장비 설치 및 최적화	31,801	상동	X
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	1983. 07	3655 N. 1st St., San Jose, California, USA	반도체・DP 판매	12,199,102	상동	O
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	1996. 02	12100 Samsung Blvd., Austin, Texas, USA	반도체 생산	9,301,017	상동	O
Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	2016. 06	3655 N. 1st St., San Jose, California, USA	해외자회사 관리	550,459	상동	O
SEMES America, Inc.	1998. 10	13400 Immanuel Rd., Pflugerville, Texas, USA	반도체 장비 서비스	2,292	상동	X

Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	1980. 07	2050 Derry Rd. West, Mississauga, Ontario, Canada	전자제품 판매	1,652,195	상동	O
AdGear Technologies Inc.	2010. 08	481 Viger West #300, Montreal, Quebec, Canada	디지털광고 플랫폼	125,162	상동	O
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	1995. 01	Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240 Diamond Tower, Sao Paulo, Brazil	전자제품 생산 및 판매	4,600,508	상동	O
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	1995. 07	Col. Chapultepec Morales, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, Mexico	전자제품 판매	1,816,895	상동	O
Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	2012. 12	Av. Benito Juarez #119, Parque Industrial Qro, Sta. Rosa Jauregui C.P, Queretaro, Mexico	가전제품 생산	1,257,964	상동	O
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	1989. 04	Calle 50 Edificio PH Credicorp Bank Piso 16, Panama City, Panama	전자제품 판매	1,234,491	상동	O
Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	1995. 05	9800 NW 41st St. #200, Miami, Florida, USA	전자제품 판매	395,124	상동	O
Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	1997. 03	Carrera 7 #114-43 Oficina 606, Bogota, Colombia	전자제품 판매	487,904	상동	O
Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	1996. 06	Bouchard 710 Piso #8, Buenos Aires, Argentina	마케팅 및 서비스	102,325	상동	O
Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	2002. 12	Americo Vespucio Sur 100 Oficina 102, Las Condes, Chile	전자제품 판매	646,185	상동	O
Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	2010. 04	Av. Rivera Navarrete 501 Piso 6, San Isidro, Lima, Peru	전자제품 판매	357,460	상동	O
Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	2010. 05	Torre Kepler Piso 1, Av. Blandin Castellana, Municipio Chacao, Caracas, Venezuela	마케팅 및 서비스	37	상동	X
Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA)	2012. 07	Torre C Piso 23 Torre de Las Americas, Panama City, Panama	컨설팅	5,636	상동	X
Harman International Industries, Inc.	1980. 01	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA	해외자회사 관리	15,627,849	상동	O
Harman Becker Automotive Systems, Inc.	1981. 06	30001 Cabot Drive, Novi, Michigan, USA	오디오제품 생산, 판매, R&D	2,930,229	상동	O
Harman Connected Services, Inc.	2002. 02	636 Ellis St., Mountain View, California, USA	Connected Service Provider	2,249,385	상동	O
Harman Connected Services Engineering Corp.	2004. 09	636 Ellis St., Mountain View, California, USA	Connected Service Provider	2,980	상동	X
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	2005. 07	Av. Cupiuba 401, Distrito Industrial, Manaus, Amazonas, Brazil	오디오제품 생산, 판매	134,845	상동	O
Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	1997. 02	2290 Ave De Las Torres, Juarez, Chih, Mexico	오디오제품 생산	180,271	상동	O
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	1958. 11	BR-386 KM 435, Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, Brazil	오디오제품 판매, R&D	273,861	상동	O
Harman Financial Group LLC	2004. 06	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA	Management Company	755	상동	X
Harman International Industries Canada Ltd.	2005. 05	2900-550 Burrard St., Vancouver, British Columbia, Canada	오디오제품 판매	313	상동	X
Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	2014. 12	2290 Ave De Las Torres, Juarez, Chih, Mexico	오디오제품 판매	31,954	상동	X
Harman KG Holding, LLC	2009. 03	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA	해외자회사 관리	-	상동	X
Harman Professional, Inc.	2006. 07	8500 Balboa Blvd., Northridge, California, USA	오디오제품 판매, R&D	892,007	상동	O
Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	2014. 12	89 Nexus Way, Cayman Bay, Grand Cayman, Cayman Islands	벤처기업 투자	13,443	상동	X

China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	2017. 09	23 Lime Tree Bay Av., Grand Cayman, Cayman Islands	벤처기업 투자	8,089	상동	X
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	1995. 07	1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK	전자제품 판매	2,819,792	상동	O
Samsung Electronics Ltd. (SEL)	1999. 01	1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK	해외자회사 관리	6,711	상동	X
Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	1997. 04	No.5 The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, UK	반도체・DP 판매	102,683	상동	O
Samsung Electronics GmbH (SEG)	1984. 12	Am Kronberger Hang 6, Schwalbach/Ts., Germany	전자제품 판매	1,968,273	상동	O
Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	1982. 02	Am Kronberger Hang 6, Schwalbach/Ts., Germany	해외자회사 관리	651,158	상동	O
Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	1987. 12	Koelner Str. 12, Eschborn, Germany	반도체・DP 판매	816,633	상동	O
Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	1988. 01	1 Rue Fructidor, Saint-Ouen, France	전자제품 판매	1,053,910	상동	O
Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	1991. 04	Via Mike Bongiorno 9, Milano, Italy	전자제품 판매	959,801	상동	O
Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	1989. 01	Parque Empresarial Omega Edf. C Av. de Barajas 32, Alcobendas, Madrid, Spain	전자제품 판매	1,098,852	상동	O
Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	1982. 09	Lagoas, Edificio 5B, Piso 0, Porto Salvo, Portugal	전자제품 판매	273,915	상동	O
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	1989. 10	Samsung ter 1, Jaszfenyszaru, Hungary	전자제품 생산 및 판매	2,374,317	상동	O
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	1991. 05	Olof Palmestraat 10, Delft, Netherlands	물류	2,194,975	상동	O
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	1995. 07	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands	전자제품 판매	2,377,730	상동	O
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	2008. 10	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands	해외자회사 관리	10,841,515	상동	O
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	1992. 03	Box 1235, 16428, Kista, Sweden	전자제품 판매	697,034	상동	O
Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK)	2002. 06	Hviezdoslavova 807, Galanta, Slovakia	TV・모니터 생산	1,585,901	상동	O
Samsung Display Slovakia, s.r.o. (SDSK)	2007. 03	Voderady 401, Voderady, Slovakia	DP 임가공	28,179	상동	X
Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	1996. 04	ul.Marynarska 15, Warszawa, Poland	전자제품 판매	1,172,265	상동	O
Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	2010. 02	ul. Mickiewicza 52, Wronki, Poland	가전제품 생산	808,474	상동	O
Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	2007. 09	Sos. Pipera-Tunari, nr. 1/VII, Nord City Tower, Voluntari, Romania	전자제품 판매	371,708	상동	O
Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	2002. 01	Praterstraße 31, Vienna, Austria	전자제품 판매	574,106	상동	O
Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	2013. 05	Binzallee 4, Zurich, Switzerland	전자제품 판매	390,327	상동	O
Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	2010. 01	V Parku 14, Prague, Czech Republic	전자제품 판매	344,331	상동	O
SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	2001. 10	Duntes iela 6, Riga, Latvia	전자제품 판매	146,994	상동	O
Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	2010. 04	280 Kifissias Ave, Halandri 15232, Athens, Greece	전자제품 판매	129,431	상동	O
Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	2017. 04	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands	에어컨공조 판매	286,316	상동	O
Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	2004. 02	Torshamnsgatan 48, 16440, Kista, Sweden	R&D	26,918	상동	X
Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	2012. 09	c/o Novi Science park, Niels Jernes Vej 10, Aalborg Øst, Denmark	R&D	24,563	상동	X
Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	2012. 09	St. John's Houst, St. John's Innovation Park, Cowley Rd., Cambridge, UK	R&D	170,489	상동	O

SAMSUNG Zhilabs, S.L.	2008. 11	Numancia 69-73, 5F, Barcelona, Spain	네트워크 Solution 개발, 판매	9,812	상동	X
FOODIENT LTD.	2012. 03	Cornwall House, 31 Lionel St., Birmingham, UK	R&D	2,349	상동	X
Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	2006. 10	31 Novinsky Boulevard, Moscow, Russia	전자제품 판매	876,346	상동	O
Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	2007. 07	1 Vladenie, Perviy Severniy proezd St., Koryakovo, Borovsk, Kaluga, Russia	TV 생산	1,149,970	상동	O
Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	2008. 09	75A, Zhylianska St., Kiev, Ukraine	전자제품 판매	244,279	상동	O
Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	2022. 02	57 L'va Tolstogo St. Kyiv Ukraine	R&D	8,119	상동	X
Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	2008. 09	Naurizbay batyr st., Almaty, Republic of Kazakhstan	전자제품 판매	606,726	상동	O
Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	1997. 01	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands	전자제품 판매	1,960	상동	X
Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	2011. 11	12, building 1, Dvintsev St., Moscow, Russia	R&D	52,581	상동	X
Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	2014. 10	1065 Bridge Plaza Biz Centre 12F, 6 Bakikhanov St., Baku, Azerbaijan	마케팅	2,500	상동	X
Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	2022. 03	International Business Center, 107 B - Amir Temur str., Tashkent Uzbekistan	마케팅	6,418	상동	X
AKG Acoustics Gmbh	1947. 03	254, Laxenburger St., Vienna, Austria	오디오제품 생산, 판매	350,440	상동	O
Apostera UA, LLC	2020. 10	3 Sumska St., Kyiv, Ukraine	Connected Service Provider	631	상동	X
Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	2012. 11	C/ ERCILLA 17 3ºBILBAO48, Bizkaia, Spain	오디오제품 판매	1,399	상동	X
Harman Automotive UK Limited	2012. 10	Salisbury House, London Wall, London, UK	오디오제품 생산	-	상동	X
Harman Becker Automotive Systems GmbH	1990. 07	16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany	오디오제품 생산, 판매, R&D	3,962,309	상동	O
Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	2005. 12	17, Viale Luigi Majno, Milano (MI), Italy	오디오제품 판매	1,047	상동	X
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	1994. 08	19 Holland Fasor, Szekesfehervar, Hungary	오디오제품 생산, R&D	3,291,277	상동	O
Harman Belgium SA	1967. 04	4 Drukperstraat, Brussels, Belgium	오디오제품 판매	2,944	상동	X
Harman Connected Services AB.	1984. 10	24 Nordenskioldsgatan, Malmo, Sweden	Connected Service Provider	12,527	상동	X
Harman Finland Oy	1998. 07	Hermiankatu 1 A, Tampere, Finland	Connected Service Provider	-	상동	X
Harman Connected Services GmbH	2005. 12	45 Wittener Str., Bochum, Germany	Connected Service Provider	51,968	상동	X
Harman Connected Services Poland Sp.zoo	2007. 06	UL Kasprzaka 6, Lodz, Poland	Connected Service Provider	10,015	상동	X
Harman Connected Services UK Ltd.	2008. 09	Devonshire House, 60 Goswell Rd., London, UK	Connected Service Provider	54,603	상동	X
Harman Consumer Nederland B.V.	1995. 12	16 Danzigerkade, 1013 AP, Amsterdam, Netherlands	오디오제품 판매	489,585	상동	O
Harman Deutschland GmbH	1998. 03	Parkring 3 B. Munich, Garching, Germany	오디오제품 판매	13,547	상동	X
Harman Finance International GP S.a.r.l	2015. 04	6, rue Eugene Ruppert, Luxembourg	해외자회사 관리	-	상동	X
Harman France SNC	1995. 11	12 bis, rue des Colonnes-du-Trone, Paris, France	오디오제품 판매	167,450	상동	O

Harman Holding Gmbh & Co. KG	2002. 06	16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany	Management Company	5,700,548	상동	O
Harman Hungary Financing Ltd.	2012. 06	Holland Fasor 19, Szekesfehervar, Hungary	Financing Company	45,415	상동	X
Harman Inc. & Co. KG	2012. 06	16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany	해외자회사 관리	4,540,799	상동	O
Harman International Estonia OU	2015. 05	Parnu mnt 139a, Tallinna linn, Harju maakond, Estonia	R&D	232	상동	X
Harman International Industries Limited	1980. 03	Westside, Two London Rd, Apsley, Hemel Hempstead, Hertfordshire, UK	오디오제품 판매, R&D	79,014	상동	O
Harman International Romania SRL	2015. 02	5-7, Bdul. Dimitrie Pompeiu, Metroffice, Cladirea A parter, et. 2 si et. 4, Sec. 2, Bucharest, Romania	R&D	17,145	상동	X
Harman Finance International, SCA	2015. 04	6, rue Eugene Ruppert, Luxembourg	Financing Company	10,320	상동	X
Harman Management Gmbh	2002. 04	Becker Goering St. 16, Karlsbad, Germany	해외자회사 관리	-	상동	X
Harman Professional Kft	2014. 12	Holland Fasor 19, Szekesfehervar, Hungary	오디오제품 생산, R&D	68,463	상동	X
Harman Professional Denmark ApS	1987. 07	Olof Palmes Alle 18., Aarhus, Denmark	오디오제품 판매, R&D	55,117	상동	X
Red Bend Software Ltd.	2004. 08	25 Farringdon Street, London, UK	소프트웨어 디자인	-	상동	X
Red Bend Software SAS	2002. 10	Immeuble 15 place Georges Pompidou, MontignyLe Bretonneux, France	소프트웨어 디자인	7,259	상동	X
Studer Professional Audio GmbH	2003. 11	Althardstrasse 30, Regensdorf, Switzerland	오디오제품 판매, R&D	4,586	상동	X
Harman Connected Services OOO	1998. 11	8 Kovalikhinskaya St., Nizhny Novgorod, Russia	Connected Service Provider	37,721	상동	X
Harman RUS CIS LLC	2011. 08	RS 12/1 Dvintsev street, Moscow, Russia	오디오제품 판매	52,838	상동	X
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	1995. 05	Butterfly Building A, Dubai Media City, Dubai, UAE	전자제품 판매	1,031,216	상동	O
Samsung Electronics Turkiye (SETK)	1984. 12	Flatofis Is Merkezi Otakcilar Caddesi No.78 Kat 3 No. B3 Eyup, Istanbul, Turkey	전자제품 판매	693,954	상동	O
Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	2021. 02	Flatofis Is Merkezi Otakcilar Caddesi No.78 Kat 3 No. B3 Eyup, Istanbul, Turkey	전자제품 생산	130,961	상동	O
Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. (SELV)	2009. 07	Building Nr.5, King Hussein Business Park, King Abdullah II St., Amman, Jordan	전자제품 판매	262,165	상동	O
Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	2009. 11	Lot N°9 Mandarouna 300 Route Sidi Maarouf, Casablanca, Morocco	전자제품 판매	291,185	상동	O
Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG)	2012. 07	62815 Piece No. 98, Engineering Sector, Kom Abu Radi, Al Wasta, BeniSuef, Egypt	전자제품 생산 및 판매	1,055,570	상동	O
Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	2012. 09	Holland Building 1F, Europark, Yakum, Israel	마케팅	16,764	상동	X
Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	2012. 09	2eme etage Immeuble Adonis, rue du Lac D'annecy, Tunis, Tunisia	마케팅	5,294	상동	X
Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	2012. 11	No.4 1F Park Lane Tower 172 Turfail Rd., Cantt, Lahore, Pakistan	마케팅	3,765	상동	X
Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	2019. 11	Hamad Tower, Olaya District, Riyadh, Saudi Arabia	전자제품 판매	469,588	상동	O
Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	2007. 10	10 Oholiav St., Ramat Gan, Israel	R&D	153,328	상동	O

Corephotonics Ltd.	2012. 01	25 Habarzel St., Tel Aviv, Israel	R&D	21,964	상동	X
Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	1994. 06	2929 William Nicol Drive, Bryanston, Johannesburg, South Africa	전자제품 판매	573,688	상동	O
Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	2014. 07	35 Umkhomazi Drive, La Mercy, Kwa-Zulu Natal, South Africa	TV・모니터 생산	81,698	상동	O
Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	2010. 03	Mulliner Tower, Alfred Rewane Rd., Ikoyi, Lagos, Nigeria	마케팅	33,487	상동	X
Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	2011. 12	Milford Suites 4F, Nairobi, Kenya	마케팅	18,273	상동	X
Global Symphony Technology Group Private Ltd.	2002. 01	International Financial Services Ltd, IFS Court, TwentyEight CyberCity, Ebene, Mauritius	해외자회사 관리	61,038	상동	X
Harman Connected Services Morocco	2012. 04	Technopark, Route Nouaceur, Rs 114 & CT1029, Casablanca, Morocco	Connected Service Provider	73	상동	X
Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	2009. 10	IFS Court Twenty Eight Cybercity, Ebene, Mauritius	해외자회사 관리	93,636	상동	O
Red Bend Ltd.	1998. 02	4 HaCharash St., Neve Ne'eman Industrial Park, Hod Ha'Sharon, Israel	오디오제품 생산	129,006	상동	O
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	2006. 07	30 Pasir Panjang Rd., Mapletree Business City, Singapore	해외자회사 관리	26,894,611	상동	O
Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	2020. 10	30 Pasir Panjang Rd., Mapletree Business City, Singapore	전자제품 판매	625,194	상동	O
Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME)	2003. 05	#E-09-01, Level 9, East Wing, No.1 Jalan 1/68F, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia	전자제품 판매	541,255	상동	O
Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	1995. 03	Tuanku Jaafar Industrial Park, Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia	전자제품 생산	24,689	상동	X
Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA)	1989. 09	North Klang Straits, Area 21 Industrial Park, Port Klang, Selangor, Malaysia	가전제품 생산	278,943	상동	O
Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	1995. 01	938 1A Highway, Linh Trung ward, Thu Duc Dist, Ho Chi Minh, Vietnam	전자제품 판매	129,160	상동	O
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	2008. 03	Yentrung Commune, Yenphong Dist, Bacninh, Vietnam	전자제품 생산	10,931,037	상동	O
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	2013. 03	Yen Binh 1, Industrial Park, Pho Yen district, Thai Nguyen, Vietnam	통신제품 생산	15,718,299	상동	O
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	2015. 02	Lot I-11, D2 Road, Saigon Hi-Tech Park, District 9, Ho Chi Minh, Vietnam	전자제품 생산 및 판매	3,732,057	상동	O
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	2014. 07	Yenphong I I.P, Yentrung Commune, Yenphong Dist, Bacninh, Vietnam	DP 생산	7,471,680	상동	O
DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	2022. 06	Lot CN9, Song Cong II Industrial Zone, Tan Quang, SongCong, Thai Nguyen, Vietnam	DP 부품 생산	58,171	상동	X
PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	1991. 08	Cikarang Industrial Estate, JL. Jababeka Raya Blok F29-33, Cikarang, Bekasi, West Java, Indonesia	전자제품 생산 및 판매	883,023	상동	O
PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	2003. 03	Prudential Tower 23F Jl. Jend. Sudirman Kav 79, Jakarta, Indonesia	전자제품 판매 및 서비스	58,012	상동	X
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	1988. 10	313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd, Sriracha Industry Park, T.Bung A.Sriracha Chonburi, Thailand	전자제품 생산 및 판매	3,263,473	상동	O
Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	2016. 09	3F Kolao Tower 2, 23 Singha Rd., Vientiane, Laos	마케팅	1,099	상동	X

Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	1996. 03	8F HanjinPhil Building 1128 University Parkway, North Bonifacio, Global City, Taguig, Philippines	전자제품 판매	353,596	상동	O
Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	1987. 11	Quad Samsung, 8 Parkview Drive, Homebush Bay 2127, Sydney, Australia	전자제품 판매	593,991	상동	O
Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	2013. 09	24 The Warehouse Way, Northcote, Auckland, New Zealand	전자제품 판매	178,053	상동	O
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	1995. 08	Two Horizon Centre, Golf Course RD, Gurgaon, Haryana, India	전자제품 생산 및 판매	6,772,537	상동	O
Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	2012. 01	6th Floor, Salarpuria Sattva Magnificia, Old Madras Road, Bengaluru, Karnataka, India	마케팅	2,082	상동	X
Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	2019. 07	B-1, Sector 81, Phase-II, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India	DP 생산	597,383	상동	O
Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	2005. 05	Bagmane Tech. Park, Bangalore, Karnataka, India	R&D	351,226	상동	O
Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	2010. 08	Gualshan-1, Gulshan Ave., Dhaka, Bangladesh	R&D	16,386	상동	X
Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL)	2017. 11	Ward No 1, Durbar Marg, Kathmandu Municipality, Kathmandu, Nepal	서비스	506	상동	X
Samsung Japan Corporation (SJC)	1975. 12	Shinagawa Grand Central Tower, Konan, Minato, Tokyo, Japan	반도체・DP 판매	1,445,517	상동	O
Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	1992. 08	2-7, Sugasawa-cho, Tsurumi-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan	R&D	157,868	상동	O
Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	2008. 09	Iidabashi Grand Bloom, 2-10-2, Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan	전자제품 판매	906,235	상동	O
Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	2002. 04	Survey No. 85 & 86, Sadarmangala Village, Krishnarajapuram Hobli, Bangalore, India	Connected Service Provider	305,295	상동	O
Harman International (India) Private Limited	2009. 01	Plot No. 9, Phase I , Doddenakkundi Industrial Area, K.R. Puram Hobli, Bangalore, India	오디오제품 판매, R&D	370,100	상동	O
Harman International Industries PTY Ltd.	2014. 12	Warehouse 25 26-18, Roberna St., Moorabbin, Victoria, Australia	해외자회사 관리	-	상동	X
Harman International Japan Co., Ltd.	1991. 06	14F Sumitomo Fudosan Akihabara-ekimae, Kanda, Chiyoda, Tokyo, Japan	오디오제품 판매, R&D	77,535	상동	O
Harman Singapore Pte. Ltd.	2007. 08	108, Pasir Panjang Rd., #02-08 Golden Agri Plaza, Singapore	오디오제품 판매	14,332	상동	X
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	1996. 03	Fortune Financial Center, No5. Dongsanhuan Zhong Rd., Chaoyang, Beijing, China	전자제품 판매	13,830,988	상동	O
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	1988. 09	33F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong	전자제품 판매	1,366,841	상동	O
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	1994. 11	10F, No.399, Rui Guang Rd., Nei Hu, Taipei, Taiwan	전자제품 판매	1,364,801	상동	O
Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. (TSEC)	1993. 04	#12, no 4 Big St., Dong Ting Rd., Teda, Tianjin, China	TV・모니터 생산	392,205	상동	O
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	1995. 04	No.501, SuHong East Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	가전제품 생산	668,331	상동	O
Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	1995. 04	No.501, SuHong East Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	가전제품 생산	504,994	상동	O

Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	2002. 09	No.198, Fangzhou Rd., Suzhou Industrial park, Suzhou, China	R&D	150,161	상동	O
Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC)	2001. 03	No.9 WeiWu Rd. Micro Electronic Industrial Park, Xiqing, Tianjin, China	통신제품 생산	643,732	상동	O
Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	2000. 09	12/F Zhongdian fazhan Building, No. 9, xiaguangli, Chaoyang, Beijing, China	R&D	106,400	상동	O
Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	2004. 05	8/F, Huijie Plaza, 268 Zhongshan Rd., Nanjing, China	R&D	25,344	상동	X
Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	2010. 01	A3 Building, No.185 Kexue Ave., Science City, Luogang, Guangzhou, China	R&D	109,198	상동	O
Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	2013. 03	22F, Building 2C, Shenzhen Software Industry Base, Nanshan District, Shenzhen, China	R&D	38,911	상동	X
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	2001. 10	3F, No.458, Fute North Rd., Shanghai, China	반도체・DP 판매	5,067,891	상동	O
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	2012. 09	No.1999, Xiaohe Rd., Changan, Xian, China	반도체 생산	17,095,000	상동	O
Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	2016. 04	8F Customs Clearance Center, No.5 Tonghai First Rd., Changan, Xian, China	반도체・DP 판매	906,967	상동	O
Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	1994. 12	No.15, JinJiHu Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	반도체 임가공	1,494,205	상동	O
Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	2009. 05	No 1. Weisan Rd., Micro Electronic Industrial Park., Xiqing, Tianjin, China	LED 생산	509,355	상동	O
Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	2003. 04	No.15, Jinjihu Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	R&D	76,826	상동	O
Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	2001. 11	High Technology Industrial Zone, Houjie, Dongguan, China	DP 생산	2,135,132	상동	O
Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	2004. 06	No.25, Mip Fourth Rd., Xiqing, Tianjin, China	DP 생산	1,446,605	상동	O
SEMES (XIAN) Co., Ltd.	2013. 07	#A501, ZTE PLAZA, No.10 Tangyan South Rd., Gaoxin, Xian, China	반도체・FPD 장비 서비스	3,712	상동	X
Samsung Semiconductor Investment L.P. I	2021. 12	#409, Building 2, No. 599, Wanzhen Road, Zhenxinxincun St., Jiading Dist., Shanghai, China	신기술사업자, 벤처기업 투자	14,754	상동	X
Harman (China) Technologies Co., Ltd.	2011. 03	No.68, First Yinquan Rd., Zhengxing, Dandong, China	오디오제품 생산	181,150	상동	O
Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	2013. 03	20F, Modern Logistics No.88 Modern Ave., Suzhou, China	오디오제품 판매	9,890	상동	X
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	2006. 09	No.125, Fangzhou Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	오디오제품 생산, R&D	351,647	상동	O
Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	2010. 10	Suite 2903B, Level 29, 288, West Nanjing Rd., Huangpu, Shanghai, China	오디오제품 판매	347	상동	X
Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	2007. 08	14F, 15F, No 383 Jiaozi Ave., High-tech, Chengdu, China	Connected Service Provider	10,427	상동	X
Harman Holding Limited	2007. 05	Flat/RM A 12F, Kiu Fu Commercial Building, 300 Lockhart Rd., Wan Chai, Hong Kong	오디오제품 판매	765,662	상동	O

Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	2009. 06	30F, No. 288, Nanjing Road West, Shanghai, China	오디오제품 판매, R&D	589,116	상동	O
Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	2004. 09	14F, China Merchants Bureau Port Building, Merchants St., Nanshan, Shenzhen, China	오디오제품 판매, R&D	48,247	상동	X
삼성디스플레이㈜	2012. 04	경기도 용인시 기흥구 삼성로 1(농서동)	DP 생산 및 판매	57,302,567	상동	O
에스유머티리얼스㈜	2011. 08	충청남도 아산시 탕정면 탕정로 380-2	DP 부품 생산	36,204	상동	X
스테코㈜	1995. 06	충청남도 천안시 서북구 3공단1로 20(백석동)	반도체 부품 생산	133,987	상동	O
세메스㈜	1993. 01	충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 77	반도체・FPD 장비 생산, 판매	2,065,558	상동	O
삼성전자서비스㈜	1998. 10	경기도 수원시 영통구 삼성로 290(원천동)	전자제품 수리 서비스	711,020	상동	O
삼성전자서비스씨에스㈜	2018. 10	경기도 수원시 영통구 중부대로 324(매탄동)	고객상담서비스	15,593	상동	X
삼성전자판매㈜	1996. 07	경기도 성남시 분당구 백현로101번길 30	전자제품 판매	1,393,235	상동	O
삼성전자로지텍㈜	1998. 04	경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)	종합물류대행	415,659	상동	O
삼성메디슨㈜	1985. 07	강원도 홍천군 남면 한서로 3366	의료기기 생산 및 판매	528,834	상동	O
주식회사 희망별숲	2022. 12	경기도 용인시 기흥구 서천로 201번길 14, 프리미엄원희캐슬 2층	식품 제조 가공	895	상동	X
㈜미래로시스템	1994. 01	경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120(영덕동)	반도체 소프트웨어 개발 및 공급	39,440	상동	X
㈜도우인시스	2010. 03	충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 605-1(송절동)	DP 부품 생산	128,665	상동	O
지에프㈜	2015. 10	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 38	DP 부품 생산	7,241	상동	X
㈜하만인터내셔널코리아	2005. 01	서울특별시 강남구 테헤란로 223(역삼동), 큰길타워 17층	소프트웨어 개발 및 공급	24,424	상동	X
SVIC 21호 신기술투자조합	2011. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	82,214	상동	O
SVIC 22호 신기술투자조합	2011. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	56,370	상동	X
SVIC 26호 신기술투자조합	2014. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	50,614	상동	X
SVIC 28호 신기술투자조합	2015. 02	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	370,503	상동	O
SVIC 29호 신기술투자조합	2015. 04	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	27,519	상동	X
SVIC 32호 신기술투자조합	2016. 08	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	283,547	상동	O
SVIC 33호 신기술투자조합	2016. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	334,846	상동	O
SVIC 37호 신기술투자조합	2017. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	22,549	상동	X
SVIC 40호 신기술투자조합	2018. 06	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	40,354	상동	X
SVIC 42호 신기술투자조합	2018. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	35,845	상동	X
SVIC 43호 신기술투자조합	2018. 12	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	11,034	상동	X
SVIC 45호 신기술투자조합	2019. 05	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	221,274	상동	O

SVIC 48호 신기술투자조합	2019. 12	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	75,744	상동	O
SVIC 52호 신기술투자조합	2021. 05	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	46,829	상동	X
SVIC 55호 신기술투자조합	2021. 09	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	136,758	상동	O
SVIC 56호 신기술투자조합	2021. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	31,135	상동	X
SVIC 57호 신기술투자조합	2022. 08	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	18,681	상동	X
반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	2017. 03	서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동), 한국거래소 별관 4층	반도체산업 투자	69,862	상동	X
시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	2020. 04	서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동), 한국거래소 별관 4층	반도체산업 투자	79,664	상동	O

※ 주요 사업에 대한 상세 내역은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

※ 주요 종속기업 여부 판단기준은 최근사업연도말 자산총액 750억원 이상입니다.

(종속기업의 변동)

(단위 : 개사)

구 분	미주	유럽 · CIS	중동 · 아프리카	아시아 (중국 제외)	중국	국내	합계	변동내역	
								증 가	감 소
제51기말 (2019년말)	54	75	19	30	34	28	240	-	-
제52기 증감	1	-	-	-	△1	1	1	[미주: 4개사] · TeleWorld Solutions, Inc. (TWS) · TWS LATAM B, LLC · TWS LATAM S, LLC · SNB Technologies, Inc. Mexico, S.A. de C.V [아시아(중국 제외): 1개사] · Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP) [국내: 1개사] · 시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	[미주: 3개사] · Harman Connected Services South America S.R.L. · EverythingDacor.com, Inc. · Distinctive Appliances of California, Inc. [아시아(중국 제외): 1개사] · Martin Professional Pte. Ltd. [중국: 1개사] · Samsung Tianjin Mobile Development Center (SRC-Tianjin)
제52기말 (2020년말)	55	75	19	30	33	29	241	-	-
제53기 증감	△9	△4	1	-	△3	2	△13	[중국: 1개사] · Samsung Semiconductor Investment L.P. I [중동 · 아프리카: 1개사] · Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P) [국내: 3개사] · SVIC 52호 신기술투자조합 · SVIC 55호 신기술투자조합 · SVIC 56호 신기술투자조합	[미주: 9개사] · Viv Labs, Inc. · Stellus Technologies, Inc. · SigMast Communications Inc. · Prismview, LLC · Zhilabs, Inc. · TWS LATAM B, LLC · TWS LATAM S, LLC · SNB Technologies, Inc. Mexico, S.A. de C.V · RT SV CO-INVEST, LP [유럽 · CIS: 4개사] · Arcam Limited · A&R Cambridge Limited · Harman Connected Services Limited · Martin Manufacturing (UK) Ltd. [중국: 4개사] · Samsung Suzhou Module Co., Ltd. (SSM) · Samsung Suzhou LCD Co., Ltd. (SSL) · Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd. (SEHZ) · Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication Co., Ltd.(SSET) [국내: 1개사] · SVIC 27호 신기술투자조합
제53기 (2021년말)	46	71	20	30	30	31	228	-	-

제54기 증감	△1	1	-	2	-	2	4	[유럽・CIS: 4개사] ・Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR) ・Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ) ・Apostera GmbH ・Apostera UA, LLC [아시아(중국 제외): 2개사] ・DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED ・Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd. [국내: 2개사] ・SVIC 57호 신기술투자조합 ・㈜희망별숲	[미주: 1개사] ・Dacor Canada Co. [유럽・CIS: 3개사] ・AMX UK Limited ・Harman International s.r.o ・Apostera GmbH
제54기 (2022년말)	45	72	20	32	30	33	232	-	-

2. 계열회사 현황(상세)

가. 국내 계열회사 현황

2022년말 현재 삼성그룹에는 전년말 대비 4개 회사가 증가하여 63개의 국내 계열회사가 있습니다. 이중 상장사는 당사를 포함하여 총 16개사이며 비상장사는 47개사입니다.

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	16	삼성물산㈜	1101110015762
		삼성바이오로직스㈜	1201110566317
		삼성생명보험㈜	1101110005953
		삼성에스디아이㈜	1101110394174
		삼성에스디에스㈜	1101110398556
		삼성엔지니어링㈜	1101110240509
		삼성전기㈜	1301110001626
		삼성전자㈜	1301110006246
		삼성중공업㈜	1101110168595
		삼성증권㈜	1101110335649
		삼성카드㈜	1101110346901
		삼성화재해상보험㈜	1101110005078
		㈜멀티캠퍼스	1101111960792
		㈜에스원	1101110221939
		㈜제일기획	1101110139017
		㈜호텔신라	1101110145519
비상장	47	삼성디스플레이㈜	1345110187812
		삼성메디슨㈜	1346110001036
		삼성바이오에피스㈜	1201110601501
		삼성벤처투자㈜	1101111785538
		삼성생명서비스손해사정㈜	1101111855414
		삼성선물㈜	1101110894520
		삼성액티브자산운용㈜	1101116277382
		삼성에스알에이자산운용㈜	1101115004322
		삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜	1101118376893
		삼성웰스토리㈜	1101115282077
		삼성자산운용㈜	1701110139833
		삼성전자로지텍㈜	1301110046797
		삼성전자서비스㈜	1301110049139
		삼성전자서비스씨에스㈜	1358110352541

		삼성전자판매㈜	1801110210300
		삼성카드고객서비스㈜	1101115291656
		삼성코닝어드밴스드글라스(유)	1648140003466
		삼성헤지자산운용㈜	1101116277390
		삼성화재서비스손해사정㈜	1101111237703
		삼성화재애니카손해사정㈜	1101111595680
		성균관대학교기술지주㈜	1358110215426
		세메스㈜	1615110011795
		수원삼성축구단㈜	1358110160126
		스테코㈜	1647110003490
		신라에이치엠㈜	1101115433927
		에스디플렉스㈜	1760110039005
		에스비티엠㈜	1101116536556
		에스원씨알엠㈜	1358110190199
		에스유머티리얼스㈜	1648110061337
		에스코어㈜	1101113681031
		에스티엠㈜	2301110176840
		에이치디씨신라면세점㈜	1101115722916
		오픈핸즈㈜	1311110266146
		제일패션리테일㈜	1101114736934
		㈜미라콤아이앤씨	1101111617533
		㈜삼성글로벌리서치	1101110766670
		㈜삼성라이온즈	1701110015786
		㈜삼성생명금융서비스보험대리점	1101115714533
		㈜삼성화재금융서비스보험대리점	1101116002424
		㈜삼우종합건축사사무소	1101115494151
		㈜서울레이크사이드	1101110504070
		㈜시큐아이	1101111912503
		㈜씨브이네트	1101111931686
		㈜에스에이치피코퍼레이션	1101118151310
		㈜하만인터내셔널코리아	1101113145673
		㈜휴먼티에스에스	1101114272706
		㈜희망별숲	1345110611259

※ 삼성코닝어드밴스드글라스는 2020년 10월 유한회사에서 주식회사로 변경하였다가,
2021년 2월 주식회사에서 유한회사로 재변경하였습니다.

※ 2022년중 계열회사에 추가된 4개 회사 중 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜와 ㈜희망별숲은
2023년 1월에 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 상호출자제한기업집단으로 편입되었습니다.

나. 해외 계열회사 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	소재국
비상장	573	SAMOO AUSTIN INC	USA
		SAMOO HU Designer and Engineering Services Limited	Hungary
		SAMOO DESIGNERS & ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED	India
		SAMOO (KL) SDN. BHD.	Malaysia
		SAMOO Design Consulting Co.,Ltd	China
		Meadowland Distribution	USA
		Samsung Green repower, LLC	USA
		Samsung Solar Construction Inc.	USA
		QSSC, S.A. de C.V.	Mexico
		Samsung Solar Energy LLC	USA
		Equipment Trading Solutions Group, LLC	USA
		SP Armow Wind Ontario LP	Canada
		SRE GRW EPC GP Inc.	Canada
		SRE GRW EPC LP	Canada
		SRE SKW EPC GP Inc.	Canada
		SRE SKW EPC LP	Canada
		SRE WIND PA GP INC.	Canada
		SRE WIND PA LP	Canada
		SRE GRS Holdings GP Inc.	Canada
		SRE GRS Holdings LP	Canada
		SRE K2 EPC GP Inc.	Canada
		SRE K2 EPC LP	Canada
		SRE KS HOLDINGS GP INC.	Canada
		SRE KS HOLDINGS LP	Canada
		SP Belle River Wind LP	Canada
		SRE Armow EPC GP Inc.	Canada
		SRE Armow EPC LP	Canada
		North Kent Wind 1 LP	Canada
		SRE Wind GP Holding Inc.	Canada
		South Kent Wind LP Inc.	Canada
		Grand Renewable Wind LP Inc.	Canada
		SRE North Kent 2 LP Holdings LP	Canada
		SRE Solar Development GP Inc.	Canada
		SRE Solar Development LP	Canada
		SRE Windsor Holdings GP Inc.	Canada
		SRE Southgate Holdings GP Inc.	Canada
		SRE Solar Construction Management GP Inc.	Canada

		SRE Solar Construction Management LP	Canada
		SRE BRW EPC GP INC.	Canada
		SRE BRW EPC LP	Canada
		SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	Canada
		SRE North Kent 2 GP Holdings Inc	Canada
		SRE Belle River GP Holdings Inc	Canada
		SRE NK1 EPC GP Inc	Canada
		SRE NK1 EPC LP	Canada
		SRE Summerside Construction GP Inc.	Canada
		SRE Summerside Construction LP	Canada
		Monument Power, LLC	USA
		PLL Holdings LLC	USA
		PLL E&P LLC	USA
		Parallel Petroleum LLC	USA
		Grand Renewable Solar GP Inc.	Canada
		KINGSTON SOLAR GP INC.	Canada
		SP Armow Wind Ontario GP Inc	Canada
		South Kent Wind GP Inc.	Canada
		Grand Renewable Wind GP Inc.	Canada
		North Kent Wind 1 GP Inc	Canada
		SP Belle River Wind GP Inc	Canada
		Samsung Solar Energy 1 LLC	USA
		Samsung Solar Energy 2 LLC	USA
		Samsung Solar Energy 3, LLC	USA
		CS SOLAR LLC	USA
		5S ENERGY HOLDINGS, LLC	USA
		SungEel Recycling Park Thuringen GmbH	Germany
		POSS-SLPC, S.R.O	Slovakia
		Solluce Romania 1 B.V.	Romania
		S.C. Otelinox S.A	Romania
		WARIS GIGIH ENGINEERING AND TECHNOLOGY SDN. BHD.	Malaysia
		Samsung Chemtech Vina LLC	Vietnam
		Samsung C&T Thailand Co., Ltd	Thailand
		PT. INSAM BATUBARA ENERGY	Indonesia
		Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	Malaysia
		S&G Biofuel PTE.LTD	Singapore
		PT. Gandaerah Hendana	Indonesia
		PT. Inecda	Indonesia
		VISTA CONTRACTING AND DEVELOPMENT BANGLADESH LTD.	Bangladesh
		SAMSUNG CONST. CO. PHILS.	Philippines
		SAMSUNG TRADING (SHANGHAI) CO., LTD	China

		Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	China
		Samsung Japan Corporation	Japan
		Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd.	Japan
		Samsung Electronics America, Inc.	USA
		Samsung Electronics Canada, Inc.	Canada
		Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	Mexico
		Samsung Electronics Ltd.	United Kingdom
		Samsung Electronics (UK) Ltd.	United Kingdom
		Samsung Electronics Holding GmbH	Germany
		Samsung Electronics Iberia, S.A.	Spain
		Samsung Electronics France S.A.S	France
		Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	Hungary
		Samsung Electronics Italia S.P.A.	Italy
		Samsung Electronics Europe Logistics B.V.	Netherlands
		Samsung Electronics Benelux B.V.	Netherlands
		Samsung Electronics Overseas B.V.	Netherlands
		Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o	Poland
		Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda.	Portugal
		Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	Sweden
		Samsung Electronics Austria GmbH	Austria
		Samsung Electronics Slovakia s.r.o	Slovakia
		Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Netherlands
		Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	Malaysia
		Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd.	Malaysia
		Samsung Vina Electronics Co., Ltd.	Vietnam
		Samsung Asia Pte. Ltd.	Singapore
		Samsung India Electronics Private Ltd.	India
		Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited	India
		Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.	Australia
		PT Samsung Electronics Indonesia	Indonesia
		Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	Thailand
		Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd.	Malaysia
		Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	Hong Kong
		Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	China
		Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	China
		Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd.	China
		Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	China
		Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	Taiwan
		Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.	China
		Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.	China
		Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	China

		Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd.	China
		Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.	China
		Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd.	China
		Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	Utd.Arab Emir.
		Samsung Electronics Egypt S.A.E	Egypt
		Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd.	South Africa
		Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A.	Panama
		Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.	Brazil
		Samsung Electronics Argentina S.A.	Argentina
		Samsung Electronics Chile Limitada	Chile
		Samsung Electronics Rus Company LLC	Russian Fed.
		Samsung Electronics Rus Kaluga LLC	Russian Fed.
		Tianjin Samsung LED Co., Ltd.	China
		Samsung Biologics America, Inc.	USA
		Samsung Bioepis United States Inc.	USA
		SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED	United Kingdom
		Samsung Bioepis NL B.V.	Netherlands
		Samsung Bioepis CH GmbH	Switzerland
		Samsung Bioepis PL Sp z o.o.	Poland
		SAMSUNG BIOEPIS AU PTY LTD	Australia
		SAMSUNG BIOEPIS NZ LIMITED	New Zealand
		Samsung Biopeis TW Limited	Taiwan
		Samsung Bioepis HK Limited	Hong Kong
		SAMSUNG BIOEPIS IL LTD	Israel
		SAMSUNG BIOEPIS BR PHARMACEUTICAL LTDA	Brazil
		Intellectual Keystone Technology LLC	USA
		Samsung Display Slovakia, s.r.o.	Slovakia
		Samsung Display Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
		Samsung Display Noida Private Limited	India
		Samsung Display Dongguan Co., Ltd.	China
		Samsung Display Tianjin Co., Ltd.	China
		Novaled GmbH	Germany
		SEMES America, Inc.	USA
		SEMES (XIAN) Co., Ltd.	China
		NeuroLogica Corp.	USA
		Dacor Holdings, Inc.	USA
		Samsung HVAC America, LLC	USA
		SmartThings, Inc.	USA
		Samsung Oak Holdings, Inc.	USA
		Joyent, Inc.	USA
		TeleWorld Solutions, Inc.	USA

		Samsung Semiconductor, Inc.	USA
		Samsung Research America, Inc	USA
		Samsung Electronics Home Appliances America, LLC	USA
		Samsung International, Inc.	USA
		Harman International Industries, Inc.	USA
		Dacor, Inc.	USA
		Samsung Austin Semiconductor LLC.	USA
		AdGear Technologies Inc.	Canada
		SAMSUNG NEXT LLC	USA
		SAMSUNG NEXT FUND LLC	USA
		Samsung Mexicana S.A. de C.V	Mexico
		Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV	Mexico
		Harman International Japan Co., Ltd.	Japan
		Harman International Industries Canada Ltd.	Canada
		Harman Becker Automotive Systems, Inc.	USA
		Harman Professional, Inc.	USA
		Harman Connected Services, Inc.	USA
		Harman Financial Group LLC	USA
		Harman Belgium SA	Belgium
		Harman France SNC	France
		Red Bend Software SAS	France
		Harman Inc. & Co. KG	Germany
		Harman KG Holding, LLC	USA
		Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	Italy
		Harman Finance International, SCA	Luxembourg
		Harman Finance International GP S.a.r.l	Luxembourg
		Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	Mauritius
		Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	Mexico
		Harman International Estonia OU	Estonia
		Harman Singapore Pte. Ltd.	Singapore
		Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	Brazil
		Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	Brazil
		Harman Connected Services Engineering Corp.	USA
		Harman Connected Services AB.	Sweden
		Harman Connected Services UK Ltd.	United Kingdom
		Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	India
		Global Symphony Technology Group Private Ltd.	Mauritius
		Harman International (India) Private Limited	India
		Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	Mexico
		Samsung Semiconductor Europe Limited	United Kingdom
		Samsung Semiconductor Europe GmbH	Germany

		Samsung Electronics GmbH	Germany
		Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	Czech Republic
		SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA	Latvia
		Samsung Electronics West Africa Ltd.	Nigeria
		Samsung Electronics East Africa Ltd.	Kenya
		Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd.	Saudi Arabia
		Samsung Electronics Israel Ltd.	Israel
		Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	Tunisia
		Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd.	Pakistan
		Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd.	South Africa
		Samsung Electronics Turkiye	Turkiye
		Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd.	Turkiye
		Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd.	Israel
		Samsung Electronics Levant Co.,Ltd.	Jordan
		Samsung Electronics Maghreb Arab	Morocco
		Samsung Electronics Venezuela, C.A.	Venezuela
		Samsung Electronics Peru S.A.C.	Peru
		Samsung Electronics Ukraine Company LLC	Ukraine
		Samsung R&D Institute Ukraine	Ukraine
		Samsung R&D Institute Rus LLC	Russian Fed.
		Samsung Electronics Central Eurasia LLP	Kazakhstan
		Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd	Azerbaijan
		Samsung Electronics Uzbekistan Ltd.	Uzbekistan
		Corephotonics Ltd.	Israel
		Samsung Nanoradio Design Center	Sweden
		Harman Professional Denmark ApS	Denmark
		Studer Professional Audio GmbH	Switzerland
		Martin Professional Japan Ltd.	Japan
		Harman International Romania SRL	Romania
		Apostera UA, LLC	Ukraine
		Harman Becker Automotive Systems GmbH	Germany
		Harman Deutschland GmbH	Germany
		Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Hungary
		Harman RUS CIS LLC	Russian Fed.
		Harman Holding Gmbh & Co. KG	Germany
		Harman Management Gmbh	Germany
		Harman Hungary Financing Ltd.	Hungary
		Harman Connected Services OOO	Russian Fed.
		Harman Professional Kft	Hungary
		Harman Consumer Nederland B.V.	Netherlands
		Red Bend Ltd.	Israel

		Harman International Industries Limited	United Kingdom
		AKG Acoustics Gmbh	Austria
		Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	Spain
		Harman Holding Limited	Hong Kong
		Harman Finland Oy	Finland
		Harman Connected Services GmbH	Germany
		Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Poland
		Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	China
		Harman Automotive UK Limited	United Kingdom
		Harman International Industries PTY Ltd.	Australia
		Harman Connected Services Morocco	Morocco
		Samsung Electronics Switzerland GmbH	Switzerland
		Samsung Electronics Romania LLC	Romania
		SAMSUNG Zhilabs, S.L.	Spain
		Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.	Italy
		Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o	Poland
		Samsung Electronics Greece S.M.S.A	Greece
		Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.	Netherlands
		FOODIENT LTD.	United Kingdom
		Samsung Denmark Research Center ApS	Denmark
		Samsung Cambridge Solution Centre Limited	United Kingdom
		iMarket Asia Co., Ltd.	Hong Kong
		Samsung Electronics Japan Co., Ltd.	Japan
		Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd.	Singapore
		Samsung Electronics New Zealand Limited	New Zealand
		Samsung Electronics Philippines Corporation	Philippines
		Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited	Bangladesh
		Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
		Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd.	Vietnam
		Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd.	Vietnam
		Samsung Nepal Services Pvt, Ltd	Nepal
		Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	India
		PT Samsung Telecommunications Indonesia	Indonesia
		Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd	Laos
		Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd.	China
		Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou	China
		Samsung R&D Institute China-Shenzhen	China
		Beijing Samsung Telecom R&D Center	China
		Samsung Electronics China R&D Center	China
		Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	China
		Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	China

		Harman (China) Technologies Co., Ltd.	China
		Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	China
		Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	China
		Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	China
		Red Bend Software Ltd.	United Kingdom
		Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc.	USA
		Samsung Electronica Colombia S.A.	Colombia
		Samsung Electronics Panama. S.A.	Panama
		Samsung SDI Japan Co., Ltd.	Japan
		Samsung SDI America, Inc.	USA
		Samsung SDI Hungary., Zrt.	Hungary
		Samsung SDI Europe GmbH	Germany
		Samsung SDI Battery Systems GmbH	Austria
		Samsung SDI Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
		Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd.	Malaysia
		Samsung SDI India Private Limited	India
		Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Hong Kong
		Samsung SDI China Co., Ltd.	China
		Samsung SDI-ARN (Xi'An) Power Battery Co., Ltd.	China
		Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd.	China
		STARPLUS ENERGY LLC.	USA
		SAMSUNG SDI WUXI CO.,LTD.	China
		Tianjin Samsung SDI Co., Ltd.	China
		Samsung Electro-Machanics Japan Co., Ltd.	Japan
		Samsung Electro-Mechanics America, Inc.	USA
		Samsung Electro-Mechanics GmbH	Germany
		Samsung Electro-Mechanics Philippines, Corp.	Philippines
		Calamba Premier Realty Corporation	Philippines
		Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd.	Singapore
		Samsung Electro-Mechanics Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
		Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited	India
		Dongguan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	China
		Tianjin Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	China
		Samsung High-Tech Electro-Mechanics(Tianjin) Co., Ltd.	China
		Samsung Electro-Mechanics (Shenzhen) Co., Ltd.	China
		Kunshan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	China
		Batino Realty Corporation	Philippines
		Samsung Fire & Marine Management Corporation	USA
		SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD.	United Kingdom
		PT. Asuransi Samsung Tugu	Indonesia

		SAMSUNG VINA INSURANCE COMPANY LIMITED	Vietnam
		Samsung Reinsurance Pte. Ltd.	Singapore
		삼성재산보험 (중국) 유한공사	China
		Samsung Fire & Marine Insurance Management Middle East Limited	Utd.Arab Emir.
		Camellia Consulting Corporation	USA
		Samsung Heavy Industries India Pvt.Ltd.	India
		SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (M) SDN.BHD	Malaysia
		삼성중공업(영파)유한공사	China
		삼성중공업(영성)유한공사	China
		SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED	Nigeria
		Samsung Heavy Industries Mozambique LDA	Mozambique
		Samsung Heavy Industries Rus LLC	Russian Fed.
		SHI - MCI FZE	Nigeria
		Samsung Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd	Thailand
		Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd	China
		Samsung Asset Management (New York), Inc.	USA
		Samsung Global SME Private Equity Manager Fund Co., Ltd.	Cayman Islands
		Samsung Asset Management U.S. Holdings, Inc.	USA
		Samsung Private Equity Fund 2022 GP, Ltd.	Cayman Islands
		Samsung Co-Investment 2021 GP, Ltd.	Cayman Islands
		Samsung Asset Management(London) Ltd.	United Kingdom
		Samsung Private Equity Manager I Co., Ltd.	Cayman Islands
		Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.	Hong Kong
		Samsung Asset Management (Beijing) Ltd.	China
		Samsung C&T Japan Corporation	Japan
		Samsung C&T America Inc.	USA
		Samsung E&C America, INC.	USA
		Samsung Renewable Energy Inc.	Canada
		Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	USA
		Samsung C&T Lima S.A.C.	Peru
		Samsung C&T Deutschland GmbH	Germany
		Samsung C&T U.K. Ltd.	United Kingdom
		Samsung C&T ECUK Limited	United Kingdom
		Whessoe engineering Limited	United Kingdom
		SAM investment Manzanilo.B.V	Netherlands
		Samsung C&T (KL) Sdn.,Bhd.	Malaysia
		Samsung C&T Malaysia SDN. BHD	Malaysia
		Erdsam Co., Ltd.	Hong Kong
		Samsung C&T India Private Limited	India
		Samsung C&T Corporation India Private Limited	India

		Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Singapore
		SAMSUNG C&T Mongolia LLC.	Mongolia
		Samsung C&T Eng.&Const. Mongolia LLC.	Mongolia
		S&WOO CONSTRUCTION PHILIPPINES,INC.	Philippines
		VSSC STEEL CENTER LIMITED LIABILITY COMPANY	Vietnam
		Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd.	Singapore
		CHEIL HOLDING INC.	Philippines
		Samsung C&T Renewable Energy Australia Pty Ltd	Australia
		Samsung C&T Hongkong Ltd.	Hong Kong
		Samsung C&T Taiwan Co., Ltd.	Taiwan
		SAMSUNG C&T (SHANGHAI) CO., LTD.	China
		Samsung C&T (Xi'an) Co., Ltd.	China
		SAMSUNG C&T CORPORATION SAUDI ARABIA	Saudi Arabia
		SAM Gulf Investment Limited	Utd.Arab Emir.
		Samsung C&T Chile Copper SpA	Chile
		SCNT Power Kelar Inversiones Limitada	Chile
		Samsung C&T Corporation Rus LLC	Russian Fed.
		CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL	Italy
		Samsung Fashion Trading Co. ,Ltd	China
		SAMSUNG C&T CORPORATION VIETNAM CO., LTD	Vietnam
		Samsung C&T Corporation UEM Construction JV Sdn Bhd	Malaysia
		WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED	Vietnam
		Shanghai Ever-Hongjun Business Mgt Service Co.,LTD	China
		Shanghai Welstory Food Company Limited	China
		LANGUAGE TESTING INTERNATIONAL, INC.	USA
		PENGTAI CHINA CO.,LTD.	China
		PengTai Taiwan Co., Ltd.	Taiwan
		PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD	China
		PENGTAI MARKETING SERVICE CO.,LTD.	China
		Medialytics Inc.	China
		Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd.	China
		iMarket China Co., Ltd.	China
		Samsung Securities (America), Inc.	USA
		Samsung Securities (Europe) Limited.	United Kingdom
		Samsung Securities (Asia) Limited.	Hong Kong
		Samsung SDS America, Inc.	USA
		SAMSUNG SDS GSCL Canada., Ltd.	Canada
		Neo EXpress Transportation (NEXT) Inc.	USA
		Samsung SDS Europe, Ltd.	United Kingdom
		Samsung SDS Global SCL Hungary, Kft.	Hungary
		Samsung SDS Global SCL Slovakia, S.R.O.	Slovakia

		Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o.	Poland
		Samsung GSCL Sweden AB	Sweden
		Samsung SDS Global SCL France SAS	France
		Samsung SDS Global SCL Italy S.R.L. A Socio Unico	Italy
		Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Spain S.L.U	Spain
		Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	Netherlands
		Samsung SDS Global SCL Germany GmbH	Germany
		Samsung SDS Global SCL Romania S.R.L	Romania
		Samsung SDS Asia Pacific Pte, Ltd.	Singapore
		Samsung Data Systems India Private Limited	India
		Samsung SDS Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
		PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia	Indonesia
		Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd.Inc.	Philippines
		Samsung SDS Global SCL Thailand Co.,Ltd	Thailand
		Samsung SDS Global SCL Malaysia SDN.BHD.	Malaysia
		SAMSUNG SDS Global SCL Austraila Pty.,Ltd.	Australia
		SDS-ACUTECH CO., Ltd.	Thailand
		ALS SDS Joint Stock Company	Vietnam
		SDS-MP Logistics Joint Stock Company	Vietnam
		Samsung SDS China Co., Ltd.	China
		Samsung SDS Global SCL Hong Kong Co., Ltd.	Hong Kong
		SAMSUNG SDS Global SCL Egypt	Egypt
		Samsung SDS Global SCL South Africa (PTY) Ltd.	South Africa
		Samsung SDS Global SCL Nakliyat ve Lojistik Anonim Sirketi	Turkiye
		Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Middle East DWC-LLC	Utd.Arab Emir.
		Samsung SDS Latin America Solucoes Em Tecnologia Ltda.	Brazil
		INTE-SDS Logistics S.A. de C.V.	Mexico
		Samsung SDS Rus Limited Liability Company	Russian Fed.
		Samsung SDS Mexico, S.A. DE C.V.	Mexico
		Samsung SDS Global SCL Panama S.A.	Panama
		Samsung SDS Global SCL Chile Limitada	Chile
		Samsung SDS Global SCL Peru S.A.C	Peru
		Samsung SDS Global SCL Colombia S.A.S	Colombia
		Samsung SDS Global Development Center Xi'an	China
		Samsung Engineering America Inc.	USA
		Samsung Project Management Inc.	Canada
		Samsung Engineering Hungary Ltd.	Hungary
		Samsung Engineering Italy S.R.L.	Italy
		Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD.	Malaysia
		PT Samsung Engineering Indonesia Co., Ltd.	Indonesia

		Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.	Thailand
		Samsung Engineering India Private Limited	India
		Samsung Engineering Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
		Samsung Engineering Global Private Limited	India
		Samsung Engineering Construction(Shanghai) Co., Ltd	China
		Samsung Engineering Construction Xi' an Co., Ltd.	China
		Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.	Saudi Arabia
		Muharraq Wastewater Services Company W.L.L.	Bahrain
		Muharraq STP Company B.S.C.	Bahrain
		Muharraq Holding Company 1 Ltd.	Utd.Arab Emir.
		Samsung Ingenieria Mexico Construccion Y Operacion S.A. De C.V.	Mexico
		Samsung Engineering Trinidad Co., Ltd.	Trinidad,Tobago
		Samsung Ingenieria Manzanillo, S.A. De C.V.	Mexico
		Grupo Samsung Ingenieria Mexico, S.A. De C.V.	Mexico
		Samsung Ingenieria Energia S.A. De C.V.	Mexico
		Samsung Engineering Bolivia S.A	Bolivia
		Samsung Ingenieria DUBA S.A. de C.V.	Mexico
		Samsung Engineering Kazakhstan L.L.P.	Kazakhstan
		SEA Construction, LLC	USA
		SEA Louisiana Construction, L.L.C.	USA
		Samsung EPC Company Ltd.	Saudi Arabia
		Muharraq Holding Company 2 Ltd.	Utd.Arab Emir.
		Asociados Constructores DBNR, S.A. de C.V.	Mexico
		S-1 CORPORATION HUNGARY LLC	Hungary
		S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD	Vietnam
		Samsung Beijing Security Systems	China
		PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD	China
		Cheil USA Inc.	USA
		Cheil Central America Inc.	USA
		Iris Worldwide Holdings Limited	United Kingdom
		CHEIL EUROPE LIMITED	United Kingdom
		Cheil Germany GmbH	Germany
		Cheil France SAS	France
		CHEIL SPAIN S.L	Spain
		Cheil Benelux B.V.	Netherlands
		Cheil Nordic AB	Sweden
		Cheil India Private Limited	India
		Cheil (Thailand) Ltd.	Thailand
		Cheil Singapore Pte. Ltd.	Singapore
		CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED	Vietnam

		Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.	Philippines
		CHEIL MALAYSIA SDN. BHD.	Malaysia
		Cheil New Zealand Limited	New Zealand
		CHEIL CHINA	China
		Cheil Hong Kong Ltd.	Hong Kong
		Caishu (Shanghai) Business Consulting Co., Ltd	China
		Cheil MEA FZ-LLC	Utd.Arab Emir.
		Cheil South Africa (Pty) Ltd	South Africa
		CHEIL KENYA LIMITED	Kenya
		Cheil Communications Nigeria Ltd.	Nigeria
		Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC.	Jordan
		Cheil Ghana Limited	Ghana
		Cheil Egypt LLC	Egypt
		Cheil Brasil Comunicacoes Ltda.	Brazil
		Cheil Mexico, S.A. de C.V.	Mexico
		Cheil Chile SpA.	Chile
		Cheil Peru S.A.C.	Peru
		CHEIL ARGENTINA S.A.	Argentina
		Cheil Rus LLC	Russian Fed.
		Cheil Ukraine LLC	Ukraine
		Cheil Kazakhstan LLC	Kazakhstan
		Samsung Hospitality America Inc.	USA
		Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	Singapore
		Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.	China
		Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	Hong Kong
		HDC SHILLA (SHANGHAI) CO., LTD	China
		Samsung Hospitality U.K. Ltd.	United Kingdom
		Samsung Hospitality Europe GmbH	Germany
		SAMSUNG HOSPITALITY ROMANIA SRL	Romania
		Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
		Samsung Hospitality Philippines Inc.	Philippines
		Samsung Hospitality India Private Limited	India
		Samsung Venture Investment (Shanghai) Co., Ltd.	China
		Iris (USA) Inc.	USA
		Iris Atlanta, Inc.	USA
		89 Degrees, Inc.	USA
		The Barbarian Group LLC	USA
		McKinney Ventures LLC	USA
		Iris Nation Worldwide Limited	United Kingdom
		Iris Americas, Inc.	USA
		Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V.	Mexico

		Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V.	Mexico
		Pricing Solutions Ltd	Canada
		Iris London Limited	United Kingdom
		Iris Promotional Marketing Ltd	United Kingdom
		Iris Ventures 1 Limited	United Kingdom
		Founded Partners Limited	United Kingdom
		Iris Korea Limited	United Kingdom
		Iris Digital Limited	United Kingdom
		Iris Amsterdam B.V.	Netherlands
		Iris Ventures (Worldwide) Limited	United Kingdom
		Iris Culture Limited	United Kingdom
		Concise Consultants Limited	United Kingdom
		Atom42 Ltd	United Kingdom
		WDMP Limited	United Kingdom
		Pricing Solutions (UK) Limited	United Kingdom
		Iris Services Limited Dooel Skopje	Macedonia
		Irisnation Singapore Pte. ltd.	Singapore
		Iris Worldwide Integrated Marketing Private Limited	India
		Iris Sydney PTY Ltd	Australia
		Iris Worldwide (Thailand) Limited	Thailand
		Iris Partners LLP	United Kingdom
		Holdings BR185 Limited	Brit.Virgin Is.
		Iris Germany GmbH	Germany
		Founded, Inc.	USA
		Pepper NA, Inc.	USA
		Pepper Technologies Pte. Ltd.	Singapore
		Beattie McGuinness Bungay Limited	United Kingdom
		Cheil Italia S.r.l	Italy
		Cheil Austria GmbH	Austria
		Centrade Integrated SRL	Romania
		Centrade Cheil HU Kft.	Hungary
		Centrade Cheil Adriatic D.O.O.	Serbia/Monten.
		Experience Commerce Software Private Limited	India
		Pengtai Greater China Company Limited	Hong Kong
		PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA	Indonesia
		Cheil Philippines Inc.	Philippines
		Shilla Retail Plus Pte. Ltd.	Singapore
		Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd	China
		Shilla Retail Limited	Macau
		Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited	Hong Kong
		One Agency FZ-LLC	Utd.Arab Emir.

		One RX Project Management Design and Production Limited Company	Turkiye
		One RX India Private Limited	India
		ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C	Utd.Arab Emir.
		ONE AGENCY PRINTING L.L.C	Utd.Arab Emir.
		One Agency South Africa (Pty) Ltd	South Africa
		Brazil 185 Participacoes Ltda	Brazil
		Iris Router Marketing Ltda	Brazil

3. 타법인출자 현황(상세)

2022년말 현재 당사 타법인 출자 금액은 장부금액 기준 58조 7,619억원이며, 경영참여 등 목적으로 출자하였습니다.

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장 여부	최초취득일자	출자 목적	최초취득 금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
					수량	지분율	장부가액	취득(처분) 수량	취득(처분) 금액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익
삼성전기㈜	상장	1977.01.01	경영참여	250	17,693	23.7	445,244	-	-	-	17,693	23.7	445,244	10,997,171	993,519
삼성SDI㈜	상장	1977.01.01	경영참여	304	13,463	19.6	1,242,605	-	-	-	13,463	19.6	1,242,605	30,257,525	1,952,149
삼성중공업㈜	상장	1977.09.01	경영참여	125	134,027	15.2	759,935	-	-	-75,056	134,027	15.2	684,879	14,491,679	-627,412
㈜호텔신라	상장	1979.12.01	경영참여	252	2,005	5.1	156,368	-	-	10,224	2,005	5.1	166,592	2,938,545	-50,164
㈜제일기획	상장	1988.09.01	경영참여	185	29,038	25.2	491,599	-	-	-	29,038	25.2	491,599	2,751,445	193,732
삼성에스디에스㈜	상장	1992.07.01	경영참여	6,160	17,472	22.6	560,827	-	-	-	17,472	22.6	560,827	11,952,424	1,099,745
삼성바이오로직스㈜	상장	2011.04.21	경영참여	30,000	20,837	31.5	443,193	1,380	1,152,699	-	22,217	31.2	1,595,892	16,582,051	798,056
삼성디스플레이㈜	비상장	2012.04.01	경영참여	16,009,547	221,969	84.8	18,509,307	-	-	-	221,969	84.8	18,509,307	57,302,567	4,365,588
스테코㈜	비상장	1995.06.29	경영참여	24,000	2,590	70.0	35,861	-	-	-	2,590	70.0	35,861	133,987	5,544
세메스㈜	비상장	1992.12.31	경영참여	1,000	2,173	91.5	71,906	-	-	-	2,173	91.5	71,906	2,065,558	185,762
삼성전자서비스㈜	비상장	1998.01.01	경영참여	30,000	6,000	99.3	48,121	-	-	-	6,000	99.3	48,121	711,020	9,446
삼성전자판매㈜	비상장	2000.12.21	경영참여	3,100	1,767	100.0	247,523	-	-	-	1,767	100.0	247,523	1,393,235	13
삼성전자로지텍㈜	비상장	1999.04.01	경영참여	76	1,011	100.0	46,669	-	-	-	1,011	100.0	46,669	415,659	12,376
삼성메디슨㈜	비상장	2011.02.16	경영참여	286,384	87,350	68.5	369,169	-	-	63,857	87,350	68.5	433,026	528,834	69,172
㈜삼성글로벌리서치	비상장	1991.05.01	경영참여	320	3,576	29.8	24,942	-	-	-	3,576	29.8	24,942	178,806	241
삼성벤처투자㈜	비상장	1999.11.01	경영참여	4,900	980	16.3	22,198	-	-	9,875	980	16.3	32,073	204,057	12,157
SVIC 21호 신기술투자조합	비상장	2011.11.02	경영참여	19,800	0	99.0	5,707	-0	-4,737	-	0	99.0	970	96,117	4,016
SVIC 22호 신기술투자조합	비상장	2011.11.02	경영참여	19,800	1	99.0	75,458	-0	-25,938	-	0	99.0	49,520	54,415	-14,289
SVIC 26호 신기술투자조합	비상장	2014.11.07	경영참여	19,800	2	99.0	96,443	-0	-20,790	-	1	99.0	75,653	45,827	-4,049
SVIC 28호 신기술투자조합	비상장	2015.02.13	경영참여	7,425	1	99.0	69,710	0	-34,224	-	0	99.0	35,486	395,545	-19,969
SVIC 32호 신기술투자조합	비상장	2016.08.09	경영참여	19,800	2	99.0	171,141	-0	-27,720	-	1	99.0	143,421	283,767	3,175
SVIC 33호 신기술투자조합	비상장	2016.11.11	경영참여	4,950	2	99.0	166,974	-0	-44,352	-	1	99.0	122,622	334,846	9,875
SVIC 42호 신기술투자조합	비상장	2018.11.30	경영참여	4,950	0	99.0	18,657	0	24,820	-	0	99.0	43,477	35,845	-1,443
SVIC 45호 신기술투자조합	비상장	2019.05.10	경영참여	19,800	2	99.0	173,042	0	18,281	-	2	99.0	191,323	221,522	-3,064
SVIC 52호 신기술투자조합	비상장	2021.05.17	경영참여	9,900	0	99.0	9,900	0	39,699	-	0	99.0	49,599	46,829	-147
SVIC 56호 신기술투자조합	비상장	2021.11.12	경영참여	22,084	0	99.0	22,084	0	10,296	-	0	99.0	32,380	31,984	651
SVIC 57호 신기술투자조합	비상장	2022.08.10	경영참여	14,850	-	-	-	0	18,860	-	0	99.0	18,860	18,681	-320
반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	비상장	2017.03.03	경영참여	500	50,000,000	66.7	50,000	-	-	-	50,000,000	66.7	50,000	69,862	-4,574
시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	비상장	2020.04.27	경영참여	25,000	50,000,000	62.5	50,000	-	-	-	50,000,000	62.5	50,000	79,664	-49
㈜희망별숲	비상장	2022.12.26	경영참여	900	-	-	-	180	900	-	180	100.0	900	895	-5
㈜아이마켓코리아	상장	2000.12.07	경영참여	1,900	647	1.9	6,926	-	-	-388	647	1.9	6,538	1,228,690	29,087
㈜케이티스카이라이프	상장	2001.12.01	단순투자	3,344	240	0.5	2,194	-	-	-240	240	0.5	1,954	1,361,298	23,086
㈜용평리조트	상장	2007.05.11	단순투자	1,869	400	0.8	1,958	-	-	-546	400	0.8	1,412	841,500	8,674
에이테크솔루션㈜	상장	2009.11.26	단순투자	26,348	1,592	15.9	26,188	-	-	-13,309	1,592	15.9	12,879	204,679	4,686
㈜원익홀딩스	상장	2013.12.18	경영참여	15,411	1,759	2.3	8,761	-	-	-2,789	1,759	2.3	5,972	1,946,027	141,203
㈜원익아이피에스	상장	2016.04.01	경영참여	16,214	1,851	3.8	78,295	-	-	-32,484	1,851	3.8	45,811	1,127,557	97,900
㈜동진쎄미켐	상장	2017.11.01	경영참여	48,277	2,468	4.8	125,863	-	-	-51,950	2,468	4.8	73,913	1,085,264	144,946

솔브레인홀딩스㈜	상장	2017.11.01	경영참여	30,752	462	2.2	15,976	-	-	-4,987	462	2.2	10,989	1,523,516	29,996
솔브레인㈜	상장	2020.07.01	경영참여	24,866	373	4.8	103,983	-	-	-22,626	373	4.8	81,357	829,947	152,221
㈜에스앤에스텍	상장	2020.08.14	경영참여	65,933	1,716	8.0	63,153	-	-	-17,933	1,716	8.0	45,220	226,610	17,323
와이아이케이㈜	상장	2020.08.14	경영참여	47,336	9,602	11.7	59,530	-	-	-32,597	9,602	11.7	26,933	519,025	33,065
㈜케이씨텍	상장	2020.11.16	경영참여	20,720	1,022	4.9	24,584	-	-	-9,455	1,022	4.9	15,129	483,313	55,386
㈜엘오티베큠	상장	2020.11.16	경영참여	18,990	1,268	7.1	21,804	-	-	-7,479	1,268	7.1	14,325	323,108	20,575
㈜뉴파워프라즈마	상장	2020.11.16	경영참여	12,739	2,141	4.9	13,723	-	-	-6,144	2,141	4.9	7,579	635,198	22,261
㈜에프에스티	상장	2021.03.16	경영참여	43,009	1,523	7.0	38,607	-	-	-14,849	1,523	7.0	23,758	391,197	37,576
㈜디엔에프	상장	2021.08.11	경영참여	20,964	810	7.0	18,509	-	-	-7,817	810	7.0	10,692	191,897	7,152
Marvell	상장	2021.10.05	단순투자	11,705	173	0.0	17,963	-	-	-9,833	173	0.0	8,130	28,542,257	-207,204
한국경제신문㈜	비상장	1987.05.01	단순투자	150	72	0.4	365	-	-	-	72	0.4	365	517,215	44,984
㈜한국비지니스금융대부	비상장	1995.01.01	단순투자	5,000	1,000	17.2	2,964	-	-	-	1,000	17.2	2,964	86,276	1,236
㈜싸이버뱅크	비상장	2000.12.30	단순투자	8,000	1,083	7.5	0	-	-	-	1,083	7.5	0	-	-
화인칩스㈜	비상장	2001.12.01	단순투자	10	2	3.2	10	-	-	-	2	3.3	10	15,919	3,878
㈜인켈	비상장	2006.11.01	단순투자	130	0	0.0	0	-	-	-	0	0.0	0	56,198	-5,524
인텔렉추얼디스커버리㈜	비상장	2011.05.13	단순투자	5,000	357	10.7	1,922	-	-	-	357	10.7	1,922	79,972	14,984
㈜말타니	비상장	2012.04.01	단순투자	16,544	45	15.0	8,825	-	-	-1,394	45	15.0	7,431	72,421	2,891
㈜팬택자산관리	비상장	2013.06.19	단순투자	53,000	53,000	10.0	0	-	-	-	53,000	10.0	0	8,151	-11,411
㈜인공지능연구원	비상장	2016.07.28	단순투자	3,000	600	14.3	3,000	-	-	-	600	14.3	3,000	5,935	3,021
㈜미코세라믹스	비상장	2020.11.16	경영참여	21,667	747	13.7	24,636	-	-	4,749	747	13.7	29,385	180,809	20,984
㈜신성건설	비상장	2010.07.29	단순투자	1	0	0.0	0	-	-	-	0	0.0	0	135,006	-17,958
㈜우방	비상장	2010.07.01	단순투자	0	1	0.0	0	-	-	-	1	0.0	0	493,942	4,378
㈜삼보컴퓨터	비상장	2012.09.27	단순투자	0	0	0.0	0	-	-	-	0	0.0	0	55,572	-2,832
대우산업개발㈜	비상장	2012.12.18	단순투자	0	0	0.0	0	-	-	-	0	0.0	0	321,513	-3,342
대우송도개발㈜	비상장	2012.12.18	단순투자	0	9	0.0	0	-	-	-	9	0.0	0	19,369	-350
자일자동차판매㈜	비상장	2012.12.18	단순투자	0	1	0.0	0	-	-	-	1	0.0	0	382,807	-8,162
성원건설㈜	비상장	2014.04.30	단순투자	0	1	0.0	0	-	-	-	1	0.0	0	27,744	-627
㈜인희	비상장	2014.04.30	단순투자	0	0	0.1	0	-	-	-	0	0.1	0	2,753	211
포인트애니빔㈜	비상장	2019.12.26	단순투자	61	12	3.5	61	-	-	-	12	3.5	61	-	-
JNT(반도체펀드)	비상장	2011.02.28	단순투자	1,800	0	24.0	1,758	-	-	-	0	24.0	1,758	4,856	1,355
대신아주IB(반도체펀드)	비상장	2011.08.16	단순투자	258	0	3.0	258	0	-	-258	-	-	-	-	-
L&S(반도체펀드)	비상장	2012.07.30	단순투자	848	0	7.5	1	-	-	-	0	7.5	1	3,241	171
KTCNP-GC(반도체펀드)	비상장	2013.12.01	단순투자	960	0	3.6	1,816	-	-1,594	-	0	3.6	222	28,999	-4,695
포스코사회적기업펀드	비상장	2013.12.01	단순투자	600	0	10.0	60	-	-	-	0	10.0	60	245	-481
베어포트리조트	비상장	2022.04.18	단순투자	-	-	-	-	51	0	-	51	0.5	0	94,074	641
SEA	비상장	1978.07.01	경영참여	59,362	492	100.0	17,166,557	-	-	-	492	100.0	17,166,557	37,883,156	219,670
SECA	비상장	1992.08.13	경영참여	3,823	0	100.0	90,922	-	-	-	0	100.0	90,922	1,652,195	126,200
SEDA	비상장	1994.01.01	경영참여	13,224	77,205,709	87.0	647,620	-	-	-	77,205,709	87.0	647,620	4,600,508	-38,490
SEM	비상장	1995.07.01	경영참여	3,032	3,837	63.6	165,638	-	-	-	3,837	63.6	165,638	1,816,895	110,386
SELA	비상장	1989.04.01	경영참여	319	40	100.0	86,962	-	-	-	40	100.0	86,962	683,447	43,364
SEASA	비상장	1996.06.01	경영참여	4,696	21,854	98.0	6,779	-	-	-	21,854	98.0	6,779	102,325	9,879
SECH	비상장	2002.12.19	경영참여	597	0	4.1	597	-	-	-	0	4.1	597	646,185	43,112
SEUK	비상장	1995.07.01	경영참여	33,908	109,546	100.0	433,202	-	-	-	109,546	100.0	433,202	2,819,792	243,396
SEL	비상장	1998.12.31	경영참여	8,280	4,393	100.0	0	-	-	-	4,393	100.0	0	7,030	0
SEHG	비상장	1982.02.01	경영참여	28,042	0	100.0	354,846	-	-	-	0	100.0	354,846	651,158	114,185
SEF	비상장	1991.08.21	경영참여	230	2,700	100.0	234,115	-	-	-	2,700	100.0	234,115	1,053,910	72,776
SEI	비상장	1993.05.24	경영참여	862	677	100.0	143,181	-	-	-	677	100.0	143,181	959,801	59,143
SESA	비상장	1989.01.01	경영참여	3,276	8,021	100.0	142,091	-	-	-	8,021	100.0	142,091	1,098,852	51,972
SEP	비상장	1982.09.01	경영참여	204	1,751	100.0	37,616	-	-	-	1,751	100.0	37,616	273,915	11,737
SEH	비상장	1991.05.31	경영참여	1,954	753	100.0	650,157	-	-	-	753	100.0	650,157	2,374,317	199,742
SELS	비상장	1991.05.01	경영참여	18,314	1,306	100.0	24,288	-	-	-	1,306	100.0	24,288	2,194,975	20,347
SEBN	비상장	1995.07.01	경영참여	236	539,138	100.0	914,751	-	-	-	539,138	100.0	914,751	2,377,730	25,411

SEEH	비상장	2008.01.01	경영참여	4,214	0	100.0	1,369,992	-	-	-	0	100.0	1,369,992	10,841,515	57,997
SENA	비상장	1992.03.01	경영참여	392	1,000	100.0	69,372	-	-	-	1,000	100.0	69,372	697,034	46,974
SESK	비상장	2002.06.01	경영참여	8,976	0	55.7	263,767	-	-	-	0	55.7	263,767	1,585,901	74,065
SEPOL	비상장	1996.04.01	경영참여	5,462	106	100.0	78,267	-	-	-	106	100.0	78,267	1,172,265	83,313
SEAG	비상장	2002.01.01	경영참여	40	0	100.0	32,162	-	-	-	0	100.0	32,162	574,106	22,506
SERC	비상장	2006.01.01	경영참여	24,877	0	100.0	188,290	-	-	-	0	100.0	188,290	876,346	-48,890
SERK	비상장	2007.07.19	경영참여	4,600	0	100.0	204,555	-	-	-	0	100.0	204,555	1,149,970	-104,424
SEO	비상장	1997.01.01	경영참여	120	0	100.0	-10,043	-	-	-	0	100.0	-10,043	1,960	-76
SGE	비상장	1995.05.25	경영참여	827	0	100.0	32,836	-	-	-	0	100.0	32,836	1,031,216	23,024
SEEG	비상장	2012.07.09	경영참여	23	0	0.1	39	-	-	-	0	0.1	39	1,055,570	90,110
SSA	비상장	1998.12.01	경영참여	263	2,000	100.0	32,622	-	-	-	2,000	100.0	32,622	573,688	27,116
SAPL	비상장	2006.07.01	경영참여	793	877,133	100.0	981,483	-	-	-	877,133	100.0	981,483	26,894,611	8,699,679
SME	비상장	2003.05.01	경영참여	4,796	17,100	100.0	7,644	-	-	-	17,100	100.0	7,644	541,255	19,997
SDMA	비상장	1995.03.01	경영참여	21,876	71,400	75.0	18,741	-	-	-	71,400	75.0	18,741	24,689	-653
SEMA	비상장	1989.09.01	경영참여	4,378	16,247	100.0	103,402	-	-	-	16,247	100.0	103,402	278,943	27,678
SAVINA	비상장	1995.01.17	경영참여	5,839	0	100.0	28,365	-	-	-	0	100.0	28,365	129,160	23,545
SEIN	비상장	1991.08.28	경영참여	7,463	46	100.0	118,909	-	-	-	46	100.0	118,909	883,023	81,977
TSE	비상장	1988.01.01	경영참여	1,390	11,020	91.8	279,163	-	-	-	11,020	91.8	279,163	3,263,473	168,524
SEAU	비상장	1987.11.01	경영참여	392	53,200	100.0	111,964	-	-	-	53,200	100.0	111,964	593,991	89,655
SIEL	비상장	1995.08.01	경영참여	5,414	216,787	100.0	75,263	-	-	-	216,787	100.0	75,263	6,772,537	508,510
SRI-Bangalore	비상장	2005.05.30	경영참여	7,358	17	100.0	31,787	-	-	-	17	100.0	31,787	351,226	70,907
SJC	비상장	1975.12.01	경영참여	273	1,560	100.0	253,108	-	-	-	1,560	100.0	253,108	1,445,517	1,698
SRJ	비상장	1992.08.25	경영참여	3,120	122	100.0	117,257	-	-	-	122	100.0	117,257	157,868	3,705
SCIC	비상장	1996.03.01	경영참여	23,253	0	100.0	640,452	-	-	-	0	100.0	640,452	13,830,988	257,878
SEHK	비상장	1988.09.01	경영참여	349	274,250	100.0	79,033	-	-	-	274,250	100.0	79,033	1,366,841	27,953
SET	비상장	1994.11.01	경영참여	456	27,270	100.0	112,949	-	-	-	27,270	100.0	112,949	1,364,801	39,316
TSEC	비상장	1993.04.01	경영참여	15,064	0	48.2	103,134	-	-	-	0	48.2	103,134	392,205	78,285
SSEC	비상장	1995.04.01	경영참여	32,128	0	69.1	130,551	-	-	-	0	69.1	130,551	668,331	27,284
SESC	비상장	2002.09.01	경영참여	5,471	0	73.7	34,028	-	-	-	0	73.7	34,028	150,161	6,470
TSTC	비상장	2001.03.01	경영참여	10,813	0	90.0	260,092	-	-	-	0	90.0	260,092	643,732	6,712
SSS	비상장	2001.01.01	경영참여	1,200	0	100.0	19,189	-	-	-	0	100.0	19,189	5,067,891	318,578
SCS	비상장	2012.09.19	경영참여	111,770	0	100.0	5,275,760	-	-	-	0	100.0	5,275,760	17,095,000	638,385
SSCX	비상장	2016.04.25	경영참여	1,141	0	100.0	1,141	-	-	-	0	100.0	1,141	906,967	44,249
SESS	비상장	1994.12.30	경영참여	18,875	0	100.0	504,313	-	-	-	0	100.0	504,313	1,494,205	101,122
TSLED	비상장	2012.04.01	경영참여	119,519	0	100.0	119,519	-	-	-	0	100.0	119,519	509,355	31,809
SSCR	비상장	2006.09.01	경영참여	3,405	0	100.0	9,332	-	-	-	0	100.0	9,332	76,826	11,076
TSST Japan	비상장	2004.03.29	경영참여	1,639	30	49.0	0	-	-	-	30	49.0	0	159	-21
STE	비상장	1996.01.01	경영참여	4,206	2	49.0	0	-	-	-	2	49.0	0	8,040	0
Semiconductor Portal Inc.	비상장	2002.12.01	단순투자	38	0	1.2	10	-	-	-	0	1.2	10	1,981	159
Nanosys Inc.	비상장	2010.08.13	단순투자	4,774	2,000	0.8	2,387	-	-	-1,305	2,000	0.6	1,082	0	0
One-Blue, LLC	비상장	2011.07.14	경영참여	1,766	0	16.7	1,766	-	-	-	0	16.7	1,766	19,098	599
TidalScale Inc.	비상장	2013.08.12	단순투자	1,112	2,882	4.3	1,112	-	-	-	2,882	4.3	1,112	-	-
Sentiance NV	비상장	2012.12.01	단순투자	3,422	7	7.2	3,422	-	-	-	7	7.2	3,422	14,481	-2,875
Mantis Vision Ltd.	비상장	2014.01.16	단순투자	1,594	355	2.1	1,980	-	-	-	355	2.1	1,980	19,901	-27,332
Leman Micro Devices SA	비상장	2014.08.14	단순투자	1,019	17	3.4	1,019	-	-	-	17	3.4	1,019	3,602	-3,363
Keyssa, Inc.	비상장	2016.01.28	단순투자	3,332	1,235	1.9	3,332	-1,235	-3,332	-	0	-	0	-	-
Sensifree LTD	비상장	2016.01.01	단순투자	2,111	666	9.5	2,111	-	-	-	666	9.5	2,111	1,119	-1,710
Unispectral Ltd.	비상장	2016.02.29	단순투자	1,112	2,308	7.9	2,130	-	-	-	2,308	7.9	2,130	3,059	-3,170
Quobyte, Inc.	비상장	2016.04.28	단순투자	2,865	729	11.8	2,865	-	-	-	729	11.8	2,865	1,909	-831
Afero, Inc.	비상장	2016.05.04	단순투자	5,685	723	5.5	5,685	-	-	-	723	5.5	5,685	59,600	-6,289
Graphcore Limited	비상장	2016.06.30	단순투자	3,494	12,000	1.4	3,494	-	-	-	12,000	1.4	3,494	279,496	-148,852
SoundHound Inc.	상장	2016.12.01	단순투자	7,059	306	1.1	7,059	1,415	973	-4,212	1,703	0.9	3,820	58,330	-91,002
Almotive GmbH.	비상장	2017.12.22	단순투자	3,302	2	3.2	3,302	-2	-10,976	7,674	0	-	0	-	-

Fasetto, Inc.	비상장	2019.01.29	단순투자	6,701	475	5.2	12,554	-	-	-	475	5.2	12,554	1,973	-10,269
합 계					-	-	57,890,266	1,789	1,092,865	-221,274	-	-	58,761,857	-	-

※ 별도재무제표 기준입니다.

※ 법인명은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참고하시기 바랍니다.

※ 최초취득일자의 날짜는 일부 과거 취득시 자료 확보가 현실적으로 곤란한 경우 일괄적으로 1일로 기재하였습니다.

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

※ 당사는 기업회계기준에 따라 금융상품(지분상품)에 대해서는 공정가치로 측정하고 있으며, 종속기업 및 관계기업 투자주식에 대해서는
매년 손상(감액) 징후가 있는지 검토하고 징후가 있다면 해당 자산의 회수가능액을 추정하여 손상 회계처리를 하고 있습니다.

※ 최근사업연도 재무 현황은 일부 법인의 자료 확보가 현실적으로 곤란하여, 성원건설㈜은 2016년 12월 31일, 대우송도개발㈜는 2017년 12월 31일,
Mantis Vision은 2019년 12월 31일, Sentiance, SensiFree, Unispectral, Afero, Graphcore, Soundhound, Leman Micro Devices SA, 솔브레인홀딩스㈜, 솔브레인㈜,
㈜팬택자산관리, TSST Japan, Semiconductor Portal, One-Blue, 베어포트리조트, ㈜용평리조트는 2021년 12월 31일 현재의 재무 현황을 기재하였습니다.

4. 연구개발실적(상세)

☞ 본문 위치로 이동

부문		연구과제 등	연구결과 및 기대효과 등
DX 부문	영상디스플레이	QLED 8K TV (2019.02. ~2020.06.)	□ Flat QLED 8K TV (65・75・85") - 세계 최초 화면과 베젤 간 경계 없는 Infinity 스크린, 플랫한 디자인으로 벽면과의 조화, Floating한 느낌의 메탈 스탠드 적용한 혁신적 폼팩터 - 실제를 보는 듯한 화질을 제공하는 QLED 8K 화질, AI Upscaling을 통한 고해상도 화질 경험, 어떤 환경에서도 True Reality화질 제공 - 멀티사운드 채널과 Object Tracking Sound+ 적용하여 영상과 사운드가 일치되어 입체감 극대화 - 다양한 콘텐츠, Multimedia Experience 및 엔터테인먼트 특화된 기능으로 편리하고 다양한 경험 제공
		Neo QLED 8K (2021.03. ~2022.03.)	□ Mini LED 기반 초고화질 & 슬림 8K TV (65・75・85") - QN900 (65・75・85") / QN800 (65・75・85") / QN700 (65・75") - 세밀한 Mini LED의 향상된 명암비로 더욱 실제를 보는 듯한 QLED 8K 화질 - 'OTS Pro(Object Tracking Sound Pro)' 기능 추가
		Neo QLED 4K (2021.03. ~2022.03.)	□ Mini LED 기반 3개 시리즈, 7개 사이즈 (43・50・55・65・75・85・98") □ Mini LED 적용을 통한 Slim 구현 및 Bezel-less/Metal를 통한 디자인 프리미엄 Look - Quantum Nano-Layer Multi-Cell 구조를 적용하여 Slim하면서도 높은 광 효율과 광 Profile 조절이 가능한 New LED - 계조 표현력 4배 향상으로 밝고 어두운 영역을 더욱 자세하게 표현
		QD-Display TV (~2022.03.)	□ Quantum Dot 기반 self-emitting Display Flat 4K TV (55・65") □ Quantum Dot 기반 self-emitting Display 고화질과 Sleek한 Blade Slim Design에 OTS 및 True Ch. ATMOS 까지 모두 적용된 진정한TV 가치를 제공하는 QD-Display TV
		QLED 4K TV (~2022.03.)	□ Flat QLED 4K TV (43・50・55・60・65・70・75・82・85") - 4K 최고의 화질(AI/밝기/시야각) 및 음질(OTS)을 통한 시청 경험을 극대화한 Flagship QLED - 최고의 명암비, 시야각 Free, Life-like 컬러와 최적의 밝기로 몰입감을 극대화 - 음성인식 및 AI 기술 기반으로 외부 환경 및 사용자 Context를 인지하여 최적의 시청 경험 제공 - 외장 Camera 적용을 통한 Google Duo 지원
		UHD TV (~2022.03.)	□ Flat UHD TV (43・50・55・ 58・60・65・70・75・82・85") - Slim한 Bezel-less 디자인과 실제 자연색에 가까운 Color를 제공하는 UHD 스마트 TV - Dynamic Crystal Color 및 Dual LED를 통해 원본 콘텐츠의 화질을 그대로 표현하는 UHD 화질 - Multi-media Screen 경험 제공, 풍부한 콘텐츠, Smart Home의 경험을 통해 완성된 Smart 경험 제공 - Game Home, IoT Hub, Watch/Chat together 기능 추가를 통한 Smart 경험 강화
		Lifestyle TV (~2022.03.)	□ The Sero (43") - Modern & Simple 한 세로형 Screen에 판상형 Speaker가 부착된 360도 Design - 다양한 거주공간 어디에도 쉽게 거치 가능, 이동 가능한 Floor 스탠드 제공 - 기울어진 폼팩터에도 외광/실내 조명 반사 없는 화질로 기존 제품의 VoC 대폭 개선 □ The Frame (32・43・50・55・65・75・85") - Real 액자 디자인 및 액자 설치 경험 완성 - 다양한 명화, 사진 등 감상 가능, 인테리어와 조화로운 Lifestyle 디자인 채용 - 초대형 Life Style 제품 Needs에 따른 85" 추가도입 - 외광/실내 조명 반사 없이 항상 종이와 같은 질감을 표현하는 화질로 Real Frame 경험 완성 □ The Serif (43・49・55・65") - 'I' 형태 Serif Font 디자인으로 확실한 차별화 및 인테리어 감성 극대화 - 대형 사이즈 제품 포지션 확대를 위한 65" 추가도입 - 외광/실내 조명 반사 없이 항상 매트한 질감을 표현하는 화질로 가구와 같은 디자인 완성 □ Outdoor TV(55・65・75")

			- 옥외에서 휴식과 Entertainment를 동시에 즐기려는 Lifestyle 대응을 위한 차별화된 제품 □ The Premiere (100~130") - 초단초점・레이저・고화질 폼팩터에 업계 최고 Smart UX/OTT 경험 제공 - Blended 디자인으로 벽 근처에 쉽게 놓고 원하는 공간에 적합한 사이즈로 투영 - 당사 TV의 완성된 콘텐츠 경험과 차별화된 화질・음질을 제공하는 프로젝터 □ The Freestyle (30~100") - 언제 어디서나 다양한 컨텐츠를 쉽게 감상할 수 있는 Movable Smart Screen - 다양한 공간에 쉽게 놓이며 각도/거리에 상관없이 최적 시청 경험 제공(Auto Focus/Auto Keystone) - 기본 Cradle로 다양한 공간에 거치 사용성이 추가되고 소켓을 통해 신규 설치 확장도 가능
		Micro-LED TV (~2022.01.)	□ The Wall 2.0 (110") - Tech. leadership 및 Micro-LED 시장 장악력 강화하기 위해 Micro-LED 완품형 출시 - 실제 세상을 화면에 재현하는 초대형 Home Screen - 해상도 제약없이, 실제를 보는 듯한 공간감 및 깊이감/입체감 있는 Micro-LED 화질
		Sound Bar (~2022.03.)	□ Sound Bar - TV와 조화로운 'Bar' 형태의 오디오 제품 - 음성 인식 AI Solution 채용 - 3D 서라운드 채용으로 현장감 극대화 및 공간을 채우는 사운드 구현 □ Sound Bar Q990B - 업계 최초, TV에서 사운드바로 무선 ATMOS 전송(Wireless ATMOS) - TV와 Soundbar의 모든 채널을 활용하여 극장과 같은 최상의 Cinema True ATMOS 제공 - 사운드바 자제 공간 보정 기술 탑재
		모니터 (2021.01. ~2022.12.)	□ 스페이스 모니터 - 모니터가 차지하는 공간을 최소화한 일체형 Arm Stand 적용 □ Neo QLED 게이밍 모니터(49") - Neo QLED 적용하여 향상된 명암비를 기반으로 블랙 표현력 강화 - 세계 최고 곡률 1000R 적용하여 게이밍 몰입 강화 □ 고해상도 QHD 모니터(34") - Intelligent Eye Care 솔루션 등으로 눈에 편안한 화질 솔루션 제공 □ LCD 스마트 모니터: 스마트 TV 서비스 활용하여 PC 없이 VOD 시청 (Netflix, Youtube 등) □ 스마트 모니터 M80B (32") - 초슬림, Flat Back, Warm White 컬러 적용 Lifestyle 디자인 - Magnetic 방식의 전용 카메라 In-box 영상 커뮤니케이션 - 스마트 경험 강화(VOD 시청/모바일 연결/PC-less기능/IoT/Communication/Game) □ 게이밍 모니터 G85NB (32") - 세계 최초 UHD 240Hz 1ms(GTG) 최고 게이밍 성능 모니터 (1000R Curved) - 새로운 수준 화질 경험을 제공하는 Odyssey Neo (Mini LED, Quantum HDR2000) □ 세계 최초 1000R 대형 게임 스크린 G97NB (55") - 1000R, 16:9, 55" Big Curved Screen으로 근접 환경에서도 시야각 제약 없는 최대 사이즈 화면으로 최고의 몰입감 제공 - 세로로 회전하고 자유로운 각도 조정으로 우주선 조종석에 앉은 것 같은 새로운 몰입 경험 제공 - 4K 165Hz 입출력 및 반응속도 1ms까지 지원 가능한 게임 전용 패널 □ QD-OLED 게이밍 모니터 (G85SB 34") - True RGB 자발광 Display와 Quantum Dot 기술의 조합으로 다양한 컬러를 정교하게 표현 - 0.1ms 최고 응답속도, 175Hz 주사율로 보다 깨끗한 화면으로 게임 플레이 가능 - Gaming Hub 적용으로 Cloud Game, 콘솔 등 All-In-One Game Discovery Platform 도입
		사이니지 (2019.10.	□ LCD 기반의 B2B Smart Signage (LFD, Video Wall 등) (49・ 55・65・75 ・85 ・98") □ LED 소자를 활용한 Indoor / Outdoor 사이니지

		~2022.12.)	□ 부가 장치 일체형 All-in-one Kiosk (24") - Tizen 결제모듈/주문 앱 개발 위한 결제 플랫폼, 항균 코팅 □ FLIP-Edu (75 / 85") 교육용 인터렉티브 제품
	생활가전	냉장고 (~2022.02.)	□ Chef Collection 냉장고 - 프리미엄 Bespoke 디자인 및 신규 CMF 적용 - Water & Ice Solution 적용: Auto Fill Pitcher, Auto Ice Maker (Dual Mode: Cocktail Ice, Standard Ice) - FDSR 에너지 1등급 구현 □ Cube 냉장고 - Multi Cube 냉장고, 나에게 맞춘 디자인과 수납(와인, 맥주, 화장품 등 온도별 저장) - Peltier System 구현, 최적의 온도 제어 (5~18℃ 온도 조절 가능) - 2중 Glass System 적용으로 자외선 차단 및 정온 유지 - Wi-Fi Control로 상시 모니터링・제어 - RM(Remote Management) Function: 각종 오류 원격 진단・조치 및 보관중 음료의 유통기한 알림 □ 북미/중남미 신규 TMF - 대용량, 전문보관, New Design으로 경쟁력 강화 및 제품 차별화(440L/480L) - Flex Zone(Fridge 1℃ / Chilled -1℃ / Soft Freezing) & Quick Chill Smart Alarm - Flat Door & Bespoke CMF, 용량 및 최적 사이즈로 경쟁력 강화(20ℓ More) - Bi Volt(Free Voltage), Auto Icemaker, Water Dispenser, Big Box, Hygiene □ 1-Door Premium Kitchen Fit 냉장고 (냉동/냉장/김치/와인) - Premium Bespoke 디자인 및 신규 CMF 적용 - Auto Door Open - Water & Ice Solution 적용: Auto Fill Pitcher, Dual Auto Ice Maker(Cocktail Ice, Standard Ice)
		세탁기 (~2022.01.)	□ BESPOKE 세탁기 & 건조기 - 당신의 공간에 딱 맞추는 비스포크 Flat 디자인 - 국내 최대 용량 올인원 컨트롤 UX 디자인 - 세탁부터 건조까지 AI 의류 케어(AI 맞춤세탁, 건조) - 99.9% 살균부터 세탁실 제습까지 위생관리 솔루션 □ Agitator 세탁기 - 북미 Agitator 신규 시장 진입(Top Loader 시장 중 50% 점유) - ActiveWave™ Agitator 구현으로 소음, 진동 및 엉킴 줄이는 동시에 강력 세탁 가능 - 'Active Water Jet' 구현으로 애벌 세탁 가능 □ 구주향 친환경 신냉매 건조기 - 친환경 냉매 : 온실가스감축을 위한 친환경 냉매(R290) 적용 - 에너지 A+++ : 구주 에너지 최고 등급 달성 - Sensor Dry : 건조행정 중 건조도 감지, 추가 건조부터 행정 종료까지 알아서 판단 - Simple UX : 제품 사용성 개선 (상세한 건조 정보 전달 및 맞춤형 패널 설정) - Hygiene Care : 유해 세균3종(녹농균, 대장균, 황색포도상구균) 99% 이상 살균 □ 그랑데 AI 24kg 세탁기 - 24kg, Flat Design (Glass Type) - 펫케어 코스 적용(얼룩, 냄새, 알러젠 제거) - Auto open door 적용(세탁 종료 후 자동으로 문 열림) □ BESPOKE 그랑데 AI 20kg 건조기 - 국내최초 최대 용량 20kg, Flat Design - 펫케어 코스 적용(털제거 특화), - Auto open door 적용(건조 종료 후 자동으로 문 열림) - 온/습도 센서추가하여 세탁실 주변 습도 감지하여 제습 솔루션 제공
		에어컨	□ 무풍 갤러리 스탠드에어컨(56.9・62.6・75.5・81.8・92.5㎡)

		(~2021.04.)	- 에너지 우위 확보가 가능한 최고 효율 Next 무풍 플랫폼 개발(56.9㎡ 싱글 에너지 2등급 달성) - 1.5배 넓어진 무풍 면적(패널)과 강력한 부스터풍 - 부스터 청정: 집진효율 99.95% 필터, 가구같이 편안한 갤러리 디자인 □ 무풍 벽걸이 와이드 에어컨(24.4・29.3・39.6・49.5㎡) - QMD 기반의 신규 통합 플랫폼 개발로 원가경쟁력 확보, 제품 경쟁력 강화 - 12% 더 커진 팬으로 빠르고 시원한 패스트 쿨링 - 전기료 부담을 최대 77% 덜어주는 무풍 미세 초절전 - 초미세먼지까지 제거하는 PM1.0 필터시스템의 무풍청정 □ BESPOKE 윈도우핏 에어컨(17㎡, 그린/블루/핑크/베이지/그레이) - 실내외기 일체형으로 셀프 간편 설치 - 2중 바람 날개로 냉기를 빠르게 순환하는 강력 회전 냉방 - 트윈 인버터 컴프레서로 도서관 수준의 37dB 저소음&저진동 - 저소음 모드 사용 시 소비전력 최대70% 절전
		청소기 (~2021.05.)	□ BESPOKE 제트 스틱 청소기(최고 흡입력 210W) - 일체형 자동 먼지배출기, 스마트한 정보전달(LCD Display) - 물분사 물걸레 브러시, 슬림 융 브러시 □ 제트봇 AI 로봇 청소기 - Active 3D 센서 개발 및 세계최초 적용하여 세계 최소(1㎝) 감지 실현으로 걸림 없는 주행 - 우리집 구조과 사물 종류까지 인식하는 AI 자율주행 - 제트 싸이클론과 디지털 인버터모터로 강력한 흡입력 - 충전과 동시에 자동 먼지비움 일체형 청정스테이션 - SmartThings로 더욱 편리해진 청소(AI 스마트컨트롤) □ BESPOKE 슬림 스틱 청소기 - 강력한 싸이클론과 디지털 인버터모터로 최대 150W 흡입력 - 셀프 스탠딩 및 허리 부담없이 간편 먼지 비움(POP & SHOOT) - 손목에 무리없이 가볍게 청소(인체공학 설계)
		조리기기 (2021.03.)	□ BESPOKE 큐커(Qooker) - 열원이나 온도/시간이 다른 식품을 한번에 맞춤 조리하는 "멀티쿡" - Multi Cook: 하나 이상의 조리가 동시에 완료되어지는 모드 적용 - 식품사(8개 회사)와 연계 큐커 전용 알고리즘 적용 - SmartThings 연계 스캔 한번으로 쉽게 자동 조리 구현 - 열효율 및 고급감 STS 조리실: 법랑 → STS 적용
		정수기 (2021.03.)	□ 가정용 Water Purifier - 소비자 라이프스타일에 따라 업그레이드하고 스스로 케어하는 모듈형 정수기 - 소비자 Needs에 따라 선택 가능한 모듈(정수/냉수/온수) - Smart AI 케어 및 직수형 최다항목 NSF 인증 필터 - 라이프 스타일과 공간 맞춤 『BESPOKE 정수기』
		의류관리기 (2019.02. ~2021.05.)	□ BESPOKE 에어드레서 (18・24") - AI 건조 및 세탁기 코스 연동 - 긴 옷도 편리하게 관리하는 긴 옷 케어존, 18인치 3벌 →5벌 용량 확장 - 리얼 케어(안감 케어, 저소음), 리얼 청정(미세먼지필터), 리얼 탈취(냄새분해필터) 리얼 살균(제트스팀), 주름관리, 리얼 공간제습 □ 슈드레서 - 에어워시와 UV 냄새분해필터로 강력 탈취 - 매일 신는 신발 기분좋게 저온섬세 건조 - 국내 가전 최초 제논 UVC 살균으로 99.9% 살균 - 제트슈트리로 다양한 신발 맞춤케어 관리

		공기청정기 (2020.12.)	□ BESPOKE Cube 공기청정기 - Bespoke를 적용한 프리미엄 공기청정기 - 살균・탈취・Pet 3가지 전문 필터를 소비자의 필요에 따라 사용 - 공간, 인테리어, 라이프 스타일 맞춤 Bespoke 공기청정기 - 인테리어에 어울리게 벽에 붙여 사용해도 성능 저하 없는 입체 흡입 구조
		청정환기 시스템 (2020.09.)	□ 청정환기 시스템 - 청정성능 33㎡, 환기풍량 40~50CMH - 환기장치에 실내청정모듈 연결로 환기와 실내청정 동시 구현 - 각 재실공간별 개별&독립 청정 및 순환&무풍 청정 - CO2센서 등의 센서 탑재를 통한 상황맞춤 자동 환기제어
		인버터 제습기 (2022.05.)	□ 에너지 소비효율 1등급 저소음 인버터 제습기 - 와이드 블레이드로 빠르고 강력하게 대용량 제습 - 욕실부터 드레스룸까지 공간을 쾌적하게 스마트 공간 케어 - 스윙 블레이드로 섬세한 의류도 골고루 와이드 의류 건조 - 어디에도 잘 어울리는 심플한 디자인과 컴팩트 사이즈 - 장시간 사용해도 조용한 저소음 모드
		식기세척기 (2022.06.)	□ 구주/한국 시장 경쟁력있는 자체 기술 플랫폼 - 구주 시장 Tall Tub 대응 - 최고 수준 에너지/물/소음 사양 경쟁력 확보 - 한국 세제자동투입, Simple UX 등 차별화를 통한 프리미엄 강화 - Z-wash, Smart, Flexible Basket 사양 차별화
	MX	갤럭시 폴더블 (~2022.08.)	□ Galaxy Z Flip (2020.02.) - Design: The New Style with Innovative Foldable Display - 인치: Main 6.7" Flexible Ultra Thin Glass(2,636 x 1080) Cover 1.1" Super AMOLED(300 x 112) - 사이즈(W x H x D): (Unfolded) 73.6mm x 167.3mm x 6.9~7.2mm (Folded) 73.6mm x 87.4mm x 15.4~17.3mm - Platform(H/W, S/W): SDM855+, Android 10.0 - Ultra Thin Glass 기술로 갤럭시 최초 접히는 유리 디스플레이 탑재하여 내구성 강화 - Flip 폴드 형태의 Compact한 신규 폼팩터로 휴대성 강화 - Free-Stop 기능을 통해 접히는 각도를 자유롭게 조절하는 Flex Mode 사용 경험 제공 - 21.9 : 9 화면 비율로 상하 Multi Active Window 사용성 강화
			□ Galaxy Z Fold2 (2020.09.) - 인치: 메인 디스플레이 7.6", 커버 디스플레이 6.2" - 사이즈(W x H x D): (접힘상태) 68 x 159.2 x 13.8 (~16.8) mm - Platform(H/W, S/W): SDM865 Plus, Android 10.0, One UI 2.5 - 초고속 5G 이동통신 지원, 1,200만 화소 카메라 - 인피니티 플렉스 디스플레이(Infinity Flex Display), 플렉스 모드 지원 - 120Hz 가변 주사율의 다이내믹 아몰레드 2X 디스플레이(Dynamic AMOLED 2X display) - 삼성 Ultra Thin Glass - 무선 연결 삼성 덱스(Samsung Dex), UWB(초광대역) 지원 - 최대 3개의 앱을 동시에 사용할 수 있는 진화된 멀티 액티브 윈도우 - 커버 디스플레이에서 메인 디스플레이로 앱 연속성 제공
			□ Galaxy Z Fold3 5G (2021.08.) - 인치: 메인 디스플레이 7.6", 커버 디스플레이 6.2" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 158.2mm x 67.1mm x 14.4~16.0mm (펼쳤을 때) 158.2mm x 128.1mm x 6.4mm

			- Platform(H/W, S/W): 5나노 64비트 옥타코어 프로세서, Android 11, One UI 3.1.1 - 폴더블 스마트폰 최초 IPX8 등급지원 (1.5m 담수에서 최대 30분간 방수지원) - 알루미늄 소재인 'Armor Aluminum'과 'Corning Gorilla Glass Victus' 강화 유리 적용으로 내구성 강화 - 7.6"인피니티 플렉스 디스플레이 탑재 및 언더 디스플레이 카메라 (Under Display Camera) 적용 - 에코스퀘어(Eco2) 기술로 디스플레이 화면 약 29% 밝기 향상 - 메인 / 커버 디스플레이 모두 120Hz 화면 주사율 지원 - 폴더블폰 최초로 S펜 적용 - 플렉스 모드패널(Flex Mode Panel)로 최적화 되지 않은 앱도 원하는 각도에서 상하단 표시 지원 - 최대 3개 앱까지 화면 분할해 사용하는 멀티 액티브 윈도우 (Multi-Active Windows) 지원
			□ Galaxy Z Flip3 5G (2021.08.) - 인치: 메인 디스플레이 6.7", 커버 디스플레이 1.9" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 72.2mm x 86.4mm x 15.9~17.1mm (펼쳤을 때) 72.2mm x 166mm x 6.9mm - Platform(H/W, S/W): 5나노 64비트 옥타코어 프로세서, Android 11, One UI 3.1.1 - 폴더블 스마트폰 최초 IPX8 등급지원 (1.5m 담수에서 최대 30분간 방수지원) - 알루미늄 소재인 'Armor Aluminum'과 'Corning Gorilla Glass Victus' 강화 유리 적용으로 내구성 강화 - 커버 디스플레이 사용성 강화 : 알림/메시지 8줄까지 확인가능, 날씨/걸음수 위젯 지원, 삼성페이 결재 지원 - 플렉스 모드 활용 강화: 촬영 인원에 따라 자동으로 구도를 조절하는 자동 프레이밍(Auto Framing), 듀얼 프리뷰 (Dual Preview) 등 지원 - 메인 디스플레이120Hz 화면 주사율 지원
			□ Galaxy Z Fold4 (2022.08.) - 인치: 메인 디스플레이 7.6", 커버 디스플레이 6.2" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 155.1mm x 67.1mm x 14.2~15.8mm (펼쳤을 때) 155.1mm x 130.1mm x 6.3mm - Platform(H/W, S/W): SM8475, Android 12.0, One UI 4.1.1 - Nightography 사진/비디오, 고해상도(50M/8K), 고배율줌(30X)로 카메라 사용 경험 완성도 제고 - Taskbar제공으로 쉽고 빨라진 멀티 태스킹 - 다양한 진입점으로 편리하게 생성하는 멀티 윈도우 - 이미지에서 텍스트를 인식하여 AI 기반 Action 추천 기능
			□ Galaxy Z Flip4 (2022.08.) - 인치: 메인 디스플레이 6.7", 커버 디스플레이 1.9" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 71.9mm x 84.9mm x 15.9~17.1mm (펼쳤을 때) 71.9mm x 165.2mm x 6.9mm - Platform(H/W, S/W): SM8475, Android 12.0, One UI 4.1.1 - 25W 충전 지원 및 3700mAh 배터리 제공 - 다양한 각으로 사진/영상 촬영에 최적화된 플렉스 캠 지원 - 플렉스 모드에서 쉽고 빠른 앱 전환 및 조작 - 커버 스크린 기능 확대 (간편 답장, 삼성 월렛 플랫폼, 퀵세팅 확대 등)
		갤럭시 S (~2022.02.)	□ Galaxy S20・S20+・S20 Ultra 5G (2020.03.) - Design: Best Fit in hand compact, yet large screen design - 인치: S20 6.2", S20+ 6.7", S20 U 6.9" - 사이즈(W x H x D): S20 69.1 x 151.7 x 7.9 mm, S20+ 73.7 x 161.9 x 7.8 mm, S20 U 76.0 x 166.9 x 8.8 mm - Platform(H/W, S/W): Exynos990, SDM865, Android 10.0, One UI 2.1 - 비약적으로 향상된 해상도와 8K 동영상 촬영으로 전에 없던 퀄리티의 사진과 영상을 찍고 5G로 쉽고 빠르게 공유하여 모바일과 사진의 미래를 바꿀 스마트폰 - 비약적으로 향상된 해상도로 완성하는 사진과 동영상: S20・S20+ 64MP, S20 U 108MP

			- 스마트폰 사상 가장 높은 배율의 스페이스 줌(100배): S20 U 108MP - 3배 가까이 커진 센서로 야간에도 더 밝고 선명한 사진・동영상 기록(AI기술접목) - 스마트폰 사상 가장 뛰어난 8K 해상도의 동영상 촬영 - 떨리는 순간에도 흔들림은 적게, 역동적인 모습은 고스란히 담는 슈퍼스테디 - 단 한번의 촬영으로 베스트 사진과 동영상을 남길 수 있는 싱글테이크
			□ Galaxy S20 FE (2020.10.) - 더 많은 고객에게 S 시리즈의 경험 제공 - 인치: 6.5" FHD+ sAMOLED Infinity-O (2,400 x 1,080) - 사이즈(W x H x D): 74.5mm x 159.8mm x 8.4mm - Platform(H/W, S/W): Exynos990, SDM865, Android 10.0, One UI 2.5 - 프리미엄 기능을 흡수한 새로운 Entry Flagship Line 제품으로 시장 영향력 확대 및 소비자에게 최적화된 다양한 기능의 경험 기회 부여 - S20 핵심 기능 제공: 120Hz display, Camera, Battery 등 동일 체험 제공, Flagship 동등 AP 사용 및 One UI 2.5 UX
			□ Galaxy S21 5G・S21+ 5G・S21 Ultra 5G (2021.01.) - Design: Iconic and premium full metal camera housing, Bezel-less Design - 인치: S21 5G 6.2", S21+ 5G 6.7", S21 Ultra 5G 6.8" - 사이즈(W x H x D): S21 5G 71.2 x 151.7 x 7.9 mm, S21+ 5G 75.6 x 161.5 x 7.8 mm, S21 Ultra 5G 75.6 x 165.1 x 8.9 mm - Platform(H/W, S/W): Exynos2100, SDM888, Android 11.0, One UI 3.1 - 초고속 5G 이동통신 지원, Wi-Fi 6E 지원, 고화소 카메라 탑재 ・카메라: S21 Ultra 1억 8백만 화소, S21・S21+ 6,400만 화소, Multi Camera Recording 기능 ・최대 120Hz 가변 주사율 Dynamic AMOLED 2X Infinity-O 디스플레이 탑재 ・SmartTag와 연동한 쉬운 사물 등록・찾기 기능 지원 ・Digital Car Key 서비스 지원(S21+ 5G・S21 Ultra 5G only) ・S Pen 지원(S21 Ultra 5G only)
			□ Galaxy S22・S22+・S22 Ultra (2022.02.) - Design: Enhance Galaxy Design attractiveness with geometric bold design and integrity on quality - 인치 : S22 6.1", S22+ 6.6", S22 Ultra 6.8" - 사이즈(W x H x D) : S22 70.6 x 146.0 x 7.6 mm, S22+ 75.8 x 157.4 x 7.6 mm, S22 Ultra 77.9 x 163.3 x 8.9 mm - Platform(H/W, S/W): SM8450 | Exynos2200, Android 12.0, One UI 4.1 - 카메라 동영상 촬영 및 저조도 성능 강화 ・동영상 : HDR, OIS+AI Stabilizer성능 개선으로 풍부한 컬러 지원 및 흔들림/지터링 최소화 ・저조도 성능강화 : Big Pixel 센서 및 On-device AI 알고리즘 적용 - S Pen 내장을 통한 Ultra/Note 통합 * Latency 최적화 : 5.6ms(S21 Ultra) → 2.8ms(S22 Ultra) - Display 야외 시인성 개선 * Peak 휘도: 1,500nit(S21 Ultra) → 1,750nit(S22 Ultra) - All day 사용 가능한 배터리와 초고속 45W 충전 속도 (S22 Ultra/S22+) - 내구성 강화 : 10% 개선된 Amor AL, Victus+ Glass 적용 - Galaxy Foundation 경험 완성도 제고 ・One UI 4.1: 감성적 Interaction경험과 사용자 개인경험 고도화 ・Galaxy Eco : End-to-End 완성도 제고 및 체감 편의 경험 강화
		갤럭시 노트 (~2020.08.)	□ Galaxy Note20・20 Ultra (6.7・6.9") (2020.08.) - 사이즈(W x H x D): Note20 75.2 x 161.6 x 8.3 mm, Note20 Ultra 77.2 x 164.8 x 8.1 mm - Platform(H/W, S/W): Exynos990, SDM865 Plus, Android 10, One UI 2.5 - 초고속 5G 이동통신 지원, Wi-Fi 6 지원 - 갤럭시 스마트폰 최초로 UWB(Ultra Wideband, 초광대역통신) 지원(Note 20 Ultra)

			- 1억 8백만 화소 카메라(Note 20 Ultra), 6,400만 화소 카메라(Note 20) - 최대 120Hz 주사율의 디스플레이(Note 20 Ultra) - 최초 무선 연결 삼성 덱스(Samsung DeX) 연결 지원 - 완벽한 필기감과 함께 편리한 사용성을 제공하는 S펜과 삼성 노트, MS 엑스박스(Xbox) 게임 지원
		갤럭시 탭 (~2022.02.)	□ Galaxy Tab S7・S7+ (2020.08.) - Design: Premium Tablet (Display, Pen, Performance) - 인치: 12.4" WQXGA sAMOLED(16:10, 2800x1752/120Hz), 11" WQXGA LTPS TFT(16:10, 2,560x1,600/120Hz) - 사이즈(W x H x D): 285.0 x 185.0 x 5.7mm(12.4"), 253.8 x 165.3 x 6.3mm(11") - Platform(H/W, S/W): SDM865+, Android 10.0, One UI 2.5 - 대형 Display 박형 Metal 디자인 구현으로 프리미엄 제품 경쟁력 확보 - Tablet 최초 5G (mmWave) 탑재하여 Global 및 미주 4대 사업자 출시 - 120Hz Display 고속 구동 및 Pen Latency(9ms) 최적화로 Samsung Notes 사용성 강화 - N세대 AP 탑재로 Performance 극대화(Seamless multi-tasking & gaming experience)
			□ Galaxy Tab S7 FE (2021.06.) - 인치: 12.4” WQXGA (2560 x 1600) - 사이즈(W x H x D) & 무게: 284.8mmx 185mm x 6.3mm, 608g(LTE 기준) - 12.4" 대화면 Display와 slim 베젤로 몰입감 있는 디스플레이 - 긴 배터리 사용시간 (10,090mAh, Up to 13 hours video play) - Dolby Atmos 적용으로 풍성한 사운드 - Samsung Note 사용성 강화 ・간편하게 손글씨를 TEXT로 변환 ・입력창에 직접 S Pen으로 입력 - PENUP Drawing 기능 강화 ・Layer 구조 적용 및 컬러링 & 라이브 드로잉 제공 - 경량화 키보드 커버 (330g) - 3Mic를 통한 주변 Noise 50%감소로 깨끗한 보이스 전달 - Device 연결성 강화 ・Second Screen: Tablet을 PC의 보조 모니터로 사용 ・Hand off: Phone에서 사용하던 걸 Tablet에서 바로 이어서 사용 (Internet, Samsung Notes) ・Copy & Paste: Phone과 Tablet 간 Text 및 이미지를 복사 & 붙이기 ・Auto Switching: 자동으로 Phone/Tablet 간 버즈 스위칭
			□ Galaxy Tab A8 (2021.12.) - 인치: 10.5” WUXGA (1920 x 1200) - 사이즈(W x H x D) & 무게: 246.8mm x 161.9mm x 6.9mm, 508 g - Platform(H/W, S/W): UniSOC T618(12nm) 프로세서, Android 11, One UI 3 - Memory : 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 4GB + 128GB, microSD 최대 1TB 전작 대비 RAM 4GB 및 ROM 128GB 옵션 신규 제공 - 당사 Tablet Design ID 확립 및 적용 (Samsung Logo, Camera 형상 및 위치, 측면 전후면 대칭), Tab S8 Flagship Family 와 동일 컬러 적용 (Gray, Silver, Pink Gold) - 당사 태블릿 표준 Display 비율 16:10 적용, 10.5”대화면 및 Slim Bezel로 몰입감 있는 멀티미디어 경험 제공 - Dolby Atmos 지원 및 Quad Speaker 탑재, Samsung TV Plus 등 컨텐츠 특화 앱 프리로드 (무료 Live Streaming 및 VOD 제공) - Multi-Active Window 로 2 Split Windows 및 Pop-up 창 지원, Fold3 적용된 Drag & Split 태블릿 최초 지원으로 멀티태스킹 경험 강화

			- Tab A 시리즈 최초 Screen Recorder 지원으로 온라인 클래스 활용도 강화 - One UI 3.1.1 Galaxy Experience 확산 지원 (Copy&Paste, Auto Sync, Auto Switch)
			□ Galaxy Tab S8・S8+・S8 Ultra (2022.02.) - 인치 : Tab S8 11" WQXGA+ (2560 x 1600) Tab S8+ 12.4" WQXGA+ (2800 x 1752) Tab S8 Ultra 14.6" WQXGA+ (2960 x 1848) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : Tab S8 253.8mm x 165.3mm x 6.3mm, 503g Tab S8+ 285.0mm x 185.0mm x 5.7mm, 567g Tab S8 Ultra 326.4mm x 208.6mm x 5.5mm, 726g - Platform(H/W, S/W): SM8450 프로세서, Android 12, One UI 4.1 - Memory : 8GB+128GB / 8GB+256GB / 12GB+256GB / 16G+512G, microSD up to 1TB - 화상 통화 경험 향상 [Tab S8 Ultra] Dual 전면 카메라(12M 80도, 12M 120도) 및 Auto Framing 기능 제공 [Tab S8+ / Tab S8] 12M 120도 전면 카메라 및 Auto Framing 기능 제공 - AP 방열 설계 강화를 통한 AP Sustain 성능 개선(전작비 GPU 70%, CPU 25%↑), 게임 성능 향상 - S Pen Latency 개선 (5.6ms → 2.65ms) 및 Prediction Algorithm 최적화 Writing & Drawing 시 Real Pen과 같이 끊김 없고 정밀한 필기 경험 제공, 밀착감 개선 - 3 MIC Noise Cancelation 성능 강화 (3종 잡음 제거 모드)로 화상 회의 오디오 경험 향상 - 태블릿 최초로 WiFi 6E 기능을 탑재하여 Device 간 대용량 데이터 전송 시간 개선 - D2D 15W 충전 기능 탑재하여 전작 대비 Phone Power Share 충전 시간 절반으로 단축
		갤럭시 A (~2022.09.)	□ Galaxy A52 LTE・5G (2021.03.) - 핵심 사양 강화를 통한 소비자 경험 제공 및 경쟁력 강화 - 인치 : 6.5" FHD+ sAMOLED HID (2,400 x 1,080) - 사이즈(W x H x D) : 75.1mm x 159.9mm x 8.4mm - Platform(H/W, S/W) : SDM750G(5G) / SDM720G(LTE), Android 11, One UI 3.1 - Supreme smooth UX/Dynamic refresh rate and Brightest (6.5" sAMOLED with 120Hz(5G)/90Hz(LTE), 800nit) - High-resolution 64MP Quad Camera (64M OIS/12M UW/5M Depth/5M Macro) - Powerful AP with High Capacity Battery (4,500mAh)
			□ Galaxy A72 (2021.03.) - 핵심 사양 강화를 통한 소비자 경험 제공 및 경쟁력 강화 - 인치 : 6.7" FHD+ sAMOLED HID (2,400 x 1,080) - 사이즈(W x H x D) : 77.4mm x 165.0mm x 8.4mm - Platform(H/W, S/W) : SDM720G, Android 11, One UI 3.1 - High refresh Rate Brightest Display (6.7" FHD+ sAMOLED with 90Hz, 800nit) - Advanced High-res/Multi Camera, More detail with blur-less (64M OIS/12M UW/8M Tele/5M Macro) - Long-lasting Battery with bigger capacity (5,000mAh)
			□ Galaxy A32 LTE・5G (LTE: 2021.03., 5G: 2021.01.) - 핵심 사양 강화를 통한 소비자 경험 제공 및 경쟁력 강화 - 인치 : LTE 6.4" FHD+ sAMOLED (2,400 x 1,080) / 5G 6.5" HD+ TFT (1,600 x 720) - 사이즈(W x H x D) : LTE 73.6mm x 158.9mm x 8.4mm / 5G 76.1mm x 164.2mm x 9.1mm - Platform(H/W, S/W) : LTE MT6769T / 5G MT6853V, Android 11, One UI 3.1 - LTE ・Brightest Display: 800nit Super AMOLED ・High Resolution Camera: 64MP Quad (64M W/8M UW/5M Macro/5M Depth) ・High Capacity Battery: 5,000mAh - 5G

			・Rich Camera Experience of 48MP Quad(48M W/8M UW/5M Macro/2M Depth) ・High Capacity Battery: 5000mAh
			□ Galaxy Quantum2 A82 (2021.04.) - 인치 : 6.7" QHD+ (3200 x 1440) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 161.9mm x 73.8mm x 8.1mm, 176g - Platform(H/W, S/W) : SDM855+, Android 11, One UI 3.1 - QRNG 보안칩셋 적용 - 시원한 대화면과 부드러운 화면전환 120Hz지원 - 전문가급 사진 촬영이 가능한 강력한 카메라 (초광각 12MP, 메인 64MP, 접사 5MP)
			□ Galaxy A03-Core (2021.12.) - 인치 : 6.5" HD+(1480 x 720) TFT 60Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 164.2mm x 75.9mm x 9.1mm, 211g - Platform(H/W, S/W) : 28나노 옥타코어 프로세서, Android 11(Android GO) ・전작 A01-Core(28나노 쿼드코어 프로세서) 대비 CPU 성능 향상 - Entry 시장 대응을 위한 대화면/대용량 배터리 적용 초저가 제품 ・전작A01-Core 대비 디스플레이(5.3"→6.5" HD+), 배터리(3,000→5,000mAh) 강화
			□ Galaxy A23 (2022.03.) - 인치 : 6.6"FHD+ (2408 x 1080) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.9mm x 165.4mm x 8.4mm, 195g - Platform(H/W, S/W) : SDM680, Android 12, One UI 4.1 - 6.6" FHD+ 디스플레이, 90Hz 주사율 지원 (전작 A22 6.4" HD+ 90Hz) - 고화소 50MP OIS 카메라 적용으로 어두운 곳에서 흔들림 없는 선명한 사진 촬영 가능 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용 및 25W 초고속 충전 지원
			□ Galaxy A13 5G (2022.01.) - 인치 : 6.5"HD+ (1600 x 720) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.5mm x 164.5mm x 8.8mm, 195g - 6.5" HD+ 디스플레이, 90Hz 주사율 지원 (전작 A12 6.5" HD+ 60Hz) - LTE 사용자 Migration 및 5G 시장 확산을 위한 초저가 5G 모델 - Entry 시장 대응을 위한 AP(5G) AP(MT6765 → MT6833v)강화 - 50MP 카메라 적용으로 전작(A12 16MP)비 고화소 사진 촬영 가능
			□ Galaxy A13 LTE (2022.03.) - 인치 : 6.6"FHD+ (2400 x 1080) 60Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.4mm x 165.1mm x 8.8mm, 195g - Platform(H/W, S/W) : 8나노 옥타코어 프로세서, Android 12, One UI Core 4.1 - 6.6" FHD+ 디스플레이 적용하여 전작(A12 6.5" HD+)비 향상된 대화면 경험 제공 - 50MP 카메라 적용하여 전작(A12 48MP)비 고화소 사진 촬영 가능 - 5,000mAh 고용량 배터리 및 AI Power mode 적용하여 1회 충전으로 2 Days 사용 가능
			□ Galaxy A73 5G (2022.04.) - 인치 : 6.7"FHD+ Super AMOLED+ (1080 x 2400) 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.1mm x 163.7mm x 7.6mm, 181g - Platform(H/W, S/W) : SDM778G, Android 12, One UI 4.1 - 108MP 고해상도 화질 및 OIS 지원으로 선명하면서도 어두운 곳에서 흔들림 없는 사진 촬영 가능 - 120Hz 고주사율과 sAMOLED display적용으로 부드럽고 선명한 화면 경험 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용(2 days battery) 및 25W 초고속 충전 지원 - Gorilla Glass 5 및 IP67등급 적용으로 강력한 내구성 제공 - One UI 4.1 지원으로 최신 Flagship 경험 제공
			□ Galaxy A53 5G (2022.04.)

			- 인치 : 6.5”FHD+ Super AMOLED (1080 x 2400) 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 74.8mm x 159.6mm x 8.1mm, 189g - Platform(H/W, S/W) : Exynos1280, Android 12, One UI 4.1 - 8.1t 슬림 디자인 및 5,000mAh 대용량 배터리 적용 (전작比 0.3t↓, 500mAh↑) - 120Hz 고주사율과 빠른 반응속도의 sAMOLED 조합이 제공하는 부드럽고 선명한 화면 경험 - Gorilla Glass 5 적용으로 Glass 내구성 향상 - One UI 4.1 지원으로 최신 Flagship 경험 제공
			□ Galaxy A33 5G (2022.04.) - 인치 : 6.4”FHD+ Super AMOLED (1080 x 2400) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 74.0mm x 159.7mm x 8.1mm, 186g - Platform(H/W, S/W) : Exynos1280, Android 12, One UI 4.1 - 6.4" FHD+ 디스플레이, 90Hz 지원으로 향상된 화면 경험 제공 (전작 A32-5G HD+ TFT 60Hz) - 48MP OIS 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능 - Gorilla Glass 5 적용, IP67 등급의 방수&방진 지원으로 내구성 향상 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용(2 days battery) 및 25W 초고속 충전 지원
			□ Galaxy A23 5G (2022.09.) - 인치 : 6.6”FHD+ TFT LCD (1080 x 2400) 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.9mm x 165.4mm x 8.4mm, 197g - Platform(H/W, S/W) : SDM695, Android 12, One UI 4.1 - SDM695 적용하여 전작(A22-5G MT6833V) 대비 AP 성능 강화 - 50MP OIS 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능 (NA 권역 OIS 미지원) - 6.6" FHD+ 적용하여 전작(A22-5G 6.6" HD+ 90Hz) 대비 향상된 대화면 경험 제공 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용(2 days battery) 및 25W 고속충전 지원
		갤럭시북 (~2022.12.)	□ Galaxy Book Flex 2 (2020.12.) - Design : QLED 적용 2-in-1 PC with S Pen - 인치 : 15.6" QLED FHD (16:9, 1920 x 1080), 13.3" QLED FHD (16:9, 1920 x 1080) - 사이즈(W x H x D) : (15.6") 355.0mm x 227.2mm x 14.9mm, (13.3") 302.6mm x 202.9mm x 12.9mm - Platform, OS : Intel 11세대 CPU, Windows 10 - QLED : Color Volume 100%, Super Bright Outdoor Mode Max 600nit - S Pen : Samsung Notes, Clip Studio, Gesture - SSD : Powerful performance & Latest Gen4 SSD
			□ Galaxy Book Flex2 5G (2020.12.) - 인치 : 13.3" QLED FHD Up to 600nit Brightness, Color Volume 100% - 사이즈(W x H x D) : 304.9mm x 202.3mm x 13.9~14.9mm - Platform, OS : Intel 11세대 CPU, Intel Iris Xe Graphics, Windows 10 - 초고속 5G통신을 지원 (Sub-6) - 최신 무선랜 연결 802.11 ax (Wi-Fi6) - Double Camera : 키보드부 고화질 13M AF Camera와 전면부 1M Camera - 긴 배터리 사용시간 (20 hours battery life, based on MM14) - 제품에 내장된 S-Pen으로 창의적 영감 표현 가능 (Digitizer) - Tablet, Phone 연결성 강화 ・Link to Windows: Phone의 App을 PC에서 바로 실행 ・Samsung Notes: Phone-Tablet-PC간 노트 연동
			□ Galaxy Book Go (2021.04.) - 인치 : 14" FHD (1920 x 1080) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 323.9mm x 224.8mm x 14.9mm, 1,380 g - Platform : 2세대 스냅드래곤 7C, Windows 10

			- 언제 어디서나 인터넷이 가능한 LTE 지원 - 휴대에 최적화된 슬림 디자인 (14.9mm 두께) - Dolby Atmos 적용으로 풍성한 사운드 - 긴 배터리 사용시간 (up to 18 hours battery life) - Tablet, Phone 연결성 강화 ・Quick Share : Phone, Tablet의 파일을 손쉽게 공유 ・Second Screen : Tablet을 PC의 보조 모니터로 사용 ・Galaxy Book Smart Switch : 기존 노트북의 데이터를 간편하게 전송 ・SmartThings : 스마트 기기 연동
			□ Galaxy Book2 Pro 360 (2022.04.) - 인치 : 15.6"FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120% 13.3"FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120% - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 15.6" 354.85 x 227.97 x 11.9mm, 1.41kg 13.3" 302.5 x 202 x 11.5 mm, 1.04kg - Platform, OS : Intel 12세대 CPU (EVO Verified by Intel), Windows 11 - sAMOLED : Default 370nit/HDR 500nit, Color volume 120% - S Pen & Touchscreen support - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing 지원) - SSD : Gen4 SSD , Expendable SSD (M.2 2230) - WiFi 6E 지원 - Battery : 15.6" 68Wh (21hrs), 13.3"63Wh (21hrs) - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control 등 ・QR Sign-in : 폰에 사용중인 계정과 연동된 QR 인식으로 갤럭시북에 로그인 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원
			□ Galaxy Book2 Pro (2022.04.) - 인치 : 15.6"FHD AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120% 13.3"FHD AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120% - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 15.6" 355.4 x 225.8 x 11.7mm, 1.11kg 13.3" 304.4 x 199.8 x 11.2mm, 0.87kg - Platform, OS : Intel 12세대 CPU (EVO Verified by Intel), Windows 11 - AMOLED : Default 400nit/HDR 500nit, Color volume 120% - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing 지원) - SSD : Gen4 SSD, Expendable SSD (15.6"Only, M.2 2280) - WiFi 6E, 5G Sub6 (15.6"Only) 지원 - Battery : 15.6"68Wh (21hrs), 13.3"63Wh (21hrs) - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control 등 ・ QR Sign-in : 폰에 사용중인 계정과 연동된 QR 인식으로 갤럭시북에 로그인 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원
			□ Galaxy Book2 Go 5G (2022.12.) - 인치 : 14" IPS (1920 x 1080) - 사이즈(W x H x D) : 323.6mm x 224.8mm x 15.5mm - Platform : WoA 7C+ Gen3, Window 11 - 7C+ Gen3 적용 Mass WoA 제품 개발 (7C Gen2 대비 CPU 63%↑, GPU 102%↑) - Display 화질개선 (TN →IPS) - WiFi 6E, 5G Sub6 지원 - 보급형ENDC/eSIM지원 5G 모델 도입 - 45W 충전 지원

			- MIL-STD-810H 8개 항목 보증 ・Shock, High/Low Temperature, Thermal Shock, Dust, Vibration, Low pressure, Humidity
			□ Galaxy Book2 Pro 360(2023) (2022.12.) - 인치 : 13.3"FHD AMOLED (16:9), Touch Screen, Color Volume(DCI-P3) 100%, S Pen - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 13.3" 302.5 x 202.0 x 11.5mm, 1.04kg - Platform, OS : Qualcomm Snapdragon 8cx Gen3, Windows 11 Home - AMOLED : 13.3" FHD Super AMOLED (16:9), Color Volume(DCI-P3) 100%, up to 370nit, S Pen - Speakers : Stereo 2 x 4W (Smart AMP), AKG, Dolby Atmos - SSD : eUFS on board, 256GB - WiFi 6E (802.11ax) - Battery : 63Wh (Video Play 35hrs↑) - Galaxy ecosystem : Smart Switch, Samsung Account, Samsung Apps, Keyboard & Touch Pad Sharing between Galaxy devices - Security : 지문 인식, Secured Core PC (Level 3, H/W & F/W Protection) - AI : Noise Reduction, Video Call with Neural Engine
		갤럭시 워치 (~2022.08.)	□ Galaxy Watch3 (2020.08.) - Design : Real Watch 디자인의 Premium Smart Watch - 인치 : 1.4"(45mm), 1.2"(41mm) OLED Display(360 x 360) - 사이즈(W x H x D) : 45.0 x 46.2 x 11.1mm(45mm), 41.0 x 42.5 x 11.3mm(41mm) - Platform(H/W, S/W) : Exynos9110, Tizen 5.5 - Titanium 소재의 고급 seg. Portfolio 확대 - 헬스 관련 차별화 서비스 발굴 및 탑재 ・BP(혈압), ECG(심전도), Fall Detection(낙상 감지) 글로벌 상용화 등
			□ Galaxy Watch4 & Galaxy Watch4 Classic(2021.08.) - 인치: Watch4 : (44mm) 1.4" (450 x 450), (40mm) 1.2"(396 x 396) Watch4 Classic : (46mm) 1.4" (450 x 450), (42mm) 1.2"(396 x 396) - 사이즈(W x H x D) : Watch4 : (44mm) 44.4 x 43.3 x 9.8mm, (40mm) 40.4 x 39.3 x 9.8mm Watch4 Classic : (46mm) 45.5 x 45.5 x 11.0mm, (42mm) 41.5 x 41.5 x 11.2mm - Platform(H/W, S/W) : AP Exynos W920(5나노 64비트 Dual-Core), Wear OS Powered By Samsung, One UI Watch 버전 3.0 - Memory : 1.5GB RAM + 16GB ROM 탑재하여 성능 개선 및 사용자 가용량 확대 제공 - 330 ppi Display 적용을 통한 가독성 개선 - 체성분 측정 기능 최초 탑재 및 Health 사용성 강화로 차별화 추진 - 산소포화도, 코골이 등 수면 상태 모니터링 강화 - Wear OS 기반 App Eco 확장 및 Phone 연동 경험 강화 ・Play store/구글맵/YT Music 등 구글 주요 서비스 제공 ・최적화된 Fitness 전용 앱 및 다양한 서비스 앱 지원
			□ Galaxy Watch5 & Galaxy Watch5 Pro(2022.08.) - 인치 : Watch5 Pro (46mm) : 34.6mm AMOLED (450 x 450) 330PPI Watch5 (44mm) : 34.6mm AMOLED (450 x 450) 330PPI Watch5 (40mm) : 30.4mm AMOLED (396 x 396) 330PPI - 사이즈(W x H x D) & 무게 : Watch5 Pro (46mm) : 45.4 x 45.4 x 10.5 mm, 46.5g Watch5 (44mm) : 44.4 x 43.3 x 9.8 mm, 33.5g Watch5 (40mm) : 40.4 x 39.3 x 9.8 mm, 28.7g - Platform(H/W, S/W) : Exynos W920, Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 3.5) - 사파이어 크리스탈 디스플레이 적용한 시그니처 원형 디자인 - 진화된 바이오액티브 센서 탑재로 더 강력해진 통합 건강 관리 기능

			・체성분, 심박, 혈압, 심전도 정확도 개선 및 수면 관리 기능 강화 - Wear OS 기반의 'One UI Watch 4.5' 탑재하여 다양한 구글 모바일 서비스와 앱 활용 - 프리미엄 소재 티타늄 바디, 향상된 GPS 성능으로 아웃도어 스포츠에 최적화 (Watch5 Pro) ・기능 향상과 내구성 제고하여 하이킹/싸이클링과 같은 아웃도어 스포츠 활용도 제고 ・마그네틱 D-버클 스포츠 밴드 제공하여 내구성, 편의성 및 스타일리시한 모습 연출 ・경로운동(Route Workout) 및 GPX(GPS Exchange Format) 파일 이용한 운동경로 저장 및 공유 ・트랙백(Track back) 기능 통해 지나왔던 길찾기 제공 ・큰 용량 배터리(590mAh) 적용으로 장시간 아웃도어 활동 가능
		갤럭시 버즈 (~2022.08.)	□ Galaxy Buds+ (2020.01.) - Design : Canal형 TWS(True Wireless Stereo) - Platform(H/W, S/W) : MCU(BCM43015), OS(RTOS), BT 5.0 - Battery : (Earbuds) 85mAh x 2, (Cradle) 270mAh - 2 Way 스피커(Woofer, Tweeter) 적용을 통한 중저음 강화 및 음질 최고 성능 확보 - 외부 Beamforming Mic(2개), 내부 Mic(1개) 적용으로 통화 품질 최적화 - Grip 센서 추가로 착용감지 오동작 개선 - 업그레이드된 배터리 탑재를 통해 동급 최고의 사용시간 확보: 스트리밍 시 22H(Earbuds 11H, Cradle 11H)
			□ Galaxy Buds Live (2020.08.) - Design : 혁신적 Design과 고품질 Sound 를 구현한 오픈형 TWS - 사이즈(W x H x D) : (Earbuds) 16.5 x 27.3 x 14.9mm, (Cradle) 50.0 x 50.2 x 27.8mm - Platform(H/W, S/W) : BCM43015, RTOS - 귀 형상에 최적화된 인체 공학적 설계로 편안하고 부드러운 착용감 제공 - 귀가 먹먹하지 않는 오픈형ANC 기능 탑재로 저소음 모드 지원 - 12mm 대형 스피커와 Bass Duct로 풍부하고 입체감 있는 라이브 사운드 제공 - 3개의 마이크와 가속도 센서(보이스 픽업 유닛) 탑재로 우수한 통화품질 제공
			□ Galaxy Buds Pro (2021.01.) - Design : Intelligent ANC 기능을 갖춘 커널 타입 Premium TWS - 사이즈(W x H x D) : (Earbuds) 20.5 x 19.5 x 20.8mm, (Cradle) 50.0 x 50.2 x 27.8mm - Platform(H/W, S/W) : BCM43015, RTOS - 2Way(Woofer + Tweeter) 11mm 스피커 탑재를 통한 사운드 품질 향상 ・3개의 마이크와 가속도 센서 (보이스 픽업 유닛) 탑재로 우수한 통화품질 제공 ・커널 타입 및 Intelligent ANC 기능 탑재 및 대화감지를 통해 주변소리 듣기로 자동 전환 ・영화관에 온 듯한 공간감을 느낄 수 있는 3D Audio 기능 제공 - IPx7 등급 방수 지원
			□ Galaxy Buds 2 (2021.08.) - 기본기능 강화와 ANC기능 추가로 Buds Mass모델의 경쟁력 강화 - 사이즈(W x H x D) : (Earbuds) 17.0 x 20.9 x 21.1 mm (Cradle) 50.0 x 50.2 x 27.8 mm - BES2500 ZP-83 (BT + Codec + Flash) 저전력 신규 솔루션 ・ANC 기능 제공 ・음악 재생 총 사용시간 29시간 확보 (Streaming, ANC OFF 기준) - Touch + BT Antenna FPCB 일체형 적용하여 RF 방사 성능 최적화 - Canal형 무선 이어폰 Audio 성능 고도화 ・DNN 활용 통화 잡음 제거 성능 극대화 알고리즘 적용(DNN + 3-Mic +VPU) * DNN : Deep Neural Network , VPU : Voice Pickup Unit

			・자연스러운 주변소리듣기 모드 전환 지연 속도 개선(3.2ms→0.65ms) ・Woofer 진동판 신소재 적용을 통한 저역 강화 ・무결점 Mic 단품 도입으로 Mic 노이즈 차단 강화 ・통기홀 밀도 변경 및 FeedBack Mic 관로 개선을 통한 ANC 성능 및 음질 개선 ・Mic 챔버 공간 극대화 및 위치 최적화를 통한 Wind Noise 개선
			□ Galaxy Buds 2 Pro (2022.08.) - 24bit 고품질 Hi-Fi 사운드와 편안한 착용감을 제공하는 커널 타입Premium TWS - 사이즈(W x H x D) : (Earbuds) 21.6mm x 19.9mm x 18.7mm (Cradle) 50.2mm x 50.1mm x 27.7mm - Platform(H/W, S/W) : BES2700YP 1Chip솔루션, RTOS ・당사 Buds 최초24bit/48kHz Hi-Fi기술 적용하여 원본 음질 손실을 최소화한 고품질 사운드 경험All High-SNR MIC, 소음 제거 솔루션과 대화 감지 기술을 적용한 Intelligence ANC ・멀티 채널 오디오와 향상된 헤드 트래킹 기술을 통해 현장감 있는360 Audio 청취 경험 강화 ・개선된VPU와 개인화Beamforming 기술을 통해 또렷하고 향상된 통화 음질 제공 - 인체공학적 디자인을 통해 편안하고 안정감 있는 착용감 제공 ・전작 대비 15% 작아진 기기 사이즈와 개선된 통기홀 구조를 적용하여 착용감 개선 - Galaxy Device간 쉬운 연결을 통한 사용 경험 강화 ・오토 스위치 기능 제공을 폰, 태블릿, 워치에서 TV로 확장하고 쉽고 빠르게 기기 전환
	네트워크	RAN S/W Package (2019.04. ~2021.06.)	□ SVR18.3 5G S/W Package (2019.04.) - 국내 5G NR 세계 최초 상용화를 위한 S/W Package ・서울/수도권에서 LTE 상용망 연동을 통해 NSA 기반 상용화 ・5G 기지국 지원(3.5GHz, 28GHz, 39GHz 5G Massive MIMO) □ SVR21B NR vDU SW Package (2021.06.) - TDD 기반 C-Band vDU ・H/W 변경없이 유연한 기지국Upgrade 및 자원 할당 가능 * vDU(virtual DU): 5G 기지국 기능을 상용 서버 기반의 S/W 개발로 구현
		Core S/W Package (2020.03.)	□ SVR19B 5G Core S/W Package (2020.03.) - Containerized 기반 5G Core Network Function 개발 ・서버(Host OS)의 자원을 필요한 만큼 유동성 있게 할당하여 효율적이고 빠른 서비스 배포 및 유지보수 비용 절감 가능
		기지국 (2019.09. ~2022.11.)	□ NR DU 개발 (2019.09.) - 신규 Dual CPU Based-Main Card, 5G 최초 SOC 모뎀 적용 - 단일 HW 형상으로 LTE, NR Above/Below제품과 혼용실장 - 고용량, 저전력(Power Saving 포함) 및 가상화/비가상화 지원 □ 26GHz NR RFIC Chip 개발 (2020.02.) - 당사 1세대(28GHz/39GHz) 이후 2세대 RFIC Chip 개발 (1세대 대비 전력소모 개선, 양산성 향상 등) □ FSU10 개발 (2020.05.) - vRAN 사업 지원을 위한 FSU(Fronthaul Switch Unit) 개발 - LTE/NR(Below 6GHz) Spectrum Sharing 역할 ・사업자의 LTE DU와 NR vRAN을 Spectrum Sharing을 통해 한 개의 RU에서 LTE/NR 모두 정합 가능 □ NR Indoor AU 개발 (2020.08.) - 당사 5G In-Building Solution AU 첫 제품 - Small Form-Factor로 저전력, 실내(벽면, 기둥, 천장) 설치 가능 □ NR C-Band MMU(Massive MIMO Unit) 개발(3.7GHz 64T64R 200W) (2020.12.) - 미주 C-Band 대역 TDD 기반 MMU 첫 제품

			- 광대역(순시 대역폭 280MHz) 지원(C-Band 전 사업자 및 전국 Cover가능) □ MMU Beam Forming SOC 개발 (2021.02.) - MMU 보드 내 Beam Forming FPGA가 수행하는 기능을 SOC로 구현 - 기존 소모 전력의30% 수준으로 감축(최대 소모전력40W 이하) □ 미주 ORAN* RU 5종 개발 (2021.09.) - DU-RU간 표준 interface를 정의하여, DU에서 RU 벤더에 상관없이 연동가능 - AWS/PCS, 700/850 4T4R 40W 2종, 320W 2종, C-Band 8T8R 320W □ 북미향 AWS/PCS Dual Band 16T16R FDD MMU (2021.10.) - 당사 최초16T16R FDD Dual Band MMU 상용 제품(자체 개발 Chip 적용) □ 국내 3.5GHz NR 32T32R TDD MMU (2022.02.) - 당사 최초 Mechanical PSA(Phase Shift Antenna) 적용 * 안테나 기울기(Tilt 0~12°)를 MMU 내부에서 Motor로 자동 제어 □ 고성능 RFIC + DFE 통합 Chip 개발 (2022.04) * RFIC(Radio Frequency Integrated Circuit): 무선통신에 적합한 고주파 집적 회로 * DFE(Digital Front End): 통신을 위한 Digital 신호처리의 마지막 단계 □ Dish향 FDD RU 2종(Dual Band/Tri Band RU) (2022.09) - ORAN 표준을 준수하고 여러 주파수 대역을 동시에 지원하는 5G FDD RU 제품 개발 * RU 지원 주파수 : n71(600MHz), n29(700MHz), n66(AWS: 1.7GHz/2.1GHz), n70(AWS: 1.7GHz/1.9GHz) □ Gen.3 Dual Band NR 2T2R AU (2022.10.) - 세계 최초 Dual Band(28GHz+39GHz) AU 개발 - 기존 2세대 AU 대비 동일 사이즈에 출력 2배 향상, 용량 2배 확대로 제품 성능 개선 □ 국내 3.5GHz NR 64T64R MMU (2022.11.) - 국내向 최초 상용 64T64R Massive MIMO MMU 개발 - 기존 국내向 32T32R MMU(구형) 대비 Antenna Element 2배 증가, 출력 2.7배 증가
DS 부문	메모리	모바일용 DRAM (2019.07. ~2022.10.)	□ 세계 최고 속도・최대 용량 모바일용 2세대 10나노급(1y) 12Gb LPDDR5 DRAM 양산 - 속도, 용량, 절전 특성 동시 강화 차세대 모바일 솔루션 제공 - 1.3배 속도(5,500Mbps), 소비전력 30% 절감 5G 스마트폰 출시 기여 - 12Gb LPDDR5 기반 라인업(6GB, 12GB) 최초 제공 □ 역대 최고 속도・최대 용량을 구현한 초격차 '16GB LPDDR5 모바일 DRAM' 세계 최초 양산 - 기존 8GB LPDDR4X 대비 성능 약 30% 향상, 용량 2배, 소비전력 20% 감소 - 스마트폰으로도 게이밍 PC 이상의 게임 퍼포먼스(화질・타격감) 가능 □ 업계 최초 LPDDR5X D램 개발 - 기존 제품 대비 속도 30% 이상, 소비전력 효율 약 20% 개선 - 업계 최선단 14나노 기반, 단일 패키지 용량 64GB까지 확대 가능하여 모바일 외, 서버/Automotive 등 고성능 저전력 메모리 적용 분야 확대 - 퀄컴 스냅드래곤 모바일 플랫폼에 8GB LPDDR5X D램 패키지 탑재해 업계 최고 동작 속도(8.5Gbps) 검증
		서버용 DRAM (2019.08. ~2022.12.)	□ 세계 최대 용량 서버용 1세대 10나노급(1x) 256GB 3DS DDR4 DRAM 양산 - 초고성능・초고용량 256GB DRAM 세계 최초 양산 - 128GB 대비 용량 2배・소비전력 효율 30% 향상 □ 세계 최고 서버용 3세대 10나노급(1z) 나노기반 8Gb DDR4 DRAM 개발 - DDR5・LPDDR5 양산 위한 초고속・초절전 솔루션 확보 - 기존 2세대(1y나노) DRAM 대비 20% 이상 효율 향상 - 평택 라인 1z나노DRAM 라인업 9월 양산으로 차세대 비중 확대 □ 업계 최초 HKMG 공정 적용 고용량 DDR5 메모리 개발 - High-K Metal Gate, 8단 TSV 적용으로 512GB DDR5 모듈 구현 - 기존 공정 대비 약 13% 전력소모 낮추고, 성능은 2배 이상 향상

			- 차세대 컴퓨팅, 슈퍼컴퓨터, 대용량 데이터센터 등에 적용 예정 □ 업계 최선단 12나노급 D램 개발 - 업계 최초로 '12나노급 16Gb DDR5 D램' 개발, 차세대 컴퓨팅 서비스에 최적화된 '고성능・저전력' 특성 확보 - 기존 대비 소비전력 약 23% 감소, 생산성 약 20% 향상 - 2023년 양산 돌입으로 고객의 차세대 시스템에 최적의 메모리 솔루션 제공, 데이터센터, 인공지능, 차세대 컴퓨팅 등 응용처 확산 기대
		그래픽 DRAM (2022.07. ~2022.11.)	□ 업계 최고 속도 GDDR6 D램 개발 - 3세대 10나노급(1z) 공정 적용으로 업계 최초 24Gbps 구현 - 기존 제품 대비 성능 30% 이상 높여 초당 최대 1.1TB 데이터 처리, 1.1V 동작전압 지원, 전력 효율 20% 높여 다양한 고객 요구 충족 - 국제 반도체 표준화 기구 JEDEC의 표준규격 준수해 호환성 확보 - 차세대 그래픽카드, 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 응용처 확대 □ 첨단 패키징 기술을 활용한 그래픽 메모리 GDDR6W 개발 - GDDR6W는 새로운 메모리 칩 다이(die)의 개발 없이 적층, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer level Package) 기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6와 동일한 크기의 패키지로 성능(대역폭) 2배와 용량 2배를 구현
		HBM DRAM (2019.10. ~2022.10.)	□ 세계 최대 HBM DRAM 용량 12단 3DS TSV PKG 기술 개발 - 수퍼컴용 최고성능・최대용량 12GB HBM DRAM 업계 최초 개발 - 8GB 패키지로 용량 1.5배・시스템 설계 편의성 향상 - 패키지 기술 한계 돌파로 차세대 HPC DRAM 시장 선도 역량 강화 - 고객 수요에 맞춰 업계 최대 24GB HBM 양산 예정 □ AI・차세대 슈퍼컴퓨터용 초고속 DRAM 세계최초 출시 (16GB HBM2E 'Flashbolt') - 10나노급(1y) 16기가비트(Gb) DRAM 8개 쌓아 최대용량(16GB) 구현 - 1초에 3.2기가비트 속도로 Full HD 영화 82편(410기가바이트) 전송 가능 - 2세대 HBM2 및 3세대 HBM2E 동시 공급해 시장 확대 지속 주도 □ 세계 최초로 AI 엔진을 탑재한 인공지능 HBM-PIM 개발 - 기존 HBM2 대비 성능 2배 이상 향상, 시스템 에너지 약 70% 이상 감소 - 반도체 분야 최고 권위 학회 ISSCC에서 논문 공개('21.2월) - 기존 메모리 인터페이스 사용으로 별도 시스템 변경없이 적용 가능 - 데이터센터, AI 고객들과 PIM 표준화, 에코 시스템 구축 협력 □ 인공지능 탑재 메모리 제품군 확대 (HBM-PIM 성능 평가결과 및 AXDIMM/LPDDR5-PIM 개발 - 지난 2월 개발한 HBM-PIM 실제 시스템 적용 사례 공개 (자일링스 AI 가속시스템에 탑재시 성능 2.5배, 에너지사용 60% 이상 감소) - D램 모듈에 AI 기능 탑재한 AXDIMM은 기존 대비 성능 2배, 에너지사용 40% 감소 - 모바일 D램과 PIM 기술을 결합한 LPDDR5-PIM 공개 □ HBM-PIM과 GPU를 함께 탑재한 AI용 가속기 구현 - AMD의 GPU 가속기 카드에 HBM-PIM 메모리를 탑재하여 HBM-PIM Cluster 구현 - HBM-PIM을 활용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 감소 - HBM-PIM 탑재한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 통합된 소프트웨어 환경에서 PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대
		NAND (2022.11.)	□ '8세대 V낸드' 양산 - 세계 최고 용량의 '1Tb(테라비트) 8세대 V낸드' 양산 - 웨이퍼당 비트 집적도 대폭 향상, 업계 최고 수준 비트 밀도 확보

			- 차세대 인터페이스 적용, 2.4Gbps 전송 속도 구현으로 기존대비 성능 1.2배 향상 - 차세대 서버시장 고용량화 주도, 고신뢰성 요구하는 전장 시장까지 사업 영역 확대
		eStorage (2019.02. ~2022.05.)	□ 세계 최초 차세대 스마트폰 메모리 eUFS 3.0 양산 - 5세대(9x단) 셀 적층 512Gb 3비트 V낸드 업계 최초 탑재 - eUFS 2.0 대비 2배 빠른 읽기・쓰기 속도 구현 - 초고해상도 차세대 모바일 시장 선점 고성장 주도 □ 업계 유일 1200MB/s 쓰기 속도 구현한 초격차 '1TB eUFS 2.1' 본격 양산 - 기존 512GB eUFS 3.0(연속 쓰기 속도 410MB/s) 대비 성능 3배 향상 - 스마트폰 메모리 저장 속도(1200MB/s)가 PC(SSD 540MB/s)보다 2배 빨라짐 □ 업계 최고 성능 UFS 4.0 개발 - UFS 3.1 제품 대비 읽기/쓰기 속도 약 2배로 개선 - 동일한 데이터 처리시, 전력효율 약 46% 향상되어 장시간 사용 가능 - 최신 보안 기술 적용하여 고객들의 중요 데이터를 읽고 저장하는 성능 개선 - 스마트폰, Automotive 및VR/AR 등 컨슈머 기기로의 확대 예상
		서버용 SSD (2019.08. ~2022.07.)	□ 세계 최고 속도・최대 용량 서버용 5세대(9x단) V낸드 기반 30.72TB NVMe SSD 양산 - 속도, 용량, 경제성 강화 차세대 SSD 솔루션 확보 - 기존 대비 2.2배 속도 8GB/s PCIe Gen4 SSD 출시 - 3대 SW(Never Die SSD, FIP, ML) 솔루션 유일 제공 □ 데이터센터 전용 고성능 OCP SSD 양산 - 6세대 V낸드로는 업계 최초로 OCP 규격의 SSD 양산 - 데이터센터 업계가 요구하는 성능, 전력효율, 신뢰성, 보안 모두 만족 - 업계 최고 전력효율 특성으로 비용 절감 및 탄소 저감 효과에 기여 □ 업계 최고 성능 SAS 24Gbps 서버용 SSD 양산 - 이전 세대 SSD 대비 약 2배 향상된 속도 지원 - 6세대 V낸드 기반으로 800GB 부터 30.72TB까지 고용량 제공 - 전력효율 약40% 향상되어 서버 운영 비용 절감 및 탄소 저감 효과 기대 □ 차세대 기업 서버용 ZNS SSD 업계 최초 양산 - 데이터 성격에 따라 구역(Zone)별로 분류하여 저장하는 ZNS 기술 적용 - 기존 SSD 대비 수명연장 및 SSD 용량 최대 활용 - AI, 빅데이터, IOT등 차세대 서버/스토리지 시스템 효율 제고에 기여 및 다양한 오픈소스 프로젝트 활동으로 ZNS SSD 저변 확대 □ PCIe 5.0 기반 고성능 SSD PM1743 개발 - PCIe 4.0 기반 SSD 대비 읽기/쓰기 속도 약 2배 및 전력효율 약 30% 개선 - 듀얼포트 지원 및 최신 보안 기술 적용으로 서버 운영 안전성 보장 □ 연산기능 강화한 '2세대 스마트SSD' 개발 - 연산 성능 2배 향상, 처리시간 50% 이상, 에너지 70%, CPU 사용 97% - SSD 내에서 데이터 처리, 시스템 성능과 에너지 효율 동시에 향상 - 데이터베이스, 비디오 트랜스코딩 등 다양한 시장 요구에 적극 대응 - 컴퓨테이셔널 스토리지 표준화 주도, 차세대 스토리지 제품 개발 확대
		브랜드 SSD (2020.01. ~2022.08.)	□ 업계 최고수준 성능의 프리미엄 포터블 SSD 'T7 Touch' 출시 - 세계 최고 성능의 5세대 512Gb V낸드와 초고속 인터페이스 NVMe 컨트롤러를 탑재 - 외장형 HDD(110MB/s) 대비 최대 9.5배, 전작(삼성전자 포터블 SSD 'T5') 대비 약 2배 빨라진 1,050MB/s・1,000MB/s의 읽기・쓰기 속도를 구현 □ 고용량 4비트 SSD '870 QVO' 글로벌 출시 - 업계 최대 용량 8TB 모델 포함, 1/2/4TB 등 SATA SSD 4종 출시 - SATA 인터페이스 한계치에 근접한 빠른 데이터 처리 속도로 고용량・고성능의 컴퓨팅 환경을 원하는 소비자에게 최적의 솔루션 제공

			- 속도와 용량, 합리적인 가격으로 전세계40개국에 순차 출시 □ PCIe Gen4 적용한 업계 최고 성능 SSD '980 PRO' 글로벌 출시 - 업계 최고 속도 소비자용 SSD로 초고해상도 구현 - 8K・4K급 영상편집, 고사양 게임 등에 활용되는 전문가용 PC・워크스테이션 시장 지속 주도 - 보증기간 5년(업계 최고 수준) □ 소비자용 SATA SSD 870 EVO 글로벌 출시 - 최신 V낸드, 컨트롤러 탑재, 인텔리전트 터보라이트 기술 적용 - 업계 최고 수준 내구성 보유, 지속성능 30% 이상 향상 - 250GB~4TB까지 5개 모델로, 한국・미국・독일・중국 등 40여개국 순차 출시 □ 성능과 경제성을 모두 만족한 고성능 NVMe SSD 980 출시 - 6세대 V낸드 탑재, SATA SSD 대비 최대 6배 빠른 성능 제공 - 비용을 고려한 DRAMless 설계와 컨트롤러, 펌웨어 최적화 기술 적용 - 하이엔드 제품에 적용되는 열 제어 기능 탑재 - 970 EVO 대비 전력효율 56% 향상, 소비자들 '착한 소비' 가능 □ 성능과 내구성 모두 갖춘 전문가용 포터블 SSD 'T7 실드(Shield)' 출시 - 방수, 방진, 최대 3미터 낙하 보호 설계 - 고화질 영상 녹화, 편집 등의 성능 저하 없이 안정적으로 데이터 전송 □ 게이밍에 최적화된 고성능 SSD '990 PRO' 공개 - 최신 V낸드 기술과 독자 컨트롤러로 업계 최고 수준 성능 구현 - 전작보다 속도 최대 55%, 전력 효율 최대 50% 향상 - 고성능 그래픽 게임, 4K/8K 고화질 비디오 등 초고속 데이터 처리 작업이 요구되는 환경에 최고 성능 제공
		EUV (2020.03. ~2021.10.)	□ 1세대 10나노급(D1x) DRAM 모듈 1백만개 공급 - EUV DRAM 양산으로 업계 유일 EUV DRAM 양산체제 구축 - 10나노급 공정 미세화 기술 및 양산성 확보로 차세대 DRAM 적기 출시 가능 - 4세대 10나노급 DRAM부터 EUV전면 적용 후 5세대, 6세대도 확대 적용 □ 업계 최선단 14나노 EUV DDR5 D램 양산 - EUV 멀티레이어 적용 및 업계 최고 웨이퍼 집적도 구현으로 생산성 약 20% 향상 - DDR4 대비 속도 2배 및 이전 공정 대비 소비전력 약 20% 개선
		CXL (2021.05. ~2022.10.)	□ 업계 최초 CXL 기반 DRAM 메모리 기술 개발 - 대용량 데이터센터가 요구하는 차세대 메모리 솔루션으로 DRAM 모듈의 물리적 한계 극복, 용량 대역폭의 획기적인 확장 가능 - CXL 컨트롤러를 통해 인터페이스 컨버팅, 에러 관리 등 지원 - 데이터센터, 서버, 칩셋 업체들과 협력으로 CXL DRAM 메모리에 최적화된 컨트롤러, 소프트웨어 기술 개발 □ 업계 최초 CXL 메모리 오픈소스 소프트웨어 솔루션 개발 - 메인 메모리와 CXL 메모리가 최적으로 동작할 수 있도록 지원하여 시스템 메모리의 성능/용량 확장 가능 □ 업계 최초 고용량 512GB CXL D램 개발 - CXL D램 용량 4배 향상, 서버 한 대당 수십 테라바이트 이상 확장 가능 - CXL 전용 컨트롤러 탑재, 데이터 지연 시간1/5로 감소 □ 고용량 AI 모델을 위한 CXL 기반의 PNM 솔루션 개발 - PNM(Processing-near-Memory)은 연산기능을 메모리 옆에 위치시켜 CPU-메모리간 발생하는 병목현상을 줄이고 시스템 성능 개선 - 높은 메모리 대역폭을 요구하는 추천 시스템이나 인-메모리 데이터베이스 등의 응용에서 약2배 이상 성능이 향상
		복합칩 (2021.06.)	□ 업계 최고 성능의 uMCP5(LPDDR5 + UFS3.1) 멀티칩 패키지 양산 - 기존 LPDDR4X 대비 속도 1.5배, UFS2.2 대비 2배 향상 - 중저가 5G 스마트폰까지 탑재하여 5G 대중화 견인
		브랜드 Card	□ 성능·안정성을 강화한 마이크로 SD카드 신제품 출시

		(2021.09. ~2022.05.)	- 'PRO Plus'는 이전세대 대비 읽기 속도 약 1.6배, 쓰기 속도 약 1.3배 - 'EVO Plus'는 이전세대 대비 읽기 속도 약 1.3배 - 강화된 성능과 외부 충격에 강한 디자인 설계로 일반 소비자 뿐만 아니라 4K UHD 영상과 같은 고사양의 컨텐츠를 제작, 고객까지 만족 기대 □ 성능과 내구성을 강화한 메모리카드 'PRO Endurance' 출시 - 서버급 고품질 낸드 채용, 16년 연속 녹화 가능한 내구성 - CCTV, 블랙박스 등 고해상도(4K, 풀HD) 영상 녹화장치에 최적화 - 극한 환경에서도 안정적 녹화 성능을 유지, 6-proof 보호 적용 - 클래스 10, UHS 클래스 U3, 비디오 스피드 클래스 V30 속도 지원, 풀HD·4K 고해상도 영상 연속 촬영
		Automotive (2021.12.)	□ Automotive향 메모리 토탈 솔루션 양산 - IVI향 256GB SSD, 2GB DDR4/GDDR6 및 AD향 2GB GDDR6, 128GB UFS - 서버급에 탑재되는 고성능 SSD와 그래픽D램 공급 및 차량용 반도체 시장에서 요구하는 높은 안전성 확보(영하 40℃~영상 105℃ 동작보증구간 지원)
	System LSI	이미지센서 (2019.01. ~2022.06.)	□ 초소형 픽셀 적용 ISOCELL Slim 센서(3T2, 0.8um/20Mp) - 1/3.4" 센서 중 최고 화소(20Mp)로 베젤리스 디스플레이에 최적화된 고화소 구현 - 전면 테트라셀 기술 적용으로 저조도 촬영 성능 우수, 후면 고배율 사용시 모듈 사이즈 감소, 화질 개선 □ 초고화소 ISOCELL Bright 센서(GW1, 0.8um/64Mp) - DCG 구조 적용으로 Dynamic Range 증가 - 슈퍼 PD 기술로 Auto Focus 성능 극대화 및 초당 480 프레임 Full-HD 슬로우 모션 기능 제공 - 실시간 HDR 기능 지원으로 풍부한 색감 구현 □ 고화소 ISOCELL Bright 센서(GM2, 0.8um/48Mp) - 슈퍼 PD 기술로 Auto Focus 성능 극대화 및 초당 240 프레임 Full-HD 슬로우 모션 기능 제공 □ 세계 최초 1억8백만 화소 ISOCELL Bright 센서(HMX, 0.8um/108Mp) - AI-ISO 적용하여 S/W로 광량 조절, 색재현력 향상 - 최대 6K 해상도로 초당 30 프레임 촬영 가능 - 아이소셀 플러스, 테트라셀 기술로 감도 개선 □ 세계 최초 최소 픽셀 적용 ISOCELL Slim 센서(GH1, 0.7um/43.7Mp) - 모듈의 크기와 두께 소형화 가능하여 Full-Screen Display 세트 탑재 용이 - 고해상도 녹화 지원 및 화각 손실 최소화 - 아이소셀 플러스, 테트라셀 기술로 감도 개선 □ 업계 최초 '노나셀' 기술로 감도 2배 높인 차세대 1억8백만 화소 ISOCELL Bright센서(HM1, 0.8um/108Mp) - 강화된 줌 기능으로 피사체 3배 확대해도 화질 저하 없이 프리뷰 가능 - 스마트 ISO, 실시간 HDR, 전자식 이미지 흔들림 보정 등 최신 기술 적용 □ 듀얼 픽셀 및 테트라셀 적용 센서(GN1, 1.2um/50Mp) - 한 픽셀당 2개 포토다이오드 탑재하는 듀얼 픽셀 기술로 1억 화소 수준 이미지도 출력 가능 - 어두운 곳에서 감도 4배 향상되는 테트라셀 적용으로 밝고 섬세한 이미지 촬영 □ 업계 최초 0.7um 픽셀 적용 이미지센서 라인업 구축(HM2, GW3, GM5, JD1) - '아이소셀 2.0' 등 첨단 기술 적용해 초소형, 고화질 기술 리더십 선도 - (HM2) 0.7um픽셀 최초 1억8백만 화소 - (GW3) 4K 60프레임 동영상 촬영 가능한 6천4백만 화소 - (GM5) 초광각과 폴디드줌 지원하는 4천8백만 화소 - (JD1) 베젤리스 디자인 구현에 최적화된 초소형 3천2백만 화소 □ 1억8백만화소 프리미엄 이미지센서 '아이소셀 HM3' 출시 (HM3, 0.8um/108Mp) - 0.8㎛ 크기 작은 픽셀 1억 8백만개를 '1/1.33인치'에 집적 - '스마트 ISO 프로'로 잔상 최소화, 밝고 선명한 이미지 촬영 가능 - 자동초점 최적 렌즈 탑재 '슈퍼 PD 플러스' 적용… 초점 검출 능력 50% 향상 - 설계 최적화로 프리뷰 모드 동작 전력 기존 대비 약 6% 절감

			□ 사람 눈과 더욱 가까워진 이미지센서 '아이소셀 GN2' 출시 (GN2, 1.4um/50Mp) - 업계 최초, 픽셀을 대각선 분할하는 '듀얼 픽셀 프로' 적용 - 1.4um 픽셀 구조, 보다 밝고 선명한 이미지 촬영 - 스태거드 HDR, 기존 제품 대비 동작 전력 약 24% 감소 □ 업계 최초 0.64um 픽셀 적용 '아이소셀 JN1' 출시(JN1, 0.64um/50Mp) - 초소형 픽셀 크기 양산, 고화소 모바일 카메라 슬림 디자인 적용 - 어두운 곳에서 촬영 감도 높이는 최첨단 이미지센서 기술 적용 - 카메라 렌즈 모듈사 협력, 1/2.8" 제품과 호환 가능한 생태계 구축 □ 차량용 이미지센서 '아이소셀 오토 4AC' 본격 출시(4AC, 3.0um/1.2Mp) - 서라운드 뷰 모니터, 후방 카메라에 적용 예정 - 극한 환경에서도 운전자 보조, 사각지대를 최소화하는 안전 솔루션 □ 초격차 모바일 이미지센서 신기술 공개(HP1, 0.64um/200Mp 및 GN5, 1.0um/50Mp) - 업계 최초 '2억화소' 벽을 넘어선 '아이소셀 HP1' - 업계 최소 크기의 듀얼 픽셀 이미지셀'아이소셀 GN5' □ 업계 최소 픽셀 크기의 2억화소 이미지센서 공개(HP3, 0.56um/200Mp) - 기존 HP1(0.64um)보다 12% 작아진 픽셀 크기로 카메라 모듈 면적 최대 20% 감소 - '슈퍼 QPD' 기술로 2억개 픽셀 모두 자동 초점 기능 구현 - '테트라 스퀘어드 픽셀' 기술 활용, 저조도 환경에서도 선명한 화질
		엑시노스 (2019.01. ~2022.03.)	□ 세계최초 5G 스마트폰용 모뎀 솔루션(엑시노스 모뎀 5100, 엑시노스 RF 5500, 엑시노스 SM 5800) - 데이터 통신 속도 1.7배 증가 (LTE대비) - 신규 RF・SM 탑재, 송수신 전력 효율 개선 □ 업계 최고 수준의 7나노 5G 모뎀(엑시노스 5123) - 6GHz 이하 5G 환경에서 기존대비 최고 2배 속도 향상 - 4G 네트워크에서 최고속도 3.0Gbps 달성 - 글로벌 Sub-6GHz/mmWave 대역 지원 □ 차량용 인포테인먼트용 SOC(엑시노스 오토 V9) - 옥타코어 CPU활용하여 디스플레이 6개 및 카메라 12개 동시 제어 - GPU 3개 탑재로 계기판・CID・HUD 개별 지원 - NPU 탑재로 디지털 음성・얼굴・동작 인식 - ASIL-B 기능안전 지원으로 안정성 강화 □ 저전력・보안강화 단거리 IoT 전용 SOC(엑시노스 i T100) - 프로세서・메모리・통신기능 패키지화 □ Sub-6GHz 대역 지원 5G 모뎀 + AP 통합 원칩(엑시노스 980) - EN-DC, Wi-Fi 6 등 최신 통신 기능 지원 - 전세대 및 프리미엄 제품 대비 NPU 성능 향상 □ 5세대 CPU 및 프리미엄 GPU 탑재로 성능 강화(엑시노스 990) - AI 연산 성능 10TOPS 이상 확보로 이미지 분석 및 안면 인식 기능 강화 - 최신 LPDDR5 DRAM 및 50MP↑ 고해상도 카메라 지원 □ 5G 통합 프리미엄 모바일AP '엑시노스 2100' 출시(엑시노스 2100) - 최첨단 5나노 EUV 공정・최신 CPU/GPU 적용, 성능 대폭 향상 - 설계 최적화로 전작 대비 성능 CPU 30%, GPU 40% 이상 개선 - 온디바이스 AI 성능 강화, 초당 26조번 인공지능(AI) 연산 - 소비전력 최대 20% 감소, 자체 전력 관리 솔루션 'AMIGO'도 적용 - 초고주파 대역 5G 통신 지원, 최대 6개 이미지센서 처리 등 □ EUV(Extreme UltraViolet, 극자외선) 공정 기반 웨어러블용 '엑시노스 W920' 출시 - 최신 5나노 EUV 공정 및 설계 기술 적용으로 성능과 전력효율 향상 - 최첨단 패키지 기술을 적용, 웨어러블용 초소형 패키지로 구현

			- 최신 ARM 코어 적용, 전세대(Exynos 9110) 대비 CPU 성능 20%, 그래픽 성능 10배 향상 - 저전력 디스플레이용 코어 탑재, AOD(Always On Display) 모드에서 프로세서 전력소모 97% 개선 □ 업계 최초 5G 통신 서비스 제공하는 차량용 통신칩 '엑시노스 오토 T5123' 출시 - 초당 5.1Gb 다운로드 지원, 주행 중에도 끊김없이 고용량・고화질 콘텐츠 이용 가능 - 최신 5G 기반 멀티모드 통신칩 내장돼 5G 단독망 및 LTE 혼합망 모두 지원 □ 차량 인포테인먼트용 프로세서 '엑시노스 오토 V7' 출시 - 신경망처리장치(NPU), 카메라 센서의 불량화소 및 왜곡 보정 기술, 이미지 압축기술 등 최신 차량용 기술 적용 - 그래픽 장치는 디지털 계기판, 중앙 정보 디스플레이(CID, Center Information Display), 헤드업 디스플레이(HUD, Head Up Display) 등 독립된 4개 디스플레이 구동 및 최대 12개의 카메라 센서 지원 - 보안 프로세서 탑재해 차량 주요 정보를 안전하게 보관 및 물리적 복제 방지 기술 제공 □ 프리미엄 모바일 AP '엑시노스 2200' 출시 - AMD와 공동 개발한 차세대 GPU '엑스클립스(Xclipse)' 탑재, 게임 성능 및 전력 효율 극대화 - 업계 최초 모바일 기기에서 하드웨어 기반 '광선 추적(Ray Tracing)' 기술 구현 - ARM 최신 CPU 아키텍처 'Armv9' 기반 코어 적용하여 성능 및 보안 강화 - NPU 연산 성능 이전 대비 두 배 이상 향상, 머신러닝 성능 대폭 향상
		LSI (2019.01. ~2022.03.)	□ USB-PD 3.0 표준 및 고속 충전 프로토콜 지원 TA용 PDIC(MM101) - 수분 감지, 전압 보호 기능 탑재 □ 세계최초 PDIC + SE 통합 원 칩(SE8A) - Type-C 인증 지원으로 비인증 제품 차단 - 보안키・인증서 저장, 암호화・복호화 지원 등 고성능 보안기능 탑재 □ 업계 최초 무선이어폰용 통합 전력관리 칩(MUA01, MUB01) - 여러 칩을 하나로 통합해 소형 배터리에 최적화한 전력관리 칩 - 급성장하는 무선이어폰 시장을 위한 최적의 솔루션 제공 □ 8K TV 초고화질 영상 구현 최적화 및 전송 효율 향상 DDI(S6CT93P) - 이쿼라이져 S/W화로 신호 품질 및 개발 효율 향상 □ 모바일 최고 수준의 통합 보안 솔루션(S3K250AF) - 보안 국제 공통 평가 기준(CC)에서 'EAL 5+' 등급을 획득한 H/W 보안칩에 독자 개발 S/W 탑재 - 모바일 보안 솔루션으로 신규 모바일서비스 위한 기반 마련 □ 모바일기기 최고 등급인 EAL 6+ 획득, 자체 S/W 탑재 솔루션(S3FV9RR) - 다양한 프로세서에 독립적으로 적용해 여러 종류의 스마트기기에 활용 가능 - 하드웨어 보안 부팅, 기기 인증 등 다양한 기능 탑재해 보안 강화 □ DDR5 D램 모듈용 전략관리반도체(S2FPD01, S2FPD02, S2FPC01) - 차세대 기기 성능향상 및 전력절감에 핵심, 전력관리반도체 3종 - 전력 소비 및 발열 낮추는 자체 기술 적용, 동작 효율 최고 91%까지 향상 - 메모리용 전력관리반도체 라인업 지속확대 및 기술 리더십 강화 □ 차량 인포테인먼트 프로세서용 전력공급반도체(S2VPS01) - 차량용 시스템 안전기준 '에이실-B' 인증 획득, 기능 안전성 강화 - 발열 차단 기능, 자가 진단 기능 등 시스템 안정성 강화 □ 생체인증카드용 원칩 지문인증 IC 출시(S3B512C) - 하드웨어 보안칩(SE, Secure Element), 지문 센서, 보안 프로세서 기능을 하나의 IC로 통합 - 보안 국제 공통 평가 기준(CC, Common Criteria)의 EAL6+ 등급 획득, 글로벌 온라인 카드 결제 기술표준(EMVCo) 인증 및 마스터카드의 생체 인식 평가 통과로 보안성 입증
	Foundry	3차원 적층 패키지 기술 'X-Cube'	□ 3차원 적층 기술 'X-Cube' 및 설계 인프라 개발 - 별도의 웨이퍼로 제조된 이종 칩을 실리콘 관통 전극(TSV)으로 얇게 적층하여 하나의 반도체로 구현 ・전체 칩 면적을 줄이면서 고용량 메모리 솔루션 장착 가능해 설계 자유도 확보

		(2020.08.)	・시스템 반도체의 데이터 처리속도 및 전력 효율 획기적 향상 - 5, 7나노 공정에 'X-Cube' 적용을 위한 설계방법론 및 설계툴 검증 완료 ・EUV 7나노 공정 기반 로직・SRAM을 적층한 테스트칩 업계 최초 생산
		2.5D 반도체 패키지 기술 'I-Cube4' (2021.05.)	□ 로직칩과 4개의 HBM칩을 한 패키지에 구현하여 하나의 반도체처럼 동작 □ 실리콘 인터포저를 적용해 안정적 전력 공급 및 초미세 배선 구현 - 100마이크로미터 수준의 얇은 인터포저 변형을 막는 반도체 공정/제조 노하우 적용 □ 열 방출 성능 우수한 독자 구조로 생산기간 단축 및 수율 향상
		8나노 RF 공정 (2021.06.)	□ 서브 6GHz 및 밀리미터파까지 지원하는 5G 통신용 RF(Radio Frequency) 공정 - 멀티 채널, 멀티 안테나 지원 원칩 솔루션으로 소형, 저전력, 고품질 통신 제공 □ 독자 개발 RF 전용 반도체 소자 'RFeFET(RF extremeFET)' 적용해 RF 성능 향상 - 전자의 이동 통로인 채널 주변부에 물리적 자극을 가해 전자 이동 특성 극대화 □ 전 세대 14나노 RF 공정 대비 전력 효율 35% 증가, 아날로그 회로 면적 35% 감소 - RFeFET의 성능이 크게 향상되어 칩의 전체 트랜지스터 수 감소
		2.5D 반도체 패키지 기술 'H-Cube' (2021.11.)	□ 실리콘 인터포저 및 하이브리드 기판을 사용한 2.5D 솔루션 'Hybrid Cube' - 인터포저 위에 로직과 고대역폭 메모리(HBM)를 배치, 최대 6HBM 집적 구현 - 하이브리드 기판은 상단의 고사양 메인 기판이 로직/메모리 칩을 연결하고, 대면적 구현이 용이한 하단의 보조 기판이 시스템 보드 연결을 전담하는 이중 구조 - 두 기판을 전기적으로 연결하는 솔더볼(Solder ball) 간격을 35% 좁혀 기판 크기 감소 - 칩 분석기술 적용해 안정적으로 전원을 공급하고 신호의 왜곡 및 손실을 축소 - 고성능/대면적이 요구되는 데이터센터, AI, 네트워크 등 분야 반도체에 최적화
		세계 최초 GAA 기술 적용 3나노 공정 (2022.06.)	□ 세계 최초 Gate-All-Around(GAA) 트랜지스터 기술 적용한 3나노 공정 양산 - 나노시트 활용한 독자적 GAA 기술 'MBCFET' 적용해 전력효율 및 성능 극대화 - 3나노 1세대 공정은 5나노 대비 전력 45%↓, 성능 23%↑, 면적 16%↓ □ GAA는 핀펫의 기술적 한계를 극복하여 공정 미세화 지속을 가능케 하는 기술 - 채널의 모든 면을 게이트가 감싸 전류제어 특성 향상, 동작전압 및 전력소모 감소 - 채널을 수직 적층한 구조로 단위 면적당 채널폭 및 전류량이 증가하며 성능 향상 - 채널 폭을 조절할 수 있어 설계 자유도 향상 □ 에코시스템 파트너들과 검증된 3나노 설계 인프라 및 서비스 제공 중 □ 고성능・저전력HPC용 시스템 반도체, 모바일SOC 등에 적용 확대 계획
SDC	DP	갤럭시 S10용 홀 디스플레이 OLED (2019.03.)	□ 세계 최초 Flexible Hole in Display 상품화로 화면공간 극대화 - S10 6.1" 3K QHD+(3,040 ×1,440) Hole 1개, S10+ 6.4" Hole 2개 □ 블루라이트의 획기적인 감소로 눈이 편안한 디스플레이 제공 - S9 대비 블루라이트 42% 감소(TUV 라인란드 아이컴포트 인증)
		NPC용 15.6" UHD OLED (2019.05.)	□ 세계 최초 NPC용 4K OLED 디스플레이 개발 - 15.6" UHD(3,840 x 2,160), 16:9 - Blue Light 저감, 빠른 응답속도, 넓은 시야각으로 선명한 화질 제공
		스마트폰용 4K 고해상도 OLED (2019.06.)	□ 세계 최초 4K 모바일 OLED 디스플레이 개발 - 6.5" UHD(1,644 ×3,840), 643ppi,16M Color - 21 : 9 화면 비율로 영화의 원본 비율 그대로 감상 가능
		Gaming 모니터용 Curved LCD (2019.06.)	□ 세계 최초 240Hz Curved LCD 디스플레이 개발 - 27" FHD(1920 ×1080), 16:9 - 240Hz 고속주사율과 G-sync 지원으로 부드럽고 끊김없는 게임환경 제공 - 곡률 1500R, 광시야각 기술로 몰입감 극대화
		갤럭시 폴드용 폴더블 OLED (2019.09.)	□ 세계 최초 폴더블 디스플레이 개발로 디스플레이 혁신 - In-Foldable AM OLED (곡률반경 1.5R) - 7.3" QXGA+(1,536 ×2,152), 4:3 - 복합 폴리머 소재 개발로 기존 디스플레이 대비 약 50% 두께 감소

		갤럭시 Z 플립용 폴더블 OLED (2020.02.)	□ 세계 최초 Glass type Window 폴더블 디스플레이 양산 - 6.7" Full HD+(1,080 x 2,640) - UTG(Ultra Thin Glass)적용 내구성 향상 및 폴더블 최초 카메라 홀 적용
		갤럭시 S20용 WQ+ 고속구동 OLED (2020.03.)	□ 세계 최초 WQ+ 해상도 120Hz 고속구동으로 Touch 성능 극대화 - S20 6.23"/6.67"/6.87" QHD+(3,200 ×1,440) - 유해 Blue 6.5% 이하로 Eye Care Display 인증(국제 인증기관, SGS)
		갤럭시 Z 폴드2용 폴더블 OLED (2020.09.)	□ 세계 최초 곡률(1.4R) 폴더블 디스플레이 양산 - 7.6"(2,208 ×1,768) In - Foldable - 응력최소화 구조설계로 곡률반경 1.4R 달성 - 어댑티브 프리퀀시(화면에 맞춘 주사율 조정, 10~120Hz구동)로 소비전력 개선
		갤럭시 S21용 저소비전력 OLED (2021.01.)	□ 저소비전력, 고휘도 혁신 OLED 디스플레이 양산 - S21 시리즈: 6.24"・6.67"・6.81" QHD+(3,200×1,440) - 신규 유기재료 적용으로 발광효율 개선: 전작 대비 소비전력 16% 개선 - 휘도・명암비 향상으로 우수한 야외시인성 확보 (Max/HBM 420/800 →500/1100nit, Peak 1,785nit) → Sunlight Visibility 인증(UL, 글로벌 안정인증회사)
		갤럭시Z 폴드3용 폴더블 OLED개발 (2021.08.)	□ 다양한 신기술의 폴더블 최초 적용 - 7.6" QXGA+7.55" (2,208×1,768) - 언더 패널 카메라(Under Panel Camera) 기술로 화면 사각지대 제거 - 에코스퀘어(Eco2) 기술로 전작 대비 배터리 소모 절감
		55/65" QD-Display (2022.01.)	□ 세계 최초 TV향 QD-Display (55" UHD, 65" UHD) - BT2020 90% 업계 최고의 넓고 선명한 색 표현 - 전방위 균일하게 빛을 발하는 QD 특성으로 어느 각도에서도 최고의 휘도와 색감 구현 - 뛰어난 HDR 성능, 깊고 디테일한 Black 표현
		34" QD-Display (2022.03.)	□ 세계 최초 모니터향 QD-Display (34" QHD) - 175Hz, 0.1ms, 1800r, HDR True Black, G-Sync 지원으로 최고의 게이밍 경험 제공 - 뛰어난 색, 시야각, 명암비 특성 및 유해 블루라이트를 최소화
		갤럭시Z 폴드4용 폴더블 OLED개발 (2022.08.)	□ 전작비 추가적인 개선 진행 - 카메라 성능을 유지하면서 Under Panel Camera 영역 시인성 크게 개선, 대화면 경험 강조 - 투과율이 개선된 에코스퀘어 플러스(Eco2 OLED Plus)로 에너지 효율 증가 - FRP(Fiber Reinforced Plastics)-Digitizer 일체형을 통한 원가 및 무게 저감

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

2. 전문가와의 이해관계